

C 部—化學；冶金

本部內容

(參見及附註省略)

次部：化學

C01	無機化學.....	C-4
C01B	非金屬元素；其化合物.....	C-4
C01C	氨；氰；其化合物.....	C-14
C01D	鹼金屬，即鋰、鈉、鉀、銣、鉍、或銩之化合物.....	C-15
C01F	金屬鈹、鎂、鋁、鈣、鋇、鋇、鐳、釷之化合物，或稀土金屬之化合物.....	C-17
C01G	含有不包括C01D或C01F次類之金屬之化合物.....	C-21
C02	水、廢水、污水或污泥之處理.....	C-27
C02F	水、廢水、污水或污泥之處理.....	C-27
C03	玻璃；礦棉或渣棉.....	C-31
C03B	玻璃、礦棉或渣棉之製造或成型；玻璃、礦棉或渣棉之製造或成型輔助工藝.....	C-31
C03C	玻璃、釉或搪瓷釉之化學成分；玻璃之表面處理；由玻璃、礦物或礦渣製成的纖維或細絲之表面處理；玻璃與玻璃或與其他材料之接合.....	C-38
C04	水泥；混凝土；人造石；陶瓷；耐火材料.....	C-44
C04B	石灰；氧化鎂；礦渣；水泥；其組合物，例如砂漿、混凝土或類似之建築材料；人造石；陶瓷；耐火材料；天然石之處理.....	C-44
C05	肥料；肥料製造.....	C-55
C05B	磷肥.....	C-55
C05C	氮肥.....	C-56
C05D	不包括C05B、C次類之無機肥料；產生二氧化碳之肥料.....	C-56
C05F	不包括C05B、C次類內之有機肥料、如用垃圾或廢渣製成的肥料.....	C-57
C05G	分屬於C05主類下各次類內肥料之混合物；由一種或多種肥料與無特殊肥效之添加劑所組成的混合物；以形狀為特徵之肥料.....	C-58
C06	炸藥；火柴.....	C-60
C06B	炸藥或熱劑之組合物；其製造；用單種物質作炸藥.....	C-60
C06C	起爆或點火裝置；引信；化學點火具；點火劑.....	C-63
C06D	煙霧發生裝置；毒氣攻擊劑；爆炸或推進用氣體之產生.....	C-63
C06F	火柴；火柴之製造.....	C-64

C07	有機化學	C-65
C07B	有機化學之一般方法；及所用的裝置	C-66
C07C	無環或碳環化合物.....	C-67
C07D	雜環化合物	C-132
C07F	含除碳、氫、鹵素、氧、氮、硫、硒或碲以外的其它元素之無環、 碳環或雜環化合物.....	C-178
C07H	糖類；其衍生物；核苷；核苷酸；核酸	C-182
C07J	類固醇化合物	C-187
C07K	肽類.....	C-190
C08	有機高分子化合物；其製備或化學加工；以其為基料之組合物.C-198	
C08B	多糖類；其衍生物.....	C-198
C08C	橡膠之處理或化學改性.....	C-201
C08F	僅用碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物.....	C-202
C08G	用碳—碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物	C-221
C08H	天然高分子化合物之衍生物	C-232
C08J	加工；一般的混合方法；不包含於C08B、C、F、G或H次類內之 後處理.....	C-232
C08K	使用無機物或非高分子有機物做為配料	C-234
C08L	高分子化合物之組合物.....	C-238
C09	染料；塗料；拋光劑；天然樹脂；黏合劑；其他類目不包括的組 合物；其他類目不包括的各種材料之應用	C-247
C09B	有機染料或用於製造染料之有關化合物；媒染劑；色澱.....	C-247
C09C	纖維狀填料以外的無機材料之處理以增強其著色或填充性能；碳 黑之製備.....	C-259
C09D	塗料組合物；例如色漆、清漆或天然漆；補土；化學塗料或油墨 之去除劑；油墨；修正液；木材著色劑；用於著色或印刷之漿料 或固體；該等材料之使用	C-259
C09F	天然樹脂；蟲膠清漆；乾性油；催乾劑；松節油	C-271
C09G	拋光組合物；滑雪覆蠟.....	C-271
C09H	動物膠或明膠之製備.....	C-271
C09J	黏合劑；一般非機械方面黏合方法；其它類目不包括的黏合方法； 用作黏合劑之材料.....	C-272
C09K	其他類目不包括的各種應用材料；其他類目不包括的材料之各種 應用.....	C-281
C10	石油、煤氣及煉焦工業；含一氧化碳之工業氣體；燃料；潤滑劑； 泥煤	C-287
C10B	含碳物料之乾餾生產煤氣、焦炭、焦油或類似物	C-287
C10C	焦油，焦油瀝青，石油瀝青，天然瀝青之加工；焦木酸.....	C-290
C10F	泥煤之乾燥或加工.....	C-290
C10G	烴油裂解；液態烴混合物之製備，例如，利用破壞性氫化反應， 低聚反應，聚合反應.....	C-291

C10H	乙炔之濕法生產.....	C-298
C10J	由固態含碳物料與氧氣或蒸汽行部份氧化反應以製造含一氧化碳及氫氣之氣體；混合碳化物之空氣或其他氣體.....	C-299
C10K	含一氧化碳可燃氣體化學組合物之淨化及改良.....	C-301
C10L	其他類目不包括之燃料；天然氣；用C10G或C10K次類不包括的方法而得的合成天然氣；液化石油氣；在燃料或火焰中使用添加劑；引火物.....	C-301
C10M	潤滑組合物；於潤滑組合物內化學物質之單獨使用或用作潤滑組成分.....	C-305
C10N	與次類C10M聯合使用之索引碼.....	C-317
C11	動物或植物油、脂、脂肪物質或蠟；由此製取的脂肪酸；清潔劑；蠟燭.....	C-319
C11B	生產，例如由原料中壓榨或由廢料內萃取、精製或保存脂肪、脂肪物質，例如羊毛脂、油脂或蠟；香精油；香料.....	C-319
C11C	由脂、油或蠟內獲得的脂肪酸；蠟燭；脂、油或脂肪酸經化學修飾而獲得的脂、油或脂肪酸.....	C-320
C11D	清潔劑組合物；用單一物質作為清潔劑；皂或製皂；樹脂皂；甘油之回收.....	C-320
C12	生物化學；啤酒；烈性酒；葡萄酒；醋；微生物學；酶學；突變或遺傳工程.....	C-325
C12C	啤酒；用發酵製備啤酒；用於製造啤酒之麥芽之製備；用於製造啤酒之啤酒花之製備.....	C-325
C12F	發酵溶液副產品之回收；變性酒精；其製備.....	C-326
C12G	葡萄酒；其製備；含酒精飲料；C12C或C12H次類不包括的含酒精飲料之製備.....	C-327
C12H	酒精飲料之低溫殺菌，除菌，保存，純化，澄清，陳釀或由其去除酒精.....	C-328
C12J	醋；其製備或純化.....	C-329
C12L	塗瀝青或脫瀝青機器；酒窖用具.....	C-329
C12M	酶學或微生物學裝置.....	C-329
C12N	微生物或酶；其組合物；繁殖、保存或維持微生物；變異或遺傳工程；培養基.....	C-330
C12P	藉由發酵或使用酶催化反應以合成所欲之化合物、組合物或從外消旋混合物中分離出光學異構物.....	C-337
C12Q	包含酶或微生物之測定或檢驗方法；其所用之組合物或試紙；此種組合物之製備方法；於微生物學方法或酶學方法內之條件反應控制.....	C-341
C12R	涉及微生物與次類C12C至C12Q聯合使用之索引碼.....	C-343
C13	糖工業.....	C-346
C13B	蔗糖之生產；及其專門適用的設備.....	C-346
C13K	從天然來源或由天然存在的雙醣、寡醣或多醣水解而得之醣類...	C-347

C14	小原皮；大原皮；毛皮或皮革	C-348
C14B	小原皮；大原皮及皮革之一般機械處理或加工；毛皮剪切機械； 剖割腸之機械	C-348
C14C	以化學物、酶或微生物對大原皮，小原皮或皮革進行處理，如鞣 製、浸漬或整飾；所用的設備；鞣製組合物	C-349
C21	鐵之冶金	C-351
C21B	鐵或鋼之冶金	C-351
C21C	生鐵之加工處理，例如精煉，熟鐵及鋼之冶煉；熔融態下鐵類合 金之處理	C-352
C21D	改變含鐵金屬之物理結構；含鐵或非鐵金屬或合金之熱處理用之 一般設備；使金屬具有韌性，例如：利用脫碳或回火	C-354
C22	冶金；鐵或非鐵合金；鐵或非鐵合金之處理	C-357
C22B	金屬之生產或精煉；原材料之預處理	C-357
C22C	合金	C-360
C22F	改變非鐵金屬或非鐵合金之物理結構	C-365
C23	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆；表面化學處理； 金屬材料之擴散處理；真空蒸發法、濺射法、離子注入法或化學 氣相沈積法之一般鍍覆；金屬材料腐蝕或積垢之一般抑制	C-366
C23C	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆；表面擴散法，化 學轉化或置換法之金屬材料表面處理；真空蒸發法、濺射法、離 子注入法或化學氣相沈積法之一般鍍覆	C-366
C23D	金屬之搪瓷或塗玻璃層	C-373
C23F	非機械方法去除表面上之金屬材料；金屬材料之緩蝕；一般防積 垢	C-373
C23G	電解法除外的化學法金屬材料清洗及除油	C-375
C25	電解或電泳工藝；其所用的設備	C-377
C25B	生產化合物或非金屬之電解工藝或電泳工藝；其所用的設備	C-377
C25C	電解法生產、回收或精煉金屬之工藝；其所用的設備	C-380
C25D	覆層之電解或電泳生產之工藝方法；電鑄	C-382
C25F	電解法除去物體上材料之方法；其所用的設備	C-384
C30	晶體生長	C-386
C30B	晶體生長；共晶材料之定向凝固或共析材料之定向分層；材料之 區熔精煉；具有一定結構的均勻多晶材料之製備；單晶或具有一 定結構之均勻多晶材料；單晶或具有一定結構之均勻多晶材料之 後處理；其所用的裝置	C-386
C40	組合技術	C-392
C40B	組合化學；化合物庫，如化學庫	C-392
C99	本部其他類目中不包括的技術主題	C-395
C99Z	本部其他類目中不包括的技術主題	C-395

C 部—化學；冶金

附註[2009.01]

(1) C 部中，各化學元素之定義如下：

鹼金屬： Li、Na、K、Rb、Cs、Fr

鹼土金屬： Ca、Sr、Ba、Ra

鑷系元素： 原子序為 57 至 71 之元素

稀土金屬： Sc、Y、鑷系元素

鈷系元素： 原子序為 89 至 103 之元素

難熔金屬： Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W

鹵素： F、Cl、Br、I、At

惰性氣體： He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn

鉑族金屬： Os、Ir、Pt、Ru、Rh、Pd

貴金屬： Ag、Au、鉑族金屬

輕金屬： 鹼金屬、鹼土金屬、Be、Al、Mg

重金屬： 除輕金屬以外之金屬

鐵族金屬： Fe、Co、Ni

非金屬： H、B、C、Si、N、P、O、S、Se、Te、惰性氣體、鹵素

金屬： 非金屬以外之元素

過渡元素： 原子序為 21 至 30、39 至 48、57 至 80、89 以上之元素

(2) C 部包括：

- 純化學，包括無機化合物、有機化合物、高分子化合物，及其製備方法；
 - 應用化學，包括含有上列化合物之組合物，例如：玻璃、陶瓷、肥料、塑膠組合物、塗料、石油工業產品。尚包括因具有特殊性能而適於某些用途之某些組合物，如炸藥、染料、黏合劑、潤滑劑及洗滌劑；
 - 某些邊緣工業，如焦炭製造及固態燃料或氣態燃料製造，油、脂及蠟之生產及精製，發酵工業（如釀造及製酒），製糖工業；
 - 某些操作或處理，其或者屬純機械者，如皮革及原皮之機械處理，或者係部份機械者，如水處理，或一般防腐蝕；
 - 冶金、含鐵合金或非鐵合金。
- (3) 在國際專利分類表中所有的部，若無相反指示，化學元素週期表指的是下列表中描述具有 18 族元素之週期表。

週期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	[-----VIII B-----]	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA		
1	H 氫																	He 氦
2	Li 鋰	Be 鈹											B 硼	C 碳	N 氮	O 氧	F 氟	Ne 氖
3	Na 鈉	Mg 鎂											Al 鋁	Si 矽	P 磷	S 硫	Cl 氯	Ar 氬
4	K 鉀	Ca 鈣	Sc 釷	Ti 鈦	V 釩	Cr 鉻	Mn 錳	Fe 鐵	Co 鈷	Ni 鎳	Cu 銅	Zn 鋅	Ga 鎵	Ge 鍮	As 砷	Se 硒	Br 溴	Kr 氪
5	Rb 鉀	Sr 銻	Y 釷	Zr 鈳	Nb 鈮	Mo 鉬	Tc 錳	Ru 鈷	Rh 銠	Pd 鈀	Ag 銀	Cd 鎘	In 銦	Sn 錫	Sb 銻	Te 碲	I 碘	Xe 氙
6	Cs 銫	Ba 鋇	Lanthanides 鐳系元素	Hf 鈳	Ta 鉭	W 鎢	Re 錒	Os 鋳	Ir 銥	Pt 鉑	Au 金	Hg 汞	Tl 鉈	Pb 鉛	Bi 鉍	Po 鉷	At 砹	Rn 氡
7	Fr 銣	Ra 鐳	Actinides 錒系元素	Rf 鈳	Db 鈳	Sg 鎢	Bh 鈳	Hs 鈳	Mt 鈳	Ds 鈳	Rg 鈳			Fl 鈳		Lv 鈳		

Lanthanides
鐳系元素
Actinides
錒系元素

La 鐳	Ce 鈾	Pr 鐳	Nd 鈳	Pm 鈳	Sm 鈳	Eu 鈳	Gd 鈳	Tb 鈳	Dy 鈳	Ho 鈳	Er 鈳	Tm 鈳	Yb 鈳	Lu 鐳
Ac 錒	Th 釷	Pa 鐳	U 鈾	Np 鈳	Pu 鈳	Am 鈳	Cm 鈳	Bk 鈳	Cf 鈳	Es 鈳	Fm 鈳	Md 鈳	No 鈳	Lr 鐳

- (4) (a) 若操作、處理、產品或製品既具有化學部分或方面且又具有非化學部分或方面，一般規定將化學部分或方面列入 C 部。
- (b) 於某些上述之情況中，化學部分或方面本身具有非化學部分或方面，甚至係純機械者，但由於後者為操作或處理所必不可缺，抑或構成操作或處理之重

要組成部分，故事實上更符合邏輯者為，不需分開連貫整體之不同部分或方面。應用化學及附註(2) (c)(d)及(e)中所提及之工業、操作及處理即屬此情況。例如，製造玻璃專用之熔爐列入 C03 主類而不列入 F27 主類。

(c) 然而，亦有少許例外情況，其中機械（或非化學）方面本身具有化學方面，例如：

- A61K 次類內之某些萃取工藝；
- A61L 次類內之空氣化學淨化；
- A62D 次類內之化學滅火方法；
- B01 主類內之化學工藝及裝置；
- B27K 次類內之木材浸漬；
- G01N 次類內之化學分析方法或化學檢驗方法；
- G03 主類內之照相材料及工藝及一般者，D 部內之紡織品化學處理及纖維素或紙張生產。

(d) 尚有其他情況，其中化學方面列入 C 部而應用化學方面則列入其他部，例如 A、B、F 部，如物質或組合物用於

- 列入 A01N 次類之植物處理或動物處理；
- 列入 A23 主類之食品；
- 列入 F42 主類之彈藥或爆破器材。

(e) 當化學方面與機械方面密切結合而無法截然地簡單區分時，或當某些機械工藝為化學處理之自然延續或邏輯延續時，則除化學方面外，C 部尚可包括部分之機械方面，例如，列入 C04 主類之人造石後處理。於上述後一種情況下，通常標上附註或參見，使位置明確，有時此種區分並非客觀。

次 部：化 學

C01 無機化學

附註

- (1) 在 C01B 至 C01G 各次類中，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，化合物請分入最後適當位置。例如，在 C01G 次類中，過錳酸鉀分入過錳酸鹽化合物中。[3]
- (2) 殺生、害蟲驅避、害蟲引誘或植物生長調節活性的化合物或抑制劑進一部分入 A01P。[8]

C01B 非金屬元素；其化合物(除二氧化碳之外的無機元素或無機化合物之發酵或使用酶之製備見 C12P 3/00；電解或電泳生產非金屬元素或無機化合物見 C25B)

附註[3,6,7,2006.01]

- (1) 在此次類中，科學與專利文獻中常見之商標名已被使用，以精確定義其範圍。
- (2) 注意 C 部標題下各化學元素之定義。
- (3) 注意 C01 主類後的附註(1)，該附註定義本主類，即在 C01B 至 C01G 各次類中，採用末位規則。
- (4) 化合物之治療活性，被進一步分入 A61P 次類內。

次類索引

氫；氫同位素；水；	碳，其化合物.....32/00
氫化物..... 3/00；4/00；5/00；6/00	矽，其化合物.....33/00
合成氣..... 3/00	硒或碲；碲..... 19/00；35/00
鹵素或其化合物..... 7/00，9/00，11/00	惰性氣體.....23/00
氧，一般氧化物；	具有分子篩性能但不具有
過氧化合物.....13/00；15/00	鹼一交換性能的化合物.....37/00
硫，其化合物..... 17/00	具有分子篩和鹼一交換性能的
氮，其化合物..... 21/00	化合物.....39/00
磷，其化合物..... 25/00	

氫；氫化物；水；由烴類製合成氣

- 3/00 氫；含氫混合氣；由含氫混合氣中分離氫；氫之淨化（用固體碳質物料生產水煤氣或合成氣見 C10J） [3]**
- 3/02 • 氫或含氫混合氣之生產 [3]
- 3/04 • • 用無機化合物，如氨之分解法 [3]
- 3/06 • • 用含正電性氫之無機化合物，如水、酸、鹼、氨與無機還原劑之反應（用電解水法見 C25B 1/04） [3]
- 3/08 • • • 與金屬 [3]
- 3/10 • • • • 用水蒸汽與金屬之反應 [3]
- 3/12 • • • 用水蒸汽與一氧化碳之反應 [3]
- 3/14 • • • • 用熱及蒸汽處理 [3]
- 3/16 • • • • 使用催化劑 [3]
- 3/18 • • • • 使用移動固體顆粒 [3]
- 3/20 • • • 用金屬氫氧化物與一氧化碳之反應 [3]
- 3/22 • • 用氣態或液態有機化合物之分解（液態碳質物料之焦化見 C10B 55/00） [3]
- 3/24 • • • 烴類者 [3]
- 3/26 • • • • 使用催化劑 [3]
- 3/28 • • • • 使用移動固體顆粒 [3]
- 3/30 • • • • • 使用流化床技術 [3]
- 3/32 • • 用氣態或液態之有機化合物與氯化劑，如水、二氧化碳、空氣之反應 [3]
- 3/34 • • • 用烴類與氯化劑之反應 [3]
- 3/36 • • • • 使用氧或含氧混合物作氯化劑 [3]
- 3/38 • • • • 使用催化劑 [3]
- 3/40 • • • • • 以催化劑為特徵者 [3]
- 3/42 • • • • • 使用移動固體顆粒 [3]
- 3/44 • • • • • 使用流化床技術 [3]
- 3/46 • • • • 使用間斷預熱之非移動固體物料，如鼓風及轉動 [3]
- 3/48 • • • • 隨後有水蒸汽與一氧化碳

反應者 [3]

- 3/50 • 氫或含氫氣體由混合氣體中之分離，如淨化（3/14 優先） [3]
- 3/52 • • 用與液體接觸法；所用液體之再生 [3]
- 3/54 • • • 包含催化反應 [3]
- 3/56 • • 用固體接觸法；所用固體之再生 [3]
- 3/58 • • • 包含催化反應 [3]
- 4/00 氫同位素；用同位素交換法製備之無機化合物，如 $\text{NH}_3 + \text{D}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{D} + \text{HD}$ [1,2,2006.01]**
- 5/00 水**
- 5/02 • 重水；同氫同位素或其化合物之化學反應製備，如 $4\text{ND}_3 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO}_2 + 6\text{D}_2\text{O}$ ， $2\text{D}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{D}_2\text{O}$
- 6/00 金屬氫化物；甲硼烷或乙硼烷；其加成錯合物 [2]**
- 6/02 • 過渡元素之氫化物；其加成錯合物
- 6/04 • 鹼金屬、鹼土金屬、鉍或鎂之氫化物；其加成錯合物
- 6/06 • 鋁、鎂、銦、鉍、銻、錳、鉛、砷、銻、鉍或鉍之氫化物；甲硼烷；乙硼烷；其加成錯合物
- 6/10 • • 甲硼烷；乙硼烷；其加成錯合物 [2]
- 6/11 • • • 用硼或含硼及氧之無機化合物製備 [2]
- 6/13 • • • 甲硼烷或乙硼烷之加成錯合物，如與膦、肼或者肼 [2]
- 6/15 • • • • 金屬氫硼化物；其加成錯合物 [2]
- 6/17 • • • • • 用硼或含硼及氧之無機化合物製備 [2]
- 6/19 • • • • • 用硼之其他化合物製備 [2]
- 6/21 • • • • • 鹼金屬、鹼土金屬、鎂或鉍之氫硼化合物之製備，其加成錯合物，如 LiBH_4 •

- 6/23 $2\text{N}_2\text{H}_4$, NaB_2H_7 [2]
 • • • • • 其他金屬氫硼化物之
 製備，如硼氫化鋁；
 其加成錯合物如 Li
 $[\text{Al}(\text{BH}_4)_3\text{H}]$ [2]
 6/24 • 含至少兩種金屬之氫化物，如
 $\text{Li}(\text{AlH}_4)$ ；其加成錯合物（6/13
 至 6/23 優先）[2]
 6/26 • • 用最高價之金屬或用其氧化物
 或其含氧酸鹽製備
 6/34 • 純化；穩定

鹵素；其化合物

7/00 鹵素；氫鹵酸

- 7/01 • 氯；氯化氫 [2]
 7/03 • • 用氯化物製備 [2,3]
 7/04 • • • 用氯化氫製備氯 [3]
 7/05 • • • 用氯化銨製備 [2,3]
 7/07 • • 純化 [2,3]
 7/075 • • • 液態氯者 [2,3]
 7/09 • 溴；溴化氫 [2]
 7/13 • 碘；碘化氫 [2]
 7/14 • • 碘 [2]
 7/16 • • • 用海藻製備 [2]
 7/19 • 氟；氟化氫 [2]
 7/20 • • 氟 [2]
 7/24 • 鹵間化合物

9/00 製備鹵化物之一般方法（個別特殊之鹵化物，見按與鹵素化合之元素分入 C01B 至 C01G 次類中各有關目；無機化合物之電解法製備見 C25B）

- 9/02 • 氯化物
 9/04 • 溴化物
 9/06 • 碘化物
 9/08 • 氟化物

11/00 鹵素之氧化物或含氧酸；其鹽類

- 11/02 • 氯之氧化物
 11/04 • 次氯酸
 11/06 • • 次氯酸鹽，如漂白粉
 11/08 • 亞氯酸

- 11/10 • • 亞氯酸鹽
 11/12 • 氯酸
 11/14 • • 氯酸鹽
 11/16 • 過氯酸
 11/18 • • 過氯酸鹽
 11/20 • 溴之氧化物
 11/22 • 碘之氧化物
 11/24 • 氟之氧化物

氧；一般氧化物或氫氧化物；過氧化物

13/00 氧；臭氧；一般氧化物或氫氧化物

- 13/02 • 氧之製備（用液化法見 F25J）
 13/08 • • 用空氣借助金屬氧化物，如氧化鋇，氧化錳
 13/10 • 臭氧之製備
 13/11 • • 用放電法 [2]
 13/14 • 製備一般氧化物或氫氧化物之方法，（個別特殊氧化物或氫氧化物見按與氧或經基化合之元素分入之 C01B 至 C01G 或 C25B 中有關目）
 13/16 • • 純化 [3]
 13/18 • • 用化合物，如鹽或氫氧化物之熱分解 [3]
 13/20 • • 用氣態元素之氧化；氣態化合物之氧化或水解 [3]
 13/22 • • • 鹵化物或鹵氧化物者 [3]
 13/24 • • • • 於熱燃燒氣存在下 [3]
 13/26 • • • • 於流化床存在下 [3]
 13/28 • • • • 使用電漿或放電 [3]
 13/30 • • • • 含懸浮物氧化物之去除及冷卻 [3]
 13/32 • • 用液態者或固態之元素或化合物之氧化或水解法 [3]
 13/34 • • 用噴霧或霧化溶液之氧化或水解法 [3]
 13/36 • • 用溶液中之沈澱反應法 [3]

15/00 過氧化物；過氧水合物；過氧酸或其鹽；超氧化物；臭氧化物

- 15/01 • 過氧化氫 [3]
- 15/013 • • 分離，純化；濃縮 [3]
- 15/017 • • • 無水過氧化氫；含有過氧化氫之無水溶液或氣態混合物 [3]
- 15/022 • • 用有機化合物製備 [2]
- 15/023 • • • 用烷基蒽醌方法 [3]
- 15/024 • • • 用烴類 [3]
- 15/026 • • • 用醇類 [3]
- 15/027 • • 用水製備 [3]
- 15/029 • • 用氫及氧製備 [3]
- 15/03 • • 用無機過氧化物製備，如用過硫酸鹽 [3]
- 15/032 • • • 用金屬過氧化物 [3]
- 15/037 • • 用添加劑增強穩定性 [3]
- 15/04 • 金屬過氧化物或其過氧化水合物；超氧化物；臭氧化物 [3]
- 15/043 • • 鹼金屬、鹼土金屬或鎂者 [2,3]
- 15/047 • • 重金屬者 [2,3]
- 15/055 • 過氧化水合物（15/04 優先）；過氧酸或其鹽 [3]
- 15/06 • • 含硫 [3]
- 15/08 • • • 過硫酸鹽 [3]
- 15/10 • • 含碳 [3]
- 15/12 • • 含硼 [3]
- 15/14 • • 含矽 [3]
- 15/16 • • 含磷 [3]
- 17/00 硫；其化合物**
- 17/02 • 硫之製備；純化
- 17/027 • • 由含有元素硫之物料，如活性黃土中回收硫；純化[3]
- 17/033 • • • 利用液體提取劑 [3]
- 17/04 • • 用包括氣態硫化物之氣態含硫化合物
- 17/05 • • • 用濕法 [3]
- 17/06 • • 用非氣態硫化物或內有此種硫化物之物料，如礦石
- 17/10 • • 細碎硫，如昇華硫，硫華
- 17/12 • • 不溶性硫（ μ -硫）
- 17/16 • 硫化氫
- 17/18 • • 多硫化氫
- 17/20 • 製備一般硫化物或多硫化物之方法（硫化銨或多硫化銨見 C01C；除鹼金屬、鎂、鈣、鋇及鋇以外之金屬硫化物或多硫化物，見按金屬分入之 C01F 或 C01G 內有關各目）
- 17/22 • 鹼金屬之硫化物或多硫化物
- 17/24 • • 用還原法製備
- 17/26 • • • 用碳
- 17/28 • • • 用還原氣體
- 17/30 • • 用鈉汞齊或鉀汞齊與硫或硫化物製備
- 17/32 • • 鈉或鉀之氫硫化物
- 17/34 • • 鈉或鉀之多硫化物
- 17/36 • • 純化
- 17/38 • • 脫水
- 17/40 • • 製造成型產品，如顆粒
- 17/42 • 鎂、鈣、鋇或鋇之硫化物或多硫化物
- 17/43 • • 用氧化物或氫氧化物與硫或硫化氫
- 17/44 • • 用硫酸鹽還原法
- 17/45 • 含氧或不含氧之硫及鹵素之化合物
- 17/46 • 含硫、鹵素、氫及氧之化合物
- 17/48 • 二氧化硫；亞硫酸
- 17/50 • • 二氧化硫之製備
- 17/52 • • • 用硫化物焙燒法（礦石或廢料之初步處理見 C22B 1/00）[1,2006.01]
- 17/54 • • • 用元素硫燃燒法
- 17/56 • • • 分離；純化
- 17/58 • • • 由酸焦油及同類物中二氧化硫之回收
- 17/60 • • • 煤氣中二氧化硫之分離
- 17/62 • 一般亞硫酸鹽之製備方法(個別特殊之亞硫酸鹽，見按其正離子而分之 C01B 至 C01G 有關各目)
- 17/64 • 硫代硫酸鹽；連二亞硫酸鹽；連多硫酸鹽
- 17/66 • • 連二亞酸鹽
- 17/69 • 三氧化硫；硫酸 [3]
- 17/70 • • γ -形三氧化硫之穩定

- 17/74 • • 製備 [3]
- 17/76 • • • 用接觸法
- 17/765 • • • • 三氧化硫多級轉化 [3]
- 17/77 • • • • 流化床方法 [3]
- 17/775 • • • • 液相接觸方法或濕催化方法 [3]
- 17/78 • • • • 以所用催化劑為特徵者
- 17/79 • • • • • 含釩 [3]
- 17/80 • • • • 裝置
- 17/82 • • • 使用氧化氮法之硫酸者
- 17/84 • • • • 鉛室法
- 17/86 • • • • 塔式法
- 17/88 • • 硫酸之濃縮
- 17/90 • • 分離；純化
- 17/92 • • • 由酸焦油及同類物中回收
- 17/94 • • • 由硝化酸中回收
- 17/96 • 一般硫酸鹽之製備方法（個別特殊之硫酸鹽，見其按正離子而分 C01B 至 C01G 有關各目）
- 17/98 • 含硫及氧之其他化合物（過硫酸見 15/06；過硫酸鹽見 15/08）
- 19/00 碲；碲；其化合物**
- 19/02 • 元素碲或碲 [3]
- 19/04 • 二元化合物 [3]
- 21/00 氮；其化合物**
- 21/02 • 氮之製備（用氮之分解製備見 3/04）
- 21/04 • 氮之淨化或分離（用液化法見 F25J）
- 21/06 • 氮與金屬、與矽、或與硼的二元化合物
- 21/064 • • 與硼 [3]
- 21/068 • • 與矽 [3]
- 21/072 • • 與鋁 [3]
- 21/076 • • 與鈦或鈳 [3]
- 21/08 • 疊氮酸；疊氮化物；疊氮化鹵
- 21/082 • 含氮及非金屬之化合物（21/06，21/08 優先） [3]
- 21/083 • • 含有一個或多個鹵素原子 [3]
- 21/084 • • • 亦含有一個或多個氧原子，如亞硝鹽鹵化物 [3]
- 21/086 • • 含有一個或多個硫原子 [3]
- 21/087 • • 含有一個或多個氫原子 [3]
- 21/088 • • • 亦含有一個或多個鹵原子 [3]
- 21/09 • • • • 鹵化胺，如氯胺 [3]
- 21/092 • • • 亦含有一個或多個金屬原子 [3]
- 21/093 • • • 亦含有一個或多個硫原子 [3]
- 21/094 • • • • 含有酸之亞硝鹽者 [3]
- 21/096 • • • • 氨基磺酸；其鹽類 [3]
- 21/097 • • 含有磷原子 [3]
- 21/098 • • • 二氧磷基脒之二鹵化物；其聚合物 [3]
- 21/12 • • 氨基甲酸；其鹽類
- 21/14 • • 脛胺；其鹽類
- 21/16 • • 肼；其鹽類
- 21/20 • 氮之氧化物；氮之含氧酸；其鹽類
- 21/22 • • 一氧化二氮（ N_2O ）
- 21/24 • • 一氧化氮（ NO ）
- 21/26 • • • 用氮之催化氧化法製備
- 21/28 • • • • 裝置
- 21/30 • • • 用氮之氧化法製備
- 21/32 • • • • 裝置
- 21/34 • • 三氧化二氮（ N_2O_3 ）
- 21/36 • • 二氧化氮（ NO_2 , N_2O_4 ）（21/26，21/30 優先）
- 21/38 • • 硝酸
- 21/40 • • • 用氮之氧化物吸收法製備
- 21/42 • • • 用硝酸鹽製備
- 21/44 • • • 濃縮
- 21/46 • • • 純化；分離
- 21/48 • • 一般硝酸鹽之製備方法（個別特殊之硝酸鹽，見按其正離子分之 C01B 至 C01G 有關各目）
- 21/50 • • 亞硝酸；其鹽類
- 23/00 惰性氣體；其化合物；（液化見 F25J）**
- 25/00 磷；其化合物（21/00，23/00 優先；過磷酸鹽見 15/16） [3]**
- 25/01 • 處理磷酸鹽礦或其他含磷酸鹽物料製備磷或磷之化合物 [2]

- 25/02 • 磷之製備 — 溶劑萃取之製備見 25/46)
- 25/023 • • 紅磷者 [2]
- 25/027 • • 黃磷者 [2]
- 25/04 • 磷之純化
- 25/043 • • 紅磷者 [2]
- 25/047 • • 黃磷者 [2]
- 25/06 • 磷化氫
- 25/08 • 其他磷化物
- 25/10 • 磷之鹵化物或鹵氧化物 [2]
- 25/12 • 磷之氧化物
- 25/14 • 含硫、硒或碲之磷化合物
- 25/16 • 磷之含氧酸；其鹽類（過氧酸或其鹽見 15/00）
- 25/163 • • 亞磷酸；其鹽類 [2,2006.01]
- 25/165 • • 次磷酸；其鹽類 [2]
- 25/168 • • 焦亞磷酸；其鹽類 [2]
- 25/18 • • 磷酸
- 25/20 • • • 由元素磷或磷酐製備
- 25/22 • • • 用含磷酸鹽物料與酸反應製備，如濕法
- 25/222 • • • • 與硫酸，以硫酸為主要成分之酸之混合物或反應中形成其化合物混合物，如二氧化硫，水及氧之混合物 [3]
- 25/223 • • • • • 僅形成一種形式之硫酸鈣 [3]
- 25/225 • • • • • 二水合物法 [3]
- 25/226 • • • • • 半水合物法 [3]
- 25/228 • • • • • 形成一種形式之硫酸鈣然後轉變成另一種形式 [3]
- 25/229 • • • • • 半水合物—二水合物法 [3]
- 25/231 • • • • • 二水合物—半水合物法 [3]
- 25/232 • • • • • 用含磷酸鹽之物料與濃硫酸反應然後浸提所獲得之塊狀物以製備，如熔塊法 [3]
- 25/234 • • • 純化；穩定；濃縮；（伴隨製備之純化見 25/22；含溶劑
- 25/235 • • • • 澄清；穩定以防止溶解雜質之繼續沉澱 [3]
- 25/237 • • • • 雜質之選擇性消除 [3]
- 25/238 • • • • • 陽離子之雜質 [3]
- 25/24 • • 縮合磷酸
- 25/26 • • 磷酸鹽（過磷酸鹽見 15/16）
- 25/28 • • • 磷酸銨
- 25/30 • • • 鹼金屬磷酸鹽
- 25/32 • • • 鎂、鈣、鋇或鋇之磷酸鹽
- 25/34 • • • • 磷酸鎂
- 25/36 • • • 磷酸鋁
- 25/37 • • • 重金屬磷酸鹽 [2]
- 25/38 • • • 縮合磷酸鹽
- 25/39 • • • • 鹼金屬者 [3]
- 25/40 • • • • 多磷酸鹽 [2]
- 25/41 • • • • • 鹼金屬者 [3]
- 25/42 • • • • 焦磷酸鹽 [2]
- 25/44 • • • • 偏磷酸鹽 [2]
- 25/445 • • • • • 鹼金屬者 [3]
- 25/45 • • • 含兩種以上金屬或金屬及銨 [3]
- 25/455 • • • 含鹵素 [3]
- 25/46 • • 含溶劑—溶劑萃取之製備 [2]
- 31/00 (轉見 32/00，32/10 - 32/15，32/22)**
- 31/02 (轉見 32/05，32/15 - 32/198)
- 31/04 (轉見 32/182 - 32/23)
- 31/06 (轉見 32/25 - 32/28)
- 31/08 (轉見 32/30 - 32/33，32/354 - 32/378，32/39)
- 31/10 (轉見 32/336)
- 31/12 (轉見 32/342 - 32/348)
- 31/14 (轉見 32/384)
- 31/16 (轉見 B01J 39/24，B01J 41/18)
- 31/18 (轉見 32/40)
- 31/20 (轉見 32/50)
- 31/22 (轉見 32/55)
- 31/24 (轉見 32/60)
- 31/26 (轉見 32/70 - 32/77)
- 31/28 (轉見 32/80)

- 31/30 (轉見 32/90 - 32/935)
- 31/32 (轉見 32/942)
- 31/34 (轉見 32/949)
- 31/36 (轉見 32/956 - 32/991)
- 32/00 碳；其化合物** (21/00, 23/00 優先；過碳酸鹽見 15/10；碳黑見 C09C1/48) [2017.01]
- 32/05 • 碳的製備或淨化，不涵蓋 32/15，32/20，32/25，32/30 等目[2017.01]
- 32/10 • 碳氟化合物，例如[CF]_n 或[C₂F]_n (其石墨層間見 32/22) [2017.01]
- 32/15 • 奈米碳材料[2017.01]
- 32/152 • • 富勒烯[2017.01]
- 32/154 • • • 製備[2017.01]
- 32/156 • • • 後處理[2017.01]
- 32/158 • • 奈米碳管[2017.01]
- 32/159 • • • 單層[2017.01]
- 32/16 • • • 製備[2017.01]
- 32/162 • • • • 其特徵為催化劑[2017.01]
- 32/164 • • • • 涉及連續製程[2017.01]
- 32/166 • • • • 液相[2017.01]
- 32/168 • • • 後處理[2017.01]
- 32/17 • • • • 純化[2017.01]
- 32/172 • • • • 排序揀選[2017.01]
- 32/174 • • • • 衍生化；溶解；分散在溶劑[2017.01]
- 32/176 • • • • 切割[2017.01]
- 32/178 • • • • 開啟；充填[2017.01]
- 32/18 • • 奈米洋葱；奈米卷；奈米角；奈米錐；奈米牆[2017.01]
- 32/182 • • 石墨烯[2017.01]
- 32/184 • • • 製備[2017.01]
- 32/186 • • • • 利用化學氣相沉積法(CVD)[2017.01]
- 32/188 • • • • 利用晶膜生長[2017.01]
- 32/19 • • • • 利用剝離作用[2017.01]
- 32/192 • • • • • 從石墨氧化物開始[2017.01]
- 32/194 • • • 後處理[2017.01]
- 32/196 • • • • 純化[2017.01]
- 32/198 • • • 氧化石墨烯[2017.01]
- 32/20 • 石墨[2017.01]
- 32/205 • • 製備[2017.01]
- 32/21 • • 後處理[2017.01]
- 32/215 • • • 純化；回收或純化在製鐵中形成的石墨，例如：凝析石墨[2017.01]
- 32/22 • • • 插層[2017.01]
- 32/225 • • • • 擴張；剝離[2017.01]
- 32/23 • • • 氧化[2017.01]
- 32/25 • 鑽石[2017.01]
- 32/26 • • 製備(利用超高壓見 B01J3/06；晶體生長 C30B29/04) [2017.01]
- 32/28 • • 後處理，例如：純化、照射、分離或回收[2017.01]
- 32/30 • 活性碳[2017.01]
- 32/306 • • 具有分子篩性質[2017.01]
- 32/312 • • 製備[2017.01]
- 32/318 • • • 具起動物質特性[2017.01]
- 32/324 • • • • 從廢棄物，例如：輪胎或亞硫酸鹽廢漿液[2017.01]
- 32/33 • • • • 從煤或石油的蒸餾殘渣；來自石油酸污泥[2017.01]
- 32/336 • • • 其特徵在於氣體活化劑[2017.01]
- 32/342 • • • 其特徵在於非氣體活化劑[2017.01]
- 32/348 • • • • 金屬化合物[2017.01]
- 32/354 • • 後處理[2017.01]
- 32/36 • • • 再活化或再生[2017.01]
- 32/366 • • • • 物理的處理，例如：藉由照射、藉由使用電流通過含碳進料或藉由可回收再利用的惰性加熱體[2017.01]
- 32/372 • • • 塗層；嫁接；微膠囊化[2017.01]
- 32/378 • • • 純化[2017.01]
- 32/384 • • • 造粒[2017.01]
- 附註[2017.01]
- 在此目中，術語「造粒」也包括利用含碳前驅物本身及黏合劑，例如：瀝青，用以製備活性碳的方法
- 32/39 • • 製備及其設備裝置[2017.01]
- 32/40 • 一氧化碳[2017.01]
- 32/50 • 二氧化碳[2017.01]

- 32/55 • • 固化[2017.01]
- 32/60 • 碳酸鹽或碳酸氫鹽一般製備方法
(過碳酸鹽見 15/10; 特定碳酸鹽或碳酸氫鹽的陽離子見 C01B-C01G) [2017.01]
- 32/70 • 含碳和硫的化合物, 例如: 硫光氣[2017.01]
- 32/72 • • 二硫化碳[2017.01]
- 32/75 • • • 藉由硫或硫反應製備碳氫化合物(烴類) [2017.01]
- 32/77 • • 硫氧化碳 [2017.01]
- 32/80 • 光氣 [2017.01]
- 32/90 • 碳化物 [2017.01]
- 32/907 • • 氧化碳; 硫碳化物; 碳化物的混合物 [2017.01]
- 32/914 • • 單一元素的碳化物 [2017.01]
- 32/921 • • • 碳化鈦 [2017.01]
- 32/928 • • • 鋼系碳化物 [2017.01]
- 32/935 • • • 鹼性金屬的碳化物、鋇、鋇或鎂 [2017.01]
- 32/942 • • • 碳化鈣(電石) [2017.01]
- 32/949 • • • 碳化鎢或碳化鉬 [2017.01]
- 32/956 • • • 碳化矽 [2017.01]
- 32/963 • • • • 從含矽化合物來製備 [2017.01]
- 32/97 • • • • • 從 SiO 或 SiO₂ 製備 [2017.01]
- 32/977 • • • • • 從含矽的有機化合物來製備 [2017.01]
- 32/984 • • • • • 從矽元素來製備[2017.01]
- 32/991 • • • 碳化硼 [2017.01]
- 33/00 矽; 其化合物** (21/00、23/00 優先; 過矽酸鹽見 15/14; 碳化物見 32/956) [3]
- 33/02 • 矽(形成單晶或有一定結構之均勻多晶材料見 C30B) [5]
- 33/021 • • 製備(由氣相之化學塗層見 C23C 16/00) [5]
- 33/023 • • • 用二氧化矽或含二氧化矽之物料之還原方法 [5]
- 33/025 • • • • 使用碳或固體碳質物料, 例如, 碳熱還原工藝 [5]
- 33/027 • • • 使用除二氧化矽或含二氧化矽物料以外之氣態或汽化之矽化合物之分解或還原[5]
- 33/029 • • • • 使用甲矽烷之分解 [5]
- 33/03 • • • • 使用鹵化矽或鹵化矽烷之分解, 或其以氫作為唯一的還原劑之還原 [5]
- 33/031 • • • • • 使用四碘化矽之分解 [5]
- 33/033 • • • • 使用金屬或金屬合金作為唯一還原劑之鹵化矽或鹵代矽烷之還原 [5]
- 33/035 • • • • 於存在矽、碳或耐熔金屬, 如鉭或鎢之熱絲情況下, 或於存在熱矽棒情況下, 經由沈積矽獲得之矽棒, 如西門子方法(Siemens process), 用氣態或汽化之矽化合物之分解或還原[5]
- 33/037 • • 純化(用區域熔融見 C30B 13/00) [5]
- 33/039 • • • 使用將矽轉化為化合物、任意法純化化合物並再轉化為矽 [5]
- 33/04 • 矽之氫化物
- 33/06 • 金屬之矽化物
- 33/08 • 含鹵素之化合物
- 33/10 • • 含矽、氟及其他元素之化合物
- 33/107 • • 鹵化矽烷 [3]
- 33/113 • 氧化矽; 其水合物 [3]
- 33/12 • • 矽石; 其水合物, 如靛皮矽酸 [3]
- 33/14 • • • 膠體矽石, 如分散體, 凝膠, 溶膠 [3]
- 33/141 • • • • 水溶膠或水分散體之製備 [3]
- 33/142 • • • • • 用矽酸鹽之酸處理法[3]
- 33/143 • • • • • 矽酸鹽水溶性液者[3]
- 33/145 • • • • 水有機溶膠, 有機溶膠或有機介質中分散體之製備 [3]
- 33/146 • • • • 溶膠之後處理(由水溶膠製備水有機溶膠, 有機溶膠或有機介質中之分散體見 33/145) [3]

- 33/148 濃縮；乾燥；脫水；穩定；純化 [3]
- 33/149 塗覆 [3]
- 33/151 用逐步將一種溶膠添加到另一種溶膠內，即用一個“起始物種”使粒子“累積” [3]
- 33/152 水凝膠之製備 [3]
- 33/154 用矽酸鹽水溶液之酸處理法 [3]
- 33/155 水有機凝膠或有機凝膠之製備 [3]
- 33/157 凝膠之後處理 [3]
- 33/158 純化；乾燥；脫水 [3]
- 33/159 塗覆或疏水化 [3]
- 33/16 矽乾凝膠之製備 [3]
- 33/18 即非溶膠態又非凝膠態之細分散矽石之製備；其後處理（提高著色或填充性質之處理見 C09C） [3]
- 33/187 矽酸鹽之酸處理法 [3]
- 33/193 矽酸鹽水溶液者 [3]
- 33/20 矽酸鹽（過矽酸鹽見 15/14）
- 33/22 矽酸鎂
- 33/24 鹼土金屬之矽酸鹽
- 33/26 含鋁之矽酸鹽 [5]
- 33/32 鹼金屬矽酸鹽（33/26 優先） [3]
- 33/36 具有鹼交換性質但不具分子篩性質 [6]
- 33/38 層狀鹼交換矽酸鹽，如黏土，雲母或水矽矽鈉石或菱型矽鈉石型式之鹼金屬矽酸鹽 [6]
- 33/40 黏土 [6]
- 33/42 雲母 [6]
- 33/44 與有機化合物如銨，磷或硫化物行離子交換或置入有機化合物，如有機黏土材料，而得層狀鹼—交換矽酸鹽之產物 [6]
- 33/46 無定形矽酸鹽，如所謂“無定形沸石” [6]

- 35/00 硼；其化合物**(甲硼烷，乙硼烷，金屬硼氫化物或其加成錯合物見 6/00；過硼酸鹽見 15/12；含氮之二元化合物見 21/06；磷化物見 25/08；碳化物見 32/991) [2]
- 35/02 硼；硼化物 [2]
- 35/04 金屬硼化物 [2]
- 35/06 硼鹵化合物 [2]
- 35/08 含硼及氮、磷、氧、硫、硒或碲之化合物 [2]
- 35/10 含硼及氧之化合物（35/06 優先） [2]
- 35/12 硼酸鹽 [2]
- 35/14 含硼及氮、磷、硫、硒或碲之化合物 [2]
- 35/16 含兩個直接鍵合硼原子之化合物，如 $\text{Cl}_2\text{B}-\text{BCl}_2$ [2]
- 35/18 含有三個或更多硼原子之化合物，如 NaB_3H_8 ， $\text{MgB}_{10}\text{Br}_{10}$ （硼類見 35/14） [2]

物理或化學性質優於化學結構為特徵之化合物 [6]

- 37/00 具分子篩性質但不具鹼交換性質之化合物**
- 37/02 結晶矽石—多形體，如矽質岩 [6]
- 37/04 磷酸鋁鹽[APO 化合物]/[6,2006.01]
- 37/06 含其它元素（如金屬，硼）之磷酸鋁鹽 [6]
- 37/08 磷酸矽鋁鹽[SAPO 化合物]/[6,2006.01]
- 39/00 具分子篩與鹼交換性質之化合物，如結晶沸石；其製備；後處理，如離子交換或去鋁酸（利用黏合劑處理以改變其吸附性質，如成形見 B01J 20/10；修改催化性質之處理，如使沸石適於其做為觸媒用途之處理的結合，見 B01J 29/04；改良離子交換性質之處理，見 B01J 39/14） [6]**

附註

在本目中，下列名詞之意義如下：

— “沸石”意指：

(i) 具鹼—交換與分子篩性

質之結晶鋁矽酸鹽，有四
面體氧化物單元之三度
空間，微孔晶格結構；

(ii) 與上述類別同形之化合

物，其中結構中之鋁或矽
原子部份或全部被其它
元素取代，如鎂，鋅，磷
或硼。[6]

39/02 • 結晶矽酸鋁沸石；其同形化合物；
直接製備；由包含另一類型結晶
沸石之反應混合物或由預先形成
之反應物起始之製備；後處理
[6,2006.01]

39/04 • • 使用至少一種有機樣品直接試
劑，如一種離子第四級銨化合
物或胺化化合物 [6]

39/06 • • 以其它元素取代晶格結構中之
鋁或矽原子為特徵之同形沸
石之製備 [6]

39/08 • • • 鋁原子完全被取代 [6]

39/10 • • • 取代原子為磷原子 [6]

39/12 • • • 取代原子為硼原子 [6]

39/14 • • A 型 [6]

39/16 • • • 由鹼金屬鋁酸鹽與鹼金屬矽
酸鹽之水溶液，排除鋁或矽
之任何其它來源 [6]

39/18 • • • 由包含至少一種矽酸鋁或黏
土型之矽酸鋁鹽，如高嶺土
或偏高嶺土或其放熱變形體
或水鋁英石的反應混合物

39/20 • • 八面沸石型，如 X 或 Y 型 [6]

39/22 • • • X 型 [6]

39/24 • • • Y 型 [6]

39/26 • • 絲光沸石型 [6]

39/28 • • 鈣十字石或交沸石型，如 B 型
[6]

39/30 • • 毛沸石或菱鉀沸石型，如沸石
T [6]

39/32 • • L 型 [6]

39/34 • • ZSM-4 型 [6]

39/36 • • 硼碳烷矽酮型，如 ZSM-5，
ZSM-8 或 ZSM-11 型 [6]

39/38 • • • ZSM-5 型 [6]

39/40 • • • • 使用至少一種有機樣品直
接試劑 [6]

39/42 • • ZSM-12 型 [6]

39/44 • • 鐵鹼沸石型，如 ZSM-21，
ZSM-35 或 ZSM-38 [6]

39/46 • • 以 X-射線繞射及其特定組成
為特徵之其它型 [6]

39/48 • • • 使用至少一種有機樣品直接
試劑 [6]

39/50 • 無機鹼或鹽封閉晶格結構中之孔
洞之沸石，如方鈉石，鈣霞石，
黝方石，藍方石 [6]

39/52 • • 方鈉石 [6]

39/54 • 磷酸鹽，如 APO 或 SAPO 化合
物 [6]

C01C 氮；氮；其化合物（鹵素之含氧酸鹽見 C01B 11/00；過氧化物，過氧酸鹽見 C01B 15/00；硫代硫酸鹽，連二亞硫酸鹽，連多硫酸鹽見 C01B 17/64；含碲或碲之化合物見 C01B 19/00；疊氮化合物見 C01B 21/08；金屬氮化物見 C01B 21/092；亞硝酸鹽見 C01B 21/50；磷化物見 C01B 25/08；磷之含氧酸鹽見 C01B 25/16；含矽化合物 C01B 33/00；含硼化合物見 C01B 35/00；除二氧化碳之外的無機元素或無機化合物之發酵或使用酶之製備見 C12P 3/00；

電解或電泳生產非金屬元素或無機化合物見 C25B)

附註

- (1) 注意 C01 主類後的附註(1)，該附註定義本主類，即在 C01B 至 C01G 各次類中，採用末位規則。[8]
 (2) 化合物之治療活性，被進一步分入 A61P 次類內。[7]

1/00 氮；其化合物

附註

- 1/02 • 氮之製備或分離
 1/04 • • 合成法製氮（氮合成用氣體混合物之製備或淨化見 C01B 3/02）
 1/08 • • 用含氮有機物製氮
 1/10 • • 由粗氨水，如煤氣水中分離氮
 1/12 • • 由氣體及蒸汽中分離氮
 1/14 • • • 飽和器
 1/16 • 氮之鹵化物
 1/18 • 氮之硝酸鹽
 1/20 • 硫化物；多硫化物
 1/22 • 氮之亞硫酸鹽
 1/24 • 氮之硫酸鹽（1/14 優先）
 1/242 • • 用氮及硫酸或三氧化硫製備[2]
 1/244 • • 用氮鹽與硫酸鹽之複分解法製備 [2]
 1/245 • • 用含氮及硫之化合物製備 [2]
 1/246 • • • 用含硫之氮化合物 [2]
 1/247 • • • • 用游離氧氧化法 [2]
 1/248 • • 防止結塊或控制晶體之形狀或大小 [2]
 1/249 • • 晶體之脫酸 [2]
 1/26 • 氮之碳酸鹽或酸式碳酸鹽
 1/28 • 氮鹽之一般製備方法

- (1) 本目不包括陰離子中含有金屬之錯合酸之氮鹽（錯合氰化物除外），此類氮鹽列入按金屬而分的 C01D 至 C01G 次類中有關各目。
 (2) 氮及金屬作為正離子之多元酸鹽，將氮當作氮進行分類。
 (3) 錯合胺鹽，分入按金屬而分的 C01D 至 C01G 次類之有關各目。

3/00 氟；其化合物

- 3/02 • 氟化氫之製備
 3/04 • • 由氣體中分離
 3/06 • 氟化氫之穩定
 3/08 • 簡單的或錯合的金屬氟化物
 3/10 • • 簡單鹼金屬氟化物 [3]
 3/11 • • 錯合氟化物 [3]
 3/12 • • 簡單的或錯合的鐵氟化物 [2]
 3/14 • 氟酸；其鹽類
 3/16 • 氨基氟；其鹽類
 3/18 • • 氟氨化鈣
 3/20 • 硫氟酸；其鹽類

C01D 鹼金屬，即鋰、鈉、鉀、銣、銻、或銩之化合物（金屬氮化物見 C01B 6/00；鹵素之含氧酸鹽見 C01B 11/00；過氧化物，過氧酸鹽見 C01B 15/00；硫化物或多硫化物見 C01B 17/22；硫代硫酸鹽，連二亞硫酸鹽，連多硫酸鹽見 C01B 17/64；含碲或碲之化合物見 C01B 19/00；金屬與氮之二元化合物見 C01B 21/06；疊氮化物見 C01B 21/08；金屬氮化物見 C01B 21/092；亞硝酸鹽見 C01B 21/50；磷化物見 C01B 25/08；磷之含氧酸鹽見 C01B 25/16；碳化物見 C01B 32/90；含矽之化合物見 C01B 33/00；含硼之化合物見 C01B 35/00；氟化物見

C01C 3/08; 氰酸鹽見 C01C 3/14; 氰氨鹽見 C01C 3/16; 硫氰酸鹽見 C01C 3/20; 除二氧化碳之外的無機元素或無機化合物之發酵或使用酶之製備見 C12P 3/00; 自混合物中得到金屬化合物, 如: 鑛石, 即為得到游離金屬之冶金製程之中間物, 見 C22B; 電解或電泳生產非金屬元素或無機化合物見 C25B)

附註

- (1) 注意 C01 主類後的附註(1), 該附註定義本主類, 即在 C01B 至 C01G 各次類中, 採用末位規則。[8]
- (2) 化合物之治療活性, 被進一步分入 A61P 次類內。[7]

1/00	鈉、鉀或一般鹼金屬之氧化物或 氫氧化物 [2]	3/18	• • 用選擇性溶劑
		3/20	• • 用熔化法
1/02	• 氧化物	3/22	• 製備粒狀、片狀、或其他形狀之 產品
1/04	• 氫氧化物		
1/20	• • 用鹼金屬鹽與氧化物或氫氧化 物反應製備	3/24	• • 對結晶過程之影響
		3/26	• 防止晶體吸潮或結塊
1/22	• • • 用碳酸鹽或酸式碳酸鹽	5/00	鈉、鉀一般鹼金屬之硫酸鹽或亞 硫酸鹽 [2]
1/24	• • • 由或經由氟化物或矽氟化物		
1/26	• • 由或經由氰基化合物, 如氰化 物, 氰氨製備	5/02	• 由鹼金屬鹽及硫酸或酸式硫酸鹽 製備硫酸鹽, 酸式硫酸鹽之製備
1/28	• • 純化; 分離	5/04	• 借助於亞硫酸或亞硫酸鹽製備硫 酸鹽, 如哈貴夫士(Hargreaves)法
1/30	• • • 用結晶法	5/06	• 用複分解法製備硫酸鹽
1/32	• • • 用吸附或沉澱法	5/08	• • 相互作用或與硫酸銨作用
1/34	• • • 用選擇性溶劑	5/10	• • 用鎂、鈣、鋇或鋇之硫酸鹽
1/36	• • • 用氧化法	5/12	• 製備鈉或鉀與鎂之複式硫酸鹽[2]
1/38	• • • 用滲析法	5/14	• 亞硫酸鹽之製備 (5/04 優先)
1/40	• • • 用電解法	5/16	• 純化
1/42	• • 濃縮; 脫水	5/18	• 脫水
1/44	• • 製備粒狀、片狀、或其他形狀 之產品		
3/00	鈉、鉀或一般鹼金屬之鹵化物[2]	7/00	鈉、鉀或一般鹼金屬之碳酸鹽[2]
3/02	• 氟化物	7/02	• 用複分解法製備
3/04	• 氯化物	7/04	• • 用氟化物或矽氟化物 (1/24 優 先)
3/06	• • 用加工鹽水、海水或廢鹼液製 備	7/06	• 經由碳酸鎂鈉或碳酸鎂鉀製備
3/08	• • 用加工天然或工業鹽混合物或 含矽礦物製備	7/07	• 用氫氧化物製備 [2]
3/10	• 溴化物	7/08	• 由或經由鈉或鉀之氰基化合物製 備 (1/26 優先)
3/12	• 碘化物	7/10	• 用碳酸鹽製備酸式碳酸鹽 (氨鹼 法見 7/18)
3/14	• 純化	7/12	• 用酸式碳酸鹽製備碳酸鹽
3/16	• • 用沉澱或吸附法		

7/14	• 倍半碳酸鹽之製備	9/04	• 用硝酸溶液製備
7/16	• 用鈉或鉀化合物與胺及二氧化碳製備	9/06	• 用氣態硝酸或氮氧化物製備
7/18	• 用氨鹼法製備	9/08	• 用複分解法製備
7/22	• 純化	9/10	• • 用硝酸鉍
7/24	• • 結晶	9/12	• • 用鎂、鈣、鋇或鋇之硝酸鹽
7/26	• • 用沉澱或吸附法	9/14	• • 鉀鹽與硝酸鈉者
7/28	• • 用選擇性溶劑	9/16	• 純化
7/30	• • 用氧化法	9/18	• 製備成型產品，如顆粒
7/32	• • 用滲析法	9/20	• 防止吸潮或結塊
7/34	• • 用電解法	13/00	其他類目不包括的鈉或鉀之化合物 [2]
7/35	• 改變結晶水含量或比重 [2]	15/00	鋰之化合物 [2]
7/37	• • 碳酸鈉增濃 [2]	15/02	• 氧化物；氫氧化物 [2]
7/38	• 製備粒狀、片狀、或其他形狀之產品	15/04	• 鹵化物 [2]
7/40	• • 對結晶過程之影響	15/06	• 硫酸鹽，亞硫酸鹽 [2]
7/42	• 防止吸潮或結塊	15/08	• 碳酸鹽，酸式碳酸鹽 [2]
9/00	鈉、鉀或一般鹼金屬之硝酸鹽[2]	15/10	• 硝酸鹽 [2]
9/02	• 用加工天然鹽混合物製備	17/00	銣，銯，或銩之化合物 [2]

C01F 金屬鈹、鎂、鋁、鈣、鋇、鋇、鐳、鈷之化合物，或稀土金屬之化合物（金屬氮化物見 C01B 6/00；鹵素之含氧酸鹽見 C01B 11/00；過氧化物，過氧酸鹽見 C01B 15/00；鎂、鈣、鋇或鋇之硫化物或多硫化物見 C01B 17/42；硫代硫酸鹽、連二亞硫酸鹽、連多硫酸鹽見 C01B 17/64；含碲或碲之化合物見 C01B 19/00；氮及金屬之二元化合物見 C01B 21/06；疊氮化物見 C01B 21/08；金屬氮化物見 C01B 21/092；亞硝酸鹽見 C01B 21/50；磷化物見 C01B 25/08；磷之含氧酸鹽見 C01B 25/16；碳化物見 C01B 32/90；含矽化合物 C01B 33/00；含硼化合物見 C01B 35/00；具有分子篩特性但不具有鹼交換特性的化合物見 C01B 37/00；具有分子篩和鹼交換特性的化合物，如結晶沸石見 C01B 39/00；氰化物見 C01C 3/08；氰酸鹽見 C01C 3/14；氰氨鹽見 C01C 3/16；硫氰酸鹽見 C01C 3/20；除二氧化碳之外的無機元素或無機化合物之發酵或使用酶之製備見 C12P 3/00；自混合物中得到金屬化合物，如：鑽石，即為得到游離金屬之冶金製程之中間物，見 C22B；電解或電泳生產非金屬元素或無機化合物見 C25B）

附註

- (1) 注意 C01 主類後的附註(1)，該附註定義本主類，即在 C01B 至 C01G 各次類中，採用末位規則。[8]
- (2) 化合物之治療活性，被進一步分入 A61P 次類內。[7]

- 1/00 製備金屬鈹、鎂、鋁、鈣、鋇、鋇、鐳、鈦化合物或稀土金屬化合物之一般方法**
- 3/00 鈹之化合物**
- 3/02 · 氧化物；氫氧化物 [3]
- 5/00 鎂之化合物**
- 5/02 · 氧化鎂
- 5/04 · · 用金屬鎂之氧化法
- 5/06 · · 用鎂化合物之熱分解法(焙燒菱鎂礦或白雲石見 C04B 2/10)
- 5/08 · · · 用焙燒氫氧化鎂法
- 5/10 · · · 用氯化鎂與水蒸汽之熱分解法
- 5/12 · · · 用硫酸鎂之熱分解法，有還原作用或無還原作用
- 5/14 · 氫氧化鎂
- 5/16 · · 用水或不含鎂之鹽溶液處理鎂氧礦石，如焙燒過之白雲石
- 5/20 · · 用鎂鹽溶液之氨沉澱法
- 5/22 · · 用鹼金屬氫氧化物或鹼土金屬之氧化物或氫氧化物與鎂之化合物
- 5/24 · 碳酸鎂
- 5/26 · 鹵化鎂
- 5/28 · · 氟化物
- 5/30 · · 氯化物
- 5/32 · · · 用鎂化合物之氯化法製備無水氯化鎂
- 5/34 · · · 含結晶水氯化鎂之脫水
- 5/36 · · 溴化物
- 5/38 · 硝酸鎂
- 5/40 · 硫酸鎂（鎂與鈉或鉀之複式硫酸鹽見 C01D 5/12，其他鹼金屬之複式硫酸鹽見 C01D 15/06，17/00）[3]
- 5/42 · 亞硫酸鎂
- 7/00 鋁之化合物[1,2006.01,2022.01]**
- 7/02 · 氧化鋁；氫氧化鋁；鋁酸鹽 [1,2006.01,2022.01]
- 7/021 · · 氧化物或氫氧化物之後處理
- 7/022 · · · 分級 [2022.01]
- 7/023 · · · 研磨、去黏聚或粉碎 [2022.01]
- 7/025 · · · 粒化或黏聚 [2022.01]
- 7/026 · · · 製備或穩定分散體 [2022.01]
- 7/027 · · · 包括熔化或汽化之處理 [2022.01]
- 7/028 · · β -氧化鋁 [2022.01]
- 7/04 · · 鹼金屬鋁酸鹽之製備；由鹼金屬鋁酸鹽製備鋁之氧化物或氫氧化物 (7/028 優先) [1,2006.01,2022.01]
- 7/043 · · · 鋁酸鋰 [2022.01]
- 7/046 · · · 鋁酸鹽之穩定化 [2022.01]
- 7/06 · · · 用鹼金屬氫氧化物處理含鋁礦石或類似廢料之原料，例如根據拜耳法瀝取鋁土礦(由所得之鋁酸鹽溶液獲得氧化鋁或氫氧化鋁見 7/14) [1,2006.01,2022.01]
- 7/0606 · · · · 用回收的廢液製備鹼金屬氫氧化物溶液 [2022.01]
- 7/0613 · · · · 礦物之預處理，例如研磨 [2022.01]
- 7/062 · · · · 溶出 [2022.01]
- 7/0626 · · · · 僅使用管道溶出之製程 [2022.01]
- 7/0633 · · · · 以使用添加劑為特徵 [2022.01]
- 7/064 · · · · 溶出設備，例如溶出容器或熱交換器 [2022.01]
- 7/0646 · · · · 不溶性殘餘物之分離，例如紅泥 [2022.01]
- 7/0653 · · · · 以在漿液中加入絮凝劑為特徵 [2022.01]
- 7/066 · · · · 分離殘餘物之處理 [2022.01]
- 7/0666 · · · · 製程之控制或調節 [2022.01]
- 7/0673 · · · · 由含磷酸鹽之礦物 [2022.01]
- 7/068 · · · · 由含碳酸鹽之礦物，例如碳鈉鋁石 [2022.01]
- 7/0686 · · · · 由含硫酸鹽之礦物，例如明礬石 [2022.01]

- 7/0693 由類似廢料之原料，例如飛灰或拜耳煅燒粉塵 [2022.01]
- 7/08 . . . 用碳酸鈉處理含鋁礦石，例如燒結工藝(7/0613、7/066 優先) [1,2006.01,2022.01]
- 7/085 根據石灰燒結法 [2022.01]
- 7/10 . . . 用鹼金屬硫酸鹽及還原劑處理含鋁礦石
- 7/12 . . . 由鹼土金屬鋁酸鹽製鹼金屬鋁酸鹽[1,2006.01]
- 7/14 . . . 由鹼金屬鋁酸鹽製氧化鋁或氫氧化鋁 [1,2006.01,2022.01]
- 7/141 由酸性試劑中和鋁酸鹽水溶液 [2022.01]
- 7/142 用二氧化碳 [2022.01]
- 7/144 由鋁酸鹽水溶液冷卻沉澱，例如作為拜耳法之一部份 [2022.01]
- 7/145 以使用氫氧化鋁晶種以外之晶體生長調節劑為特徵 [2022.01]
- 7/147 沉澱設備 [2022.01]
- 7/148 所得氫氧化物之分離，例如通過過濾或脫水 [2022.01]
- 7/16 . . 鹼土金屬鋁酸鹽或鋁酸鎂之製備；由鹼土金屬鋁酸鹽製備鋁之氧化物或氫氧化物(7/028 優先) [1,2006.01,2022.01]
- 7/162 . . . 鋁酸鎂 [2022.01]
- 7/164 . . . 鋁酸鈣 [2022.01]
- 7/166 . . . 鋁酸鋇 [2022.01]
- 7/168 . . . 鋁酸鋇 [2022.01]
- 7/18 . . . 由鹼土金屬鋁酸鹽製氧化鋁或氫氧化鋁 [1,2006.01]
- 7/20 . . 用酸或鹽由含鋁礦石製備氧化鋁或氫氧化鋁 [1,2006.01]
- 7/22 . . . 用鹵化物或氫鹵酸 [1,2006.01]
- 7/24 . . . 用硝酸或氮之氧化物
- 7/26 . . . 用硫酸或硫酸鹽
- 7/28 . . . 用亞硫酸
- 7/30 . . 用鋁化合物之熱分解法或水解法或氧化法製備氧化鋁或氫氧化鋁 [1,2006.01,2022.01]
- 7/302 . . . 在氣相中水解或氧化氣態鋁化合物 [2022.01]
- 7/304 有機鋁化合物 [2022.01]
- 7/306 . . . 氯化水合物之熱分解，例如六水合三氯化鋁 [2022.01]
- 7/308 . . . 硝酸鹽之熱分解 [2022.01]
- 7/32 . . . 硫酸鹽之熱分解包括複合磷酸鹽，例如明礬 [1,2006.01]
- 7/34 . . 用含鋁鹽溶液沈澱法製備氫氧化鋁 [1,2006.01]
- 7/36 . . . 由有機鋁鹽
- 7/38 . . 用含鋁礦物熱還原法製備氧化鋁 [1,2006.01]
- 7/40 . . . 有硫化鋁存在下
- 7/42 . . 由金屬鋁製備氧化鋁或氫氧化鋁，例如氧化法 [1,2006.01,2022.01]
- 7/422 . . . 在高溫下用氣態氧化劑氧化 [2022.01]
- 7/424 使用電漿 [2022.01]
- 7/426 . . . 在低溫下對固態鋁施加機械能 [2022.01]
- 7/428 . . . 在水溶液中氧化 [2022.01]
- 7/44 . . 氧化鋁或氫氧化鋁之脫水，即由一晶形完全轉變為另一晶形包括失水 [1,2006.01,2022.01]
- 7/441 . . . 通過鍛燒 [2022.01]
- 7/442 存在鍛燒添加劑 [2022.01]
- 7/444 其設備 [2022.01]
- 7/445 使用流化床 [2022.01]
- 7/447 . . . 通過濕法 [2022.01]
- 7/448 用超大氣壓，例如三水鋁石水熱轉化為軟水鋁石 [2022.01]
- 7/46 . . 氧化鋁，氫氧化鋁或鋁酸鹽之純化(7/028 優先) [1,5,2006.01]
- 7/47 . . . 鋁酸鹽者，例如從拜耳法溶液中去除矽、鎂、鐵之化合

- 物 或 有 機 化 合 物
[5,2006.01,2022.01]
- 7/473 去除有機化合物，例如草
酸鈉 [2022.01]
- 7/476 通過氧化法 [2022.01]
- 7/48 . 含或不含除鋁以外其他陽離子之
鹵化物 [1,2006.01]
- 7/50 . . 氟化物
- 7/52 . . . 同時含有氟及其他鹵素之複
合物 [1,2006.01]
- 7/54 . . . 同時含有鋁及鹼金屬或鹼土
金屬之複合物
- 7/56 . . 氯化物（含氟見 7/52）
[1,3,2006.01,2022.01]
- 7/57 . . . 鹼性氯化鋁，例如聚合氯化
鋁 [2022.01]
- 7/58 . . . 無水氯化鋁之製備
- 7/60 用鋁之含氧化合物
- 7/62 純化
- 7/64 . . 溴化物（含氟見 7/52）[3]
- 7/66 . 含或不含除鋁以外其他陽離子之
硝酸鹽 [1,3,2006.01]
- 7/68 . 含硫之鋁化合物 [1,3,2006.01]
- 7/70 . . 硫化物
- 7/72 . . 亞硫酸鹽
- 7/74 . . 硫酸鹽 [1,2006.01,2022.01]
- 7/741 . . . 由鋁元素或含鋁元素材料製
備，例如箔或浮渣 [2022.01]
- 7/743 . . . 由矽鋁材料製備，例如黏土
或鋁土礦 [2022.01]
- 7/745 . . . 由明礬製備，例如明礬石
[2022.01]
- 7/746 . . . 後處理，例如脫水或穩定化
[2022.01]
- 7/748 純化 [2022.01]
- 7/76 . . . 複鹽，即除鋁及硫酸根離子
以外僅含其他陽離子之化
合 物 ， 例 如 明 礬
[1,2006.01,2022.01]
- 7/762 鉍或鹼金屬硫酸鹽
[2022.01]
- 7/765 硫酸鉍 [2022.01]
- 7/767 鹼土金屬硫酸鹽 [2022.01]
- 7/77 . 碳酸鋁 [2022.01]
- 7/78 . 含有鋁，含或不含氧或氫及含二
或多種其他元素（鋁酸鹽見
7/02；含鋁、氟及鹼金屬或鹼土
金屬見 7/54；含除鋁以外其他陽
離子之硝酸鹽見 7/66；含除鋁以
外其他陽離子之硫化物、亞硫酸
鹽 或 硫 酸 鹽 見 7/70-7/74）
[2022.01]
- 7/782 . . 含碳酸根離子，例如碳酸鋁石
[2022.01]
- 7/784 . . 層狀雙氫氧化合物，例如包含
硝酸根、硫酸根或碳酸根離子
作為嵌入陰離子 [2022.01]
- 7/785 . . . 水滑石 [2022.01]
- 7/786 . . 除鋁外僅含陰離子，例如
 $\text{Al}(\text{OH})_x\text{Cl}_y[\text{SO}_4]_z$ （混合鹵化物
見 7/48）[2022.01]
- 7/788 . . 氟化鋁鉍，例如六氟鋁酸鉍
[2022.01]
- 11/00 鈣、鋇或鋇之化合物（7/00 優先）
[3]**
- 11/02 . 氧化物或氫氧化物（石灰之生產
見 C04B 2/00）
- 11/04 . . 用熱分解法
- 11/06 . . . 碳酸鹽者
- 11/08 . . 用硫酸鹽還原法
- 11/10 . . 由硫化物
- 11/12 . . 由矽酸鹽
- 11/16 . . 純化
- 11/18 . 碳酸鹽
- 11/20 . 鹵化物
- 11/22 . . 氟化物
- 11/24 . . 氯化物
- 11/26 . . . 由硫化物
- 11/28 . . . 用鹼土金屬化合物氯化法
- 11/30 . . . 濃縮；脫水；防止吸潮或結
塊
- 11/32 . . . 純化
- 11/34 . . 溴化物
- 11/36 . 硝酸鹽
- 11/38 . . 用硝酸或氫之氧化物製備
- 11/40 . . 用硝酸鹽複分解法製備
- 11/42 . . 複鹽（含鎂者見 5/38）

- 11/44 · · 濃縮；結晶；脫水；防止吸潮或結塊
- 11/46 · 硫酸鹽（石膏之脫水見 C04B 11/02）
- 11/48 · 亞硫酸鹽
- 13/00 鏷之化合物**
- 15/00 鈷之化合物**
- 17/00 稀土金屬化合物**
[1,2006.01,2020.01]
- 附註 [2020.01]**
- (1)於本目中，下列名詞之意義如下：
- “稀土金屬”意指鏷系元素以及鈳或鈹，單獨或組合使用。
- (2)當化合物被分類入 17/20 至 17/38 目中時，只要該化合物以其製備或處理為特徵，其特定的製備或處理也必須被分類入 17/10 至 17/17 目中，反之亦然。
- 17/10 · 製備或處理，例如分離或純化 [2020.01]
- 17/13 · · 用離子交換樹脂，例如：螯合樹脂 [2020.01]
- 17/17 · · 包括液-液萃取 [2020.01]
- 17/20 · 僅包含稀土金屬作為金屬元素的化合物 [2020.01]
- 17/206 · · 氧化物或氫氧化物作為唯一的陰離子 [2020.01]
- 17/212 · · · 氧化鈳或氫氧化鈳 [2020.01]
- 17/218 · · · 氧化鈹或氫氧化鈹 [2020.01]
- 17/224 · · · 鏷系元素之氧化物或氫氧化物 [2020.01]
- 17/229 · · · · 氧化鏷或氫氧化鏷 [2020.01]
- 17/235 · · · · 氧化鈾或氫氧化鈾 [2020.01]
- 17/241 · · · 包含二或多個稀土金屬，例如：NdPrO₃ 或 LaNdPrO₃ [2020.01]
- 17/247 · · 碳酸鹽 [2020.01]
- 17/253 · · 鹵化物 [2020.01]
- 17/259 · · · 鹵氧化物 [2020.01]
- 17/265 · · · 氟化物 [2020.01]
- 17/271 · · · 氯化物 [2020.01]
- 17/276 · · 硝酸鹽 [2020.01]
- 17/282 · · 硫酸鹽 [2020.01]
- 17/288 · · 硫化物 [2020.01]
- 17/294 · · · 硫氧化物 [2020.01]
- 17/30 · 包含稀土金屬和至少一種稀土金屬、氧或氫以外的元素，例如：La₄S₃Br₆ (17/247 至 17/294 優先) [2020.01]
- 17/32 · · 氧化物或氫氧化物作為唯一的陰離子，例如：NaCeO₂ 或 Mg_xCa_yEuO [2020.01]
- 17/34 · · · 鋁酸鹽，例如：YAlO₃ 或 Y_{3-x}GdAl₅O₁₂ [2020.01]
- 17/36 · · 鹵素作為唯一的陰離子，例如：NaYF₄ [2020.01]
- 17/38 · · 硫作為唯一的陰離子，例如：CaLa₂S₄ [2020.01]

C01G 含有不包括 C01D 或 C01F 次類之金屬之化合物（金屬氫化物見 C01B 6/00；鹵素之含氧酸鹽見 C01B 11/00；過氧化物，過氧酸鹽見 C01B 15/00；硫代硫酸鹽、連二亞硫酸鹽、連多硫酸鹽見 C01B 17/64；含硒或碲之化合物見 C01B 19/00；氮與金屬之二元化合物見 C01B 21/06；疊氮化物見 C01B 21/08；金屬氮化物見 C01B 21/092；亞硝酸鹽見 C01B 21/50；磷化物見 C01B 25/08；磷之含氧酸鹽見 C01B 25/16；碳化物見 C01B 32/90；含矽之化合物見 C01B 33/00；含硼之化合物見 C01B 35/00；具有分子篩特性但不具有鹼交換特性的化合物見 C01B 37/00；具有分子篩和鹼交換特性的化合物，如結晶

沸石見 C01B 39/00；氰化物見 C01C 3/08；氰酸鹽見 C01C 3/14；氰氨鹽見 C01C 3/16；硫氰酸鹽見 C01C 3/20；除二氧化碳之外的無機元素或無機化合物之發酵或使用酶之製備見 C12P 3/00；自混合物中得到金屬化合物，如：鑛石，即為得到游離金屬之冶金製程之中間物，見 C21B、C22B；電解或電泳生產非金屬元素或無機化合物見 C25B)

附註

- (1) 注意 C01 主類後的附註(1)，該附註定義本主類，即在 C01B 至 C01G 各次類中，採用末位規則。[8]
- (2) 化合物之治療活性，被進一步分入 A61P 次類內。[7]

次類索引

一般製備方法.....	1/00	Ni 鎳.....	53/00
金屬化合物按金屬元素符號字母順序排列		Os 銱.....	55/00
Ag 銀.....	5/00	Pb 鉛.....	21/00
As 砷.....	28/00	Pd 鈀.....	55/00
Au 金.....	7/00	Pt 鉑.....	55/00
Bi 鉍.....	29/00	Re 銻.....	47/00
Cd 鎘.....	11/00	Rh 銠.....	55/00
Co 鈷.....	51/00	Ru 鈷.....	55/00
Cr 鉻.....	37/00	Sb 銻.....	30/00
Cu 銅.....	3/00	Sn 錫.....	19/00
Fe 鐵.....	49/00	Ta 鉭.....	35/00
Ga 鎵.....	15/00	Ti 鈦.....	23/00
Ge 鍺.....	17/00	Tl 鉍.....	15/00
Hf 鈪.....	27/00	U 鈾.....	43/00
Hg 汞.....	13/00	V 釩.....	31/00
In 銦.....	15/00	W 鎢.....	41/00
Ir 銱.....	55/00	Zn 鋅.....	9/00
Mn 錳.....	45/00	Zr 鈷.....	25/00
Mo 鉬.....	39/00	超鈾元素之化合物.....	56/00
Nb 鈮.....	33/00	上列各目不包括的金屬化合物.....	57/00

1/00 不包括 C01B、C、D、或 F 次類之金屬化合物的一般製備方法
(無機化合物之電解生產見 C25B 1/00) [2]

- 1/02 • 氧化物
- 1/04 • 羰基化合物
- 1/06 • 鹵化物

- 1/08 • 硝酸鹽
- 1/10 • 硫酸鹽
- 1/12 • 硫化物
- 1/14 • 亞硫酸鹽

3/00 銅之化合物

- 3/02 • 氧化物；氫氧化物
- 3/04 • 鹵化物

- 3/05 • • 氯化物 [3]
- 3/06 • • 氯氧化物
- 3/08 • 硝酸鹽
- 3/10 • 硫酸鹽
- 3/12 • 硫化物
- 3/14 • 與氮之錯合物
- 5/00 銀之化合物**
- 5/02 • 鹵化物 [3]
- 7/00 金之化合物**
- 9/00 鋅之化合物**
- 9/02 • 氧化物；氫氧化物 [3]
- 9/03 • • 用乾法，如氣相法之生產方法
- 9/04 • 鹵化物
- 9/06 • 硫酸鹽
- 9/08 • 硫化物
- 11/00 鎘之化合物**
- 11/02 • 硫化物 [2]
- 13/00 汞之化合物**
- 13/02 • 氧化物
- 13/04 • 鹵化物
- 15/00 鎳、銅、或鈹之化合物**
- 17/00 鋅之化合物**
- 17/02 • 二氧化鋅
- 17/04 • 鋅之鹵化物
- 19/00 錫之化合物**
- 19/02 • 氧化物
- 19/04 • 鹵化物
- 19/06 • • 氯化亞錫
- 19/08 • • 氯化錫
- 21/00 鉛之化合物**
- 21/02 • 氧化物
- 21/04 • • 一氧化二鉛[Pb₂O] [1,2006.01]
- 21/06 • • 一氧化鉛[PbO] [1,2006.01]
- 21/08 • • 二氧化鉛[PbO₂]/[1,2006.01]
- 21/10 • • 鉛丹[Pb₃O₄]/[1,2006.01]
- 21/12 • 氫氧化物
- 21/14 • 碳酸鹽
- 21/16 • 鹵化物
- 21/18 • 硝酸鹽
- 21/20 • 硫酸鹽
- 21/21 • 硫化物 [3]
- 21/22 • 過鉛酸鹽；鉛酸鹽
- 23/00 鈦之化合物**
- 23/02 • 鈦之鹵化物
- 23/04 • 氧化物；氫氧化物 [3]
- 23/047 • • 二氧化鈦 [3]
- 23/053 • • • 用濕法生產，如水解鈦鹽[3]
- 23/07 • • • 用氣相法生產，如鹵化物之
 氧化 [3]
- 23/08 • • • 乾燥；煅燒 [3]
- 25/00 鈳之化合物**
- 25/02 • 氧化物
- 25/04 • 鹵化物
- 25/06 • 硫酸鹽
- 27/00 鈐之化合物**
- 27/02 • 氧化物
- 27/04 • 鹵化物
- 27/06 • 硫酸鹽
- 28/00 砷之化合物 [3]**
- 28/02 • 砷酸鹽；亞砷酸鹽 [3]
- 29/00 鉍之化合物**
- 30/00 銻之化合物**
- 30/02 • 銻酸鹽；亞銻酸鹽 [3]
- 31/00 釩之化合物**
- 31/02 • 氧化物 [3]
- 31/04 • 鹵化物 [3]
- 33/00 鈮之化合物**
- 35/00 鉭之化合物**
- 35/02 • 鹵化物 [3]
- 37/00 鉻之化合物**
- 37/02 • 氧化物或其水合物
- 37/027 • • 二氧化鉻 [3]
- 37/033 • • 三氧化鉻；鉻酸 [3]
- 37/04 • 鉻之鹵化物
- 37/06 • • 鉻鹽鹵
- 37/08 • 鉻之硫酸鹽
- 37/10 • • 鉻礬

37/14 • 鉻酸鹽；重鉻酸鹽

39/00 鉬之化合物

39/02 • 氧化物；氫氧化物 [3]

39/04 • 鹵化物 [3]

39/06 • 硫化物 [3]

41/00 鎢之化合物

41/02 • 氧化物；氫氧化物 [3]

41/04 • 鹵化物 [3]

43/00 鈾之化合物

43/01 • 氧化物；氫氧化物 [3]

43/025 • • 二氧化鈾 [3]

43/04 • 鈾之鹵化物

43/06 • • 氟化物

43/08 • • 氯化物

43/10 • • 溴化物

43/12 • • 碘化物

45/00 錳之化合物[1,2006.01,2025.01]

45/01 • 涉及液-液萃取、吸附或離子交換之製備或分離[2025.01]

45/02 • 氧化物[1,2006.01,2025.01]

45/022 • • 一氧化錳[2025.01]

45/024 • • 二氧化錳[2025.01]

45/026 • • 三氧化二錳[2025.01]

45/028 • • 四氧化三錳[2025.01]

45/03 • 氫氧化物；羥基氧化物[2025.01]

45/04 • 羰基化合物

45/05 • 碳酸鹽[2025.01]

45/06 • 鹵化物；鹵氧化物
[1,2006.01,2025.01]

45/07 • • 氯化物；氯氧化物[2025.01]

45/08 • 硝酸鹽

45/10 • 硫酸鹽

45/12 • 含錳和至少一種其他金屬元素之複合氧化物 [1,2006.01,2025.01]

45/1207 • • 過錳酸鹽 $[(\text{MnO}_4)^-]$ 或錳酸鹽
[$(\text{MnO}_4)^{2-}$] [2025.01]

45/1214 • • • 含有鹼金屬[2025.01]

45/1221 • • 含三價錳、四價錳或其混合物的錳酸鹽或亞錳酸鹽化合物
[2025.01]

45/1228 • • • $(\text{MnO}_2)^-$ 類型之化合物，如

LiMnO_2 或

$\text{Li}(\text{M}_x\text{Mn}_{1-x})\text{O}_2$ [2025.01]

45/1235 • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^{2-}$ 類型之化合物，如
 $\text{Li}_2\text{Mn}_2\text{O}_4$ 或

$\text{Li}_2(\text{M}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ [2025.01]

45/1242 • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^-$ 類型之化合物，如
 LiMn_2O_4 或

$\text{Li}(\text{M}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ [2025.01]

45/125 • • • $(\text{MnO}_3)^n$ 類型之化合物，如
 CaMnO_3 [2025.01]

45/1257 • • • • 含鋰，如 Li_2MnO_3 或
 $\text{Li}_2(\text{M}_x\text{Mn}_{1-x})\text{O}_3$ [2025.01]

45/1264 • • • • 含稀土元素，如
 $(\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x)\text{MnO}_3$ 或
 LaMnO_3 [2025.01]

45/20 • 含錳，含或不含氧或氫，並含有一
種或多種其他元素之化合物
(45/04 至 45/12 優先)[2025.01]

45/22 • • 含錳，含或不含氧或氫，並且
含有兩種或多種其他元素之
化合物[2025.01]

45/24 • • 氫氧化物[2025.01]

47/00 銻之化合物

49/00 鐵之化合物

49/02 • 氧化物；氫氧化物

49/04 • • 氧化亞鐵 $[\text{FeO}]$ [1,2006.01]

49/06 • • 氧化鐵 $[\text{Fe}_2\text{O}_3]$ [1,2006.01]

49/08 • • 四氧化三鐵 $[\text{Fe}_3\text{O}_4]$ [1,2006.01]

49/10 • 鹵化物

49/12 • 硫化物

49/14 • 硫酸鹽

49/16 • 羰基化合物

51/00 鈷之化合物[1,2006.01,2025.01]

51/01 • 涉及液-液萃取、吸附或離子交換
之製備或分離[2025.01]

51/02 • 羰基化合物

51/04 • 氧化物[1,2006.01,2025.01]

51/05 • 氫氧化物；羥基氧化物[2025.01]

51/06 • 碳酸鹽

51/08 • 鹵化物；鹵氧化物[1,2006.01]

51/10 • 硫酸鹽

51/12 (轉見 51/20)

- 51/15 • 硫化物；硫氧化物[2025.01]
- 51/20 • 與氨之錯合物[2025.01]
- 51/40 • 含鈷和至少一種其他金屬元素之複合氧化物[2025.01]
- 51/42 • • 含鹼金屬，如 LiCoO_2 [2025.01]
- 51/44 • • • 含錳 [2025.01]
- 51/50 • • • • $(\text{MnO}_2)^n$ -類型之化合物，如 $\text{Li}(\text{Co}_x\text{Mn}_{1-x})\text{O}_2$ 或 $\text{Li}(\text{M}_y\text{Co}_x\text{Mn}_{1-x-y})\text{O}_2$ [2025.01]
- 51/52 • • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^{2-}$ -類型之化合物，如 $\text{Li}_2(\text{Co}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ 或 $\text{Li}_2(\text{M}_y\text{Co}_x\text{Mn}_{2-x-y})\text{O}_4$ [2025.01]
- 51/54 • • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^-$ -類型之化合物，如 $\text{Li}(\text{Co}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ 或 $\text{Li}(\text{M}_y\text{Co}_x\text{Mn}_{2-x-y})\text{O}_4$ [2025.01]
- 51/56 • • • • $[\text{MnO}_3]^{2-}$ -類型之化合物，如 $\text{Li}_2[\text{Co}_x\text{Mn}_{1-x}]\text{O}_3$ 或 $\text{Li}_2[\text{M}_y\text{Co}_x\text{Mn}_{1-x-y}]\text{O}_3$ [2025.01]
- 51/66 • • 含鹼土金屬，如 SrCoO_3 [2025.01]
- 51/68 • • • 含稀土元素，如 $[\text{La}_{0.3}\text{Sr}_{0.7}]\text{CoO}_3$ [2025.01]
- 51/70 • • 含稀土元素，如 LaCoO_3 (51/68 優先) [2025.01]
- 51/80 • 含鈷，含或不含氧或氫，並且含有一種或多種其他元素之化合物 (51/02、51/06 至 51/40 優先) [2025.01]
- 51/82 • • 含鈷，含或不含氧或氫，並且含有兩種或多種其他元素之化合物[2025.01]
- 51/84 • • 氫氧化物[2025.01]
- 53/00 鎳之化合物[1,2006.01,2025.01]**
- 53/01 • 涉及液-液萃取、吸附或離子交換之製備或分離[2025.01]
- 53/02 • 羰基化合物
- 53/04 • 氧化物[1,2006.01,2025.01]
- 53/05 • 氫氧化物；羥基氧化物[2025.01]
- 53/06 • 碳酸鹽
- 53/08 • 鹵化物；鹵氧化物[1,2006.01]
- 53/09 • • 氯化物；氯氧化物[3,2006.01]
- 53/10 • 硫酸鹽
- 53/11 • 硫化物；硫氧化物[3,2006.01]
- 53/12 • 與氨之錯合物[1,2006.01]
- 53/40 • 含鎳和至少一種其他金屬元素之複合氧化物[2025.01]
- 53/42 • • 含鹼金屬，如 LiNiO_2 [2025.01]
- 53/44 • • • 含錳 [2025.01]
- 53/50 • • • • $(\text{MnO}_2)^n$ -類型之化合物，如 $\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Mn}_{1-x})\text{O}_2$ 或 $\text{Li}(\text{M}_y\text{Ni}_x\text{Mn}_{1-x-y})\text{O}_2$ [2025.01]
- 53/502 • • • • • 含鋰和鈷 [2025.01]
- 53/504 • • • • • 鎳相對於除鹼金屬以外之所有金屬之莫耳比大於或等於 0.5，如 $\text{Li}[\text{M}_z\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y-z}]\text{O}_2$ ，且 $x \geq 0.5$ [2025.01]
- 53/506 • • • • • 鎳相對於除鹼金屬以外之所有金屬之莫耳比大於或等於 0.8，如 $\text{Li}[\text{M}_z\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y-z}]\text{O}_2$ ，且 $x \geq 0.8$ [2025.01]
- 53/51 • • • • • 含鈉 [2025.01]
- 53/52 • • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^{2-}$ -類型之化合物，如 $\text{Li}_2(\text{Ni}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ 或 $\text{Li}_2(\text{M}_y\text{Ni}_x\text{Mn}_{2-x-y})\text{O}_4$ [2025.01]
- 53/54 • • • • $(\text{Mn}_2\text{O}_4)^-$ -類型之化合物，如 $\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Mn}_{2-x})\text{O}_4$ 或 $\text{Li}(\text{M}_y\text{Ni}_x\text{Mn}_{2-x-y})\text{O}_4$ [2025.01]
- 53/56 • • • • $[\text{MnO}_3]^{2-}$ -類型之化合物，如 $\text{Li}_2[\text{Ni}_x\text{Mn}_{1-x}]\text{O}_3$ 或 $\text{Li}_2[\text{M}_y\text{Ni}_x\text{Mn}_{1-x-y}]\text{O}_3$ [2025.01]
- 53/66 • • 含鹼土金屬，如 SrNiO_3 或 SrNiO_2 [2025.01]
- 53/68 • • • 含稀土元素，如 $[\text{La}_{1.62}\text{Sr}_{0.38}]\text{NiO}_4$ [2025.01]
- 53/70 • • 含稀土元素，如 LaNiO_3 (53/68 優先) [2025.01]

C01G

53/80 • 含鎳，含或不含氧或氫，並且含
 有一種或多種其他元素之化合物
 （53/02、53/06 至 53/40 優先）

[2025.01]

53/82 • • 含鎳之化合物，含或不含氧或
 氫，並且含有兩種或多種其他
 元素**[2025.01]**

53/84 • • 氫氧化物**[2025.01]**

**55/00 鈮、銻、鈮、鐵、鉍或鉑之化合
物**

56/00 超鈾元素之化合物

57/00 (轉見 99/00)

**99/00 本類其他目未包括的金屬化
合物[2010.01]**

C02 水、廢水、污水或污泥之處理

C02F 水、廢水、污水或污泥之處理（藉由使有害物質產生化學變化，以減低其傷害性或轉為無傷害性之製程見 A62D 3/00；分離、沈澱池或過濾裝置見 B01D；有關處理水、廢水或污水，如淡水生產裝置之水運容器之特殊設備見 B63J；為防止腐蝕而加入水之添加物質見 C23F；放射性廢液之處理見 G21F 9/04）[3]

附註

- (1) 當分類入本次類時，若含有與色層分析相關的技術主題，則尚須分入 B01D 15/08。[8]
- (2) 於本次類內，最好加入 101/00 或 103/00 目之索引碼。[7]

次類索引

水之化學或物理處理	1/00，5/00	多級處理.....	9/00
水之生物處理.....	3/00	污泥之處理.....	11/00
水面之曝氣.....	7/00		

1/00 水、廢水或污水之處理（3/00 至 9/00 優先）[3,2006.01,2023.01]

1/02 • 加熱法 [3,2006.01,2023.01]

1/04 • • 蒸餾或蒸發 [3,2006.01,2023.01]

1/06 • • • 閃蒸 [3,2006.01,2023.01]

1/08 • • • 薄膜蒸發 [3,2006.01,2023.01]

1/10 • • • 與作為傳熱介質之固體顆粒或流體直接接觸 [3,2006.01,2023.01]

1/12 • • • • 噴霧蒸發 [3,2006.01,2023.01]

1/14 • • • 利用太陽能 [3,2006.01,2023.01]

1/16 • • • 利用其他工藝中之廢熱 [3,2006.01,2023.01]

1/18 • • • 獲得飲用水之移動式裝置 [3,2006.01,2023.01]

1/20 • 脫氣法，即溶解氣體之釋放 [3,2006.01,2023.01]

1/22 • 冷凍法 [3],2006.01,2023.01

1/24 • 浮選法（1/465 優先） [3,5,2006.01,2023.01]

1/26 • 萃取法 [3,2006.01,2023.01]

1/28 • 吸附法（離子交換法見 1/42；吸

附劑之組成見 B01J）
[3,2006.01,2023.01]

1/30 • 光照法 [3,2006.01,2023.01]

1/32 • • 用紫外線者 [3,2006.01,2023.01]

1/34 • 機械振動法 [3,2006.01,2023.01]

1/36 • • 超音波振動 [3,2006.01,2023.01]

1/38 • 離心分離法 [3,2006.01,2023.01]

1/40 • 分離或去除油脂或油狀物質或類似浮游物之裝置（淨化或防止油或類似物對露天水面之污染見 E02B 15/04；於污水管中分離污水之液體或固體物質之裝置見 E03F5/14） [3,5,2006.01,2023.01]

1/42 • 離子交換法 [3,2006.01,2023.01]

1/44 • 滲析法、滲透法或反滲透法 [3,2006.01,2023.01]

1/46 • 用電化學方法 [3,5,2006.01,2023.01]

1/461 • • 用電解法 [5,2006.01,2023.01]

1/463 • • • 用電凝聚法 [5,2006.01,2023.01]

1/465 • • • 用電浮選法 [5,2006.01,2023.01]

- 1/467 • • • 用電化學殺菌法
[5,2006.01,2023.01]
- 1/469 • • 用電化學分離、如用電滲透、
電滲析，電泳
[5,2006.01,2023.01]
- 1/48 • 用磁場或電場者（1/46 優先）
[3,2006.01,2023.01]
- 1/50 • 添加或使用殺菌劑或用微動力處理（1/467 優先）
[3,5,2006.01,2023.01]
- 1/52 • 懸浮雜質之絮凝或沉澱
[3,2006.01,2023.01]
- 1/54 • • 使用有機物 [3,2006.01,2023.01]
- 1/56 • • • 高分子化合物
[3,2006.01,2023.01]
- 1/58 • 除去特定之溶解化合物（所用之
離子交換法見 1/42；水之軟化見
5/00）[3,2006.01,2023.01]
- 1/60 • • 矽化合物 [3,2006.01,2023.01]
- 1/62 • • 重金屬化合物
[3,2006.01,2023.01]
- 1/64 • • • 鐵或錳者 [3,2006.01,2023.01]
- 1/66 • 利用中和法；pH 之調節（脫氣見
1/20；用離子交換見 1/42；懸浮
雜質之絮凝或沉澱見 1/52；溶解
化合物之除去見 1/58）
[3,2006.01,2023.01]
- 1/68 • 添加特定之物質，如微量元素以改
善飲用水質 [3,2006.01,2023.01]
- 1/70 • 還原法 [3,2006.01,2023.01]
- 1/72 • 氧化法 [3,2006.01,2023.01]
- 1/74 • • 用空氣（水面之曝氣見
7/00）[3,2006.01,2023.01]
- 1/76 • • 用鹵素或鹵素化合物
[3,2006.01,2023.01]
- 1/78 • • 用臭氧 [3,2006.01,2023.01]
- 3/00 水、廢水或污水之生物處理**
[3,2006.01,2023.01]
- 3/02 • 好氧處理 [3,2006.01,2023.01]
- 3/04 • • 使用滴濾池 [3,2006.01,2023.01]
- 3/06 • • 使用地下滲濾池
[3,2006.01,2023.01]
- 3/08 • • 使用運動之接觸體
[3,2006.01,2023.01]
- 3/10 • • 填充物；填料；格柵
[3,2006.01,2023.01]
- 3/12 • • 活性污泥法 [3,2006.01,2023.01]
- 3/14 • • • 採用表面曝氣器
[3,2006.01,2023.01]
- 3/16 • • • • 有豎軸之曝氣器
[3,2006.01,2023.01]
- 3/18 • • • • 有橫軸之曝氣器
[3,2006.01,2023.01]
- 3/20 • • • 採用擴散器
[3,2006.01,2023.01]
- 3/22 • • • 採用循環管
[3,2006.01,2023.01]
- 3/24 • • • 採用自由降落曝氣或噴霧
[3,2006.01,2023.01]
- 3/26 • • • 使用純氧或富氧氣體者
[3,2006.01,2023.01]
- 3/28 • 厭氧消化處理
[3,2006.01,2023.01]
- 3/30 • 好氧與厭氧處理
[3,2006.01,2023.01]
- 3/32 • 以利用動物或植物為特徵者，如
藻類 [3,2006.01,2023.01]
- 3/34 • 以利用微生物為特徵者
[3,2006.01,2023.01]
- 5/00 水之軟化；防垢；加入水中之防
垢劑或除垢劑，如添加多價螯
合劑（利用離子交換軟化法見
1/42）[3,2006.01,2023.01]**
- 5/02 • 硬度之沈澱法軟化水
[3,2006.01,2023.01]
- 5/04 • • 使用磷酸鹽者（5/06 優先）
[3,2006.01,2023.01]
- 5/06 • • 使用鈣化合物者
[3,2006.01,2023.01]
- 5/08 • 為軟化，防垢或除垢用配合物或
其他增溶劑處理，如添加多價螯
合劑 [3,2006.01,2023.01]
- 5/10 • • 使用有機物質者
[3,2006.01,2023.01]
- 5/12 • • • 含氮者（5/14 優先）
[3,2006.01,2023.01]
- 5/14 • • • 含磷者 [3,2006.01,2023.01]
- 7/00 水面之曝氣 [3]**
- 9/00 水、廢水或污水之多級處理**

[3,2006.01,2023.01]**附註 [3,7,2006.01]**

(1) 本目 包括 聯合處理操作，在三個或更多不同的處理階段按規定的順序進行，每個階段發生在一個單獨的位置，例如裝置、反應器或隔間。

[3,2006.01,2023.01]

(2) 本目 不包括 主要特徵屬於 1/00 至 7/00 目所涵蓋之單獨處理步驟。

9/02 (轉見 1/00-1/78、9/00、9/20)

9/04 (轉見 1/00-1/78、5/00-5/14、9/00、9/20)

9/06 (轉見 1/00-1/78、5/00-5/14、9/00、9/20)

9/08 (轉見 1/00-1/78、5/00-5/14、9/00、9/20)

9/10 (轉見 1/00-1/78、5/00-5/14、9/00、9/20)

9/12 (轉見 1/00-1/78、5/00-5/14、9/00、9/20)

9/14 (轉見 1/00-5/14、9/00、9/20)

9/20 • 便攜式或可拆卸的小型多級處理裝置，例如 單點使用或實驗室水淨化系統 [2023.01]

11/00 污泥之處理；其裝置 [3]

11/02 • 生物處理

11/04 • • 厭氧處理；用此工藝生產甲烷 [3]

11/06 • 氧化法 [3]

11/08 • • 濕氣氧化 [3]

11/10 • 熱解法 [3]

11/12 • 脫水法、乾燥法或濃縮法 [3,2006.01,2019.01]

11/121 • • 機械脫水[2019.01]

11/122 • • • 使用壓濾機（11/123 優先）[2019.01]

11/123 • • • 使用帶濾器或帶式過濾器 [2019.01]

11/125 • • • 使用螺旋過濾器[2019.01]

11/126 • • • 使用桶式過濾器[2019.01]

11/127 • • • 離心[2019.01]

11/128 • • • 使用批次處理[2019.01]

11/13 • • 加熱[2019.01]

11/131 • • • 使用電磁波或超聲波 [2019.01]

11/14 • • 添加化學試劑者 [3,2006.01,2019.01]

11/143 • • • 使用無機物質者（11/148 優先）[2019.01]

11/145 • • • • 使用鈣化合物者[2019.01]

11/147 • • • 使用有機物質者（11/148 優先）[2019.01]

11/148 • • • 同一處理步驟中添加無機和有機物質組合使用 [2019.01]

11/15 • • 用電場、磁場或電磁場處理；用超音波處理（用於加熱目的見 11/131）[2019.01]

11/16 • • 使用乾燥床或堆肥床 [3,2006.01]

11/18 • 加熱處置（熱解見 11/10）[3]

11/20 • • 冷凍法 [3]

涉及水中污染物、廢水、污水或污泥性質與主目 1/00 至 11/00 聯合使用之索引碼。[7]

101/00 污染物之性質 [7]

101/10 • 無機化合物 [7]

101/12 • • 鹵素或含鹵素化合物 [7]

101/14 • • • 氟或含氟化合物 [7]

101/16 • • 氮化物，例如氨 [7]

101/18 • • • 氰化物 [7]

101/20 • • 重金屬或重金屬化合物 [7]

101/22 • • • 鉻或鉻化物，例如鉻酸鹽[7]

101/30 • 有機化合物 [7]

101/32 • • 碳氫化合物，例如油 [7]

101/34 • • 含氧者 [7]

101/36 • • 含鹵素者 [7]

101/38 • • 含氮者 [7]

涉及水中污染物、廢水、污水或污泥性質與主目 1/00 至 11/00 聯合使用之索引碼。[7]

103/00 待處理水、廢水、污水或污泥之

性質 [7]

- 103/02 • 未污染水，例如工業供水 [7]
- 103/04 • • 為取得純水或超純水 [7]
- 103/06 • 被污染之地下水或瀝濾水 [7]
- 103/08 • 海水，例如為了脫鹽分 [7]
- 103/10 • 來自採石場或採礦活動者 [7]
- 103/12 • 來自矽酸鹽或陶瓷工業者，例如
來自水泥廠和玻璃廠之廢水 [7]
- 103/14 • 塗料廢棄物 [7]
- 103/16 • 來自冶金加工者，亦即來自金屬
生產、精製或處理，例如電鍍廢
棄物 [7]
- 103/18 • 來自氣體排放物的濕式純化者
[7]
- 103/20 • 來自畜牧業者 [7]
- 103/22 • 來自各種動物加工者，例如家
禽、魚類或其各身體部分 [7]
- 103/24 • • 來自製革廠者 [7]
- 103/26 • 來自各種植物或其各部分加工者
[7]
- 103/28 • • 來自造紙或纖維素生產工業者
[7]
- 103/30 • 來自紡織工業者 [7]
- 103/32 • 來自食品或食料工業者，例如釀
酒廠廢水 [7]
- 103/34 • 來自 103/12 至 103/32 未包含之
其他化學工業者 [7]
- 103/36 • • 來自有機化合物之生產者 [7]
- 103/38 • • • 聚合物 [7]
- 103/40 • • 來自感光材料之生產或使用者
[7]
- 103/42 • 來自浴場設施者，例如游泳池 [7]
- 103/44 • 來自洗車設施者 [7]

C03 玻璃；礦棉或渣棉

C03B 玻璃、礦棉或渣棉之製造或成型；玻璃、礦棉或渣棉之製造或成型輔助工藝（表面處理見 C03C）

次類索引

玻璃之製造

熔化前之工藝.....	1/00，3/00
熔化工藝.....	5/00，7/00
其他工藝.....	8/00

成型

吹製.....	9/00
壓製.....	11/00
壓延.....	13/00
其他方法.....	15/00 至 21/00
纖維或細絲之製造.....	37/00

製造過程中之運輸.....	35/00
防止玻璃黏附.....	40/00
石英或熔凝矽石製品之生產.....	20/00

後處理

熱處理.....	25/00，29/00，32/00
熱強化.....	27/00
切割.....	23/26，33/00
再成型.....	23/00，31/00
纖維或細絲之後處理.....	37/10

原料之熔化

1/00 配合料之製備

- 1/02 • 壓製玻璃配合料，例如粒化 [5]

3/00 熔窯之投料

- 3/02 • 與預熱、預熔或預處理製造玻璃之組成分，粒料或碎玻璃相結合 [5]

5/00 爐內熔化；玻璃製造專用之熔窯

- 5/02 • 於電爐
- 5/027 • 於玻璃液中浸入之電極間利用電流法，即採用直接電阻加熱 [3]
- 5/03 • • • 池窯 [3]
- 5/033 • 於玻璃液上面或內部使用電阻加熱器，即採用間接電阻加熱 [3]

附註

5/02 目優先於 5/04 至 5/14 目。
[1, 8]

- 5/04 • 池窯
- 5/05 • • 非連續工作之池窯，如日池窯 [5]

- 5/06 • 坩堝窯
- 5/08 • • 玻璃熔料坩堝
- 5/10 • 池窯及坩堝窯相結合之熔化裝置
- 5/12 • 豎窯
- 5/14 • 圓筒型旋轉爐
- 5/16 • 熔化工藝特點；玻璃熔窯專用之輔助設備
- 5/167 • • 防止例如熔融玻璃，熱氣體、配合料侵害設備之裝置（5/20，5/42 優先）[5]
- 5/173 • • 用於在玻璃窯爐中改變熔融玻璃組成之設備，例如用於使熔融玻璃著色（化學成分見 C03C）[5]
- 5/18 • • 攪拌裝置；均化
- 5/182 • • • 使熔融玻璃沿固定部件移動，如導向裝置、窯坎、擋板 [5]
- 5/183 • • • 利用熱裝置，如用於產生對流
- 5/185 • • • • 電裝置 [5]
- 5/187 • • • 用活動元件 [3]
- 5/193 • • • 用氣體，如鼓泡器 [3]
- 5/20 • • 阻擋殘渣、泡沫或配合料之橋

- 磚、馬蹄磚、流液洞或其他裝置
- 5/225 • • 澄清 (5/18 優先) [3]
- 5/23 • • 熔融玻璃之冷卻 (5/18、5/225 優先) [3]
- 5/235 • • 玻璃之加熱 (5/02、5/18、5/255 優先) [3]
- 5/237 • • • 專門適用於玻璃熔爐之蓄熱室或換熱器 [5]
- 5/24 • • 熔化過程之自動調節 [1,2006.01]
- 5/26 • • 出口；溢流
- 5/28 • • 虹吸
- 5/42 • • 爐壁之建築元件，如防腐；爐壁材料之使用 [3]
- 5/425 • • • 防止腐蝕或侵蝕 (5/44 優先) [5]
- 5/43 • • • 爐壁材料之使用，例如耐火磚 [5]
- 5/435 • • • 爐壁之加熱裝置 [5]
- 5/44 • • • 爐壁之冷卻裝置 [5]
- 7/00 熔融玻璃分配器；負責取出熔融玻璃料之工具；料滴之製造**
- 7/01 • 熔融玻璃之卸料裝置 [5]
- 7/02 • 供料通路；即供料槽 [3]
- 7/04 • • 旋轉供料通路 [5]
- 7/06 • • 熱調節或控制玻璃溫度之裝置 [3]
- 7/07 • • • 電裝置
- 7/08 • 供料機嘴，如料滴供料機 [3]
- 7/082 • • 氣動式供料機 [5]
- 7/084 • • 旋轉管供料機 [5]
- 7/086 • • 沖頭式供料機 [5]
- 7/088 • • 出口，如料碗 [5]
- 7/09 • • 料盆 [5]
- 7/092 • • 攪拌裝置；均化 (5/18 優先) [5]
- 7/094 • • 用於加熱、冷卻或保溫之裝置 [5]
- 7/096 • • • 用於加熱者 [5]
- 7/098 • • • • 電者 [5]
- 7/10 • 借助於刀片或剪刀割斷玻璃液流；所用刀片之結構 [3]

- 7/11 • • 刀片之結構 [5]
- 7/12 • • 割斷自由懸掛之玻璃料股 [3]
- 7/14 • 向玻璃吹製機或壓製機輸送熔融玻璃或料滴 (7/18 至 7/22 優先) [3]
- 7/16 • • 利用導料槽 [3]
- 7/18 • 真空吸料機 [3]
- 7/20 • 杓式供料機 [3]
- 7/22 • 桿式或管式收集裝置 [3]
- 8/00 用熔化工藝以外之的其他工藝生產玻璃** (37/014 優先；細分散矽石製備，一般情況下見 C01B 33/18) [4]
- 8/02 • 用液相反應工藝 [4]
- 8/04 • 用氣相反應工藝 [4]

玻璃之成型

- 9/00 吹製玻璃；空心玻璃製品之生產**
- 9/02 • 人工吹製；人工吹製所需之輔助設備
- 9/03 • • 吹管 [3]
- 9/04 • • 具有高腳或突出物之空心玻璃製品之吹製
- 9/06 • • 雙壁空心玻璃製品之吹製，如真空盛器
- 9/08 • 用壓縮空氣對人工吹製後之胚料進行終吹
- 9/10 • 製板用之玻璃圓筒之吹製
- 9/12 • 由玻璃帶開始吹製；帶式玻璃成型機
- 9/13 • 採用料滴供料機 (9/28、9/29 優先) [3]
- 9/14 • • 採用“吹製”機或“吹—吹”成型機 (9/193、9/20 優先) [3]
- 9/16 • • • 採用具翻轉模具之成型機 [3]
- 9/18 • • • • 轉台成型機 [3]
- 9/19 • • • • 僅有一個轉台 [3]
- 9/193 • • 採用“壓—吹”成型機 [3]
- 9/195 • • • 轉台成型機 [3]
- 9/197 • • • 初模之結構 [3]
- 9/20 • 採用“真空吹製”或“真空吸料—吹製”成型機

- 9/22 • • 轉台成型機
- 9/24 • • 初模之結構
- 9/28 • 採用環鏈式成型機（9/12 優先）
[3]
- 9/29 • 襯碳模成型機（9/28 優先）[3]
- 9/295 • • 轉台成型機 [5]
- 9/30 • 吹製玻璃之各種部件（用於人工
吹製見 9/02），模具所用之材料
[3]
- 9/31 • • 吹製夾層玻璃製品或附有封入
物；如金屬絲，氣泡之玻璃 [5]
- 9/32 • • 使空心玻璃製品產生特殊形狀
者
- 9/325 • • • 於空心玻璃製品口處形成螺
紋或唇口；頸模 [3]
- 9/33 • • • 具腳或突出部分之空心玻璃
製品之製造；及其模 [3]
- 9/335 • • • 吹製空心製品底部之成形；
底模 [3]
- 9/34 • • 其他方面未提供之玻璃吹製模
- 9/347 • • • 初型模或成型模之結構 [3]
- 9/353 • • • 模支架 [3]
- 9/36 • • 吹頭；空氣之供給、排除或控
制
- 9/38 • • 玻璃吹製機之冷卻、加熱或保
溫手段
- 9/40 • • 玻璃吹製機專用之傳動或控制
機械
- 9/41 • • • 電或電子系統 [5]
- 9/42 • • 與玻璃吹製機相結合之熔化，
熱爆口，或熔邊設備（用熔化
法結合玻璃塊見 23/20）
- 9/44 • • 與玻璃吹製機相結合之製品卸
取裝置，如鉗
- 9/447 • • • 自吹模取出玻璃製品之裝
置，如鉗 [5]
- 9/453 • • • 用於將剛形成之玻璃製品推
入輸送機之裝置，如刮機；
固定冷卻板機 [5]
- 9/46 • • 玻璃吹製機中之熱玻璃切割裝
置（熱爆口見 9/42）
- 9/48 • • 製模材料使用 [3]

11/00 玻璃之壓製

- 11/02 • 使用裝有轉台之玻璃壓製機
- 11/04 • 使用附有吸料法裝料模之壓製機
- 11/05 • 使用附有往復運動模之壓製機
[3]
- 11/06 • 衝頭或模之構造
- 11/07 • • 真空吸料模 [3]
- 11/08 • • 用於製造實心玻璃製品者，如
透鏡片 [3]
- 11/10 • • 用於製造空心玻璃製品者
- 11/12 • 衝頭，模具，或玻璃壓製機之冷
卻，加熱或保溫（9/38 優先）[3]
- 11/14 • 裝有金屬嵌入體
- 11/16 • 玻璃壓製機專用之傳動或控制機
械

13/00 玻璃之壓延

- 13/01 • 滾壓成型玻璃製品 [5]
- 13/02 • 不具花之板玻璃之非連續壓延
- 13/04 • 不具花之板玻璃之連續壓延
- 13/06 • 波形板玻璃之壓延
- 13/08 • 附花板玻璃之壓延
- 13/10 • 多層板玻璃之壓延
- 13/12 • 附有封入物，如金屬線或夾石棉
之玻璃之壓延
- 13/14 • 其他玻璃製品之壓延
- 13/16 • 玻璃壓輥之構造
- 13/18 • 壓延玻璃用之輔助工具，如支承
板，夾具，手工取料勺，玻璃坩
堝移動工具

15/00 玻璃液之垂直拉引

- 15/02 • 板玻璃之拉引
- 15/04 • • 由玻璃液自由表面
- 15/06 • • 由槽子磚中
- 15/08 • • 用玻璃液下面之引磚
- 15/10 • • 多層板玻璃或塗覆彩色層之板
玻璃
- 15/12 • • 退火機膛之結構
- 15/14 • 由玻璃液拉引管、圓柱、或棒
- 15/16 • • 塗彩色層之管、圓柱或棒玻璃
之拉引
- 15/18 • 與板、管或棒玻璃拉引相連之置

放、運送裝置

17/00 採用流出、推出，或由成形狹道下拉或橫拉或溢流法之玻璃成形

- 17/02 · 塗覆彩色層之玻璃之成型
- 17/04 · 由固定或旋轉之工具或成型噴嘴拉引玻管或棒
- 17/06 · 玻璃板之成型

18/00 浮法玻璃之成形

- 18/02 · 板玻璃之成型
- 18/04 · · 熔融玻璃附尺寸之改變或調節 [3]
- 18/06 · · · 使用機械方法，如閘桿，輥式拉邊器 [3]
- 18/08 · · · 使用氣體 [3]
- 18/10 · · · 使用電裝置 [3]
- 18/12 · · 多層，著色或裝甲玻璃之製造（化學方面見 C03C） [3]
- 18/14 · · 改變玻璃帶之表面，如粗糙性（用化學方面見 C03C） [3]
- 18/16 · · 浮拋窯之結構；浮拋窯使用之材料；池壁之塗層或保護 [3]
- 18/18 · · 浮拋槽溫度之控制或調節；浮拋槽之構成或淨化 [3]
- 18/20 · · 浮拋槽上空氣之組成；槽上空氣之處理或純化 [3]
- 18/22 · · · 浮拋窯上空氣溫度之控制或調節 [3]

19/00 玻璃成型之其他方法（由軟化之玻璃、礦物、或礦渣製造或處理絮片，纖維或細絲見 37/00）

- 19/01 · 利用使玻璃粉末逐漸地熔於成型基板上，例如增長法 [5]
- 19/02 · 澆注法
- 19/04 · 離心法
- 19/06 · 燒結法（石英或熔凝矽石製品之生產見 20/00） [2]
- 19/08 · 發泡法
- 19/09 · 於成型模中熔融粉末狀玻璃 [3]
- 19/10 · 玻璃珠之成形
- 19/12 · 用液相反應法 [5]

- 19/14 · 用氣相反應法 [5]

20/00 生產石英或熔融矽製品之專用方法 [3]

21/00 塑性狀態下之玻璃板，管，或棒之切割

- 21/02 · 切割法（9/46 優先）
- 21/04 · 穿孔法
- 21/06 · 火刺，熱爆口，或熔化（9/42 優先） [3]

23/00 初型玻璃之再成型（纖維或細絲之再成形見 37/14）

- 23/02 · 玻璃板之再成型
- 23/023 · · 熱彎法 [3]
- 23/025 · · · 重力法 [3]
- 23/027 · · · · 用至少具有兩個可繞樞軸轉動之豎式半型模之模 [3]
- 23/03 · · · 於成型模之間壓彎法 [3]
- 23/031 · · · · 玻璃板於垂直位置（23/033 優先） [5]
- 23/033 · · · · 連續方法，如滾壓成型 [3]
- 23/035 · · · 利用氣墊或改變氣壓法，如真空法 [3]
- 23/037 · · 拉製法 [3]
- 23/04 · 管或棒之再成型
- 23/043 · · 專門適用於一般管或棒再成型之加熱裝置、例如燃燒器 [5]
- 23/045 · · 專門適用於使一般管或棒再成型之工具或設備，如玻璃車床、夾具（23/043 優先） [5]
- 23/047 · · 拉製法（37/025 優先） [5]
- 23/049 · · 壓製法（21/04，23/26 優先） [5]
- 23/051 · · 重力法，如下垂 [5]
- 23/053 · · 離心法（37/04 優先） [5]
- 23/055 · · 滾壓法 [5]
- 23/057 · · 熔化法，如用於火焰封接（9/42、21/06、33/08 優先） [5]
- 23/06 · · 熱彎法
- 23/07 · · 吹製法，如電燈泡之製造 [3]
- 23/08 · · 到達要求之準確尺寸，如校準

- 23/09 • • 末端之再成型，如槽、螺紋或口 [3]
- 23/11 • • 吹製以外者，與切割相結合之拉製法再成型，如用於安甌製造者 [3]
- 23/13 • • 與接合或熱封接相結合之再成型，如保溫瓶之製造 [3]
- 23/18 • 安甌之再成型及封口
- 23/20 • 實質上無再成型之玻璃件之熔融結合
- 23/203 • • 玻璃板之接合（23/24 優先）[3]
- 23/207 • • 玻璃棒、玻璃管、或空心玻璃製品之接合（23/24 優先）[3]
- 23/213 • • • 突出部分或腳之接合 [3]
- 23/217 • • • 用於陰極射線管或相似型管之生產 [3]
- 23/22 • • 鏡片之接合，如形成雙焦鏡片
- 23/24 • • 空心玻璃板或玻璃磚之製造
- 23/26 • 再加熱玻璃之衝壓

玻璃製之後處理

- 25/00 玻璃製品之退火**（纖維之後處理見 37/10）
- 25/02 • 間歇式退火
- 25/04 • 連續式退火
- 25/06 • • 用玻璃製品之水平位移 [3]
- 25/08 • • • 玻璃板者 [3]
- 25/087 • • • • 於垂直位置 [5]
- 25/093 • • • • 於一流體，如氣體或熔融金屬支承物上沿水平位置 [5]
- 25/10 • • 用玻璃製品之豎向位移 [3]
- 25/12 • • • 玻璃板者 [3]
- 27/00 玻璃製品之熱強化**（纖維之後處理見 37/10）
- 27/004 • 利用使熱玻璃製品與固體冷卻表面，如砂粒相接觸 [5]
- 27/008 • 利用利用固體顆粒之昇華熱 [5]
- 27/012 • 利用熱處理，例如使結晶化；於冷卻淬火之前玻璃製品之熱處理（27/008、27/016 優先）[5]
- 27/016 • 利用吸收由玻璃製品輻射之熱

- [5]
- 27/02 • 利用液體 [3,5]
- 27/03 • • 該液體係熔融金屬或熔融鹽[5]
- 27/04 • 利用氣體 [3]
- 27/044 • • 對處於水平位置之平面或彎曲玻璃板 [5]
- 27/048 • • • 於一氣墊上 [5]
- 27/052 • • 對處於垂直位置之平面或彎曲玻璃板 [5]
- 27/056 • • • 支承於低邊上 [5]
- 27/06 • • 除平面或彎曲玻璃板之外玻璃製品之熱強化，如空心玻璃器皿，透鏡 [3]

29/00 使玻璃製品表面軟化或熔融之再加熱；火焰拋光；邊熔（纖維之後處理見 37/10）

- 29/02 • 間歇式者
- 29/04 • 連續式者
- 29/06 • • 玻璃製品水平位移 [5]
- 29/08 • • • 玻璃板 [5]
- 29/10 • • • • 於垂直位置 [5]
- 29/12 • • • • 沿流體如氣體或熔融金屬支承物上之水平位置 [5]
- 29/14 • • 製品之垂直位移 [5]
- 29/16 • • • 玻璃板 [5]

31/00 波紋或碎紋玻璃之製造

- 32/00 不包括於 25/00 至 31/00 目之玻璃產品熱加工後處理，如結晶化、消除所含氣體或其他雜質**（纖維之後處理見 37/10） [2]
- 32/02 • 熱晶化，如使玻璃體結晶形成微晶玻璃製品 [5]

33/00 冷玻璃之裁割（玻璃纖維之裁割見 37/16）

- 33/02 • 板玻璃之切割或分割；所用設備或機器（33/09 優先；玻璃切割工具見 33/10）[3]
- 33/023 • • 板處於水平位置 [5]
- 33/027 • • • 劃線工具之夾具；及其驅動機械 [5]

- 33/03 · · · 玻璃切割台；用以於切割或裁切操作中傳送或裝卸板之裝置 [5]
- 33/033 · · · 用以於玻璃板上擴大劃線之設備 [5]
- 33/037 · · · 控制或調節 [5]
- 33/04 · · 玻璃之曲線切割或分割，特別用於鏡片之製造
- 33/06 · 玻璃管、棒或空心製品之切割或分割（33/09 優先）[3]
- 33/07 · 裝甲玻璃或夾層玻璃製品之切割 [3]
- 33/08 · 熔化法
- 33/085 · · 管、棒或空心製品 [5]
- 33/09 · 熱衝擊法 [3]
- 33/095 · · 管、棒或空心製品 [5]
- 33/10 · 玻璃切割工具，如劃線工具
- 33/12 · · 手工工具 [3]
- 33/14 · · · 專門適用於切割管、棒或空心製品 [5]

35/00 玻璃製品於製造過程中之運輸 [2]

- 35/04 · 熱空心玻璃製品之運輸（35/26 優先）[3]
- 35/06 · · 熱空心玻璃製品往退火窯或熱窯內之送入 [3]
- 35/08 · · · 使用直接作用於製品上之旋轉裝置 [3]
- 35/10 · · · 使用直接作用於製品上之往復運動裝置，如推動器、送料器 [3]
- 35/12 · · · 採用托起或沈降法 [3]
- 35/14 · 熱玻璃板之運輸 [3]
- 35/16 · · 使用輥式運輸機 [3]
- 35/18 · · · 運輸機輥之結構 [3]
- 35/20 · · 使用兩用鉗或支架 [3]
- 35/22 · · 於流體支承床上，如金屬液上面 [3]
- 35/24 · · · 氣體支承床上 [3]
- 35/26 · 玻璃管或棒之運輸 [3]

37/00 由軟化的玻璃、礦物或渣製成的

絮片，纖維，或細絲之製造或處理

- 37/005 · 絮片之製造 [5]
- 37/01 · 玻璃纖維或細絲之製造 [3]
- 37/012 · · 拉製纖維或細絲用預製棒之製造 [4]
- 37/014 · · · 完全或部分用化學方法製造 [4]
- 37/016 · · · · 用液相反應工藝，例如利用凝膠相 [4]
- 37/018 · · · · 用玻璃基體上沈積玻璃法，例如用化學氣相沉積法（37/016 優先；用塗覆法之玻璃表面處理見 C03C 17/02）[4]
- 37/02 · · 拉製或擠壓法（37/04 優先）[3]
- 37/022 · · · 由熔融玻璃製造，其中產品包括不同種類之玻璃或以形狀特殊為特徵之玻璃，例如空心纖維 [4]
- 37/023 · · · · 由不同種類玻璃組成之纖維，例如光學纖維 [4]
- 37/025 · · · 由再加熱軟化的玻璃管、棒、纖維或細絲之製造 [3]
- 37/026 · · · · 拉製用金屬絲增強之纖維 [5]
- 37/027 · · · · 不同種類玻璃組成之纖維，例如光學纖維（37/028 優先）[4]
- 37/028 · · · · 拉製纖維束，例如製成多絲纖維束 [4]
- 37/029 · · · · 及其窯 [5]
- 37/03 · · · 拉製工具，例如拉製轉鼓 [3]
- 37/035 · · · · 具有撓曲或剝離纖維之工具 [3]
- 37/04 · · 用離心力法 [3]
- 37/05 · · · 用無徑向漏孔之旋轉體上之投射法 [3]
- 37/06 · · 用噴或吹玻璃液法，如用於製造定長纖維 [3]
- 37/065 · · · 由管、棒、纖維或細絲開始 [3]
- 37/07 · 控制或調節 [3]

- 37/075 • 製造不同種類或形狀特殊之玻璃纖維或細絲，例如空心纖維，波浪型纖維（37/022，37/027，37/028 優先）[3,4]
- 37/08 • 電熔白金坩堝；拉絲機頭；噴嘴或噴嘴板 [1,2006.01]
- 37/081 • • 間接熔化坩堝 [5]
- 37/083 • • 噴嘴，坩堝噴嘴板（37/095 優先）[5]
- 37/085 • • 其加料裝置 [3]
- 37/09 • • 電加熱者 [3]
- 37/092 • • • 直接電阻加熱 [5]
- 37/095 • • 及其使用材料 [3]
- 37/10 • 非化學處理（由玻璃、礦物或礦渣製的纖維或細絲之表面處理見 C03C 25/00）[1,2006.01]
- 37/12 • • 纖維或細絲繞緊時者 [3]
- 37/14 • • 纖維或細絲之再成形（37/025

優先）[3]

- 37/15 • • • 利用熱，例如用以製造纖維光學元件（光導波之耦合見 G02B 6/225；利用光導波之處理形成光學元件見 G02B 6/287）[5, 8]
- 37/16 • • 切割或分割（光導波見 G02B 6/25）[5]

40/00 玻璃與玻璃或玻璃與成型工具之間黏接的防止 [3]

- 40/02 • 用潤滑法；用釋放物或潤滑組成分之材料 [3]
- 40/027 • • 用以對玻璃成型模或工具施加潤滑劑之裝置 [5]
- 40/033 • • 防止玻璃與玻璃之間黏接之裝置 [5]
- 40/04 • 使用氣體 [3]

C03C 玻璃、釉或搪瓷釉之化學成分；玻璃之表面處理；由玻璃、礦物或礦渣製成的纖維或細絲之表面處理；玻璃與玻璃或與其他材料之接合

次類索引

化學成分

- 玻璃 1/00，3/00，4/00，6/00，
10/00 至 12/00
- 釉，搪瓷釉 1/00，8/00
- 微晶玻璃陶瓷 10/00
- 纖維或細絲 13/00
- 含非玻璃組成分之玻璃 14/00

表面處理

- 表面擴散法 21/00
- 塗層法 17/00
- 其他處理方法 15/00，19/00，23/00
- 纖維或細絲之表面處理 25/00
- 接合 27/00，29/00
- 特殊結構之玻璃 10/00 至 12/00，14/00

玻璃、釉或搪瓷釉之化學成分

附註

於 1/00 至 14/00 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明請放入最後適當位置。 [4]

1/00 製造玻璃、釉或搪瓷釉之普通的

組成分

- 1/02 • 經預處理之組成分
- 1/04 • 乳濁劑，如氟化物或磷酸鹽等；色料
- 1/06 • • 製造不均勻彩色製品，如具斑紋者、大理石紋者或紋理之製品用者
- 1/08 • 產生碎紋效果者
- 1/10 • 製造彩色之均勻透明製品者

3/00 玻璃組成（玻璃配合料組成見 6/00）[4]

3/04 • 含二氧化矽 [4]

附註

二氧化矽之用量若於 3/06、3/062 或 3/076 內之兩個目所包括之百分數範圍內之發明應分入相應之每一目，若於其中兩個以上之目所包括之百分數範圍內，僅分見 3/04 目。[4]

3/06 • • 用大於 90%（重量）之二氧化矽，如石英

3/062 • • 用小於 40%（重量）之二氧化矽 [4]

3/064 • • • 含硼 [4]

3/066 • • • • 含鋅 [4]

3/068 • • • • 含稀土元素 [5]

3/07 • • • 含鉛 [4]

3/072 • • • • 含硼 [4]

3/074 • • • • • 含鋅 [4]

3/076 • • 用 40%至 90%（重量）之二氧化矽 [4]

3/078 • • • 含二價金屬氧化物，例如鋅之氧化物 [4]

3/083 • • • 含氧化鋁或鐵之化合物 [4]

3/085 • • • • 含二價金屬氧化物 [4]

3/087 • • • • • 含氧化鈣，例如普通之平板玻璃或器皿玻璃[4]

3/089 • • • 含硼 [4]

3/091 • • • • 含鋁 [4]

3/093 • • • • • 含鋅或鋅 [4]

3/095 • • • 含稀土元素 [4]

3/097 • • • 含磷、鉍或鉍 [4]

3/102 • • • 含鉛 [4]

3/105 • • • • 含鋁 [4]

3/108 • • • • 含硼 [4]

3/11 • • • 含鹵素或氮 [4]

3/112 • • • • 含氟 [4]

3/115 • • • • • 含硼 [4]

3/118 • • • • • 含鋁 [4]

3/12 • 無二氧化矽之氧化物玻璃組成 [4]

3/14 • • 含硼 [4]

3/145 • • • 含鋁或鉍 [4]

3/15 • • • 含稀土元素 [4]

3/155 • • • • 含鋁、鈦、鉍或鉍 [4]

3/16 • • 含磷 [4]

3/17 • • • 含鋁或鉍 [4]

3/19 • • • 含硼 [4]

3/21 • • • 含鈦、鋁、鈦、鎢或鉍 [4]

3/23 • • 含鹵素及至少一種氧化物，如硼之氧化物 [4]

3/247 • • • 含氟及磷 [4]

3/253 • • 含鋁 [4]

3/32 • 非氧化物玻璃組成，例如鋁、矽或碲之二元或三元鹵化物，硫化物或氮化物 [4]

4/00 特殊性能玻璃的組成 [4]

附註

當分入 4/00 目時，按玻璃成分亦應分入 3/00 目中適當位置。[4]

4/02 • 著色玻璃 [4]

4/04 • 光敏玻璃 [4]

4/06 • • 光變色或光致變色玻璃 [4]

4/08 • 選擇性吸收指定波長輻射之玻璃 [4]

4/10 • 透紅外線玻璃 [4,2006.01]

4/12 • 發光玻璃；螢光玻璃 [4]

4/14 • 導電玻璃 [4]

4/16 • 介電玻璃 [4]

4/18 • 離子感光玻璃 [4]

4/20 • 耐化學玻璃 [4]

6/00 玻璃配合料組成（配合料之單個成分見 1/00）[4]

附註

本目內所包括之組成係須將其各組成分充分加熱熔化成玻璃，例如玻璃冷裝窯料。[4]

6/02 • 含矽酸鹽，例如碎玻璃料 [4]

- 6/04 • 含未化合之二氧化矽，例如砂[4]
- 6/06 • 含鹵素化合物 [4]
- 6/08 • 含粒化料或燒結塊 [4]
- 6/10 • 含礦渣 [4]
- 8/00 搪瓷；釉；含有非熔塊添加劑之玻璃料熔封成分 [4,2006.01]**
- 8/02 • 熔塊之組成，即粉狀或粒狀者[4]
- 8/04 • • 含鋅 [4]
- 8/06 • • 含鹵素 [4]
- 8/08 • • 含磷 [4]
- 8/10 • • 含鉛 [4]
- 8/12 • • • 含鈦或鋇 [4]
- 8/14 • 含有非熔塊添加劑之玻璃料混合物，例如乳濁劑、著色劑、球磨添加劑 [4]
- 8/16 • • 含有載體或懸浮劑，例如料漿 [4]
- 8/18 • • 含游離金屬 [4]
- 8/20 • • 含鈦化合物；含鋇化合物 [4]
- 8/22 • 含兩種或兩種以上不同成分之熔塊 [4]
- 8/24 • 含有非熔塊添加劑之玻璃料熔封成分，即用作不相同材料之間之封接料，例如玻璃與金屬；玻璃焊料 [4]
- 10/00 微晶玻璃陶瓷，即結晶相分散於玻璃相內，並至少為總組成之50%（重量）之微晶玻璃 [4]**
- 10/02 • 非二氧化矽及非矽酸鹽結晶相，例如尖晶石、鈦酸鋇 [4]
- 10/04 • 矽酸鹽或多矽酸鹽結晶相，如莫來石、透輝石、硝石、斜長石 [4]
- 10/06 • • 二價金屬氧化物之鋁矽酸鹽結晶相，例如鈣長石、礦渣陶瓷 [4]
- 10/08 • • • 鋁矽酸鎂，例如堇青石 [4]
- 10/10 • • 鹼金屬鋁矽酸鹽結晶相 [4]
- 10/12 • • • 鋰鋁矽酸鹽，例如鋰輝石、鋰霞石 [4]
- 10/14 • 二氧化矽結晶相，例如填塞石英，方石英 [4]

- 10/16 • 含鹵素之結晶相 [4]

11/00 泡沫玻璃

12/00 玻璃粉（8/02 優先）；玻璃珠之成分 [4]

- 12/02 • 反射玻璃珠 [4]

13/00 玻璃纖維或細絲之成分（纖維或細絲之製造見 C03B 37/00）

- 13/02 • 含鈦或鋇之化合物 [4]
- 13/04 • 光學纖維，例如纖維芯及包層之成分[4, 8]
- 13/06 • 礦物纖維，例如礦渣棉、礦物棉、岩棉 [4]

14/00 含非玻璃組份之玻璃組成，例如含有分布於玻璃基質內之纖維、細絲、晶鬚、小片狀體或其他類似物之成份（玻璃配合料組成見 6/00；微晶玻璃陶瓷見 10/00）[4]

玻璃之表面處理；由玻璃、礦物或礦渣製成的纖維或細絲之表面處理

附註

專用於增強在砂漿，混凝土，人造石頭或類似物內之填充性能之材料之處理分見 C04B 次類。[4]

15/00 非纖維或細絲型態玻璃之表面處理，用蝕刻法

- 15/02 • 用於製造光滑表面

17/00 非纖維或細絲型態玻璃如失透玻璃之表面處理，用塗覆法

- 17/02 • 用玻璃（17/34，17/44 優先）[3]
- 17/04 • • 用玻璃粉結法
- 17/06 • 用金屬（17/34，17/44 優先）[3]
- 17/09 • • 採用由氣相沉積 [3]
- 17/10 • • 採用由液相沈積
- 17/22 • 用其他之無機材料（17/34，17/44 優先）[4]
- 17/23 • • 氧化物（17/02 優先）[3]

- 17/245 . . . 採用由氣相沉積 [3]
- 17/25 . . . 採用由液相沈積 [3]
- 17/27 . . . 採用預塗層之氧化法 [3]
- 17/28 . 用有機材料 (17/34, 17/44 優先) [3]
- 17/30 . . 用含矽化合物
- 17/32 . . 用合成或天然樹脂 (17/30 優先)
- 17/34 . 用至少兩種不同成分之塗層 (17/44 優先) [3]
- 17/36 . . 至少一種塗層係金屬 [3]
- 17/38 . . . 至少一種塗層係有機材料 [3]
- 17/40 . . . 所用塗層均為金屬塗層 [3]
- 17/42 . . 至少一個有機材料之塗層及至少一個非金屬塗層 [3]
- 17/44 . 上光 [3]

19/00 用機械方法進行玻璃表面處理
(玻璃之噴砂、研磨或拋光見 B24)

21/00 利用表面離子或金屬擴散法處理纖維或絲之外之玻璃

23/00 非纖維狀玻璃之其他表面處理

25/00 由玻璃、礦物或礦渣製成的纖維或細絲之表面處理
[1,2006.01,2018.01]

附註 [2018.01]

- (1) 於 25/24 至 25/48 各目中，應用末位優先規則，即在各階層中，若無相反指示，請放入最後適當位置。
- (2) 將塗層組合物，即兩種或多種成分的混合物，請依據末位規則放入包含至少一種成分的 25/24 至 25/42 目的最後適當位置。
- (3) 當分類入 25/24 至 25/42 目中時，任何一種單獨成份，即，塗層組合物的化合物或成分，利用附註(2)的分類不能確定，而且確定它本身是新穎的

且非顯而易見，也必須將其放入 25/24 至 25/42 目的最後適當位置。

- (4) 當分類入 25/24 至 25/42 目中時，如果塗層組合物的任何一種單獨成份不能根據附註(2)或附註(3)的分類確定，而被認為代表了對檢索重要的資訊，還可以將其分入 25/24 至 25/42 目。例如在使用分類號組合對於塗層組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為“附加資訊”。

- (5) 當分類入 25/1025 至 25/1095 目中時，塗層組合物也必須根據附註(1)至(4)被分類入 25/24 至 25/54 的一個或多個目中
- (6) 當分類入 25/48 目中時，任何一種單獨塗層，而且確定它本身是新穎的且非顯而易見，也必須根據附註(1)至(4)被分類入 25/24 至 25/42 目中

- 25/002 . 熱處理 [2018.01]
- 25/005 . 以機械方式 [2018.01]
- 25/007 . 用溶液浸漬；溶液摻雜或多孔玻璃的分子填充 [2018.01]
- 25/10 . 塗層 [7,2006.01,2018.01]
- 25/1025 . . 以獲得用來增強以水泥為基料之製品的纖維 [2018.01]
- 25/104 . . 以獲得光纖 [2018.01]
- 25/105 . . . 有機被覆層 [2018.01]
- 25/106 . . . 單一被覆 [2018.01]
- 25/1065 . . . 多層被覆 [2018.01]
- 25/1095 . . 以獲得塗層織物 [2018.01]
- 25/12 . . 塗層之一般方法；其有關裝置 [7,2006.01]
- 25/14 . . . 噴霧法 [7,2006.01,2018.01]
- 25/143 用於連續纖維 [2018.01]
- 25/146 用於懸浮於氣態介質中的纖維 (25/143 優先)

- [2018.01]
- 25/16 . . . 浸漬法 [7]
- 25/18 . . . 擠壓 [7,2006.01]
- 25/20 . . . 以諸如滾筒等塗佈器具接觸纖維 [7]
- 25/22 . . . 利用從氣相沉積方式 [7,2006.01,2018.01]
- 25/223 . . . 利用化學氣相沉積或熱解 [2018.01]
- 25/226 . . . 利用濺射 [2018.01]
- 25/24 . . 含有機材料之塗層 [7,2006.01,2018.01]
- 25/25 . . . 非高分子化合物 [2018.01]
- 25/255 . . . 油、蠟、脂肪或其衍生物 [2018.01]
- 25/26 . . . 高分子化合物或預聚合物 [7,2006.01,2018.01]
- 25/27 . . . 橡膠乳膠 [2018.01]
- 25/28 . . . 經由僅涉及碳—碳不飽和鍵之反應獲得 [7,2006.01,2018.01]
- 25/285 . . . 丙烯酸樹脂 [2018.01]
- 25/30 . . . 聚烯烴 [7,2006.01,2008.01]
- 25/305 . . . 聚氟烯烴 [2018.01]
- 25/32 . . . 除僅涉及碳—碳不飽和鍵之外之反應獲得 [7,2006.01,2018.01]
- 25/321 . . . 澱粉；澱粉衍生物 [2018.01]
- 25/323 . . . 聚酯，例如醇酸樹脂 [2018.01]
- 25/325 . . . 聚碳酸酯 [2018.01]
- 25/326 . . . 聚脲；聚氨酯 [2018.01]
- 25/328 . . . 聚醯胺 [2018.01]
- 25/34 . . . 諸如與酚、尿素、三聚氰胺、醯胺或胺類形成之醛縮合聚合體 [7]
- 25/36 . . . 環氧樹脂 [7]
- 25/38 . . . 有機金屬化合物 [7]
- 25/40 . . . 有機矽化合物 [7]
- 25/42 . . 含無機材料之塗層 [7]
- 25/44 . . . 碳，例如石墨 [7]
- 25/46 . . . 金屬 [7]
- 25/465 . . 含複合材料之塗層 [2018.01]
- 25/47 . . . 含顆粒、纖維或薄片，例如在連續相中 [2018.01]
- 25/475 . . . 含著色劑 [2018.01]
- 25/48 . . 含兩種或以上不同成分之塗層 [7]
- 25/50 . . . 僅含有機材料之塗層 [7]
- 25/52 . . . 僅含無機材料之塗層 [7]
- 25/54 . . . 至少一層有機材料與至少一層無機材料之組合 [7]
- 25/60 . 利用離子或金屬擴散進入表面方式 [7,2006.01,2018.01]
- 25/601 . . 在液相中，例如用溶液或熔融鹽 [2018.01]
- 25/602 . . . 在鹼離子間進行離子交換 (25/605 優先) [2018.01]
- 25/603 . . . 在施加電位差的情況下 [2018.01]
- 25/605 . . . 將金屬或金屬離子，例如銀或銅，引入玻璃中 [2018.01]
- 25/607 . . 在氣相中 [2018.01]
- 25/608 . . 在固相中，例如使用糊劑或粉末 [2018.01]
- 25/62 . 利用電能或波動能（用來乾燥或脫水則見 25/64）；利用粒子輻射或離子注入 [7,2006.01,2018.01]
- 25/6206 . . 電磁波 [2018.01]
- 25/6208 . . . 雷射 [2018.01]
- 25/621 . . . 微波 [2018.01]
- 25/6213 . . . 紅外線 [2018.01]
- 25/622 . . . 可見光 [2018.01]
- 25/6226 . . . 紫外線 [2018.01]
- 25/624 . . . X 射線 [2018.01]
- 25/6246 . . . γ 伽馬射線 [2018.01]
- 25/626 . . 粒子輻射或離子注入 [2018.01]
- 25/6266 . . . 電子、質子或 α 粒子 [2018.01]
- 25/6273 . . . 中子 [2018.01]
- 25/628 . . . 原子 [2018.01]
- 25/6286 . . . 離子注入 [2018.01]
- 25/6293 . . 電漿或電量放電 [2018.01]

- 25/64 • 乾燥；脫水；脫羥基作用 [7]
- 25/66 • 化學處理，例如瀝瀘、酸或鹼處理（脫羥基作用則見 25/64） [7]
- 25/68 • • 以蝕刻方式 [7]
- 25/70 • 清理淨化，例如為了重複使用（25/62 至 25/66 優先） [7]

玻璃與玻璃或與其他材料之接合

附註

27/00 或 29/00 目中夾層製品亦分見 B32B 次類。

27/00 玻璃製件與其他無機材料製件之接合；玻璃與玻璃之非熔化法接合（17/00 優先；熔封成分見 8/24；夾絲玻璃見 C03B；玻璃與陶瓷之接合見 C04）

- 27/02 • 將玻璃直接熔化於金屬上
- 27/04 • 利用夾層使玻璃與金屬接合
- 27/06 • 玻璃與玻璃之非熔融法接合
- 27/08 • • 借助於中介金屬
- 27/10 • • 借助於專用的黏合劑
- 27/12 • • • 夾層玻璃（其夾層製造中部分為塑膠之夾層玻璃之機械特徵見 B32B）

29/00 利用玻璃接合金屬

C04 水泥；混凝土；人造石；陶瓷；耐火材料 [4]**附註**

本類內不包括已列入其他類之機械特徵部分，例如機械加工見 B28，窯見 F27。

C04B 石灰；氧化鎂；礦渣；水泥；其組合物，例如砂漿、混凝土或類似之建築材料；人造石；陶瓷（微晶玻璃陶瓷見 C03C 10/00）；耐火材料（難熔金屬合金見 C22C）；天然石之處理 [4]

附註

本次類中，下列名詞之意義如下：

- “填料”包括顏料，砂石及纖維強化材料；
- “活性成分”包括加工助劑或性質改善劑，如燃燒程序後或無燃燒程序中使用之研磨助劑；
- “砂漿”，“混凝土”及“人造石”被視為單一之材料群，因此，若無相反指示，其包括砂漿，混凝土及其它水泥組合物。[6]

次類索引

石灰；氧化鎂；礦渣.....	2/00，5/00	後處理.....	41/00
水泥.....	7/00 至 12/00	陶瓷	
砂漿；混凝土；人造石		黏土製品.....	33/00
組合物.....	26/00 至 32/00	其他陶瓷.....	35/00
填料.....	14/00 至 20/00	黏接.....	37/00
有效成分.....	22/00，24/00	多孔製品.....	38/00
多孔產品.....	38/00	後處理.....	41/00
影響或改變砂漿之性質.....	40/00	天然石之處理.....	41/00

石灰；氧化鎂；礦渣

2/00 石灰、氧化鎂或白雲石 [4]

2/02 • 石灰 [4]

2/04 • • 消化 [4]

2/06 • • • 附加物質，例如疏水劑 [4]

2/08 • • • 消化裝置 [4]

2/10 • 預熱，焙燒，煅燒或冷卻（水泥原料焙燒時之脫碳見 7/43） [4]

2/12 • • 於豎窯或立式窯內 [4]

5/00 熔渣之處理（礦渣棉製造見

C03B；與金屬生產有關之礦渣處理見 C21B、C22B）；用熔渣製造的人造石 [1,4,2006.01]

5/02 • 造粒（造粒設備見 B01J 2/00）；脫水；乾燥

5/06 • 加入熔渣內之成分（水除外）；用氣體或產生氣體之材料處理，例如為製取多孔礦渣 [4]

水泥

附註

於 7/00 至 32/00 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明請放入最後適當位置上。[4, 8]

7/00 水硬性水泥

- 7/02 • 矽酸鹽水泥
- 7/04 • • 使用含石膏之原料
- 7/06 • • 使用鹼性原料
- 7/12 • 天然火山灰；天然火山灰水泥 [4]
- 7/13 • • 與無機黏結材料之混合物，例如矽酸鹽水泥 [4]
- 7/14 • 含礦渣之水泥
- 7/147 • • 冶金渣 [4]
- 7/153 • • • 與其他無機黏結材料或活化劑之混合物 [4]
- 7/17 • • • • 與含有活化劑之氧化鈣 [4]
- 7/19 • • • • • 矽酸鹽水泥 [4]
- 7/21 • • • • 與含有活化劑之硫酸鈣[4]
- 7/22 • 鐵礦石水泥
- 7/24 • 用油頁岩、殘渣或爐渣之外的廢物製造之水泥 [4]
- 7/26 • • 用含煙灰之原料製成者
- 7/28 • • 用燃燒殘餘物製成者（7/26 優先）[4]
- 7/30 • • 用油頁岩製成者；用油頁岩殘渣製成者 [4]
- 7/32 • 高鋁水泥
- 7/34 • 水硬性石灰水泥；羅馬水泥
- 7/345 • 於 7/02 至 7/34 等一個目中未被包括之水硬性水泥 [4]
- 7/36 • 普通水硬性水泥之製造
- 7/38 • • 單獨或作為批料製備或處理原料 [4]
- 7/40 • • • 脫水；成型，如造粒（造粒設備見 B01J 2/00）
- 7/42 • • • 於焙燒過程之前或焙燒過程中加入之有效成分
- 7/43 • • 熱處理，例如預煅燒，焙燒，熔融；冷卻 [4]

- 7/44 • • • 焙燒；熔融 [4]
- 7/45 • • • • 於流化床內 [4]
- 7/46 • • • • 電法 [4]
- 7/47 • • • 冷卻 [4]
- 7/48 • • 熟料處理（7/47 優先）[4]
- 7/51 • • • 水化 [4]
- 7/52 • • • 粉磨
- 7/60 • • 去除鹼金屬或其化合物之方法

9/00 鎂質水泥或類似的水泥

- 9/02 • 含氯化物之鎂質水泥，如索瑞耳水泥
- 9/04 • 含硫酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽或氟化物之鎂質水泥
- 9/06 • 含有除鎂化合物之外的金屬化合物，例如含鋅或鉛化合物之水泥
- 9/11 • 與其他無機黏結材料之混合物 [4]
- 9/12 • • 與水硬性水泥，例如矽酸鹽水泥 [4]
- 9/20 • 製造，例如批料製備（石灰石，菱鎂礦或白雲石之預熱、焙燒、煅燒或冷卻見 2/10）

11/00 硫酸鈣水泥

- 11/02 • 石膏下脫水
- 11/024 • • 於煅燒過程之前或煅燒期間加入之成分，例如煅燒改性劑 [4]
- 11/028 • • 煅燒設備 [4]
- 11/032 • • • 用於濕法者，例如於溶液內或於飽和蒸汽條件下脫水者 [4]
- 11/036 • • • 用於乾法者，例如於流化床內或回轉窯中脫水者 [4]
- 11/05 • 製取硬石膏（11/028 優先）[4]
- 11/06 • 用硬石膏作原料 [4]
- 11/26 • 用含磷石膏或廢物，例如煙之純化產物，作原料（11/02 優先）[4]
- 11/28 • 與其他無機黏結材料之混合物（7/04、7/153 優先）[4]
- 11/30 • • 與水硬性水泥，例如矽酸鹽水泥 [4]

12/00 7/00 至 11/00 各目不包括的水泥 [4]

12/02 • 磷酸鹽水泥 [4]

12/04 • 鹼金屬或銨之矽酸鹽水泥 [4]

用作砂漿，混凝土或人造石之填充材料 [4]**14/00 於砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料內使用無機材料作為填充料，例如顏料；為增強其於砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料內之填充性能而專門採用的無機材料之處理（建築之補強構件見 E04C 5/00） [4]**

14/02 • 顆粒材料 [4]

14/04 • • 富矽材料；矽酸鹽 [4]

14/06 • • • 石英；砂 [4]

14/08 • • • 矽藻土 [4]

14/10 • • • 黏土 [4]

14/12 • • • • 膨脹黏土 [4]

14/14 • • • • 火成礦物 [4]

14/16 • • • • 多孔者，例如浮石 [4]

14/18 • • • • 珍珠岩 [4]

14/20 • • • • 雲母；蛭石 [4]

14/22 • • • • 玻璃 [4]

14/24 • • • • 多孔者，例如泡沫玻璃

14/26 • • 碳酸鹽 [4]

14/28 • • • 鈣者 [4]

14/30 • • 氧化矽之外的氧化物 [4]

14/32 • • 碳化物；氮化物；硼化物

14/34 • • 金屬 [4]

14/36 • • 14/04 至 14/34 各目未包括的無機材料 [5]

14/38 • 纖維材料；晶鬚 [4]

14/40 • • 石棉 [4]

14/42 • • 玻璃 [4]

14/44 • • • 提高耐鹼性之處理 [4]

14/46 • • 礦棉 [4]

14/48 • • 金屬 [4]

16/00 使用有機材料作為砂漿、混凝土、人造石或其他類材料之填充

料，例如顏料；為提高其於砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料內之填充性能而專門採用的有機材料之處理（建築之補強構件見 E04C 5/00）

16/02 • 纖維素材料 [4]

16/04 • 高分子化合物（16/02 優先） [4]

16/06 • • 纖維狀 [4]

16/08 • • 多孔者，例如膨脹聚苯乙烯珠粒 [4]

16/10 • • • 提高與砂漿可混性之處理 [4]

16/12 • 以形狀為特徵者（纖維狀高分子化合物見 16/06；多孔高分子化合物見 16/08） [4]

18/00 使用燒結料、廢料或廢物作為砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料之填充料；為提高其於砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料內之填充性能而專門採用的燒結料，廢料或廢物之處理（建築之補強構件見 E04C 5/00） [4,2006.01]

18/02 • 燒結材料 [4]

18/04 • 廢料；廢物 [4]

18/06 • • 燒燒殘渣，例如煙、煙霧或廢氣純化產物 [4]

18/08 • • • 煙道塵 [4]

18/10 • • • 燃燒廢物 [4]

18/12 • • 來自採石，採礦或類似之廢料 [4]

18/14 • • 冶金廢料（熔渣處理見 5/00） [4]

18/16 • • 建築工業或陶瓷工業中者 [4,2006.01,2023.01]

18/162 • • • 水泥窯粉塵；石灰窯粉塵 [2023.01]

18/165 • • • 陶瓷廢料 [2023.01]

18/167 • • • 回收材料，即生產相同材料時再利用的廢料 [2023.01]

18/18 • • 有機者（18/10 優先） [4]

18/20 • • • 高分子化合物者 [4]

- 18/22 橡膠 [4]
- 18/24 . . . 植物廢物，例如稻殼、玉米
芯廢物；纖維素材料，例如
紙 [4]
- 18/26 木質者，例如鋸末、刨花
[4]
- 18/28 礦化；所用之組合物 [4]
- 18/30 . . 混合廢物；未知組成之廢物，
例如城市廢物(18/10 優先)[4]

**20/00 於 14/00 至 18/00 一個以上之目
內作為砂漿、混凝土、人造石或
其他類似材料內之填料使用
者，以形狀或粒度分布為特點之
材料；於 14/00 至 18/00 一個以
上之目內做為增強其於砂漿、混
凝土、人造石或其他類似材料內
之填充性能而專門採用的材料
之處理；膨脹材料或脫纖維材料
(建築之補強構件見 E04C 5/00)
[4]**

- 20/02 . 處理 [4]
- 20/04 . . 熱處理 [4]
- 20/06 . . . 膨脹黏土、珍珠岩、蛭石或
其他類似之粒狀材料 [4]
- 20/08 . . 石棉之脫纖維 [4]
- 20/10 . 塗敷或浸漬 [4]
- 20/12 . . 多層塗敷或浸漬 [4]

用做有效成分之材料 [4]

附註

- (1) 與水泥化合物反應形成新物相
或改變物相並且於硬化過程之
前加入的有效成分，及做為其他
水泥之摻和料加入的水泥分入
7/00 至 12/00 內，例如分入 7/42
目。[4,8]
- (2) 在 22/00 至 24/00 目中，最好加
入 103/00 目之索引碼。[6, 8]

22/00 使用無機材料做為砂漿、混凝

**土、人造石或其他類似材料之有
效成分，例如促凝劑 [4]**

- 22/02 . 元素 [4]
- 22/04 . . 金屬，例如用做發泡劑之鋁[4]
- 22/06 . 氧化物；氫氧化物 [4]
- 22/08 . 酸或其鹽類 [4]
- 22/10 . . 陰離子內含碳者，例如碳酸鹽
[4]
- 22/12 . . 陰離子內含鹵素者，例如氯化
鈣 [4]
- 22/14 . . 陰離子內含硫者，例如硫化物
[4]
- 22/16 . . 陰離子內含磷者，例如磷酸鹽
[4]

**24/00 使用有機化材料作為砂漿、混凝
土、人造石或其他類似材料之有
效成分，例如增塑劑 [4]**

- 24/02 . 醇類；酚類；醚類 [4]
- 24/04 . 羧酸；此等之鹽、酸酐或酯 [4]
- 24/06 . . 含羥基者 [4]
- 24/08 . 脂肪；脂肪油；酯蠟；高級脂肪
酸，即於羧基連接的一個未斷鏈
上至少有七個碳原子者；經氧化
之油或脂肪 [4]
- 24/10 . 碳水化合物或其衍生物 [4]
- 24/12 . 含氮化合物 [4]
- 24/14 . . 肽；蛋白質；此等之衍生物 [4]
- 24/16 . 含硫化合物 [4]
- 24/18 . . 木質素磺酸或其衍生物，例如
亞硫酸鹽鹼液 [4]
- 24/20 . . 磺化之芳族化合物 [4]
- 24/22 . . . 縮合產物 [4]
- 24/24 . 高分子化合物(24/14 優先；含磺
酸鹽或硫酸鹽之高分子化合物入
24/16) [4,6]
- 24/26 . . 僅由碳一碳不飽和鍵反應而得
者 [4]
- 24/28 . . 不由碳一碳不飽和鍵反應而得
者 [4]
- 24/30 . . . 醛或酮之縮聚物 [4]
- 24/32 . . . 聚醚，例如烷基酚聚乙二醇
醚 [4]

- 24/34 · · 天然樹脂，例如松香 [4]
- 24/36 · · 瀝青材料，例如焦油、瀝青[4]
- 24/38 · · 多糖或其衍生物 [4]
- 24/40 · 含矽、鈦或鋅之化合物 [4]
- 24/42 · · 含有一個或多個碳—矽鍵之化合物 [4]

砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料之組合物 [4]

附註

(1) 依據末位規則，分入 26/00 至 32/00 目中且確定其本身是新穎的、非顯而易見的砂漿、混凝土或人造石組合物中的任何組成分，也必需分入 7/00 至 24/00 目中的最後適當位置。[4,8]

(2) C04B 砂漿、混凝土或人造石組合物的任何一種成分，依據末位規則不能確定分入 26/00 至 32/00 目中，而該成分被認為代表了對檢索重要的資訊，也可以將其分入 7/00 至 24/00 目的最後適當位置。例如，使用分類號組合對於組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為“附加資訊”給出。例如，一種詳細定義的含有黏土作為其主要或特徵性填料的矽酸鹽水泥（Portland cement）砂漿混合物分入 28/04，並可以另外分入 14/10。[4,8]

(3) 在 26/00 至 32/00 目中，最好加入 111/00 目之索引碼。[6, 8]

26/00 僅含有機黏結劑之砂漿、混凝土、人造石或其他類似材料之組合物 [4]

- 26/02 · 高分子化合物 [4]
- 26/04 · · 僅由碳—碳不飽和鍵反應而得者 [4]
- 26/06 · · · 丙烯酸鹽 [4]

- 26/08 · · · 含鹵素者 [4]
- 26/10 · · 不僅由碳—碳不飽和鍵反應而得者 [4]
- 26/12 · · · 醛或酮之縮聚物 [4]
- 26/14 · · · 聚環氧化合物 [4]
- 26/16 · · · 聚胺基甲酸酯 [4]
- 26/18 · · · 聚脂；聚碳酸酯 [4]
- 26/20 · · · 聚醯胺 [4]
- 26/22 · · 天然樹脂，例如松香 [4]
- 26/24 · · · 纖維素廢液，例如亞硫酸鹼液 [4]
- 26/26 · · 瀝青材料，例如焦油、瀝青 [4]
- 26/28 · · 多糖或其衍生物 [4]
- 26/30 · 具有一個或多個碳—金屬鍵或碳—矽鍵之化合物 [4]
- 26/32 · · 含矽者 [4]

28/00 含有無機黏結劑或含有無機與有機黏結劑之反應產物的砂漿、混凝土人造石或其他類似材料之組合物，例如多元羧酸鹽水泥 [4]

- 28/02 · 含有除硫酸鈣之外的水硬性水泥 [4]
- 28/04 · · 矽酸鹽水泥 [4]
- 28/06 · · 高鋁水泥 [4]
- 28/08 · · 礦渣水泥 [4]
- 28/10 · · 石灰水泥或氧化鎂水泥 [4]
- 28/12 · · · 水硬性石灰 [4]
- 28/14 · 含硫酸鈣水泥者 [4]
- 28/16 · · 含無水石膏者 [4]
- 28/18 · 含氧化矽—石灰型混合物者 [4]
- 28/20 · · 灰砂 [4]
- 28/22 · · 石灰及火山灰 [4]
- 28/24 · 含烷基銨或鹼金屬矽酸鹽者；含矽膠者 [4]
- 28/26 · · 鹼金屬矽酸鹽 [4]
- 28/28 · 含有機多元酸者，例如多元羧酸鹽水泥 [4]
- 28/30 · 含鎂質水泥者（氧化鎂水泥見 28/10） [4]
- 28/32 · · 氧氯化鎂水泥，例如索瑞耳水

泥 [4]

28/34 · 含磷酸鹽冷黏結劑者 [4]

28/36 · 含硫、硫化物或硒者 [4]

30/00 不含黏結劑之人造石或其他類似材料之組合物（由熔渣製造人造石見 5/00） [4]

30/02 · 含有纖維狀材料者 [4]

32/00 本次類其他目未包括的人造石（由熔渣製造人造石見 5/00） [4]

32/02 · 有鋼筋者 [4]

陶瓷

33/00 黏土製品（耐火泥或搗固料見 35/66；多孔製品見 38/00） [2]

33/02 · 製備或處理原料，單個的原料或配合料

33/04 · · 黏土；高嶺土 [4]

33/06 · · · 消除石灰之有害作用

33/08 · · · · 防止粉化

33/10 · · 去除鐵質或氧化鈣

33/13 · · 配料成分（33/36，35/71 優先） [2]

33/132 · · · 廢料；廢物（33/16 優先） [8]

33/135 · · · · 燃燒殘渣，例如飛灰、焚燒廢料 [8]

33/138 · · · · 冶金工藝廢料，例如爐渣、爐灰、電沉廢料 [8]

33/14 · · · 著色料

33/16 · · · 瘠料，如黏土熟料，石英

33/18 · · · 用於熔化配合料者

33/20 · · 用於乾壓工藝者（33/13 優先）

33/22 · 黏土熟料製品

33/24 · 瓷器或白陶瓷器製造

33/26 · · 電絕緣瓷器之製造

33/28 · 泥漿注漿成型

33/30 · 乾燥方法

33/32 · 焙燒方法

33/34 · · 與施釉結合者

33/36 · 增強的黏土製品 [2]

35/00 以成分為特徵之陶瓷成型製

品；陶瓷組合物（含有不用做巨觀增強劑者、黏接於碳化物、金剛石、氧化物、硼化物、氮化物、矽化物上游離金屬者，例如金屬陶瓷，或其他金屬化合物，例如氮氧化合物或硫化物者見 C22C）；用於製備陶瓷製品之無機化合物加工粉末 [4]

附註

(1) 在本目內，若無相反指示，組合物請依據主成分規則分類。 [3]

(2) 在本目內，鎂被視為鹼土金屬。 [6]

(3) 在本目內，合成物被視為不同粉末物質之泉華混合物，除了泉華酸之外，該等物質在泉華產物中為分離相存在。 [6]

(4) 在本目內，精密陶瓷被視為具有聚結晶微細結構之產物，例如低於 100 微米尺寸。 [6]

(5) 陶瓷粉末產物在本目內之分類關連於具特定特徵之粉末之製備。 [6]

35/01 · 以氧化物為基料者 [6]

35/03 · · 以白雲石衍生之氧化鎂、氧化鈣或氧化物混合物為基料者 [6]

35/035 · · · 來自包含非氧化物耐火材料（如碳）之粒狀大小混合物之耐火物 [6]

35/04 · · · 以氧化鎂為基料者 [6]

35/043 · · · · 來自粒狀大小混合物之耐火物 [6]

35/047 · · · · · 包含氧化鉻或鉻礦 [6]

35/05 · · · · 利用熔解鑄造之耐火物 [6]

35/053 · · · · 精密陶瓷 [6]

35/057 · · · 以氧化鈣為基料者 [6]

35/06 · · · 以來自白雲石之氧化物混合

- 物為基料者
- 35/08 . . . 以氧化鋁為基料者 [6]
- 35/10 . . . 以氧化鋁為基料者 [6]
- 35/101 . . . 來自粒狀大小混合物之耐火物 [6]
- 35/103 . . . 包含非氧化物耐火材料，如碳（35/106 優先） [6]
- 35/105 . . . 包含氧化鉻或鉻礦 [6]
- 35/106 . . . 包含氧化鋯或鋯英石（ $ZrSiO_4$ ） [6]
- 35/107 . . . 利用熔解燒造之耐火物 [6]
- 35/109 . . . 包含氧化鋯或鋯英石（ $ZrSiO_4$ ） [6]
- 35/111 . . . 精密陶瓷 [6]
- 35/113 . . . 以 β - 氧化鋁為基料者 [6]
- 35/115 . . . 半透明或透明產物 [6]
- 35/117 . . . 複合物 [6]
- 35/119 . . . 含氧化鋯者 [6]
- 35/12 . . . 以氧化鉻為基料者（35/047，35/105 優先） [6]
- 35/14 . . . 以矽石為基料者 [6]
- 35/16 . . . 以黏土以外之矽酸鹽為基料者 [6]
- 35/18 . . . 高氧化鋁者 [6]
- 35/185 . . . 耐火矽酸鋁 [6]
- 35/19 . . . 鹼金屬鋁矽酸鹽，如鋰輝石 [6]
- 35/195 . . . 鹼土鋁矽酸鹽，如堇青石 [6]
- 35/20 . . . 高氧化鎂者 [6]
- 35/22 . . . 高氧化鈣者 [6]
- 35/26 . . . 以亞鐵酸鹽為基料者 [2,6]
- 35/28 . . . 以氧化鎳為主要氧化物者 [2,6]
- 35/30 . . . 含氧化鋅者 [2,6]
- 35/32 . . . 以氧化鈷為主要氧化物者 [2,6]
- 35/34 . . . 含氧化鋅者 [2,6]
- 35/36 . . . 以氧化錳為主要氧化物者 [2]
- 35/38 . . . 含氧化鋅者 [2,6]
- 35/40 . . . 含稀土氧化物者 [2,6]
- 35/42 . . . 以鉻鐵礦為基料者（35/047，35/105 優先） [2,6]
- 35/44 . . . 以鋁酸鹽為基料者 [2]
- 35/443 . . . 鋁酸鎂尖晶石 [6]
- 35/447 . . . 以磷酸鹽為基料者 [6]
- 35/45 . . . 以氧化銅或其與它種氧化物之固態溶液為基料者 [6]
- 35/453 . . . 以鋅、錫、鉍氧化物或其它種氧化物（如鋅酸鹽、錫酸鹽或鉍酸鹽）之固態溶液為基料者 [6]
- 35/457 . . . 以氧化錫或錫酸鹽為基料者 [6]
- 35/46 . . . 以氧化鈦或鈦酸鹽為基料者（亦包含鋯或鉛氧化物，鋯酸鹽或鉛酸鹽 35/49） [6]
- 35/462 . . . 以鈦酸鹽為基料者 [6]
- 35/465 . . . 以鹼土金屬鈦酸鹽為基料者 [6]
- 35/468 . . . 以鈦酸鋇為基料者 [6]
- 35/47 . . . 以鈦酸鋇為基料者 [6]
- 35/472 . . . 以鈦酸鉛為基料者 [6]
- 35/475 . . . 以鈦酸鉍為基料者 [6]
- 35/478 . . . 以鈦酸鋁為基料者 [6]
- 35/48 . . . 以鋯或鉛氧化物或鋯酸鹽或鉛酸鹽為基料者 [6]
- 35/482 . . . 來自粒狀大小混合物之耐火物 [6]
- 35/484 . . . 利用熔解鑄造之耐火物 [6]
- 35/486 . . . 精密陶瓷 [6]
- 35/488 . . . 複合物 [6]
- 35/49 . . . 亦包含氧化鈦或鈦酸鹽者 [3,6]
- 35/491 . . . 以鋯酸鉛及鈦酸鉛為基料者 [6]
- 35/493 . . . 亦包含其它鉛化合物者 [6]
- 35/495 . . . 以鈇、鈳、鉭、鉬、鎢氧化物或其它種氧化物（如鈇酸鹽、鈳酸鹽、鉭酸鹽、鉬酸鹽或鎢酸鹽）之固態溶液為基料者 [6]
- 35/497 . . . 以氧化鉛固態溶液為基料者 [6]
- 35/499 . . . 亦包含鈦酸鹽者 [6]

- 35/50 · 以稀土化合物為基料者
- 35/505 · · 以氧化釔為基料者 [6]
- 35/51 · 以鈦系化合物為基料者 [2]
- 35/515 · 以非氧化物為基料者 (35/50、35/51 優先) [6]
- 35/52 · · 以碳為基料者，如石墨 [6]
- 35/524 · · · 由聚合物先質獲得者，如類似玻璃之碳物質 [6]
- 35/528 · · · 由含或不含非有機成分之碳粒子獲得者 [6]
- 35/532 · · · · 包含可碳化之接著劑者 [6]
- 35/536 · · · 以膨脹石墨為基料者 [6]
- 35/547 · · 以硫化物或硒化物為基料者 [6]
- 35/553 · · 以氟化物為基料者 [6]
- 35/56 · · 以碳化物為基料者 [4]
- 35/563 · · · 以碳化硼為基料者 [6]
- 35/565 · · · 以碳化矽為基料者 [6]
- 35/567 · · · · 來自粒狀大小混合物之耐火物 [6]
- 35/569 · · · · 精密陶瓷 [6]
- 35/571 · · · · · 由聚合物先質獲得 [6]
- 35/573 · · · · · 由反應燒結獲得 [6]
- 35/575 · · · · · 由壓力燒結獲得 [6]
- 35/576 · · · · · 由無壓燒結獲得 [6]
- 35/577 · · · · · 複合物 [6]
- 35/58 · · 以硼化物、氮化物或矽化物為基料者 [4,6]
- 35/581 · · · 以氮化鋁為基料者 [6]
- 35/582 · · · · 複合物 [6]
- 35/583 · · · 以氮化硼為基料者 [6]
- 35/5831 · · · · 以立方體氮化硼為基料者 [6]
- 35/5833 · · · · 以六面體氮化硼為基料者 [6]
- 35/5835 · · · · 複合物 [6]
- 35/584 · · · 以氮化矽為基料者 [6]
- 35/586 · · · · 來自粒狀大小混合物之耐火物 [6]
- 35/587 · · · · 精密陶瓷 [6]
- 35/589 · · · · · 由聚合物先質獲得 [6]
- 35/591 · · · · · 由反應燒結獲得 [6]
- 35/593 · · · · · 由壓力燒結獲得 (35/594 優先) [6]
- 35/594 · · · · · 由燒結反應獲得一燒結產物，有或無壓 [6]
- 35/596 · · · · · 複合物 [6]
- 35/597 · · · 以矽氧氮化物為基料者 [6]
- 35/599 · · · · 以矽鋁氧氮化物為基料者 [SiAlON][6,2006.01]
- 35/622 · 形成程序；準備用於製造陶瓷產物之無機化合物加工粉末 [6]
- 35/624 · · 溶膠凝膠加工 [6]
- 35/626 · · 各別或批次製備或處理粉末 [6]
- 35/628 · · · 塗覆粉末 [6]
- 35/63 · · · 利用特別適於形成製品之添加劑 [6]
- 35/632 · · · · 有機添加劑 [6]
- 35/634 · · · · · 聚合物 (35/636 優先) [6]
- 35/636 · · · · · 多醣類或其衍生物 [6]
- 35/638 · · · · 移除 [6]
- 35/64 · · 燃燒或燒結程序 (33/22 優先) [6]
- 35/645 · · · 壓力燒結 [6]
- 35/65 · · · 包含游離金屬或游離矽之組合物之反應燒結 [3]
- 35/653 · · 包含熔化步驟之程序 [6]
- 35/657 · · · 用於製備耐火物 (35/05，35/107，35/484 優先) [6]
- 35/66 · 整塊耐火物或耐火物灰泥，包括是否含有黏土

附註

分入 35/66 目中的、水凝水泥 (如高鋁水泥) 的耐火砂漿組合物的任何一種成分，被認為代表了對檢索重要的資訊，請依據末位規則將其分入 7/00 至 24/00 目的最後適當位置。例如，使用分類號組合對於組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為“附加資訊”給出。例如，對於加入到砂漿組合物中的有機緩凝劑可以給出 24/00 目中的

分類作為附加分類。[8]

- 35/71 • 含有巨觀增強劑之陶瓷製品
(35/66 優先) [3,4]
- 35/74 • • 含成型金屬材料者 [2]
- 35/76 • • • 纖維、單絲、晶鬚、薄片或
其它類似材料 [2]
- 35/78 • • 含非金屬材料者 [2]
- 35/80 • • • 纖維、單絲、晶鬚、薄片或
其他類似材料 [2]
- 35/81 • • • • 晶鬚 [6]
- 35/82 • • • • 石棉；玻璃；熔融石英 [2]
- 35/83 • • • • 碳基質中之碳纖維 [6]

附註

本目中所涵蓋之製品通常為
“碳—碳複合物”。[6]

- 35/84 • • • 浸漬或塗覆材料 [2]
- 37/00 陶瓷燒成製品與另外陶瓷燒成
製品或其它製品之加熱法黏接**
- 37/02 • 與金屬製品黏接
- 37/04 • 與玻璃製品黏接
- 38/00 多孔灰泥、混凝土、人造石或陶
瓷製品；其製造方法（以氣體或
氣體發生材料處理礦渣見 5/06）
[4,6]**

附註[4]

以成分或組成為特徵之多孔灰
泥、混凝土、人造石或陶瓷製品
亦分入 2/00 至 35/00 各目內。

- 38/02 • 加入化學發泡劑 [4]
- 38/04 • 溶解出加入的物質 [4]
- 38/06 • 燒除加入的物質 [4]
- 38/08 • 加入多孔物質 [4]
- 38/10 • 使用起泡劑（38/02 優先）[4]
- 40/00 影響或改變灰泥、混凝土或人造
石組成之性質（例如其凝結或硬
化能力）之一般程序（藉由選擇有**

效成分見 22/00 至 24/00；特定組合
物之硬化見 26/00 至 28/00；形成多
孔、胞狀或減重見 38/00）[4,6]

- 40/02 • 硬化環境之選擇 [4]
- 40/04 • 防止拌合水之蒸發（永久性覆層
見 41/00）[4]
- 40/06 • 防止定型，例如易碎容器中含水
之延緩動作型之灰泥 [4]
- 41/00 砂漿，混凝土，人造石或陶瓷之
後處理；天然石之處理（冷釉料
之外的釉料見 C03C 8/00）[3]**

附註

(1) 在 41/00 目中，下列名詞之意
義為：

“灰泥”、“混凝土”與“人造
石”涵蓋初步成型後之材料。
[6, 8]

(2) 用相同材料或最後轉成相同
材料之物質處理（例如塗覆或
浸漬）材料，不視為本目所指
的後處理，而將其視為材料之
製備加以分類，例如浸有可碳
化物質之碳質物體分入 C04B
35/52）。[4]

(3) 於 41/45 至 41/80 各目內，適
用末位規則，即在各階層中，
若無相反指示，發明請放入最
後適當位置。[4]

- 41/45 • 塗覆或浸漬 [4]
- 41/46 • • 用有機材料 [4]
- 41/47 • • • 油、脂或蠟 [4]
- 41/48 • • • 高分子化合物 [4]
- 41/49 • • • 含一個或多個碳—金屬鍵或
碳—矽鍵之化合物 [4]
- 41/50 • • 用無機材料 [4]
- 41/51 • • • 金屬化 [4]
- 41/52 • • 多次塗覆或浸漬 [4]
- 41/53 • 包括由被處理的製品上去除部份
材料 [4]

- 41/60 · 僅對人造石者 [4]
- 41/61 · · 塗覆或浸漬 [4]
- 41/62 · · · 用有機材料 [4]
- 41/63 · · · · 高分子化合物 [4]
- 41/64 · · · · 含有一個或多個碳－金屬鍵或碳－矽鍵之化合物 [4]
- 41/65 · · · 用無機材料 [4]
- 41/66 · · · · 氟化物，例如用四氟化矽處理（ocration） [4]
- 41/67 · · · · 磷酸鹽 [4]
- 41/68 · · · · 矽酸鹽 [4]
- 41/69 · · · · 金屬 [4]
- 41/70 · · · 形成至少兩層具有不同組成之疊加層 [4]
- 41/71 · · · · 至少有一層係有機材料 [4]
- 41/72 · · 包括由被處理的製品上去除部分材料者，例如蝕刻 [4]
- 41/80 · 僅對陶瓷者 [4]
- 41/81 · · 塗覆或浸漬 [4]
- 41/82 · · · 用有機材料 [4]
- 41/83 · · · · 高分子化合物 [4]
- 41/84 · · · · 含有一個或多個碳－金屬鍵或碳－矽鍵之化合物 [4]
- 41/85 · · · 用無機材料 [4]
- 41/86 · · · · 釉料；冷釉料 [4]
- 41/87 · · · · 陶瓷 [4]
- 41/88 · · · · 金屬 [4]
- 41/89 · · · 形成至少兩層具有不同組成之疊加層者 [4]
- 41/90 · · · · 至少有一層係金屬 [4]
- 41/91 · · 包括由被處理的製品上去除部分材料者，例如蝕刻 [4]

涉及有效成分之功用或性質與主目 22/00 及 24/00 聯合使用之索引碼。
[6]

103/00 有效成分之功用或性質 [6]

- 103/10 · 加速劑 [6]
- 103/12 · · 定型加速劑 [6]
- 103/14 · · 硬化加速劑 [6]

- 103/20 · 延緩劑 [6]
- 103/22 · · 定型延緩劑 [6]
- 103/24 · · 硬化延緩劑 [6]
- 103/30 · 減水劑、塑化劑、混氣劑 [6]
- 103/32 · · 超塑化劑 [6]
- 103/40 · 表面活性劑；分散劑 [6,2006.01]
- 103/42 · 小孔形成劑 [6]
- 103/44 · 增厚劑、凝膠劑或黏度增加劑 [6]
- 103/46 · 失水減少劑、吸水或親水劑 [6]
- 103/48 · 發泡穩定劑 [6]
- 103/50 · 去發泡劑；去空氣劑 [6,2006.01]
- 103/52 · 研磨助劑 [6]
- 103/54 · 顏料；染料 [6]
- 103/56 · 遮光劑 [6]
- 103/60 · 化學、物理或生物攻擊之保護劑 [6]
- 103/61 · · 腐蝕抑制劑 [6]
- 103/63 · · 防火劑 [6]
- 103/65 · · 防水劑或斥水劑 [6]
- 103/67 · · 殺生劑 [6]
- 103/69 · · · 殺菌劑 [6]

涉及灰泥、混凝土人造石之功用、性質或用途與主目 26/00 至 32/00 聯合使用之索引碼。 [6]

111/00 灰泥、混凝土或人造石之功用、性質或用途 [6,2006.01]

- 111/10 · 以不含特定材料為特徵之組成物 [6]
- 111/12 · · 不含石棉者，例如水泥－石棉替代物 [6]
- 111/20 · 對抗化學、物理或生物攻擊 [6]
- 111/21 · · 抗風化 [6]
- 111/22 · · 抗碳化 [6]
- 111/23 · · 抗酸 [6]
- 111/24 · · 抗海水 [6]
- 111/25 · · 抗刻劃 [6]
- 111/26 · · 抗強化腐蝕 [6]
- 111/27 · · 抗水，例如防水或疏水材料 [6,2006.01]
- 111/28 · · 防火 [6]
- 111/30 · 可釘或可鋸材料 [6]

C04B

- 111/32 • 抑制膨脹材料 [6]
- 111/34 • 不收縮材料 [6]
- 111/40 • 多孔或輕質材料 [6]
- 111/42 • • 浮動材料 [6]
- 111/50 • 撓性或彈性材料 [6]
- 111/52 • 隔音材料 [6]
- 111/54 • 天然石替代物，例如人造大理石
[6]
- 111/56 • 適於製造管子之組成物，例如離
心鑄造 [6]
- 111/60 • 地板材料 [6]
- 111/62 • • 自我平坦組成物 [6]
- 111/70 • 泥漿 [6]
- 111/72 • 適於修理現有建築之組成物或建
築材料 [6]
- 111/74 • 下水道應用 [6]
- 111/76 • 於零下溫度使用 [6]
- 111/80 • 光學性質，例如透明度 [6]
- 111/82 • • 有色物質 [6]
- 111/90 • 電學性質 [6]
- 111/92 • • 電絕緣材料 [6]
- 111/94 • • 導電材料 [6]

C05 肥料；肥料製造 [4]

附註

- (1) 混合肥料內之一種成分，或含有一種以上據以細分入有關次類之化學元素之單一肥料，僅分入第一個適當的次類內。因此，硝酸磷酸鹽或氮化過磷酸鈣分入 C05B，而不分入 C05C，磷酸鎂分入 C05B，而不分入 C05D，氰氨化鈣分入 C05C，而不分入 C05D。
- (2) 混合物中被認為代表了對檢索重要的資訊的任何成分，還可以依據附註(1)進行附加分類。例如，使用分類號組合對於組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為“附加資訊”給出。[8]

C05B 磷肥

次類索引

過磷酸鈣	1/00	有機肥料.....	15/00，17/00
濕法生產者.....	11/00	造粒；壓片	19/00
焦化法生產者.....	13/00	混合磷肥.....	21/00
其他無機肥料.....	3/00 至 9/00，17/00		

1/00 過磷酸鈣，即為直接獲得固體產品用磷酸岩或骨質磷酸鹽與一定量及一定濃度之硫酸或磷酸反應生產的肥料

- 1/02 · 過磷酸鈣
- 1/04 · 複合過磷酸鈣；三重過磷酸鈣，以磷酸一鈣為基料之其他肥料 [1,2006.01]
- 1/06 · 過磷酸鹽類之氮化（以正磷酸銨為基料之肥料 7/00）
- 1/10 · 過磷酸鈣生產設備

3/00 以磷酸二鈣為基料之肥料（11/00 優先）

5/00 托馬斯磷肥；其他礦渣磷肥

7/00 以正磷酸銨或鹼為基料之肥料（11/00 優先）

9/00 以磷酸鎂或雙料磷酸鎂為基料之肥料（11/00 優先）

11/00 用濕法處理或用一定量及一定濃度之酸浸析原料以得溶液然後予以中和之方法，或用鹼液浸析原料之方法生產的肥料

- 11/02 · 預處理
- 11/04 · 用無機酸
- 11/06 · · 用硝酸（硝基磷酸鹽）
- 11/08 · · 用硫酸
- 11/10 · · 用正磷酸
- 11/12 · · 用鹽酸
- 11/14 · · 用濕的氣態酸類
- 11/16 · 用鹼液

13/00 用焦化法自含磷酸鹽材料生產的肥料

- 13/02 · 自磷酸鹽岩（13/06 優先）
- 13/04 · 自金屬磷化合物，如鐵磷化合物
- 13/06 · 鹼金屬或鹼土金屬偏磷酸鹽或多磷酸鹽肥料

15/00 有機磷肥（骨粉見 17/00）

- 17/00 其他磷肥，如軟磷酸岩、骨粉**
 17/02 · 含錳者
19/00 非礦渣磷肥之造粒或壓片

- 19/02 · 過磷酸鈣或含過磷酸鈣混合物者
21/00 包括多於前面各主目內之一目的混合磷肥

C05C 氮肥

次類索引

以硝酸鹽為基料者.....	1/00, 5/00	以尿素為基料者.....	9/00
以銨鹽、氨為基料者.....	1/00, 3/00	其他肥料.....	11/00
以氰氨為基料者.....	7/00	混合氮肥.....	13/00

1/00 硝酸銨肥料

- 1/02 · 造粒；壓片；穩定；著色

3/00 含有其他銨鹽或氨之肥料，如煤氣水

5/00 含有其他硝酸鹽之肥料

- 5/02 · 含硝酸鈉或硝酸鉀者
 5/04 · 含硝酸鈣者

7/00 含氰氨化鈣或其他氰氨化物之

肥料

- 7/02 · 造粒；壓片；脫氣；水合；硬化；穩定；油化

9/00 含尿素或尿素化合物之肥料

- 9/02 · 含脲醛縮合物者

11/00 其他氮肥

13/00 包括多於前各主目內之一目的混合氮肥

C05D 不包括 C05B、C 次類之無機肥料；產生二氧化碳之肥料

1/00 鉀肥（7/00 優先）

- 1/02 · 自氯化鉀或硫酸鉀或其複鹽或混合鹽製取者
 1/04 · 自礦石或火成岩製取者

3/00 鈣肥（7/00 優先）

- 3/02 · 自石灰石、碳酸鈣、氫氧化鈣、熟石灰、氧化鈣、廢鈣化合物製取者
 3/04 · 由鼓風爐渣或其他含石灰或矽酸

鈣之渣製取者

5/00 鎂肥（7/00 優先）

7/00 產生二氧化碳之肥料

9/00 其他無機肥料

- 9/02 · 含微量元素者

11/00 包括多於前面各主目內之一目的混合肥料

C05F 不包括 C05B、C 次類內之有機肥料、如用垃圾或廢渣製成的肥料**附註**

以施堆肥步驟為特徵之工藝過程或其設備分入 17/00 [5]

-
1/00 由動物屍體或臟器製成的肥料 1/02 • 製造用設備 3/00 人或動物排泄物製成的肥料，如糞肥 3/02 • 鳥糞 3/04 • 由人類糞便 3/06 • 製造用設備 5/00 自釀造廠廢物、廢糖漿、酒糟、蔗渣或其他類似廢物或殘渣製成的肥料 7/00 自廢水、污水淤渣、海水淤泥、軟湖泥或類似物質製成之肥料 7/02 • 自纖維素製造中之亞硫酸鹽廢液或其他廢液 7/04 • 自鉀鹼工業中之廢液 9/00 自家庭或市鎮垃圾製成的肥料 9/02 • 製造用設備 9/04 • 生物堆肥 11/00 其他有機肥料 11/02 • 自泥炭土、褐煤及類似之植物沉積物製成者 11/04 • • 自泥炭土製成之園藝用土(生長基質含有泥炭土見 A01G 24/28) [1,2006.01,2018.01] 11/06 • • 製造用設備 11/08 • 含有加入的培養菌種、菌絲或其他類似微生物之有機肥料 11/10 • 含植物維生素或激素之肥料 15/00 包括多於前面各主目內之一目的混合肥料，由包括於本次類惟不包括於同一主目之原料混合物製造的肥料 [5]	17/00 以生物或生化處理步驟為特徵之肥料製備，例如堆肥或發酵 [5,2006.01,2020.01] 17/02 (轉見 17/90 – 17/993) 17/05 • 處理包括無脊椎動物，例如：蟲、蒼蠅或蛆 [2020.01] 17/10 • 處理過程中向材料添加或去除水或空氣以外的物質（用於活化或刺激處理見 17/20） [2020.01] 17/20 • 用特定的微生物或物質，例如：酶，活化或刺激處理（使用無脊椎動物見 17/05） [2020.01] 17/30 • 用輻射，例如：太陽或核輻射；用電場或磁場 [2020.01] 17/40 • 液體或漿體之處理 [2020.01] 17/50 • 結合二或多種不同生物或生化處理，例如：厭氧及好氧處理或蚯蚓堆肥法及好氧處理 [2020.01] 17/60 • 處理過程中的加熱或冷卻 [2020.01] 17/70 • 根據程序參數控制處理 [2020.01] 17/80 • 處理過程中有害物質的分離、排除或處置 [2020.01] 17/90 • 其設備 [2020.01] 17/907 • • 無用於進料或出料的機械裝置之小型設備，例如：花園堆肥箱 [2020.01] 17/914 • • 便攜式或移動式設備，例如：運輸容器或卡車 [2020.01] 17/921 • • 物料在進料口與出料口間基本上水平輸送的設備 [2020.01] 17/929 • • • 汽缸或鼓輪 [2020.01] 17/936 • • • 隧道 [2020.01] 17/943 • • • 混合攪拌及輸送的裝置 [2020.01]

17/95	• • 物料在進料口與出料口間基本上垂直輸送的設備 [2020.01]	質；用於進料或卸料其他物質 [2020.01]
17/957	• • 使用二或多個串聯設備 [2020.01]	17/979 • • • • 其他物質是氣態的 [2020.01]
17/964	• • 結構零件，例如：底盤、蓋或門 [2020.01]	17/986 • • • • 其他物質是液態的[2020.01]
17/971	• • • • 用於進料或卸料被處理的物	17/993 • • 測量程序參數之配置，例如：溫度、壓力或濕度 [2020.01]

C05G 分屬於 C05 主類下各次類內肥料之混合物；由一種或多種肥料與無特殊肥效之添加劑所組成的混合物（含有加入培養菌種、菌絲或其他類似微生物之有機肥料見 C05F 11/08；含植物維生素或激素之有機肥料見 C05F 11/10）；以形狀為特徵之肥料 [4]

附註 [6]

- (1) 本次類涵蓋肥料與以肥效為特徵之土壤改良劑或土壤穩定劑所組成之混合物。[6]
- (2) 本次類不涵蓋肥料與以 C09K17/00 目所涵蓋土壤改良或土壤穩定活性為特徵之土壤改良劑或土壤穩定劑所組成之混合物。

1/00 分屬於 C05 主類下各次類內肥料之混合物	3/30 • 抗凝聚添加劑；抗固化添加劑 [2020.01]
1/02 • 過磷酸鈣與硝酸銨者	3/40 • 影響肥料劑量或釋放速率；影響溶解度 [2020.01]
1/04 • 托馬斯磷肥與鉀化合物者	3/50 • 界面活性劑；乳化劑 [2020.01]
1/06 • 鹼金屬或銨之正磷酸鹽與硝酸銨或硫酸銨或其他硝酸鹽或鉀化合物者	3/60 • 殺生劑或防腐劑，例如：消毒劑、農藥或除草劑；害蟲驅避劑或引誘劑 [2020.01]
1/08 • 硝酸銨與石灰石或碳酸鈣者	3/70 • 影響濕潤性，例如：乾燥劑 [2020.01]
1/10 • 硫酸銨與鉀化合物者	3/80 • 土壤改良劑 [2020.01]
3/00 一種或多種肥料與無特殊肥效添加劑之混合物 [1,2006.01,2020.01]	3/90 • 影響土壤中銨化合物或尿素的硝化作用 [2020.01]
3/02 (轉見 3/60)	5/00 以形狀為特徵之肥料 [4,2006.01,2020.01]
3/04 (轉見 3/80)	5/10 • 固態或半固態肥料，例如：粉末（層狀或塗層見 5/30；結合入基質見 5/40） [2020.01]
3/06 (轉見 3/70)	5/12 • • 顆粒或薄片 [2020.01]
3/08 (轉見 3/90)	5/14 • • 錠、尖釘狀、桿狀、塊狀或球
3/10 (轉見 5/30 – 5/35)	
3/20 • 防止肥料還原成粉末；抗粉塵添加劑 [2020.01]	

- 狀 [2020.01]
- 5/16 • • 薄膜或薄板；網狀或纖維狀
[2020.01]
- 5/18 • • 半固態肥料（層狀或塗層見
5/30；結合入基質見 5/40）
[2020.01]
- 5/20 • 液態肥料（層狀或塗層見 5/30；
結合入基質見 5/40） [2020.01]
- 5/23 • • 溶液[2020.01]
- 5/27 • • 分散液，例如：懸浮液或乳劑
[2020.01]
- 5/30 • 層狀或塗層，例如：防塵塗覆
[2020.01]
- 5/35 • • 膠囊，例如：核－殼 [2020.01]
- 5/40 • 肥料結合入基質 [2020.01]

C06 炸藥；火柴

C06B 炸藥或熱劑之組合物（爆破見 F42D）；其製造；用單種物質作炸藥 [2]

附註

(1) 本次類包括：

— 組合物

- (a) 炸藥組合物：同時含有燃料及足夠氧化劑，起爆後發生高速化學變化，產生可用於爆破、槍炮發射及推進發射物或其他類似用途之所需作用力之物質； [2]
- (b) 熱劑組合物：同時含有(i)由金屬、B、Si、Se 或 Te 中任何元素或其混合物、其中間化合物或氫化物等組成之可以燃盡成分，及(ii)由金屬氧化物或能夠分解生成金屬氧化物之鹽（有機或無機鹽）組成之氧化劑成分之物質； [2]
- (c) 燃料組合物；火箭發動機燃料及與氧化劑（空氣除外）反應以產生推動力之燃料； [2]
- (d) 用於影響爆炸環境之組合物：如中和爆炸後之有毒氣體、冷卻爆炸氣體等 [2]

— 其他類不包括的此種組合物之製備或處理之方法或設備； [2]

— 使用單種物質作為炸藥之方法。[2]

(2) 本次類所使用的下列術語含義為：

— “經硝化”一詞包括含硝基或硝酸酯基之化合物。[2]

(3) 製備或處理此種組合物之方法或設備，按照前述組合物之特定成分分類。[2]

次類索引

炸藥或熱劑之組合物

含經硝化之衍生物者

無機者.....31/00

有機者.....25/00，41/00

含氮化物或雷酸鹽者.....35/00，37/00

含氯酸鹽或高氯酸鹽者.....29/00

含金屬者.....27/00，33/00

含磷者.....39/00

其他組合物.....23/00，43/00

依成分之結構或排列而

定義之組合物.....45/00，47/00

用單種物質作為炸藥.....49/00

製造.....21/00

21/00 炸藥之加工，如成型、分割、乾燥之方法或設備

附註

於 23/00 至 49/00 目內，若無相反之指示，組合物應分入為成分規定之最後適當位置。[2]

23/00 以非炸藥成分或非熱劑成分為特徵之組合物 [2]

23/02 • 中和炸藥爆破時產生之有毒氣體用者 [2]

23/04 • 冷卻爆炸氣體者 [2]

25/00 含經硝化的有機化合物之組合物 [2]

25/02 • 經硝化的化合物係澱粉或糖 [2]

25/04 • 經硝化的化合物係芳族者 [2]

25/06 • • 具有兩個或多個硝化之芳族化合物者 [2]

25/08 • • • 至少其中之一係經硝化之甲苯 [2]

25/10 • 化合物係硝基甘油

25/12 • • 含其他經硝化之有機化合物[2]

25/14 • • • 其他化合物，係經硝化之脂族二醇 [2]

25/16 • • • 其化合物係經硝化之芳族化合物 [2]

25/18 • 化合物係占全部組成分重量 10% 或 10%以上之硝化纖維素 [2]

25/20 • • 含非炸藥成分或非熱劑成分[2]

25/22 • • 含經硝化之芳族化合物[2]

25/24 • • 含硝化甘油 [2]

25/26 • • • 含有機非炸藥成分或非熱劑成分 [2]

25/28 • 化合物係占全部組成分重量 10% 以下之硝化纖維素 [2]

25/30 • • 含硝化甘油 [2]

25/32 • 化合物係經硝化之季戊四醇 [2]

25/34 • 化合物係經硝化之無環，脂環或雜環胺 [2]

25/36 • 化合物係硝基鏈烷烴 [2]

25/38 • • 含其他經硝化之有機化合物[2]

25/40 • • 含兩個或多個硝基鏈烷烴 [2]

27/00 含金屬、硼、矽、硒、或碲、或其混合物、中間化合物或其氫化物、以及烴或鹵代烴之組合物[2]**29/00 含無機鹵氧酸鹽，如氯酸鹽、過氯酸鹽之組合物 [2]**

29/02 • 鹼金屬者 [2]

29/04 • • 含無機非炸藥成分或非熱劑成分 [2]

29/06 • • • 成分係氰化物；成分係鐵、鉻或錳之氧化物 [2]

29/08 • • 含有機非炸藥成分或非熱劑成分 [2]

29/10 • • • 成分係染料或著色劑 [2]

29/12 • • 含碳或硫 [2]

29/14 • • 含碘或碘化物 [2]

29/16 • • 含硝化之有機化合物 [2]

29/18 • • • 化合物係經硝化之甲苯或經硝化之苯酚 [2]

29/20 • • • 化合物係硝化纖維素 [2]

29/22 • 鹽係過氯酸鉍 [2]

31/00 含無機氮氧酸鹽之組合物 [2]

31/02 • 鹽係鹼金屬或鹼土金屬硝酸鹽 [2]

31/04 • • 含碳或硫 [2]

31/06 • • • 含有機非炸藥成分或非熱劑成分 [2]

31/08 • • 含金屬鹵氧酸鹽，如無機氯酸鹽或過氯酸鹽 [2]

31/10 • • • 含碳或硫 [2]

31/12 • • 含經硝化之有機化合物 [2]

31/14 • • • 化合物係芳族者 [2]

31/16 • • • • 化合物係經硝化的甲苯 [2]

31/18 • • • • 化合物係經硝化的苯酚，如苦味酸 [2]

31/20 • • • 化合物係硝化甘油 [2]

31/22 • • • 化合物係硝化纖維素 [2]

31/24 • • • • 含其他炸藥或熱劑成分 [2]

31/26 • • • • • 其他成分係硝化甘油 [2]

31/28 • 鹽係硝酸鉍 [2]

31/30 • • 含植物性物質；含樹脂；含橡膠 [2]

31/32 • • 含經硝化的有機化合物 [2]

31/34 • • • 經硝化的化合物是澱粉或糖 [2]

31/36 • • • • 含其他炸藥或熱劑成分 [2]

31/38 • • • 經硝化的化合物之芳族者 [2]

31/40 • • • • 含有機非炸藥成分或非熱

- 劑成分 [2]
- 31/42 含其他炸藥成分或熱劑成分 [2]
- 31/44 化合物係硝化甘油 [2]
- 31/46 含植物性物質成分，如木漿、木屑 [2]
- 31/48 含其他炸藥成分或熱劑成分 [2]
- 31/50 其他成分係經硝化的有機化合物 [2]
- 31/52 化合物係占全部組成分重量 10%或 10%以上之硝化纖維素 [2]
- 31/54 含其他經硝化的有機化合物 [2]
- 31/56 化合物係占全部組成分重量 10%以下之硝化纖維素 [2]
- 33/00 含至少一種供氧物質之粒狀金屬、合金、硼、矽、硒或碲的組合物，供氧物質係金屬氧化物或能產生金屬氧化物之有機或無機鹽 [2]**
- 33/02 . 含有機非炸藥成分或非熱劑成分 [2]
- 33/04 . 供氧物質係無機氮氧酸鹽 [2]
- 33/06 . 供氧物質係無機鹵氧酸鹽 [2]
- 33/08 . 含經硝化的有機化合物 [2]
- 33/10 . . 化合物係芳族者 [2]
- 33/12 . 供氧物質係兩種或多種產生氧之化合物 [2]
- 33/14 . . 其中至少一種係無機氮氧酸鹽 [2]
- 35/00 含金屬疊氮化物之組合物 [2]**
- 37/00 含金屬雷酸鹽之組合物 [2]**
- 37/02 . 含經硝化的有機化合物或無機鹵氧酸鹽 [2]
- 39/00 含游離磷或無氧二元磷化合物之組合物**
- 39/02 . 含無機鹵氧酸鹽 [2]
- 39/04 . . 含無氧二元磷化合物 [2]
- 39/06 . 含游離金屬、合金、硼、矽、硒或碲 [2]
- 41/00 含經硝化的金屬有機化合物之組合物 [2]**
- 41/02 . 含鉛之化合物 [2]
- 41/04 . . 含有機炸藥成分或熱劑成分[2]
- 41/06 . . . 含無機炸藥成分或熱劑成分 [2]
- 41/08 . . 含金屬疊氮化物或金屬雷酸鹽 [2]
- 41/10 . . 含其他經硝化的金屬有機化合物 [2]
- 43/00 以不包括 25/00 至 41/00 目內之炸藥或熱劑成分為特徵的組合物 [2]**
- 45/00 按成分或產品之結構或排列定義的組合物或產品（特殊形狀或形式之爆炸裝藥見 F42B1/100，3/00） [2]**
- 45/02 . 含有不同尺寸或形狀之顆粒者 [2]
- 45/04 . 含有分散於固溶體或基質內之固體顆粒者 [2]
- 45/06 . . 含有機成分之固溶體或基質[2]
- 45/08 . . . 含無機炸藥或熱劑成分之分散固體 [2]
- 45/10 . . . 含樹脂之有機成分 [2]
- 45/12 . 有連接層或連接區者 [2]
- 45/14 . . 含無機炸藥或熱劑成分之連接層或連接區 [2]
- 45/16 . . . 連接層或連接區至少含有疊氮化物、雷酸鹽、磷及磷化物中之一種無機成分 [2]
- 45/18 . 含包覆成分者（藥粒分散於基質內者見 45/04；包覆炸藥之裝藥見 F42B） [2]
- 45/20 . . 基本成分含有機炸藥成分或熱劑成分 [2]
- 45/22 . . . 塗層含有機化合物 [2]
- 45/24 化合物係有機炸藥成分或有機熱劑成分 [2]
- 45/26 化合物係經硝化的甲苯

	[2]	(Sprengel) ” ；固體成分懸浮於通常的非爆炸性液相，包括增稠的水相之內 [2]
45/28	• • • 基本成分含硝化纖維素及硝化甘油 [2]	
45/30	• • 基本成分含無機炸藥或無機熱劑成分 [2]	47/02 • 含二元推進劑之成分 [2]
45/32	• • • 塗層含有機化合物 [2]	47/04 • • 含氧化氮或其酸之成分[2]
45/34	• • • • 化合物係有機炸藥成分或有機熱劑成分 [2]	47/06 • • 成分係通常液化的氣態供氧物質（47/04 優先）[2]
45/36	• • 基本成分既含有機炸藥或熱劑成分又含無機炸藥或熱劑成分 [2]	47/08 • • 含肼或肼衍生物之成分 [2]
47/00	於燃燒或爆炸之前成分分開貯存的組合物，如“斯普倫格爾	47/10 • • 含游離硼、有機硼烷或無氧二元硼化合物之成分 [2]
		47/12 • • 成分係通常液化的氣體燃料 [2]
		47/14 • 含固體成分及水相者 [2]
		49/00 用單種物質作炸藥 [2]

C06C 起爆或點火裝置；引信；化學點火具；點火劑 [2]

5/00	引信，例如，導火索	7/02	• 製造；包裝
5/04	• 導爆索	9/00	化學接觸點火裝置；化學點火具
5/06	• 引信點火裝置；引信連接套管	15/00	點火劑；打火石（化學點火具見9/00）
5/08	• 引信之製造裝置		
7/00	非電雷管；雷管；火帽		

C06D 煙霧發生裝置；毒氣攻擊劑；爆炸或推進用氣體之產生（化學部分） [2]

3/00	煙或霧之發生[化學部分]（用作殺生物劑、驅蟲劑或誘蟲劑、或植物生長調節劑之組合物見A01N25/18） [1,2006.01]	5/06	• 用兩種或兩種以上固體反應之方法 [1,2006.01]
5/00	壓縮氣體之產生，如用於爆破筒、起動器、火箭者（含有氧化劑之爆炸組合物，用於與空氣之外的氧化劑反應之火箭發動機燃料見C06B）	5/08	• 用兩種或兩種以上液體反應之方法 [1,2006.01]
5/02	• 使用壓縮氣體、液化氣體或固化氣體減壓之方法	5/10	• 用固體與液體反應之方法
5/04	• 用單種物質自動分解之方法	7/00	毒氣攻擊劑

C06F 火柴；火柴之製造**1/00 火柴之機械加工**

- 1/02 • 火柴梗之切割
- 1/04 • 於鏈板上充填火柴梗；卸火柴梗
- 1/06 • 火柴之浸沾、塗敷、浸漬或乾燥之方法[2]
- 1/08 • 鏈板
- 1/10 • • 鏈板導向裝置
- 1/12 • 火柴之裝盒
- 1/14 • 擦火片之生產
- 1/16 • 互相連接者，如成條者或成片之火柴生產
- 1/18 • 與火柴生產過程相結合的火柴或火柴盒上之印刷
- 1/20 • 擦火面層之塗敷，如於火柴盒、

於火柴簿上

- 1/22 • 紙板火柴、火柴包或火柴包裝之製造
- 1/24 • 防火安全裝置
- 1/26 • 完整火柴生產製程之產線

3/00 火柴生產之化學部分

- 3/02 • 火柴用木片或其代用品
- 3/04 • • 於浸沾前後之化學處理，如染色、浸漬
- 3/08 • 擦火面層藥劑

5/00 火柴（火柴簿見 A24F 27/12）

- 5/02 • 永久火柴
- 5/04 • 蠟火柴

C07 有機化學

附註[2,4,5,2006.01,2012.01]

- (1) 於本類中，下列術語的含義為：
 - 除非另有位置，則“製備”包括純化、分離、穩定化或使用添加劑。
[4]
- (2) 殺生、害蟲驅避、害蟲引誘或植物生長調節活性的化合物或製劑進一步分入 A01P。[8]
- (3) 於 C07C 至 C07K 次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示且於下述例外情況下，化合物請放入最後適當位置。例如，含無環鏈及雜環之 2-丁基-嘓啶僅按雜環化合物分入 C07D。一般若無相反指示時，例如：C07C 59/58、59/70 目中提及的，“無環的”及“脂族的”等詞係用於描述無環化合物者；若有環時，按“末位”規則，此化合物將歸入脂環族或芳族化合物中較後的目內，若此種之目存在時。若一化合物或整目之化合物以互變異構形式存在時，即按此化合物或此目化合物於分類表內最後的異構體形式分類，除非於分類表內已先設置專門的異構體形式。[8]
- (4) 有關化合物及其製備之發明，應分類入所製備的化合物之類型的目內。製備方法若無此種之目時亦需分類入所用反應的類型之目內。除本類外的類似範例，請見：
 - C12P 藉由發酵或使用酶催化反應以合成所欲之化合物、組合物或從外消旋混合物中分離出光學異構物
 - C25B 3/00 有機化合物之電解生產
 - C25B 7/00 化合物之電泳法生產
- (5) 屬於不止一個主目之一類化合物的一般製備方法，應分類入所用方法之目內，若該等目存在時。所製備的化合物亦需分類入所製備的化合物之類型的目內。[2012.01]
- (6) 於本類內，若無相反指示，含有羧基或硫代羧基之化合物依相關之羧酸或硫代羧酸分類，除非“末位規則”(見上述之附註(3))另有指示；羧基係指碳原子有三個鍵，且不超過三個鍵連接雜原子，除硝基或亞硝基之氮原子外，其中至少有連接同一雜原子之多鍵；硫代羧基係指至少有一個鍵連接硫原子者，例如羧酸鹽或羧酸胺，應依對應的酸分類。[5, 8]
- (7) 除非另有指明，一化合物之鹽類依該化合物分類，例如苯胺鹽依僅含碳、氫及氮之化合物分類見 C07C 211/46，丙二酸鈉依丙二酸分類見 C07C 55/08，硫醇鹽依硫醇分類。金屬螯合物亦依相同方式處理。同理，金屬醇化物及金屬酚鹽分類至 C07C 而非 C07F，例如：醇化物分類至 C07C 31/28 至 31/32 目中，酚鹽分類至 C07C 39/235 或 39/44。由兩個或多個有機化合物形成的鹽、加成物或錯合物係依形成鹽、加成物或錯合

物之所有化合物予以分類 [2]

C07B 有機化學之一般方法；及所用的裝置（用調聚反應製備羧酸酯見 C07C 67/47；用以製備巨分子化合物之製程，如調聚反應見 C08F、C08G）

附註

- (1) 於本次類內，原先於若干被引入的殘餘物中存在且實際上不參與化學反應之官能基，不視作該化學反應所形成或引入的官能基。[4]
- (2) 於本次類內，下列術語意指：
 - “分離”係僅為回收有機化合物之分離過程。[4]
- (3) 當分類入本次類時，只要是含有與色層分析相關的技術主題，則須分入 B01D 15/08。[8]
- (4) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層內，若無相反指示，請將化學反應結果所形成或引入之鍵或官能基指明的反應類型分入最後適當位置。[4]

次類索引

不形成或不引入含雜原子官能基之反應

原已直接相連的碳原子間

鍵型之變化.....35/00

新的碳—碳鍵之形成或原有的

碳—碳鍵之斷裂.....37/00

形成或引入含有雜原子官能基之反應

鹵化.....39/00

含氧官能基.....41/00

含氮官能基.....43/00

含硫官能基.....45/00

其他的官能基.....47/00

Grignard 反應.....49/00

引入不包括先行各目之保護

或活化基團.....51/00

不對稱合成.....53/00

外消旋化，轉化.....55/00

分離，純化，穩定化，

添加劑之使用.....57/00, 63/00

同位素之引入.....59/00

有機自由基之生產.....60/00

其他的一般方法.....61/00

31/00 一般的還原 [4]

33/00 一般的氧化 [4]

不形成或不引入含雜原子官能基之反應

35/00 不形成或不引入含雜原子官能基之反應，其中包括原已直接相連的兩個碳原子間鍵型之變化 [4]

35/02 • 還原 [4]

35/04 • 脫氫 [4]

35/06 • 分解，例如，脫鹵素，脫水或脫鹵化氫 [4]

35/08 • 異構化 [4]

37/00 不形成或不引入含雜原子官能基之反應，其中包括兩個原來不直接相連碳原子之間碳—碳鍵之形或兩個直接相連原子之斷開 [4]

37/02 • 加成 [4]

37/04 • 取代 [4]

37/06 • 分解，例如，脫二氧化碳 [4]

37/08 • 異構化 [4]

- 37/10 · 環化 [4]
 37/12 · · Diels-Alder 反應 [4]
- 形成或引入含雜原子官能基的反應**
- 39/00 鹵化 [4]**
- 41/00 含氧官能基之形成或引入 [4]**
 41/02 · 羥基或氧—金屬基 [4]
 41/04 · 醚基，縮醛基或縮酮基 [4]
 41/06 · 羰基 [4]
 41/08 · 羧基或其鹽，鹵化物或酐 [4]
 41/10 · · 羧基之鹽，鹵化物或酐 [4]
 41/12 · 羧酸酯基 [4]
 41/14 · 過氧基或過氧化氫基 [4]
- 43/00 含氮官能基之形成或引入 [4]**
 43/02 · 硝基或亞硝基 [4]
 43/04 · 胺基 [4]
 43/06 · 醯胺基 [4]
 43/08 · 氰基 [4]
 43/10 · 異氰酸基 [4]
- 45/00 含硫官能基之形成或引入 [4]**
 45/02 · 磺酸基或二羥基磺醯基 ^[4]
 45/04 · 磺醯基或亞磺醯基 [4]
 45/06 · 巯基或硫醚基 [4]
- 47/00 形成或引入不包括 39/00 至 45/00 各目之官能基 [4]**
- 49/00 Grignard 反應 [4]**
- 51/00 引入不包括上述各目內之保護基團或活化基團 [4]**
- 53/00 不對稱合成 [4]**
- 55/00 外消旋化，完全轉化或部分轉化 [4]**
- 57/00 有機旋光化合物之分離 [4]**
- 59/00 有機化合物中引入同位素 [4]**
- 60/00 有機自由基之生產 [2011.01]**
- 61/00 其他的一般方法 [4]**
 61/02 (轉見 60/00)
- 純化；分離；穩定化 [4]**
- 63/00 純化；特別適於用以回復有機化合物之分離(有機旋光化合物之分離見 57/00)；穩定化；添加劑之使用 [4]**
 63/02 · 引起化學改性之處理 [4]
 63/04 · 添加劑之使用 [4]
- 47/00 形成或引入不包括 39/00 至**

C07C 無環或碳環化合物 (高分子化合物見 C08；用電解或電泳法生產之有機化合物見 C25B3/00、7/00)

附註

(1) 於本次類內，下列名詞或術語意指：

- “橋接”表示至少有一個不同於鄰、迫或螺之鍵合；
- 兩個環“稠合”表示兩個環至少共用一環原子，例如“螺”及“橋接”視為稠合；
- “稠環系”係指所有的環相互間均稠合的環系；
- 稠環系內之“環數”等於將此環系變成非環系需要的切斷數；
- “醌類”係由含有六節芳環或含有六節芳環體系（該體系可稠合或不稠合）衍生的化合物，該化合物係用 $>C=O$ 基團取代六節芳環中之二個或四個 $>CH$ 基團，並除去對應的一個或兩個碳—碳雙鍵，同時重排其餘的碳—碳雙鍵，包括碳—氧鍵在內，以給與具有交替雙

鍵之環或環系，其意義不認為茚醌或樟腦醌為醌類。[5]

- (2) 注意 C07 主類後的附註(3)，該附註明確了在 C07C 至 C07K 次類中，採用末位規則。[8]
- (3) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]
- (4) 當分類入本次類時，只要含有與色層分析相關的技術主題，則須分入 B01D 15/08。[8]
- (5) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，方法請放入最後適當位置。[3]
- (6) 於本次類內，若無相反指示，“季胺化合物”依“非季胺化的氮化合物”分類。[5]
- (7) 對 1/00 至 71/00 及 401/00 至 409/00 各目之化合物的分類如下：
 - 化合物依全分子（“全分子處理規則”）(rule of the "whole molecule approach")分類；
 - 不含相互以多鍵相結合之碳原子的化合物被視為飽和者；
 - 包括六節芳環在內，含有相互間以多鍵相結合的碳原子之化合物被視為不飽和者，除非另有規定或細分中有所暗示，如 69/00 目內，例如 69/712。
- (8) 對 201/00 至 395/00 各目中化合物的分類，即於根據“末位規則”確定官能基之後，化合物依下述原則分類：
 - 化合物係根據與官能基相連的碳原子之性質分類；
 - 碳架係指除羧基碳原子外之一個碳原子或相互鍵合的碳原子之鏈；碳架由連至除碳以外之元素或羧基之碳原子的每個鍵所終止；
 - 當分子含有若干個官能基時，僅與同一碳架相連的官能基被認為係首先被確定的官能基；
 - 不含相互由多鍵結相結合的碳原子之碳架被認為係飽和者；
 - 包括六節芳環在內，含有相互由多鍵結相結合的碳原子之碳架被認為係不飽和者。[5]

次類索引

僅含碳及氫之化合物

製備 1/00，2/00，4/00，5/00，6/00

純化；分離；穩定化.....7/00

化合物

脂族者.....9/00，11/00

脂環族者，芳族者.....13/00，15/00

含碳及鹵素之含或不含氫的化合物

製備 17/00

化合物

脂族者.....19/00，21/00

脂環者，芳族者.....22/00，23/00，25/00

含碳及氧之含或不含氫及鹵素的化合物

製備

同時產生多於一類之含氧化合物 27/00

醇者；酚者 29/00；37/00

醚或縮醛；氧代化合物者.....41/00；45/00

醌者.....46/00

羧酸者，此等之鹽或酐者.....51/00

羧酸酯者.....67/00

碳酸酯或鹵代甲酸酯者 68/00

化合物

含脂族羥基 31/00，33/00

含環式脂族羥基.....35/00

含芳族羥基 39/00

醚，縮醛，原酸酯；醛；	
酮.....	43/00；47/00；49/00
醌.....	50/00
羧酸	
無環者.....	53/00，55/00，57/00，59/00
環者.....	61/00，62/00，63/00， 65/00，66/00
酯.....	69/00，71/00
含碳及氮之含或不含氫、 鹵素或氧的化合物	
製備	
胺者.....	209/00
脛胺者，胺基醚者，或胺基酯者....	213/00
胺基醛者，胺基酮者，胺基醌者....	221/00
胺基羧酸者.....	227/00
羧酸鹽胺者.....	231/00
羧酸腈者.....	253/00
胍衍生物者.....	241/00
含碳—氮雙鍵之化合物，如亞胺、 脞、異氰酸酯.....	249/00，263/00
胺基甲酸衍生物者.....	269/00
脲或衍生物者.....	273/00
胍或衍生物者.....	277/00
硝基或亞硝基化合物， 或硝酸酯或亞硝酸酯者.....	201/00
化合物	
有氮與碳結合者或氮與碳及氫結合之	
胺.....	211/00
脛胺；胺基醚；	
胺基酯.....	215/00，217/00，219/00
胺基醛，胺基酮，	
胺基醌.....	223/00，225/00
胺基羧酸.....	229/00
羧酸鹽胺.....	233/00，235/00，237/00
含有一個或多個碳—氮雙鍵之 化合物，如亞胺.....	251/00
羧酸腈.....	255/00
脞，亞胺醚.....	257/00
異脛胺.....	259/00
氰酸或異氰酸衍生物.....	261/00，265/00
碳化二亞胺.....	267/00
胺基甲酸.....	271/00
脲.....	275/00
胍.....	279/00
有氮與鹵素結合者.....	239/00
有氮與氧結合者	

硝基或亞硝基化合物.....	205/00，207/00
亞硝酸酯或硝酸酯.....	203/00
脛胺.....	239/00
脞.....	251/00
有氮與另一個氮結合者	
胍，鹽胍.....	243/00
胺基胍甲酸酯(Semicarbazates)， 胺基胍.....	281/00
偶氮化合物，重氮化合物.....	245/00
脞，鹽胍定.....	251/00，257/00
縮胺基脲.....	281/00
N—硝基或N—亞硝基化合物.....	243/00
有三個氮原子相結合者	
三氮烯.....	245/00
疊氮化合物.....	247/00
其他含氮化合物.....	291/00
含碳同時含硫、硒或碲，含有不含氮、 鹵素、氧或氮之化合物	
製備	
硫酸或磺酸衍生物者.....	303/00
硫醇者，硫酚者，硫化物者， 或多硫化物者.....	319/00
碲或亞碲化合物者.....	315/00
化合物	
有硫與氧結合者	
亞硫酸酯或硫酸酯.....	301/00，305/00
磺酸或衍生物.....	309/00
次磺酸或亞磺酸或衍生物.....	313/00
碲，亞碲.....	317/00
有硫與碳結合者	
硫醇，硫酚，硫化物， 或多硫化物.....	321/00，323/00
硫醛，硫酮.....	325/00
硫代羧酸或衍生物.....	327/00
硫代碳酸或衍生物.....	329/00
硫氰酸酯，異硫氰酸酯.....	331/00
硫代胺基甲酸或衍生物.....	333/00
硫脲.....	335/00
胺基硫脲或縮胺基硫脲.....	337/00
有硫與氮結合者	
胺磺鹽.....	311/00
次磺鹽胺，亞磺鹽胺，亞氧硫 基胺基甲酸酯或亞氧硫基脲.....	313/00
硫酸鹽胺.....	307/00
其他含硫化合物.....	381/00
含硒化合物.....	391/00

含碲化合物 395/00
 膽固醇之輻射產物 401/00
 具至少四個碳原子之不飽和側鏈
 的環己烷或環己烯衍生物 403/00

前列腺素或衍生物 405/00
 過氧化物；過氧酸
 製備 407/00
 化合物 409/00

烴 [3]

1/00 由一種或多種非烴化合物製備 烴

- 1/02 • 由碳之氧化物（未確定組成之液態烴混合物的製備見 C10G 2/00；合成天然氣之製備見 C10L 3/06） [5]
- 1/04 • • 由一氧化碳與氫
- 1/06 • • • 於存在有機化合物，例如烴之情況下
- 1/08 • • • 異構化
- 1/10 • • 由一氧化碳與水蒸氣
- 1/12 • • 由二氧化碳與氫
- 1/20 • 由僅含氧雜原子之有機化合物開始
- 1/207 • • 由羰基化合物 [5]
- 1/213 • • • 由酯之裂解 [5]
- 1/22 • • 還原
- 1/24 • • 脫水
- 1/247 • • 環醚之裂解 [3]
- 1/26 • 由僅含鹵素雜原子之有機化合物開始
- 1/28 • • 閉環
- 1/30 • • 由單一分子中裂解出鹵化氫
- 1/32 • 由僅含雜原子，或除含氧或鹵素以外的雜原子之化合物含或不含氧及鹵素開始 [3]
- 1/34 • • 磷化氫與醛或酮反應，例如 Wittig 反應 [3]
- 1/36 • 酯裂解（1/213、1/30 優先） [3,5]
- 2/00 由含碳原子數較少的烴製備烴 [3]
- 2/02 • 不飽和烴間加成 [3]
- 2/04 • • 無環形成的不飽和烴之寡聚反應 [3]
- 2/06 • • • 烯烴者，即僅有一個碳—碳

雙鍵之無環烴 [3]

- 2/08 • • • • 催化法 [3]
- 2/10 • • • • 用金屬氧化物 [3]
- 2/12 • • • • 用結晶矽酸鋁，例如分子篩 [3]
- 2/14 • • • • 用無機酸；酸之鹽或酐 [3]
- 2/16 • • • • 硫酸；硫酸鹽；氧化硫 [3]
- 2/18 • • • • 磷酸；磷酸鹽；氧化磷 [3]
- 2/20 • • • • 鹵酸；及其鹽 [3]
- 2/22 • • • • 金屬鹵化物；其有機錯合物 [3]
- 2/24 • • • • 用金屬 [3]
- 2/26 • • • • 用氫化物或有機化合物（2/22 優先） [3]
- 2/28 • • • • 用離子交換樹脂 [3]
- 2/30 • • • • 含金屬—碳鍵之化合物；金屬氫化物 [3]
- 2/32 • • • • 錯合物，例如，乙醯丙酮化物 [3]
- 2/34 • • • • 金屬—烴錯合物 [3]
- 2/36 • • • • 磷化三氫，砷化三氫，銻化三氫或三氫化銻 [3]
- 2/38 • • • 二烯或炔者 [3]
- 2/40 • • • 共軛二烯者 [3]
- 2/42 • • 形成環之均—或共—寡聚作用，而非 Diels-Alder 轉化 [3]
- 2/44 • • • 僅含共軛二烯者 [3]
- 2/46 • • • 催化法 [3]
- 2/48 • • • 僅含碳—碳參鍵之烴者 [3]
- 2/50 • • Diels-Alder 轉化 [3]
- 2/52 • • • 催化法 [3]
- 2/54 • 不飽和烴與飽和烴之加成，或與環上無不飽和側鏈之六節芳環烴

- 的加成 [3]
- 2/56 • • 與無環烴之加成 [3]
- 2/58 • • • 催化法 [3]
- 2/60 • • • • 用鹵化物 [3]
- 2/62 • • • • 用酸 [3]
- 2/64 • • 與六節芳環碳原子之加成 [3]
- 2/66 • • • 催化法 [3]
- 2/68 • • • • 用鹵化物 [3]
- 2/70 • • • • 用酸 [3]
- 2/72 • • 與含有六節芳環之烴的非芳環
原子之加成 [3]
- 2/74 • 同時發生氫化之加成 [3]
- 2/76 • 具有部分脫氫之烴的縮合 [3]
- 2/78 • • 部分燃燒法 [3]
- 2/80 • • 用電之方法 [3]
- 2/82 • • 氧化偶合 [3]
- 2/84 • • • 催化法 [3]
- 2/86 • 烴及非烴之間縮合 [3]
- 2/88 • • 增長及消除反應 [3]
- 4/00 由含碳原子數較多的烴製備烴 [3]**
- 4/02 • 用裂化烴或烴之混合物或標準氣
態的烴餾分 [3]
- 4/04 • • 熱法 [3]
- 4/06 • • 催化法 [3]
- 4/08 • 由分子中裂解出脂族或脂環族部
分 [3]
- 4/10 • • 由無環烴 [3]
- 4/12 • • 由含六節芳環之烴，例如，丙
基甲苯裂解為乙烯基甲苯 [3]
- 4/14 • • • 裂解發生於芳—脂鍵上 [3]
- 4/16 • • • • 熱法 [3]
- 4/18 • • • • 催化法 [3]
- 4/20 • • • • 就地生成的氫，例如由蒸
氣 [3]
- 4/22 • 解聚為原來的單體，例如二聚環
戊二烯裂解為環戊二烯 [3]
- 4/24 • 於脂族—脂族鍵上裂解多芳基取
代的脂族化合物，例如，1、4—
二苯基丁烷裂解為苯乙烯 [3]
- 4/26 • 於未耦合的六節芳環間之鍵上裂
解多芳基化合物，例如聯苯裂解
為苯 [3]

- 5/00 由含相同碳原子數的烴製備烴**
- 5/02 • 氫化法
- 5/03 • • 非芳碳—碳雙鍵者 [3]
- 5/05 • • • 部分氫化 [3]
- 5/08 • • 碳—碳參鍵者
- 5/09 • • • 製成碳—碳雙鍵 [3]
- 5/10 • • 芳族六節環者
- 5/11 • • • 部分氫化 [3]
- 5/13 • • 同時異構化 [3]
- 5/22 • 異構化（同時氫化見 5/13）
- 5/23 • • 碳—碳不飽和鍵之重排 [3]
- 5/25 • • • 碳—碳雙鍵之遷移 [3]
- 5/27 • • 烴骨架中碳原子之重排
- 5/29 • • • 改變環之碳原子數而保持環
之數目不變 [3]
- 5/31 • • • 改變環數 [3]
- 5/32 • 同時生成游離氫之脫氫 [2]
- 5/327 • • 僅形成非芳碳—碳雙鍵 [3]
- 5/333 • • • 催化法 [3]
- 5/35 • • 僅形成碳—碳參鍵 [3]
- 5/367 • • 由已有的六節環形成芳族六節
環，例如，乙基環己烷脫氫生
成乙苯 [3]
- 5/373 • • 同時異構化 [3]
- 5/387 • • • 非六節環之環狀化合物形成
含六節芳環化合物 [3]
- 5/393 • • • 環化作用形成芳族六節環，
例如，正己烷脫氫生成苯
[3]
- 5/41 • • • • 催化法 [3]
- 5/42 • 有氫接受體之脫氫

附註

- (1) 本目內：
- 於催化劑同時發生還原的
情況下，催化劑被視作接
受體體系之形成部分； [3]
 - 為結合還原之接受體體系
所加入的化合物，不視成
屬於接受體體系。 [3]
- (2) 於就地形成接受體體系或就
地再生還原之接受體體系的

- 情況下，接受體體系依給與的物質分類。[3]
- 5/44 • • 用鹵素或含鹵素之化合物作接受體 [2]
- 5/46 • • 用硫或含硫化合物作接受體 [2]
- 5/48 • • 用氧作接受體 [2]
- 5/50 • • 用有機化合物作接受體 [2]
- 5/52 • • • 用烴作接受體，例如，烴之岐化，即

$$2C_nH_p \rightarrow C_nH_{p+q} + C_nH_{p-q}$$
 [2]
- 5/54 • • 用含於 5/44 至 5/50 內之多於一個目內具備的至少兩種化合物之接受體體系 [3]
- 5/56 • • • 僅含氧及鹵素或含鹵素化合物 [3]
- 6/00 由含不同碳原子數之烴的再分配反應製備烴 [3]**
- 6/02 • 於不飽和碳—碳鍵上之複分解反應 [3]
- 6/04 • • 於碳—碳雙鍵上 [3]
- 6/06 • • • 於環之碳—碳雙鍵上 [3]
- 6/08 • 於飽和碳—碳鍵上之轉化 [3]
- 6/10 • • 不含六節芳環之烴 [3]
- 6/12 • • 僅含六節芳環之烴 [3]
- 7/00 烴之純化，分離或穩定化；添加劑之使用 [5]**
- 7/04 • 蒸餾 [3]
- 7/05 • • 借助於輔助化合物 [3]
- 7/06 • • • 共沸蒸餾
- 7/08 • • • 萃取蒸餾
- 7/09 • 分凝 [3]
- 7/10 • 萃取，即借助於液體純化或分離液態烴 [3]
- 7/11 • 吸收，即借助於液體純化或分離氣態烴 [3]
- 7/12 • 吸附，即借助於固體純化或分離烴，如用離子交換劑 [3]
- 7/13 • • 用分子篩技術 [2,3]
- 7/135 • 用氣相色譜 [3]
- 7/14 • 結晶；晶體之純化或分離 [3]
- 7/144 • 用隔膜，例如選擇性滲透 [3]
- 7/148 • 處理使至少一種化合物發生化學改變 [3]
- 7/152 • • 形成加成物或錯合物 [3]
- 7/156 • • • 用銅鹽溶液
- 7/163 • • 氫化 [3]
- 7/167 • • • 為除去含碳—碳參鍵之化合物 [3]
- 7/17 • • 用酸或氧化硫 [3]
- 7/171 • • • 硫酸或發煙硫酸 [7]
- 7/173 • • 用有機金屬化合物 [3]
- 7/177 • • 混合物內至少一種化合物之選擇寡聚作用或選擇聚合作用 [3]
- 7/20 • 使用添加劑，例如，為穩定作用 [3]
- 9/00 無環飽和烴**
- 9/02 • 一至四個碳原子者 [5]
- 9/04 • • 甲烷（污泥處理之生產見 C02F 11/04） [5]
- 9/06 • • 乙烷
- 9/08 • • 丙烷
- 9/10 • • 含四個碳原子者
- 9/12 • • • 異丁烷
- 9/14 • 五至十五個碳原子者
- 9/15 • • 直鏈烴 [3]
- 9/16 • • 支鏈烴
- 9/18 • • • 含五個碳原子者
- 9/21 • • • 2,2,4—三甲基戊烷 [3]
- 9/22 • 多於十五個碳原子者
- 11/00 無環不飽和烴**
- 11/02 • 烯烴
- 11/04 • • 乙烯
- 11/06 • • 丙烯
- 11/08 • • 含四個碳原子者
- 11/09 • • • 異丁烯 [3]
- 11/10 • • 含五個碳原子者
- 11/107 • • 含六個碳原子
- 11/113 • • • 甲基戊烯 [3]
- 11/12 • 二烯烴
- 11/14 • • 丙二烯
- 11/16 • • 四個碳原子者

- 11/167 . . . 1,3-丁二烯 [3]
- 11/173 . . . 五個碳原子者 [3]
- 11/18 . . . 異戊二烯 [3]
- 11/20 . . . 1,3-戊二烯 [3]
- 11/21 . 三烯烴; 四烯烴; 其他多烯烴 [2,3]
- 11/22 . 含碳-碳參鍵者
- 11/24 . . 乙炔 (用濕法生產乙炔氣見 C10H) [5]
- 11/28 . 含碳-碳雙鍵及碳-碳參鍵者
- 11/30 . . 乙烯基乙炔

13/00 含有除六節芳環外之環的環烴，或具有六節芳環之環烴

- 13/02 . 單環烴或其無環烴衍生物
- 13/04 . . 具三節環者
- 13/06 . . 具四節環者
- 13/08 . . 具五節環者
- 13/10 . . . 具環戊烷環者
- 13/11 為不飽和烴基取代者 [2]
- 13/12 . . . 具環戊烯環者
- 13/15 . . . 具環戊二烯環者 [3]
- 13/16 . . 具六節環者
- 13/18 . . . 具環己烷環者
- 13/19 為不飽和烴基取代者 [2]
- 13/20 . . . 具環己烯環者
- 13/21 1,8-對薄荷二烯 [2]
- 13/23 . . . 具環己二烯環者 [3]
- 13/24 . . 具七節環者
- 13/26 . . 具八節環者
- 13/263 . . . 具環辛烯或環辛二烯環者 [3]
- 13/267 . . . 具環辛三烯或環辛四烯環者 [3]
- 13/271 . . 具九至十一節環者 [3]
- 13/273 . . 具十二節環者 [3]
- 13/275 . . . 不飽和十二節環 [3]
- 13/277 具環十二碳三烯環者 [3]
- 13/28 . 多環烴或其無環烴衍生物

附註

僅由具最大數無累積雙鍵之稠合六節環組成的環狀體系分類見 15/00 目 [3]

- 13/32 . . 具稠環者
- 13/34 . . . 具四碳原子二環體系者
- 13/36 . . . 具五碳原子二環體系者
- 13/38 . . . 具六碳原子二環體系者
- 13/39 . . . 具七碳原子二環體系者 [3]
- 13/40 具二環庚烷環結構者 [3]
- 13/42 具二環庚烯環結構者 [3]
- 13/43 為不飽和無環烴基取代者 [3]
- 13/44 . . . 具八碳原子二環體系者
- 13/45 . . . 具九碳原子二環體系者 [3]
- 13/465 茛; 完全或部分氫化之茛 [3]
- 13/47 . . . 具十碳原子二環體系者 [3]
- 13/48 完全或部分氫化之萘 [3]
- 13/50 十氫化萘 [3]
- 13/52 蒽; 完全或部分氫化之蒽 [3]
- 13/54 . . . 具三元稠環者
- 13/547 至少一個環非為六節環，其他環最大者為六節環 [3]
- 13/553 二環戊二烯并苯; 完全或部分氫化二環戊二烯并苯 [3]
- 13/567 菲; 完全或部分氫化菲 [3]
- 13/573 具三個六節環者 [3]
- 13/58 完全或部分氫化蒽 [3]
- 13/60 完全或部分氫化菲 [3]
- 13/605 具橋環體系者 [3]
- 13/61 橋茛，例如，二聚環戊二烯 [3]
- 13/615 金剛烷 [3]
- 13/62 . . . 具多於三個稠環者 [3]
- 13/64 具橋環體系者 [3]
- 13/66 僅含四個環之稠環體系 [3]
- 13/68 具橋環體系者 [3]
- 13/70 . . . 由至少兩個相互不稠合的芳環體系組成之稠環體系，其中不稠合的芳環體系係為芳環非鄰位的碳鏈形成之環形結構連接而成者，例如

繫 (cyclophanes) [3]

13/72 . . . 螺環烴 [3]

15/00 僅含六節芳環作為環部分之芳烴

15/02 . 單環芳烴

15/04 . . 苯

15/06 . . 甲苯

15/067 . . C₈H₁₀ 烴 [3]

15/073 . . . 乙苯 [3]

15/08 . . . 二甲苯 [3]

15/085 . . 異丙苯 [3]

15/107 . . 含有至少六個碳原子之飽和側鏈者，例如，清潔劑烷基化物 [3]

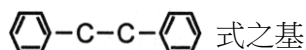
15/113 . . . 至少含兩個飽和側鏈，每個側鏈至少含六個碳原子 [3]

15/12 . 多環非稠合芳烴

15/14 . . 所有苯基均直接相連 [3]

15/16 . . 至少含兩個，為一個非環碳原子連接個而成之苯基

15/18 . . 至少含一個



15/20 . 多環稠合烴

15/24 . . 含兩個環者

15/27 . . 含三個環者 [3]

15/28 . . . 蒽 [3]

15/30 . . . 菲 [3]

15/38 . . 含四個環者 [3]

15/40 . 為不飽和烴基取代者 [3]

15/42 . . 一元環者 [3]

15/44 . . . 含碳—碳雙鍵取代烴基者 [3]

15/46 苯乙烯；烷基苯乙烯 [3]

15/48 . . . 含碳—碳參鍵取代烴基者 [3]

15/50 . . 非稠合多環者 [3]

15/52 . . . 含式 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}=\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5$ 基者 [3]

15/54 . . . 含式 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5$ 基者 [3]

15/56 . . 稠合多環者 [3]

15/58 . . . 含兩個環者 [3]

15/60 . . . 含三個環者 [3]

15/62 . . . 含四個環者 [3]

含碳及鹵素，含或不含氫之化合物

17/00 製備鹵化烴之方法

17/007 . 由碳或碳化物與鹵素 [6]

17/013 . 利用鹵素之加成 [6]

17/02 . . 至不飽和烴 [6]

17/04 . . 至不飽和鹵化烴 [6]

17/06 . . 併有氫為鹵素取代

17/07 . 利用鹵化氫之加成 [6]

17/08 . . 至不飽和烴 [6]

17/087 . . 至不飽和鹵化烴 [6]

17/093 . 利用被鹵素取代 [6]

17/10 . . 取代氫原子（併有鹵素加成至不飽和烴見 17/06） [6]

17/12 . . . 於芳族化合物之環上 [6]

17/14 . . . 於芳族化合物之側鏈上 [6]

17/15 . . 以氧為輔助試劑，例如氯氧化 [2,6]

17/152 . . . 烴者 [3,6]

17/154 飽和烴者 [3,6]

17/156 不飽和烴者 [3,6]

17/158 . . . 鹵化烴者 [3,6]

17/16 . . 取代烴基 [3,6]

17/18 . . 取代羰基之氧原子 [6]

17/20 . . 被其它鹵素原子取代鹵素原子 [6]

17/21 . . . 同時增加鹵素原子之數目 [6]

17/23 . 利用去鹵化作用 [6]

17/25 . 經由鹵化烴中分出鹵化氫 [6]

17/26 . 利用在碳架中增加碳原子數之反應

17/263 . . 利用縮合反應 [6]

17/266 . . . 烴與鹵化烴之縮合者 [6]

17/269 . . . 僅有鹵化烴之縮合者 [6]

17/272 . . 利用加成反應 [6]

17/275 . . . 烴與鹵化烴之加成者 [6]

17/278 . . . 僅有鹵化烴之加成者 [6]

17/281 僅有一個化合物者 [6]

17/30 . . 利用 Diels-Alder 合成

17/32 . . 利用環化合物中引入鹵化烷基

17/35 . 利用不影響分子中碳或鹵原子數

- 目之反應 [6]
- 17/354 · · 利用氫化 [6]
- 17/357 · · 利用脫氫化 [6]
- 17/358 · · 利用異構化 [6]
- 17/361 · 利用減少碳原子數之反應 [6]
- 17/363 · · 除去羧基者 [6]
- 17/367 · · 去聚合反應者 [6]
- 17/37 · 利用鹵化烴之不均化反應 [6]
- 17/38 · 分離；純化；安定化；使用添加物
- 17/383 · · 利用蒸餾者 [6]
- 17/386 · · · 與輔助化合物 [6]
- 17/389 · · 利用固體吸附 [6]
- 17/392 · · 利用結晶；純化或晶體分離[6]
- 17/395 · · 利用至少一化合物之化學修正之處理 [6]
- 17/42 · · 使用添加物，例如用於安定 [3,6]
- 19/00 含有鹵原子之無環飽和化合物 [5]**
- 19/01 · 含氯 [6]
- 19/03 · · 氯甲烷 [6]
- 19/04 · · · 氯仿 [6]
- 19/041 · · · 四氯化碳 [6]
- 19/043 · · 氯乙烷 [6]
- 19/045 · · · 二氯乙烷 [3,6]
- 19/05 · · · 三氯乙烷 [3,6]
- 19/055 · · · 四氯乙烷 [3,6]
- 19/07 · 含碘 [2]
- 19/075 · 含溴 [6]
- 19/08 · 含氟
- 19/10 · · 與氯 [6]
- 19/12 · · · 有兩個碳原子 [6]
- 19/14 · · 與溴 [6]
- 19/16 · · 與碘 [6]
- 21/00 含有鹵原子之無環不飽和化合物 [5]**
- 21/02 · 含碳—碳雙鍵
- 21/04 · · 氯烯
- 21/06 · · · 氯乙烯
- 21/067 · · · 烯丙基氯；甲代烯丙基氯[3]
- 21/073 · · · 二氯烯烴 [3]
- 21/08 · · · · 1,1 — 二氯乙烯 [3]
- 21/09 · · · · 二氯丁烯 [3]
- 21/10 · · · 三氯乙烯
- 21/12 · · · 四氯乙烯
- 21/14 · · 含溴
- 21/16 · · · 巴豆基溴
- 21/17 · · 含磺 [5]
- 21/18 · · 含氟
- 21/185 · · · 四氟乙烯 [5]
- 21/19 · · 鹵代二烯 [3]
- 21/20 · · · 鹵代丁二烯 [3]
- 21/21 · · · · 氯丁二烯 [3]
- 21/215 · · 含多於兩個碳—碳雙鍵之鹵代多烯 [3]
- 21/22 · 含碳—碳參鍵
- 22/00 鹵原子連於非環碳原子上之環狀化合物 [5]**
- 22/02 · 環上有不飽和部分 [5]
- 22/04 · · 含有六節芳環 [5]
- 22/06 · · · 三氯甲基苯 [5]
- 22/08 · · · 含氟 [5]
- 23/00 含至少一個鹵原子與六節芳環以外之環連接的化合物**
- 23/02 · 單環鹵代烴
- 23/04 · · 含三節環
- 23/06 · · 含四節環
- 23/08 · · 含五節環
- 23/10 · · 含六節環
- 23/12 · · · 六氯環己烷
- 23/14 · · 含七節環
- 23/16 · · 含八節環
- 23/18 · 多環鹵代烴
- 23/20 · · 具稠環，而非芳族者
- 23/22 · · · 具含四個碳原子之雙環體系
- 23/24 · · · 具含有五個碳原子之雙環體系
- 23/26 · · · 具含有六個碳原子之雙環體系
- 23/27 · · · 具含有七個碳原子之雙環體系 [5]

- 23/28 飽和雙環體系 [5]
- 23/30 單一不飽和雙環體系 [5]
- 23/32 具含有八個碳原子之雙環體系 [5]
- 23/34 鹵代完全或部分氫化之茛
- 23/36 鹵代完全或部分氫化之萘
- 23/38 具三個稠環
- 23/40 鹵代完全或部分氫化之芴
- 23/42 鹵代完全或部分氫化之蒽
- 23/44 鹵代完全或部分氫化之菲
- 23/46 具多於三個稠環

25/00 最少有一個鹵原子連至六節芳環上之化合物

- 25/02 . 單環芳鹵烴
- 25/06 . . 一氯苯 [3]
- 25/08 . . 二氯苯 [3]
- 25/10 . . 三氯苯 [3]
- 25/12 . . 六氯苯 [3]
- 25/125 . . 鹵代二甲苯 [2,3]
- 25/13 . . 含氟 [2,3]
- 25/18 . 多環鹵代芳烴
- 25/20 . . 二氯二苯基三氯乙烷
- 25/22 . . 具稠環
- 25/24 . 具不飽和側鏈之鹵代芳烴
- 25/28 . . 鹵代苯乙烯 [3]

含碳及氧，具或不具氫及鹵素之化合物 [2]

27/00 同時產生多於一類含氧化合物之方法

- 27/02 . 有機酸酯之皂化
- 27/04 . 用含氧化合物之還原(29/14 優先)
- 27/06 . . 碳之氧化物的氫化
- 27/08 . . . 用活動催化劑床
- 27/10 . 用烴之氧化法
- 27/12 . . 用氧
- 27/14 . . . 全氣相反應
- 27/16 . . 用其他氧化劑
- 27/18 . 用炔與醛、酮或烯化氧加成
- 27/20 . 用氧化反應
- 27/22 . . 用特效催化劑

- 27/24 . . 用活動催化劑床
- 27/26 . 純化；分離；穩定化
- 27/28 . . 用蒸餾
- 27/30 . . . 用共沸蒸餾
- 27/32 . . . 用萃取蒸餾
- 27/34 . . 用萃取

29/00 含羥基或氧—金屬基連接碳原子之化合物的製備，不包括六節芳環

- 29/03 . 羥基與不飽和碳—碳鍵加成，例如，利用過氧化氫 [3]
- 29/04 . . 碳—碳雙鍵之水合
- 29/05 . . . 於無機酸中生成吸收產物及此等之水解 [3]
- 29/06 於硫酸內 [3]
- 29/08 於磷酸內 [3]
- 29/09 . 用水解(有機酸酯之水解見 27/02) [3]
- 29/10 . . 醚之水解，包括環醚，例如，環氧乙烷
- 29/12 . . 無機酸酯之水解 [3]
- 29/124 . . . 鹵化物之水解 [3]
- 29/128 . 用醇解(有機酸酯之水解見 27/02) [3]
- 29/132 . 用含氧官能基之還原 [3]
- 29/136 . . 含 $>C=O$ 基者，例如 $-COOH$ [3]
- 29/14 . . . $-CHO$ 基者 [3]
- 29/141 用氫氣或含氫氣體 [5]
- 29/143 . . . 酮之還原 [5]
- 29/145 用氫氣或含氫氣體 [5]
- 29/147 . . . 羧酸或其衍生物之還原 [5]
- 29/149 用氫氣或含氫氣體 [5]
- 29/15 . 完全用碳之氧化物的還原 [3]
- 29/151 . . 用氫氣或含氫氣體 [5]
- 29/152 . . . 以所用的反應器為特徵 [5]
- 29/153 . . . 以所用的催化劑為特徵 [5]
- 29/154 含銅、銀、金或其化合物 [5]
- 29/156 含鐵族金屬、鉑族金屬或其他化合物 [5]
- 29/157 含鉑族金屬或其化合物

[5]

- 29/158 含銻或其化合物 **[5]**
- 29/159 . . 用除氫氣或含氫氣體以外之還原劑 **[5]**
- 29/16 . 用與還原相結合的氧代反應
- 29/17 . 用碳－碳雙鍵或參鍵之氫化 **[3]**
- 29/19 . . . 六節芳環中者 **[3]**
- 29/20 . . . 用羥基在非稠環上取代 **[3]**
- 29/32 . 用無羥基形成的反應增加碳原子數 **[3]**
- 29/34 . . 用含羥基或由無機酯基而得之羥基化合物縮合，例如 Guerbet 反應 **[3]**
- 29/36 . 用形成羥基之反應增加碳原子數，可經過羥基衍生物之中間物生成，例如氧－金屬 **[3]**
- 29/38 . . 用醛或酮反應 **[3]**
- 29/40 . . . 用含碳－金屬鍵之化合物**[3]**
- 29/42 . . . 用含碳－碳參鍵之化合物，例如金屬－炔烴 **[3]**
- 29/44 . 用加成反應增加碳原子數，即反應至少包括一個碳－碳雙鍵或參鍵（29/16 優先）**[3]**
- 29/46 . . 用雙烯合成 **[3]**
- 29/48 . 用形成羥基之氧化反應 **[3]**
- 29/50 . . 僅用分子氧 **[3]**
- 29/52 . . . 需要存在無機硼化合物時，形成的中間物之水解 **[3]**
- 29/54 . . . 由含碳－金屬鍵之化合物開始，然後將氧－金屬鍵轉化為羥基 **[3]**
- 29/56 . 用異構化 **[3]**
- 29/58 . 用消除鹵素，例如氫解，分裂（29/124 優先）**[3]**
- 29/60 . 消除羥基，例如脫水（29/34 優先）**[3]**
- 29/62 . 用引入鹵素；鹵原子為其他鹵原子取代 **[3]**
- 29/64 . 用同時引入羥基及鹵素 **[3]**
- 29/66 . . 用原處生成的次鹵酸與碳－碳不飽和鍵加成 **[3]**
- 29/68 . 醇金屬之製備（29/42、29/54 優

先）**[3]**

- 29/70 . . 羥基轉變為氧－金屬基 **[3]**
- 29/72 . . 碳－金屬鍵之氧化 **[3]**
- 29/74 . 分離；純化；穩定化；添加劑之使用
- 29/76 . . 用物理方法處理 **[3]**
- 29/78 . . . 濃縮或結晶 **[3]**
- 29/80 . . . 蒸餾 **[3]**
- 29/82 共沸蒸餾 **[3]**
- 29/84 萃取蒸餾 **[3]**
- 29/86 . . . 用液－液法處理 **[3]**
- 29/88 . . 處理使至少一種化合物發生化學改性（化學吸附見 29/76）**[3]**
- 29/90 . . . 僅用氫 **[3]**
- 29/92 . . . 用連串的轉化及再設計 **[3]**
- 29/94 . . 使用添加劑，例如，為穩定化 **[3]**

31/00 非環碳原子上連有羥基或氧－金屬基之飽和化合物

- 31/02 . 非環一元醇
- 31/04 . . 甲醇
- 31/08 . . 乙醇
- 31/10 . . 含三個碳原子
- 31/12 . . 含四個碳原子
- 31/125 . . 含五至廿二個碳原子 **[3]**
- 31/13 . 含飽和環之一元醇 **[2,3]**
- 31/133 . . 單環者 **[3]**
- 31/135 . . . 具五或六元環；環烷醇 **[3]**
- 31/137 . . 稠合多環系 **[3]**
- 31/18 . 非環多元醇
- 31/20 . . 二元醇
- 31/22 . . 三元醇，例如甘油 **[3]**
- 31/24 . . 四元醇，例如季戊四醇 **[3]**
- 31/26 . . 六元醇
- 31/27 . 含飽和環之多元醇 **[3]**
- 31/28 . 醇金屬
- 31/30 . . 醇之鹼金屬或鹼土金屬
- 31/32 . . 醇鋁
- 31/34 . 鹵代醇
- 31/36 . . 氟以外之鹵素 **[3]**
- 31/38 . . 僅含氟作為鹵素者 **[3]**
- 31/40 . . 全鹵代醇 **[3]**

- 31/42 • • 非環鹵代多元醇 [3]
 31/44 • • 含飽和環之鹵代醇 [3]
33/00 非環碳原子上連羥基或氧—金屬基之不飽和化合物

附註

本目，於六節芳環及其他環稠合之環系內，屬於苯環之雙鍵不視作與之稠合的非芳環之不飽和鍵。例如：1,2,3,4—四氫化萘，其外之視作飽和的。[3]

- 33/02 • 含碳—碳雙鍵之非環醇
 33/025 • • 僅有一個雙鍵 [3]
 33/03 • • • 於 β —位，例如烯丙醇，甲代烯丙基醇 [3]
 33/035 • • • 鏈烯二醇 [3]
 33/04 • 含碳—碳參鍵之非環醇
 33/042 • • 僅有一個參鍵 [3]
 33/044 • • • 鏈炔二醇 [3]
 33/046 • • • • 丁炔二醇 [3]
 33/048 • • 含雙鍵及參鍵 [3]
 33/05 • 除六節芳環外之環醇 [2]
 33/12 • • 含五節環 [3]
 33/14 • • 含六節環 [3]
 33/16 • • 含多於六節之環 [3]
 33/18 • 僅含六節芳環作為環部之一元芳醇 [3]
 33/20 • • 單環者 [3]
 33/22 • • • 苺醇；苯乙醇 [3]
 33/24 • • 非稠合體系多環者 [3]
 33/26 • 僅六節芳環作為環部之多元芳醇 [3]
 33/28 • 僅含六節芳環作為環部之具不飽和側鏈的芳醇 [3]
 33/30 • • 單環者 [3]
 33/32 • • • 肉桂醇 [3]
 33/34 • 含六節芳環及其他環之一元醇 [3]
 33/36 • 含六節芳環及其他環之多元醇 [3]
 33/38 • 含六節芳環及其他與有不飽和側

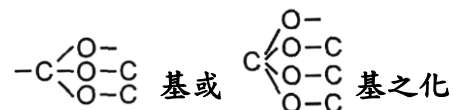
- 鏈之芳環的醇 [3]
 33/40 • 不飽和鹵代醇 [3]
 33/42 • • 非環者 [3]
 33/44 • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 33/46 • • 僅含六節芳環作為環部 [3]
 33/48 • • • 具不飽和側鏈之芳環 [3]
 33/50 • • 含六節芳環及其他環 [3]
35/00 至少有一個羥基或氧—金屬基連至除六節芳環外之環的碳原子上之化合物 [2]
 35/02 • 單環者
 35/04 • • 含三或四節環者
 35/06 • • 含五節環者
 35/08 • • 含六節環者
 35/12 • • • 薄荷腦，蓋醇
 35/14 • • • 環上具有一個以上之羥基
 35/16 • • • • 環己六醇
 35/17 • • • 僅具不飽和側鏈之環 [3]
 35/18 • • • 在環上至少具不飽和環 [3]
 35/20 • • 含七或八節環
 35/205 • • 含九至十二節環，例如環十二烷醇 [3]
 35/21 • 多環醇，於非稠合環上至少連一個羥基者
 35/22 • 多環醇，於稠合環上至少連一個羥基者 [2]
 35/23 • • 羥基連於雙環稠環體系上 [3]
 35/24 • • • 含五個碳原子之稠環體系[3]
 35/26 • • • • 二環戊二醇 [3]
 35/27 • • • 含六個碳原子之稠環體系[3]
 35/28 • • • 含七個碳原子之稠環體系[3]
 35/29 • • • • 為 [2.2.1] 體系 [3]
 35/30 • • • • • 冰片，異冰片 [3]
 35/31 • • • 含八個碳原子之稠環體系[3]
 35/32 • • • 稠環體系係 [4.3.0] 體系，例如茛酚 [3]
 35/34 • • • 稠環體系係 [5.3.0] 體系，例如莖醇 [3]
 35/36 • • • 稠環體系係 [4.4.0] 體系，例如萘酚 [3]
 35/37 • • 三環稠環體系上具有羥基 [3]
 35/38 • • • 由茛骨架而得者 [3]

- 35/40 • • • 由萸骨架而得者 [3]
- 35/42 • • • 由菲骨架而得者 [3]
- 35/44 • • 多於三環之稠環體系上具有羥基
- 35/46 • 連至環上羥基的氧—金屬衍生物 [3]
- 35/48 • 鹵代衍生物 [3]
- 35/50 • • 至少含兩個環之醇 [3]
- 35/52 • • 具稠環體系之醇 [3]
- 37/00 有羥基或氧—金屬基連至六節芳環碳原子上化合物之製備**
- 37/01 • 六節芳環上之官能基為羥基所置換，例如水解 [3]
- 37/02 • • 為鹵素被取代 [3]
- 37/04 • • 為 SO_3H 基或其衍生物被取代 [3]
- 37/045 • • 以氫連主環上之基團被取代
- 37/05 • • • 為 NH_2 基被取代
- 37/055 • • 以氧與環連接的基團被取代，例如醚基 [3]
- 37/06 • 非六節芳環或原處形成的六節芳環之轉化，例如脫氫
- 37/07 • • 同時發生環上 $\text{C}=\text{O}$ 基之還原 [3]
- 37/08 • 氫過氧化物之分解，例如氫過氧異丙苯
- 37/11 • 用增加碳原子數之反應 [3]
- 37/14 • • 用加成反應，即至少含有一個碳—碳不飽和鍵之反應 [3]
- 37/16 • • 用含羥基之酚、醇或醚以及此等之無機酸酯基的縮合反應 [3]
- 37/18 • • 用鹵代物鹵原子之縮合反應
- 37/20 • • 用醛或酮
- 37/48 • 羥基之交換，此羥基可為由其他化合物所取代者，例如反羥化作用 [3]
- 37/50 • 用減少碳原子數之反應（37/01、37/08、37/48 優先） [3]
- 37/52 • • 用多芳族化合物裂解，例如，多酚烷 [3]
- 37/54 • • • 用木質素或亞硫酸鹽廢液水解 [3]
- 37/56 • • 羧基或醛基為羥基所置換 [3]
- 37/58 • 用分子氧，羥基直接引入六節芳環之 $\text{CH}-$ 基上的氧化反應 [3]
- 37/60 • 用其他氧化劑或與分子氧之混合物，羥基直接引入六節芳環之 $\text{CH}-$ 基上的氧化反應 [3]
- 37/62 • 引入鹵素；鹵原子為其他鹵原子取代 [3]
- 37/64 • 氧—金屬基連至六節芳環碳原子上之氧—金屬化合物的製備 [3]
- 37/66 • • 羥基轉化為氧金屬基 [3]
- 37/68 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3]
- 37/70 • • 用物理方法處理 [3]
- 37/72 • • • 用液—液法處理 [3]
- 37/74 • • • 用蒸餾法 [3]
- 37/76 • • • • 用水蒸汽蒸餾 [3]
- 37/78 • • • • 用共沸蒸餾 [3]
- 37/80 • • • • 用萃取蒸餾 [3]
- 37/82 • • • 用固—液法處理；用化學吸附 [3]
- 37/84 • • • 用結晶法 [3]
- 37/86 • • 處理使發生化學改良（用化學吸附見 37/82） [3]
- 37/88 • • 添加劑之使用，例如，為穩定化 [3]
- 39/00 至少有一個羥基或氧—金屬基連至六節芳環碳原子上之化合物**
- 附註**
- 本目內，六節芳環與其他環之稠環系，苯環之雙鍵不視作稠合非芳環的不飽和雙鍵。
- 39/02 • 具有飽和側鏈之單芳環
- 39/04 • • 苯酚
- 39/06 • • 烷基化苯酚
- 39/07 • • • 僅含甲基作為烷基，例如甲苯酚，二甲苯酚 [3]
- 39/08 • • 二羥基苯；此等之烷基化衍生物
- 39/10 • • 多羥基苯；此等之烷基化衍生物

- 物 (39/08 優先)
- 39/11 • • 烷基化羥基苯，含不與環連接的羥基，例如水楊醇 [3]
- 39/12 • 具有飽和側鏈之多芳環
- 39/14 • • 至少有一個羥基之二環稠環系 [3]
- 39/15 • • 所有羥基於非稠環上 [3]
- 39/16 • • • 雙—(羥基苯基)—烷；三—(羥基苯基)—烷 [3]
- 39/17 • • 含除六節芳環以外之其他環[2]
- 39/18 • 具不飽和側鏈之單芳環
- 39/19 • • 含碳—碳雙鍵，但無碳—碳參鍵 [3]
- 39/20 • • • 羥基苯乙烯 [3]
- 39/205 • 僅有六節芳環成為環之部分，具不飽和側鏈之多芳環 [3]
- 39/21 • • 至少一個羥基於非稠環上 [3]
- 39/215 • • • 含
- $$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}=\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$$
- 結構，例如，二乙基己烯雌酚 [3]
- 39/225 • • 至少一個羥基於稠環系上 [3]
- 39/23 • 含六節芳環及其他環，具不飽和側鏈之多環 [3]
- 39/235 • 羥基連至六節芳環上之金屬衍生物 [3]
- 39/24 • 鹵化衍生物
- 39/26 • • 有鹵素連至環碳原子上之單環者、單羥基者
- 39/27 • • • 所有鹵原子均連至環上
- 39/28 • • • • 一個氯原子
- 39/30 • • • • 兩個氯原子
- 39/32 • • • • 三個氯原子
- 39/34 • • • • 四個氯原子
- 39/36 • • • • 五氯苯酚
- 39/367 • • 僅有六節芳環之非稠合多環，例如鹵代多—(羥基苯基)—烷 [3]
- 39/373 • • 所有羥基均連至非稠合環上及具有不飽和側鏈之芳環上 [3]
- 39/38 • • 至少有一個羥基連至雙環稠合系上

- 39/40 • • 至少有一個羥基連至多於兩個環之稠環及環稠系上 [3]
- 39/42 • • 含六節芳環及其他環
- 39/44 • • 連至六節芳環碳原子上之羥基的金屬衍生物 [3]

41/00 醚之製備；有 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}- \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，



化合物的製備 [3]

- 41/01 • 醚之製備 [3]
- 41/02 • • 由環氧烷 [3]
- 41/03 • • • 環氧烷及羥基之反應 [3]
- 41/05 • • 不飽和化合物之加成 [3]
- 41/06 • • • 僅有有機化合物之加成 [3]
- 41/08 • • • • 加至碳—碳參鍵上 [3]
- 41/09 • • 含羥基化合物之脫水 [3]
- 41/14 • • 醚—氧有機部分及另外的有機部分交換，例如，反醚化作用 [3]
- 41/16 • • 無機酸酯或有機酸酯與羥基或氧—金屬基之反應 [3]
- 41/18 • • 不形成醚—氧鍵之反應 [3]
- 41/20 • • • 碳—碳雙鍵或參鍵之氫化[3]
- 41/22 • • • 引入鹵素；鹵素原子為其他鹵素原子所取代 [3]
- 41/24 • • • 消除鹵素；例如消除 HCl [3]
- 41/26 • • • 引入羥基或氧—金屬基 [3]
- 41/28 • • • 由縮醛，例如脫醇 [3]
- 41/30 • • • 增加碳原子數，例如寡聚作用 [3]
- 41/32 • • 用異構化 [3]
- 41/34 • • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3]
- 41/36 • • • 用固—液處理；用化學吸附 [3]
- 41/38 • • • 用液—液處理 [3]
- 41/40 • • • 用物理狀態之變化，例如，結晶 [3]
- 41/42 • • • • 用蒸餾 [3]
- 41/44 • • • 處理使發生化學改性（化學吸附見 41/36） [3]

- 41/46 . . . 使用添加劑，如為穩定化[3]
- 41/48 . 有 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之化合物的製備 [3]
- 41/50 . . 產生 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之反應 [3]
- 41/52 . . . 僅有鹵素之取代 [3]
- 41/54 . . . 與不飽和碳—碳鍵之加成而成者 [3]
- 41/56 . . . 由醛，多聚甲醛或酮之縮合而成者 [3]
- 41/58 . . 分離；純化；穩定化；使用添加劑 [3]
- 41/60 . 有 $\text{-C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之化合物的製備 [3]
- 43/00 醚；含有 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基 $\text{-C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之化合物**
- 43/02 . 醚
- 43/03 . . 所有的醚—氧鍵均連接至非環碳原子上 [3]
- 43/04 . . . 飽和醚 [3]
- 43/06 二乙醚 [3]
- 43/10 多羥基化合物者 [3]
- 43/11 含 -O-(C-C-O-)_n 單元，且 $2 \leq n \leq 10$ 之聚醚 [2,3]
- 43/115 含碳環 [3]
- 43/12 含鹵素 [3]
- 43/13 含羥基或氧—金屬基者 (43/11 優先) [3]
- 43/14 . . . 不飽和醚 [3]
- 43/15 僅含非芳族之碳—碳雙鍵 [3]
- 43/16 乙烯基醚 [3]
- 43/162 含除六節芳環以外之環[3]
- 43/164 含六節芳環 [3]
- 43/166 有不飽和側鏈之芳環[3]
- 43/168 有六節芳環及其他環[3]
- 43/17 含鹵素 [3]

- 43/172 含除六節芳環以外之環 [3]
- 43/174 含六節芳環 [3]
- 43/176 有不飽和側鏈之芳環 [3]
- 43/178 含羥基或氧—金屬基 [3]
- 43/18 . . 醚氧原子連至除六節芳環以外之環碳原子上
- 43/184 . . . 連至非稠合的環碳原子上[3]
- 43/188 . . . 不飽和醚 [3]
- 43/192 . . . 含鹵素 [3]
- 43/196 . . . 含羥基或氧—金屬基 [3]
- 43/20 . . 醚—氧原子連至六節芳環碳原子上
- 43/205 . . . 非稠合芳環 [3]
- 43/21 . . . 含六節芳環以外之環 [3]
- 43/215 . . . 有不飽和側鏈之六節芳環[3]
- 43/225 . . . 含鹵素 [3]
- 43/23 . . . 含羥基或氧—金屬基 [3]
- 43/235 . . 醚—氧原子連至六節芳環碳原子及非六節芳環之環碳原子之間 [3]
- 43/243 . . . 有不飽和側鏈之六節芳環 [3]
- 43/247 . . . 含鹵素 [3]
- 43/253 . . . 含羥基或氧—金屬基 [3]
- 43/257 . . 醚—氧原子鍵兩端均連接至六節芳環碳原子上 [3]
- 43/263 . . . 非稠合芳環 [3]
- 43/267 . . . 含其他環 [3]
- 43/275 . . . 所有的醚—氧原子均連至六節芳環之碳原子上 [3]
- 43/285 . . . 有不飽和側鏈之六節芳環[3]
- 43/29 . . . 含鹵素 [3]
- 43/295 . . . 含羥基或氧—金屬基 [3]
- 43/30 . 有 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之化合物

附註

本目內，縮醛碳原子係 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{-C}$ 基之碳原子。[3]

- 43/303 . . 縮醛碳原子連至非環碳原子上 [3]

- 43/305 • • 縮醛碳原子作為環節或連接至除六節芳環外之環碳原子上 [3]
- 43/307 • • 縮醛碳原子連至六節芳環碳原子上 [3]
- 43/313 • • 含鹵素 [3]
- 43/315 • • 氧原子分別連至非縮醛之碳原子上 [3]
- 43/317 • • 有 $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}-\text{X} \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基, X 係鹵素或金屬 [3]
- 43/32 • 有 $\text{-C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基之化合物
- 45/00 含有 >C=O 基, 僅連接碳或氫原子之化合物的製備; 此類化合物之螯合物的製備 [2]**
- 45/26 • 碳—碳參鍵之水合 [3]
- 45/27 • 氧化 [3]
- 45/28 • • -CH_x 一部分者 [3]
- 45/29 • • 羥基者 [3]
- 45/30 • • 用鹵化物, 例如, 次鹵化作用 [3]
- 45/31 • • 用可在原處再生, 例如被氧化的含汞原子之化合物 [3]
- 45/32 • • 用分子氧 [3]
- 45/33 • • • CH_x 一部分者 [3]
- 45/34 • • • • 於不飽和化合物內者 [3]
- 45/35 • • • • • 於丙烯或異丁烯內者 [3]
- 45/36 • • • • • 於含六節芳環化合物內 [3]
- 45/37 • • • >C-O- 官能基連至 >C=O 基者 [3]
- 45/38 • • • • 一級羥基者 [3]
- 45/39 • • • • 二級羥基者 [3]
- 45/40 • 用臭氧氧化; 用臭氧分解 [3]
- 45/41 • 用羧基或其衍生物之氫解或還原 [3]
- 45/42 • 水解 [3]
- 45/43 • • >CX_2 基, X 係鹵素 [3]
- 45/44 • 腓之還原及水解 [3]
- 45/45 • 縮合 [3]
- 45/46 • • Friedel—Crafts 反應 [3]
- 45/47 • • 用光氣 [3]
- 45/48 • • 包括脫羧 [3]
- 45/49 • 用與一氧化碳之反應 [3]
- 45/50 • • 用 oxo 反應 (氧代反應) [3]
- 45/51 • 用熱解, 重排或分解 [3]
- 45/52 • • 同一分子中含兩個羥基之脫水及重排 [3]
- 45/53 • • 氫過氧化物者 [3]
- 45/54 • • 含雙鍵氧原子之化合物, 例如, 酯 [3]
- 45/55 • • 寡聚或聚合氧代化合物者 [3]
- 45/56 • 由雜環化合物 (45/55 優先)
- 45/57 • • 氧作為唯一的雜原子 [3]
- 45/58 • • • 於三節環內 [3]
- 45/59 • • • 於五節環內 (由臭氧化物見 45/40)
- 45/60 • • • 於六節環內 [3]
- 45/61 • 用不形成 >C=O 基之反應 [3]
- 45/62 • • 碳—碳雙鍵或參鍵之氫化 [3]
- 45/63 • • 引入鹵素; 用其他鹵原子取代鹵原子 [3]
- 45/64 • • 引入僅含單鍵氧之官能基 [3]
- 45/65 • • 裂解除掉氫原子或官能基, 官能基之氫解 [3]
- 45/66 • • • 用脫水 [3]
- 45/67 • • 用異構化; 碳骨架大小之變化 [3]
- 45/68 • • • 用碳原子數之增加 [3]
- 45/69 • • • • 碳—碳雙鍵或參鍵之加成 [3]
- 45/70 • • • • 用僅含單鍵氧官能基之反應 [3]
- 45/71 • • • • • 羥基 [3]
- 45/72 • • • • 用含 >C=O 基化合物與相同或其他含 >C=O 基化合物之反應 [3]
- 45/73 • • • • • 結合氫化 [3]
- 45/74 • • • • • 結合脫水 [3]
- 45/75 • • • • • 與甲醛反應 [3]
- 45/76 • • • 利用乙烯酮 [3]
- 45/77 • 醛或酮之螯合物的製備 [3]

- 45/78 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3]
- 45/79 • • 用固-液處理；用化學吸附 [3]
- 45/80 • • 用液-液處理 [3]
- 45/81 • • 用物理狀態之變化，例如結晶 [3]
- 45/82 • • • 用蒸餾法 [3]
- 45/83 • • • • 用萃取蒸餾 [3]
- 45/84 • • • • 用共沸蒸餾 [3]
- 45/85 • • 處理使發生化學改性 [3]
- 45/86 • • 使用添加劑；例如，為穩定化 [3]
- 45/87 • 乙烯酮或二聚乙烯酮之製備 [3]
- 45/88 • • 由酮 [3]
- 45/89 • • 由羧酸，及其酐、酯或鹵化物 [3]
- 45/90 • • 分離；純化；穩定化；用添加劑 [3]

46/00 醌之製備 [3]

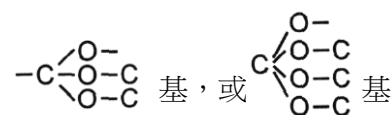
- 46/02 • 用氧化使生成醌型結構 [3]
- 46/04 • • 六節芳環中不飽和環碳原子者 [3]
- 46/06 • • 至少有一個經基連至六節芳環上者 [3]
- 46/08 • • • 用分子氧 [3]
- 46/10 • 分離；純化；穩定化；用添加劑 [3]

47/00 含有-CHO基之化合物

- 47/02 • 有-CHO基連接至非環碳原子或氫原子上之飽和化合物
- 47/04 • • 甲醛
- 47/042 • • • 由一氧化碳製備 [3]
- 47/045 • • • 用解聚製備 [3]
- 47/048 • • • 用烴之氧化製備 [3]
- 47/052 • • • 用甲醇之氧化製備 [3]
- 47/055 • • • • 用貴金屬或其化合作為催化劑 [3]
- 47/058 • • • 分離；純化；穩定化；用添加劑 [3]
- 47/06 • • 乙醛
- 47/07 • • • 用氧化製備
- 47/09 • • • 分離；純化；穩定化；用添

加劑 [3]

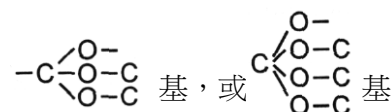
- 47/105 • • 含環者 [3]
- 47/11 • • • 單環者 [3]
- 47/115 • • • 含稠環系者 [3]
- 47/12 • • 含多於一個-CHO基者
- 47/127 • • • 乙二醛 [3]
- 47/133 • • • 含環者 [3]
- 47/14 • • 含鹵素者
- 47/16 • • • 三氯乙醛
- 47/17 • • • 含環者 [3]
- 47/19 • • 含經基者 [3]
- 47/192 • • • 含環者 [3]
- 47/195 • • • 含鹵素者 [3]
- 47/198 • • 含醚基； $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \diagup \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[3]

- 47/20 • 有醛基(-CHO)連至非環碳原子上之不飽和化合物
- 47/21 • • 僅有碳-碳雙鍵之不飽和者[3]
- 47/22 • • • 丙烯醛；甲基丙烯醛 [3]
- 47/222 • • 僅有碳-碳參鍵之不飽和者[3]
- 47/225 • • 含除六節芳環以外之環 [3]
- 47/228 • • 含六節芳環，例如，苯乙醛 [3]
- 47/23 • • • 多環者 [3]
- 47/232 • • • 有不飽和側鏈之芳環 [3]
- 47/235 • • 含六節芳環及其他環 [3]
- 47/238 • • • 有不飽和側鏈之芳環 [3]
- 47/24 • • 含鹵素
- 47/26 • • 含經基 [3]
- 47/263 • • • 無環者 [3]
- 47/267 • • • 含除六節芳環以外之環 [3]
- 47/27 • • • 含六節芳環 [3]
- 47/273 • • • 含鹵素者 [3]

- 47/277 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \diagup \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[3]

- 47/28 • 有-CHO基連至除六節芳環外其他環碳原子上之飽和化合物

47/293 • • 具三節環或四節環 [3]

47/30 • • 具五節環

47/32 • • 具六節環

47/33 • • 具七至十二節環 [3]

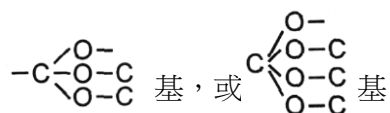
47/34 • • 多環者

47/347 • • • 稠環系上有—CHO 基 [3]

47/353 • • 含鹵素 [3]

47/36 • • 含羥基 [3]

47/37 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，



[3]

47/38 • 有—CHO 基連至除六節芳環以外之環碳原子上的不飽和化合物

47/395 • • 具三節或四節環 [3]

47/40 • • 具五節環 [3]

47/42 • • 具六節環 [3]

47/43 • • 具七至十二節環 [3]

47/44 • • 多環者 [3]

47/445 • • • 含稠環系 [3]

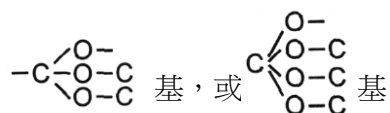
47/45 • • 環上有不飽和側鏈 [2]

47/453 • • 含六節芳環 [3]

47/457 • • 含鹵素 [3]

47/46 • • 含羥基 [3]

47/47 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，



[3]

47/52 • 有—CHO 連至六節芳環碳原子上

47/54 • • 苯甲醛

47/542 • • 烷基化之苯甲醛 [3]

47/544 • • 二甲醯基苯；此等之烷基衍生物 [3]

47/546 • • 多環者 [3]

47/548 • • 有不飽和側鏈之六節芳環 [3]

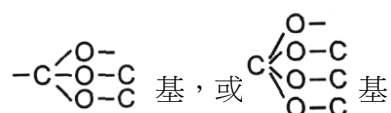
47/55 • • 含鹵素 [3]

47/56 • • 含羥基

47/565 • • • 所有的羥基均連至環上 [3]

47/57 • • • 多環者 [3]

47/575 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，



[3]

47/58 • • • 香草醛

49/00 酮；烯酮；二聚烯酮；酮之螯合物

49/04 • 有酮基連至非環碳原子上之飽和化合物

49/08 • • 丙酮 [3]

49/10 • • 甲乙酮 [3]

49/105 • • 含環者 [3]

49/11 • • • 單環者 [3]

49/115 • • • 含稠環系 [3]

49/12 • • 含多於一個酮基之酮

49/14 • • • 乙醯丙酮，即 2,4，—戊二酮

49/15 • • • 含環者 [3]

49/16 • • 含鹵素

49/163 • • • 含環者 [3]

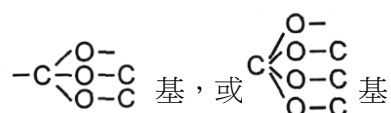
49/167 • • • 僅含氟 [3]

49/17 • • 含羥基 [2]

49/172 • • • 含環者 [3]

49/173 • • • 含鹵素 [3]

49/175 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，



[3]

49/185 • • 含—CHO 基 [3]

49/20 • 含酮基連至非環碳原子上之不飽和化合物

49/203 • • 僅具不飽和碳—碳雙鍵 [3]

49/205 • • • 甲基烯基酮 [3]

49/207 • • 僅具不飽和碳—碳參鍵 [3]

49/21 • • 含除六節芳環以外之其他環[3]

49/213 • • 含六節芳環 [3]

49/215 • • • 多環者 [3]

49/217 • • • 有不飽和側鏈之芳環 [3]

49/223 • • • • 多環者 [3]

49/225 • • 含六節芳環及其他環 [3]

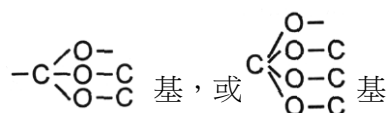
49/227 • • 含鹵素 [3]

49/23 • • • 含除六節芳環外之其他環 [3]

- 49/233 . . . 含六節芳環 [3]
 49/235 有不飽和側鏈之芳環 [3]
 49/237 . . . 含六節芳環及其他環 [3]
 49/24 . . 含羥基
 49/242 . . . 含除六節芳環以外之其他環 [3]
 49/245 . . . 含六節芳環 [3]
 49/248 有不飽和側鏈之芳環 [3]
 49/252 . . . 含六節芳環及其他環 [3]
 49/255 . . 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，
 $\text{—C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基 [3]
 49/258 . . 含—CHO 基 [3]
 49/29 . 含酮基連至環上之飽和化合物 [3]
 49/293 . . 連至三節環或四節環上 [3]
 49/297 . . 連至五節環上 [3]
 49/303 . . 連至六節環上 [3]
 49/307 . . 連至七至十二節環上 [3]
 49/313 . . 多環者 [3]
 49/317 . . . 與酮基相連之兩個碳原子均於環上 [3]
 49/323 . . . 酮基連接至稠環系上 [3]
 49/327 . . 含鹵素 [3]
 49/333 . . . 多環者 [3]
 49/337 . . 含羥基 [3]
 49/345 . . . 多環者 [3]
 49/35 . . 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，
 $\text{—C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基 [3]
 49/355 . . 含—CHO 基 [3]
 49/385 . 酮基作為環部分之飽和化合物 [3]
 49/39 . . 三節或四節環者 [3]
 49/395 . . 五節環者 [3]
 49/403 . . 六節環者 [3]
 49/407 . . . 薄荷酮 [3]
 49/413 . . 七至十二節環者 [3]
 49/417 . . 多環者 [3]
 49/423 . . . 酮基係稠環系之組成部分 [3]
 49/427 有兩個環 [3]
 49/433 含七個碳原子之稠環系 [3]
 49/437 樟腦；葑酮 [3]
 49/443 含八或九個碳原子之稠環系 [3]
 49/447 含十個碳原子之稠環系 [3]
 49/453 有三個環 [3]
 49/457 . . 含鹵素 [3]
 49/463 . . . 酮基係六節環之組成部分 [3]
 49/467 . . . 多環者 [3]
 49/473 酮基係稠環系之組成部分 [3]
 49/477 有兩個環 [3]
 49/483 有三個環 [3]
 49/487 . . 含羥基 [3]
 49/493 . . . 酮基係三至五節環之組成部分 [3]
 49/497 . . . 酮基係六節環之組成部分 [3]
 49/503 . . . 酮基係七至十二節環之組成部分 [3]
 49/507 . . . 多環者 [3]
 49/513 酮基係稠環系之組成部分 [3]
 49/517 . . 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，
 $\text{—C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基，或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{C}$ 基 [3]
 49/523 . . 含—CHO 基 [3]
 49/527 . 含酮基連至除六節芳環以外之其他環上的不飽和化合物 [3]
 49/533 . . 連至三節或四節環上 [3]
 49/537 . . 連至五節環上 [3]
 49/543 . . 連至六節環上 [3]
 49/547 . . 連至七至十二節環上 [3]
 49/553 . . 多環者 [3]
 49/557 . . 有不飽和側鏈之環 [3]
 49/563 . . 含六節芳環 [3]
 49/567 . . 含鹵素 [3]

49/573 . . 含羥基 [3]

49/577 . . 含醚基， $\text{>C<}\begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[3]

49/583 . . 含—CHO 基 [3]

49/587 . 酮基作為環之組成部分的不飽和化合物 [3]

49/593 . . 三節或四節環者 [3]

49/597 . . 五節環者 [3]

49/603 . . 六節環者，如醌甲基化物
[3,2006.01]

49/607 . . 七節至十二節環者 [3]

49/613 . . 多環者 [3]

49/617 . . . 酮基係稠環系之組成部分[3]

49/623 有兩個環 [3]

49/627 含七個碳原子之稠環系
[3]

49/633 含八或九個碳原子之稠環系 [3]

49/637 含十個碳原子之稠環系
[3]

49/643 有三個環 [3]

49/647 . . 有不飽和側鏈之環 [3]

49/653 . . . 多環者 [3]

49/657 . . 含六節芳環 [3]

49/665 . . . 酮基係稠環系之組成部分[3]

49/67 有兩個環，例如，萘滿醌
[3]

49/675 有三個環 [3]

49/683 . . . 有不飽和側鏈之芳環 [3]

49/687 . . 含鹵素 [3]

49/693 . . . 多環 [3]

49/697 . . . 含六節芳環 [3]

49/703 . . 含羥基 [3]

49/707 . . . 酮基係三至五節環之組成部分 [3]

49/713 . . . 酮基係六節環之組成部分[3]

49/717 . . . 酮基係七至十二節環之組成部分

49/723 多環者 [3]

49/727 酮基係稠環系之組成部分

[3]

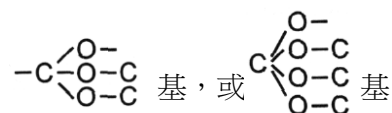
49/733 有兩個環 [3]

49/737 有三個環 [3]

49/743 . . . 有不飽和側鏈之環，例如，
葎草酮，蛇麻酮 [3]

49/747 . . . 含六節芳環 [3]

49/753 . . 含醚基， $\text{>C<}\begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[3]

49/755 . . . 酮基係具二個或三個環之稠環系的組成部分，其中至少
有一個環係六節芳環 [3]

49/757 . . 含—CHO 基 [3]

49/76 . 酮基連至六節芳環之酮，（有酮基
係稠環系之組成部分，連接至六
節芳環上之化合物見 49/657 至
49/757）

49/78 . . 苯乙酮

49/782 . . 多環者 [3]

49/784 . . . 所有酮基均連至非稠合環上
[3]

49/786 二苯甲酮 [3]

49/788 . . . 酮基連至稠環系上 [3]

49/792 . . . 含除六節芳環以外之環 [3]

49/794 . . 有不飽和側鏈之芳環 [3]

49/796 . . . 多環者 [3]

49/798 . . . 含除六節芳環以外之環 [3]

49/80 . . 含鹵素

49/807 . . . 所有鹵原子連至環上 [3]

49/813 . . . 多環者 [3]

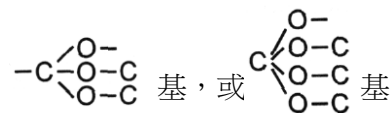
49/82 . . 含羥基 [3]

49/825 . . . 所有羥基均連至環上 [3]

49/83 . . . 多環者 [3]

49/835 . . . 有不飽和側鏈之芳環 [3]

49/84 . . 含醚基， $\text{>C<}\begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[2,3]

49/86 . . 含—CHO 基 [3]

49/88 • 乙烯酮，二聚乙烯酮 [3]

49/90 • • 乙烯酮，即 C_2H_2O [3]

49/92 • 酮螯合物 [3]

50/00 醌 [3,2006.01]

附註

本目內，氫醌依醌型部分分類。
[3]

50/02 • 附單環醌型結構 [3]

50/04 • • 苯醌，即 $C_6H_4O_2$ [3]

50/06 • • 附不飽和側鏈之醌型結構 [3]

50/08 • 附非稠合多環醌型結構 [3]

50/10 • 醌型結構係含二環稠環系之組成部分 [3]

50/12 • • 萘醌，即 $C_{10}H_6O_2$ [3]

50/14 • • 附不飽和側鏈之環系，例如，
維生素 K_1 [3]

50/16 • 醌型結構係含三環稠環系之組成部分 [3]

50/18 • • 蒽醌，即 $C_{14}H_8O_2$ [3]

50/20 • • 附不飽和側鏈之環系 [3]

50/22 • 醌型結構係含四環或更多的環之
稠環系的組成部分 [3]

50/24 • 含鹵素 [3]

50/26 • 含有氧原子以單鍵與碳原子相連
的基 [3]

50/28 • • 附單環醌型結構 [3]

50/30 • • 附多環非稠合醌型結構 [3]

50/32 • • 醌型結構係二環稠環系之組成
部分 [3]

50/34 • • 醌型結構係三環稠環系之組成
部分 [3]

50/36 • • 醌型結構係四環或更多的稠環
系之組成部分 [3]

50/38 • 含 $-CHO$ 基或非醌型酮基 [3]

51/00 羧酸或其鹽，鹵化物或酐之製備 [2]

51/02 • 由羧酸鹽

51/04 • 由醯鹵

51/06 • 由醯胺

51/08 • 由腓

51/083 • 由羧酸酐 [3]

51/087 • • 用水解 [3]

51/09 • 由羧酸酯或內酯（羧酸酯之皂化
見 27/02）

51/093 • $-CX_3$ 基之水解，X 係鹵素 [3]

51/097 • 由或經過硝基取代之有機化合物
[3]

51/10 • 用與一氧化碳之反應

51/12 • • 有機化合物中含氧基團，例如，
醇

51/14 • • 於有機化合物內含不飽和碳—
碳鍵 [3]

51/145 • • 同時發生氧化

51/15 • 用有機物與二氧化碳之反應，例
如，Kolbe-Schmitt 合成 [2]

51/16 • 用氧化（51/145 優先）[3]

51/21 • • 用分子氧 [3]

51/215 • • • 飽和烴基者 [3]

51/225 • • • • 石蠟者 [3]

51/23 • • • 含氧基至羧基者 [3]

51/235 • • • • $-CHO$ 基或一級醇基者 [3]

51/245 • • • • 酮基或二級醇基者 [3]

51/25 • • • 不含六節芳環之不飽和化
合物 [3]

51/255 • • • 含六節芳環無環裂開之化
合物者 [3]

51/265 • • • • 有烷基側鏈被氧化成羧基
[3]

51/27 • • 用氮之氧化物或含氮無機酸 [3]

51/275 • • • 羧基者 [3]

51/285 • • 用過氧化物 [3]

51/29 • • 原處形成的含鹵化合物 [3]

51/295 • • 用無機鹼，例如，用鹼熔 [3]

51/305 • • 用硫或含硫化合物 [3]

51/31 • • 環裂開的環化合物 [3]

51/34 • 用臭氧氧化；臭氧化物之水解 [3]

51/347 • 不包括形成羧基之反應

51/353 • • 用異構化；碳骨架大小之變化
[3]

51/36 • • 碳—碳不飽和鍵之氫化 [3]

51/363 • • 引入鹵素；鹵原子為其他鹵原
子所取代 [3]

- 51/367 • • 引入僅以單鍵連接的含氧官能基 [3]
- 51/373 • • 引入僅以雙鍵連接的含氧官能基 [3]
- 51/377 • • 裂解氫或官能基；官能基之氫解 [3]
- 51/38 • • • 脫羧 [3]
- 51/41 • 羧酸鹽之製備，用酸或其鹽轉變為附有相同的羧酸部分之鹽（肥皂之製備見 C11D） [3]
- 51/42 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3]
- 51/43 • • 用物理狀態之變化，例如結晶 [3]
- 51/44 • • • 用蒸餾 [3]
- 51/46 • • • • 用共沸蒸餾 [3]
- 51/47 • • 用固－液處理，用化學吸附 [3]
- 51/48 • • 用液－液處理
- 51/487 • • 用使發生化學改性之處理（化學吸附見 51/47） [3]
- 51/493 • • • 形成羧酸酯 [3]
- 51/50 • • 用添加劑，例如為穩定化 [3]
- 51/54 • 羧酸酐之製備（用氧化見 51/16）
- 51/56 • • 由有機酸，其鹽，或其酯
- 51/567 • • 用不包括羧酸酐之反應 [3]
- 51/573 • • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3]
- 51/58 • 羧酸鹵化物之製備
- 51/60 • • 用羧酸或其酐轉變為附有相同羧酸部分鹵化物 [3]
- 51/62 • • 用不包括羧酸鹵化物基之反應 [3]
- 51/64 • • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [3,2006.01]

53/00 僅有一個羧基連接至非環碳原子或氫原子之飽和化合物

- 53/02 • 甲酸
- 53/04 • • 由一氧化碳製備
- 53/06 • • 其鹽
- 53/08 • 乙酸
- 53/10 • • 其鹽
- 53/12 • 乙酸酐（乙烯酮見 49/90）

- 53/122 • 丙酸 [3]
- 53/124 • 含四個碳原子之酸 [3]
- 53/126 • 含多於四個碳原子之酸 [3]
- 53/128 • • 羧基連碳原子，此碳原子至少與兩個其他碳原子連接，例如，新酸 [3]
- 53/132 • 含環者 [3]
- 53/134 • • 單環者 [3]
- 53/136 • • 含稠環系 [3]
- 53/138 • • • 含金剛烷環系 [3]
- 53/15 • 含鹵素 [3]
- 53/16 • • 鹵代乙酸 [3]
- 53/18 • • • 含氟 [3]
- 53/19 • • 含三個或更多個碳原子之酸 [3]
- 53/21 • • • 含氟 [3]
- 53/23 • • 含環者 [3]
- 53/38 • 醯基鹵化合物 [3]
- 53/40 • • 乙醯基鹵化物 [3]
- 53/42 • • 含三個或更多碳原子之酸者 [3]
- 53/44 • • 含環者 [3]
- 53/46 • • 含羰鹵基以外之鹵原子 [3]
- 53/48 • • • 鹵代乙醯鹵化物 [3]
- 53/50 • • • 含三個或更多個碳原子之酸者 [3]

55/00 有一個以上之羧基連接至非環碳原子上之飽和化合物 [2]

- 55/02 • 二元羧酸
- 55/06 • • 草酸
- 55/07 • • • 其鹽 [3]
- 55/08 • • 丙二酸
- 55/10 • • 丁二酸
- 55/12 • • 戊二酸
- 55/14 • • 己二酸
- 55/16 • • 庚二酸
- 55/18 • • 壬二酸
- 55/20 • • 癸二酸
- 55/21 • • 有十二個碳原子之二元羧酸 [3]
- 55/22 • 三元羧酸
- 55/24 • 含三個以上羧基者
- 55/26 • 含環者 [3]
- 55/28 • • 單環者 [3]
- 55/30 • • 含稠環系 [3]

- 55/32 • 含鹵素 [3]
 55/34 • • 含環者 [3]
 55/36 • 醯基鹵化物 [3]
 55/38 • • 含環者 [3]
 55/40 • • 含羰鹵基以外之鹵原子 [3]
- 57/00 有羧基連至非環碳原子上之不飽和化合物**
- 57/02 • 僅係碳—碳雙鍵作為不飽和部分
 57/03 • • 一元羧酸 [3]
 57/04 • • • 丙烯酸；甲基丙烯酸 [3]
 57/045 • • • • 在液相用氧化製備 [3]
 57/05 • • • • 在氣相用氧化製備 [3]
 57/055 • • • • • 用不飽和醛作原料 [3]
 57/065 • • • • • 用裂解 H—X 製備，X 為鹵素、OR 或 NR₂，R 為氫或烷基 [3]
 57/07 • • • • 分離；純化；穩定化；用添加劑 [3]
 57/075 • • • • • 用添加劑，例如為穩定化 [3]
 57/08 • • • 巴豆酸 [3]
 57/10 • • • 山梨酸 [3]
 57/12 • • • 含十八個碳原子之直鏈羧酸 [3]
 57/13 • • 二元羧酸 [3]
 57/145 • • • 馬來酸 [3]
 57/15 • • • 富馬酸 [3]
 57/155 • • • 檸檬酸 [3]
 57/16 • • • 黏康酸 [3]
 57/18 • 不飽和部分僅具碳—碳參鍵
 57/20 • • 丙炔酸
 57/22 • • 乙炔二羧酸
 57/24 • • 二乙炔或多乙炔二羧酸
 57/26 • 含除六節芳環以外之環 [3]
 57/28 • • 含金剛烷環系 [3]
 57/30 • 含六節芳環 [3]
 57/32 • • 苯乙酸 [3]
 57/34 • • 含一個以上之羧基 [3]
 57/36 • • • 苯基丙二酸 [3]
 57/38 • • 多環者 [3]
 57/40 • • • 含稠環系 [3]
 57/42 • • 環外有不飽和部分 [3]

- 57/44 • • • 肉桂酸 [3]
 57/46 • 含六節芳環及其他環，例如，環己基苯乙酸 [3]
 57/48 • • 芳環外有不飽和部分 [3]
 57/50 • • 含稠環系 [3]
 57/52 • 含鹵素 [3]
 57/54 • • 鹵代丙烯酸或鹵代甲基丙烯酸 [3]
 57/56 • • 含除六節芳環以外之其他環 [3]
 57/58 • • 含六節芳環 [3]
 57/60 • • • 環外有不飽和部分 [3]
 57/62 • • 含六節芳環及其他環 [3]
 57/64 • 醯基鹵化合物 [3]
 57/66 • • 不飽和部分僅含碳—碳雙鍵 [3]
 57/68 • • 不飽和部分僅含碳—碳參鍵 [3]
 57/70 • • 含除六節芳環外之其他環 [3]
 57/72 • • 含六節芳環 [3]
 57/74 • • 含六節芳環及其他環 [3]
 57/76 • • 含醯鹵基以外之鹵原子 [3]

59/00 羧基連至非環碳原子上之化合物，含羥基、氧—金屬基，

—CHO，酮基，醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$

基， $\text{—C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基

中任何基團之化合物 [2]

- 59/01 • 僅有一個羧基及含有羥基或氧—金屬基之飽和化合物 [3]
 59/06 • • 羥基乙酸 [3]
 59/08 • • 乳酸 [3]
 59/10 • • 多羥基羧酸 [3]
 59/105 • • • 有五個或更多個碳原子，例如糖醛酸 [3]
 59/11 • • 含環者 [3]
 59/115 • • 含鹵素 [3]
 59/125 • 僅有一個羧基及含醚基，

$\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基， $\text{—C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基，

或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{—C}$ 基之飽和化合物 [3]

- 59/13 • • 含環者 [3]

- 59/135 • • 含鹵素 [3]
 59/147 • 僅有一個羧基且含醛基之飽和化合物
 59/153 • • 水合乙醛酸 [3]
 59/185 • 僅含一個羧基且含酮基之飽和化合物 [3]
 59/19 • • 丙酮酸 [3]
 59/195 • • 乙醯乙酸 [3]
 59/205 • • 含環者 [3]
 59/21 • • 含鹵素 [3]
 59/215 • • 含單鍵連接含氧之基 [3]
 59/225 • • 含醛基 [3]
 59/235 • 含多於一個羧基之飽和化合物 [3]
 59/245 • • 含羥基或氧—金屬基 [3]
 59/255 • • • 酒石酸 [3]
 59/265 • • • 檸檬酸 [3]
 59/285 • • • 含五個或更多碳原子之多羥基二元羧酸，例如糖質酸 [3]
 59/29 • • • 含環者 [3]
 59/295 • • • 含鹵素 [3]
 59/305 • • 含醚基， $\text{>C<}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基，
 $\text{-C<}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基，或 $\text{C}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基
 [3]
 59/31 • • • 含環者 [3]
 59/315 • • • 含鹵素 [3]
 59/325 • • 含醛基 [3]
 59/347 • • 含酮基 [3]
 59/353 • • • 含環者 [3]
 59/40 • 不飽和化合物 [3]
 59/42 • • 含羥基或氧—金屬基 [3]
 59/44 • • • 蓖麻醇酸 [3]
 59/46 • • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 59/48 • • • 含六節芳環 [3]
 59/50 • • • • 苯乙醇酸 [3]
 59/52 • • • 羥基或氧—金屬基連接六節芳環碳原子 [3]
 59/54 • • • 含六節芳環及其他環 [3]
 59/56 • • • 含鹵素 [3]

- 59/58 • • 含醚基， $\text{>C<}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基，
 $\text{-C<}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基，或 $\text{C}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \text{O}^- \end{smallmatrix}\text{-C}$ 基
 [3]
 59/60 • • • 醚之無羧基部分係不飽和者 [3]
 59/62 • • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 59/64 • • • 含六節芳環 [3]
 59/66 • • • • 醚之無羧基部分含六節芳環 [3]
 59/68 • • • • 醚基之氧原子連接非稠合六節芳環 [3]
 59/70 • • • • • 羥基乙酸之醚 [3]
 59/72 • • • 含六節芳環及其他環 [3]
 59/74 • • 含醛基 [3]
 59/76 • • 含酮基 [3]
 59/80 • • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 59/82 • • • • 酮基係環之組成部分 [3]
 59/84 • • • 含六節芳環 [3]
 59/86 • • • 含六節芳環及其他環 [3]
 59/88 • • • 含鹵素 [3]
 59/90 • • • 含單鍵連接含氧之基 [3]
 59/92 • • • 含醛基 [3]

61/00 有羧基連至除六節芳環外之其他環的碳原子上之化合物

- 61/04 • 有羧基連至三節或四節環上之飽和化合物 [3]
 61/06 • 羧基連至五節環上之飽和化合物 [3]
 61/08 • 羧基連至六節環上之飽和化合物 [3]
 61/09 • • 完全氫化之苯二羧酸 [2,3]
 61/10 • 羧基連至七至十二節環上之飽和化合物 [3]
 61/12 • 飽和多環化合物 [3]
 61/125 • • 羧基連至稠環系 [3]
 61/13 • • • 含兩個環 [3]
 61/135 • • • 含三個環 [3]
 61/15 • 含鹵素之飽和化合物 [3]
 61/16 • 不飽和化合物 [3]
 61/20 • • 有羧基連至五節環上 [3]

- 61/22 • • 有羧基連至六節環上 [3]
 61/24 • • • 部分氫化之苯二羧酸 [3]
 61/26 • • 有羧基連至七至十二節環上 [3]
 61/28 • • 多環者 [3]
 61/29 • • • 有羧基連至稠環系 [3]
 61/35 • • 環外有不飽和部分 [3]
 61/37 • • • 菊酸 [3]
 61/39 • • 含六節芳環 [3]
 61/40 • • 含鹵素 [3]

**62/00 有羧基連至除六節芳環外之環
 碳原子上，並含有羥基，氧—金
 屬基，醛基，酮基，醚基，**

$\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基， $-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，或

$\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基中任何基之化合物

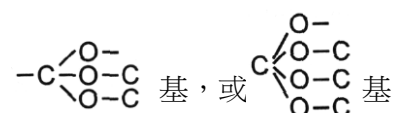
[3]

- 62/02 • 含羥基或氧—金屬基之飽和化
 合物 [3]
 62/04 • • 具六節環 [3]
 62/06 • • 多環者 [3]
 62/08 • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基， $-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$

基，或 $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基之飽和化合物

[3]

- 62/10 • • 具六節環 [3]
 62/12 • • 多環者 [3]
 62/14 • • • 羧基於稠環系上 [3]
 62/16 • 含醛基之飽和化合物 [3]
 62/18 • 含酮基之飽和化合物 [3]
 62/20 • • 具六節環 [3]
 62/22 • • 多環者 [3]
 62/24 • • 酮基係環之組成部分 [3]
 62/26 • • 含單鍵連接含氧之基 [3]
 62/28 • • 含醛基 [3]
 62/30 • 不飽和化合物 [3]
 62/32 • • 含羥基或氧—金屬基 [3]
 62/34 • • 含醚基， $\text{>C} \begin{smallmatrix} \text{O}- \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



[3]

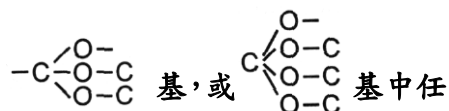
- 62/36 • • 含醛基 [3]
 62/38 • • 含酮者 [3]

**63/00 有羧基連至六節芳環碳原子上
 之化合物 [2]**

- 63/04 • 單環一元羧酸
 63/06 • • 苯甲酸
 63/08 • • • 其鹽
 63/10 • • • 其鹵化物
 63/14 • 單環二元羧酸
 63/15 • • 所有的羧基均連至六節芳環碳
 原子上 [3]
 63/16 • • • 1,2，—苯二羧酸 [3]
 63/20 • • • • 其鹽 [3]
 63/22 • • • • 其鹵化物 [3]
 63/24 • • • 1,3—苯二羧酸 [3]
 63/26 • • • 1,4—苯二羧酸 [3]
 63/28 • • • • 其鹽 [3]
 63/30 • • • • 其鹵化物 [3]
 63/307 • 單環三元羧酸 [3]
 63/313 • 含多於三個羧基之單環酸 [3]
 63/33 • 多環酸 [2, 3]
 63/331 • • 全部的羧基均連至非稠環上 [3]
 63/333 • • • 4,4'—二苯基二羧酸 [2,3]
 63/337 • • 羧基連至稠環系上 [2,3]
 63/34 • • • 含兩個環 [3]
 63/36 • • • • 含一個羧基 [3]
 63/38 • • • • 含兩個均連至稠環系碳原
 子上之羧基 [3]
 63/40 • • • • 含三個或更多個均連至稠
 環系碳原子上之羧基 [3]
 63/42 • • • 含三個或更多個環 [3]
 63/44 • • • • 含一個羧基 [3]
 63/46 • • • • 含兩個均連至稠環系碳原
 子上之羧基 [3]
 63/48 • • • • 含三個或更多個均連至稠
 環系碳原子上之羧基 [3]
 63/49 • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 63/64 • 具芳環外不飽和部分之單環酸
 [3]

- 63/66 • 具芳環外不飽和部分之多環酸 [3]
 63/68 • 含鹵素 [3]
 63/70 • • 一元羧酸 [3]
 63/72 • • 多環酸 [3]
 63/74 • • 芳環外有不飽和部分 [3]

65/00 有羰基連至六節芳環之環碳原子上，並有羥基，氧—金屬基，醛基，酮基，醚基， $>\text{C}(\text{O}-\text{C})$ 基，



何基之化合物

- 65/01 • 含有羥基或氧—金屬基 [3]
 65/03 • • 單環之所有羥基或氧—金屬基均連至環上 [3]
 65/05 • • • 鄰—羥基羧酸 [3]
 65/10 • • • • 水楊酸 [3]
 65/105 • • 多環者 [3]
 65/11 • • • 羧基連至含二環之稠環系上 [3]
 65/15 • • • 羧基連至多於二環之稠環系上 [3]
 65/17 • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 65/19 • • 芳環外有不飽和部分 [3]
 65/21 • 含醚基， $>\text{C}(\text{O}-\text{C})$ 基， $-\text{C}(\text{O}-\text{C})$ 基，或 $\text{C}(\text{O}-\text{C})$ 基 [3]
 65/24 • • 多環者 [3]
 65/26 • • • 含除六節芳環以外之環 [3]
 65/28 • • 芳環外有不飽和部分 [3]
 65/30 • 含—CHO 基 [3]
 65/32 • 含酮基 [3]
 65/34 • • 多環者 [3]
 65/36 • • • 含六節芳環以外之環 [3]
 65/38 • • 芳環外有不飽和部分 [3]
 65/40 • • 含單鍵連接含氧之基 [3]
 65/42 • • 含—CHO 基 [3]

66/00 醯羧酸 [2]

- 66/02 • 蔥醯羧酸 [3]

67/00 羧酸酯之製備

附註

本目內，內酯用作反應物並視作酯。 [3]

- 67/02 • 用酯基間相互反應，即酯基轉移作用
 67/03 • 用酯基與羥基反應 [2]
 67/035 • 用羧酸或對稱酐與飽和烴反應 [3]
 67/04 • 用羧酸或對稱酐與不飽和碳—碳鍵反應 [2]
 67/05 • • 用氧化 [2,3]
 67/055 • • • 在金屬鉑基或其化合物存在下 [3]
 67/08 • 羧酸或對稱酐與有機化合物之羥基或氧—金屬反應 [2]
 67/10 • 羧酸或對稱酐與酯基或碳—鹵鍵反應 [2]
 67/11 • • 無機酯基 [3]
 67/12 • 由不對稱酐 [2]
 67/14 • 由羧酸鹵鹵 [2]
 67/16 • 由羧酸、酯或酐製備，其中一個氧原子已為硫、硒或碲原子所置換 [2]
 67/18 • 將含氮之基轉變為酯基 [2]
 67/20 • • 由醯胺或內醯胺 [2]
 67/22 • • 由腈 [2]
 67/24 • 使羧酸或其衍生物與碳—氧醚鍵反應，例如，縮醛，四氫呋喃 [2]
 67/26 • • 與環氧乙烷 [2]
 67/27 • 由原酸酯 [3]
 67/28 • 改變酯中之羥基部分，此種改變非為引進酯基 [2]
 67/283 • • 不飽和碳—碳鍵之氫化 [3]
 67/287 • • 引入鹵素；鹵原子為其他鹵原子所取代 [3]
 67/29 • • 引入含氧官能基 [3]
 67/293 • • 異構化，改變碳架之大小 [3]
 67/297 • • 裂解氫或官能基；官能基之氫解 [3]

- 67/30 • 改變酯中之酸部分，此種改變非為引進酯基 [3]
- 67/303 • • 不飽和碳—碳鍵之氫化 [3]
- 67/307 • • 引入鹵素，鹵原子為其他鹵原子所取代 [3]
- 67/31 • • 引入僅含單鍵氧之官能基 [3]
- 67/313 • • 引入含氧雙鍵官能基，例如羧基 [3]
- 67/317 • • 裂解氫或官能基，官能基之氫解 [3]
- 67/32 • • • 脫羧 [3]
- 67/327 • • • 消除含單鍵氧之官能基 [3]
- 67/333 • • 異構化；改變碳架之大小（引入或消除羧基見 67/313、67/32） [3]
- 67/34 • • • 分子中 $\begin{array}{c} \text{—C—O—C—} \\ \parallel \quad | \\ \text{O} \quad \text{I} \end{array}$ 基之遷移 [2,3]
- 67/343 • • • 增加碳原子數 [3]
- 67/347 • • • • 不飽和碳—碳鍵之加成 [3]
- 67/36 • 與一氧化碳或甲酸鹽反應（67/02，67/03，67/10 優先） [2]
- 67/37 • • 醚與一氧化碳反應 [2]
- 67/38 • • 與不飽和碳—碳鍵加成 [2]
- 67/39 • 官能基之氧化，此官能基係酯之酸的前身 [3]
- 67/40 • • 一級醇之氧化 [3]
- 67/42 • • 二級醇或酮之氧化 [2,3]
- 67/44 • 醛之氧化還原，例如 Tishchenko 反應 [2]
- 67/46 • 由烯酮或聚烯酮 [2]
- 67/465 • 用寡聚反應 [3]
- 67/47 • 用調聚反應（高分子化合物見 C08） [3]
- 67/475 • 碳—碳鍵之斷裂及再分配，例如歧化反應或不同分子間 $\begin{array}{c} \text{—COOC—} \\ | \\ \text{I} \end{array}$ 基之遷移 [3]
- 67/48 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [2,3]
- 67/52 • • 用物理狀態之變化，例如結晶 [3]

- 67/54 • • • 用蒸餾 [3]
- 67/56 • • 用固—液處理，用化學吸附 [3]
- 67/58 • • 用液—液處理 [3]
- 67/60 • • 處理使發生化學改性（用化學吸附見 67/56） [3]
- 67/62 • • 用添加劑，例如為穩定化 [3]

68/00 碳酸酯或鹵代甲酸酯之製備 [2,2006.01,2020.01]

- 68/01 • 由一氧化碳及氧氣 [2020.01]
- 68/02 • 由光氣或鹵甲酸鹽 [2,2006.01]
- 68/04 • 由二氧化碳或無機碳酸鹽 [2,2006.01]
- 68/06 • 由有機碳酸酯 [2,2006.01,2020.01]
- 68/065 • • 由碳酸亞烷基酯 [2020.01]
- 68/08 • 純化；分離；穩定化 [2]

69/00 羧酸酯；碳酸酯或鹵甲酸酯

附註

注意本次類標題下之附註(5) [5]

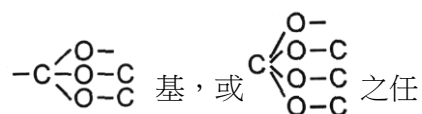
- 69/003 • 被酯化的羥基連至非環碳原子上之飽和醇的酯 [3]
- 69/007 • 被酯化的羥基連至非環碳原子上之不飽和醇的酯 [3]
- 69/01 • • 乙烯基酯 [3]
- 69/013 • 含有酯化的羥基連接六節芳環外之環碳原子的醇之酯 [3]
- 69/017 • 含有酯化的羥基連接六節芳環碳原子之羥基化合物的酯 [3]

附註

有可變的特殊酸部分之酯，即包含於 69/02、69/34、69/52、69/608、69/612、69/62、69/66、69/74、69/76、69/95、69/96 目內一個以上之目時，按照此等之羥基部分歸入 69/003 至 69/017 目 [3, 8]

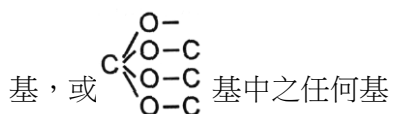
- 69/02 • 無環飽和一元羧酯，含有羧基連接非環碳原子或氫
- 69/025 • • 含有酯化的羥基連接非環碳原子之不飽和醇酯 [3]
- 69/03 • • 含有酯化的羥基連接除六節芳環外之環碳原子的醇酯 [3]
- 69/035 • • 酯化的羥基連接六節芳環之碳原子的羥基化合物之酯 [3]
- 69/04 • • 甲酸酯
- 69/06 • • • 一元羥基化合物者
- 69/07 • • • • 不飽和醇者 [2]
- 69/08 • • • • 二元羥基化合物者
- 69/10 • • • • 三元羥基化合物者
- 69/12 • • 乙酸酯
- 69/14 • • • • 一元羥基化合物者
- 69/145 • • • • • 不飽和醇者 [2]
- 69/15 • • • • • 醋酸乙烯酯 [2]
- 69/155 • • • • • 醋酸丙烯酯 [2]
- 69/157 • • • • • 含六節芳環 [3]
- 69/16 • • • • 二元羥基化合物者
- 69/18 • • • • 三元羥基化合物者
- 69/21 • • • • 具多於三個羥基化合物者 [2]
- 69/22 • • 酸之部分有三個或更多個碳原子
- 69/24 • • • • 一元羥基化合物酯化者
- 69/26 • • • • • 合成蠟
- 69/28 • • • • 二元羥基化合物酯化者
- 69/30 • • • • 三元羥基化合物酯化者
- 69/33 • • • • 多於三個羥基化合物酯化者 [2]
- 69/34 • 無環飽和多元羧酸酯，含有酯化的羧基連接非環碳原子上 [3]
- 69/347 • • 含有酯化的羥基連接非環碳原子之不飽和醇酯 [3]
- 69/353 • • 含有酯化的羥基連接六節芳環碳原子之羥基化合物的酯 [3]
- 69/36 • • 草酸酯 [3]
- 69/38 • • 丙二酸酯 [3]
- 69/40 • • 丁二酸酯 [3]
- 69/42 • • 戊二酸酯 [3]
- 69/44 • • 己二酸酯 [3]
- 69/46 • • 庚二酸酯 [3]
- 69/48 • • 壬二酸酯 [3]
- 69/50 • • 癸二酸酯 [3]
- 69/52 • 無環不飽和羧酸酯，酯化之羧基連接非環碳原子 [3]
- 69/527 • • 不飽和羥基化合物者 [3]
- 69/533 • • 僅有一個碳—碳雙鍵之一元羧酸酯 [3]
- 69/54 • • • 丙烯酸酯；甲基丙烯酸酯 [3]
- 69/56 • • • 巴豆酸酯；醋酸乙烯酯 [3]
- 69/58 • • • 於酸之部分有十八個碳原子的直鏈酸酯 [3]
- 69/587 • • 至少有兩個碳—碳雙鍵之一元羧酸酯 [3]
- 69/593 • • 僅有一個碳—碳雙鍵之二元羧酸酯 [3]
- 69/60 • • • 馬來酸酯；富馬酸酯 [3]
- 69/602 • • 至少有兩個碳—碳雙鍵之二元羧酸酯 [3]
- 69/604 • • 含多於兩個羧基之多元羧酸酯 [3]
- 69/606 • • 於羧酸之不飽和部分僅有一個碳—碳參鍵 [3]
- 69/608 • 羧酸酯，其羧基連接至非環碳原子上，酸之部分含有除六節芳環以外之環 [3]
- 69/612 • 羧酸酯，其羧基連接至非環碳原子上，酸之部分含有六節芳環 [3]
- 69/614 • • 苯乙酸者 [3]
- 69/616 • • 多環者 [3]
- 69/618 • • 六節芳環外有不飽和部分 [3]
- 69/62 • 含鹵酯 [2]
- 69/63 • • 飽和酸者 [2]
- 69/635 • • • 酸之部分含有環 [3]
- 69/65 • • 不飽和酸者 [2]
- 69/653 • • • 丙烯酸酯；甲基丙烯酸酯；鹵代丙烯酸酯；鹵代甲基丙烯酸酯 [3]
- 69/657 • • • 馬來酸酯；富馬酸酯；鹵代馬來酸酯；鹵代富馬酸酯 [3]

- 69/66 • 羧酸酯，其酯化之羧基連接至非環碳原子上，酸之部分含有羥基，氧—金屬基，醛基，酮基，醚基，醯氧基， $\text{>c}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \text{O} \diagdown \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基，



何基 [3]

- 69/67 • • 飽和酸者 [2]
 69/675 • • • 飽和羥基羧酸者 [3]
 69/68 • • • • 乳酸酯 [3]
 69/70 • • • • 酒石酸酯 [3]
 69/704 • • • • 檸檬酸酯 [3]
 69/708 • • • 醚 [3]
 69/712 • • • • 酯之羥基由羥基連接六節芳環碳原子上之羥基化合物醚化 [3]
 69/716 • • • 酮羧酸酯 [3]
 69/72 • • • • 乙醯乙酸酯 [3]
 69/73 • • 不飽和酸者 [2]
 69/732 • • • 不飽和羥基羧酸者 [3]
 69/734 • • • 醚 [3]
 69/736 • • • • 酯之羥基由羥基連接六節芳環碳原子上之羥基化合物醚化 [3]
 69/738 • • • 酮羧酸酯 [3]
 69/74 • 酯化的羧基連接除六節芳環外之環碳原子的羧酸酯
 69/743 • • 三節環酸者，環外有不飽和部分 [3]
 69/747 • • • 菊甲酸酯 [3]
 69/75 • • 六節環酸者 [3]
 69/753 • • 多環酸者 [3]
 69/757 • • 酸之部分含有羥基，氧—金屬基，醛基，酮基，醚基，醯氧基， $\text{>c}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \text{O} \diagdown \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$ 基， $-\text{c}\begin{smallmatrix} \text{O}^- \\ \diagup \text{O} \diagdown \\ \text{O}-\text{C} \end{smallmatrix}$



[3]

- 69/76 • 酯化的羧基連六節芳環碳原子之

羧酸酯

- 69/767 • • 酯化的不飽和醇之羥基連接非環碳原子 [3]
 69/773 • • 酯化的羥基化合物之羥基連接六節芳環碳原子 [3]
 69/78 • • 苯甲酸酯
 69/80 • • 苯二甲酸酯
 69/82 • • • 對苯二甲酸酯
 69/83 • • • 不飽和醇者 [2]
 69/84 • • 單環羥基羧酸酯，羥基及羧基連接六節芳環碳原子
 69/86 • • • 具有酯化的羥基
 69/88 • • • 具有酯化的羧基
 69/90 • • • 具有酯化的羥基及羧基
 69/92 • • • 具有醚化的羥基 [2]
 69/94 • • 多環羥基羧酸酯，羥基及羧基連至六節芳環碳原子上
 69/95 • 醯羧酸酯 [2]
 69/96 • 碳酸酯或鹵甲酸酯

71/00 鹵素的含氧酸酯

含碳及氮之化合物，附有或不附有氮、鹵素或氧 [5]

201/00 硝酸或亞硝酸酯之製備，硝基或亞硝基直接連於碳之骨架上的化合物之製備 [5]

- 201/02 • 硝酸酯之製備 [5]
 201/04 • 亞硝酸酯之製備 [5]
 201/06 • 硝基化合物之製備 [5]
 201/08 • • 用硝基取代氫原子 [5]
 201/10 • • 用硝基取代官能基 [5]
 201/12 • • 用不包括形成硝基之反應 [5]
 201/14 • • 用形成硝基之反應，以及不包括硝基的形成之反應 [5]
 201/16 • • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]

203/00 硝酸或亞硝酸酯 [5]

- 203/02 • 硝酸酯 [5]
 203/04 • • 硝酸酯基連至非環碳原子上 [5]
 203/06 • • • 甘油三硝酸酯 [5]
 203/08 • • 硝酸酯基連至除六節芳環之環

- 碳原子上 [5]
- 203/10 • • 硝基連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/00 含有硝基連至碳架上之化合物 [5]**
- 205/01 • 硝基連至非環碳原子上 [5]
- 205/02 • • 飽和碳架者 [5]
- 205/03 • • 不飽和碳架者 [5]
- 205/04 • • • 含六節芳環 [5]
- 205/05 • 硝基連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 205/06 • 硝基連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/07 • 用鹵原子進一步取代碳架 [5]
- 205/08 • • 硝基連至非環碳原子上 [5]
- 205/09 • • • 不飽和碳架者 [5]
- 205/10 • • 硝基連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 205/11 • • 硝基連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/12 • • • 六節芳環或含六節芳環之稠環系為鹵原子所取代 [5]
- 205/13 • 碳骨架進一步為羥基所取代 [5]
- 205/14 • • 硝基及羥基連至非環碳原子上 [5]
- 205/15 • • • 飽和碳架者 [5]
- 205/16 • • • 含六節芳環之碳架者 [5]
- 205/17 • • 硝基連至非環碳原子上及羥基連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/18 • • 硝基或羥基連至除六節芳環外之其他環的碳原子上 [5]
- 205/19 • • 硝基連至六節芳環之碳原子上和羥基連接在非環碳原子上
- 205/20 • • 硝基及羥基連至六節芳環之碳原子上
- 205/21 • • • 硝基及羥基連至同一個非稠合六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/22 • • • • 一個硝基連至環上 [5]
- 205/23 • • • • 二個硝基連至環上 [5]
- 205/24 • • • • 三個，或僅有三個硝基連至環上 [5]
- 205/25 • • • 硝基連至屬於稠環系部分之六節芳環的碳原子上 [5]
- 205/26 • • 與進一步為鹵原子所取代 [5]
- 205/27 • 碳架進一步為經醚化之羥基所取代 [5]
- 205/28 • • 硝基及經醚化之羥基連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 205/29 • • • 碳架係飽和者 [5]
- 205/30 • • • 經醚化之羥基中至少一個氧原子進一步連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/31 • • • 含六節芳環之碳架 [5]
- 205/32 • • 硝基連至非環碳原子上及經醚化之羥基連至碳架的六節芳環之碳原子上 [5]
- 205/33 • • 硝基或經醚化之羥基連至碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 205/34 • • 硝基連至六節芳環之碳原子上及經醚化之羥基連至碳架的非環碳原子上 [5]
- 205/35 • • 硝基及經醚化之羥基連至碳架之六節芳環的碳原子上 [5]
- 205/36 • • • 連至同一個非稠合六節芳環之碳原子上或連至同一個稠環系之六節芳環的碳原子上 [5]
- 205/37 • • • 經醚化之羥基中至少一個氧原子進一步連至非環碳原子上 [5]
- 205/38 • • • 經醚化之羥基中至少一個氧原子進一步連至六節芳環之碳原子上，如硝基二苯醚 [5]
- 205/39 • 碳架再為經酯化之羥基所取代 [5]
- 205/40 • • 硝基及經酯化之羥基連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 205/41 • • 硝基或經酯化之羥基連至碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 205/42 • • 硝基或經酯化之羥基連至碳架之六節芳環的碳原子上
- 205/43 • • • 連至同一個非稠合六節芳環

之碳原子上或連至同一個稠環系之六節芳環的碳原子上 [5]

205/44 • 碳架進一步為—CHO 基取代 [5]

205/45 • 碳架進一步為至少一個雙鍵連接的氧原子所取代，其氧原子非為—CHO 基之組成部分 [5]

205/46 • • 含醌環碳原子之碳架 [5]

205/47 • • • 含硝基之蒽醌 [5]

205/48 • • • • 碳架進一步為單鍵氧原子取代 [5]

205/49 • 碳架進一步為羧基所取代 [5]

205/50 • • 硝基及羧基連至碳架之非環碳原子上 [5]

205/51 • • • 碳架係飽和者 [5]

205/52 • • • • 硝基乙酸 [5]

205/53 • • • 含六節芳環之碳架 [5]

205/54 • • 硝基連至非環碳原子上及羧基連至碳架之六節芳環的碳原子上 [5]

205/55 • • 硝基或羧基連至碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]

205/56 • • 硝基連至六節芳環之碳原子上及羧基連至碳架之非環碳原子上 [5]

205/57 • • 硝基及羧基連至碳架之六節芳環的碳原子上 [5]

205/58 • • • 碳架進一步為鹵原子所取代 [5]

205/59 • • • 碳架進一步為單鍵連接的氧原子所取代 [5]

205/60 • • • • 於鄰位上連有羧基，如硝基水楊酸 [5]

205/61 • • • 碳架進一步為雙鍵連接的氧原子所取代 [5]

207/00 含亞硝基連至碳架上之化合物 [5]

207/02 • 碳架不再被取代 [5]

207/04 • 碳架進一步為單鍵連接的氧原子所取代 [5]

209/00 含胺基連至碳架上之化合物的

製備 [5]

209/02 • 用胺基取代氫原子 [5]

209/04 • 用胺基取代官能基 [5]

209/06 • • 取代鹵原子 [5]

209/08 • • • 生成的胺基連至非環碳原子上或連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]

209/10 • • • 生成的胺基連至六節芳環之碳原子上，或由連至六節芳環之碳原子上的氮原子之胺生成 [5]

209/12 • • • 生成季銨化合物 [5]

209/14 • • 取代經基或經酰化之經基或經酯化之經基 [5]

209/16 • • • 生成的胺基連至非環碳原子上或連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]

209/18 • • • 生成的胺基連至六節芳環之碳原子上或來自有連至六節芳環之碳原子上的氮原子之胺生成 [5]

209/20 • • • 生成季銨化合物 [5]

209/22 • • 取代其他的官能基 [5]

209/24 • 將氨、胺或有可還原成氨基的基團之化合物與羰基化合物同時進行還原之烷基化 [5]

209/26 • • 用氫還原 [5]

209/28 • • 用其他還原劑還原 [5]

209/30 • 用氮—氧或氮—氮鍵之還原 [5]

209/32 • • 硝基之還原 [5]

209/34 • • • 用連接非環碳原子或除六節芳環以外之其他環的碳原子之硝基的還原 [5]

209/36 • • • 用與六節芳環之碳原子連接的硝基之還原 [5]

209/38 • • 亞硝基之還原 [5]

209/40 • • 經胺基或經基亞胺基之還原 [5]

209/42 • • 氮—氮鍵之還原 [5]

209/44 • 於氨或胺存在下羧酸或其酯之還原，或腓、羧酸醯胺、亞胺或亞胺醚之還原 [5]

209/46 • • 於氨或胺存在下羧酸或其酯之

- 還原 [5]
- 209/48 • • 腓之還原 [5]
- 209/50 • • 羧酸鹽胺之還原 [5]
- 209/52 • • 亞胺或亞胺醚之還原 (209/24 優先) [5]
- 209/54 • 重排反應 [5]
- 209/56 • • 由包括霍夫曼 (Hofmann), 柯蒂斯(Curtius), 施密特 (Schmidt), 或洛森(Lossen)類之羧酸重排 [5]
- 209/58 • • 由或經由鹽胺 [5]
- 209/60 • 縮合或加成反應, 如曼尼赫 (Mannich)反應, 氨或胺加成之烯烴或炔上或含一個活性氫原子之化合物加成至希夫(Schiffs)鹼、醌亞胺或環氮乙烷上 [5]
- 209/62 • 斷開碳—氮、硫—氮或磷—氮鍵, 如水解鹽胺、胺或季胺化合物之 N—脫烷基化 (209/24 優先) [5]
- 209/64 • 歧化 [5]
- 209/66 • 由或經由金屬—有機化合物
- 209/68 • 由胺, 用不包括胺基之反應, 如還原不飽和胺、芳構化或取代碳架 [5]
- 209/70 • • 還原不飽和胺 [5]
- 209/72 • • • 還原六節芳環 [5]
- 209/74 • • 鹵化、氫鹵化作用、脫鹵作用或脫鹵化氫作用 [5]
- 209/76 • • 硝化作用 [5]
- 209/78 • • 由羰基化合物, 如甲醛, 及有連至六節芳環之碳原子上的胺基基團之胺, 生成亞甲基—二芳基胺 [5]
- 209/80 • 光化反應; 用游離基 [5]
- 209/82 • 純化; 分離; 穩定化; 添加劑之使用 [5]
- 209/84 • • 純化 [5]
- 209/86 • • 分離 [5]
- 209/88 • • • 分離旋光異構體 [5]
- 209/90 • • 穩定; 用添加劑 [5]
- 211/00 含有與碳架連接的胺基基團之化合物 [5]**
- 211/01 • 與非環碳原子連接的胺基 [5]
- 211/02 • • 無環飽和碳架者 [5]
- 211/03 • • • 單胺 [5]
- 211/04 • • • • 一、二或三甲胺 [5]
- 211/05 • • • • 一、二或三乙胺 [5]
- 211/06 • • • • 僅含正或異丙基 [5]
- 211/07 • • • • 含一、二或三個烷基, 每個烷基有三個以上數目相同的碳原子 [5]
- 211/08 • • • • 含碳原子數目不同的烷基 [5]
- 211/09 • • • 二胺 [5]
- 211/10 • • • • 二胺基乙烷 [5]
- 211/11 • • • • 二胺基丙烷 [5]
- 211/12 • • • • 1,6—二胺基己烷 [5]
- 211/13 • • • 含有與碳架連接之三或更多胺基之胺 [5]
- 211/14 • • • 含有與至少兩個胺烷基連接之胺基之胺, 如二亞乙基三胺 [5]
- 211/15 • • • 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/16 • • 含有除六芳環以外的其他環之飽和碳架者 [5]
- 211/17 • • • 僅含非稠環 [5]
- 211/18 • • • 含有至少二個與碳架連接的胺基 [5]
- 211/19 • • • 含稠環系 [5]
- 211/20 • • 無環的不飽和碳架者 [5]
- 211/21 • • • 單胺 [5]
- 211/22 • • • 含有至少二個與碳架連接的胺基 [5]
- 211/23 • • • 含碳—碳三鍵之碳架 [5]
- 211/24 • • • 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/25 • • 含除六節芳環以外之其他環的不飽和碳架者 [5]
- 211/26 • • 含至少一個六節芳環之不飽和碳架者 [5]
- 211/27 • • • 用飽和碳鏈與六節芳環連接的胺基 [5]
- 211/28 • • • 用不飽和碳鏈與六節芳環連

- 接的胺基 [5]
- 211/29 . . . 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/30 . . . 六節芳環係由二個環構成的稠環系之組成部分 [5]
- 211/31 . . . 六節芳環係由至少三個環構成的稠環系之組成部分 [5]
- 211/32 . . . 含二苯并環庚烷或二苯并環庚烯環系或其稠合衍生物 [5]
- 211/33 . 有與除六節芳環以外之其他環的碳原子連接的胺基 [5]
- 211/34 . . 飽和碳架者 [5]
- 211/35 . . . 僅含非稠環 [5]
- 211/36 . . . 含有與碳架連接的至少二個胺基 [5]
- 211/37 . . . 進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/38 . . . 含稠環系 [5]
- 211/39 . . 不飽和碳架者 [5]
- 211/40 . . . 僅含非稠環 [5]
- 211/41 . . . 含稠環系 [5]
- 211/42 . . . 六節芳環係稠環系的組成部分 [5]
- 211/43 . 有與碳架之六節芳環的碳原子連接的胺基 [5]
- 211/44 . . 有與僅有的一個六節芳環連接的胺基 [5]
- 211/45 . . . 單胺 [5]
- 211/46 . . . 苯胺 [5]
- 211/47 . . . 甲苯胺；其同系物 [5]
- 211/48 . . . N-烷基化之胺 [5]
- 211/49 . . . 有與碳架連接的至少二個胺基 [5]
- 211/50 . . . 有至少二個與碳架之六節芳環的碳原子連接之胺基 [5]
- 211/51 . . . 苯二胺 [5]
- 211/52 . . . 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/53 . . . 胺基中至少一個氮原子進一步連至用胺基取代的羥基上 [5]
- 211/54 . . 有與二個或三個六節芳環連接的胺基 [5]
- 211/55 . . . 二苯胺 [5]
- 211/56 . . . 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 211/57 . . 胺基連至屬於碳架之稠環系部分的六節芳環之碳原子上 [5]
- 211/58 . . . 蔡胺；其 N-取代衍生物 [5]
- 211/59 . . . 碳架進一步為鹵原子或硝基或亞硝基取代 [5]
- 211/60 . . . 含除構成至少一個稠環系部分之六節芳環以外的其他環 [5]
- 211/61 . . . 用三個或更多環構成的至少一個稠環系 [5]
- 211/62 . 季銨化合物 [5]
- 211/63 . . 與非環碳原子連接的經季銨化之氮原子 [5]
- 211/64 . . 與六節芳環之碳原子連接的經季銨化之氮原子 [5]
- 211/65 . 胺之金屬錯合物 [5]
- 213/00 含與同一個碳架連接的胺基及羥基，胺基及經醚化之羥基或胺基及經酯化的羥基之化合物之製備 [5]**
- 213/02 . 包括由含羥基或經醚化或經酯化之羥基化合物生成胺基的反應 [5]
- 213/04 . 氮或胺與烯烴氧化物或鹵化醇之反應 [5]
- 213/06 . 由羥基胺的羥基經醚化或酯化反應 [5]
- 213/08 . 不包括形成胺基、羥基或經醚化或經酯化之羥基的反應 [5]
- 213/10 . 分離；純化；穩定；使用添加劑 [5]
- 215/00 含連至同一個碳架上之胺基及羥基之化合物 [5]**
- 215/02 . 與同一個碳架之非環碳原子連接的羥基及胺基 [5]
- 215/04 . . 碳架係飽和者 [5]

- 215/06 . . . 及無環 [5]
- 215/08 . . . 僅有一個羥基及一個胺基與碳架連接 [5]
- 215/10 . . . 有一個胺基與至少二個羥基與碳架連接
- 215/12 . . . 胺基之氮原子進一步連至用羥基取代的羥基上 [5]
- 215/14 . . . 胺基之氮原子進一步連至用胺基取代的羥基上 [5]
- 215/16 . . . 胺基之氮原子進一步連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 215/18 . . . 羥基與至少二個胺基連至碳架上 [5]
- 215/20 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]
- 215/22 . . . 碳架係不飽和者 [5]
- 215/24 . . . 與無環者 [5]
- 215/26 . . . 與含除六節芳環以外之其他環 [5]
- 215/28 . . . 與含六節芳環 [5]
- 215/30 . . . 含羥基與六節芳環之碳原子連至碳架之同一個碳原子上 [5]
- 215/32 . . . 含羥基及二個六節芳環之碳原子連至碳架之同一個碳原子上 [5]
- 215/34 . . . 含羥基及六節芳環之碳原子連至碳架之同一個碳原子上與至少一個羥基連至碳架之另一個碳原子上[5]
- 215/36 . . . 1-芳基-2-胺基-1,3-丙二醇 [5]
- 215/38 . . . 具有係碳架組成部分之除六節芳環以外的其他環 [5]
- 215/40 . . . 經季銨化之氮原子連至碳架之碳原子上 [5]
- 215/42 . . . 胺基或羥基連至同一個碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 215/44 . . . 連至同一環或稠環系之碳原子上 [5]
- 215/46 . . . 羥基連至至少一個六節芳環之碳原子上及胺基連至非環碳原子上或連至同一個碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 215/48 . . . 胺基由不再為羥基所取代的碳鏈連至六節芳環上或連至含六節芳環之稠環系上 [5]
- 215/50 . . . 胺基及六節芳環、或含六節芳環之稠環系連至碳鏈之同一個碳原子上 [5]
- 215/52 . . . 於胺基及六節芳環或含六節芳環之稠環系之間由有兩個碳原子的碳鏈連接 [5]
- 215/54 . . . 於胺基及六節芳環或含六節芳環的稠環系之間由至少三個碳原子之碳鏈連接 [5]
- 215/56 . . . 胺基由進一步為羥基所取代的碳鏈連接至六節芳環上或含六節芳環之稠環系上 [5]
- 215/58 . . . 羥基及六節芳環，或含六節芳環之稠環系連至碳鏈的同一個碳原子上 [5]
- 215/60 . . . 於胺基及六節芳環或含六節芳環的稠環系之間有二個碳原子之鏈 [5]
- 215/62 . . . 於胺基及六節芳環或含六節芳環的稠環系之間有至少三個碳原子之鏈 [5]
- 215/64 . . . 具有係碳架組成部分之除六節芳環以外的其他環 [5]
- 215/66 . . . 具有連至碳架上之季銨化的胺基 [5]
- 215/68 . . . 胺基連至六節芳環之碳原子上及羥基連至非環碳原子上或連至同一個碳架之除六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 215/70 . . . 具有係碳架組成部分之除六節芳環以外的其他環 [5]
- 215/72 . . . 具有連至碳架上之季銨化的胺基 [5]
- 215/74 . . . 羥基及胺基連至同一個碳架之六節芳環的碳原子上 [5]
- 215/76 . . . 同一個非稠合六節芳環者 [5]

215/78 . . . 含至少二個連主碳架上之羥基 [5]

215/80 . . . 含至少二個連至碳架上之胺基 [5]

215/82 . . . 胺基中至少一個氮原子進一步連至另一個六節芳環之碳原子上 [5]

215/84 . . 胺基連至係稠環系組成部分的六節芳環之碳原子上 [5]

215/86 . . . 由二個環構成者 [5]

215/88 . . . 由至少三個環構成者 [5]

215/90 . . 季胺化之胺基連至碳架上 [5]

217/00 連至同一個碳架上之胺基及經醚化的羥基之化合物 [5]

217/02 . 經醚化之羥基及胺基連至同一個碳架之非環碳原子上 [5]

217/04 . . 碳架係無環及飽和者 [5]

217/06 . . . 僅有一個經醚化之羥基及一個胺基連至不再被取代的碳架上 [5]

217/08 經醚化之羥基的氧原子進一步連至非環碳原子上 [5]

217/10 連至含六節芳環之羥基的非環碳原子上 [5]

217/12 經醚化之羥基的氧原子進一步連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]

217/14 經醚化之羥基的氧原子進一步連至六節芳環之碳原子上 [5]

217/16 六節芳環或含六節芳環之稠環系不再被取代 [5]

217/18 六節芳環或含六節芳環之稠環系進一步被取代 [5]

217/20 為鹵原子、三鹵甲基、硝基或亞硝基、或單鍵連接之氧原子 [5]

217/22 為至少有兩條鍵連氧

原子之碳原子 [5]

217/24 六節芳環係含除六節芳環以外其他環之稠環系的組成部分 [5]

217/26 . . . 僅有一個經醚化之羥基及一個胺基連在進一步為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之碳架上 [5]

217/28 . . . 有一個胺基及至少二個單鍵連接之氧原子，與至少一個經醚化之羥基部分連至碳架上，如聚羥基胺之醚 [5]

217/30 經醚化之羥基中至少一個氧原子進一步連至六節芳環之碳原子上 [5]

217/32 六節芳環或含六節芳環之稠環系進一步被取代 [5]

217/34 由鹵原子、三鹵甲基、硝基或亞硝基、或單鍵連接的氧原子而成 [5]

217/36 由至少二個鍵連氧原子之碳原子而成 [5]

217/38 六節芳環係含除六節芳環以外其他環之稠環系的組成部分 [5]

217/40 至少二個單鍵連接的氧原子，與至少一個係經醚化之羥基部分連至碳架的同一個碳原子上，如胺基-酮縮醇、原酸酯 [5]

217/42 . . . 經醚化之羥基及至少二個胺基連至碳架上 [5]

217/44 . . 碳架係飽和者及含環者 [5]

217/46 . . 碳架係無環者與不飽和者 [5]

217/48 . . 碳架係是不飽和者與含環者 [5]

217/50 . . 未確定結構的羥基胺之醚，如由環氧化物及羥基胺反應而得 [5]

217/52 . 經醚化之羥基或胺基連至同一個碳架之除六節芳環以外的其他環

- 之碳原子上 [5]
- 217/54 • 經醚化之羥基連至少一個六節芳環的碳原子上及胺基連至非環碳原子上或連至除同一個碳架之六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 217/56 • • 胺基由不再被單鍵連接的氧原子取代之碳鏈連至六節芳環上或連至含六節芳環之稠環系上 [5]
- 217/58 • • • 有連至碳鏈之同一碳原子上的胺基及六節芳環或含有六節環之稠環系 [5]
- 217/60 • • • 於胺基及六節芳環或含有六節芳環之稠環系之間由具有 2 個碳原子之碳鏈連接 [5]
- 217/62 • • • 於胺基及六節芳環或含有六節芳環之稠環系之間由至少具有 3 個碳原子之碳鏈連接 [5]
- 217/64 • • 有以碳鏈連至六節芳環或含有六節芳環之稠環系上的胺基，其碳鏈為單鍵氧原子進一步所取代 [5]
- 217/66 • • • 有連至碳鏈之同一碳原子上的單鍵氧原子及六節芳環 [5]
- 217/68 • • • • 有連至碳鏈之同一碳原子上的單鍵氧原子，六節芳環及胺基 [5]
- 217/70 • • • • 於胺基及六節芳環或含有六節芳環的稠環系之間由有 2 個碳原子之碳鏈連接 [5]
- 217/72 • • • • 於胺基及六節芳環或含有六節芳環的稠環系之間由至少具有 3 個碳原子之碳鏈連接 [5]
- 217/74 • • 有由碳架組成部分之除六節芳環以外的其他環 [5]
- 217/76 • 除有連至六節芳環碳原子上之胺基及連至非環碳原子或同一碳架之除六節芳環以外的其他環碳原子上之醚化羥基 [5]
- 217/78 • 附有連至同一碳架之六節芳環的碳原子上之胺基及醚化羥基 [5]
- 217/80 • • 附有連至非稠合六節芳環碳原子上之胺基及醚化羥基 [5]
- 217/82 • • • 同一非稠合六節芳環者 [5]
- 217/84 • • • • 至少一個醚化羥基之氧原子進一步連至非環碳原子上 [5]
- 217/86 • • • • 連至含有六節芳環之羥基的非環碳原子上 [5]
- 217/88 • • • • 至少一個醚化羥基之氧原子進一步連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 217/90 • • • • 至少一個醚化羥基之氧原子進一步連至六節芳環之碳原子上，例如胺基二苯醚 [5]
- 217/92 • • • • 至少一個胺基之氮原子進一步連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 217/94 • • 附有連至作為稠環系組成部分之六節芳環的碳原子上之胺基及連至同一碳架之六節芳環的碳原子上之醚化羥基 [5]
- 219/00 含有連接至同一碳架之胺基及酯化羥基之化合物 [5]**
- 219/02 • 附有連至同一碳架之非環碳原子上的酯化羥基及胺基 [5]
- 219/04 • • 碳架係無環及飽和者 [5]
- 219/06 • • • 附有以含有連至氮原子或無環飽和碳架之非環碳原子上的酯化羥基之羧酸酯化的羥基 [5]
- 219/08 • • • 至少附有一個酯化之羥基，該羥基係以含有連至無環不飽和碳架之非環碳原子上的酯化羥基之羧酸酯化者 [5]
- 219/10 • • • 至少附有一個以含有連至含

- 環之非環碳原子上的酯化羧基之羧酸酯化的羥基 [5]
- 219/12 . . . 至少附有一個以含有連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上之酯化羧基的羧酸酯化之羥基 [5]
- 219/14 . . . 至少附有一個用含有連至六節芳環碳原子上之酯化羧基的羧酸酯化之羥基 [5]
- 219/16 . . . 至少附有一個用無機酸或其衍生物酯化之羥基 [5]
- 219/18 . . 碳架係飽和者及含環者 [5]
- 219/20 . . 碳架係不飽和者 [5]
- 219/22 . . . 含有六節芳環 [5]
- 219/24 . 附有連至同一碳架之除六節芳環以外環的碳原子上之酯化羥基或胺基 [5]
- 219/26 . 附有連至至少一個六節芳環之碳原子上的酯化羥基及連在非環碳原子上或同一碳架之除六節芳環以外環的碳原子上之胺基 [5]
- 219/28 . . 附有連至碳架之非環碳原子上的胺基 [5]
- 219/30 . . . 有以碳鏈連至六節芳環或含有六節芳環之稠環系上的胺基，該碳鏈為單鍵氧原子進一步取代 [5]
- 219/32 . 附有連至六節芳環碳原子上之胺基及連至非環碳原子上或同一碳架之除六節芳環以外的環之碳原子上的酯化羥基 [5]
- 219/34 . 附有連至同一碳架之六節芳環的碳原子上之胺基及酯化羥基 [5]
- 221/00 含有連至同一碳架上之胺基及雙鍵氧原子之化合物的製備 [5]**
- 223/00 含有連至碳架之非環碳原子上的胺基及—CHO 基之化合物 [5]**
- 223/02 . 附有連至碳架之非環碳原子上之胺基 [5]
- 223/04 . 附有連至碳架之除六節芳環以外的環碳原子上之胺基 [5]
- 223/06 . 附有連至碳架之六節芳環之碳原子上之胺基 [5]
- 225/00 含有連至同一碳架上之胺基及雙鍵氧原子之化合物，其中至少有一個雙鍵氧原子非為—CHO 基之組成部分，例如胺基酮 [5]**
- 225/02 . 附有連至碳架之非環碳原子上的胺基 [5]
- 225/04 . . 碳架係飽和者 [5]
- 225/06 . . . 與無環者 [5]
- 225/08 . . . 含有環者 [5]
- 225/10 有連至不作為環組成部分之碳原子上的雙鍵氧原子上 [5]
- 225/12 有連至作為環組成部分之碳原子上的雙鍵氧原子上 [5]
- 225/14 . . 碳架係不飽和者 [5]
- 225/16 . . . 含有六節芳環 [5]
- 225/18 碳架尚含有除六節芳環以外之其他環 [5]
- 225/20 . 附有連至碳架之除六節芳環以外環的碳原子上之胺基 [5]
- 225/22 . 附有連至碳架之六節芳環的碳原子上之胺基 [5]
- 225/24 . 含有醌環碳原子之碳架 [5]
- 225/26 . . 附有連至醌環或含醌環之稠環系的碳原子上之胺基 [5]
- 225/28 . . . 非稠合醌環者 [5]
- 225/30 由二個環形成之稠合醌環系者 [5]
- 225/32 由至少三個環形成之稠合醌環系者 [5]
- 225/34 胺基蒽醌 [5]
- 225/36 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
- 227/00 含有連至同一碳架上之胺基及羧基的化合物之製備 [5]**
- 227/02 . 於含胺基化合物中生成羧基，例如經由胺基醇之氧化 [5]
- 227/04 . 於含羧基化合物內生成胺基 [5]

- 227/06 • • 經由加成或取代反應，其中酸之碳架中的碳原子數未增加 [5]
- 227/08 • • • 經由胺或胺與含有官能基之酸反應 [5]
- 227/10 • • 同時增加碳架中之碳原子數 [5]
- 227/12 • 生成胺基及羧基 [5]
- 227/14 • 由已含胺基及羧基之化合物或此等衍生物 [5]
- 227/16 • • 經由不涉及胺基或羧基之反應 [5]
- 227/18 • • 經由涉及胺基或羧基之反應，例如酯或醯胺之水解，經由生成鹵化物、鹽或酯 [5]
- 227/20 • • • 經由 N-醯化胺基酸或其衍生物之水解，例如胺基甲酸酯的水解 [5]
- 227/22 • 由內醯胺，環酮或環肟，例如經由涉及貝克曼重排之反應 [5]
- 227/24 • 由乙內醯脲 [5]
- 227/26 • 由含有羧基之化合物與 HCN 反應或由此等之鹽及胺，或由胺基腈 [5]
- 227/28 • 由天然產物 [5]
- 227/30 • 製備旋光異構體 [5]
- 227/32 • • 利用立體有機合成 [5]
- 227/34 • • 經由旋光異構體之分離 [5]
- 227/36 • 旋光異構體之外消旋 [5]
- 227/38 • 分離；純化；穩定化；使用添加劑(旋光異構體之分離見 227/34) [5]
- 227/40 • • 分離；純化 [5]
- 227/42 • • • 結晶 [5]
- 227/44 • • 穩定化；使用添加劑 [5]
- 229/00 含有連至同一碳架上之胺基及羧基之化合物 [5]**
- 229/02 • 附有連至同一碳架非環碳原子上的胺基及羧基 [5]
- 229/04 • • 碳架係無環者與飽和者 [5]
- 229/06 • • • 僅附有連至碳架上之一個胺基及一個羧基 [5]
- 229/08 • • • • 胺基之氮原子進一步連接氫原子 [5]
- 229/10 • • • • 胺基之氮原子進一步與非環碳原子或除六節芳環以外環之碳原子相連 [5]
- 229/12 • • • • • 連至無環碳架之碳原子上 [5]
- 229/14 • • • • • 連至含環碳架之碳原子上 [5]
- 229/16 • • • • • 連至為胺基或羧基所取代之經基的碳原子上，例如乙二胺四乙酸，亞胺基二乙酸 [5]
- 229/18 • • • • 胺基之氮原子進一步與六節芳環之碳原子相連 [5]
- 229/20 • • • 碳架進一步為鹵原子或為硝基或亞硝基所取代 [5]
- 229/22 • • • 碳架進一步為氧原子所取代 [5]
- 229/24 • • • 附有一個以上之與碳架相連的羧基，例如天冬胺酸 [5]
- 229/26 • • • 附有一個以上與碳架相連的胺基，例如離胺酸 [5]
- 229/28 • • 碳架係飽和者及含環者 [5]
- 229/30 • • 碳架係非環者及不飽和者 [5]
- 229/32 • • 碳架係不飽和之含有除六節芳環以外的環 [5]
- 229/34 • • 碳架含有六節芳環 [5]
- 229/36 • • • 有至少一個與碳架中同一碳原子相連的胺基及羧基 [5]
- 229/38 • 附有連至非環碳原子上之胺基及連接至同一碳架之六節芳環碳原子上的羧基 [5]
- 229/40 • 附有連至至少一個六節芳環碳原子上之胺基及連接至同一碳架之非環碳原子上的羧基 [5]
- 229/42 • • 附有用飽和碳鏈連至六節芳環或連至含有六節芳環之稠環系上的羧基 [5]
- 229/44 • • 有以不飽和碳鏈連至六節芳環或含有六節芳環之稠環系上的羧基 [5]
- 229/46 • 附有連接至同一碳架之除六節芳

環以外的環的碳原子上之胺基或羧基 [5]

229/48 • • 有連接至同非稠環之碳原子上的胺基及羧基 [5]

229/50 • • 有連接至作為同一稠環系組成部分之碳原子上的胺基及羧基 [5]

229/52 • 附有連接至同一碳架之六節芳環碳原子上的胺基及羧基 [5]

229/54 • • 有連至同一非稠合六節芳環碳原子上之胺基及羧基 [5]

229/56 • • • 有連至鄰位上之胺基及羧基 [5]

229/58 • • • • 至少一個胺基之氮原子，進一步連至六節芳環碳原子上，例如 N-苯基-鄰胺基苯甲酸 [5]

229/60 • • • 有連至間位或對位上之胺基及羧基 [5]

229/62 • • • 有連至同一六節芳環碳原子上之胺基及至少兩個羧基 [5]

229/64 • • • 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]

229/66 • • • 碳架進一步為雙鍵氧原子所取代 [5]

229/68 • • 有連接至成為同一稠環系組成部分之六節芳環的碳原子上之胺基及羧基 [5]

229/70 • • • 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]

229/72 • • • 碳架進一步為雙鍵氧原子所取代 [5]

229/74 • • • • 稠環系係由至少三個環組成，例如胺基蒽醌羧酸 [5]

229/76 • 胺基羧酸之金屬錯合物 [5]

231/00 羧酸醯胺之製備 [5]

231/02 • 利用與氨或胺反應由羧酸或由此等之酯、酐或鹵化物予以製備 [5]

231/04 • 利用與氨或胺反應由乙烯酮予以

製備 [5]

231/06 • 利用將腈之氰基轉化成羧醯胺基且由腈予以製備 [5]

231/08 • 利用於羧醯胺基之氮原子上反應且由醯胺予以製備 [5]

231/10 • 由 231/02~231/08 內未被包含之化合物製備 [5]

231/12 • 利用不涉及生成羧醯胺基之反應 [5]

231/14 • 利用同時有不涉及羧醯胺基反應形成羧醯胺基製備 [5]

231/16 • 旋光異構體之製備 [5]

231/18 • • 利用立體有機合成 [5]

231/20 • • 利用分離旋光異構體 [5]

231/22 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用（旋光異構體之分離見 231/20） [5]

231/24 • • 分離；純化 [5]

233/00 羧酸醯胺 [5]

233/01 • 羧醯胺基之碳原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]

233/02 • • 羧醯胺基之氮原子連至氮原子或未取代烴基碳原子上 [5]

233/03 • • • 羧醯胺基之碳原子連至氮原子上 [5]

233/04 • • • 羧醯胺基之碳原子連至無環飽和碳架之非環碳原子上 [5]

233/05 • • • • 羧醯胺基之氮原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]

233/06 • • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]

233/07 • • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]

233/08 • • • 羧醯胺基之碳原子連至含環飽和碳架之非環碳原子上 [5]

233/09 • • • 羧醯胺基之碳原子連至無環不飽和碳架之碳原子 [5]

233/10 • • • 羧醯胺基之碳原子連至含有

- 除六節芳環以外環之不飽和碳架之碳原子 [5]
- 233/11 . . . 羧醯胺基之碳原子連至含有六節芳環之不飽和碳架的碳原子上 [5]
- 233/12 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/13 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/14 . . . 有由除六節芳環以外環之碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/15 . . . 有由六節芳環之碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/16 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/17 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/18 羧醯胺基之碳原子連至氮原子或無環飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/19 羧醯胺基之碳原子連至含環之飽和碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/20 羧醯胺基之碳原子連至無環不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/21 羧醯胺基之碳原子連至含有除六節芳環以外環之不飽和碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/22 羧醯胺基之碳原子連至含有六節芳環之碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/23 . . . 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基的氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/24 . . . 有由六節芳環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/25 羧醯胺基之碳原子連至氮原子或不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/26 羧醯胺基之碳原子連至含環飽和碳架之非環碳原子上 [5]
- 233/27 羧醯胺基之碳原子連至無環不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/28 羧醯胺基之碳原子連至含有除六節芳環以外環之不飽和碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/29 羧醯胺基之碳原子連至含有六節芳環之碳架的非環碳原子上
- 233/30 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為雙鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/31 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/32 . . . 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/33 . . . 有由六節芳環之碳原子連至羧醯胺基之氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/34 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為胺基所取代的烴基之碳原子上 [5]
- 233/35 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/36 羧醯胺基之碳原子連至氮原子或無環飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/37 羧醯胺基之碳原子連至含環飽和碳架之非環碳原子上 [5]
- 233/38 羧醯胺基之碳原子連至無

- 環不飽和碳架之碳原子上
[5]
- 233/39 羧醯胺基之碳原子連至含有除六節芳環以外環之不飽和碳架的非環碳原子上
[5]
- 233/40 羧醯胺基之碳原子連至含有六節芳環之碳架的非環原子上 [5]
- 233/41 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/42 有由六節芳環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/43 羧醯胺基之碳原子連至氫原子或飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/44 羧醯胺基之碳原子連在不飽和碳架碳原子上 [5]
- 233/45 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/46 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/47 羧醯胺基之碳原子連至無環飽和碳架之碳原子或氫原子上 [5]
- 233/48 羧醯胺基之碳原子連至含有環之飽和碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/49 羧醯胺基之碳原子連至無環不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/50 羧醯胺基之碳原子連至含有除六節芳環以外環之不飽和碳架的非環碳原子上 [5]
- 233/51 羧醯胺基之碳原子連至含有六節芳環之碳架之非環碳原子上 [5]
- 233/52 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/53 有由六節芳環之碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/54 羧醯胺基的碳原子連至氫原子或飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/55 羧醯胺基之碳原子連至不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 233/56 羧醯胺基之碳原子連至羧基之碳原子上，例如草醯胺 [5]
- 233/57 羧醯胺基之碳原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 233/58 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或未取代烴基之碳原子上 [5]
- 233/59 附有至少一個羧醯胺基之氮原子連至為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/60 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/61 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為雙鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/62 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為胺基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/63 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的碳原子上者 [5]
- 233/64 羧醯胺基之碳原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 233/65 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或未取代烴基之碳原子上 [5]
- 233/66 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/67 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]

- 233/68 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/69 . . . 無環飽和碳架者 [5]
- 233/70 . . . 含環飽和碳架者 [5]
- 233/71 . . . 無環不飽和碳架者 [5]
- 233/72 . . . 含有除六節芳環以外環之不飽和碳架者 [5]
- 233/73 . . . 含六節芳環之碳架者 [5]
- 233/74 . . . 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/75 . . . 有由六節芳環之碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/76 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為雙鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/77 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為胺基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/78 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/79 . . . 有由除六節芳環以外之環碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/80 . . . 有由六節芳環之碳原子連至羧醯胺基的氮原子上之取代烴基 [5]
- 233/81 . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 233/82 . . . 有由非環碳原子連至羧醯胺基之氮原子上的取代烴基 [5]
- 233/83 . . . 無環飽和碳架者 [5]
- 233/84 . . . 含環飽和碳架者 [5]
- 233/85 . . . 無環不飽和碳架者 [5]
- 233/86 . . . 含有除六節芳環以外環之不飽和碳架者 [5]
- 233/87 . . . 含六節芳環之碳架者 [5]
- 233/88 . 羧醯胺基之氮原子連至非環碳原子及連至至少有一個鄰位氫已被取代的六節芳環之碳原子上 [5]
- 233/89 . 羧醯胺基之氮原子季銨化 [5]
- 233/90 . 羧醯胺基之氮原子進一步醯化 [5]
- 233/91 . . 羧醯胺基之碳原子連至非環碳原子上 [5]
- 233/92 . . 至少一個羧醯胺基之碳原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/00 羧酸醯胺，酸部分之碳架進一步為氧原子所取代 [5]**
- 235/02 . 附有連非環碳原子上之羧醯胺基的碳原子及連至同一碳架上之單鍵氧原子 [5]
- 235/04 . . 碳架為無環者與飽和者 [5]
- 235/06 . . . 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 235/08 . . . 至少一個羧醯胺基氮原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 235/10 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至非硝基或亞硝基組成部分之氮原子取代的烴基之非環碳原子上 [5]
- 235/12 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 235/14 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 235/16 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/18 . . . 附有至少一個進一步連至六節芳環碳原子上之單鍵氧原子，例如苯氧基乙醯胺 [5]
- 235/20 . . . 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 235/22 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 235/24 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原

- 子連至六節芳環碳原子上
[5]
- 235/26 • • 碳架為飽和者及含環者 [5]
- 235/28 • • 碳架為無環者及不飽和者 [5]
- 235/30 • • 碳架為不飽和者及含有除六節芳環以外環者 [5]
- 235/32 • • 碳架含有六節芳環 [5]
- 235/34 • • • 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 235/36 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 235/38 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/40 • 附有連至除六節芳環以外之環碳原子上的羧醯胺基之碳原子及連至同一碳架上之單鍵氧原子 [5]
- 235/42 • 附有連至六節芳環碳原子上之羧醯胺的碳原子及連至同一碳架上之單鍵氧原子 [5]
- 235/44 • • 有連至同一非稠合六節芳環之碳原子上的羧醯胺基之碳原子及單鍵氧原子 [5]
- 235/46 • • • 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 235/48 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為單鍵氧原子所取代之氫基的非環碳原子上 [5]
- 235/50 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為非硝基或亞硝基組成部分的氮原子所取代之氫基的碳原子上 [5]
- 235/52 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之氫基非環碳原子上 [5]
- 235/54 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 235/56 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/58 • • • 有連接同一非稠合六節芳環之鄰位碳原子上的羧醯胺基之碳原子及單鍵氧原子
[5]
- 235/60 • • • 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 235/62 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子 [5]
- 235/64 • • • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/66 • • 有連至係稠環系組成部分之六節芳環碳原子上的羧醯胺基之碳原子及連至同一碳架上之單鍵氧原子 [5]
- 235/68 • 至少一個羧醯胺基之氮原子連至非環碳原子及至少有一個鄰位氫原子被取代的六節芳環原子上 [5]
- 235/70 • 附有連至同一碳架上之羧醯胺基的碳原子及雙鍵氧原子 [5]
- 235/72 • • 羧醯胺基之碳原子連至非環碳原子上 [5]
- 235/74 • • • 飽和碳架者 [5]
- 235/76 • • • 不飽和碳架者 [5]
- 235/78 • • • 碳架中含有環 [5]
- 235/80 • • • 附有連至同一碳原子上之羧醯胺基之碳原子及酮基，例如乙醯乙醯胺 [5]
- 235/82 • • 有至少一個羧醯胺基之碳原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 235/84 • • 至少一個羧醯胺基之碳原子連至六節芳環碳原子上 [5]
- 235/86 • 有至少一個羧醯胺基之氮原子季銨化 [5]
- 235/88 • 有至少一個羧醯胺基之氮原子進一步被醯化 [5]
- 237/00 羧酸醯胺，酸部分之碳架進一步為胺基取代 [5]**
- 237/02 • 羧醯胺基之碳原子連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 237/04 • • 碳架係非環者及飽和者 [5]

- 237/06 . . . 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 237/08 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 237/10 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為非硝基或亞硝基氮原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 237/12 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 237/14 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]
- 237/16 . . . 碳架係無環者及不飽和者 [5]
- 237/18 . . . 碳架係不飽和者及含有除六節芳環以外環者 [5]
- 237/20 . . . 碳架含有六節芳環 [5]
- 237/22 . . . 胺基之氮原子連至進一步被醯化的酸部分之碳架上 [5]
- 237/24 . . . 至少一個羧醯胺基之碳原子連至碳架之除六節芳環以外的環碳原子上
- 237/26 . . . 其環係至少由 4 個環組成之稠環系的組成部分，例如四環素 [5]
- 237/28 . . . 至少一個羧醯胺基之碳原子連至碳架的非稠合六節芳環碳原子上 [5]
- 237/30 . . . 羧醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 237/32 . . . 羧醯胺基之氮原子連至為氧原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 237/34 . . . 羧醯胺基之氮原子連至為非硝基或亞硝基之氮原子所取代之烴基之非環碳原子上 [5]
- 237/36 . . . 羧醯胺基之氮原子連至為羧基所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 237/38 . . . 羧醯胺基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]
- 237/40 . . . 羧醯胺基之氮原子連至六節芳環碳原子 [5]
- 237/42 . . . 胺基之氮原子連至進一步醯化的碳架上 [5]
- 237/44 . . . 附有連至同一非稠合六節芳環之碳原子上的羧醯胺基之碳原子，胺基及單鍵氧原子 [5]
- 237/46 . . . 附有連至同一非稠合六節芳環之碳原子上的羧醯胺基之碳原子，胺基及至少三個溴或碘原子 [5]
- 237/48 . . . 至少一個羧醯胺基之碳原子連至係同一碳架之稠環系組成部分的六節芳環碳原子上 [5]
- 237/50 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子季銨化 [5]
- 237/52 . . . 至少一個羧醯胺基之氮原子進一步醯化 [5]
- 239/00 含有氮—鹵鍵之化合物；脛胺基化合物或此等之醚或酯 [5]**
- 239/02 . . . 含有氮—鹵鍵之化合物 [5]
- 239/04 . . . N—鹵代胺 [5]
- 239/06 . . . N—鹵代羧醯胺 [5]
- 239/08 . . . 脛胺基化合物或此等之醚或酯 [5]
- 239/10 . . . 脛胺基之氮原子進一步連至未取代烴基碳原子上或為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 239/12 . . . 脛胺基之氮原子進一步連至為單鍵氧原子所取代之烴基碳原子上 [5]
- 239/14 . . . 脛胺基之氮原子進一步連至為雙鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 239/16 . . . 脛胺基之氮原子進一步連至非硝基或亞硝基氮原子取代的烴基之碳原子上 [5]
- 239/18 . . . 脛胺基之氮原子進一步連至為羧基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 239/20 . . . 醚化的脛胺基之氧原子 [5]
- 239/22 . . . 附有酯化脛胺基之氧原子 [5]

241/00 製備含有氮原子之間以單鍵相連的鏈之化合物，例如肼，三氮烷

241/02 · 製備肼 [5]

241/04 · 製備醯肼 [5]

243/00 含有氮原子之間以單鍵相連的鏈之化合物，例如肼，三氮烷 [5]

243/02 · N-硝基化合物 [5]

243/04 · N-亞硝基化合物 [5]

243/06 · · N-亞硝基胺 [5]

243/08 · · N-亞硝基羧醯胺

243/10 · 肼 [5]

243/12 · · 肼基之氮原子連至非環碳原子上 [5]

243/14 · · · 飽和碳架者 [5]

243/16 · · · 不飽和碳架者 [5]

243/18 · · · · 含環者 [5]

243/20 · · 附有肼基之氮原子連至除六節芳環以外之環碳原子上 [5]

243/22 · · 肼基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]

243/24 · 附有用羧酸醯化之肼基的氮原子之肼 [5]

243/26 · · 有連至氮原子或非環碳原子上之醯化羧基 [5]

243/28 · · · 連至氮原子或飽和碳架之碳原子上 [5]

243/30 · · · 連至不飽和碳架之碳原子上 [5]

243/32 · · · · 碳架係含環者 [5]

243/34 · · · 連至進一步為氮原子所取代之碳架之碳原子上 [5]

243/36 · · 有連至除六節芳環以外之環碳原子上的醯化羧基 [5]

243/38 · · 有連至六節芳環碳原子上之醯化羧基 [5]

243/40 · 附有季銨化肼基之氮原子的肼 [5]

243/42 · 附有進一步以單鍵與雜原子相連的肼基之氮原子的肼 [5]

245/00 含有至少具有一個氮-氮重鍵

之至少二個氮原子的鍵之化合物 (氧化偶氮化合物見 291/08) [5]

245/02 · 偶氮化合物，即具有 $-N=N-$ 基連至不同原子上之化合物，例如重氮氫氧化物 [5]

245/04 · · 偶氮基之氮原子連至非環碳原子或除六節芳環以外之環碳原子上 [5]

245/06 · · 偶氮基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]

245/08 · · · 有連至六節芳環碳原子上之偶氮基的二個氮原子，例如偶氮苯 [5]

245/10 · · · 偶氮基之氮原子連至屬稠環系部分之六節芳環碳原子上 [5]

245/12 · 重氮化合物，即具有 $>N_2$ 基之自由價連至同一碳原子上之化合物 [5]

245/14 · · 附有連至碳架之非環碳原子上的重氮基 [5]

245/16 · · · 重氮甲烷 [5]

245/18 · · · 碳架進一步為羧基所取代 [5]

245/20 · 重氮化合物 [5]

245/22 · 含有附有一個或多個氮-氮雙鍵之三個或更多的氮原子之鏈 [5]

245/24 · · 僅有三個氮原子之鏈，例如重氮醯胺 [5]

247/00 含有疊氮基之化合物 [5]

247/02 · 有連至碳架之非環碳原子上的疊氮基 [5]

247/04 · · 飽和者 [5]

247/06 · · · 含環者 [5]

247/08 · · 不飽和者 [5]

247/10 · · · 及含環者 [5]

247/12 · · 進一步為羧基所取代 [5]

247/14 · 有連至除六節芳環以外之環碳原子上的疊氮基 [5]

247/16 · 有連至碳架之六節芳環的碳原子上之疊氮基 [5]

247/18 · · 進一步為羧基所取代 [5]

247/20 · 由羧酸醯化之疊氮基 [5]

247/22 • • 有連至氮原子，非環碳原子或除六節芳環以外之環碳原子上的鹽化羧基 [5]

247/24 • • 有至少一個連至六節芳環碳原子上之鹽化羧基 [5]

249/00 含有雙鍵連至碳架上之氮原子的化合物之製備（重氮化合物見 245/12） [5]

249/02 • 含有亞胺基化合物者 [5]

249/04 • 肟者 [5]

249/06 • • 利用烴或取代烴之亞硝化 [5]

249/08 • • 利用經基胺與羰基化合物反應 [5]

249/10 • • 由硝基化合物或此等之鹽 [5]

249/12 • • 利用不涉及經亞胺基形成之反應 [5]

249/14 • • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]

249/16 • 腙者 [5]

251/00 氮原子以雙鍵與碳架相連的含氮化合物（重氮化合物見 245/12） [5]

251/02 • 含有亞胺基團 [5]

251/04 • • 附有與氮原子或非環碳原子連接的亞胺基之碳原子 [5]

251/06 • • • 連接至飽和碳架之碳原子上 [5]

251/08 • • • • 非環者 [5]

251/10 • • • • 連接至不飽和碳架之碳原子上 [5]

251/12 • • • • 非環者 [5]

251/14 • • • • 含有除六節芳環以外之其他環 [5]

251/16 • • • • 含有六節芳環

251/18 • • 亞胺基之碳原子連至除六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]

251/20 • • 亞胺基之碳原子係除六節芳環以外之其他環的一部分 [5]

251/22 • • • 肟亞胺 [5]

251/24 • • 亞胺基碳原子連接至六節芳環之碳原子上 [5]

251/26 • • 亞胺基的氮原子進一步連接鹵原子 [5]

251/28 • • 經鹽化的亞胺基之氮原子 [5]

251/30 • • 經季銨化的亞胺基之氮原子 [5]

251/32 • 肟 [5]

251/34 • • 氧亞胺基之氧原子連至氮原子或未取代烴基之碳原子上 [5]

251/36 • • • 經亞胺基之碳原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]

251/38 • • • • 連至飽和碳架之碳原子上 [5]

251/40 • • • • 連至不飽和碳架之碳原子上 [5]

251/42 • • • 至少一個氧亞胺基之碳原子連接除六節芳環以外的環之碳原子 [5]

251/44 • • • 至少一個氧亞胺基之碳原子係除六節芳環以外的環之組成部分 [5]

251/46 • • • • 肟肟 [5]

251/48 • • • 至少一個氧亞胺基之碳原子連接六節芳環的碳原子 [5]

251/50 • • 氧亞胺基之氧原子連接取代烴基之碳原子 [5]

251/52 • • • 由鹵原子或硝基或亞硝基取代的烴基 [5]

251/54 • • • 由單鍵氧原子取代的烴基 [5]

251/56 • • • 由雙鍵氧原子取代的烴基 [5]

251/58 • • • 由非硝基或亞硝基之氮原子取代的烴基 [5]

251/60 • • • 由羧基取代的烴基 [5]

251/62 • • 具有酯化之氧亞胺基的氧原子 [5]

251/64 • • • 由羧酸 [5]

251/66 • • • • 含有連接氮原子、非環碳原子或除六節芳環以外的環碳原子之酯化羧基 [5]

251/68 • • • • 含有至少一個連接六節芳環之碳原子的酯化羧基 [5]

251/70 • • 肟之金屬錯合物 [5]

251/72 • 肟 [5]

- 251/74 • • 腙基之雙鍵碳原子連接氮原子或非環碳原子 [5]
- 251/76 • • • 連接飽和碳架之碳原子 [5]
- 251/78 • • • 連接不飽和碳架之碳原子 [5]
- 251/80 • • • • 含有環之碳架 [5]
- 251/82 • • 腙基之雙鍵碳原子連接除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 251/84 • • 腙基之雙鍵碳原子係除六節芳環以外的環之組成部分 [5]
- 251/86 • • 腙基之雙鍵碳原子連接六節芳環之碳原子 [5]
- 251/88 • • 尚含有其他與碳原子雙鍵連接的氮原子，例如，氮雜苯類 [5]

253/00 羧酸腈之製備（氰或氰化合物製備見 C01C 3/00） [5]

- 253/02 • 由氮氧化物與有機化合物反應 [5]
- 253/04 • 由鹵化氰，例如 ClCN，與有機化合物反應 [5]
- 253/06 • 由 N-甲醯化之胺基化合物 [5]
- 253/08 • 由氰化氫或其鹽與不飽和化合物加成 [5]
- 253/10 • • 含碳-碳雙鍵之化合物 [5]
- 253/12 • • 含碳-碳參鍵之化合物 [5]
- 253/14 • 由氰化物與含鹵素化合物反應，鹵原子為氰基所取代 [5]
- 253/16 • 由氰化物與內酯或含有羥基或醚化或酯化羥基之化合物反應 [5]
- 253/18 • 由氨或胺與含有除六節芳環以外之碳-碳重鍵之化合物反應 [5]
- 253/20 • 由羧酸酐脫水 [5]
- 253/22 • 由胺與羧酸反應，羧基為氰基所取代
- 253/24 • 由烴或取代烴之氮氧化 [5]
- 253/26 • • 含有碳-碳重鍵，例如，不飽和醛 [5]
- 253/28 • • 含有六節芳環，例如，苯乙烯 [5]
- 253/30 • 由不涉及形成氰基之反應 [5]
- 253/32 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]
- 253/34 • • 分離；純化 [5]

255/00 羧酸腈（氰或氰化合物見 C01C 3/00） [5]

- 255/01 • 含有連接非環碳原子之氰基 [5]
- 255/02 • • 無環及飽和碳架者 [5]
- 255/03 • • • 一元腈 [5]
- 255/04 • • • 含有連接碳架之兩個氰基 [5]
- 255/05 • • • 至少含有三個連接碳架之氰基 [5]
- 255/06 • • 無環及不飽和碳架者 [5]
- 255/07 • • • 一元腈 [5]
- 255/08 • • • • 丙烯腈；甲基丙烯腈 [5]
- 255/09 • • • 含有至少兩個連接碳架之氰基 [5]
- 255/10 • • 含有連接同一無環碳架之氰基及鹵原子，或硝基或亞硝基 [5]
- 255/11 • • 含有連接同一飽和無環碳架之氰基及單鍵氧原子 [5]
- 255/12 • • • 含有連接碳架之氰基及羥基 [5]
- 255/13 • • • 含有連接碳架之氰基及醚化的羥基 [5]
- 255/14 • • • 含有連接碳架之氰基及酯化的羥基 [5]
- 255/15 • • 含有連接同一不飽和無環碳架之氰基及單鍵氧原子 [5]
- 255/16 • • 含有連接無環碳架之同一碳原子的氰基及單鍵氧原子 [5]
- 255/17 • • 含有連接同一無環碳架之氰基及雙鍵氧原子 [5]
- 255/18 • • 含有連接羧基碳原子之氰基 [5]
- 255/19 • • 含有連接同一飽和無環碳架的氰基及除氰基以外之羧基 [5]
- 255/20 • • • 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
- 255/21 • • • 碳架進一步為雙鍵氧原子所取代 [5]
- 255/22 • • • 含有連接碳架之氰基及至少兩個羧基 [5]
- 255/23 • • 含有連接同一不飽和無環碳架之氰基及除氰基以外的羧基 [5]

- 255/24 • • 含有連接同一飽和無環碳架之
氰基及不連接其他雜原子之
單鍵氮原子
- 255/25 • • • 胺基乙腈 [5]
- 255/26 • • • 含有連接碳架之氰基、胺基
及單鍵氧原子 [5]
- 255/27 • • • 含有連接碳架之氰基、胺基
及雙鍵氧原子 [5]
- 255/28 • • • 含有連接碳架之氰基、胺基
及除氰基以外之羧基 [5]
- 255/29 • • • 含有連接碳架之氰基及醯化
胺基 [5]
- 255/30 • • 含有連接同一不飽和碳架之氰
基及不連接其他雜原子之單
鍵氮原子 [5]
- 255/31 • • 含有連接具有除六節芳環以外
的環之碳架的非環碳原子之
氰基 [5]
- 255/32 • • 含有連接至少具有一個六節芳
環之碳架的非環碳原子之氰
基 [5]
- 255/33 • • • 氰基由飽和碳鏈連接六節芳
環或含有六節芳環之稠環
系 [5]
- 255/34 • • • 氰基由不飽和碳鏈連接六節
芳環或含有六節芳環之稠
環系 [5]
- 255/35 • • • 碳架進一步為鹵原子，或硝
基或亞硝基所取代 [5]
- 255/36 • • • 碳架進一步為羥基所取代 [5]
- 255/37 • • • 碳架進一步為醚化的羥基所
取代 [5]
- 255/38 • • • 碳架進一步為酯化的羥基所
取代 [5]
- 255/39 • • • • 具有為 2,2-二甲基環丙烷
羧酸之衍生物，例如菊
酸，所酯化之羥基者 [5]
- 255/40 • • • 碳架進一步為雙鍵氧原子所
取代 [5]
- 255/41 • • • 碳架進一步為除氰基以外之
羧基所取代 [5]
- 255/42 • • • 碳架進一步為不再連接其他
雜原子之單鍵氮原子取代
[5]
- 255/43 • • • • 碳架進一步為單鍵氧原子
所取代 [5]
- 255/44 • • • • 至少一個經醯化的單鍵氮
原子 [5]
- 255/45 • 含有連接除六節芳環以外之環的
碳原子之氰基 [5]
- 255/46 • • 連接非稠環之碳原子 [5]
- 255/47 • • 連接稠環系中之環碳原子 [5]
- 255/48 • • 連接 2,2-二甲基環丙烷之環碳
原子，例如，菊酸腈 [5]
- 255/49 • 含有連接碳架之六節芳環之碳原
子的氰基 [5]
- 255/50 • • 連接非稠合六節芳環之碳原子
[5]
- 255/51 • • • 含有至少兩個連接碳架之氰
基 [5]
- 255/52 • • 連接稠環系之六節芳環碳原子
[5]
- 255/53 • • 含有連接碳架之氰基及羥基[5]
- 255/54 • • 含有連接碳架之氰基及醚化的
羥基 [5]
- 255/55 • • 含有連接碳架之氰基及酯化的
羥基 [5]
- 255/56 • • 含有連接碳架之氰基及雙鍵氧
原子 [5]
- 255/57 • • 含有連接碳架上的氰基及除氰
基以外之羧基 [5]
- 255/58 • • 含有連接碳架之氰基及不連接
其他雜原子之單鍵氮原子 [5]
- 255/59 • • • 碳架進一步為單鍵氧原子所
取代 [5]
- 255/60 • • • 至少有一個經醯化的單鍵氮
原子 [5]
- 255/61 • 氰基及亞胺基之氮原子連接同一
碳架上 [5]
- 255/62 • 氰基及氧亞胺基之氧原子連接同
一碳架上 [5]
- 255/63 • 含有連接同一碳架之氰基及尚連
接除硝基或亞硝基之氧原子以外
的其他雜原子之氮原子 [5]

- 255/64 • • 氮原子進一步連接氧原子 [5]
- 255/65 • • 氮原子進一步連接氮原子 [5]
- 255/66 • • • 氰基及肼或脲基之氮原子連接同一碳架上 [5]
- 255/67 • • • 含有連接同一碳架之氰基及疊氮基 [5]

257/00 含有羧基之化合物，羧基之雙鍵氧原子為雙鍵氮原子所取代，該氮原子不再連接氧原子，例如，亞胺醚，脒[5]

- 257/02 • 羧基之其他氧原子為鹵原子所取代，例如，偕氯代亞胺 [5]
- 257/04 • 羧基之其他氧原子不再被取代，例如亞胺醚 [5]
- 257/06 • • 亞胺基羧基之碳原子連接氮原子、非環碳原子、或除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 257/08 • • 亞胺基羧基之碳原子連接六節芳環之碳原子 [5]
- 257/10 • 羧基之其他氧原子為氮原子所取代，例如，脒 [5]
- 257/12 • • 脒基之碳原子連接氮原子 [5]
- 257/14 • • 脒基之碳原子連接非環碳原子 [5]
- 257/16 • • 脒基之碳原子連接除六節芳環以外的環之碳原子 [5]
- 257/18 • • 脒基之碳原子連接六節芳環碳原子 [5]
- 257/20 • • 含有醯化之脒基的氮原子 [5]
- 257/22 • • 脒基之氮原子連接氮原子，例如，肼定 [5]

259/00 含有羧基之化合物，羧基之一個氧原子為氮原子所取代，該氮原子進一步連接非硝基或亞硝基之氧原子 [5]

- 259/02 • 羧基之其他氧原子為鹵原子所取代 [5]
- 259/04 • 羧基之其他氧原子不再被取代，例如，氧肟酸 [5]
- 259/06 • • 氧肟基之碳原子連接氮原子或非環碳原子 [5]

- 259/08 • • 異脛肟基之碳原子連接除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 259/10 • • 氧肟基之碳原子連接六節芳環碳原子者 [5]
- 259/12 • 羧基之其他氧原子為氮原子所取代，例如，N-脛基脒 [5]
- 259/14 • • 脛肟基之碳原子連接氮原子或非環碳原子 [5]
- 259/16 • • 脛肟基之碳原子連接除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 259/18 • • 脛肟基之碳原子連接六節芳環碳原子 [5]
- 259/20 • • 至少一個脛肟基之氮原子連接另一個氮原子 [5]

261/00 氰酸之衍生物 [5]

- 261/02 • 氰酸鹽 [5]
- 261/04 • 胺基氰(未取代之胺基氰見 C01C 3/16) [5]

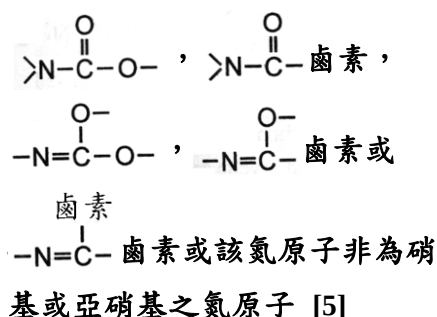
263/00 異氰酸衍生物之製備 [5]

- 263/02 • 由鹵化物與異氰酸或其衍生物反應 [5]
 - 263/04 • 由或經胺基甲酸酯或胺基甲醯基鹵化物 [5]
 - 263/06 • 由或經尿素 [5]
 - 263/08 • 由或經雜環化合物，例如 furoxans 之熱解
 - 263/10 • 由胺與羧基鹵化物，例如，與光氣反應 [5]
 - 263/12 • 由或經羧酸之含氮衍生物，例如氧肟酸，包括霍夫曼(Hofmann)、柯提斯(Curtius)或洛森(Lossen)重排(209/56 優先) [5]
 - 263/14 • 由硝基化合物與一氧化碳之催化反應
 - 263/16 • 由不包括形成異氰酸鹽基之反應 [5]
 - 263/18 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]
 - 263/20 • • 分離；純化 [5]
- 265/00 異氰酸之衍生物 [5]**
- 265/02 • 含有連接非環碳原子之異氰酸酯基 [5]

- 265/04 • • 飽和碳架者 [5]
 265/06 • • 不飽和碳架者 [5]
 265/08 • • • 含環碳架 [5]
 265/10 • 含有連接除六節芳環以外之環的
 碳原子之異氰酸酯基 [5]
 265/12 • 含有連接六節芳環碳原子之異氰
 酸酯基 [5]
 265/14 • 含有至少兩個連接同一碳架之異
 氰酸酯基 [5]
 265/16 • 含有醯化的異氰酸酯基 [5]

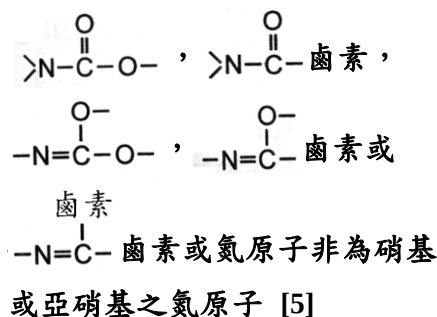
267/00 碳化二亞胺 [5]

269/00 製備胺基甲酸之衍生物，即，含 有如下任何基團之化合物



- 269/02 • 由異氰酸酯形成胺基甲酸酯基
 [5]
 269/04 • 由胺形成胺基甲酸酯基 [5]
 269/06 • 由不涉及形成胺基甲酸酯基之反
 應 [5]
 269/08 • 分離；純化；穩定化；添加劑之
 使用 [5]

271/00 胺基甲酸衍生物，即，含有如下 任何基團之化合物



- 271/02 • 胺基甲酸；胺基甲酸鹽（未取代
 的胺基甲酸或其鹽見 C01B
 21/12）[5]
 271/04 • 胺基甲酸之鹵化物 [5]

- 271/06 • 胺基甲酸酯 [5]
 271/08 • • 胺基甲酸酯基之氧原子連接非
 環碳原子 [5]
 271/10 • • • 胺基甲酸酯基之氮原子連接
 氫原子或非環碳原子 [5]
 271/12 • • • • 連接氫原子或未取代的經
 基之碳原子 [5]
 271/14 • • • • 連接由鹵原子或硝基或亞
 硝基取代的經之碳原子
 [5]
 271/16 • • • • 連接由單鍵氧原子取代的
 經基之碳原子 [5]
 271/18 • • • • 連接由雙鍵氧原子取代的
 經基之碳原子 [5]
 271/20 • • • • 連接由非硝基或亞硝基之
 氮原子取代的經基之碳原
 子 [5]
 271/22 • • • • 連接由羧基取代的經基之
 碳原子 [5]
 271/24 • • • • 至少一個胺基甲酸酯基之氮
 原子連接除六節芳環以外
 的環之碳原子 [5]
 271/26 • • • • 至少一個胺基甲酸酯基之氮
 原子連接六節芳環之碳原
 子 [5]
 271/28 • • • • 連接非稠合六節芳環之碳
 原子 [5]
 271/30 • • • • 連接稠環系之六節芳環的
 碳原子 [5]
 271/32 • • 胺基甲酸酯基之氧原子連接除
 六節芳環以外環之碳原子 [5]
 271/34 • • • 胺基甲酸酯基之氮原子連接
 氫原子或非環碳原子 [5]
 271/36 • • • • 至少一個胺基甲酸酯基之氮
 原子連接除六節芳環以外
 的環之碳原子 [5]
 271/38 • • • • 至少一個胺基甲酸酯基之氮
 原子連接六節芳環之碳原
 子 [5]
 271/40 • • 胺基甲酸酯基之氧原子連接六
 節芳環之碳原子 [5]
 271/42 • • • 胺基甲酸酯基之氮原子連接

氮原子或非環碳原子 [5]

271/44 連接氮原子或未取代的
基之碳原子 [5]

271/46 連接為氮原子或硝基或亞
硝基所取代之烷基的碳原
子 [5]

271/48 連接為單鍵氧原子所取代
之烷基的碳原子 [5]

271/50 連接為雙鍵氧原子所取代
之烷基的碳原子 [5]

271/52 連接為非硝基或亞硝基之
氮原子所取代之烷基的碳
原子 [5]

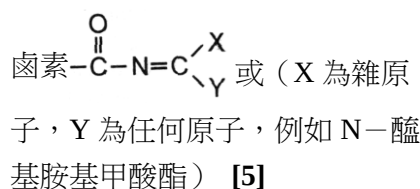
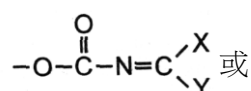
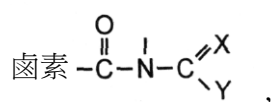
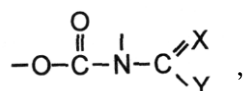
271/54 連接為羧基所取代之烷基
的碳原子 [5]

271/56 至少一個胺基甲酸酯基之氮
原子連接除六節芳環以外
之環的碳原子 [5]

271/58 至少一個胺基甲酸酯基之氮
原子連接六節芳環之碳原
子 [5]

271/60 . 胺基甲酸酯基之氧原子連接氮原
子 [5]

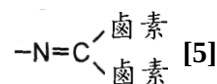
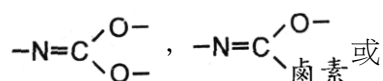
271/62 . 含有以下任何基團之化合物



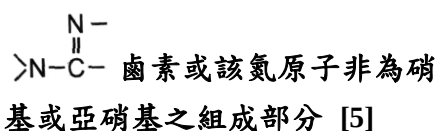
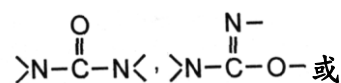
271/64 . . Y 為氮原子或碳原子, 例如,
苯甲醯基胺基甲酸酯 [5]

271/66 . . Y 為雜原子 [5]

271/68 . 含有以下任何基團之化合物



273/00 製備脲或其衍生物, 即, 含有以
下任何基團之化合物



273/02 . 脲, 其鹽, 錯合物或加成化合物
[5]

273/04 . . 由二氧化碳及胺 [5]

273/06 . . 由胺基脲或氰氨化鈣 [5]

273/08 . . 由氨水 [5]

273/10 . . 結合氨之合成 [5]

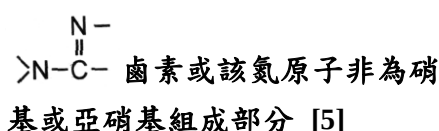
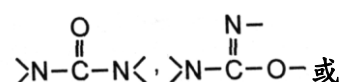
273/12 . . 結合三聚氰胺之合成 [5]

273/14 . . 分離; 純化; 穩定化; 使用添
加劑 [5]

273/16 . . . 分離; 純化 [5]

273/18 . 取代的脲 [5]

275/00 脲之衍生物, 即, 含有以下任何
基團之化合物



275/02 . 鹽; 錯合物; 加成化合物 [5]

275/04 . 脲基之氮原子連接非環碳原子
[5]

275/06 . . 無環和飽和碳架 [5]

275/08 . . . 碳架進一步為氮原子或硝基
或亞硝基所取代 [5]

275/10 . . . 進一步為單鍵氧原子所取代
[5]

275/12 . . . 進一步為雙鍵氧原子所取代
[5]

275/14 . . . 進一步為非硝基或亞硝基之
氮原子所取代 [5]

275/16 . . . 進一步為羧基所取代 [5]

275/18 . . 含環之飽和碳架 [5]

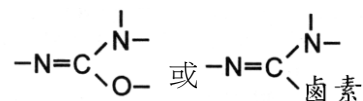
- 275/20 • • 不飽和碳架 [5]
- 275/22 • • • 含有除六節芳環以外之環 [5]
- 275/24 • • • 含六節芳環 [5]
- 275/26 • 脲基之氮原子連接除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 275/28 • 脲基之氮原子連接碳架的六節芳環碳原子 [5]
- 275/30 • • 碳架為鹵原子或硝基或亞硝基所取代 [5]
- 275/32 • • 為單鍵氧原子所取代 [5]
- 275/34 • • • 含有連接同一非稠合六節芳環之碳原子的脲基之氮原子及單鍵氧原子 [5]
- 275/36 • • • • 含進一步連接六節芳環之碳原子的至少一個氧原子，例如，N-芳氧基苯基脲 [5]
- 275/38 • • 碳架為雙鍵氧原子所取代 [5]
- 275/40 • • 進一步為非硝基或亞硝基之氮原子所取代 [5]
- 275/42 • • 進一步為羧基所取代 [5]
- 275/44 • 脲基之氮原子以雙鍵連接碳原子 [5]
- 275/46 • 含以下任何基團
- $$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}-\text{N}-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array} \quad \text{或}$$
- $$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}-\text{N}=\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}$$
- (X 為雜原子，Y 為任何原子)
例如，鹽基脲 [5]
- 275/48 • • Y 為氫或碳原子 [5]
- 275/50 • • • Y 為氫或非環碳原子 [5]
- 275/52 • • • Y 為除六節芳環以外之環的碳原子 [5]
- 275/54 • • • Y 為六節芳環之碳原子，例如苯甲鹽基脲 [5]
- 275/56 • • • X 為氮原子 [5]
- 275/58 • • Y 為雜原子 [5]
- 275/60 • • • Y 為氧原子，例如，脲基甲酸 [5]
- 275/62 • • • Y 為氮原子，例如，縮二脲 [5]
- 275/64 • 脲基之氮原子單鍵連接氧原子

[5]

- 275/66 • 脲基之氮原子連接鹵原子或硝基或亞硝基 [5]

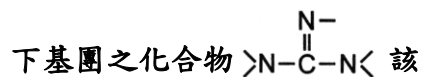
- 275/68 • • N-亞硝基脲 [5]

- 275/70 • 含有以下任何基團之化合物



或例如異脲 [5]

- 277/00 製備胍或其衍生物，即，含有以下基團之化合物



該單鍵氮原子非為硝基或亞硝基之氮原子 [5]

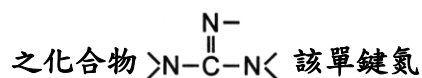
- 277/02 • 由氨脲，氰氨化鈣或二聚氨脲製備胍 [5]

- 277/04 • 由硫氰酸銨製備胍 [5]

- 277/06 • 胍之純化或分離 [5]

- 277/08 • 取代的胍 [5]

- 279/00 胍之衍生物，即，含有以下基團



該單鍵氮原子非為硝基或亞硝基之氮原子 [5]

- 279/02 • 胍；其鹽，錯合物或加成化合物 [5]

- 279/04 • 脲基之氮原子連接碳架上之非環碳原子 [5]

- 279/06 • • 進一步為鹵原子，或為硝基或亞硝基所取代 [5]

- 279/08 • • 進一步為單鍵氧原子所取代 [5]

- 279/10 • • 進一步為雙鍵氧原子所取代 [5]

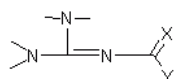
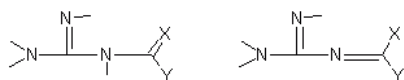
- 279/12 • • 進一步為非硝基或亞硝基之氮原子所取代 [5]

- 279/14 • • 進一步為羧基所取代 [5]

- 279/16 • 脲基之氮原子連接除六節芳環以外之環的碳原子 [5]

- 279/18 • 脲基之氮原子連接六節芳環的碳原子 [5]

- 279/20 • 含有以下任何基團



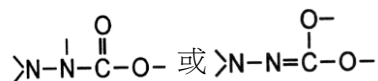
(X 為雜原子，Y 為任何原子)

例如，醯基胍 [5]

- 279/22 · · Y 為氫原子或碳原子，例如，
苯甲醯基胍 [5]
- 279/24 · · Y 為雜原子 [5]
- 279/26 · · · X 及 Y 為氮原子，例如，雙
胍 [5]
- 279/28 · 胍基之氮原子連接氰基，例如，
氰基胍，雙氰胺 [5]
- 279/30 · 胍基之氮原子連接硝基或亞硝基
[5]
- 279/32 · · N-硝基胍類 [5]
- 279/34 · · · N-硝基胍 [5]
- 279/36 · · · 取代的 N-硝基胍類 [5]

**281/00 含有包括於 269/00 至 279/00 目
內之官能基的碳酸之衍生物，其
中，至少該官能基之一個氮原子
連接另一個非硝基或亞硝基之
氮原子 [5]**

- 281/02 · 含有以下任何基團之化合物



例如，胍基甲酸酯 [5]

- 281/04 · · 其他氮原子進一步與碳原子雙
鍵連接 [5]
- 281/06 · 含有以下任何基團之化合物
-
- 281/08 · · 含有進一步與碳原子雙鍵連接
的其他氮原子，例如，半卡胍
[5]
- 281/10 · · · 碳原子進一步連接非環碳原
子或除六節芳環以外之環
的碳原子 [5]
- 281/12 · · · 碳原子是除六節芳環以外之
環的碳原子 [5]

- 281/14 · · · 碳原子進一步連接六節芳環
之碳原子 [5]

- 281/16 · 含有以下任何基團之化合物



例如，胺基胍 [5]

- 281/18 · · 含有進一步與碳原子雙鍵連接
的其他氮原子，例如，脒基脒
[5]
- 281/20 · 官能基之兩個氮原子相互雙鍵連
接，例如，偶氮甲醯胺 [5]
- 291/00 含有碳及氮原子與 201/00 至
281/00 目內不包括的官能基之
化合物 [5]**
- 291/02 · 含有氮氧化物鍵 [5]
- 291/04 · · 含有氮氧化物鍵 [5]
- 291/06 · · 腈氧化物 [5]
- 291/08 · · 氧化偶氮化合物 [5]
- 291/10 · 脒 [5]
- 291/12 · 雷酸鹽 [5]
- 291/14 · 含有至少一個連接硝基或亞硝基
且雙鍵連接雜原子之碳原子 [5]

**含碳同時含硫、硒或碲，含或不含
氫、鹵素、氧或氮之化合物 [5]**

301/00 亞硫酸酯 [5]

- 301/02 · 含有連接六節芳環之碳原子的亞
硫酸酯基團 [5]

**303/00 製備硫酸酯或硫酸醯胺；製備磺
酸或其酯，鹵化物，酞或醯胺 [5]**

- 303/02 · 磺酸或其鹵化物者 [5]
- 303/04 · · 用磺基或鹵磺基取代氮原子
[5]
- 303/06 · · · 與硫酸或三氧化硫反應 [5]
- 303/08 · · · 與鹵代磺酸反應 [5]
- 303/10 · · · 用二氧化硫及鹵素反應或與
磺醯鹵反應 [5]
- 303/12 · · · 與亞磺醯鹵化物反應 [5]
- 303/14 · · 利用磺化氧化作用，即用二氧
化硫及氧反應形成磺基或鹵
代磺醯基 [5]

- 303/16 • • 利用硫醇，硫化物，氫化多硫化物或多硫化物之氧化成磺基或鹵代磺基 [5]
- 303/18 • • 由硫化物與含有官能基之化合物反應形成磺基或鹵代磺基 [5]
- 303/20 • • 亞硫酸或其鹽與含有碳—碳重鍵之化合物加成 [5]
- 303/22 • • 由磺酸經不涉及形成磺基或鹵代磺基之反應 [5]
- 303/24 • 硫酸酯者 [5]
- 303/26 • 磺酸酯者 [5]
- 303/28 • • 利用羥基化合物與磺酸或其衍生物之反應 [5]
- 303/30 • • 由不涉及形成酯化磺基之反應 [5]
- 303/32 • 磺酸鹽者 [5]
- 303/34 • 硫酸鹽胺者 [5]
- 303/36 • 磺酸鹽胺者 [5]
- 303/38 • • 經氨或胺與磺酸，或其酯、酐、或鹵化物反應 [5]
- 303/40 • • 經不形成磺基胺基團之反應 [5]
- 303/42 • 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]
- 303/44 • • 分離；純化 [5]
- 303/46 • • • 由用硫酸精製的礦物油所得之副產物 [5]

305/00 硫酸酯 [5]

- 305/02 • 硫酸酯基之氧原子連接碳架之非環碳原子上 [5]
- 305/04 • • 無環飽和碳架 [5]
- 305/06 • • • 氫化硫酸酯 [5]
- 305/08 • • • 二烷基硫酸酯；取代的二烷基硫酸酯 [5]
- 305/10 • • • 碳架為單鍵氧原子所取代 [5]
- 305/12 • • 飽和含環碳架 [5]
- 305/14 • • 無環不飽和碳架 [5]
- 305/16 • • 不飽和含環碳架 [5]
- 305/18 • • • 含有六節芳環 [5]
- 305/20 • 硫酸酯基之氧原子連至除六節芳環以外之環之碳原子上 [5]
- 305/22 • 硫酸酯基之氧原子連至六節芳環

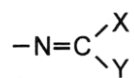
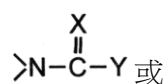
之碳原子上 [5]

- 305/24 • • 非稠合六節芳環 [5]
- 305/26 • 鹵代硫酸酯，例如，鹵代硫酸單酯 [5]
- 307/00 硫酸鹽胺，即，含有為非硝基或亞硝基之氮原子所取代的硫酸酯基之氧原子的化合物 [5]**
- 307/02 • 硫酸或其酯之單鹽胺，例如，胺基磺酸 [5]
- 307/04 • 硫酸二鹽胺 [5]
- 307/06 • • 胺基磺酸基之氮原子連至非環碳原子上 [5]
- 307/08 • • 胺基磺酸基之氮原子連至除六節芳環以外之環的碳原子上 [5]
- 307/10 • • 胺基磺酸基之氮原子連至六節芳環碳原子上 [5]

309/00 磺酸；其鹵化物，酯或酐 [5]

- 309/01 • 磺酸 [5]
- 309/02 • • 含有連接非環碳原子之磺基 [5]
- 309/03 • • • 無環飽和碳架者 [5]
- 309/04 • • • • 僅含有一個磺基 [5]
- 309/05 • • • • 至少含有兩個連接碳架之磺基 [5]
- 309/06 • • • • 含有連接碳架之鹵原子，或硝基或亞硝基 [5]
- 309/07 • • • • 含有連接碳架之氧原子 [5]
- 309/08 • • • • • 含有連接碳架之羥基 [5]
- 309/09 • • • • • 含有連接碳架之醚化的羥基 [5]
- 309/10 • • • • • 至少一個醚化的羥基之氧原子連接一個非環碳原子 [5]
- 309/11 • • • • • 至少一個醚化的羥基之氧原子連接六節芳環之碳原子 [5]
- 309/12 • • • • • 含有連接碳架之酯化的羥基 [5]
- 309/13 • • • • • 含有連接碳架之非硝基或亞硝基之氮原子 [5]
- 309/14 • • • • • 含有連接碳架之胺基 [5]

309/15 以下任何基團之至少一個胺基的氮原子



(X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]

309/16 含有連接碳架之雙鍵氮原子 [5]

309/17 含有連接碳架之羧基 [5]

309/18 含有連接同一碳架之胺基 [5]

309/19 飽和含環碳架者 [5]

309/20 無環不飽和碳架者 [5]

309/21 含有連接碳架之非硝基或亞硝基之氮原子 [5]

309/22 含有連接碳架之羧基 [5]

309/23 含有除六節芳環以外之環的不飽和碳架者 [5]

309/24 含有六節芳環之碳架者 [5]

309/25 含有連接碳架上除六節芳環以外之環的碳原子上之磺基 [5]

309/26 含有連接至碳架上之非硝基或亞硝基氮原子 [5]

309/27 含有連接碳架之羧基 [5]

309/28 含有連接碳架之六節芳環碳原子的磺基 [5]

309/29 非稠合六節芳環者 [5]

309/30 為烷基所取代之六節芳環 [5]

309/31 烷基含有至少三個碳原子 [5]

309/32 於碳架上含有至少兩個非稠合六節芳環 [5]

309/33 稠環系之六節芳環者 [5]

309/34 由兩個環形成 [5]

309/35 萘磺酸 [5]

309/36 為烷基所取代 [5]

309/37 至少含有三個碳原子之烷基 [5]

309/38 由至少三個環形成 [5]

309/39 含有連接碳架之鹵原子 [5]

309/40 含有連接碳架之硝基或亞硝基 [5]

309/41 含有連接碳架之單鍵氧原子 [5]

309/42 含有連接非稠合六節芳環碳原子之磺基 [5]

309/43 含有連接稠環系之六節芳環碳原子的至少一個磺基 [5]

309/44 含有連接碳架之雙鍵氧原子 [5]

309/45 含有連接碳架之非硝基或亞硝基的氮原子 [5]

309/46 含有連接非稠合六節芳環碳原子之磺基 [5]

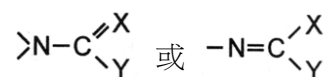
309/47 含有至少一個連接稠環系之六節芳環的碳原子之磺基 [5]

309/48 碳架為鹵原子所取代 [5]

309/49 碳架為單鍵氧原子所取代 [5]

309/50 含有至少一個連接稠環系之六節芳環的碳原子之磺基 [5]

309/51 含有至少一個如下任何基團之氮原子

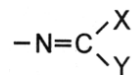
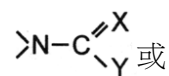


(X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]

309/52 碳架為雙鍵氧原子所取代 [5]

309/53 含有苯醌環碳原子之碳架 [5]

309/54 含有至少一個如下任何基團之氮原子



(X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]

309/55 Y 是氫或碳原子
 309/56 Y 為雜原子 [5]
 309/57 . . . 含有連接碳架之羧基 [5]
 309/58 羧酸基或酯 [5]
 309/59 羧基之氮類似物 [5]
 309/60 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
 309/61 碳架進一步為非硝基或亞硝基之氮原子所取代 [5]
 309/62 . . 未確定結構的磺化脂肪，油或石蠟 [5]
 309/63 . 磺酸酯 [5]
 309/64 . . 酯化磺基之硫原子連接非環碳原子 [5]
 309/65 . . . 飽和碳架者 [5]
 309/66 甲磺酸酯 [5]
 309/67 . . . 不飽和碳架者 [5]
 309/68 . . . 碳架為單鍵氧原子所取代者 [5]
 309/69 . . . 碳架為非硝基或亞硝基之氮原子所取代者 [5]
 309/70 . . . 碳架為羧基所取代者 [5]
 309/71 . . 有酯化的磺基之硫原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
 309/72 . . 有酯化的磺基之硫原子連至碳架之六節芳環碳原子上 [5]
 309/73 . . . 連至非稠合六節芳環之碳原子上 [5]
 309/74 . . . 連至稠環體系之六節芳環的碳原子上 [5]
 309/75 . . . 含連至碳架上之單鍵氧原子 [5]
 309/76 . . . 含連至碳架上之非硝基或亞硝基之氮原子 [5]
 309/77 . . . 含連至碳架上之羧基 [5]
 309/78 . 磺醯鹵化物 [5]
 309/79 . . 有連至非環碳原子上之磺醯鹵基 [5]
 309/80 . . . 飽和碳架者 [5]
 309/81 . . . 不飽和碳架者 [5]
 309/82 . . . 為單鍵氧原子所取代之碳架

者 [5]

309/83 . . . 為非硝基或亞硝基之氮原子所取代之碳架者 [5]
 309/84 . . . 為羧基所取代之碳架者 [5]
 309/85 . . 有連至六節芳環以外其他環碳原子上之磺醯鹵基 [5]
 309/86 . . 有連至碳架之六節芳環碳原子上的磺醯鹵基 [5]
 309/87 . . . 含連至碳架上之單鍵氧原子 [5]
 309/88 . . . 含連至碳架上之非硝基或亞硝基的氮原子 [5]
 309/89 . . . 含連至碳架上之羧基 [5]
311/00 磺醯胺，即磺基之單鍵氧原子為非硝基或亞硝基之氮原子所取代的化合物 [5]
 311/01 . 磺醯胺基之硫原子連至非環碳原子上之磺醯胺 [5]
 311/02 . . 無環飽和碳架者 [5]
 311/03 . . . 有磺醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
 311/04 連至為單鍵氧原子所取代之氫基的非環碳原子上 [5]
 311/05 連至為氮原子所取代之氫基的非環碳原子上，該氮原子非為硝基或亞硝基之部分 [5]
 311/06 連至為羧基所取代之氫基的非環碳原子上 [5]
 311/07 . . . 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環以外之其他環碳原子上 [5]
 311/08 . . . 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
 311/09 . . . 碳架進一步為至少兩個鹵原子所取代 [5]
 311/10 . . 含環飽和碳架者 [5]
 311/11 . . 無環不飽和碳架者 [5]
 311/12 . . 含環不飽和碳架者 [5]
 311/13 . . . 含六節芳環碳架 [5]

- 311/14 • 磺醯胺基之硫原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上之磺醯胺 [5]
- 311/15 • 磺醯胺基之硫原子連至六節芳環碳原子上之磺醯胺 [5]
- 311/16 • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 311/17 • • • 連至為單鍵氧原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 311/18 • • • 連至為非硝基或亞硝基之氮原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 311/19 • • • 連至為羧基所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 311/20 • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環以外的其他環的碳原子上 [5]
- 311/21 • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 311/22 • 磺醯胺，其酸部分之碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
- 311/23 • • 有磺醯胺基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 311/24 • • • 無環飽和碳架者 [5]
- 311/25 • • • 含環飽和碳架者 [5]
- 311/26 • • • 無環不飽和碳架者 [5]
- 311/27 • • • 含環不飽和碳架者 [5]
- 311/28 • • 有至少一個磺醯胺基之硫原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 311/29 • • 有至少一個磺醯胺基之硫原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 311/30 • 磺醯胺，其酸部分之碳架進一步為非硝基或亞硝基之單鍵氮原子所取代 [5]
- 311/31 • • 有磺醯胺基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 311/32 • • • 無環飽和碳架者 [5]
- 311/33 • • • 含環飽和碳架 [5]
- 311/34 • • • 無環不飽和碳架者 [5]
- 311/35 • • • 含環不飽和碳架者 [5]
- 311/36 • • 有至少一個磺醯胺基之硫原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 311/37 • • 有至少一個磺醯胺基之硫原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 311/38 • • • 有磺醯胺基之硫原子及胺基連至同一碳架之六節芳環碳原子上 [5]
- 311/39 • • • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]
- 311/40 • • • • • 連至為單鍵氧原子所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 311/41 • • • • • 連至為非硝基或亞硝基之氮原子所取代之烴基之非環碳原子上 [5]
- 311/42 • • • • • 連至為羧基所取代之烴基的非環碳原子上 [5]
- 311/43 • • • • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 311/44 • • • • • 有至少一個磺醯胺基之氮原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 311/45 • • 至少一個單鍵氮原子為

$$>N-C \begin{array}{l} \nearrow X \\ \searrow Y \end{array} \text{ 或 } -N=C \begin{array}{l} \nearrow X \\ \searrow Y \end{array}$$
中之任何一個，(X 係雜原子，Y 係任何原子)，例如 N-醯胺基磺醯胺 [5]
- 311/46 • • • Y 係氫或碳原子 [5]
- 311/47 • • • Y 係雜原子 [5]
- 311/48 • 有磺醯胺基之氮原子進一步連至其他雜原子上 [5]
- 311/49 • • 氮原子上 [5]
- 311/50 • 含 $\begin{array}{c} \text{I} \\ | \\ >C-SO_2-N-C \begin{array}{l} \nearrow X \\ \searrow Y \end{array} \end{array}$ 或

$$>C-SO_2-N=C \begin{array}{l} \nearrow X \\ \searrow Y \end{array}$$
中任何基團之化合物 (X 為雜原子，Y 為任何原子) [5]
- 311/51 • • Y 為氫或碳原子 [5]

- 311/52 · · Y 為雜原子 [5]
 311/53 · · · X 及 Y 非為氮原子，例如 N—磺醯基胺基甲酸 [5]
 311/54 · · · X 或 Y 為氮原子，惟兩者均非為氮原子，例如 N—磺醯基脒 [5]
 311/55 · · · · 有磺醯脒基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
 311/56 · · · · 有磺醯脒基之硫原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
 311/57 · · · · 有磺醯脒基之硫原子連至六節芳環之硫原子上 [5]
 311/58 · · · · · 有磺醯脒基之氮原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]
 311/59 · · · · · 有磺醯脒基之氮原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
 311/60 · · · · · 有磺醯脒基之氮原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
 311/61 · · · · · 有磺醯脒基之氮原子進一步連至其他雜原子上 [5]
 311/62 · · · · · 有磺醯脒基之氮原子進一步被醯化 [5]
 311/63 · · · · · N—磺醯基異脒 [5]
 311/64 · · · X 及 Y 為氮原子，例如 N—磺醯基胍 [5]
 311/65 · N—磺醯基異氰酸酯 [5]

313/00 亞磺酸；次磺酸；此等之醯鹵酯及酸酐；亞磺酸或次磺酸之醯胺，即亞磺酸或次磺酸或次磺酸基之單鍵氧原子為非硝基或亞硝基之氮原子所取代之化合物 [5]

- 313/02 · 亞磺酸；其衍生物 [5]
 313/04 · · 亞磺酸；其酯 [5]
 313/06 · · 亞磺醯胺 [5]
 313/08 · 次磺酸；其衍生物 [5]
 313/10 · · 次磺酸；其酯 [5]

- 313/12 · · · 有次磺酸基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
 313/14 · · · 有次磺酸基之硫原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
 313/16 · · · 有次磺酸基之硫原子連至六節芳環碳原子上 [5]
 313/18 · · 次磺醯胺 [5]
 313/20 · · · 有次磺醯胺基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
 313/22 · · · 有次磺醯胺基之硫原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
 313/24 · · · 有次磺醯胺基之硫原子連至六節芳環的碳原子上 [5]

313/26 · · · 含 $\begin{array}{c} \text{X} \\ | \\ \text{>C-S-N-C-Y} \end{array}$ 或 $\begin{array}{c} \text{X} \\ | \\ \text{>C-S-N=C-Y} \end{array}$ 基團中任何一個之化合物 (X 為雜原子，Y 為任何原子) [5]

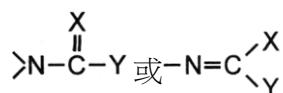
- 313/28 · · · · Y 為氮原子或碳原子 [5]
 313/30 · · · · Y 為雜原子 [5]
 313/32 · · · · · X 及 Y 非為氮原子，例如 N—次磺醯基胺基甲酸 [5]
 313/34 · · · · · X 或 Y 為氮原子，惟兩者均非為氮原子，例如 N—次磺醯脒 [5]
 313/36 · · · 有次磺醯胺基之氮原子進一步連至其他雜原子上 [5]
 313/38 · · · N—次磺醯基異氰酸酯 [5]

315/00 碲之製備；亞碲之製備 [5]

- 315/02 · 用氧化硫醚之方法形成碲或亞碲，或用氧化亞碲之方法形成碲 [5]
 315/04 · 用不涉及碲或亞碲基形成之反應 [5]
 315/06 · 分離；純化；穩定化；添加劑之使用 [5]

317/00 碲；亞碲 [5]

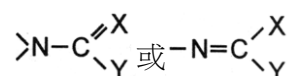
- 317/02 • 有砷基或亞砷基連至非環碳原子 [5]
- 317/04 • • 無環飽和碳架者 [5]
- 317/06 • • 含環飽和碳架者 [5]
- 317/08 • • 無環不飽和碳架者 [5]
- 317/10 • • 含環不飽和碳架者 [5]
- 317/12 • 有砷基或亞砷基連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 317/14 • 有砷基或亞砷基連至六節芳環之碳原子 [5]
- 317/16 • 有砷基或亞砷基及單鍵氧原子連至同一碳架上 [5]
- 317/18 • • 砷基或亞砷基連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 317/20 • • 砷基或亞砷基連至碳架之六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 317/22 • • 砷基或亞砷基連至碳架之六節芳環碳原子上 [5]
- 317/24 • 有砷基或亞砷基及雙鍵氧原子連至同一碳架上 [5]
- 317/26 • 有砷基或亞砷基及非硝基或亞硝基之氮原子連至同一碳架上 [5]
- 317/28 • • 有砷基或亞砷基連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 317/30 • • 砷基或亞砷基連至碳架之六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 317/32 • • 砷基或亞砷基連至碳架之六節芳環碳原子上 [5]
- 317/34 • • • 有砷基或亞砷基及胺基連至含六節芳環之同一稠環系或非稠環系六節芳環之碳原子上 [5]
- 317/36 • • • • 胺基之氮原子連至氮原子或碳原子上 [5]
- 317/38 • • • • 至少一個胺基之氮原子為基團



中之任何一個之組成部分
(X 為雜原子, Y 係任何

原子), 例如 N-醯胺基砷 [5]

- 317/40 • • • • • Y 為氮原子或碳原子 [5]
- 317/42 • • • • • Y 為雜原子 [5]
- 317/44 • 有砷基或亞砷基及羧基連至同一碳架上 [5]
- 317/46 • • 碳架進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
- 317/48 • • 碳架進一步為單鍵氮原子所取代, 該氮原子並非硝基或亞硝基之組成部分 [5]
- 317/50 • • • 至少一個氮原子為基團



中之任何一個之組成部分
(X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]

319/00 硫醇, 硫醚, 氫化多硫化物或多硫化物之製備 [5]

- 319/02 • 硫醇者 [5]
- 319/04 • • 利用硫化氫或其鹽對不飽和化合物之加成反應 [5]
- 319/06 • • 由硫醚, 氫化多硫化物或多硫化物 [5]
- 319/08 • • 利用取代羥基或醚化的或酯化的羥基 [5]
- 319/10 • • • 利用取代連至六節芳環碳原子上之羥基或醚化的或酯化的羥基 [5]
- 319/12 • • 利用不涉及形成巰基之反應 [5]
- 319/14 • 硫醚者 [5]
- 319/16 • • 利用硫化氫或其鹽對不飽和化合物之加成反應 [5]
- 319/18 • • 利用硫醇對不飽和化合物之加成反應 [5]
- 319/20 • • 利用應不涉及形成硫醚基團之反應 [5]
- 319/22 • 氫化多硫化物或多硫化物者 [5]
- 319/24 • • 利用形成硫-硫鍵之反應 [5]
- 319/26 • 分離; 純化, 穩定化; 添加劑之使用 [5]
- 319/28 • • 分離; 純化 [5]

319/30 . . . 由精煉的礦物油之副產品中
[5]

**321/00 硫醇，硫醚，氫化多硫化物或多
硫化物 [5]**

321/02 . 巯基連至非環碳原子上之硫醇
[5]

321/04 . . 無環飽和碳架者 [5]

321/06 . . 含環飽和碳架者 [5]

321/08 . . 無環不飽和碳架者 [5]

321/10 . . 含環不飽和碳架者 [5]

321/12 . 硫代基連至非環碳原子上之硫
醚，氫化多硫化物或多硫化物
[5]

321/14 . . 無環飽和碳架者 [5]

321/16 . . 含環飽和碳架者 [5]

321/18 . . 無環不飽和碳架者 [5]

321/20 . . 含環不飽和碳架者 [5]

321/22 . 硫代基連至六節芳環以外之其他
環的碳原子上之硫醇，硫醚，氫
化多硫化物或多硫化物 [5]

321/24 . 硫代基連至六節芳環碳原子上之
硫醇，硫醚，氫化多硫化物或多
硫化物 [5]

321/26 . . 硫醇 [5]

321/28 . . 硫代基連至六節芳環碳原子上
之硫醚，氫多硫化物或多硫化
物 [5]

321/30 . . . 至少一個硫代基之硫原子連
至六節芳環之兩個碳原子
上的硫醚 [5]

**323/00 為鹵素，氧或氮原子或非硫代基
硫原子所取代的硫醇，硫醚，氫
化多硫化物或多硫化物 [5]**

323/01 . 硫代基及鹵原子，或硝基或亞硝
基連至同一碳架上 [5]

323/02 . . 有硫代基之硫原子連至碳架之
非環碳原子上 [5]

323/03 . . . 碳架係無環者及飽和者 [5]

323/04 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]

323/05 . . . 碳架係無環者及不飽和者[5]

323/06 . . . 碳架係不飽和者，並且含六

節芳環以外其他環者 [5]

323/07 . . . 碳架含六節芳環 [5]

323/08 . . 有硫代基之硫原子連至碳架之
六節芳環以外的其他環之
碳原子上 [5]

323/09 . . 有硫代基之硫原子連至碳架的
六節芳環之碳原子上 [5]

323/10 . 含硫代基及連至同一碳架上之單
鍵氧原子 [5]

323/11 . . 有硫代基硫原子連至碳架之非
環碳原子上 [5]

323/12 . . . 碳架係無環者及飽和者 [5]

323/13 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]

323/14 . . . 碳架係無環者及不飽和者[5]

323/15 . . . 碳架係不飽和者及含六節芳
環以外之其他環者 [5]

323/16 . . . 碳架含六節芳環 [5]

323/17 . . 有至少一個硫代基之硫原子連
至碳架之六節芳環以外的其
他環之碳原子上 [5]

323/18 . . 有至少一個硫代基之硫原子連
至碳架之六節芳環之碳原子
上 [5]

323/19 . . . 單鍵氧原子連至碳架之非環
碳原子上 [5]

323/20 . . . 單鍵氧原子連至同一非稠合
六節芳環之碳原子上 [5]

323/21 . . . 硫代基之硫原子連至稠環系
的六節芳環之碳原子上 [5]

323/22 . 硫代基及雙鍵氧原子連至同一碳
架上 [5]

323/23 . 硫代基及非硝基或亞硝基氮原子
連至同一碳架上 [5]

323/24 . . 有硫代基之硫原子連至碳架之
非環碳原子上 [5]

323/25 . . . 碳架係無環者及飽和者 [5]

323/26 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]

323/27 . . . 碳架係無環者及不飽和者[5]

323/28 . . . 碳架係不飽和者及含六節芳
環以外之其他環者 [5]

323/29 . . . 碳架含六節芳環 [5]

323/30 . . 有至少一個硫代基之硫原子連

- 至碳架的六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]
- 323/31 . . . 有至少一個硫代基之硫原子連至碳架的六節芳環碳原子上 [5]
- 323/32 . . . 有至少一個氮原子連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 323/33 . . . 有至少一個氮原子連至同一非稠合六節芳環之碳原子上 [5]
- 323/34 硫代基係巯基 [5]
- 323/35 硫代基係硫醚基 [5]
- 323/36 硫醚基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 323/37 硫醚基之硫原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 323/38 . . . 硫代基之硫原子連至稠環系之六節芳環之碳原子上 [5]
- 323/39 . . 至少一個氮原子係 $\begin{array}{c} \text{X} \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}-\text{Y} \end{array}$ 或 $\begin{array}{c} \text{X} \\ \diagup \\ -\text{N}=\text{C} \\ \diagdown \\ \text{Y} \end{array}$ 中任何一個基團之組成部分 (X 係雜原子, Y 係任何原子) [5]
- 323/40 Y 係氫或碳原子 [5]
- 323/41 Y 係氫或非環碳原子 [5]
- 323/42 Y 係六節芳環之碳原子 [5]
- 323/43 Y 係雜原子 [5]
- 323/44 X 或 Y 係氮原子 [5]
- 323/45 . . 有至少一個氮原子以雙鍵連至碳架上 [5]
- 323/46 . . 有至少一個非硝基或亞硝基之氮原子進一步連至其他雜原子上 [5]
- 323/47 . . . 氧原子上 [5]
- 323/48 . . . 氮原子上 [5]
- 323/49 . . . 硫原子上 [5]
- 323/50 . 硫代基及羧基連至同一碳架上 [5]
- 323/51 . . 有硫代基之硫原子連至碳架之非環碳原子上 [5]
- 323/52 . . . 碳架係無環者及飽和者 [5]
- 323/53 . . . 碳架係飽和者及含環者 [5]
- 323/54 . . . 碳架係無環者及不飽和者 [5]
- 323/55 . . . 碳架係不飽和者及含六節芳環以外之其他環者 [5]
- 323/56 . . . 碳架含六節芳環 [5]
- 323/57 . . . 碳架進一步為非硝基或亞硝基氮原子所取代 [5]
- 323/58 胺基連至碳架上 [5]
- 323/59 醯化之胺基連至碳架上 [5]
- 323/60 . . . 至少一個羧基之碳原子連至氮原子上 [5]
- 323/61 . . 有至少一個硫代基之硫原子連至碳架之六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 323/62 . . 有至少一個硫代基之硫原子連至碳架的六節芳環之碳原子上 [5]
- 323/63 . . . 碳架進一步為非硝基或亞硝基之氮原子所取代 [5]
- 323/64 . 硫代基及非硫代基之硫原子連至同一碳架上 [5]
- 323/65 . . 磺基或亞磺基之硫原子連至碳架上 [5]
- 323/66 . . 磺基, 酯化之磺基或磺醯鹵基的硫原子連至碳架上 [5]
- 323/67 . . 磺醯胺基之硫原子連至碳架上 [5]
- 325/00 硫醛; 硫酮; 硫醯; 此等之氧化物 [5]**
- 325/02 . 硫酮; 其氧化物 [5]
- 325/04 . 硫醯; 其氧化物 [5]
- 327/00 硫代羧酸 [5]**
- 327/02 . 一硫代羧酸 [5]
- 327/04 . . 有硫代羧基之硫原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]
- 327/06 . . . 氮原子或無環飽和碳架之碳原子上 [5]
- 327/08 . . . 含環之飽和碳架的碳原子上 [5]
- 327/10 . . . 無環不飽和碳架之碳原子上 [5]

- 327/12 . . . 含環不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 327/14 . . 有硫代羧基之碳原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 327/16 . . 有硫代羧基之碳原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 327/18 . 二硫代羧酸 [5]
- 327/20 . 一硫代羧酸之酯 [5]
- 327/22 . . 有酯化的硫代羧基之碳原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]
- 327/24 . . 有酯化的硫化羧基之碳原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 327/26 . . 有酯化的硫代羧基之碳原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 327/28 . . 有酯化的硫代羧基之硫原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 327/30 . . 有酯化的硫代羧基之硫原子連至為非硝基及亞硝基氮原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 327/32 . . 有酯化的硫代羧基之硫原子連至為羧基所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 327/34 . . . 有胺基連至同一烴基上 [5]
- 327/36 . 二硫代羧酸之酯 [5]
- 327/38 . 硫代羧酸之醯胺 [5]
- 327/40 . . 有硫代羧酸醯胺基之碳原子連至氮原子或非環碳原子上 [5]
- 327/42 . . . 氮原子或飽和碳架之碳原子上 [5]
- 327/44 . . . 不飽和碳架之碳原子上 [5]
- 327/46 . . 有硫代羧酸醯胺基之碳原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 327/48 . . 有硫代羧酸醯胺基之碳原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 327/50 . . 含 $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{N}-\text{C}-\text{Y} \end{array}$ 或 $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{N}=\text{C} \end{array} \begin{array}{l} \text{X} \\ \diagup \\ \text{Y} \end{array}$ 基團中任何一個之化合物 (X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]

- 327/52 . . . Y 為氮或碳原子 [5]
- 327/54 . . . Y 為雜原子 [5]
- 327/56 . . 有硫代羧酸醯胺基之氮原子進一步連至其他雜原子上 [5]
- 327/58 . 硫代羧酸之衍生物, 雙鍵氧原子為氮原子所取代, 例如亞胺基硫代醚 [5]
- 327/60 . 硫代羧基之硫原子進一步以雙鍵連至氧原子上之硫代羧酸 [5]

329/00 硫代碳酸; 其醯鹵, 酯或酸酐 [5]

- 329/02 . 一硫代碳酸; 其衍生物 [5]
- 329/04 . . 一硫代碳酸之酯 [5]
- 329/06 . . . 有硫代碳酸基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 329/08 . . . 有硫代碳酸基之硫原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 329/10 . . . 有硫代碳酸基之硫原子連至六節芳環的碳原子上 [5]
- 329/12 . 二硫代碳酸; 其衍生物 [5]
- 329/14 . . 二硫代碳酸之酯 [5]
- 329/16 . . . 有二硫代碳酸基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 329/18 . . . 有二硫代碳酸基之硫原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
- 329/20 . . . 有二硫代碳酸基之硫原子連至六節芳環的碳原子上 [5]

331/00 硫氰酸或異硫氰酸之衍生物 [5]

- 331/02 . 硫氰酸酯 [5]
- 331/04 . . 有硫氰酸酯基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
- 331/06 . . 有硫氰酸酯基之硫原子連至六節芳環以外的其他環碳原子上 [5]
- 331/08 . . 有硫氰酸酯基之硫原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
- 331/10 . . 有硫氰酸酯基之硫原子連至為單鍵氧原子所取代之烴基的碳原子上 [5]
- 331/12 . . 有硫氰酸酯基之硫原子連至為氮原子所取代之烴基的碳原

子上，該氮原子並非硝基及亞硝基之部分 [5]

331/14 • • 有硫氰酸酯基之硫原子連至為羧基所取代之烴基的碳原子上 [5]

331/16 • 異硫氰酸酯 [5]

331/18 • • 有異硫氰酸酯基連至非環碳原子上 [5]

331/20 • • • 飽和碳架者 [5]

331/22 • • • 不飽和碳架者 [5]

331/24 • • • • 含六節芳環之碳架 [5]

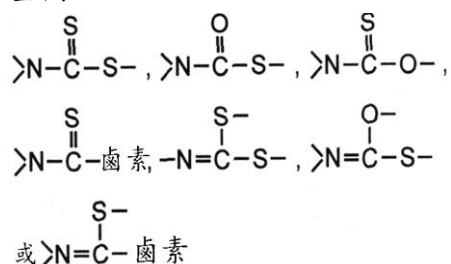
331/26 • • 有異硫氰酸酯基連至六節芳環以外之其他環碳原子上 [5]

331/28 • • 有異硫氰酸酯基連至六節芳環之碳原子上 [5]

331/30 • • 含至少兩個連至同一碳架上之異硫氰酸酯基 [5]

331/32 • • 有被醯化的異硫氰酸酯基 [5]

333/00 硫代胺基甲酸衍生物，即含下列基團



中任何一個之化合物（其中的氮原子並非硝基或亞硝基之組成部分）[5]

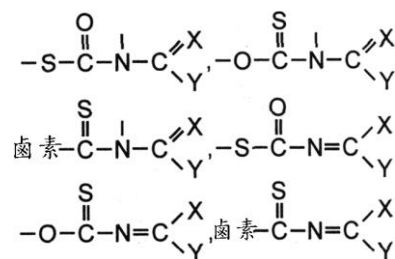
333/02 • 一硫代胺基甲酸；其衍生物 [5]

333/04 • • 有硫代胺基甲酸基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]

333/06 • • 有硫代胺基甲酸基之氮原子連至六節芳環以外之其他環的碳原子上 [5]

333/08 • • 有硫代胺基甲酸基之氮原子連至六節芳環的碳原子上 [5]

333/10 • • 硫代胺基甲酸基之氮原子係



中任何一個基團之組成部分

（X 為雜原子，Y 為任何原子），例如，N-醯基-硫代胺基甲酸酯 [5]

333/12 • • 有硫代胺基甲酸基之氮原子連至其他雜原子上 [5]

333/14 • 二硫代胺基甲酸；其衍生物 [5]

333/16 • • 二硫代胺基甲酸鹽 [5]

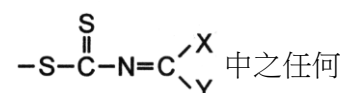
333/18 • • 二硫代胺基甲酸酯 [5]

333/20 • • • 有二硫代胺基甲酸酯基之氮原子連至氫原子或非環碳原子上 [5]

333/22 • • • 有二硫代胺基甲酸酯基之氮原子連至六節芳環以外的其他環碳原子上 [5]

333/24 • • • 有二硫代胺基甲酸酯基之氮原子連至六節芳環的碳原子上 [5]

333/26 • • • 含基團 $-\text{S}-\overset{\text{S}}{\overset{\parallel}{\text{C}}}-\text{N}-\overset{\text{X}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{Y}$ 或



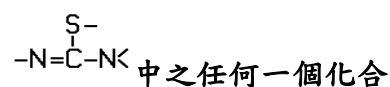
一個（X 為雜原子，Y 為任何原子），例如，N-醯基二硫代胺基甲酸酯 [5]

333/28 • • • 有二硫代胺基甲酸酯基之氮原子連至他其雜原子上 [5]

333/30 • • 有二硫代胺基甲酸基之硫原子連至其他硫原子上 [5]

333/32 • • • 硫代秋蘭姆；多硫代秋蘭姆 [5]

335/00 硫脲，即含下列基團 $\text{>N}-\overset{\text{S}}{\overset{\parallel}{\text{C}}}-\text{N}<$ 或



物，其中氮原子並非硝基或亞硝

基之組成部分 [5]

- 335/02 • 硫脲 [5]
 335/04 • 硫脲之衍生物 [5]
 335/06 • 有硫脲基之氮原子連至非環碳原子上 [5]
 335/08 • • • 飽和碳架者 [5]
 335/10 • • • 不飽和碳架者 [5]
 335/12 • • • • 含六節芳環之碳架 [5]
 335/14 • 有硫脲基之氮原子連至六節芳環以外的其他環之碳原子上 [5]
 335/16 • 有硫脲基之氮原子連至碳架的六節芳環之碳原子上 [5]
 335/18 • • • 進一步為單鍵氧原子所取代 [5]
 335/20 • • • 進一步為非硝基或亞硝基氮原子所取代 [5]
 335/22 • • • 進一步為羧基所取代 [5]
 335/24 • • 含基團 $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}-\text{N}-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}$ 或 $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}-\text{N}=\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}$ 中之任何一個 (X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]
 335/26 • • • Y 為氫或碳原子, 例如苯甲醯基硫脲 [5]
 335/28 • • • Y 為雜原子, 例如硫代縮二脲 [5]
 335/30 • 異硫脲 [5]
 335/32 • 有異硫脲基之硫原子連至非環碳原子上 [5]
 335/34 • 有異脲基之硫原子連至六節芳環以外的其他環碳原子上 [5]
 335/36 • 有異硫脲基之硫原子連至六節芳環之碳原子上 [5]
 335/38 • • 含基團 $\begin{array}{c} \text{S}- \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{C}=\text{N}-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}, \begin{array}{c} \text{S}- \\ \parallel \\ -\text{N}=\text{C}-\text{N}-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}$ 或 $\begin{array}{c} \text{S}- \\ \parallel \\ -\text{N}=\text{C}-\text{N}=\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{X} \\ \searrow \text{Y} \end{array} \end{array}$ 中之任何一個 (X 為雜原子, Y 為任何原子) [5]
 335/40 • 有硫脲基或異硫脲基之氮原子進

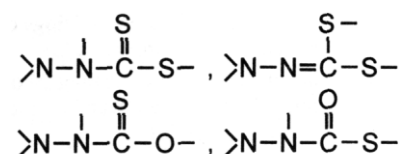
一步連至其他雜原子上 [5]

335/42 • • 磺醯基硫脲; 磺醯基異硫脲 [5]

335/44 • • 亞磺醯基硫脲; 亞磺醯基異硫脲 [5]

337/00 含 333/00 或 335/00 目所包括的官能基之硫代碳酸的衍生物, 其中此等官能基之至少一個氮原子進一步連至另一氮原子上, 該氧原子並非硝基或亞硝基的組成部分 [5]

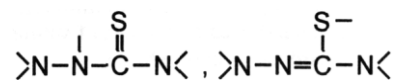
337/02 • 含基團



或 $\begin{array}{c} \text{S}- \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{N}=\text{C}-\text{O}- \end{array}$ 中之任何一個, 例如 thiocarbazates

337/04 • • 其他氮原子進一步以雙鍵連至碳原子上 [5]

337/06 • 含基團



或 $\begin{array}{c} \text{S}- \\ \parallel \\ >\text{N}-\text{N}-\text{C}=\text{N} < \end{array}$ 中之任何一個化合物, 例如, 胺基硫脲 [5]

337/08 • • 其他氮原子進一步以雙鍵連至碳原子上, 例如縮胺基硫脲 [5]

337/10 • 官能基之兩個氮原子相互以雙鍵相連 [5]

381/00 含碳及硫之化合物且不包括於 301/00 至 337/00 目內之官能基 [5]

381/02 • 硫代硫酸酯 [5]

381/04 • 硫代磺酸酯 [5]

381/06 • 含僅連至兩個氮原子上硫原子化合物 [5]

381/08 • • 有至少一個醯化之氮原子 [5]

381/10 • 含以雙鍵連至氮原子上之硫原子的化合物 [5]

381/12 • 銻化物 [5]

381/14 · 含四個價鍵連至雜原子上之碳原子的化合物，其中以雙鍵連至一個雜原子上，且至少有一個鍵連至硫原子上，該硫原子進一步以雙鍵連至氧原子上 [5]

391/00 含硒之化合物 [5]

391/02 · 有連至六節芳環碳原子上之硒原子 [5]

395/00 含碲之化合物 [5]

401/00 膽固醇或其衍生物之輻射產物；維生素 D 之衍生物，9,10 斷一環戊二烯並 [a]菲或不經輻射由化學方法而得的類似物 [5]

403/00 環己烷或環己烯之衍生物，有含至少四個碳原子之非環不飽和側鏈部分，該部分直接連至環己烷或環己烯之環上，例如維生素 A， β -胡蘿蔔素， β -芷香酮 [5]

403/02 · 有僅含碳及氫原子之側鏈 [5]

403/04 · 有為鹵原子所取代之側鏈 [5]

403/06 · 有為單鍵氧原子所取代之側鏈 [5]

403/08 · · 為經基取代者 [5]

403/10 · · 為經醚化的經基取代者 [5]

403/12 · · 為經酯化的經基取代者 [5]

403/14 · 有為雙鍵氧原子所取代之側鏈 [5]

403/16 · · 非為-CHO 部分 [5]

403/18 · 有為氮原子所取代之側鏈 [5]

403/20 · 有為羧基所取代之側鏈 [5]

403/22 · 有為硫原子所取代之側鏈 [5]

403/24 · 有為六節非芳香環所取代之側鏈，例如 β -胡蘿蔔素 [5]

405/00 含五節環之化合物，有兩個側鏈彼此處於鄰位，有氧原子直接連至一個側鏈鄰位之環上，一個側鏈含有非為直接連至環上之碳原子，該碳原子有三個鍵連至雜

原子上，同時最多一個鍵連至鹵素，並且另一個側鏈有連至環上 γ 位之氧原子，例如前列腺素 [5]

407/00 過氧化物之製備 [5]

409/00 過氧化物 [5]

409/02 · -O-O-基連於碳原子及氫之間，該碳原子並非進一步為氧原子所取代，即氫過氧化物 [5]

409/04 · · 碳原子係非環者 [5]

409/06 · · · 含六節芳環以外其他環之化合物 [5]

409/08 · · · 含六節芳環之化合物 [5]

409/10 · · · · 氫過氧異丙苯 [5]

409/12 · · · · 有兩個 α , α -二烷基甲基過氧化氫基連至同一六節芳環之碳原子上 [5]

409/14 · · 該碳原子屬於六節芳環以外之其他環 [5]

409/16 · -O-O-基連於兩個碳原子之間，該碳原子並非進一步為氧原子所取代，即過氧化物 [5]

409/18 · · 至少一個碳原子屬於六節芳環以外之其他環 [5]

409/20 · -O-O-基連至進一步為單鍵氧原子所取代之碳原子上 [5]

409/22 · · 有兩個-O-O-基連至該碳原子上 [5]

409/24 · -O-O-基連至 $>C=O$ 基及氫之間，即過氧酸 [5]

409/26 · · 過乙酸 [5]

409/28 · · $>C=O$ 基連至六節芳環以外之其他環碳原子上 [5]

409/30 · · $>C=O$ 連至六節芳環之碳原子上 [5]

409/32 · -O-O-基連至兩個 $>C=O$ 基之間 [5]

409/34 · · 兩者均屬於羧酸 [5]

409/36 · · · 二乙醯化過氧化物 [5]

409/38 · -O-O-基連至 $>C=O$ 基及碳原子之間，該碳原子並非進一步

- 為氧原子所取代，即過氧酸之酯 409/42 · 含硫原子 [5]
 [5] 409/44 · · 硫原子直接連於—O—O—基
 409/40 · 含氮原子 [5] 上，例如，過磺酸 [5]

C07D 雜環化合物（高分子化合物見 C08） [2]

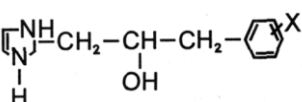
附註[2,3,7,2006.01]

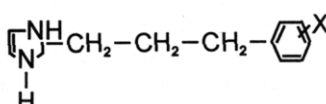
- (1) 本次類不涵蓋含糖基之化合物，糖基之定義見 C07H 次類標題下之附註(3)，糖基化合物涵蓋於 C07H 次類內。[2]
- (2) 於本次類內，凡化合物中含有一個包括於 295/00 目內之雜環及至少一個其它的雜環，則將涵蓋於 295/00 目內之雜環視作一個含氮原子之無環鏈。[3]
- (3) 於本次類內，下列名詞或術語之意義為：
 - “雜環”係一個至少有一個鹵素、氮、氧、硫、硒或碲原子做為環原子之環；[2]
 - “橋接”表示至少存在一個不同於鄰、迫或螺之鍵合；[2]
 - 若兩個環至少共有一個環原子，則係“稠合”者，即“螺”及“橋接”被視為稠合者；[2]
 - “稠環系”係指其中所有的環相互間均稠合的環系；[2]
 - 稠環系內“相關環數”等於將此環系變成一個無環鏈所需的剪斷數；[2]
 - 稠環系內之“相關環”，即被選定而用以描述環系之每個原子間的所有連接的環，接下列順序依次選擇：
 - (a) 環原子之最低數；
 - (b) 做為環原子之雜原子的最高數；
 - (c) 與其它環共有原子之最低數；
 - (d) 分類表中最後位置。[2]
- (4) 注意 C07 主類後的附註(3)，該附註明確了在 C07C 至 C07K 次類中，採用末位規則。[8]
- (5) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]
- (6) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層中，如無其它相反指示時：
 - (a) 僅有一個雜環之化合物時，請依據末位規則放入 203/00 至 347/00 目內之最後適當位置。此點同樣適用於有多個包括於同一主目內之具有多個雜環的化合物，此等雜環相互之間既不稠合，亦不與一個普通的碳環系稠合； [2]
 - (b) 含有兩個或更多包括於不同主目內之雜環、雜環間彼此既不稠合，亦不與一個普通的碳環系稠合之化合物，請依據末位規則放入 401/00 至 519/00 目內之最後適當位置； [2]
 - (c) 含有包括於同一主目或不同主目內之兩個或多個相關雜環且雜環之

間互相稠合或與一個普通的碳環稠合的化合物，請依據末位規則放入 451/00 至 519/00 目內之最後適當位置。[2]

(7) 於本次類內：

- 當一化合物以可互變異構體形式存在時，請依據末位規則放入最後適當位置。因此，環原子與非環原子間之雙鍵與環原子本身間之雙鍵於衡量環之氫化程度時被視為相同者。可用 Kekule 式寫出化學式；[2]
- 含一碳環與一無環鏈之烴基，此烴基之無環鏈與雜環相接，並於碳環及無環鏈上兩者均為雜原子或有三個鍵連接雜原子，其中最多以一個鍵連接鹵素之碳原子所取代，則依無環鏈上之取代基予以分

類。例如，化合物  分類見 233/22，化合物

 分類見 233/24 及 233/26，其中
X=—NH₂，—NHCOCH₃ 或 —COOCH₃。[2]

次類索引

含一個雜環之化合物

氮作為雜環原子

僅有氮原子

一個氮原子

多甲撐亞胺	295/00
內鹽胺之製備	201/00
三節環	203/00
四節環	205/00
五節環	207/00，209/00
六節環	211/00，213/00，215/00， 217/00，219/00，221/00

七節環

其他化合物

兩個氮原子

四節環	229/00
五節環	231/00，233/00，235/00
六節環	237/00，239/00，241/00
六氫吡啶	295/00
七節環	243/00
其他化合物	245/00，247/00

三個氮原子

五節環	249/00
六節環	251/00，253/00
其他化合物	255/00

四個或更多個氮原子

氮及氧原子

五節環

六節環

嗎啉

其他化合物

氮及硫原子

五節環

六節環

硫嗎啉

其他化合物

氮、氧及硫原子

氧作為雜環原子

僅有氧原子

一個氧原子

三節環	301/00，303/00
四節環	305/00
五節環	307/00
六節環	309/00，311/00
其他化合物	313/00，315/00

兩個氧原子

五節環	317/00
六節環	319/00
其他化合物	321/00

三個或更多氧原子

其他化合物

氧及氮原子				嗎啡.....	489/00
五節環.....	261/00	263/00	271/00	氧代青黴素.....	503/00
六節環.....	265/00	273/00		氧代頭孢藥素.....	505/00
嗎啉.....	295/00			氮及硫.....	507/00, 513/00
其他化合物.....	267/00	269/00	273/00	青黴素.....	499/00
氧及硫原子.....	327/00			頭孢菌素.....	501/00
氧、氮及硫原子.....	291/00			氮、氧及硫.....	507/00, 515/00
硫作為雜環原子				氧作為雜環原子	
僅有硫原子				僅有氧.....	493/00
一個硫原子				氧及氮.....	491/00, 498/00, 507/00
五節環.....	333/00			嗎啡.....	489/00
六節環.....	335/00			氧代青黴素.....	503/00
其他化合物.....	331/00	337/00		氧代頭孢藥素.....	505/00
兩個或更多硫原子.....	339/00	341/00		氧及硫.....	497/00
硫及氮原子				氧、氮及硫.....	507/00, 515/00
五節環.....	275/00	277/00	285/00	硫作為雜環原子	
六節環.....	279/00	285/00		僅有硫於一特殊的環內.....	495/00
硫嗎啉.....	295/00			硫及氧.....	497/00
其他化合物.....	281/00	283/00	285/00	硫、氮及氧.....	507/00, 515/00
硫及氧原子.....	327/00			硒、碲或鹵素作為雜環原子.....	517/00
硫、氮及氧原子.....	291/00			於不同的環系內、每個環系僅含一個雜環	
硒或碲作為雜環原子				氮作為雜環原子	
僅有硒或碲雜原子.....	345/00			僅有氮	
同時有氮原子.....	293/00			至少一個六節環含有一個氮原子.....	401/00
同時有氧原子.....	329/00			其他化合物.....	403/00
同時有硫原子.....	343/00			氮及氧.....	405/00, 413/00
鹵素作為雜環原子.....	347/00			氮及硫.....	417/00
含兩個或更多雜原子之化合物				硫胺素.....	415/00
於同一環系				氮、氧及硫.....	419/00
氮作為雜環原子				氧作為雜環原子	
僅有氮				僅有氧.....	407/00
至少一個六節環				氧及氮.....	405/00, 413/00
含有一個氮原子.....	471/00			氧及硫.....	411/00
托烷，石榴皮烷.....	451/00			氧、氮及硫.....	419/00
奎寧，奎寧環，異奎寧環.....	453/00			硫作為雜環原子	
吐根鹼，小檗鹼.....	455/00			僅有硫在一個特殊的環中.....	409/00
麥角酸，麥角生物鹼.....	457/00			硫及氮.....	417/00
育亨賓.....	459/00			硫胺素.....	415/00
長春蔓胺.....	461/00			硫及氧.....	411/00
Carbacephalosporin 碳				硫、氮及氧.....	419/00
代頭孢菌素.....	463/00			硒、碲或鹵素作為雜環原子.....	421/00
其他化合物.....	487/00	507/00	513/00	含兩個或更多環系、每個環系有	
嘌呤.....	473/00			兩個或更多雜環之化合物.....	519/00
喋啶.....	475/00			生物鹼	
Thienamycin.....	477/00			吐根鹼.....	455/00
氮及氧.....	491/00	498/00	507/00		

麥角	457/00, 519/00
石榴皮單寧	451/00
嗎啡	489/00
煙鹼	401/00
罌粟鹼	217/00
奎寧	453/00
馬錢子鹼	498/00
托烷	451/00

頭孢菌素	501/00
青黴素	499/00
喋啶	475/00
Thienamycin	477/00
嘌呤	473/00
硫胺素	415/00
含尚未確定的雜環之化合物	521/00

僅有氮作為雜環原子之雜環化合物[2]

201/00 非取代的內醯胺之製備、分離、純化或穩定化 [2]

- 201/02 · 內醯胺之製備 [2]
- 201/04 · · 由肟或經肟，利用 Beckmann 重排 [2]
- 201/06 · · · 由酮，利用同時進行肟之生成及重排 [2]
- 201/08 · · 由羧酸或其衍生物，例如，羧基羧酸，內脂，腈 [2]
- 201/10 · · 由脂環族化合物，利用同時進行亞硝基化及重排 [2]
- 201/12 · · 由聚醯胺解聚 [2]
- 201/14 · 內醯胺之鹽或加合物之製備 [2]
- 201/16 · 分離或純化 [2]
- 201/18 · 穩定化 [2]

203/00 雜環化合物，含三節環、附一個氮原子作為唯一的雜環原子 [2]

- 203/02 · 利用閉環製備 [2]
- 203/04 · 不與其他環稠合 [2]
- 203/06 · · 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 203/08 · · · 僅有氮原子、烴基或取代的烴基，直接連於環氮原子上 [2]
- 203/10 · · · · 為單鍵連結的氧原子所取代之基 [2]
- 203/12 · · · · 為非硝基的氮原子所取代之基 [2]
- 203/14 · · · · 有碳環直接連至環氮原子上 [2]
- 203/16 · · · 有醯化的環氮原子 [2]

203/18 · · · · 用羧酸，或用此等之硫或氮的類似物 [2]

203/20 · · · · 用碳酸或用其硫或氮之類似物，例如胺基甲酸酯 [2]

203/22 · · · 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]

203/24 · · · · 硫原子 [2]

203/26 · 與碳環或碳環系稠合 [2]

205/00 雜環化合物，含四節環、附一個氮原子作為唯一的雜環原子 [2]

- 205/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 205/04 · · 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 205/06 · · 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 205/08 · · · 有一個氧原子直接連至位置 2，例如， β -內醯胺 [2]
- 205/085 · · · · 有一個氮原子直接連至位置 3 [5]
- 205/09 · · · · 有一個硫原子直接連至位置 4 [5]
- 205/095 · · · · · 與有一個氮原子直接連至位置 3 [5]
- 205/10 · · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 205/12 · 與碳環或碳環系稠合 [2]

207/00 雜環化合物，含五節環、不與其他環稠合，附一個氮原子作為唯一的雜環原子 [2]

附註

僅有氮原子連至環碳原子上之

- 吡咯烷，分類見 295/00 目。[2]
- 207/02 · 僅有氫或碳原子直接連至環氮原子上 [2]
- 207/04 · 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 207/06 · 附有僅含氫及碳原子之基，連至環碳原子上 [2]
- 207/08 · 附有為雜原子所取代之烴基，連至環碳原子上 [2]
- 207/09 · 為非硝基氮原子所取代之基 [3]
- 207/10 · 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 207/12 · 氧或硫原子 [2]
- 207/14 · 非硝基氮原子 [2]
- 207/16 · 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [2]
- 207/18 · 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 207/20 · 僅有氫原子、烴基或取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 207/22 · 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 207/24 · 氧或硫原子 [2]
- 207/26 · 2-吡咯烷酮 [2]
- 207/263 · 僅有氫原子或僅含氫及碳原子之基直接連至其他環碳原子上 [3]
- 207/267 · 僅有氫原子或僅含氫及碳原子基，直接連至環氮原子 [3]
- 207/27 · 有取代烴基直接連至環氮原子上 [3]
- 207/273 · 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基直接連至其他環碳原子上 [3]
- 207/277 · 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [3]
- 207/28 · 2-吡咯烷酮-5-羧酸；此等官能基衍生物，例如，酯、腈 [2]
- 207/30 · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 207/32 · 僅有氫原子，烴基或取代之烴基，直接連至碳原子上 [2]
- 207/323 · 僅有氫原子，或僅含氫及碳原子之基，直接連至環氮原子上 [3]
- 207/325 · 有取代之烴基直接連至環氮原子上 [3]
- 207/327 · 為以三條鍵連雜原子、其中至多一條鍵連鹵素之碳原子，例如酯基或腈基所取代之基 [3]
- 207/33 · 有取代的烴基，直接連至環碳原子上 [3]
- 207/333 · 為氧或硫原子所取代之基 [3]
- 207/335 · 為非硝基氮原子所取代之基 [3]
- 207/337 · 為以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基所取代之基 [3]

- 207/34 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 207/36 氧或硫原子 [2]
- 207/38 2-吡咯酮 [2]
- 207/40 2, 5-吡咯烷二酮 [2]
- 207/404 僅有氫原子或僅含氫及碳原子之烴基直接連至其他環碳原子上，例如，琥珀醯亞胺 [3]
- 207/408 僅含氫及碳原子之基連至環碳原子上 [3]
- 207/412 含六個碳原子以上之非環烴基 [3]
- 207/416 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中最多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至其他環碳原子上 [3]
- 207/42 硝基 [2]
- 207/44 . . 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]
- 207/444 . . . 有兩個雙鍵鍵合之氧原子直接連至 2 及 5 位置上 [3]
- 207/448 僅有氫原子或僅含氫及碳原子之基直接連至其他環碳原子上，例如，馬來醯亞胺 [3]
- 207/452 有為雜原子所取代之烴基直接連至環氮原子上 [3]
- 207/456 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至其他環碳原子上 [3]
- 207/46 . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 207/48 . . 硫原子 [2]
- 207/50 . . 氮原子 [2]
- 209/00 雜環化合物，含五節環、與其他環稠合、附一個氮原子作為唯一的雜環原子 [2]**
- 209/02 . 與一個碳環稠合 [2]
- 209/04 . . 吡啶；氫化吡啶 [2]
- 209/06 . . . 由煤焦油製備 [2]
- 209/08 . . . 僅有氫原子或僅含氫及碳原子之基直接連至雜環之碳原子上 [2]
- 209/10 . . . 有為雜原子所取代之烴基，直接連至雜環之碳原子上 [2]
- 209/12 為氧原子所取代之基 [2]
- 209/14 為非硝基氮原子所取代之基 [2]
- 209/16 色胺 [2]
- 209/18 有為三條鍵連雜原子，其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子所取代之基，例如，酯基或腓基 [2]
- 209/20 又為氮原子所取代，例如，色胺酸 [2]
- 209/22 有芳烷基連至環氮原子上 [2]
- 209/24 有烷基或環烷基連至環氮原子上 [2]
- 209/26 有醯基連至環氮原子上 [2]
- 209/28 1-(4-氯苯甲醯)-2-甲基-吡啶基-3-乙酸，於位置 5 為氧或氮原子所取代；此等之酯 [2]
- 209/30 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，直接連至雜環之碳原子上 [2]
- 209/32 氧原子 [2]
- 209/34 於位置 2 [2]
- 209/36 於位置 3，例如，腺色

素 [2]

- 209/38 於位置 2 及 3，例如，
靛紅 [2]
- 209/40 非硝基氮原子，例如，腺
色素半卡巴腓 [2]
- 209/42 以三條鍵連雜原子、其中
至多以一條鍵連鹵素之碳
原子，例如酯基或腓基
[2]
- 209/43 有一個
—OCH₂CH(OH)CH₂NH₂
基，其可進一步被取代，連
至位置 4,5,6，或 7 [5]
- 209/44 . . . 異吡啶，氫化異吡啶 [2]
- 209/46 於位置 1 有一個氧原子 [2]
- 209/48 於在位置 1 及 3 有氮原子，
例如，鄰—苯二甲醯亞胺
[2]
- 209/49 並且於分子中有一個含飽
和三節環之醯基，例如，
菊甲酸酯 [5]
- 209/50 於位置 1 及 3 上有氧及氮原
子 [2]
- 209/52 . . . 與一非六節環稠合 [2]
- 209/54 . . . 螺—稠合 [2]
- 209/56 . . . 含三個或更多個環之環系 [2]
- 209/58 . . . [b]—或 [c]—稠合 [2]
- 209/60 萘并 [b]吡咯；氫化萘并 [b]
吡咯 [2]
- 209/62 萘并 [c]吡咯；氫化萘并 [c]
吡咯 [2]
- 209/64 於位置 1 有一個氧原子[2]
- 209/66 於位置 1 及 3 上有氧原子
[2]
- 209/68 於位置 1 及 3 上有氧及氮
原子 [2]
- 209/70 含非六節碳環 [2]
- 209/72 4,7—橋—烷撐—異吡啶 [2]
- 209/74 於位置 1 上有一個氧原子
[2]
- 209/76 於位置 1 及 3 上有氧原子
[2]
- 209/78 於位置 1 及 3 上有氧及氮

原子 [2]

- 209/80 . . . [b,c]—或 [b,d]—稠合 [2]
- 209/82 吡啶；氫化吡啶 [2]
- 209/84 分離，如，從焦油；純化
[2]
- 209/86 僅有氮原子，烴基或取代
的烴基，直接連至環系之
碳原子上 [2]
- 209/88 有雜原子或有以三條鍵連
雜原子、其中至多以一條
鍵連鹵素之碳原子，例
如，酯基或腓基，直接連
至環系之碳原子上 [2]
- 209/90 苯并 [c,d] 吡啶；氫化苯并
[c,d] 吡啶 [2]
- 209/92 8—胺基—1—萘酸內醯胺
[2]
- 209/94 含非六節之碳環 [4]
- 209/96 . . . 螺—稠合環系 [2]
- 211/00 雜環化合物，含氫化吡啶環，不
與其他環稠合 [2]**

附註

(1) 於此主目內，使用下列述語，
其意義表示：“氫化之意義係
指於環原子或環原子與非環
原子之間少於三條雙鍵”。
[2]

(2) 僅有氮原子連至環碳原子上
之六氫吡啶分類見 295/00。[2]

- 211/02 . . . 利用閉環或加氫製備 [2]
- 211/04 . . . 僅有氮或碳原子直接連至環氮原
子上 [2]
- 211/06 . . . 環原子間或環原子與非環原子
間無雙鍵 [2]
- 211/08 有烴基或取代的烴基直接連
至環碳原子上 [2,3]
- 211/10 有僅含碳原子及氮原子之
基直接連至環碳原子上
[2,3]
- 211/12 僅有氮原子連至環氮原

- 子上 [2,3]
- 211/14 有烴基或取代的烴基連至環氮原子上 [2]
- 211/16 有鹽化的環氮原子 [2]
- 211/18 有為雜原子取代之烴基連至環碳原子上 [2]
- 211/20 有為以單鍵鍵合之氧原子或硫原子所取代的烴基 [2]
- 211/22 為氧原子而成者 [2]
- 211/24 為連有第二個雜原子之硫原子而成者 [2]
- 211/26 有為氮原子所取代之烴基而成者 [2]
- 211/28 為氮原子連有第二個雜原子而成者 [2]
- 211/30 有為以雙鍵氧或硫原子所取代之烴基，或有為以單鍵連接至同一個碳原子上之兩個氧或硫原子所取代之烴基 [2]
- 211/32 為氧原子而成者 [2]
- 211/34 有為以三條鍵連接雜原子，其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基所取代之烴基 [2]
- 211/36 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 211/38 鹵素原子或硝基 [2]
- 211/40 氧原子 [2]
- 211/42 連至位置 3 或 5 上 [2]
- 211/44 連至位置 4 上 [2]
- 211/46 於位置 4 上有一個氮原子作為第二個取代基 [2]
- 211/48 有一個非環碳原子連於位置 4 上 [2]
- 211/50 芳鹽基 [2]
- 211/52 於位置 4 上有一個芳基作為第二個取代基 [2]
- 211/54 硫原子 [2]
- 211/56 氮原子（硝基見 211/38）[2]
- 211/58 連至位置 4 上 [2]
- 211/60 以三條鍵連雜原子，其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [2]
- 211/62 連至位置 4 上 [2]
- 211/64 於位置 4 上有一個芳基作為第二個取代基 [2]
- 211/66 於位置 4 上有一個雜原子作為第二個取代基 [2]
- 211/68 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 211/70 僅有氫原子、烴基或取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 211/72 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素的碳原子，直接連至環碳原子上 [2]
- 211/74 氧原子 [2]
- 211/76 連至位置 2 或 6 上 [2]
- 211/78 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子 [2]
- 211/80 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 211/82 僅有氫原子、烴基或取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 211/84 有雜原子或有以上三條鍵連雜原子，其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，直接連至環碳原子上 [2]
- 211/86 氧原子 [2]
- 211/88 連至位置 2 及 6 上，例

- 如，戊二醯亞胺 [2]
- 211/90 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子 [2]
- 211/92 . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 211/94 . . 氧原子，例如，六氫吡啶 N-氧化物 [2]
- 211/96 . . 硫原子 [2]
- 211/98 . . 氮原子 [2]
- 213/00 雜環化合物，含六節環、不與其他環稠合、有一個氮原子作為唯一的雜環原子、環原子間或環原子與非環原子間有三條或更多的雙鍵 [2]**
- 213/02 . 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]
- 213/04 . . 於環氮原子與非環原子間無鍵或僅有氫或碳原子直接連至環氮原子上 [2]
- 213/06 . . . 除環氮原子外，僅含氫及碳原子 [2]
- 213/08 利用閉環製備 [2]
- 213/09 包括用氨、胺、銨鹽或脲 [3]
- 213/10 由乙醛或其環狀聚合物 [3]
- 213/12 由不飽和化合物 [3]
- 213/127 由含吡啶化合物製備 [3]
- 213/133 利用過氧化吡啶化合物脫氫製備 [3]
- 213/14 由含環氧化合物製備 [2]
- 213/16 僅含一個吡啶環 [2]
- 213/18 此等之鹽 [2]
- 213/20 此等之第 4 級化合物 [2]
- 213/22 含相互直接連之兩個或更多的吡啶環，例如，聯吡啶 [2]
- 213/24 . . . 有取代的烴基連至環碳原子上 [2]
- 213/26 為鹵素原子或硝基所取代之基 [2]
- 213/28 為以單鍵鍵合的氧原子或硫原子所取代之基 [2]
- 213/30 氧原子 [2]
- 213/32 硫原子 [2]
- 213/34 第二個雜原子連至氧或硫原子上 [2]
- 213/36 為以單鍵連接之氮原子取代的基（硝基見 213/26）[2]
- 213/38 僅有氫或烴基連至取代基之氮原子上 [2]
- 213/40 取代基之氮原子經醯化者 [2]
- 213/42 有雜原子連至取代基之氮原子上（硝基見 213/26）[2]
- 213/44 為以雙鍵鍵合之氧、硫或氮原子所取代的基，或為兩個此類原子以單鍵形式鍵合於同一碳原子所取代之基上 [2]
- 213/46 氧原子 [2]
- 213/48 醛基 [2]
- 213/50 酮基 [2]
- 213/51 縮醛基 [2]
- 213/52 硫原子 [2]
- 213/53 氮原子 [2]
- 213/54 為以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或脲基所取代之基上 [2]
- 213/55 酸；酯 [2]
- 213/56 醯胺 [2]
- 213/57 脲 [2]
- 213/58 脒 [2]
- 213/59 其中至少有一條鍵連至硫上 [2]
- 213/60 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或脲基，直接連至環碳原子

- 上 [2]
- 213/61 鹵素原子或硝基 [2]
- 213/62 氧或硫原子 [2]
- 213/63 一個氧原子 [2]
- 213/64 連至位置 2 或 6 上 [2]
- 213/643 2-苯氧基吡啶；其衍生物 [5]
- 213/647 且於分子中有一個含飽和三節環之醯基，例如，菊甲酸酯 [5]
- 213/65 連至位置 3 或 5 上 [5]
- 213/66 於位置 3 上有一個氧原子，且於位置 4 及 5 上各有一個碳原子與一個氧、硫或氮原子相連，例如，維生素 B₆ [2]
- 213/67 2-甲基-3-羧基-4,5-雙(羥甲基)吡啶，即吡哆醇(pyridoxine) [2]
- 213/68 連至位置 4 [2]
- 213/69 兩個或更多氧原子 [2]
- 213/70 硫原子 [4]
- 213/71 於上述硫原子上有第二個雜原子與之相連 [2]
- 213/72 氮原子(硝基見 213/61) [2]
- 213/73 未取代之胺基或亞胺基 [2]
- 213/74 為烴基或取代烴基所取代之胺基或亞胺基 [2]
- 213/75 胺基或亞胺基，為羧酸或碳酸醯化，或為此等之硫或氮的類似物所醯化，例如，胺基甲酸酯 [2]
- 213/76 氮原子上有第二個雜原子與之相連(硝基見 213/61) [2]
- 213/77 肼基 [2]
- 213/78 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [2]
- 213/79 酸；酯 [2]
- 213/80 於位置 3 上 [2]
- 213/803 製備方法 [3]
- 213/807 利用吡啶或稠合吡啶之氧化 [3]
- 213/81 醯胺；醯亞胺 [3]
- 213/82 於位置 3 上 [2]
- 213/83 硫代酸；硫酯；硫代醯胺；硫代醯亞胺 [2]
- 213/84 腈 [2]
- 213/85 於位置 3 上 [2]
- 213/86 醯肼；此等之硫或亞胺之類似物 [2]
- 213/87 於位置 3 上 [2]
- 213/88 菸醯胺 [2]
- 213/89 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 213/90 環原子間或環原子與非環原子間多於三條雙鍵 [2]
- 215/00 雜環化合物，含喹啉或氫化喹啉環系 [2]**
- 215/02 環氮原子及非環原子間無鍵連或僅有氮原子或碳原子直接連至環氮原子上 [2]
- 215/04 僅有氮原子或僅含氮及碳原子之基直接連至環碳原子上 [2]
- 215/06 僅有氮原子，烴基或取代之烴基，連至環氮原子上 [2]
- 215/08 有醯化的環氮原子 [2]
- 215/10 第 4 級化合物 [2]
- 215/12 有取代的烴基連至環碳原子上 [2]
- 215/14 為氧原子所取代之基 [2]
- 215/16 有雜原子或有以三條鍵與雜原子相連、其中至多以一條鍵與鹵素相連之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子

上 [2]

- 215/18 . . . 鹵素原子或硝基 [2]
- 215/20 . . . 氧原子 [2]
- 215/22 連至位置 2 或 4 上 [2]
- 215/227 僅有一個氧原子連至位置 2 [5]
- 215/233 僅有一個氧原子連至位置 4 [5]
- 215/24 連至位置 8 上 [2]
- 215/26 醇；此等之醚 [2]
- 215/28 有鹵素原子或硝基於位置 5、6 或 7 上 [2]
- 215/30 金屬鹽；螯合物 [2]
- 215/32 酯 [2]
- 215/34 胺基甲酸酯 [2]
- 215/36 . . . 硫原子（215/24 優先）[2]
- 215/38 . . . 氮原子（硝基見 215/18）[2]
- 215/40 連至位置 8 上 [2]
- 215/42 連至位置 4 上 [2]
- 215/44 有芳基連至上述氮原子上 [2]
- 215/46 有為氮原子所取代之烴基，連至上述氮原子上 [2]
- 215/48 . . . 碳原子，以三條鍵與雜原子相連、其中至多以一條鍵與鹵素相連 [2]
- 215/50 連至位置 4 [2]
- 215/52 有芳基連至位置 2 上 [2]
- 215/54 連至位置 3 上 [2]
- 215/56 有氮原子於位置 4 上 [2]
- 215/58 . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 215/60 . . N—氧化物 [2]

217/00 雜環化合物，含異喹啉或氫化異喹啉環系 [2]

- 217/02 . 僅有氮原子或僅含碳或氮原子之基直接連至含氮環的碳原子上；
烷撐—雙—異喹啉 [2]
- 217/04 . . 有烴基或取代之烴基連至環氮原子上 [2]
- 217/06 . . 有為羧酸或碳酸所醯化者、或

為此等之硫或氮類似物所醯化之環氮原子，例如，胺基甲酸酯 [2]

- 217/08 . . 有一個雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 217/10 . . 第 4 級化合物 [2]
- 217/12 . 有為雜原子所取代之基直接連至含氮環之碳原子上 [2]
- 217/14 . . 芳烷基以外者 [2]
- 217/16 . . . 為氧原子所取代者 [2]
- 217/18 . . 芳烷基 [2]
- 217/20 . . . 有氮原子直接連至上述芳烷基之芳環上，例如，罌粟鹼 [2]
- 217/22 . 有雜原子，或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，如酯基或腓基，直接連至含氮環之碳原子上 [2]
- 217/24 . . 氧原子 [2]
- 217/26 . . 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子 [2]

219/00 雜環化合物，含吡啶或氫化吡啶環系 [2]

- 219/02 . 僅有氮原子、烴基或取代之烴基，直接連至環系之碳原子上 [2]
- 219/04 . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至環系之碳原子上 [2]
- 219/06 . . 氧原子 [2]
- 219/08 . . 氮原子 [2]
- 219/10 . . . 連至位置 9 上 [2]
- 219/12 胺烷基—胺基連至位置 9 上 [2]
- 219/14 . 有為氮原子所取代之烴基連至環氮原子上 [2]
- 219/16 . 有為氮原子所取代的醯基連至環氮原子上 [2]

221/00 雜環化合物，含六節環、有一個氮原子作為唯一的雜原子、未為 211/00 至 219/00 各目內未包括

者 [2]

- 221/02 · 與碳環或碳環系耦合 [2]
 221/04 · · 鄰位或迫位耦合之環系 [2]
 221/06 · · · 三環環系 [2]
 221/08 · · · · 氮雜蔥 [2]
 221/10 · · · · 氮雜菲 [2]
 221/12 · · · · · 菲啶 [2]
 221/14 · · · · 氮雜菲那烯，例如，
 1,8-萘二甲醯亞胺 [2]
 221/16 · · · · 含非六節之碳環 [2]
 221/18 · · · 四環或更多環之環系 [2]
 221/20 · · 螺稠合之環系 [2]
 221/22 · · 橋接之環系 [2]
 221/24 · · · 茨非啶 [2]
 221/26 · · · 苯異嗎啡烷 [2]
 221/28 · · · 嗎啡烷 [2]

223/00 雜環化合物，含七節環、有一個氮原子作為唯一的雜環原子 [2]

附註

六甲撐亞胺或 3-氮雜雙環
 [3.2.2]壬烷、僅有氮原子連至環
 碳原子上，分類見 295/00 目。[2]

- 223/02 · 不與其他環稠合 [2]
 223/04 · · 僅有氮原子、鹵素原子、烴基
 或取代之烴基，直接連至環碳
 原子上 [2]
 223/06 · · 有雜原子或有以三條鍵連雜原
 子、其中至多以一條鍵連鹵素
 之碳原子，例如，酯基或腈
 基，直接連至環碳原子上（鹵
 素原子見 223/04）[2]
 223/08 · · · 氧原子 [2]
 223/10 · · · · 連至位置 2 上 [2]
 223/12 · · · 非硝基之氮原子 [2]
 223/14 · 與碳環或碳環系耦合 [2]
 223/16 · · 苯并吡啶因；氫化苯并吡啶因
 [2]
 223/18 · · 二苯并吡啶因；氫化二苯并吡
 啶因 [2]
 223/20 · · · 二苯并 [b,e] 吡啶因；氫化

二苯并 [b,e] 吡啶因 [2]

- 223/22 · · · 二苯并 [b,f] 吡啶因；氫化
 二苯并 [b,f] 吡啶因 [2]
 223/24 · · · · 有為氮原子所取代之烴
 基，連至環氮原子上 [2]
 223/26 · · · · · 位置 10 與 11 間有一條
 雙鍵 [2]
 223/28 · · · · · 位置 10 與 11 間有一條
 單鍵 [2]
 223/30 · · · · 有雜原子直接連至環氮原
 子上 [2]
 223/32 · · 含非六節之碳環 [2]
**225/00 雜環化合物，含大於七節之環、
 有一個氮原子作為唯一的雜環
 原子 [2]**

附註

多甲撐亞胺，至少含五節環、僅
 有氮原子連至環碳原子上，分類
 見 295/00 目。[2]

- 225/02 · 不與其他環稠合 [2]
 225/04 · 與碳環或碳環系耦合 [2]
 225/06 · · 與一個六節環稠合 [2]
 225/08 · · 與兩個六節環稠合 [2]

**227/00 雜環化合物，含有一個氮原子作
 為唯一的雜環原子之環、與
 203/00 至 225/00 各目內一個以
 上之目相應者 [2]**

附註

多甲撐亞胺，至少含五節環、僅
 有氮原子連至環碳原子上，分類
 見 295/00 目 [3]

- 227/02 · 僅有氮或碳原子直接連至環氮原
 子上 [2]
 227/04 · · 僅有氮原子、烴基或取代之烴
 基，連至環碳原子上 [2]
 227/06 · · 有雜原子或有以三條鍵連雜原
 子、其中至多以一條鍵連鹵素

- 之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 227/08 . . . 氧原子 [2]
- 227/087 . . . 一個雙鍵氧原子於位置 2 上，例如，內醯胺 [2]
- 227/093 . . . 兩個雙鍵氧原子連至與環氮原子相鄰的碳原子上，例如，二羧酸醯亞胺 [2]
- 227/10 . . . 非硝基氮原子 [2]
- 227/12 . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 229/00 雜環化合物，含小於五節之環、有兩個氮原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 229/02 . 含三節環 [3]
- 231/00 雜環化合物，含 1,2-二唑或氫化 1,2-二唑環 [2]**
- 231/02 . 不與其他環稠合 [2]
- 231/04 . . 環原子間或環原子及非環原子間無雙鍵 [2]
- 231/06 . . 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 231/08 . . . 有氧或硫原子直接連至環碳原子上 [2]
- 231/10 . . 環原子間或環原子與非環原子間有兩條或三條雙鍵 [2]
- 231/12 . . . 僅有氫原子、烴基或取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 231/14 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子，其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接與環碳原子相連 [2]
- 231/16 . . . 鹵素原子與硝基 [2]
- 231/18 . . . 一個氧或硫原子 [2]
- 231/20 . . . 一個氧原子連至位置 3 或 5 上 [2]
- 231/22 . . . 有芳基連至環氮原子上 [2]
- 231/24 . . . 分子中有礬基或磺
- 酸基 [2]
- 231/26 . . . 苯環上未被取代的或被取代的 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 [2]
- 231/28 . . . 兩個氧或硫原子 [2]
- 231/30 . . . 連至位置 3 及 5 上 [2]
- 231/32 . . . 氧原子 [2]
- 231/34 . . . 僅有氫原子或僅含碳及氮原子之基連至位置 4 [2]
- 231/36 . . . 有為雜原子所取代之烴基連至位置 4 [2]
- 231/38 . . . 氮原子（硝基見 231/16）[2]
- 231/40 . . . 上述氮原子經醯化者 [2]
- 231/42 . . . 苯磺醯胺基吡唑 [2]
- 231/44 . . . 氧及氮原子或硫及氮原子 [2]
- 231/46 . . . 氧原子於位置 3 或 5 上及氮原子於位置 4 上 [2]
- 231/48 . . . 有烴基連至上述氮原子上 [2]
- 231/50 . . . 上述氮原子經醯化者 [2]
- 231/52 . . . 氧原子於位置 3 上及氮原子於位置 5 上，或反之 [2]
- 231/54 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 231/56 . . 苯并吡唑；氫化苯并吡唑 [2]
- 233/00 雜環化合物，含 1,3-二唑或氫化 1,3-二唑環，不與其他環稠合 [2]**
- 233/02 . 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 233/04 . 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 233/06 . . 僅有氫原子或僅含氫及碳原子之基，直接連至環碳原子上 [2]
- 233/08 . . . 有多於四個碳原子之烷基，

- 直接連至環原子上 [2]
- 233/10 僅有氮原子或僅含氮及碳原子之基，直接連至環氮原子上 [2]
- 233/12 有取代之烴基，連至環氮原子上 [2]
- 233/14 為氧原子所取代之基[2]
- 233/16 為氮原子所取代之基[2]
- 233/18 為以三條鍵連接雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子所取代之基，例如，酯基或腈基 [2]
- 233/20 . . 有取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 233/22 . . . 為氧原子所取代之基 [2]
- 233/24 . . . 為非硝基氮原子所取代之基 [2]
- 233/26 . . . 為以三條鍵連雜原子之碳原子所取代之基 [2]
- 233/28 . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 233/30 . . . 氧或硫原子 [2]
- 233/32 一個氧原子 [2]
- 233/34 乙撐脲 [2]
- 233/36 有為氮原子所取代之烴基，連至環氮原子上 [2]
- 233/38 有鹽基或雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 233/40 兩個或更多氧原子 [2]
- 233/42 硫原子 [2]
- 233/44 . . . 非硝基氮原子 [2]
- 233/46 僅有氮原子連至上述氮原子上 [2]
- 233/48 有無環烴基或取代之無環烴基連至上述氮原子上 [2]
- 233/50 有碳環基直接連至上述氮原子上 [2]
- 233/52 有雜原子直接連至上述氮原子上 [2]
- 233/54 . 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 233/56 . . 僅有氮原子或僅含氮原子及碳原子之基，連至環碳原子上 [2]
- 233/58 . . . 僅有氮原子或僅含氮及碳原子之基，連至環氮原子上 [2]
- 233/60 . . . 有為氧或硫原子所取代之烴基，連至環氮原子上 [2]
- 233/61 . . . 有為非硝基氮原子所取代之烴基，連至環氮原子上 [3]
- 233/62 . . . 有三芳基甲基連至環氮原子上 [2]
- 233/64 . . 有取代之烴基連至環碳原子上，例如組胺酸 [2]
- 233/66 . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 233/68 . . . 鹵原子 [2]
- 233/70 . . . 一個氧原子 [2]
- 233/72 . . . 兩個氧原子，例如，乙內醯脲 [2]
- 233/74 僅有氮原子或有僅含氮及碳原子之基，連至其他環原子上 [2]
- 233/76 有取代之烴基連至第三個環碳原子上 [2]
- 233/78 為氧原子所取代之基[2]
- 233/80 有雜原子或鹽基直接連至環氮原子上 [2]
- 233/82 鹵素原子 [2]
- 233/84 . . . 硫原子 [2]
- 233/86 . . . 氧原子及硫原子，例如，硫代乙內醯脲 [2]
- 233/88 . . . 氮原子，如尿囊素 [2]
- 233/90 . . . 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [2]

- 233/91 硝基 [2]
- 233/92 連至位置 4 或 5 [2]
- 233/93 有為鹵原子所取代之烴基，連至其他環原子上 [2]
- 233/94 有為氧或硫原子所取代之烴基，連至其他環原子上 [2]
- 233/95 有為氮原子所取代之烴基，連至其他環原子上 [2]
- 233/96 . 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]

235/00 雜環化合物，含 1,3-二唑或氫化 1,3-二唑環、與其他環稠合 [2]

- 235/02 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 235/04 . . 苯并咪唑；氫化苯并咪唑 [2]
- 235/06 . . . 僅有氮原子、烴基或取代之烴基，直接連至位置 2 上 [2]
- 235/08 僅有氮及碳原子之基 [2]
- 235/10 為鹵素原子或硝基所取代之基 [2]
- 235/12 為氧原子所取代之基 [2]
- 235/14 為氮原子所取代之基（為硝基所取代見 235/10）[2]
- 235/16 為以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子所取代之基，例如，酯基或腓基 [2]
- 235/18 . . . 有芳基直接連至位置 2 [2]
- 235/20 . . . 兩個苯并咪唑-2 基直接相連，或經烴基或所取代之烴基而相連 [2]
- 235/22 . . . 有雜原子直接連至環氮原子上（235/10 優先）[2]
- 235/24 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至位置 2 上 [2]
- 235/26 氧原子 [2]
- 235/28 硫原子 [2]

- 235/30 非硝基氮原子 [2]
- 235/32 苯并咪唑-2-胺基甲酸，未取代者或取代者；其酯；其硫代類似物 [2]

237/00 雜環化合物，含 1,2-二吡環或氫化 1,2-二吡環 [2]

- 237/02 . 不與其他環稠合 [2]
 - 237/04 . . 環原子間或環原子與非環原子間少於三條雙鍵 [2]
 - 237/06 . . 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]
 - 237/08 . . . 僅有氮原子，烴基或取代之烴基，直接連至環碳原子上 [2]
 - 237/10 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如酯基或腓基，直接連在環碳原子上 [2]
 - 237/12 鹵素原子或硝基 [2]
 - 237/14 氧原子 [2]
 - 237/16 兩個氧原子 [2]
 - 237/18 硫原子 [2]
 - 237/20 氮原子（硝基見 237/12）[2]
 - 237/22 氮及氧原子 [2]
 - 237/24 以三條鍵連雜原子，至多以一條鍵連鹵素之碳原子 [2]
 - 237/26 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
 - 237/28 . . 咪唑 [2]
 - 237/30 . . 吡啶 [2]
 - 237/32 . . . 有氮原子直接連至含氮環之碳原子上 [2]
 - 237/34 . . . 有氮原子直接連至含氮環之碳原子上，例如腓基 [2]
 - 237/36 . . 苯并咪唑 [2]
- 239/00 雜環化合物，含 1,3-二吡環或氫化 1,3-二吡環 [2]**
- 239/02 . 不與其他環稠合 [2]
 - 239/04 . . 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]

- 239/06 · · · · · 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 239/08 · · · · · 有雜原子直接連至位置 2 [2]
- 239/10 · · · · · 氧或硫原子 [2]
- 239/12 · · · · · 非硝基氮原子 [2]
- 239/14 · · · · · 僅有氫原子，烴基或取代之烴基，連至上述氮原子上 [2]
- 239/16 · · · · · 上述氮原子經鹽化者 [2]
- 239/18 · · · · · 有雜原子連至上述氮原子上，硝基除外，例如肼基 [2]
- 239/20 · · · · · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 239/22 · · · · · 有雜原子直接連至環碳原子上 [2]
- 239/24 · · · · · 環原子間或環原子與非環原子間有三條或更多雙鍵 [2]
- 239/26 · · · · · 僅有氫原子、烴基或取代的烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 239/28 · · · · · 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中最至多以一條鍵連鹵素之碳原子，直接連至環碳原子上 [2]
- 239/30 · · · · · 鹵素原子或硝基 [2]
- 239/32 · · · · · 一個氧，硫或氮原子 [2]
- 239/34 · · · · · 一個氧原子 [2]
- 239/36 · · · · · 以雙鍵連接之氧原子或未被取代的烴基 [2]
- 239/38 · · · · · 一個硫原子 [2]
- 239/40 · · · · · 以雙鍵連接之硫原子或未被取代的巯基 [2]
- 239/42 · · · · · 一個氮原子（硝基見 239/30） [2]
- 239/46 · · · · · 兩個或更多的氧、硫或氮原子 [2]
- 239/47 · · · · · 一個氮原子及一個氧或硫原子，如胞嘧啶 [3]
- 239/48 · · · · · 兩個氮原子 [2]
- 239/49 · · · · · 有一個芳烷基或被取代的芳烷基，連至位置 5 上，如三甲氧苄二胺嘧啶 [3]
- 239/50 · · · · · 三個氮原子 [2]
- 239/52 · · · · · 兩個氧原子 [2]
- 239/54 · · · · · 以雙鍵連接之氧原子或未被取代的烴基 [2]
- 239/54 · · · · · 有其他雜原子或有以三條鍵連雜原子、至多以一條鍵連鹵素之碳原子直接連至環碳原子上 [5]
- 239/553 · · · · · 有鹵原子或硝基直接連至環碳原子上，例如，氟尿嘧啶 [5]
- 239/557 · · · · · 有以三條鍵連雜原子、最多以一條鍵連鹵素之碳原子直接連至環碳原子上，例如，乳清酸（尿嘧啶-4-甲酸） [5]
- 239/56 · · · · · 一個氧原子及一個硫原子 [2]
- 239/58 · · · · · 兩個硫原子 [2]
- 239/60 · · · · · 三個或更多個氧原子或硫原子 [2,2006.01]
- 239/62 · · · · · 巴比妥酸 [2]
- 239/64 · · · · · 有機鹼之鹽；有機複合物 [2]
- 239/66 · · · · · 硫代巴比妥酸 [2]
- 239/68 · · · · · 有機鹼之鹽；有機複合物 [2]
- 239/69 · · · · · 苯磺醯胺基嘧啶 [3]
- 239/70 · · · · · 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 239/72 · · · · · 喹啉；氫化喹啉 [2]
- 239/74 · · · · · 僅有氫原子、烴基或取代的烴基，連至雜環之環碳原子

- 上 [2]
- 239/76 N-氧化物 [2]
- 239/78 有雜原子連至位置 2 上 [2]
- 239/80 氧原子 [2]
- 239/82 有一個芳基連至位置 4 上 [2]
- 239/84 氮原子 [2]
- 239/86 有雜原子直接連至位置 4 上 [2]
- 239/88 氧原子 [2]
- 239/90 有無環基連至位置 2 或 3 上 [2]
- 239/91 有芳基或芳烷基連至位置 2 或 3 [2]
- 239/92 有雜原子直接連至雜環之氮原子上
- 239/93 硫原子 [2]
- 239/94 氮原子 [2]
- 239/95 有雜原子直接連至位置 2 及 4 [2]
- 239/96 兩個氧原子 [2]

241/00 雜環化合物，含 1,4-二吡環或氫化 1,4-二吡環 [2]

附註

僅有氮原子直接連至環碳原子上之六氮吡啶分類見 295/00 目。[2]

- 241/02 . 不與其他環稠合 [2]
- 241/04 . . 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 241/06 . . 環原子間或環原子與非環原子間有一條或兩條雙鍵 [2]
- 241/08 . . . 有氮原子直接連至環碳原子上 [2]
- 241/10 . . 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]
- 241/12 . . . 僅有氮原子，烴基或取代的烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 241/14 . . . 有雜原子或有以三條鍵連雜

原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]

- 241/16 鹵素原子；硝基 [2]
- 241/18 氧或硫原子 [2]
- 241/20 氮原子（硝基見 241/16）[2]
- 241/22 苯磺醯胺基吡啶 [2]
- 241/24 以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基 [2]
- 241/26 有氮原子直接連至環碳原子上 [2]
- 241/28 其中與上述雜原子相連之碳原子以雙鍵連氧、硫或氮原子 [2, 5]
- 241/30 其中與上述雜原子連接之碳原子係 -C(=X)-X-C(=X)-X-結構之一部分，式中 X 為一個氧或硫原子或一個亞胺基，例如，亞胺基胍 [2,5]
- 241/32 (胺基—吡啶基) 胍 [2,5]
- 241/34 (胺基—吡啶甲醯胺基) 胍 [2]
- 241/36 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 241/38 . . 僅有氮或碳原子直接連在環氮原子上 [2]
- 241/40 . . . 苯并吡啶 [2]
- 241/42 僅有氮原子，烴基或取代的烴基，直接連至雜環之碳原子上 [2]
- 241/44 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、其中至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至雜環之碳原子上 [2]

- 241/46 . . . 啡啉 [2]
- 241/48 . . . 有為氮原子所取代之烴基，直接連至環氮原子上 [2]
- 241/50 . . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 241/52 . . . 氧原子 [2]
- 241/54 . . . 氮原子 [2]
- 243/00 雜環化合物，含七節環，有兩個氮原子成為僅有的雜環原子 [2]**
- 243/02 . 氮原子於位置 1 及 2 上 [2]
- 243/04 . 氮原子於位置 1 及 3 上 [2]
- 243/06 . 氮原子於位置上 1 及 4 上 [2]
- 243/08 . . 不與其他環稠合 [2]
- 243/10 . . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 243/12 . . . 1,5-苯二氮平；氫化 1,5-苯二氮平 [2]
- 243/14 . . . 1,4-苯二氮平；氫化 1,4-苯二氮平 [2]
- 243/16 於位置 5 上為芳基所取代 [2]
- 243/18 於位置 2 上為氮、氧或硫原子所取代 [2]
- 243/20 氮原子 [2]
- 243/22 硫原子 [2]
- 243/24 氧原子 [2]
- 243/26 由已有苯二氮平骨架之化合物製備 [2]
- 243/28 由不含雜環之化合物製備，包括建立苯二氮平骨架 [2]
- 243/30 由已含雜環之化合物製備，包括建立苯二氮平骨架 [2]
- 243/32 含有一個鄰苯二甲醯亞胺或氫化鄰苯二甲醯亞胺環系 [2]
- 243/34 含有一個喹唑啉或氫化喹唑啉環系 [2]
- 243/36 含有一個吡啶或氫化吡啶環系 [2]
- 243/38 . . . 與六節環 [b,e]—或 [b,f]—稠合 [2]
- 245/00 雜環化合物，含大於七節之環，有兩個氮原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 245/02 . 不與其他環稠合 [2]
- 245/04 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 245/06 . . 與一個六節環稠合 [2]
- 247/00 雜環化合物，含有兩個氮原子作為僅有的雜環原子之環，與 229/00 至 245/00 中一個以上之目相對應 [2]**
- 247/02 . 氮原子於位置 1 及 3 上 [2]
- 249/00 雜環化合物，五節環，有三個氮原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 249/02 . 不與其他環稠合 [2]
- 249/04 . . 1,2,3-三唑；氫化 1,2,3-三唑 [2]
- 249/06 . . . 有芳基直接連至環原子上 [2]
- 249/08 . . 1,2,4-三唑；氫化 1,2,4-三唑 [2]
- 249/10 . . . 有雜原子或有以三條鍵連接雜原子，其中至多以一條鍵連接鹵素之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 249/12 氧或硫原子 [2]
- 249/14 氮原子 [2]
- 249/16 . 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 249/18 . . 苯并三唑 [2]
- 249/20 . . . 有芳基直接連至位置 2 上 [2]
- 249/22 . . 苯并三唑 [2]
- 249/24 . . . 有 1,2-二苯乙烯基直接連至位置 2 上 [2]
- 251/00 雜環化合物，含 1,3,5-三吡環 [2]**
- 251/02 . 不與其他環稠合 [2]
- 251/04 . . 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 251/06 . . . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]

- 251/08 • • 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 251/10 • • 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵 [2]
- 251/12 • • 環原子間或環原子與非環原子間有三條雙鍵 [2]
- 251/14 • • • 有氮或碳原子直接連至至少一個環碳原子上 [2]
- 251/16 • • • • 僅連至一個環碳原子上 [2]
- 251/18 • • • • • 有氮原子直接連至其他兩個環碳原子上，例如，胍胺 [2]
- 251/20 • • • • • 無氮原子直接連至環碳原子上 [2]
- 251/22 • • • • • 連至兩個環碳原子上 [2]
- 251/24 • • • • • 連至三個環碳原子上 [2]
- 251/26 • • • • 僅有雜原子直接連至環碳原子上 [2]
- 251/28 • • • • 僅有鹵素原子，例如，氰尿酸 [2]
- 251/30 • • • • 僅有氧原子 [2]
- 251/32 • • • • • 氰尿酸；異氰尿酸 [2]
- 251/34 • • • • • 氰尿酸酯或異氰尿酸酯 [2]
- 251/36 • • • • • 有鹵素原子直接連至環氮原子上 [2]
- 251/38 • • • • • 硫原子 [2]
- 251/40 • • • • • 氮原子 [2]
- 251/42 • • • • • 一個氮原子 [2]
- 251/44 • • • • • 有鹵素原子連至其他兩個環碳原子上 [2]
- 251/46 • • • • • 有氮或硫原子連至其他兩個環碳原子上 [2]
- 251/48 • • • • • 兩個氮原子 [2]
- 251/50 • • • • • 鹵素原子連至第三環碳原子上 [2]
- 251/52 • • • • • 氧原子或硫原子連至第三環碳原子上 [2]
- 251/54 • • • • • 三個氮原子 [2]
- 251/56 • • • • • 三聚氰胺之製備 [2]
- 251/58 • • • • • 由氨脲、二氨脲或

氰氨化鈣 [2]

- 251/60 • • • • • 由尿素，或由二氧化碳及胺 [2]
- 251/62 • • • • • 三聚氰胺之純化 [2]
- 251/64 • • • • • 三聚氰胺及醛之縮合產物及其衍生物（縮聚產物見 C08G） [2]
- 251/66 • • • • • 雜原子直接連至三聚氰胺氮原子上之衍生物 [2]
- 251/68 • • • • • 三吡基胺基 1,2-二苯乙烯 [2]
- 251/70 • • • • • 其他取代之三聚氰胺 [2]
- 251/72 • 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 253/00 雜環化合物，含六節環，有三個氮原子作為僅有的雜環原子，未包括於 251/00 目內 [2]**
- 253/02 • 不與其他環稠合 [2]
- 253/04 • • 1,2,3-三吡 [2]
- 253/06 • • 1,2,4-三吡 [2]
- 253/065 • • • 環原子間或環原子與非環環原子間有三條雙鍵 [5]
- 253/07 • • • • 有雜原子，或有以三條鍵連雜原子、至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 253/075 • • • • • 兩個雜原子，於位置 3 及 5 [5]
- 253/08 • 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 253/10 • • 稠合的 1,2,4-三吡；氫化的稠合 1,2,4-三吡 [5]

255/00 雜環化合物，有三個氮原子作為僅有的雜環原子的環，不包括於 249/00 至 253/00 目內 [2]

- 255/02 • 不與其他環稠合 [2]
- 255/04 • 與碳環或碳環系稠合 [2]

257/00 雜環化合物，有四個氮原子作為僅有的雜環原子之環 [2]

- 257/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 257/04 · · 五節環 [2]
- 257/06 · · · 有氮原子直接連至環碳原子上 [2]
- 257/08 · · 六節環 [2]
- 257/10 · 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 257/12 · · 有四個氮原子之六節環 [2]

259/00 雜環化合物，有四個以上氮原子作為僅有的雜環原子之環 [2]

雜環化合物，僅有氮及氧作為雜環原子 [2]

261/00 雜環化合物，含有 1,2-噁唑環或氫化 1,2-噁唑環 [2]

- 261/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 261/04 · · 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 261/06 · · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條或更多條雙鍵 [2]
- 261/08 · · · 僅有氫原子、烴基或取代烴基直接連至環碳原子上 [2]
- 261/10 · · · 有雜原子或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至環碳原子 [2]
- 261/12 · · · · 氧原子 [2]
- 261/14 · · · · 氮原子 [2]
- 261/16 · · · · · 苯亞磺醯胺基異噁唑 [2]
- 261/18 · · · · 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵素原子之碳原子 [2]
- 261/20 · 與碳環或碳環系稠合 [2]

263/00 雜環化合物，含有 1,3-噁唑環或氫化 1,3-噁唑環 [2]

- 263/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 263/04 · · 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 263/06 · · · 有為氧原子所取代之烴基連至環碳原子上 [2]
- 263/08 · · 環原子間或環原子與非環原子

間有一條雙鍵 [2]

- 263/10 · · · 僅有氫原子、烴基或取代烴基直接連至環碳原子上 [2]
- 263/12 · · · · 有僅含氫原子及碳原子之基 [2]
- 263/14 · · · · 有為氧原子所取代之基 [2]
- 263/16 · · · 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 263/18 · · · · 氧原子上 [2]
- 263/20 · · · · · 連至位置 2 上 [2]
- 263/22 · · · · · 僅有氫原子，或僅含有氫原子及碳原子之基直接連至其他環碳原子上 [2]
- 263/24 · · · · · 有為氧原子所取代之烴基連至其他環碳原子上 [2]
- 263/26 · · · · · 有雜原子或醯基直接連至環氮原子上 [2]
- 263/28 · · · · 非硝基氮原子 [2]
- 263/30 · · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條或三條雙鍵 [2]
- 263/32 · · · 僅有氫原子、烴基或取代烴基，直接連至環碳原子上 [2]
- 263/34 · · · 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至環碳原子上 [2]
- 263/36 · · · · 一個氧原子 [2]
- 263/38 · · · · · 連至位置 2 上 [2]
- 263/40 · · · · · 連至位置 4 上 [2]
- 263/42 · · · · · 連至位置 5 上 [2]
- 263/44 · · · · 兩個氧原子 [2]
- 263/46 · · · · 硫原子 [2]
- 263/48 · · · · 非硝基氮原子 [2]
- 263/50 · · · · · 苯亞磺醯胺基噁唑 [2]
- 263/52 · 與碳環或碳環系稠合 [2]

- 263/54 • • 苯并𨾏唑；氫化苯并𨾏唑 [2]
 263/56 • • • 僅有氫原子、烴基或取代烴基，直接連至位置 2 上 [2]
 263/57 • • • • 芳基或取代的芳基 [5]
 263/58 • • • 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至位置 2 上 [2]
 263/60 • • 萘并𨾏唑；氫化萘并𨾏唑 [2]
 263/62 • • 含有稠合的 1, 3-𨾏唑環之兩個或更多個環系 [2]
 263/64 • • • 利用含有六節芳環或含該環之環系的鏈連接至位置 2 及 2' 上 [5]

265/00 雜環化合物，含六節環，有一個氮原子及一個氧原子作為僅有的雜環原子 [2]

附註

僅有氫原子連至環碳原子上之嗎啉分類見 295/00 目 [2]

- 265/02 • 1,2-𨾏啡；氫化 1,2-𨾏啡 [2]
 265/04 • 1,3-𨾏啡；氫化 1,3 𨾏啡 [2]
 265/06 • • 不與其他環稠合 [2]
 265/08 • • • 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
 265/10 • • • • 有氮原子直接連至環碳原子上 [2]
 265/12 • • 與碳環或碳環系稠合 [2]
 265/14 • • • 和一個六節環稠合 [2]
 265/16 • • • • 僅有氮原子或碳原子直接連至位置 2 及 4 上 [2]
 265/18 • • • • 有雜原子直連至位置 2 上 [2]
 265/20 • • • • 有雜原子直接連至位置 4 上 [2]
 265/22 • • • • • 氧原子 [2]
 265/24 • • • • 有雜原子直接連至位置 2 及 4 上 [2]
 265/26 • • • • • 兩個氧原子，例如氧化

旋紅酸酐 [2]

- 265/28 • 1,4-𨾏啡；氫化 1,4-𨾏啡 [2]
 265/30 • • 不與其他環稠合 [2]
 265/32 • • • 有氮原子直接連至環碳原子上 [2]
 265/33 • • • • 兩個氧原子，於位置 3 及 5 上 [5]
 265/34 • • 與碳環稠合 [2]
 265/36 • • • 與一個六節環稠合 [2]
 265/38 • • • 與兩個六節環 [b,e]-稠合 [2]
267/00 雜環化合物，含大於六節之環，有一個氮原子及一個氧原子作為僅有的雜環原子者 [2]
 267/02 • 七節環 [2]
 267/04 • • 於位置 1 及 2 上有雜原子 [2]
 267/06 • • 於位置 1 及 3 上有雜原子 [2]
 267/08 • • 於位置 1 及 4 上有雜原子 [2]
 267/10 • • • 不與其他環稠合 [2]
 267/12 • • • 與碳環或碳環系稠合 [2]
 267/14 • • • • 與一個六節環稠合 [2]
 267/16 • • • • 與兩個六節環稠合 [2]
 267/18 • • • • • [b,e]-稠合 [2]
 267/20 • • • • • [b,f]-稠合 [2]
 267/22 • 八節環 [2]

269/00 雜環化合物，有一個氮原子與一個氧原子作為僅有的雜環原子之環，與 261/00 至 267/00 內一個以上之目相對應 [2]

269/02 • 位置 1 及 3 上有雜原子 [2]

271/00 雜環化合物，含五節環，有兩個氮原子及一個氧原子作為僅有的雜環原子 [2]

- 271/02 • 不與其他環稠合 [2]
 271/04 • • 1,2,3-𨾏二唑；氫化 1,2,3-𨾏二唑 [2]
 271/06 • • 1,2,4-𨾏二唑；氫化 1,2,4-𨾏二唑； [2]
 271/07 • • • 有氮、硫或氮原子直接連至環碳原子上，氮原子為非硝基形式 [5]

- 271/08 · · 1,2,5-噁二唑；氫化 1,2,5-噁二唑 [2]
- 271/10 · · 1,3,4-噁二唑；氫化 1,3,4-噁二唑 [2]
- 271/107 · · · 有兩個芳基或取代的芳基連至位置 2 及 5 上 [5]
- 271/113 · · · 有氮，硫或氮原子直接連至環碳原子上，氮原子係非硝基形式 [5]
- 271/12 · 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 273/00 雜環化合物，有氮原子及氧原子作為僅有的雜環原子之環，未包括於 261/00 至 271/00 目 [2]**
- 273/01 · 有一個氮原子 [3]
- 273/02 · 有兩個氮原子及僅有一個氧原子 [2]
- 273/04 · · 六節環 [2]
- 273/06 · · 七節環 [2]
- 273/08 · 有兩個氮原子及一個以上之氧原子 [3]
- 雜環化合物，僅有氮原子及硫原子作為雜環原子 [2]**
- 275/00 雜環化合物，含有 1,2-噻唑或氫化 1,2-噻唑環 [2]**
- 275/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 275/03 · · 有雜原子或有以三條鍵連雜原子、至多以一條鍵連鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [5]
- 275/04 · 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 275/06 · · 有雜原子直接連至環硫原子上 [2]
- 277/00 雜環化合物，含有 1,3-噻唑或氫化 1,3-噻唑環 [2]**
- 277/02 · 不與其他環稠合 [2]
- 277/04 · · 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 277/06 · · · 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵素原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 277/08 · · 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵 [2]
- 277/10 · · · 僅有氮原子、鹵基或取代鹵基，直接連至環碳原子上 [2]
- 277/12 · · · 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵素原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 277/14 · · · · 氧原子 [2]
- 277/16 · · · · 硫原子 [2]
- 277/18 · · · · 氮原子 [2]
- 277/20 · · 環原子間或環原子與非環原子間有兩條或三條雙鍵 [2]
- 277/22 · · · 僅有氮原子、鹵基或取代鹵基，直接連至環碳原子上 [2]
- 277/24 · · · · 為氧原子所取代之基 [2]
- 277/26 · · · · 為硫原子所取代之基 [2]
- 277/28 · · · · 為氮原子所取代之基 [2]
- 277/30 · · · · 為有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵素原子之碳原子所取代的鹵基，例如酯基或腓基 [2]
- 277/32 · · · 雜原子或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵素原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 277/34 · · · · 氧原子 [2]
- 277/36 · · · · 硫原子 [2]
- 277/38 · · · · 氮原子 [2]
- 277/40 · · · · · 未被取代的胺基或亞胺基 [2]
- 277/42 · · · · · 為鹵基或取代鹵基所取代之胺基或亞胺基 [5]
- 277/44 · · · · · 經醯基化的胺基或亞胺基 [2]
- 277/46 · · · · · 由羧酸或其硫或氮之類似物而成者 [2]

- 277/48 由碳酸或其硫或氮之類似物衍生的基而成者，例如碳醯肼 [2]
- 277/50 連接雜原子之氮原子 [2]
- 277/52 連接硫原子，例如，磺醯胺類 [2]
- 277/54 氮及氧原子或氮及硫原子 [2]
- 277/56 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子 [2]
- 277/58 硝基 [2]
- 277/587 有為以三條鍵連雜原子、至多以一條鍵連鹵素，例如，酯基或腈基之碳原子，取代的脂肪族烴基直接連至環碳原子上，所謂脂肪族基係於連接環之 α 一位上為一個雜原子所取代者，例如，
- $$\begin{array}{c} \text{-N} \\ \text{+} \quad \text{+} \quad \text{C} - (\text{CH}_2)_m - \text{C} \begin{array}{l} \diagup \\ \text{Z} \end{array} \\ \text{S} \quad \text{||} \end{array}$$
- 其中 $m \geq 0$ (Z 表示單鍵或雙鍵連接之雜原子) [5]
- 277/593 Z 為雙鍵氧或雙鍵氮，其中氮可為取代的肟基之一部分 [5]
- 277/60 與碳環或環系稠合 [2]
- 277/62 苯并噻唑 [2]
- 277/64 僅有烴基及取代的烴基連接於位置 2 上 [2]
- 277/66 有芳環或芳環系直接連至位置 2 上 [2]
- 277/68 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至位置 2 上 [2]
- 277/70 硫原子 [2]
- 277/72 2-巰基苯并噻唑 [2]
- 277/74 硫原子為碳原子所取代者 [2]

- 277/76 硫原子連至第二個雜原子上 [2]
- 277/78 連至第二個硫原子上 [2]
- 277/80 連至氮原子上 [2]
- 277/82 氮原子 [2]
- 277/84 蔡并噻唑 [2]
- 279/00 雜環化合物，含六節環，有一個氮原子及一個硫原子作為僅有的雜環原子 [2]**

附註

僅有氮原子連至環碳原子上之硫嗎啉分類見 295/00 目 [2]

- 279/02 1,2-噻吩；氫化 1,2-噻吩 [2]
- 279/04 1,3-噻吩；氫化 1,3-噻吩 [2]
- 279/06 不與其他環稠合 [2]
- 279/08 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 279/10 1,4-噻吩；氫化 1,4-噻吩 [2]
- 279/12 不與其他環稠合 [2]
- 279/14 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 279/16 與一個六節環稠合 [2]
- 279/18 與兩個六節環 [b,e]-稠合 [2]
- 279/20 有氮原子直接連至環氮原子上 [2]
- 279/22 有碳原子直接連至環氮原子上 [2]
- 279/24 有為胺基所取代之烴基直接連至環氮原子上 [2]
- 279/26 無其他取代基連至環系上 [2]
- 279/28 有其他取代基連至環系上 [2]
- 279/30 有醯基連至環氮原子上 [2]
- 279/32 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]
- 279/34 有雜原子直接連至環硫原子上 [2]
- 279/36 [b,e]-稠合，至少有一個附

有另一個稠合苯環 [2]

**281/00 雜環化合物，含大於六節之環，
有一個氮原子與一個硫原子作
為僅有的雜環原子 [2]**

281/02 · 七節環 [2]

281/04 · · 雜原子於位置 1,4 上 [2]

281/06 · · · 不與其他環稠合 [2]

281/08 · · · 與碳環系稠合 [2]

281/10 · · · · 與一個六節環稠合 [2]

281/12 · · · · 與兩個六節環稠合 [2]

281/14 · · · · · [b,e]—稠合 [2]

281/16 · · · · · [b,f]—稠合 [2]

281/18 · 八節環 [2]

**283/00 雜環化合物，有一個氮原子及一
個硫原子作為僅有的雜環原子
之環，與 275/00 至 281/00 內一
個以上之目相對應 [2]**

283/02 · 雜原子於位置 1 及 3 上 [2]

**285/00 雜環化合物，有氮原子及硫原子
作為僅有的雜環原子之環，未包
括於 275/00 至 283/00 目內 [2]**

285/01 · 五節環 [5]

285/02 · · 噻二唑；氫化噻二唑 [2,5]

285/04 · · · 不與其他環稠合 [2,5]

285/06 · · · · 1,2,3-噻二唑；氫化 1,2,3-
噻二唑 [2,5]

285/08 · · · · 1,2,4-噻二唑；氫化 1,2,4-
噻二唑 [2,5]

285/10 · · · · 1,2,5-噻二唑；氫化 1,2,5-
噻二唑 [2,5]

285/12 · · · · 1,3,4-噻二唑；氫化 1,3,4-
噻二唑 [2,5]

285/125 · · · · · 有氮、硫或氮原子直接
連至環碳原子上，氮原
子係非硝基氮原子 [5]

285/13 · · · · · 氧原子 [5]

285/135 · · · · · 氮原子 [5]

285/14 · · · 與碳環或碳環系稠合 [2,5]

285/15 · 六節環 [5]

285/16 · · 噻二唑；氫化噻二唑 [2,5]

285/18 · · · 1,2,4-噻二唑；氫化 1,2,4-噻
二唑 [2,5]

285/20 · · · · 與碳環或碳環系稠合 [2,5]

285/22 · · · · · 與一個六節環稠合 [2,5]

285/24 · · · · · 有氮原子直接連至環
硫原子上 [2,5]

285/26 · · · · · 於位置 6 或 7 上，
為胺磺基或取
代的胺磺基所
取代 [2,5]

285/28 · · · · · 僅有氮原子，或
僅含氮和碳原子
之基，直接連至
位置 3 上 [2,5]

285/30 · · · · · 有為雜原子所取
代之基連至位
置 3 上 [2,5]

285/32 · · · · · 有雜原子，或有
三條鍵連雜原
子，其中至多有
一條鍵連鹵素原
子之碳原子，例
如酯基或腈基，
直接加至位置 3
上 [2,5]

285/34 · · · 1,3,5-噻二唑，氫化 1,3,5-噻
二唑 [2,5]

285/36 · 七節環 [2]

285/38 · 八節環 [2]

**291/00 雜環化合物，含有氮、氧及硫原
子作為僅有的雜環原子之環 [2]**

291/02 · 不與其他環稠合 [2]

291/04 · · 五節環 [2]

291/06 · · 六節環 [2]

291/08 · 與碳環或碳環系稠合 [2]

**293/00 雜環化合物，含有氮與硫或氮與
磷，有或無氧或硫原子，作為雜
環原子之環 [2]**

293/02 · 不與其他環稠合 [2]

293/04 · · 五節環 [2]

293/06 · · · 噻唑；氫化噻唑 [2]

- 293/08 · · 六節環 [2]
- 293/10 · 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 293/12 · · 硒唑；氫化硒唑 [2]
- 295/00 雜環化合物，含有多亞甲基亞胺環，至少有五節環，3-氮雜二環 [3.2.2]—壬烷，六氫吡啶，嗎啉或硫嗎啉環，僅有氮原子直接連至環碳原子上 [2]**
- 295/02 · 除環雜元素外，僅含氮原子及碳原子 [2]
- 295/023 · · 製備；分離；穩定化；使用添加劑 [5]
- 295/027 · · 僅含一個雜環 [5]
- 295/03 · · · 有環氮原子直接連至非環碳原子上 [5]
- 295/033 · · · 有環氮原子直接連至碳環上 [5]
- 295/037 · · 有第 4 級氮原子 [5]
- 295/04 · 有為雜原子所取代之烴基，連至環氮原子上 [2]
- 295/06 · · 為鹵原子或硝基所取代 [2]
- 295/067 · · · 有環氮原子及取代的基連至同一碳鏈上，該碳鏈不為碳環斷開 [5]
- 295/073 · · · 有為碳環或為碳環斷開之碳鏈分隔開的環氮原子及取代基 [5]
- 295/08 · · 為以單鍵鍵合之氧或硫原子取代 [2]
- 295/084 · · · 有環氮原子及氧或硫原子連至同一碳鏈上，該碳鏈不為碳環斷開 [5]
- 295/088 · · · · 連至一個無環之飽和鏈上 [5]
- 295/092 · · · · 有芳基連至該鏈上 [5]
- 295/096 · · · · 有為碳環或為碳環所斷開的碳鏈分隔之環氮原子及氧或硫原子 [5]
- 295/10 · · 為以雙鍵鍵合之氧或硫原子所取代 [2]
- 295/104 · · · 有環氮原子及雙鍵氧或硫原子連至同一碳鏈上，該碳鏈不為碳環所斷開 [5]
- 295/108 · · · · 連至一個無環的飽和鏈上 [5]
- 295/112 · · · 有為碳環或為碳環斷開的碳鏈所隔開之環氮原子及雙鍵氧或硫原子 [5]
- 295/116 · · · · 有雙鍵氧或硫原子直接連至碳環上 [5]
- 295/12 · · 為以單鍵或雙鍵鍵合之氮原子取代（硝基見 295/06）[2]
- 295/125 · · · 有環氮原子及取代基氮原子連至同一碳鏈上，該碳鏈不為碳環所斷開 [5]
- 295/13 · · · · 連至無環的飽和鏈上 [5]
- 295/135 · · · 有為碳環或為碳環斷開之碳鏈所隔開之環氮原子及取代基氮原子 [5]
- 295/14 · · 為碳原子所取代，碳原子有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵結合鹵素原子之碳原子，例如酯基或腈基所取代 [2]
- 295/145 · · · 有環氮原子及以三條鍵連雜原子之碳原子連至同一碳鏈上，該碳鏈不為碳環所斷開 [5]
- 295/15 · · · · 連至一個無環之飽和鏈上 [5]
- 295/155 · · · 有環氮原子及以三條鍵連雜原子之碳原子為碳環或為碳環所斷開之碳鏈分隔開 [5]
- 295/16 · 環氮原子經鹼基化者 [2]
- 295/18 · · 為羧酸或羧酸之硫或氮之類似物所衍生之基而成的鹼基化物 [2]
- 295/182 · · · 由羧酸所衍生之基 [5]
- 295/185 · · · · 由脂肪羧酸所衍生之基 [5]
- 295/192 · · · · 由芳香羧酸所衍生之基 [5]
- 295/194 · · · 由硫代羧酸或硫羧酸所衍生之基 [5]
- 295/195 · · · 由羧酸之氮類似物所衍生之基 [5]
- 295/20 · · 為由碳酸，或其硫或氮之類似

物所衍生之基者 [5]

295/205 . . . 由碳酸所衍生之基 [5]

295/21 . . . 由碳酸之硫類似物所衍生之基 [5]

295/215 . . . 由碳酸之氮類似物所衍生之基 [5]

295/22 . 有雜原子直接連至環氮原子上 [2]

295/24 . . 氧原子 [5]

295/26 . . 硫原子 [5]

295/28 . . 氮原子 [5]

295/30 . . . 非醯化 [5]

295/32 . . . 用羧酸或碳酸，或此等之氮或硫類似物所醯化者 [5]

雜環化合物，含有氧原子，附有或不附有硫、硒或碲原子，作為雜環原子 [2]

301/00 環氧乙烷之製備 [2]

301/02 . 環氧乙烷環之合成 [2]

301/03 . . 利用不飽和化合物之氧化，或利用不飽和化合物與飽和化合物之混合物的氧化 [3]

301/04 . . . 用空氣或分子氧者 [2,3]

301/06 於液相內進行 [2,3]

301/08 於氣相內進行 [2,3]

301/10 用含銀或金之催化劑 [2,3]

301/12 . . . 用過氧化氫或無機過氧化物或過酸者 [2,3]

301/14 . . . 用有機過酸，或其鹽、酐或酯者 [2,3]

301/16 由原地形成之有機過酸或其鹽，其酐或其酯類而引起之氧化，例如由羧酸及過氧化氫所形成者 [2,3]

301/18 由多元羧酸者 [2,3]

301/19 . . . 用有機過氧化氫者 [3]

301/22 . . 利用空氣或分子氧氧化飽和化合物（飽和與不飽和化合物之混合物的氧化見 301/04） [2]

301/24 . . 由含有 Hal-C-C-OY 基之化合

物脫除 Hal-Y 者 [2]

301/26 . . . Y 係氫者 [2]

301/27 . 表鹵代醇或鹵代醇與含活性氫原子之化合物間的縮合（高分子化合物見 C08） [3]

301/28 . . 利用與羥基反應者 [2,3]

301/30 . . 利用與羧基反應者 [2,3]

301/32 . 分離；純化 [2]

301/36 . 使用添加劑，例如，為安定化者 [3]

303/00 雜環化合物，含三節環，含有一個氧原子作為僅有的雜環原子 [2]

303/02 . 含環氧乙烷環之化合物 [2]

303/04 . . 除環氧原子外，僅含氫及碳原子 [2]

303/06 . . . 其中環氧乙烷環與一個碳環系稠合，此碳環系有三個或更多相關環 [2]

303/08 . . 有為鹵原子、硝基或亞硝基所取代之羥基 [2]

303/10 . . . 其中環氧乙烷環與一個碳環系稠合，此碳環系有三個或更多個相關環 [2]

303/12 . . 有為單鍵或雙鍵鍵合之氧原子所取代之羥基 [2]

303/14 . . . 為游離羥基所取代者 [2]

303/16 . . . 為酯化羥基所取代者 [2]

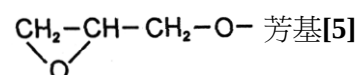
303/17 含有與碳環系稠合之環氧乙烷環，此碳環系有三個或更多個相關環 [3]

303/18 . . . 經醚化之羥基所取代者 [2]

303/20 與不含環氧乙烷環之羥基化合物而成之醚 [2]

303/22 與單羥基化合物而成之醚 [2]

303/23 有一個羥基連六節芳環之化合物的環氧乙烷基甲基醚，該環氧乙烷基甲基不再進一步被取代者，即



- 303/24 與多羥基化合物而成之
醚 [2]
- 303/26 有一個或多個游離羥
基者 [2]
- 303/27 有全部為含環氧乙烷
化合物醚化之羥基
- 303/28 與含環氧乙烷環之羥基化
合物而成之醚 [2]
- 303/30 所有羥基與含環氧乙烷
之羥基化合物醚化之含
有環氧乙烷環之多羥基
化合物而成之醚 [2]
- 303/31 與環氧乙烷環有三個或更
多個相關環之碳環系稠合
者 [3]
- 303/32 由醛基或酮基而成者 [2]
- 303/34 具有為硫、硒或碲原子所取代
之羥基者 [2]
- 303/36 有為氮原子所取代之羥基（硝
基，亞硝基見 303/08） [2]
- 303/38 有為以三條鍵連雜原子，其中
至多有一條鍵連鹵原子之碳
原子，例如酯基或腈基所取代
之羥基 [2]
- 303/40 由酯基所取代者 [2]
- 303/42 無環化合物，有一條七個
或更多個碳鏈者，例如環
氧化油脂 [2]
- 303/44 用含環氧乙烷環之羥基化
合物酯化者 [2]
- 303/46 為鹽胺或腈基所取代者 [2]
- 303/48 有雜原子，或有三條鍵連雜原
子，其中至多有一條鍵連鹵原
子之碳原子，例如酯基或腈
基，直接連至環碳原子上 [3]

**305/00 雜環化合物，含四節環，含有一
個氧原子作為僅有的雜環原子
[2]**

- 305/02 不與其他環稠合 [2]
- 305/04 環原子間或環原子與非環原子
間無雙鍵 [2]

- 305/06 僅有氫原子、羥基或取代羥
基，直接連至環原子上 [2]
- 305/08 有雜原子，或有三條鍵連雜
原子，其中至多有一條鍵連
鹵原子之碳原子，例如酯基
或腈基，直接連至環原子上
[2]
- 305/10 環原子間或環原子與非環原子
間有一條或更多條雙鍵 [2]
- 305/12 β -內酯 [2]
- 305/14 與碳環或碳環系稠合 [2]

**307/00 雜環化合物，含五節環，含有一
個氧原子作為僅有的雜環原子
[2]**

- 307/02 不與其他環稠合 [2]
- 307/04 環原子間或環原子與非環原子
間無雙鍵 [2]
- 307/06 僅有氫原子或僅含有氫原子
及碳原子之基直接連至環
碳原子上 [2]
- 307/08 四氫呋喃之製備 [2]
- 307/10 有為雜原子取代之羥基連至
環碳原子上 [2]
- 307/12 為氧原子所取代之基 [2]
- 307/14 為非硝基氮原子所取代之
基 [2]
- 307/16 為有三條鍵連雜原子，其
中至多有一條鍵連鹵原子
之碳原子，例如酯基或腈
基，直接連至環碳原子上
[2]
- 307/18 有雜原子，或有三條鍵連雜
原子，其中至多有一條鍵連
鹵原子之碳原子，例如酯基
或腈基，直接連至環碳原子
上 [2]
- 307/20 氧原子 [2]
- 307/22 非硝基氮原子 [2]
- 307/24 有三條鍵連雜原子其中至
多有一條鍵連鹵原子之碳
原子 [2]
- 307/26 環原子間或環原子與非環原子

- 間有一條雙鍵 [2]
- 307/28 . . . 僅有氫原子，烴基或取代烴基直接連至環碳原子上 [2]
- 307/30 . . . 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 307/32 . . . 氧原子 [2]
- 307/33 . . . 於位置 2 上，氧原子為酮基或非取代之烯醇形式 [5]
- 307/34 . . 環原子間或環原子與非環原子間有兩條或三條雙鍵者 [2]
- 307/36 . . . 僅有氫原子，或僅含有氫原子及碳原子之基，直接連至環碳原子上者 [2]
- 307/38 . . . 有為雜原子所取代之烴基連至環碳原子上 [2]
- 307/40 . . . 為氧原子所取代之基 [2]
- 307/42 . . . 為單鍵鍵合之氧原子 [2]
- 307/44 . . . 糠醇 [2]
- 307/45 . . . 氧原子為有含有環丙烷之羧酸鹽基所鹽化者，例如菊甲酸酯 [3]
- 307/46 . . . 雙鍵鍵合之氧原子，或兩個以單鍵連至同一碳原子上之氧原子 [2]
- 307/48 . . . 糠醛 [2]
- 307/50 . . . 由天然物製備 [2]
- 307/52 . . . 為非硝基氮原子所取代之基 [2]
- 307/54 . . . 為有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上 [2]
- 307/56 . . . 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子
- 上者 [2]
- 307/58 . . . 一個氧原子，例如丁烯羧酸內酯 [2]
- 307/60 . . . 兩個氧原子，例如丁二酸酐 [2]
- 307/62 . . . 三個氧原子，例如抗壞血酸 [2]
- 307/64 . . . 硫原子 [2]
- 307/66 . . . 氮原子 [2]
- 307/68 . . . 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子 [2]
- 307/70 . . . 硝基 [2]
- 307/71 . . . 連至位置 5 上 [2]
- 307/72 . . . 有為含氮之基所取代的烴基連至位置 2 上 [2]
- 307/73 . . . 為胺基或亞胺基，或為取代的胺基或取代的亞胺基而成者 [2]
- 307/74 . . . 為胍基或亞胍基，或經取代之胍基或亞胍基而成者 [2]
- 307/75 . . . 有羧酸鹽基或其硫或氮之類似物者，直接連接胍基或亞胍基，例如鹽胍 [2]
- 307/76 . . . 有碳酸鹽基或其硫或氮之類似物，直接連接胍基或亞胍基，如胺脲 [2,3]
- 307/77 . 與碳環或碳環系鄰位或迫位稠合
- 307/78 . . 苯并[b]呋喃；氫化苯并[b]呋喃 [2]
- 307/79 . . . 僅有氫原子、烴基或取代烴基，直接連至雜環之碳原子上者 [2]
- 307/80 . . . 為氧原子所取代之基 [2]

- 307/81 為非硝基氮原子所取代之基 [2]
- 307/82 . . . 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至雜環碳原子上者 [2]
- 307/83 氧原子 [2]
- 307/84 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子上 [2]
- 307/85 連至位置 2 上 [2]
- 307/86 . . . 有一個氧原子直接連至位置 7 上者 [2]
- 307/87 . . 苯并[c]呋喃；氫化苯并[c]呋喃 [2]
- 307/88 . . . 有一個氧原子直接連至位置 1 或 3 上者 [2]
- 307/885 3,3-二苯基苯酞 [5]
- 307/89 . . . 有兩個氧原子直接連至位置 1 及 3 [2]
- 307/90 . . . 有一個氧原子於位置 1 上，且一個氮原子於位置 3 上，或反之 [2]
- 307/91 . . 二苯并呋喃；氫化二苯并呋喃 [2]
- 307/92 . . 萘并呋喃；氫化萘并呋喃 [2]
- 307/93 . . 與非六節環稠合者 [2]
- 307/935 . . . 不與其他環稠合之環戊基[b]呋喃或氫化環戊基[b]呋喃 [3]
- 307/937 有烴基或取代的烴基直接連至位置 2 上者，例如，前列腺環素 [5]
- 307/94 . 與碳環或碳環系之螺稠合者，例如灰黃黴素 [2]
- 309/00 雜環化合物，含六節環，有一個氧原子作為僅有的雜環原子，不與其他環稠合 [2]**
- 309/02 . 環原子間或環原子與非環原子間無雙鍵 [2]
- 309/04 . . 僅有氮原子、烴基或取代烴基直接連至環碳原子上者 [2]
- 309/06 . . . 為氧原子所取代之基 [2]
- 309/08 . . 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上者 [2]
- 309/10 . . . 氧原子 [2]
- 309/12 僅有氮原子及一個氧原子直接連至環碳原子上，例如四氫吡喃酮 [2]
- 309/14 . . . 非硝基氮原子 [2]
- 309/16 . 環原子間或環原子與非環原子間有一條雙鍵者 [2]
- 309/18 . . 除雜環原子外僅含有氮及碳原子者 [2]
- 309/20 . . 有氮原子及取代烴基直接連至環碳原子上者 [2]
- 309/22 . . . 為氧原子所取代之基 [2]
- 309/24 羥甲基 [2]
- 309/26 羧醛基 [2]
- 309/28 . . 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上者 [2]
- 309/30 . . . 氧原子，例如 δ -內酯 [2]
- 309/32 . 環原子間或環原子與非環原子間有兩條雙鍵者 [2]
- 309/34 . 環原子間或環原子與非環原子間有三條或更多條雙鍵者 [2]
- 309/36 . . 有氧原子直接連至環碳原子上者 [2]
- 309/38 . . . 一個氧原子於位置 2 或 4 上，例如吡喃酮 [2]
- 309/40 . . . 氧原子連至位置 3 及 4 上，例如麥芽酚(2-甲基-3-羥基- γ -吡喃酮) [2]
- 311/00 雜環化合物，含六節環，有一個氧原子作為僅有的雜環原子，與其他環稠合 [2]**
- 311/02 . 與碳環或碳環系鄰位或迫位稠合

- 者 [2]
- 311/04 · · · 碳環未氫化之苯并[b]吡喃 [2]
- 311/06 · · · 有氮原子或硫原子直接連至位置 2 上者 [2]
- 311/08 · · · · 雜環未氫化者 [2]
- 311/10 · · · · · 未取代者 [2]
- 311/12 · · · · · 於位置 3 上取代而於位置 7 上未取代者 [2]
- 311/14 · · · · · 於位置 6 上取代而於位置 7 上未取代者 [2]
- 311/16 · · · · · 於位置 7 上取代者 [2]
- 311/18 · · · · · 除於位置 3 或 7 以外之位置上取代者 [2]
- 311/20 · · · · 雜環經氫化者 [2]
- 311/22 · · · 有氮原子或硫原子直接連至位置 4 上 [2]
- 311/24 · · · · 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至位置 2 上 [2]
- 311/26 · · · · 有芳族環連至位置 2 或 3 上者 [2]
- 311/28 · · · · · 有芳族環僅連至位置 2 上者 [2]
- 311/30 · · · · · 雜環未予氫化者，例如黃酮 [2]
- 311/32 · · · · · 2,3-二氫化衍生物，例如黃烷酮 [2]
- 311/34 · · · · · 有芳環僅連至位置 3 上者 [2]
- 311/36 · · · · · 雜環未予氫化者，例如異黃酮 [2]
- 311/38 · · · · · 2,3-二氫化衍生物，例如異黃烷酮 [2]
- 311/40 · · · · · 分離，例如由天然原料分離：純化 [2]
- 311/42 · · · 有氮原子或硫原子於位置 2 及 4 上者 [2]
- 311/44 · · · · 有一個氮原子於位置 3 上者 [2]
- 311/46 · · · · · 碳環未取代者
- 311/48 · · · · · 有兩個以碳鏈連接之苯并吡喃基者 [2]
- 311/50 · · · · · 於位置 3 上有除碳及氮外之元素者 [2]
- 311/52 · · · · · 烯醇酯或醚，或此等之硫之類似物 [2]
- 311/54 · · · · · 碳環經取代者 [2]
- 311/56 · · · · 於位置 3 上無氮原子者 [2]
- 311/58 · · · 除於位置 2 或 4 上附氮原子或硫原子以外者 [2]
- 311/60 · · · · 有芳基連至位置 2 上者 [2]
- 311/62 · · · · · 有氮原子直接連至位置 3 上者，例如花色素 [2]
- 311/64 · · · · 有氮原子直接連至位置 8 上者 [2]
- 311/66 · · · · 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，如酯基或腈基，直接連至位置 2 上者 [2]
- 311/68 · · · · 氮原子直接連至位置 4 上者 [2]
- 311/70 · · · · 有兩個烴基連至位置 2 及除碳及氮以外之元素連至位置 6 上者 [2]
- 311/72 · · · · · 3,4-二氫化衍生物，至少於位置 2 上有一個甲基及於位置 6 上有一個氮原子者，例如維生素 E [2]
- 311/74 · · 碳環經氫化之苯并[b]吡喃 [2]
- 311/76 · · 苯并[c]吡喃 [2]
- 311/78 · · 有三個或更多個相關環之環系 [2]
- 311/80 · · · 二苯并吡喃；氫化二苯并吡喃 [2]
- 311/82 · · · · 氧雜蒽 [2]
- 311/84 · · · · · 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至位置 9 上者 [2]
- 311/86 · · · · · 氧原子，例如氧雜蒽酮 [2]

- 311/88 氮原子 [2]
- 311/90 有為胺基所取代之烴基
直接連至位置 9 上者
[2]
- 311/92 蔡并哌喃；氫化蔡并哌喃
- 311/94 與非六節環或含有六節環之環
系稠合者 [2,5]
- 311/96 與碳環或碳環系螺稠合者 [2]
- 313/00 雜環化合物，含有大於六節之
環，有一個氧原子作為僅有的雜
環原子 [2]**
- 313/02 七節環 [2]
- 313/04 不與其他環稠合者 [2]
- 313/06 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 313/08 與一個六節環稠合者 [2]
- 313/10 與兩個六節環稠合者 [2]
- 313/12 [b,e]—稠合 [2]
- 313/14 [b,f]—稠合 [2]
- 313/16 八節環 [2]
- 313/18 不與其他環稠合者 [2]
- 313/20 與碳環或碳環系稠合 [2]
- 315/00 雜環化合物，含有一個氧原子作
為僅有的雜環原子之環，與
303/00 至 313/00 內一個以上之
目相對應 [2]**
- 317/00 雜環化合物，含五節環，有兩個
氧原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 317/02 於位置 1 及 2 上有雜原子者 [2]
- 317/04 不與其他環稠合者 [2]
- 317/06 與碳環或環系稠合 [2]
- 317/08 於位置 1 及 3 有雜原子 [2]
- 317/10 不與其他環稠合者 [2]
- 317/12 僅有氫原子或僅含有氫原子
及碳原子之基，直接連至環
碳原子上者 [2]
- 317/14 有為雜原子所取代之烴基連
至碳原子上 [2]
- 317/16 為鹵原子或硝基所取代之
基 [2]
- 317/18 為以單鍵鍵合之氧原子或
硫原子所取代之基 [2]
- 317/20 游離烴基或硫醇 [2]
- 317/22 經醚化者 [2]
- 317/24 經酯化者 [2]
- 317/26 為以雙鍵鍵合之氧原子或
硫原子所取代之基；或為
以單鍵鍵合之兩個此等原
子連至同一個碳原子上所
取代之基 [2]
- 317/28 為氮原子所取之基（硝基
見 317/16）[2]
- 317/30 為有三條鍵連雜原子，其
中至多有一條鍵連鹵原子
之碳原子，例如酯基或腈
基所取代之基 [2]
- 317/32 有雜原子，或有三條鍵連雜
原子，其中至多有一條鍵連
鹵原子之碳原子，例如酯基
或腈基，直接連至環碳原子
上者 [2]
- 317/34 氧原子 [2]
- 317/36 碳酸亞烴酯；取代的碳
酸亞烴酯 [2]
- 317/38 碳酸亞乙酯 [2]
- 317/40 碳酸亞乙烯酯；取代的
碳酸亞乙烯酯 [2]
- 317/42 鹵原子或硝基 [2]
- 317/44 與碳環或碳環系鄰位或迫位稠
合者 [2]
- 317/46 與一個六節環稠合者 [2]
- 317/48 雜環未取代之亞甲二氧基
苯或氫化亞甲二氧基苯之
上 [2]
- 317/50 僅有氮原子、烴基或取
代烴基，直接連至環碳
原子上者 [2]
- 317/52 為鹵原子或硝基所取
代之基 [2]
- 317/54 為氧原子所取代之基
[2]
- 317/56 為硫原子所取代之基
[2]

- 317/58 為氮原子所取代之基
(硝基見 317/52) [2]
- 317/60 為有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基所取代之基 [2]
- 317/62 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腈基，直接連至碳環之原子上 [2]
- 317/64 氧原子 [2]
- 317/66 非硝基氮原子 [2]
- 317/68 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子 [2]
- 317/70 . . . 與含有兩個或更多個相關環之環系稠合者 [2]
- 317/72 . . 與碳環螺稠合者 [2]
- 319/00 雜環化合物，含六節環，有兩個氧原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 319/02 . 1,2-二噁烷；氫化 1,2-二噁烷 [2]
- 319/04 . 1,3-二噁烷；氫化 1,3-二噁烷 [2]
- 319/06 . . 不與其他環稠合者 [2]
- 319/08 . . 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 319/10 . 1,4-二噁烷；氫化 1,4-二噁烷 [2]
- 319/12 . . 不與其他環稠合者 [2]
- 319/14 . . 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 319/16 . . . 與一個六節環稠合者 [2]
- 319/18 雜環上未取代之亞乙二氧基苯 [2]
- 319/20 有取代基連至雜環上者 [2]
- 319/22 . . . 與一個萘環系或氫化萘環系稠合者 [2]
- 319/24 . . . 與兩個六節環以 [b,e] 方式稠合 [2]
- 321/00 雜環化合物，含有兩個氧原子作為僅有的雜環原子之環，未包括於 317/00 至 319/00 目內 [2]**

- 321/02 . 七節環 [2]
- 321/04 . . 不與其他環稠合者 [2]
- 321/06 . . . 1,3-二噁庚因；氫化 1,3-噁庚因 [2]
- 321/08 . . . 1,4-二噁庚因；氫化 1,4-二噁庚因 [2]
- 321/10 . . 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 321/12 . 八節環 [2]
- 323/00 雜環化合物，含多於兩個氧原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 323/02 . 五節環 [2]
- 323/04 . 六節環 [2]
- 323/06 . . 三噁烷 [2]
- 325/00 雜環化合物，含有氧原子作為僅有的雜環原子之環，與 303/00 至 323/00 內一個以上之目相對應 [2]**
- 327/00 雜環化合物，含有氧原子及硫原子作為僅有的雜環原子之環 [2]**
- 327/02 . 一個氧原子及一個硫原子 [2]
- 327/04 . . 五節環 [2]
- 327/06 . . 六節環 [2]
- 327/08 . . . 與兩個六節碳環以 [b,e] 方式稠合者 [2]
- 327/10 . 兩個氧原子及一個硫原子，例如環狀硫酸酯 [2]
- 329/00 雜環化合物，含有氧原子及硒原子或氧原子及碲原子作為僅有的雜環原子之環 [2]**
- 雜環化合物，含有硫原子、硒原子或碲原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 331/00 雜環化合物，含小於五節之環，有一個硫原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 331/02 . 三節環 [2]
- 331/04 . 四節環 [2]
- 333/00 雜環化合物，含五節環，有一個硫原子作為僅有的雜環原子 [2]**

- 333/02 • 不與其他環稠合者 [2]
- 333/04 • • 環硫原子未被取代者 [2]
- 333/06 • • • 僅有氫原子、烴基或取代烴基，直接連至環碳原子上者 [2]
- 333/08 • • • • 氫原子或僅含氫原子及碳原子之基 [2]
- 333/10 • • • • • 噻吩 [2]
- 333/12 • • • • • 為鹵原子或硝基或亞硝基所取代之基 [2]
- 333/14 • • • • • 為除鹵素外單鍵鍵合之雜原子所取代的基 [2]
- 333/16 • • • • • 由氧原子而成者 [2]
- 333/18 • • • • • 由硫原子而成者 [2]
- 333/20 • • • • • 由氮原子而成者（硝基、亞硝基見 333/12） [2]
- 333/22 • • • • • 為以雙鍵鍵合之雜原子所取代的基，或為兩個以單鍵鍵合至同一個碳原子上除鹵原子外之雜原子所取代的基上 [2]
- 333/24 • • • • • 為有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基所取代之基 [2]
- 333/26 • • • 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至環碳原子上者 [2]
- 333/28 • • • • 鹵原子 [2]
- 333/30 • • • • 除鹵原子外之雜原子 [2]
- 333/32 • • • • • 氧原子 [2]
- 333/34 • • • • • 硫原子 [2]
- 333/36 • • • • • 氮原子 [2]
- 333/38 • • • • • 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基 [2]
- 333/40 • • • • • 噻吩-2-羧酸 [2]
- 333/42 • • • • • 有硝基或亞硝基直接連至環碳原子上者 [2]
- 333/44 • • • • • 連至位置 5 上者 [2]
- 333/46 • • 環之硫原子經取代者 [2]
- 333/48 • • • 由氧原子而成者 [2]
- 333/50 • 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 333/52 • • 苯并[b]噻吩；氫化苯并[b]噻吩 [2]
- 333/54 • • • 僅有氫原子、烴基或取代烴基，直接連至雜環之碳原子上者 [2]
- 333/56 • • • • 為氧原子所取代之基 [2]
- 333/58 • • • • 為氮原子所取代之基 [2]
- 333/60 • • • • 為有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基所取代之基 [2]
- 333/62 • • • 有雜原子，或有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如酯基或腓基，直接連至雜環之碳原子上者 [2]
- 333/64 • • • • 氧原子 [2]
- 333/66 • • • • 非硝基氮原子 [2]
- 333/68 • • • • 有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子 [2]
- 333/70 • • • • • 連至位置 2 上者 [2]
- 333/72 • • 苯并[c]噻吩；氫化苯并[c]噻吩 [2]
- 333/74 • • 萘并噻吩 [2]
- 333/76 • • 二苯并噻吩 [2]
- 333/78 • • 與非六節環或與含有此等之環的環系稠合者 [5]
- 333/80 • • • 七節環 [2]
- 335/00 雜環化合物，含六節環，有一個硫原子作為僅有的雜環原子 [2]**
- 335/02 • 不與其他環稠合者 [2]
- 335/04 • 與碳環或碳環系稠合者 [2]
- 335/06 • • 苯并噻喃；氫化苯并噻喃 [2]
- 335/08 • • 萘并噻喃；氫化萘并噻喃 [2]
- 335/10 • • 二苯并噻喃；氫化二苯并噻喃 [2]
- 335/12 • • • 二苯并硫哌喃 [2]
- 335/14 • • • • 有雜原子，或有三條鍵連

雜原子，其中至多有一條
鍵連鹵原子之碳原子，例
如酯基或腓基，直接連至
位置 9 上者 [2]

335/16 氧原子，例如 9-氧二苯
并硫呋喃 [2]

335/18 氮原子 [2]

335/20 有為胺基所取代之烴基，
直接連至位置 9 上者 [2]

**337/00 雜環化合物，含有大於六節之
環，有一個硫原子作為僅有的雜
環原子 [2]**

337/02 . 七節環 [2]

337/04 . . 不與其他環稠合者 [2]

337/06 . . 與碳環或碳環系稠合者 [2]

337/08 . . . 與一個六節環稠合者 [2]

337/10 . . . 與兩個六節環稠合者 [2]

337/12 [b,e]—稠合者 [2]

337/14 [b,f]—稠合者 [2]

337/16 . 八節環 [2]

**339/00 雜環化合物，含有兩個硫原子作
為僅有的雜環原子之環 [2]**

339/02 . 五節環 [2]

339/04 . . 於位置 1 及 2 上有雜原子者，
例如硫辛酸 [2]

339/06 . . 於位置 1 及 3 上有雜原子者，
例如環狀二硫代碳酸酯 [2]

339/08 . 六節環 [2]

**341/00 雜環化合物，含有三個或更多個
硫原子作為僅有的雜環原子之
環 [2]**

**343/00 雜環化合物，含有硫原子及硒原
子或硫原子及碲原子作為僅有
的雜環原子之環 [2]**

**345/00 雜環化合物，含有硒原子或碲原
子作為僅有雜環原子之環 [2]**

**347/00 雜環化合物，含有鹵原子作為雜
環原子之環 [2]**

**含有兩個或更多個雜環之雜環化
合物 [2]**

附註

於 401/00 至 421/00 目內，包括
含有兩個或更多個相關雜環之
化合物，其中至少有兩個雜環包
括於 203/00 至 347/00 目內之不
同主目中，雜環本身之不稠合，
亦不與一個共同的碳環或碳環
系稠合。[2]

**401/00 雜環化合物，含有兩個或更多個
雜環，以氮原子作為僅有的雜環
原子，至少有一個環係僅含有一
個氮原子之六節環 [2]**

401/02 . 含有兩個雜環者 [2]

401/04 . . 為環原子—環原子之鍵所直接
連接者 [2]

401/06 . . 為由僅含脂族碳原子之碳鏈所
連接者 [2]

401/08 . . 為含脂環之碳鏈所連接者 [2]

401/10 . . 為含芳環之碳鏈所連接者 [2]

401/12 . . 為含有雜原子之鏈作為鍵結而
連接者 [2]

401/14 . 含有三個或更多個雜環者 [2]

**403/00 雜環化合物，含有兩個或更多之
雜環，以氮原子作為僅有的雜環
原子，未包括於 401/00 [2]**

403/02 . 含兩個雜環 [2]

403/04 . . 為環原子—環原子之鍵結直接
連接者 [2]

403/06 . . 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接
者 [2]

403/08 . . 為含脂環之碳鏈連接者 [2]

403/10 . . 為含芳環之碳鏈連接者 [2]

403/12 . . 為含有雜原子之鏈作為鍵結而
連接者 [2]

403/14 . 含有三個或更多個雜環者 [2]

405/00 雜環化合物，含有一個或多個以

氧原子作為僅有的雜環原子之環，且含有一個或多個以氮原子作為僅有的雜環原子之環 [2]

- 405/02 • 含有兩個雜環 [2]
- 405/04 • • 為環原子—環原子之鍵結直接連接者 [2]
- 405/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 405/08 • • 由含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 405/10 • • 由含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 405/12 • • 由含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]
- 405/14 • 含三個或更多個雜環者 [2]

407/00 雜環化合物，含兩個或更多之雜環，至少有一個環有氧原子作為僅有的雜環原子，未包括於

405/00 目內 [2]

- 407/02 • 含有兩個雜環者 [2]
- 407/04 • • 為環原子—環原子之鍵結直接連接者 [2]
- 407/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 407/08 • • 為含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 407/10 • • 為含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 407/12 • • 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]
- 407/14 • 含三個或更多個雜環者 [2]

409/00 雜環化合物，含兩個或更多之雜環，至少有一個環有硫原子作為僅有的雜環原子 [2]

- 409/02 • 含有兩個雜環者 [2]
- 409/04 • • 為環原子—環原子之鍵結直接連接者 [2]
- 409/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 409/08 • • 為含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 409/10 • • 為含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 409/12 • • 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]
- 409/14 • 含三個或更多個雜環者 [2]

411/00 雜環化合物，含兩個或更多個雜環，至少有一個環有氮原子及硫原子作為僅有的雜環原子 [2]

- 411/02 • 含有兩個雜環者 [2]
- 411/04 • • 為環原子—環原子之鍵結直接連接者 [2]
- 411/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 411/08 • • 為含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 411/10 • • 為含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 411/12 • • 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]
- 411/14 • 含三個或更多個雜環者 [2]

413/00 雜環化合物，含兩個或更多個雜環，至少有一個環有氮原子及氧原子作為僅有的雜環原子 [2]

- 413/02 • 含兩個雜環者 [2]
- 413/04 • • 為環原子—環原子之鍵直接連接者 [2]
- 413/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 413/08 • • 為含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 413/10 • • 為含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 413/12 • • 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]
- 413/14 • 含有三個或更多個雜環 [2]

415/00 含有噻胺素骨架之雜環代合物 [2]

417/00 雜環化合物，含兩個或更多個雜環，至少有一個環有氮原子及硫原子作為僅有的雜環原子，未包括於 415/00 [2]

- 417/02 • 含有兩個雜環者 [2]
- 417/04 • • 為環原子—環原子之鍵直接連接者 [2]
- 417/06 • • 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]
- 417/08 • • 為含脂環之碳鏈連接者 [2]
- 417/10 • • 為含芳環之碳鏈連接者 [2]
- 417/12 • • 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]

417/14 · 含有三個或更多個雜環者 [2]

419/00 雜環化合物，含有兩個或更多個雜環、至少有一個環有氮、氧及硫原子作為僅有的雜環原子 [2]

419/02 · 含有兩個雜環者 [2]

419/04 · · 為環原子—環原子之鍵直接連接者 [2]

419/06 · · 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]

419/08 · · 為含脂環之碳鏈連接者 [2]

419/10 · · 為含芳環之碳鏈連接者 [2]

419/12 · · 為含有雜原子之鏈作為鍵結而連接者 [2]

419/14 · 含三個或更多個雜環者 [2]

421/00 雜環化合物，含有兩個或更多個雜環，至少有一個環有硒、碲或鹵原子作為僅有的雜環原子 [2]

421/02 · 含有兩個雜環者 [2]

421/04 · · 為環原子—環原子鍵直接連接者 [2]

421/06 · · 為僅含脂族碳原子之碳鏈連接者 [2]

421/08 · · 為含脂環之碳鏈連接者 [2]

421/10 · · 為含芳環之碳鏈連接者 [2]

421/12 · · 為含有雜原子之鏈作為鍵結連接者 [2]

421/14 · 含三個或更多個雜環者 [2]

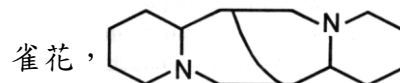
含有稠雜環系之雜環化合物 [2]

附註

(1) 於 451/00 至 517/00 目內，包括含有由兩個或更多個相關雜環組成之一個環系化合物，雜環本身相互稠合，或與一個普通的碳環系稠合，附有或不附有其他的非稠合雜環。[2]

(2) 為分類入 451/00 至 519/00 目內時，環系之氫化程度不需考慮。[2]

(3) 為分類入 451/00 至 463/00，473/00 至 477/00，489/00，499/00 至 507/00 目內時，若無相反的指示時，此等主目之用語應為包括有與可進一步與碳環系稠合之環系者，但不包括一經由與其他雜環稠合之環系，或經由互相共有的碳環系結合之環系。或例如，金



分類入 471/22，而非 455/02。

[3,5]

(4) 於 471/00，487/00，491/00 至 498/00 或 513/00 至 517/00 主目內，係依相關的雜環數進一步細分。[3]

451/00 雜環化合物，含有 8-氮雜二環 [3.2.1]辛烷，9-氮雜二環 [3.3.1]壬烷，或 3-氧雜-9-氮雜三環 [3.3.1.0^{2,4}]壬烷環系，例如，托烷或石榴皮烷生物鹼，莨菪胺；此等之環狀縮醛 [2]

451/02 · 含有不與其他環稠合之 8-氮雜二環 [3.2.1]辛烷或 3-氧雜-9-氮雜三環 [3.3.1.0^{2,4}]壬烷環系，例如，托烷；其環狀縮醛 [2]

451/04 · · 有雜原子直接連至 8-氮雜二環 [3.2.1]辛烷環系之位置 3 上或至 3-氧雜-9-氮雜三環 [3.3.1.0^{2,4}]壬烷環系之位置 7 上者 [2]

451/06 · · · 氧原子 [2]

451/08 · · · · 二芳甲氧基 [2]

451/10 · · · · 為脂族羧酸或芳脂族羧酸所醯化，例如，阿托品，莨菪胺 [2]

451/12 · · · · 為芳族或雜芳族羧酸所醯者，例如，古柯鹼 [2]

451/14 · 含 9-氮雜二環 [3.3.1]壬烷環系

者，例如石榴皮烷，2-氮雜金剛烷；其環狀縮醛 [2]

453/00 雜環化合物，含有奎寧環或異奎寧環系，例如，奎寧生物鹼 [2]

453/02 • 含有不與其他環稠合之奎寧環系者 [2]

453/04 • • 有一個喹啉-4-基、經取代的喹啉-4-基或亞烴基二氧基喹啉-4-基者，經由一個碳原子連接至位置 2 上，例如，奎寧 [2]

453/06 • 含異奎寧環系 [2]

455/00 雜環化合物，含有喹啉環系，例如，吐根鹼生物鹼，原小蘗鹼；二苯并[a,g]喹啉之亞烴基二氧基衍生物，例如，小蘗鹼 [2]

455/02 • 含有不與其他環稠合之喹啉環系 [2]

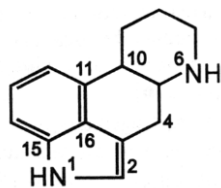
455/03 • 含直接與至少一個六節碳環稠合之喹啉環系例如，原小蘗鹼；二苯并[a,g]喹啉之亞烴基二氧基衍生物，例如，小蘗鹼 [3]

455/04 • • 含一個僅與一個六節碳環稠合之喹啉環系，例如，久咯啉 [2,3]

455/06 • • • 含苯并[a]喹啉環系 [2,3]

455/08 • • • • 有一個異喹啉-1-基，經取代的異喹啉-1-基或亞烴基二氧基異喹啉-1-基者經由一個碳原子連接至位置 2 上，例如，吐根鹼 [2,3]

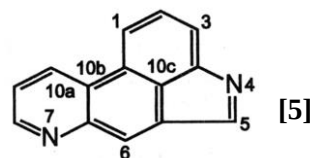
457/00 雜環化合物，含有吲哚並[4,3-f,g]喹啉環系，例如下式麥角靈之衍



生物：例如，麥角酸（由麥角胺衍生之環狀肽型化合物見 519/02） [2]

附註

依據環系索引及所給化學式，位次編號可能不同：



457/02 • 有烴基或取代的烴基連接至位置 8 上者 [2]

457/04 • 附有三條鍵連雜原子，其中至多有一條鍵連鹵原子之碳原子，例如，酯基或腈基，直接連至位置 8 上者 [2]

457/06 • • 麥角酸醯胺 [2]

457/08 • • • 其中醯胺氮原子係一個雜環中之原子 [2]

457/10 • 有雜原子直接連至位置 8 上者 [2]

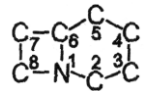
457/12 • • 氮原子 [2]

457/14 • 含與碳環或碳環系稠合之吲哚並[4,3-f,g]喹啉環系 [3]

459/00 雜環化合物，含有苯并[g]吲哚並[2,3-a]喹啉環系，例如育亨賓，其 16,18-內酯，例如，利血平酸之內酯 [2]

461/00 雜環化合物，含吲哚並[3,2,1-d,e]吡啶並[3,2,1-i,j] [1,5]一二氮雜萘環系，例如，長春蔓胺（二聚吲哚生物鹼見 519/04）

463/00 雜環化合物，含有 1-氮雜二環[4.2.0]辛烷環系，例如含有下式

環系  之化合物，例如 carbacephalosporins；此等環系被進一步稠合，例如與一含氧、氮或硫之雜環之 2,3-稠合 [5]

463/02 • 製備（利用微生物方法見 C12P 17/18） [6]

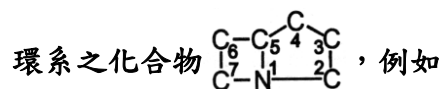
463/04 • • 利用形成環或稠合環系 [6]

- 463/06 · · 經由已包含環或稠合環系之化合物，例如利用環之脫氫化，利用取代物之引入，消除或轉化 [6]
- 463/08 · · · 羧基直接接至位置 2 之轉化，例如酯化 [6]
- 463/10 · 有以三鍵接至雜原子，至多一鍵接至鹵素原子之碳原子，例如酯或腓基，直接接至位置 2 [6]
- 463/12 · · 氮原子、烴或取代之烴基接至位置 7 [6]
- 463/14 · · 雜原子直接接至位置 7 [6]
- 463/16 · · · 氮原子 [6]
- 463/18 · · · · 進一步被羧酸或氮或硫同類物予以醯化 [6]
- 463/20 · · · · · 醯化基進一步被雜原子或含三鍵接雜原子至多一鍵接鹵素之碳原子予以取代 [6]
- 463/22 · · · · · 進一步被氮原子取代 [6]
- 471/00 於稠合系內含有氮原子作為僅有的雜環原子、其中至少一個環係含有一個氮原子之六節環的雜環化合物，未包括於 451/00 至 463/00 [2,5]**
- 471/02 · 於稠合系內含兩個雜環者 [2]
- 471/04 · · 鄰位稠合系 [2,5]
- 471/06 · · 迫位稠合系 [2]
- 471/08 · · 橋系 [2]
- 471/10 · · 螺稠合系 [2]
- 471/12 · 於稠合系內含三個雜環者 [2]
- 471/14 · · 鄰位稠合系 [2]
- 471/16 · · 迫位稠合系 [2]
- 471/18 · · 橋系 [2]
- 471/20 · · 螺稠合系 [2]
- 471/22 · 於稠合系內含有四個或更多個雜環者 [2]
- 473/00 含嘌呤環系之雜環化合物 [2]**
- 473/02 · 有氮、硫或氮原子直接連至位置 2 及 6 上者 [2]
- 473/04 · · 兩個氧原子 [2]
- 473/06 · · · 有僅含氮及碳原子之基連至位置 1 及 3 上者 [2]
- 473/08 · · · · 有甲基於位置 1 及 3 上者，例如，茶鹼 [2]
- 473/10 · · · · 有甲基於位置 3 及 7 上者，例如，可可鹼 [2]
- 473/12 · · · · 有甲基於位置 1、3 及 7 上者例如，咖啡鹼 [2]
- 473/14 · · · · 有兩個甲基於位置 1 及 3 上；兩個甲基於位置 7、8 或 9 上者 [2]
- 473/16 · · 兩個氮原子 [2]
- 473/18 · · 一個氧原子及一個氮原子，例如，鳥嘌呤 [2]
- 473/20 · · 兩個硫原子 [2]
- 473/22 · · 一個氧原子及一個硫原子 [2]
- 473/24 · · 一個氮原子及一個硫原子 [2]
- 473/26 · 有一個氮、硫或氮原子僅直接連至位置 2 或 6 上者 [2]
- 473/28 · · 氧原子 [2]
- 473/30 · · · 連至位置 6 上者，例如 6-次黃嘌呤 [2]
- 473/32 · · 氮原子 [2]
- 473/34 · · · 連至位置 6 上者，例如 6-胺嘌呤 [2]
- 473/36 · · 硫原子 [2]
- 473/38 · · · 連至位置 6 上者 [2]
- 473/40 · 有鹵原子或全鹵代-烷基直接連至位置 2 或 6 上者 [2]
- 475/00 含蝶啶環系之雜環化合物 [2]**
- 475/02 · 有一氧原子直接連至位置 4 上者 [2]
- 475/04 · · 有一氮原子直接連至位置 2 上者 [2]
- 475/06 · 有一氮原子直接連至位置 4 上者 [2]
- 475/08 · · 有一氮原子直接連至位置 2 上者 [2]
- 475/10 · · 有一芳環或雜芳環直接連至位置 2 上者 [2]
- 475/12 · 含與碳環或碳環系稠合之蝶啶環

系者 [3]

475/14 • • 苯并[g]蝶啶，例如，核糖黃素 [3]

477/00 雜環化合物，含有 1-氮雜二環 [3.2.0]庚烷環系，例如含有下式



carbapenicillins，

thienamycins；此等環系被進一步稠合，例如與一含氧、氮或硫之雜環之 2,3-稠合 [5]

477/02 • 製備（利用微生物方法見 C12P 17/18） [6]

477/04 • • 利用形成環或稠合環系 [6]

477/06 • • 經由已包含環或稠合環系之化合物，例如利用環之脫氫化，利用取代物之引入，消除或轉化 [6]

477/08 • • • 羧基直接接至位置 2 之轉化，例如酯化 [6]

477/10 • 氮原子、烴基或取代之烴基直接接至位置 4，三個鍵連接至雜原子，至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如酯基或腈基，直接接至位置 2 [6]

477/12 • • 氮原子、烴基或取代之烴基直接接至位置 6 [6]

477/14 • • • 氮原子、烴基或取代之烴基直接接至位置 3 [6]

477/16 • • • 有雜原子或三個鍵連接至雜原子，至多一個鍵接至鹵素之碳原子，例如酯基或腈基，直接接至位置 3 [6]

477/18 • • • • 氧原子 [6]

477/20 • • • • 硫原子 [6]

477/22 • • • • 氮原子 [6]

477/24 • • 有雜原子或三個鍵連接至雜原子，至多一個鍵接至鹵素之碳原子，例如酯基或腈基，直接接至位置 6 [6]

477/26 • 有雜原子或三個鍵連接至雜原

子，至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如酯基或腈基，直接接至位置 4 [6]

487/00 於稠合系內含有氮原子作為僅有的雜環原子之雜環化合物，未包括於 451/00 至 477/00 目內 [2,5]

487/02 • 於稠合系中含有兩個雜環者 [2]

487/04 • • 鄰位稠合系 [2, 5]

487/06 • • 迫位稠合系 [2]

487/08 • • 橋系 [2]

487/10 • • 螺稠合系 [2]

487/12 • 稠合系內含有三個雜環者 [2]

487/14 • • 鄰位稠合系 [2]

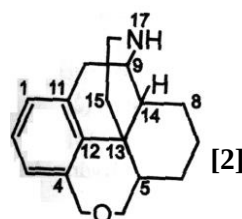
487/16 • • 迫位稠合系 [2]

487/18 • • 橋系 [2]

487/20 • • 螺稠合系 [2]

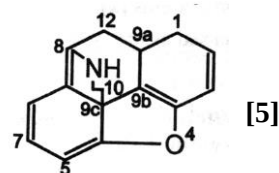
487/22 • 稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

489/00 雜環化合物，含有 4aH-8,9c-亞胺基橋亞乙基菲並[4,5-b,c,d]呋喃環系，例如下式的 [4,5-環氧]—嗎啡喃之衍生物：



附註

依據環系索引及所給化學式，位次編號可能不同：



489/02 • 有氮原子連至位置 3 及 6 上者，例如，嗎啡，嗎啡酮 [2]

489/04 • • 鹽，有機錯合物 [2]

489/06 · 有一個雜原子直接連接至位置 14 上者 [2]

489/08 · · 氧原子 [2]

489/09 · 含有與碳環或碳環系稠合之 4aH-8,9c-亞胺基橋亞乙基菲並 [4,5-b,c,d]呋喃環系者 [3]

489/10 · · 於位置 6 及 14 之間有架橋者 [2,3]

489/12 · · · 僅含有兩個碳原子之架橋者 [2,3]

491/00 雜環化合物，於稠環系中含有一個或多個有氧原子作為僅有的雜環原子之環，且含有一個或多個有氮原子作為僅有的雜環原子之環，未包括於 451/00 至 459/00、463/00、477/00 或 489/00 目內 [2,3]

491/02 · 於稠環系內含有兩個雜環者 [2]

491/04 · · 鄰位稠合系 [2]

491/044 · · · 於含氧環上僅有一個氧原子作為雜環原子者 [3]

491/048 · · · · 含氧環係五節環 [3]

491/052 · · · · 含氧環係六節環 [3]

491/056 · · · 於含氧環上有兩個或更多個氧原子為雜環原子者 [2]

491/06 · · 迫位稠合系 [2]

491/08 · · 橋系 [2]

491/10 · · 螺稠合系 [2]

491/107 · · · 於含氧環中僅有一個氧原子作為雜環原子者 [3]

491/113 · · · 於含氧環中有兩個或更多個氧原子作為雜環原子者 [3]

491/12 · 於稠環系內含有三個雜環者 [2]

491/14 · · 鄰位稠合系 [2]

491/147 · · · 含一個氧作為雜環原子之環及兩個以氮作為雜環原子之環的稠合系 [3]

491/153 · · · 含有兩個以氧作雜環原子之環及一個以氮作雜環原子之環的稠合系 [3]

491/16 · · 迫位稠合系 [2]

491/18 · · 橋系 [2]

491/20 · · 螺稠合系 [2]

491/22 · 於稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

493/00 雜環化合物，於稠環系中含有氧原子作為僅有的雜環原子 [2]

493/02 · 於稠環系中含有兩個雜環者 [2]

493/04 · · 鄰位稠合系 [2]

493/06 · · 迫位稠合系 [2]

493/08 · · 橋系 [2]

493/10 · · 螺稠合系 [2]

493/12 · 於稠環系內含有三個雜環者 [2]

493/14 · · 鄰位稠合系 [2]

493/16 · · 迫位稠合系 [2]

493/18 · · 橋系 [2]

493/20 · · 螺稠合系 [2]

493/22 · 於稠合環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

495/00 雜環化合物，於稠環系內至少有一個雜環具有硫原子作為僅有的雜環原子 [2]

495/02 · 於稠環系內含有兩個雜環者 [2]

495/04 · · 鄰位稠合系 [2]

495/06 · · 迫位稠合系 [2]

495/08 · · 橋系 [2]

495/10 · · 螺稠合系 [2]

495/12 · 於稠環系內含有三個雜環 [2]

495/14 · · 鄰位稠合系 [2]

495/16 · · 迫位稠合系 [2]

495/18 · · 橋系 [2]

495/20 · · 螺稠合系 [2]

495/22 · 於稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

497/00 雜環化合物，於稠環系內至少有一個雜環具有氧原子及硫原子作為僅有的雜環原子 [2]

497/02 · 於稠環系內含有兩個雜環者 [2]

497/04 · · 鄰位稠合系 [2]

497/06 · · 迫位稠合系 [2]

497/08 · · 橋系 [2]

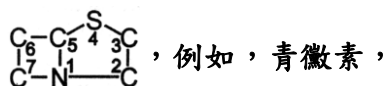
497/10 · · 螺稠合系 [2]

- 497/12 • 於稠環系內含有三個雜環 [2]
 497/14 • • 鄰位稠合系 [2]
 497/16 • • 迫位稠合系 [2]
 497/18 • • 橋系 [2]
 497/20 • • 螺稠合系 [2]
 497/22 • 於稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

498/00 雜環化合物，於稠環系內至少有一雜環具有氮原子及氧原子做為僅有的雜環原子（4-氧雜-1-氮雜二環 [3.2.0] 庚烷，例如 oxapenicillins 見 503/00；5-氧雜-1-氮雜二環 [4.2.0] 辛烷，例如 oxacephalosporins 見 505/00；在其它位置具環氧原子之同類物見 507/00） [2,6]

- 498/02 • 於稠環系內含有兩個雜環者 [2]
 498/04 • • 鄰位稠合系 [2]
 498/06 • • 迫位稠合系 [2]
 498/08 • • 橋系 [2]
 498/10 • • 螺稠合系 [2]
 498/12 • 於稠環系內含有三個雜環者 [2]
 498/14 • • 鄰位稠合系 [2]
 498/16 • • 迫位稠合系 [2]
 498/18 • • 橋系 [2]
 498/20 • • 螺稠合系 [2]
 498/22 • 於稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

499/00 雜環化合物，含有 4-硫雜-1-氮雜雙環 [3.2.0] 庚烷環系，即含有下式環系之化合物



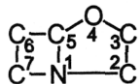
penems；該環系被進一步稠合，例如含氧、氮或硫之雜環的 2,3-稠合 [2]

- 499/04 • 製備 [2,6]
 499/06 • • 經由形成環或稠合環系（用微生物之方法見 C12P 37/00） [2,6]
 499/08 • • 羧基直接接至位置 2 之轉化，

例如酯化作用 [2,6]

- 499/10 • • 胺基直接接至位置 6 之轉化 [2,6]
 499/12 • • • 醯化作用 [2]
 499/14 • • 鹽之製備 [2]
 499/16 • • • 鹼金屬或鹼土金屬之鹽 [2,6]
 499/18 • • 分離；純化 [2]
 499/20 • • • 利用與有機鹼之鹽 [2,6]
 499/21 • 有氮原子直接接至位置 6 且有三個鍵連接至雜原子，至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接接至位置 2 [6]
 499/22 • • 與有機鹼或鹽；與有機化合物或錯合物 [2]
 499/24 • • • 與含有胺基之無環或碳環化合物者 [2]
 499/26 • • • 與雜環化合物者 [2]
 499/28 • • 有經轉化的 2-羧基者 [2]
 499/30 • • • 酸酐 [2]
 499/32 • • • 酯 [2]
 499/34 • • • 硫代酸；其酯 [2]
 499/36 • • • • O-酯 [2]
 499/38 • • • • S-酯 [2]
 499/40 • • • 醯胺；醯肼；疊氮化合物 [2]
 499/42 • • 於位置 6 上連接有一個游離的第一級胺基之化合物者 [2]
 499/44 • • 於位置 6 上連接有一為羧酸醯化的胺基之化合物者 [2]
 499/46 • • • 有無環烴基或為碳環或雜環所取代之此種基團連接至羧醯胺基上者 [2]
 499/48 • • • 有一個為雜原子所取代或為有三個鍵連接雜原子、至多以一個鍵連接鹵素之碳原子，例如酯基或腓基，連接至羧醯胺基上者 [2]
 499/50 • • • • 於羧醯胺基之 β -位置上取代者 [2]
 499/52 • • • • • 由氧或硫原子而成者 [2]
 499/54 • • • • • 由氮原子而成者 [2]
 499/56 • • • • • 為有三個鍵連接至雜原子，至多有一個鍵連接

- 至鹵原子之碳原子者 [2]
- 499/58 於羧醯胺基 α - 位置上取代者 [2]
- 499/60 由氧原子而成者 [2]
- 499/62 由硫原子而成者 [2]
- 499/64 由氮原子而成者 [2]
- 499/66 有脂環族之環做為碳鏈上的附加取代物者 [2]
- 499/68 有芳族環做為碳鏈上的附加取代物者 [2]
- 499/70 有雜環做為碳鏈上之附加取代物者 [2]
- 499/72 由有三個鍵連接至雜原子之碳原子而成者 [2]
- 499/74 有碳環直接連接至羧醯胺基上者 [2]
- 499/76 有雜環直接接至羧醯胺基上者 [2]
- 499/78 有一個為碳酸醯化或為其氮或硫類似物所醯化之胺基的化合物連接至位置 6 上 [2]
- 499/80 有一個含氮雜環之化合物，以環氮原子連接至位置 6 上 [2]
- 499/86 僅氮原子以外之原子直接接至位置 6 且有三個鍵連接至雜原子而至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如，脂基或腓基，直接接至位置 2 [5,6]
- 499/861 烴基或經取代之烴基，直接接至位置 6 [6]
- 499/865 雜原子或三個鍵連接至雜原子而至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接接至位置 6 [6]
- 499/87 在位置 3 未經取代之化合物或具有除了兩個甲基連接至位置 3 以外之取代物，且具有三個鍵連接至雜原子而至多一個鍵連接至鹵素之碳原子之化合物，例如，酯基或腓基，直接連接至位置 2 [6]
- 499/88 在位置 2 與 3 之間有雙鍵且具有
- 三個鍵連接至雜原子而至多一個鍵連接至鹵素之化合物，例如，酯基或腓基，直接連接至位置 2 [5,6]
- 499/881 有一氫原子或未經取代之烴基連接至位置 3 [6]
- 499/883 有一經取代之烴基連接至位置 3 [6]
- 499/887 有一雜原子或具有三個鍵連接至雜原子且至多一個鍵連接至鹵素之碳原子，例如，酯基或腓基，直接連接至位置 3 [6]
- 499/893 有一雜環或一稠合雜環系，直接連接至位置 3 [6]
- 499/897 具有除了有三個鍵連接至雜原子且至多一個鍵連接至鹵素之碳原子以外之取代物之化合物，直接連接至位置 2 [6]
- 499/90 與碳環或碳環系進一步稠合者 [5]
- 501/00 雜環化合物，含有 5-硫雜-1-氮雜雙環 [4.2.0]辛烷環系，即含有下式環系之化合物：**
-
- 如，頭孢菌素；上述環系進一步稠合，例如，與一個含氧或氮之雜環於 2，3 位上稠合 [2]**
- 501/02 製備 [2]
- 501/04 由含有此環系或稠環系之其他化合物，例如由環系之脫氫化，取代基之引入，消除或轉化 [2]
- 501/06 7-胺基頭孢菌素酸之醯化作用 [2]
- 501/08 利用環系之合成，(用微生物法見 C12P35/00) [2]
- 501/10 由含有青黴素環系之化合物而成者 [2]
- 501/12 分離；純化 [2]
- 501/14 有一氮原子直接連至位置 7 上之化合物者 [2]

- 501/16 · · 於位置 2 及 3 之間有一個雙鍵者 [2]
- 501/18 · · · 7-胺基頭孢黴素酸或取代的 7-胺基頭孢黴素酸 [2]
- 501/20 · · · 7-醯基胺基頭孢黴素酸或取代的 7-醯基胺基頭孢黴素酸，其醯基係由羧酸衍生而成 [2]
- 501/22 · · · · 有僅含氫及碳原子之基團連接至位置 3 上者 [2]
- 501/24 · · · · 有為雜原子或雜環取代的烴基連接至位置 3 上者 [2]
- 501/26 · · · · 為氧原子所取代之亞甲基；及其附有 2-羧基之內酯 [2]
- 501/28 · · · · · 有由雜原子所取代之脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/30 · · · · · 有由芳脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/32 · · · · · 有由芳脂族羧酸經醯化的 7-胺基者，該羧酸之脂族基為雜原子所取代者 [2]
- 501/34 · · · · · 有由含雜環之羧酸經醯化 7-胺基者 [2]
- 501/36 · · · · · 為硫原子所取代之亞甲基 [2]
- 501/38 · · · · · 為氮原子所取代之亞甲基；附有 2-羧基之內醯胺；為以環氮原子連接之含氮雜環所取代的亞甲基；其第 4 級化合物 [2]
- 501/40 · · · · · 有由雜原子所取代之脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/42 · · · · · 有由芳脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/44 · · · · · 有由芳脂族酸經醯化的 7-胺基者，該羧酸於脂族基團上為雜原子所取代 [2]
- 501/46 · · · · · 有由含雜環之羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/48 · · · · · 為雜環所取代之亞甲基（501/38 至 501/46 優先）[2]
- 501/50 · · · · · 有為雜原子所取代之脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/52 · · · · · 有由芳脂族羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/54 · · · · · 有由芳脂族羧酸經醯化的 7-胺基者，該羧酸於脂族基團上為雜原子所取代 [2]
- 501/56 · · · · · 有由含雜環之羧酸經醯化的 7-胺基者 [2]
- 501/57 · · · · 於位置 7 上有進一步的取代基，例如，頭黴素 [3]
- 501/58 · · · 有一個氮原子連接至位置 7 上，該氮原子係雜環之一員者 [2]
- 501/59 · · · 有雜原子直接連接至位置 3 上者 [2]
- 501/60 · · 位置 3 及 4 之間有一個雙鍵者 [2]
- 501/62 · 進一步與碳環或碳環系稠合之化合物 [3]
- 503/00 雜環化合物，含有 4-氧雜-1-氮雜雙環 [3.2.0] 庚烷環系，即含有下式環系之化合物：**
- ，例如
- oxapenicillins，clavulanic 酸衍生物；上述環系進一步稠合，例如，與一個含氧、氮或硫之雜環於 2，3 位上稠合 [6]**
- 503/02 · 製備（利用微生物方法見 C12P 17/18）[6]
- 503/04 · · 利用形成環或稠合環系 [6]

- 503/06 · · 由已含有環或稠合環系之化合物，例如，利用環之脫氫作用，利用取代物之引入、消除或轉化 [6]
- 503/08 · · · 羧基直接連接至位置 2 之轉化，例如酯化 [6]
- 503/10 · 具有三個鍵接至雜原子而至多一個鍵接至鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基直接連接至位置 2 [6]
- 503/12 · · 位置 6 未被取代 [6]
- 503/14 · · · 氫原子、烴或經取代之烴基，除了具有三個鍵接至雜原子而至多一個鍵接至鹵素之碳原子外，連接至位置 3 [6]
- 503/16 · · · · 被雜原子或具有三個鍵接至雜原子而至多一個鍵接至鹵素之碳原子所取代之基，例如酯基或腈基 [6]
- 503/18 · · · · · 被氧原子取代者 [6]
- 503/20 · · · · · 被硫原子取代者 [6]
- 503/22 · · · · · 被氮原子取代者 [6]
- 505/00 雜環化合物，含有 5-氧雜-1-氮雜雙環 [4.2.0] 辛烷環系，即含有下式環系之化合物：**
- ，例如，
- oxacephalosporins；上述環系進一步稠合，例如，與一個含氧、氮或硫之雜環於 2,3 位上稠合 [6]**
- 505/02 · 製備（利用微生物方法見 C12P 17/18） [6]
- 505/04 · · 利用形成環或稠合環系 [6]
- 505/06 · · 由已含有環或稠合環系之化合物，例如，利用環之脫氫作用，利用取代物之引入、消除或轉化 [6]
- 505/08 · · · 羧基直接連接至位置 2 之轉化，例如酯化 [6]
- 505/10 · 具有三個鍵接至雜原子而至多一個鍵接至鹵素之碳原子，例如，酯基或腈基直接連接至位置 2 [6]
- 505/12 · · 位置 7 被取代 [6]
- 505/14 · · · 雜原子直接連接至位置 7 [6]
- 505/16 · · · · 氮原子 [6]
- 505/18 · · · · · 進一步被衍生自羧酸之基或氮或硫同類物醯化 [6]
- 505/20 · · · · · 醯化基進一步被雜原子或具有三個鍵接至雜原子而至多一個鍵接至鹵素之碳原子取代 [6]
- 505/22 · · · · · 進一步被單鍵結之氮原子取代 [6]
- 505/24 · · · · · 進一步被雙鍵結之氮原子取代 [6]
- 507/00 雜環化合物，含有一稠合 β -內醯胺環系，未包括於 463/00、477/00 或 499/00 至 505/00 目內；上述環系進一步被稠合 [6]**
- 507/02 · 含有 3-氧雜-1-氮雜雙環 [3.2.0] 庚烷環系 [6]
- 507/04 · 含有 2-氧雜-1-氮雜雙環 [4.2.0] 辛烷環系 [6]
- 507/06 · 含有 3-氧雜-1-氮雜雙環 [4.2.0] 辛烷環系 [6]
- 507/08 · 含有 4-氧雜-1-氮雜雙環 [4.2.0] 辛烷環系 [6]
- 513/00 雜環化合物，於稠環系內至少有一個雜環具有氮原子及硫原子做為僅有的雜環原子，未包括於 463/00、477/00 或 499/00 至 507/00 目內 [2,6]**
- 513/02 · 稠環系內含有兩個雜環者 [2]
- 513/04 · · 鄰位稠合系 [2]
- 513/06 · · 迫位稠合系 [2]
- 513/08 · · 橋接系 [2]
- 513/10 · · 螺稠合系 [2]

- 513/12 • 稠環系內含有三個雜環者 [2]
- 513/14 • • 鄰位稠合系 [2]
- 513/16 • • 迫位稠合系 [2]
- 513/18 • • 橋接系 [2]
- 513/20 • • 螺稠合系 [2]
- 513/22 • 稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

515/00 雜環化合物，於稠環系內至少含有一個雜環，雜環內有氧、氮及硫作為僅有的雜環原子，未包括

**於 463/00、477/00 或 499/00 至
507/00 目內 [2]**

- 515/02 • 於稠環系內含有兩個雜環者 [2]
- 515/04 • • 鄰位稠合系 [2]
- 515/06 • • 迫位稠合系 [2]
- 515/08 • • 橋系 [2]
- 515/10 • • 螺稠合系 [2]
- 515/12 • 稠環系內含有三個雜環者 [2]
- 515/14 • • 鄰位稠合系 [2]
- 515/16 • • 迫位稠合系 [2]
- 515/18 • • 橋系 [2]
- 515/20 • • 螺稠合系 [2]
- 515/22 • 稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

**517/00 雜環化合物，於稠環系內至少含
有一個雜環具有硒、碲或鹵素原
子作為雜環原子 [2]**

- 517/02 • 稠環系內含有兩個雜環者 [2]
- 517/04 • • 鄰位稠合系 [2]
- 517/06 • • 迫位稠合系 [2]
- 517/08 • • 橋系 [2]
- 517/10 • • 螺稠合系 [2]
- 517/12 • 稠環系內含有三個雜環者 [2]
- 517/14 • • 鄰位稠合系 [2]
- 517/16 • • 迫位稠合系 [2]

- 517/18 • • 橋系 [2]
- 517/20 • • 螺稠合系 [2]
- 517/22 • 稠環系內含有四個或更多個雜環者 [2]

**519/00 雜環化合物，含有一個以上由兩
個或更多個相關雜環組成之環
系，雜環間互相稠合，未包括於
453/00 或 455/00 目內 [2]**

- 519/02 • 環狀肽型之麥角生物鹼 [2]
- 519/04 • 二聚吡啶生物鹼，例如，長春鹼 [2]
- 519/06 • 含有至少一稠合 β -內鹽胺環系，未包括於 463/00、477/00 或 499/00 至 507/00 目內，例如，penem 或 cepham 系 [6]

**521/00 雜環化合物，含有未特別指明的
雜環 [2]**

附註

本目用於未特別指明化學結構之雜環化合物的分類，即未包括於 201/00 至 519/00 目之雜環化合物。[2009.01]

C07F 含除碳、氫、鹵素、氧、氮、硫、硒或碲以外的其它元素之無環、碳環或雜環化合物（含金屬之嘧啶見 C07D487/22；高分子化合物見 C08）

附註[2,7,2006.01,2010.01]

- (1) 注意 C07 類標題下之附註(3)，該附註規定了在 C07C 至 C07K 次類中採用末位規則。
- (2) 注意 C07 類標題下之附註(6)。
- (3) (刪除)
- (4) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。
- (5) 於本次類內，有機酸鹽、醇化物、酚鹽、螯合物或硫醇鹽依其母體化合物分類。

1/00	含週期表第 1 或 11 族元素之化合物[1,2006.01]	7/21	• • 具有至少一個含矽而不含碳之環的環狀化合物 [2]
1/02	• 鋰化合物	7/22	• 錫化合物
1/04	• 鈉化合物	7/24	• 鉛化合物
1/06	• 鉀化合物	7/26	• • 四烷基鉛化合物
1/08	• 銅化合物	7/28	• 鈦化合物
1/10	• 銀化合物	7/30	• 鍺化合物 [2]
1/12	• 金化合物		
3/00	含週期表第 2 或 12 族元素之化合物[1,2006.01]	9/00	含週期表第 5 或 15 族元素之化合物[1,2006.01]
3/02	• 鎂化合物	9/02	• 磷化合物 [2]
3/04	• 鈣化合物	9/04	• • 磷硫化合物與烴之反應產物
3/06	• 鋅化合物	9/06	• • 無 P-C 鍵者
3/08	• 鎘化合物	9/08	• • • 磷之含氧酸的酯
3/10	• 汞化合物	9/09	• • • • 磷酸之酯 [2]
3/12	• • 含汞之芳香族物質	9/10	• • • • • 磷酯，如卵磷酯
3/14	• • 含汞之雜環物質	9/11	• • • • • 與烴烷基化合物反應而成者，於烷基上無進一步取代之基 [2]
5/00	含週期表第 3 或 13 族元素之化合物[1,2006.01]	9/113	• • • • • 與不飽和的無環醇間之反應產物 [2]
5/02	• 硼化合物	9/117	• • • • • 與脂環族醇間之反應產物 [2]
5/04	• • 硼酸之酯	9/12	• • • • • 與烴芳基化合物間之反應產物 [2]
5/05	• • 具有至少一個含硼而不含碳之環的環化合物 [2]	9/14	• • • • • 含 P-鹵化物基團者 [2]
5/06	• 鋁化合物	9/141	• • • • 亞磷酸之酯 [2]
7/00	含週期表第 4 或 14 族元素之化合物[1,2006.01]	9/142	• • • • • 與烴烷基化合物反應而成者，於烷基上無進一步於取代之基 [2]
7/02	• 矽化合物	9/143	• • • • • 與不飽和無環醇間之反應產物 [2]
7/04	• • 矽酸之酯	9/144	• • • • • 與脂環族醇間之反應產物 [2]
7/06	• • • 附有烴芳基化合物	9/145	• • • • • 與烴芳基化合物間之反應產物 [2]
7/07	• • • 環酯 [2]	9/146	• • • • • 含 P-鹵化物基團 [2]
7/08	• • 具有一個或更多的 C-Si 鍵之化合物	9/16	• • • 硫代磷酸或硫代亞磷酸之酯
7/10	• • • 含有氮者	9/165	• • • • 硫代磷酸之酯 [2]
7/12	• • • 有機鹵化矽	9/17	• • • • • 與烴烷基化合物反應而成者，於烷基上無進一步取代之基 [2]
7/14	• • • • 由鹵化矽烷及烴予以製備	9/173	• • • • • 與不飽和無環醇間之反
7/16	• • • • 由矽及鹵代烴製備		
7/18	• • • 具有一個或更多的 C-Si 鍵以及一個或更多的 C-O-Si 鍵之化合物		
7/20	• • • 純化；分離		

應產物 [2]		雜環原子者 [5]	
9/177	• • • • • 與酯環族醇間之反應產物 [2]	9/553	• • • 有一個氮原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/18	• • • • • 與羥芳基化合物間之反應產物 [2]	9/564	• • • • 三節環 [5]
9/20	• • • • • 含 P-鹵化物基團 [2]	9/568	• • • • 四節環 [5]
9/201	• • • • 硫代亞磷酸之酯 [2]	9/572	• • • • 五節環 [5]
9/202	• • • • • 與羥烷基化合物反應而成者，於烷基上無進一步取代之基 [2]	9/576	• • • • 六節環 [5]
9/203	• • • • • 與不飽和無環醇間之反應產物 [2]	9/58	• • • • • 吡啶環 [5]
9/204	• • • • • 與脂環族醇間之反應產物 [2]	9/59	• • • • • 氫化吡啶環 [5]
9/205	• • • • • 與羥芳基化合物間之反應產物 [2]	9/60	• • • • • 喹啉或氫化喹啉環系 [5]
9/206	• • • • • 含 P-鹵化物基團者	9/62	• • • • • 異喹啉或氫化異喹啉環系 [5]
9/22	• • • 含磷酸之醯胺	9/64	• • • • • 吡啶或氫化吡啶環系 [5]
9/24	• • • • 酯醯胺	9/645	• • • 有二個氮原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/26	• • • • 含 P-鹵化物基團者	9/6503	• • • • 五節環 [5]
9/28	• • 具有一個或更多的 P-C 鍵結者	9/6506	• • • • • 於位置 1 及 3 上有氮原子
9/30	• • • 次膦酸[R ₂ =P(:O)OH]；硫代次膦酸 [1,2006.01]	9/6509	• • • • 六節環 [5]
9/32	• • • • 此等之酯	9/6512	• • • • • 於位置 1 及 3 上有氮原子者 [5]
9/34	• • • • 此等之鹵化物	9/6515	• • • 有三個氮原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/36	• • • • 此等之醯胺	9/6518	• • • • 五節環 [5]
9/38	• • • 膦酸[R-P(:O(OH) ₂]；硫代膦酸 [1,2006.01]	9/6521	• • • • 六節環 [5]
9/40	• • • • 此等之酯	9/6524	• • • 有四個或更多的氮原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/42	• • • • 此等之鹵化物	9/6527	• • • 有氮原子及氧原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/44	• • • • 此等之醯胺	9/653	• • • • 五節環 [5]
9/46	• • • 卑膦酸[R ₂ =P-OH]；硫代卑膦酸 [1,2006.01]	9/6533	• • • • 六節環 [5]
9/48	• • • 亞膦酸[R-P(OH) ₂]；硫代亞膦酸 [1,2006.01]	9/6536	• • • 有氮原子及硫原子，有或無氧原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/50	• • • 有機膦	9/6539	• • • • 五節環 [5]
9/52	• • • • 鹵代膦	9/6541	• • • • • 與碳環或環系稠合 [5]
9/53	• • • • 有機氧化膦；有機硫化膦 [2]	9/6544	• • • • 六節環 [5]
9/535	• • • 有機正膦 [3]	9/6547	• • • • • 與碳環或環系稠合 [5]
9/54	• • • 第 4 級磷化合物	9/655	• • • 有氮原子，有或無硫、硒或碲原子作為僅有的雜環原子者 [5]
9/547	• • 雜環化合物，例如含有磷作為	9/6553	• • • 有硫原子，有或無硒或碲原

	子作為僅有的雜環原子者 [5]	9/72	• • • 脂族化合物
9/6558	• • • 含有至少兩個不同的雜環或兩個不同取代的雜環，雜環本身間既不稠合，亦不與普通的碳環或環系稠合者 [5]	9/74	• • • 芳族化合物
9/6561	• • • 含有稠合雜環系者 [5]	9/76	• • • • 含有羥基者
9/6564	• • • 有磷原子，有或無氮、氧、硫、硒、碲原子作為雜環原子者 [5]	9/78	• • • • 含有胺基者
9/6568	• • • • 有磷原子作為僅有的雜環原子者 [5]	9/80	• • • 雜環化合物
9/6571	• • • • 有磷原子及氧原子作為僅有的雜環原子者 [5]	9/82	• • • • 含一個或更多吡啶環之砷化合物
9/6574	• • • • • 磷之含氧酸酯 [5]	9/84	• • • • 含一個或更多喹啉環系之砷化合物
9/6578	• • • • 有磷及硫原子，有或無氧原子作為雜環原子者 [5]	9/86	• • • • 含有一個或更多異喹啉系之砷化合物
9/6581	• • • • 有磷及氮原子，有或無氧或硫原子作為雜環原子者 [5]	9/88	• • • • 含一個或更多的吡啶環系之砷化合物
9/6584	• • • • • 有一個磷原子作為雜環原子者 [5]	9/90	• 銻化合物
9/6587	• • • • • 有兩個磷原子作為雜環原子者 [5]	9/92	• • 芳族化合物
9/659	• • • • • 有三個磷原子作為雜環原子者 [5]	9/94	• 鉍化合物
9/6593	• • • • • 1,3,5-三氮雜-2,4,6-三磷雜苯 (phosphorine) [5]	11/00	含週期表第 6 或 16 族元素之化合物 [1,2006.01]
9/6596	• • • 有除氧、硫、硒、碲、氮或磷原子以外之原子作為雜環原子者 [5]	13/00	含週期表第 7 或 17 族元素之化合物 [1,2006.01]
9/66	• 砷化合物	15/00	含週期表第 8、9、10 或 18 族元素之化合物 [1,2006.01]
9/68	• • 無 As-C 鍵結者	15/02	• 鐵化合物
9/70	• • 有機砷化合物	15/03	• • 鐵胺錯合物；相應的脫鐵化合物 [1,2006.01]
		15/04	• 鎳化合物
		15/06	• 鈷化合物
		17/00	茂金屬 [2]
		17/02	• 週期表第 8、9 或 10 族的金屬者 [2,2006.01]
		19/00	包括於 1/00 至 17/00 一個以上主目之金屬化合物 [5]

C07G 未知結構之化合物（未確定結構的磺化脂肪、磺化油或磺化蠟見 C07C 309/62）

附註

- (1) 本次類不包括於 C07K 次類內之未知結構的肽及蛋白質。[4]
- (2) 注意 C07 類標題下之附註(3)，該附註規定了在 C07C 至 C07K 次類中採用末位規則。[8]
- (3) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]

1/00 木質素之低分子量衍生物（木質素之高分子量衍生物見 C08H 7/00）[1,2011.01]

13/00 未知結構的維生素

15/00 激素

3/00 糖苷

99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [2009.01]

5/00 生物鹼

9/00 瀝青磺酸胺，例如，魚石酯

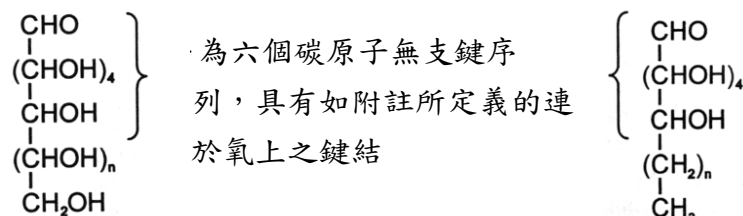
11/00 抗生素

C07H 糖類；其衍生物；核苷；核苷酸；核酸（糖醛酸或糖質酸之衍生物見 C07C、C07D；糖醛酸、糖質酸見 C07C 59/105、C07C 59/285；氰醇類見 C07C 255/16；烯糖類見 C07D；未知結構的化合物見 C07G；多糖類，其衍生物見 C08B；有關基因工程之 DNA 或 RNA，載體，如質體，或其分離、製造或純化見 C12N 15/00；製糖工業見 C13）[2]

附註

- (1) 本次類涵蓋含有糖化物基團之化合物（見以下附註(3)之定義）。
- (2) 本次類不涵蓋彼此由配糖鍵連接至多於五個糖化基團之多糖類。
- (3) 於本次類內，下列表示意指：
 - “糖化物基團”係衍生自無環多羥基醛或無環多羥基酮或其環狀互變異構體，以去除氫原子或以連至鹵素、氮、硫、硒或碲之相同數目的雜鍵代替連至氧之雜鍵，此係依下列各定義而得：
 - (a) 糖化物基團
 - (i) 由一個連續碳鏈之骨架，且氧原子與之直接連接而成，及
 - (ii) 由連至環結構碳原子上之每個鍵，或連至有三個連至雜原子之鍵的碳原子，如酯基或腈基上之每個鍵所終止者，及
 - (iii) 於碳骨架內含有一個至多為六個碳原子之無支鏈序列，其中至少三個碳原子（當骨架上僅有四個碳原子下至少有兩個碳原子）具有一個單鍵連接至氧原子上做為僅有的雜鍵，且

- (A) 於一個環狀或無環之序列中，至少有一個其它的碳原子上有兩個單鍵連至氧原子上做為僅有的雜鍵，或
- (B) 於一個無環之序列中，至少有一個其它的碳原子上有一個雙鍵連至氧原子做為僅有的雜鍵，除上述(A)或(B)中提及的雜鍵外，上述序列最多含有一個雙鍵，即 $C=C$ 或亦可為經縮酮化之 $C=O$ ，例如，化合物



n 為整數，分類至 3/02 目；[4]

- (b) 至多有四個指定連至氧上之雜鍵，為相同的數目連至鹵素、氮、硫、硒或碲之雜鍵所取代，此亦可為由上述(a)所規定之基團衍生而得者； [2]

— “雜環基團”或“雜環”被視為不包含上述定義之糖化物基團者。[2]

- (4) 注意 C07 類標題下之附注(3)，該附註規定了在 C07C 至 C07K 次類中採用末位規則。[8]

- (5) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]

次類索引

一般製造法.....	1/00	核苷類	19/00
化合物		核苷酸類.....	19/00，21/00
糖化物類，脫氧糖類		核酸	21/00
脫水糖類，鄰酮醛糖類.....	3/00	含無環基衍生物	7/00，13/00，15/00
胺基糖類，氮雜，硫代，碲代，		含碳環基衍生物	7/00，13/00，15/00
碲代類似物.....	5/00	含雜環基衍生物	
糖酯類	11/00，13/00	... 9/00，13/10，15/26，17/00，19/00，21/00	
糖醚類，苷類.....	15/00，17/00	含硼，碲或一種金屬元素之衍生物.....	23/00
環縮醛類	9/00	本次類各目中不包括的技術主題	99/00

1/00 糖衍生物之製備方法 [2]

1/02 • 磷酸化 [2]

1/04 • • 引入多磷酸基 [2]

1/06 • 分離；純化 [2]

1/08 • • 由天然產物 [2]

3/00 僅含有氫原子及僅有碳、氮、及氧原子之糖化基團的化合物（由二糖或多糖之水解製備見 C13；蔗糖，葡萄糖，果糖，乳糖或麥芽糖

之分離或純化見 C13）[2]

3/02 • 單糖 [2]

3/04 • 二糖 [2]

3/06 • 低聚糖類，即具有三至五個相互間以配糖鍵相連的糖化物基團者 [2]

3/08 • 脫氧糖類；不飽和糖類（1,2-二脫氧-1-烯糖類見 C07D）；鄰酮醛糖類 [2]

3/10 • 脫水糖類，如環氧化合物 [2]

5/00 含有糖化物基團之化合物，其中連至氧上之雜鍵為相同數目連至鹵素、氮、硫、硒或碲之雜鍵所取代 [2]

5/02 • 鹵素 [2]

5/04 • 氮 [2]

5/06 • • 胺基糖類 [2]

5/08 • 硫、硒或碲 [2]

5/10 • • 硫 [2]

7/00 含有以碳-碳鍵連至糖化物基團上之非糖化物基團的化合物 [2]

7/02 • 無環基 [2]

7/027 • • 酮基醛糖酸 [4]

7/033 • • 糖醛酸 [4]

7/04 • 碳環基 [2]

7/06 • 雜環者 [2]

9/00 含有與糖化物基團至少共有兩個雜原子雜環之化合物 [2]

9/02 • 僅含有氧作為雜環原子之雜環 [2]

9/04 • • 環縮醛類 [2]

9/06 • 含有氮作為雜環原子之雜環 [2]

11/00 含為無機酸酯化的糖化物基團之化合物；其金屬鹽（鹵代-糖類見 5/02；硫代-、硒代-或碲代-糖類見 5/08） [2]

11/02 • 硝酸酯；亞硝酸酯 [2]

11/04 • 磷酸酯；亞磷酸酯；多磷酸酯 [2]

13/00 含經碳酸或其衍生物、或有機酸，如膦酸所酯化的糖化物基團之化合物 [2]

13/02 • 由羧酸而成者 [2]

13/04 • • 具有連至無環碳原子上之經酯化的羧基者 [2]

13/06 • • • 脂肪酸 [2]

13/08 • • 具有直接連至碳環上之經酯化的羧基者 [2]

13/10 • • 具有直接連到雜環上之經酯化的羧基者 [2]

13/12 • 由具有-X-C(=X)-X-基團之酸或其

鹵化物，其中 X 代表氮、氧、硫、硒或碲，如碳酸，胺基甲酸或氫化物而成者 [2]

15/00 含有直接連至糖化物基團雜原子上的烴基或取代烴基之化合物 [2]

附註

於此主目內，直接連至糖化物基團之雜原子上的鹵基不作為取代烴基。[4]

15/02 • 未為環狀結構所取代之無環基團 [2]

15/04 • • 連接至糖化物基團之一個氧原子上者 [2]

15/06 • • • 一個烴烷基經脂肪酸酯化者 [4]

15/08 • • • 聚亞氧烷基衍生物 [2]

15/10 • • • 含不飽和碳-碳鍵者 [2]

15/12 • • 連至糖化物基團之一個氮原子上者 [2]

15/14 • • 連至糖化物基團之一個硫，硒或碲原子上者 [2]

15/16 • • • 林絲黴素；其衍生物 [2]

15/18 • 為碳環所取代之無環基團 [2]

15/20 • 碳環類 [2]

15/203 • • 除環己烷外之單碳環；雙環之碳環系統 [4]

15/207 • • 不為氮原子所取代之環己烷環，例如，春日黴素 [4]

15/22 • • 為氮原子所取代之環己烷環 [4]

15/222 • • • 至少為兩個氮原子所取代之環己烷環 [4]

15/224 • • • • 僅有一個糖化物基團直接連接至環己烷環上，如越黴素，強力黴素，新黴胺 [4]

15/226 • • • • 至少有兩個糖化物基團直接連至環己烷環上者 [4]

15/228 • • • • • 連接至環己烷環之相鄰環碳原子上者 [4]

15/23 • • • • • 分子中僅有兩個糖化物基團者，例如，丁

- 醯甘黴素，丁酸素木糖黴素，核糖黴素
[4]
 15/232 於分子內至少有三個糖化物基團者，例如青紫黴素，新黴素，巴洛莫黴素 **[4]**
 15/234 已結合糖類基之環己烷構成碳原子未相鄰接者，例如卡那黴素，托普黴素，暗黴素，慶大黴素 A₂ **[4]**
 15/236 糖化物基團，於位置 3 上為烷基胺基取代及於位置 4 上為兩個與氫不同之取代基所取代，例如慶大黴素錯合物，紫蘇黴素，Verdamycin **[4]**
 15/238 . . . 為兩個胍基取代之環己烷，例如，鏈黴素 **[4]**
 15/24 . . 含有三個或更多的環之稠環系 **[2]**
 15/244 . . . 蒽醌基團，如番瀉葉苷 **[4]**
 15/248 . . . 秋水仙鹼基，如，秋水仙苷 **[4]**
 15/252 . . . 萘并四萘基，如，正定黴素，亞德里亞黴素 **[4]**
 15/256 . . . 多萜烯基 **[4]**
 15/26 . 為雜環取代之無環或碳環基 **[4]**
17/00 含有直接連至糖化物基團之雜原子上的雜環基之化合物 [2]
 17/02 . 僅含有氮作為雜環原子之雜環基 **[2]**
 17/04 . 僅含有氧作為雜環原子之雜環基 **[2]**
 17/06 . . 苯并吡喃基 **[4]**
 17/065 . . . 苯并 [b]吡喃 **[4]**
 17/07 苯并 [b]吡喃-4-酮 **[4]**
 17/075 苯并 [b]吡喃-2-酮 **[4]**
 17/08 . . 含有八節或更多節的雜環，如紅黴素 **[2]**
19/00 含有雜環與糖化物基團共有一個雜環原子之化合物；核苷；單核苷酸類；及其脫水衍生物 [2,4]
 19/01 . 共有氧者 **[4]**
 19/02 . 共有氮者 **[2]**
 19/04 . . 僅含有氮作為雜環原子之雜環基 **[2]**
 19/044 . . . 吡咯基 **[4]**
 19/048 . . . 吡啶基 **[4]**
 19/052 . . . 咪唑基 **[4]**
 19/056 . . . 三唑或四唑基 **[4]**
 19/06 . . . 嘧啶基 **[2]**
 19/067 以核糖基作為糖化物基 **[4]**
 19/073 以 2-脫氧核糖基作為糖化物基 **[4]**
 19/09 以阿戊糖基作為糖化物基 **[4]**
 19/10 有為磷酸或多聚磷酸所酯化之糖化物基 **[2]**
 19/11 含有環磷酸酯者 **[2]**
 19/12 . . . 三呋基 **[2]** 19/14 . . . 吡咯並嘧啶基 **[2]**
 19/16 . . . 嘌呤基 **[2]**
 19/167 有核糖基成為糖化物基者 **[4]**
 19/173 有 2-脫氧核糖基作為糖化物基者 **[4]**
 19/19 有阿戊糖基作為糖化物基者 **[4]**
 19/20 有為磷酸或多磷酸所酯化的糖化物基者 **[4]**
 19/207 磷酸或多磷酸為另外的經基化合物所酯化者，如黃素-腺嘌呤二核苷酸或煙醯胺嘌呤二核苷酸 **[4]**
 19/213 含有環磷酸酯者 **[4]**
 19/22 . . . 喋啶基 **[2]**
 19/23 . . . 含有兩個或更多個雜環之雜環基，雜環基本身稠合或與一個共同的碳環系稠合，不

- 包括於 19/14～19/22 目內者
[4]
- 19/24 • • 含有氧或硫作為雜環原子之雜
環基者 [2]
- 21/00** 含有兩個或多個單核苷酸單元
之化合物，具有以核苷基之糖化
物基團單獨連接的磷酸酯基或
多磷酸酯基，例如核酸 [2]
- 21/02 • 以核糖基作為糖化物基團者 [2]
- 21/04 • 以脫氧核糖基成為糖化物基團者
[2]

23/00 含有硼、矽或金屬元素之化合
物，例如螯合物或維生素 B₁₂（與
無機酸之酯見 11/00） [2,2006.01]

附註[2025.01]

化合物之金屬鹽依其母體化合
物分類

99/00 本次類各目中不包括的技術主
題 [8]

C07J 類固醇化合物（閉聯類固醇化合物見 C07C）[2]**附註**

- (1) 本次類包括含有環戊烷並 [a] 氫化菲骨架，或由其衍生而成之環結構：
- 於一個環上增加或減少一個原子，
 - 於二個環上每個環增加或減少一個原子，
 - 於一個環減少一個原子及一個環增加一個原子，
 - 以雜原子取代環戊烷並 [a] 氫化菲骨架之一個或兩個非為環共用的碳原子，結合或不結合上述的縮減與增加之情況，或
 - 以與碳環或雜環稠合，結合或不結合上述的一項或多項的變更情況。[4]
- (2) 注意 C07C 次類標題下之附注(3)，該附註規定了在 C07C 至 C07K 次類中採用末位規則。[8]
- (3) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]

次類索引**正系類固醇化合物**

含鹵素或氧者

氧不作為雜環原子者..... 1/00，3/00，
5/00，7/00，9/00，11/00，13/00，15/00

氧作為雜環原子者 17/00，19/00，21/00

含有硫者 31/00，33/00

含有氮 41/00，43/00

其他類固醇..... 51/00

具有變型骨架之類固醇化合物

反類固醇化合物 15/00

降－高類固醇化合物..... 61/00，63/00，
65/00，67/00，69/00

與碳環稠合者 53/00

雜類固醇化合物 71/00，73/00

一般的類固醇化合物之製備 75/00

正系類固醇化合物，即環戊烷並(a)氫化菲，含碳，氫，鹵素或氧 [2]

- 1/00 含有碳、氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上未為碳原子取代，如雌固烷，雄固烷 [2]
- 3/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一個碳原子取代 [2]
- 5/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條兩個碳原子之鏈所取代，如孕固烷，並於位置 21 上僅為一個單鏈連之氧原子所取代 [2]
- 7/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條兩個碳原子之鏈所取代（5/00 優先） [2]
- 9/00 含右碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條多於兩個碳原子之鏈所取代，如膽烷，膽固烷，糞固烷 [2]
- 11/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 3 上未被取代 [2]
- 13/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 上有一條碳-碳雙鍵 [2]
- 15/00 含有碳，氫，鹵素或氧之立體化學上純的類固醇化合物，且有部分或全部的轉化骨架，如，反類固醇化合物，L-異構體類 [2]
- 17/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，具有一個不與環戊烷並(a)氫化菲骨架稠合之含氧雜環 [2]

19/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 上為內酯環所取代 [2]

21/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，具有一個與環戊烷並(a)氫化菲骨架螺稠合之含氧雜環 [2]

正系類固醇化合物，即含硫之環戊烷並(a)氫化菲 [2]

31/00 含有一個或多個不屬於雜環之硫原子的正系類固醇化合物 [2]

33/00 具有與環戊烷並(a)氫化菲骨架螺稠合或不稠合的含硫雜環之正系類固醇化合物 [2]

正系類固醇化合物，即含氮之環戊烷並(a)氫化菲 [2]

41/00 含有一個或多個不屬於雜環之氮原子的正系類固醇化合物 [2]

43/00 具有與環戊烷並(a)氫化菲骨架螺稠合或不稠合的含氮雜環之正系類固醇化合物 [2]

51/00 正系類固醇化合物，不屬於 1/00 至 43/00 目內之具有未變型環戊烷並(a)氫化菲骨架者 [2]

53/00 類固醇化合物，為一個碳環稠合或用兩個環碳原子間直接連接的方法形成一個附加的環以改變環戊烷並(a)氫化菲骨架 [2]

降類固醇化合物或高類固醇化合物 [2]

61/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)氫化菲骨架以僅有一個環減少一個或兩個原子予以收縮而成 [2]

- 63/00 類固醇化合物，其中環戊烷並(a)氫化菲骨架以僅有一個環增加一個或兩個原子予以擴大而成 [2]
- 65/00 類固醇化合物，其中環戊烷並(a)氫化菲骨架以兩個環各減少一個原子予收縮而成 [2]
- 67/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)氫化菲骨架以兩個環各增加一個原子予以擴大而成 [2]
- 69/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)氫化菲骨架以僅有一個環減少一個原子及僅有一個環增加一個原子予以擴大而成 [2]
- 71/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)氫化菲骨架與雜環稠合（螺稠合之雜環見 21/00、33/00、43/00） [2]
- 73/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)氫化菲骨架之一個或兩個碳原子為雜原子所取代者 [2]
- 75/00 類固醇化合物一般的製造方法[4]
正系類固醇化合物，即環戊烷並(a)氫化菲，含碳，氫，鹵素或氧 [2]
- 1/00 含有碳、氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上未為碳原子取代，如雌固烷，雄固烷 [2]
- 3/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一個碳原子取代 [2]
- 5/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條兩個碳原子之鏈所取代，如孕固烷，並於位置 21 上僅為一個單鏈連之氧原子所取代 [2]
- 7/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條兩個碳原子之鏈所取代（5/00 優先） [2]
- 9/00 含右碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 β 上為一條多於兩個碳原子之鏈所取代，如膽烷，膽固烷，糞固烷 [2]
- 11/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 3 上未被取代 [2]
- 13/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 上有一條碳-碳雙鍵 [2]
- 15/00 含有碳，氫，鹵素或氧之立體化學上純的類固醇化合物，且有部分或全部的轉化骨架，如，反類固醇化合物，L-異構體類 [2]
- 17/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，具有一個不與環戊烷並(a)氫化菲骨架稠合之含氧雜環 [2]
- 19/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，於位置 17 上為內酯環所取代 [2]
- 21/00 含有碳，氫，鹵素或氧之正系類固醇化合物，具有一個與環戊烷並(a)氫化菲骨架螺稠合之含氧雜環 [2]
- 正系類固醇化合物，即含硫之環戊烷並(a)氫化菲 [2]
- 31/00 含有一個或多個不屬於雜環之硫原子的正系類固醇化合物 [2]
- 33/00 具有與環戊烷並(a)氫化菲骨架

螺稠合或不稠合的含硫雜環之
正系類固醇化合物，即含氮之環戊烷
並(a)氫化菲 [2]

41/00 含有一個或多個不屬於雜環之
氮原子的正系類固醇化合物 [2]

43/00 具有與環戊烷並(a)氫化菲骨架
螺稠合或不稠合的含氮雜環之
正系類固醇化合物 [2]

51/00 正系類固醇化合物，不屬於 1/00
至 43/00 目內之具有未變型環戊
烷並(a)氫化菲骨架者 [2]

53/00 類固醇化合物，為一個碳環稠合
或用兩個環碳原子間直接連接
的方法形成一個附加的環以改
變環戊烷並(a)氫化菲骨架 [2]

降類固醇化合物或高類固醇化合物
[2]

61/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)
氫化菲骨架以僅有一個環減少
一個或兩個原子予以收縮而成
[2]

63/00 類固醇化合物，其中環戊烷並(a)

正系類固醇化合物 [2]

氫化菲骨架以僅有一個環增加
一個或兩個原子予以擴大而成
[2]

65/00 類固醇化合物，其中環戊烷並(a)
氫化菲骨架以兩個環各減少一
個原子予以收縮而成 [2]

67/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)
氫化菲骨架以兩個環各增加一
個原子予以擴大而成 [2]

69/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)
氫化菲骨架以僅有一個環減少
一個原子及僅有一個環增加一
個原子予以擴大而成 [2]

71/00 類固醇化合物，其環戊烷
並(a)氫化菲骨架與雜環稠合（螺
稠合之雜環見 21/00、33/00、43/00）
[2]

73/00 類固醇化合物，其環戊烷並(a)
氫化菲骨架之一個或兩個碳原
子為雜原子所取代者 [2]

75/00 類固醇化合物一般的製造方法
[4]

C07K 肽類（包含 β -內醯胺之肽類見 C07D；於分子內除形成本身的肽環外不含有
任何其它的肽鏈之環狀二肽，例如呱吡2,5-二酮見 C07D；環肽型麥角生物鹼
見 C07D 519/02；單細胞蛋白質，酶見 C12N；得到肽類之基因工程方法見
C12N 15/00） [4]

附註

(1) 於本次類內，下列名詞或術語意指：

- “胺基酸”為至少有一個胺基及一個羧基與同一碳骨架相連的化合物，且胺基中之氮原子可以為環之一部份；
- “正常的肽鏈”係指一個胺基酸之 α -胺基與另一個胺基酸之 1 位上的羧基間之鍵結；
- “非正常的肽鏈”係指相連之胺基酸之至少一個為非 α -胺基酸之

鍵或由至少一個為 α —胺基酸側鏈一部份之羧基或胺基形成之鍵。

- “肽類”係包含至少兩個胺基酸單元之化合物，其中之單元係經由至少一個正常的肽鍵連結，包括寡肽、多肽及蛋白質，其中
 - (i) “直鏈肽”可包含經由 S—S 橋接或經由羥基—或巰基—胺基酸中之羥基或巰基與另一個胺基酸之羧基間之鍵結所形成的環(例如，肽內酯)，但不包含僅經由肽鍵所形成的環；
 - (ii) “環狀肽”係指含有至少一個僅經由肽鍵所形成的環之肽；環之形成可經由正常的肽鍵或非正常的肽鍵予以，例如，經由 2,4—二胺基丁酸之 4—胺基而得。因此，環中至少一個鍵為非肽鍵之環狀化合物，被視作“直鏈肽”。
 - (iii) “縮肽”係指含有至少兩個 α —胺基酸與至少一個 α —羥基酸之序列的化合物，經由至少一個正常的肽鍵與此羥基酸所衍生而得之酯鍵結合而成，其中
 - (a) “直鏈縮肽”亦可包含經由 S—S 橋接或經由一個羥基胺基酸或巰基胺基酸之羥基或巰基與另一個胺基酸或羥基酸之羧基間之鍵結所形成的環，惟不包含僅經由肽鍵或由羥基羧酸所衍生之酯鍵所形成的環，例如 Gly-Ala-Gly-OCH₂CO₂H 及 Gly-OCH₂CO-Ala-Gly 被視為“直鏈縮肽”，但 HOCH₂CO-Gly-Ala-Gly 因不含酯鍵，即成涵蓋於 5/08 之 Gly-Ala-Gly 之衍生物；
 - (b) “環狀縮肽”係含有至少一個僅經由肽鍵或由羥基酸所衍生之酯鍵而形成的環狀肽，例如 Gly-Ala-Gly-OCH₂CO； [4]
 - (iv) “雜種肽”係指二或多個異質肽經由熔合或其價鍵結形成的肽。
- (2) 注意 C07 類標題下之附注(3)，該附註規定了在 C07C 至 C07K 次類中採用末位規則。[8]
- (3) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]
- (4) 當分類入本次類時，若含有與色層分析相關的技術主題，則尚須分入 B01D 15/08。[8]
- (5) 經由胺基酸之移去或加入，經由胺基酸被其它取代，或經由該等轉化之結合所轉化而得之肽之片段或肽歸類為親代肽類。然而，僅有四個或更少胺基酸之肽之片段亦歸類至 5/00 目中。[6]
- (6) 由化學方法製備且衍生自天然肽類之胺基酸序列所得之肽歸類為天然者。[6]
- (7) 由重組 DNA 技術製得之肽類不依據宿主分類，而依其原始顯示之肽，例如顯示於大腸桿菌中之 HIV 肽歸類於 HIV 肽類。[6]

次類索引

肽類

製備	1/00
胺基酸數目不定者	2/00
在未確定或僅部份確定序列中	
具有高達 20 個胺基酸者	4/00
在完全確定序列中具有高達	
20 個胺基酸者	5/00 至 9/00

1/00 肽之一般製備方法 [4]

1/02	• 於溶液內 [4]
1/04	• 於載體上 [4]
1/06	• 使用保護基或活化劑者 [4]
1/08	• • 使用活化劑者 [4]
1/10	• 使用偶合劑者 [4]
1/107	• 利用肽之前驅物之化學轉化者 [6]
1/113	• • 不改變主要結構者 [6]
1/12	• 利用水解者 [4]
1/13	• 肽之標示 [6]
1/14	• 萃取；分離；純化 [4,6]
1/16	• • 利用層析 [6]
1/18	• • • 離子交換層析 [6]
1/20	• • • 分配、逆相或疏水性交互作用層析 [6]
1/22	• • • 親和力層析或以基於選擇吸收方法之相關技術 [6]
1/24	• • 利用電化學方法 [6]
1/26	• • • 電泳法 [6]
1/28	• • • • 等電點電泳法 [6]
1/30	• • 利用沈澱 [6]
1/32	• • • 錯合物者 [6]
1/34	• • 利用過濾、超濾或逆滲透者 [6]
1/36	• • 結合兩種或更多不同類型之方法者 [6]

2/00 具有不定數目胺基酸之肽類；其衍生物 [6]**4/00 在未確定或部份確定序列中含有最多 20 個胺基酸之肽類；其衍生物 [6]**

4/02	• 來自病毒者 [6]
4/04	• 來自細菌者 [6]

在完全確定序列中具有高達

20 個胺基酸之縮肽	11/00
具有超過 20 個胺基酸	14/00
免疫球蛋白	16/00
載體結合或固定化肽	17/00
雜種肽	19/00

4/06	• 來自真菌者 [6,2006.01]
4/08	• 來自藻類者；來自地衣者 [6]
4/10	• 來自植物者 [6]
4/12	• 來自動物者；來自人類者 [6]
5/00	在完全確定序列中含有最多四個胺基酸之肽類；其衍生物 [4]

附註

於本目中，下列名詞之意義如下：

— “第一胺基酸”意指由肽序列左側起之第一個胺基酸，即 N—端胺基酸。[6]

5/02	• 含有至少一個非正常的肽鍵者 [4]
5/023	• • 其中包含至少一個 β -胺基酸 [6]
5/027	• • 其中包含至少一個 γ -胺基酸，例如，statine [6]
5/03	• • 其中包含至少一個 δ -胺基酸，例如，isosteres [6]
5/033	• • 其中包含至少一個 ϵ 或 ζ -胺基酸 [6]
5/037	• • 該非正常的肽鍵係由 α -胺基酸之側鏈形成，例如， γ -Glu， ϵ -Lys，穀胱甘肽 [6]
5/04	• 僅含有正常的肽鍵者 [4]
5/06	• • 雙肽類 [4]
5/062	• • • 第一胺基酸之側鏈為無環者，例如，Gly，Ala [6]
5/065	• • • 第一胺基酸之側鏈包含碳環者，例如，Phe，Tyr [6]
5/068	• • • 第一胺基酸之側鏈包含之胺

- 基多於羧基者，或其衍生物，例如，Lys，Arg [6]
- 5/072 . . . 第一胺基酸之側鏈包含之羧基多於胺基者，或其衍生物，例如，Asp，Glu，Asn [6]
- 5/075 Asp-Phe；其衍生物，例如，糖精 [6]
- 5/078 . . . 第一胺基酸為雜環者，例如 Pro，His，Trp [6]
- 5/08 . . 三肽類 [4]
- 5/083 . . . 第一胺基酸之側鏈為無環者，例如，Gly，Ala [6]
- 5/087 . . . 第一胺基酸之側鏈包含碳環者，例如，Phe，Tyr [6]
- 5/09 . . . 第一胺基酸之側鏈包含胺基多於羧基者，或其衍生物，例如，Lys，Arg [6]
- 5/093 . . . 第一胺基酸之側鏈包含羧基多於胺基者，或其衍生物，例如，Asp，Glu，Asn [6]
- 5/097 . . . 第一胺基酸為雜環者，例如 Pro，His，Trp，例如，thyroliberin，melanostatin [6]
- 5/10 . . 四肽類 [4]
- 5/103 . . . 第一胺基酸之側鏈為無環者，例如，Gly，Ala [6]
- 5/107 . . . 第一胺基酸之側鏈包含碳環者，例如，Phe，Tyr [6]
- 5/11 . . . 第一胺基酸之側鏈包含胺基多於羧基者，或其衍生物，例如，Lys，Arg [6]
- 5/113 . . . 第一胺基酸之側鏈包含羧基多於胺基者，或其衍生物，例如，Asp，Glu，Asn [6]
- 5/117 . . . 第一胺基酸為雜環者，例如 Pro，His，Trp [6]
- 5/12 . . 環肽類 [4]
- 7/00 於一個完全確定的序列內含有 5 至 20 個胺基酸之肽，其衍生物 [4,6]
- 7/02 . 含有至少一個非正常肽鍵之直鏈肽 [4]
- 7/04 . 僅含有正常肽鍵之直鏈肽 [4]
- 7/06 . . 含有 5 至 11 個胺基酸 [4]
- 7/08 . . 含有 12 至 20 個胺基酸 [4,6]
- 7/14 . . 血管緊張肽；相關的肽 [4]
- 7/16 . . 催產素；血管加壓素；有關之肽類 [4]
- 7/18 . . 胰激肽；(血管)舒緩激肽；相關的肽 [4]
- 7/22 . . 章魚毒素；相關的肽 [4]
- 7/23 . . 促黃體激素釋放激素 [LHRH]；相關的肽 [6,2006.01]
- 7/28 . . 短桿菌肽 A、B、D；相關的肽 [4]
- 7/50 . 至少有一個非正常肽鍵之環肽 [4]
- 7/52 . . 於環中僅有正常之肽鍵者 [4]
- 7/54 . . 於環中至少有一個非正常之肽鍵者 [4]
- 7/56 . . . 不經由 2,4-二胺基丁酸進行環化 [4]
- 7/58 枯草桿菌肽，相關的肽 [4]
- 7/60 . . . 經由 2,4-二胺基丁酸之 4-胺基進行環化 [4]
- 7/62 多黏菌素；相關的肽 [4]
- 7/64 . 僅含有正常肽鍵之環肽者 [4]
- 7/66 . . 短桿菌肽 S，C；短桿菌酪素 A，B，C；相關的肽 [4]
- 9/00 具有最多 20 個胺基酸之肽，含有糖化物基團且具有完全確定之序列；其衍生物 [4,6]
- 11/00 在完全確定序列中含有最多 20 個胺基酸之縮肽；其衍生物 [4,6]
- 11/02 . 環狀者，例如，鰵胺黴素 [4]
- 14/00 含有超過 20 個胺基酸之肽；胃泌激素；生長激素釋放抑制因子；Melanotropins；其衍生物 [6]
- 14/005 . 來自病毒 [6]
- 14/01 . . DNA 病毒者 [6]
- 14/015 . . . 小病毒科，例如，貓

- panleukopenia 病毒，人類小病毒 [6]
- 14/02 . . . 肝病毒科，例如，B 型肝炎病毒 [6]
- 14/025 . . . 乳頭多瘤空泡病毒科，例如乳頭狀瘤病毒，多瘤病毒，SV40，BK 病毒，JC 病毒 [6]
- 14/03 . . . 疱疹病毒科，例如，假狂犬病毒 [6]
- 14/035 疱疹單一病毒 I 或 II [6]
- 14/04 水痘-帶狀疱疹病毒 [6]
- 14/045 巨細胞病毒 [6]
- 14/05 Epstein-Barr 病毒 [6]
- 14/055 Marek 病病毒 [6]
- 14/06 傳染性牛鼻氣管病毒 [6]
- 14/065 . . . 痘病病毒科，例如，avipox 病毒 [6]
- 14/07 疫苗病毒，痘瘡病毒 [6]
- 14/075 . . . 腺病毒科 [6]
- 14/08 . . RNA 病毒 [6]
- 14/085 . . . 小核糖核酸病毒科，例如，柯沙奇病毒，艾柯病毒，腸道病毒 [6]
- 14/09 口蹄疫病毒 [6]
- 14/095 鼻病病毒 [6]
- 14/10 肝炎病毒 [6]
- 14/105 小兒麻痺病毒 [6]
- 14/11 . . . 正黏液病毒科，例如，流行性感感冒病毒 [6]
- 14/115 . . . 副黏液病毒科，例如，副流行性感感冒病毒 [6]
- 14/12 耳下腺炎病毒；麻疹病毒 [6]
- 14/125 新城病病毒 [6]
- 14/13 犬瘟熱病毒 [6]
- 14/135 呼吸道合胞體病毒 [6]
- 14/14 . . . 呼吸道腸道病毒，例如，螺旋病毒，藍舌病毒，科羅拉多扁蟲熱病毒 [6]
- 14/145 . . . 棒狀病毒科，例如，狂犬病毒，Duvenhage 病毒，Mokola 病毒，小胞口腔炎病毒 [6]
- 14/15 . . . 逆轉錄病毒，例如，牛白血

球症病毒，貓白血症病毒，人類 T-細胞白血症-淋巴病毒 [6]

- 14/155 . . . 慢病毒科，例如，人類免疫不全病毒 [HIV]，visna-maedi 病毒或馬感染性貧血病毒 [6,2006.01]
- 14/16 HIV-1 [6]
- 14/165 . . . 冠狀病毒科，例如，鳥感染性支氣管炎病毒 [6]
- 14/17 豬傳遞性腸胃炎病毒 [6]
- 14/175 . . . 布尼亞病毒科，例如，加州腦炎病毒，Rift 山谷熱病毒，Hantaan 病毒 [6]
- 14/18 . . . 披蓋病毒科，例如，氣味病毒，鼠疫病毒，黃熱病毒，C 型肝炎病毒，日本腦炎病毒 [6]
- 14/185 豬霍亂病毒 [6]
- 14/19 德國麻疹病毒 [6]
- 14/195 . 來自細菌 [6]

附註

於 14/20 至 14/365 目中，適當時，在細菌名詞後，以括號指示目(O)、科(F)或屬(G)。[6]

- 14/20 . . 來自螺旋體 (O)，例如，Treponema，Leptospira [6]
- 14/205 . . 來自 Campylobacter (G) [6]
- 14/21 . . 來自假單胞菌 (F) [6]
- 14/215 . . 來自嗜鹽細菌 (F) [6]
- 14/22 . . 來自 Neisseriaceae (F)，例如，Acinetobacter [6]
- 14/225 . . 來自 Alcaligenes (G) [6]
- 14/23 . . 來自 Brucella (G) [6]
- 14/235 . . 來自 Bordetella (G) [6]
- 14/24 . . 來自腸細菌 (F)，例如，Citrobacter，Serratia，Proteus，Providencia，Morganella，Yersinia [6]
- 14/245 . . . 大腸桿菌 (G) [6]
- 14/25 . . . Shigella (G) [6]

- 14/255 . . . Salmonella (G) [6]
 14/26 . . . Klebsiella (G) [6]
 14/265 . . . 腸細菌 (G) [6]
 14/27 . . . Erwinia (G) [6]
 14/275 . . . Hafnia (G) [6]
 14/28 . . . 來自弧菌 (F) [6]
 14/285 . . . 來自 Pasteurellaceae (F), 例如, 血友病感冒 [6]
 14/29 . . . 來自立克次體 (O) [6]
 14/295 . . . 來自披衣菌 (O) [6]
 14/30 . . . 來自黴漿菌, 例如, 類胸膜肺炎微生物[PPLO][6,2006.01]
 14/305 . . . 來自微球菌 (F) [6]
 14/31 . . . 來自葡萄球菌 (G) [6]
 14/315 . . . 來自鏈球菌 (G), 例如, 腸球菌 [6]
 14/32 . . . 來自桿細菌 (G) [6]
 14/325 . . . 桿菌結晶肽, 即 δ -內毒素 [6,2006.01]
 14/33 . . . 來自梭孢桿菌 (G) [6]
 14/335 . . . 來自乳酸桿菌 (G) [6]
 14/34 . . . 來自棒狀桿菌 (G) [6]
 14/345 . . . 來自短菌 (G) [6]
 14/35 . . . 來自分枝桿菌 (F) [6]
 14/355 . . . 來自諾卡氏菌 (G) [6]
 14/36 . . . 來自放線菌; 來自鏈黴菌 (G) [6]
 14/365 . . . 來自游動放線菌 (G) [6]
 14/37 . . . 來自真菌 [6,2006.01]
 14/375 . . . 來自擔子菌綱 [6]
 14/38 . . . 來自曲黴菌 [6]
 14/385 . . . 來自青黴菌 [6]
 14/39 . . . 來自酵母菌 [6]
 14/395 . . . 來自糖酵母菌 [6]
 14/40 . . . 來自念珠菌 [6]
 14/405 . . . 來自藻類 [6]
 14/41 . . . 來自地衣 [6]
 14/415 . . . 來自植物 [6]
 14/42 . . . 外源凝集素, 例如, 半刀豆球蛋白, 植物血凝素 [6]
 14/425 . . . 玉米醇溶蛋白 [6]
 14/43 . . . 樹狀地衣 [6]
 14/435 . . . 來自動物; 來自人類 [6]
 14/44 . . . 來自原生動物 [6]
 14/445 . . . 原質團 [6]
 14/45 . . . 住血原蟲 [6]
 14/455 . . . 艾美球蟲 [6]
 14/46 . . . 來自脊椎動物 [6]
 14/465 . . . 來自鳥類 [6]
 14/47 . . . 來自哺乳動物 [6]
 14/475 . . . 生長因子; 生長調節因子 [6]
 14/48 . . . 神經生長因子[NGF][6,2006.01]
 14/485 . . . 表皮生長因子 [EGF], 即尿抑胃激素[6,2006.01]
 14/49 . . . 血小板衍生因子 [PDGF][6,2006.01]
 14/495 . . . 轉化生長因子[TGF][6,2006.01]
 14/50 . . . 纖維原細胞生長因子 [FGF][6,2006.01]
 14/505 . . . 紅血球生成素[EPO][6,2006.01]
 14/51 . . . 骨骼形成因子; 成骨素; 成骨因子; 骨骼-誘生因子 [6]
 14/515 . . . 血管形成因子; 成血素 [6]
 14/52 . . . 細胞素; 淋巴激活素; 干擾素 [6]
 14/525 . . . 腫瘤壞死因子[TNF][6,2006.01]
 14/53 . . . 群叢形成刺激因子 [CSF][6,2006.01]
 14/535 . . . 粒細胞 CSF; 粒細胞-巨噬細胞 CSF [6]
 14/54 . . . 白血球間白素[IL][6,2006.01]
 14/545 . . . IL-1 [6]
 14/55 . . . IL-2 [6]
 14/555 . . . 干擾素[IFN][6,2006.01]
 14/56 . . . IFN- α [6]
 14/565 . . . IFN- β [6]
 14/57 . . . IFN- γ [6]
 14/575 . . . 激素 [6]
 14/58 . . . 心房鈉尿因子複合基因; 心房肽激素; 心房鈉尿肽 [ANP]; 心鈉素; 心肌擴張素[6,2006.01]
 14/585 . . . 降鈣素 [6]
 14/59 . . . 促卵泡激素[FSH]; 絨毛膜促性腺激素, 例如, hCG[人

- 類絨毛膜促性腺激素]；促黃體激素[LH]；促甲狀腺激素[TSH]/[6,2006.01]
- 14/595 . . . 胃泌激素；胰肽分泌素 [CCK]/[6,2006.01]
- 14/60 . . . 生長激素釋放因子[GH-RF]，即生長激素釋放素 [6,2006.01]
- 14/605 . . . 升糖激素 [6]
- 14/61 . . . 生長激素[GH]，即促生長素 [6,2006.01]
- 14/615 . . . 由天然來源萃取 [6]
- 14/62 . . . 胰島素 [6]
- 14/625 . . . 由天然來源萃取 [6]
- 14/63 . . . 胃動素 [6]
- 14/635 . . . 副甲狀腺激素，即副甲狀腺素；副甲狀腺素－有關之肽類 [6,2006.01]
- 14/64 . . . 鬆弛激素 [6]
- 14/645 . . . 促胰泌素 [6]
- 14/65 . . . 胰島素樣生長因子，即促生長因子，例如，IGF-1，IGF-2 [6,2006.01]
- 14/655 . . . 生長激素釋放抑制因子 [6]
- 14/66 . . . 促胸腺生成素 [6]
- 14/665 . . . 衍生自促黑激素肽，腦啡肽或強啡肽 [6]
- 14/67 . . . 促脂解激素，例如， β 或 γ 一促脂解激素 [6]
- 14/675 . . . β -內啡肽 [6]
- 14/68 . . . 促黑激素[MSH]/[6,2006.01]
- 14/685 . . . α －黑色素 [6]
- 14/69 . . . β －黑色素 [6]
- 14/695 . . . 促腎上腺皮質激素 [ACTH]/[6,2006.01]
- 14/70 . . . 腦啡肽 [6]
- 14/705 . . . 受體；細胞表面抗原；細胞表面決定子 [6]
- 14/71 . . . 生長因子；生長調節因子 [6]
- 14/715 . . . 細胞素；淋巴激活素；干擾素 [6]
- 14/72 . . . 激素 [6]
- 14/725 . . . T-細胞受體 [6]
- 14/73 . . . CD4 [6]
- 14/735 . . . Fc 受體 [6]
- 14/74 . . . 主組織相容性複合基因 [MHC]/[6,2006.01]
- 14/745 . . . 凝血或溶血因子 [6]
- 14/75 . . . 血纖維蛋白原 [6]
- 14/755 . . . 因子 VIII [6]
- 14/76 . . . 白蛋白 [6]
- 14/765 . . . 血清白蛋白，例如，HSA [6]
- 14/77 . . . 卵清蛋白 [6]
- 14/775 . . . 去脂肽 [6]
- 14/78 . . . 結締組織肽，例如，膠原，彈性蛋白，海帶胺酸，纖維黏連蛋白，透明質蛋白，冷不溶球蛋白 [CIG]/[6,2006.01]
- 14/785 . . . 牙槽界面肽；肺界面肽 [6]
- 14/79 . . . 鐵傳遞蛋白，例如，乳鐵蛋白，鐵傳遞卵蛋白 [6]
- 14/795 . . . 含 porphyrin 或 corrin 環之肽 [6]
- 14/80 . . . 細胞色素 [6]
- 14/805 . . . 血紅素；肌球蛋白 [6]
- 14/81 . . . 蛋白酶抑制素 [6]
- 14/815 . . . 來自水蛭，例如，水蛭素，eglin [6]
- 14/82 . . . 由致癌基因轉譯產物 [6]
- 14/825 . . . 金屬巰基蛋白 [6]
- 16/00 免疫球蛋白，例如，單株或多株抗體 [6]**
- 16/02 . . . 來自蛋類者 [6]
- 16/04 . . . 來自牛奶者 [6]
- 16/06 . . . 來自血清者 [6]
- 16/08 . . . 對抗來自病毒之物質 [6]
- 16/10 . . . 來自 RNA 病毒者 [6]
- 16/12 . . . 對抗來自細菌之物質 [6]
- 16/14 . . . 對抗來自真菌、藻類或地衣之物質 [6,2006.01]
- 16/16 . . . 對抗來自植物之物質 [6]
- 16/18 . . . 對抗來自動物或人類之物質 [6]
- 16/20 . . . 來自原生動物者 [6]
- 16/22 . . . 對抗生長因子者 [6]
- 16/24 . . . 對抗細胞素、淋巴激活素或干擾素者 [6]

- 16/26 • • 對抗激素者 [6]
- 16/28 • • 對抗受體、細胞表面抗原或細胞表面決定子者 [6]
- 16/30 • • • 來自腫瘤細胞者 [6]
- 16/32 • • 對抗由致癌基因之轉譯產物者 [6]
- 16/34 • • 對抗血型抗原者 [6]
- 16/36 • • 對抗凝血因子者 [6]
- 16/38 • 對抗肽結構之蛋白酶抑制素者 [6]
- 16/40 • 對抗酶者 [6]
- 16/42 • 對抗免疫球蛋白者（抗一個體基因型抗體）[6]
- 16/44 • 對抗其他次日未提供之物質 [6]
- 16/46 • 雜種免疫球蛋白（免疫球蛋白與非免疫球蛋白之肽類之雜種見 19/00）[6]

17/00 載體結合或固定化肽；其製備 [4]

- 17/02 • 固定於有機載體上或內部之肽 [4]
- 17/04 • • 截留於載體內，例如凝膠，空心纖維 [4]
- 17/06 • • 經由交鏈劑而接至載體者 [4]
- 17/08 • • 載體為合成聚合物者 [4]
- 17/10 • • 載體為碳水化合物者 [4]
- 17/12 • • • 纖維素或其衍生物 [4]
- 17/14 • 固定於無機載體上或內部之肽 [4]

19/00 雜種肽（僅由免疫球蛋白構成之雜種免疫球蛋白見 16/46）[6]

C08 有機高分子化合物；其製備或化學加工；以其為基料之組合物

附註

(1) 本類不包含下列高分子化合物：

- 胜肽，例：蛋白質，請見 C07K [2012.01]
- 由核苷之糖自由基所連結的含有分離的磷酸或聚磷酸基團之具有兩個以上單核苷單元之化合物，例：核酸，請見 C07H 21/00 [2012.01]
- 與基因工程相關之 DNA 或 RNA、以及載體，例：質體、或其分離、製備或純化，請見 C12N 15/00 [2012.01]

(2) 殺生、害蟲驅避、害蟲引誘或植物生長調節活性的化合物或抑制劑進一部分入 A01P。[8]

C08B 多糖類；其衍生物（含少於六個相互以配糖連接的糖類基團之多糖類見 C07H；發酵或用酶方法見 C12P 19/00；纖維素生產見 D21）[4]

附註

化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]

次類索引

纖維素及其衍生物

纖維素之預處理	1/00
酯類	3/00, 5/00, 7/00, 13/00, 17/00
醚類	11/00, 13/00, 17/00
黃原酸酯	9/00
其他衍生物	15/00
纖維素之再生	16/00

澱粉；降解或非化學改性的澱粉；直鏈澱粉；支鏈澱粉	30/00
澱粉、直鏈澱粉或支鏈澱粉之衍生物	
澱粉者	31/00
直鏈澱粉者	33/00
支鏈澱粉者	35/00
其他多糖類	37/00

製備

1/00 纖維素之預處理以製造其衍生物

- 1/02 • 精製纖維素使適合於酯化作用
- 1/04 • • 硝酸纖維素之製造用
- 1/06 • 精製纖維素適合於醚化作用
- 1/08 • 鹼纖維素
- 1/10 • • 鹼纖維素之製造設備
- 1/12 • • • 浸漬裝置
- 1/14 • • • 熟成裝置

3/00 纖維素有機酸酯之製備

- 3/02 • 酯化作用催化劑
- 3/04 • 甲酸纖維素
- 3/06 • 醋酸纖維素
- 3/08 • 具有三個或更多碳原子之鹽基性有機酸酯者
- 3/10 • • 具有五個或更多之碳原子者
- 3/12 • 多元有機酸酯
- 3/14 • 有機酸之取代基，例如 NH_2 ， Cl 之有機酸酯
- 3/16 • 纖維素之混合有機酸酯之製備
- 3/18 • • 乙醯—丁酸酯
- 3/20 • 保持纖維素纖維構造之酯化
- 3/22 • 酯化後處理，包括精製
- 3/24 • • 水解或熟成
- 3/26 • • 纖維素酯之分離
- 3/28 • • • 由沉澱分離而成者
- 3/30 • • 安定化

5/00 纖維素無機酸酯之製備

- 5/02 • 硝酸纖維素
- 5/04 • • 酯化後處理，包括精製
- 5/06 • • • 硝酸纖維素之分離
- 5/08 • • • 安定化
- 5/10 • • • 降低黏度
- 5/12 • • • 利用有機液體取代水
- 5/14 • 硫酸纖維素

7/00 纖維素有機酸無機酸混合酯之製備**9/00 黃原酸纖維素酯或黏液膠纖維**

之製備

- 9/02 • 黃化器；溶解器
- 9/04 • 連續法
- 9/06 • 一段法

11/00 纖維素醚之製備

- 11/02 • 烷基或環烷基醚
- 11/04 • • 有取代之烴基者
- 11/06 • • • 有鹵素取代之烴基者
- 11/08 • • • 有烴基化之烴基者；其酯，醚，或縮醛
- 11/10 • • • 為酸基所取代者
- 11/12 • • • • 為羧酸基所取代者
- 11/14 • • • 含有氮基者
- 11/145 • • • • 有鹼性氮者，例如胺烷基醚 [2]
- 11/15 • • • • 有胺基甲醯基者 [2]
- 11/155 • • • • 有氰基者，例如氰烷基醚 [2]
- 11/16 • 芳基或芳烷基醚
- 11/18 • • 有取代之烴基者
- 11/187 • 有不飽和烴烴基者 [2]
- 11/193 • 混合醚，即具有兩個或更多不同之醚化基團之醚 [2]
- 11/20 • 醚化後處理，包括精製
- 11/22 • • 分離

13/00 纖維素醚—酯之製備

- 13/02 • 黃原酸纖維素醚

15/00 其他纖維素衍生物或改性纖維素之製備

- 15/02 • 氧化纖維素；水解纖維素；水化纖維素
- 15/04 • • 羧基纖維素，例如用二氧化氮氧化予以製備者
- 15/05 • 含有除碳、氫、氧、鹵素或硫以外元素之衍生物(磷酸酯見 5/00) [2]
- 15/06 • • 含氮者 [2]
- 15/08 • 纖維素之分級，例如纖維素結晶之分離 [2]
- 15/10 • 纖維素之交聯 [2]

- 16/00 纖維素之再生 [2]**
- 17/00 纖維素酯化或醚化之設備**
- 17/02 • 纖維素有機酯之製造用
- 17/04 • 硝酸纖維素之製造用
- 17/06 • 纖維素醚之製造用
- 30/00 澱粉、降解或非化學改性澱粉、直鏈澱粉、或支鏈澱粉之製備[4]**
- 30/02 • 預處理，例如原料之粉碎 [4]
- 30/04 • 萃取或精製 [4]
- 30/06 • 乾燥；成形 [4]
- 30/08 • 澱粉懸浮體之濃縮 [4]
- 30/10 • 澱粉萃取後殘留物之加工，包括由萃取之澱粉中脫水 [4]
- 30/12 • 降解或非化學改性之澱粉；澱粉之漂白（澱粉化學衍生物之製備見 31/00）[4]30/14 • • 於冷水中可分散或預膠凝之澱粉 [4]
- 30/16 • • 所有之設備 [4]
- 30/18 • • 糊精 [4]
- 30/20 • 直鏈澱粉或支鏈澱粉（其化學衍生物見 33/00、35/00）[4]
- 31/00 澱粉化學衍生物之製備（直鏈澱粉之化學衍生物見 33/00；支鏈澱粉之化學衍生物見 35/00）[2]**
- 31/02 • 酯 [2]
- 31/04 • • 有機酸酯者 [2]
- 31/06 • • 無機酸酯者 [2]
- 31/08 • 醚 [2]
- 31/10 • • 烷基或環烷基醚 [2]
- 31/12 • • 具有以雜原子取代之烷基或環烷基者 [2]
- 31/14 • • 芳基或芳烷基醚 [2]
- 31/16 • 醚-酯 [2]
- 31/18 • 氧化的澱粉 [2]
- 33/00 直鏈澱粉化學衍生物之製備 [2]**
- 33/02 • 酯 [2]
- 33/04 • 醚 [2]
- 33/06 • 醚-酯 [2]
- 33/08 • 氧化的直鏈澱粉 [2]
- 35/00 支鏈澱粉化學衍生物之製備 [2]**
- 35/02 • 酯 [2]
- 35/04 • 醚 [2]
- 35/06 • 醚-酯 [2]
- 35/08 • 氧化的支鏈澱粉 [2]
- 37/00 不包括於 1/00 至 35/00 目內之多糖類的製備；其衍生物（纖維素見 D21）[4]**
- 37/02 • 葡聚糖；其衍生物 [2]
- 37/04 • 藻酸；其衍生物 [2]
- 37/06 • 果膠；其衍生物 [2]
- 37/08 • 幾丁質；硫酸軟骨素；玻尿酸；其衍生物 [2]
- 37/10 • 肝素；其衍生物 [2]
- 37/12 • 瓊酯；其衍生物 [2]
- 37/14 • 半纖維素；其衍生物 [2]
- 37/16 • 環糊精；其衍生物 [2]
- 37/18 • 儲備碳水化合物，例如糖原，菊糖花粉、昆布糖；其衍生物 [4]

C08C 橡膠之處理或化學改性

附註[2]

此次類包括：

- 對天然橡膠或共軛二烯橡膠處理之製程；
- 一般的橡膠之製程。

製備

位置。[2]

1/00 橡膠乳膠之處理

- 1/02 • 乳膠濃縮前或濃縮時之化學或物理處理
- 1/04 • • 精製；脫去蛋白質
- 1/06 • • 乳膠之防腐
- 1/065 • • 分散的橡膠粒子徑之增加 [2]
- 1/07 • • • 以使用的膠凝劑為特徵者[2]
- 1/075 • • 濃縮 [2]
- 1/08 • • • 借助於乳狀液分層劑 [2]
- 1/10 • • • 由離心分離而成 [2]
- 1/12 • • • 由蒸發方法 [2]
- 1/14 • 凝結
- 1/15 • • 以使用的凝結劑為特徵者 [2]
- 1/16 • • 呈絮凝狀

2/00 橡膠溶液之處理 [2]

- 2/02 • 精製 [2]
- 2/04 • • 催化劑殘渣之去除 [2]
- 2/06 • 由溶液提取橡膠 [2]

3/00 凝固橡膠之處理 [2]

- 3/02 • 精製 [2]

4/00 未包括於 1/00 至 3/02 內之橡膠在硫化前之處理 [2]

19/00 橡膠之化學改性 [2]

附註

在 19/02 至 19/30 目內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示時，製法請放入最後適當

- 19/02 • 氫化 [2]
- 19/04 • 氧化 [2]
- 19/06 • • 環氧化 [2]
- 19/08 • 解聚作用 [2]
- 19/10 • 異構化；環化 [2]
- 19/12 • 鹵素原子結合至分子內 [2]
- 19/14 • • 由與鹵素之反應而成 [2]
- 19/16 • • 由與鹵化氫之反應而成 [2]
- 19/18 • • 由與鹵素取代的烴之反應而成 [2]
- 19/20 • 硫原子結合至分子內 [2]
- 19/22 • 氮原子結合至分子內 [2]
- 19/24 • 磷原子結合至分子內 [2]
- 19/25 • 矽原子結合之分子內 [5]
- 19/26 • 金屬原子結合至分子內 [2]
- 19/28 • 與具碳—碳不飽和鍵之化合物反應（接枝聚合物見 C08F 279/00） [2]
- 19/30 • 一種試劑之加成作用，其與分子之一個雜原子或一個含雜原子之基團反應 [2]
- 19/32 • • 與鹵素或含鹵素基反應 [2]
- 19/34 • • 與氧或含氧基團反應 [2]
- 19/36 • • • 與羧基基團 [2]
- 19/38 • • • 與羥基基團 [2]
- 19/40 • • • 與環氧基團 [2]
- 19/42 • • 與金屬或含金屬基團反應 [2]
- 19/44 • • • 含金屬原子之聚合物，此僅於分子鏈上之一端或兩端上有金屬原子 [2]

C08F 僅用碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物（由低碳烴製造液態烴混合物，例如經由寡聚作用見 C10G 50/00；藉由發酵或使用酶催化反應以合成所欲之化合物、組合物或從消旋混合物中分離出光學異構物見 C12P；包含碳-碳不飽和鍵之單體於纖維、線、紗、織物或由此物質製成之纖維製品上之接枝聚合反應見 D06M 14/00）[2]

附註[2,7]

- (1) 於此次類內，硼及矽作為金屬。[2]
- (2) 於此次類內，以下所用術語之含意為：
 - “脂族基團”係指以下列各鍵結而予終結之無環或非芳香碳環骨架：
 - (a) 碳以外之元素；
 - (b) 與碳以外之一個對原子具有雙鍵結合之碳原子；
 - (c) 與芳香族碳環或雜環。
 - 例：
 - (a) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ 之聚合物分類見 16/28 目；
 - (b) $\text{CH}_2=\text{CH}-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 之聚合物分類見 16/36 目；
 - (c) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl}$ 之聚合物分類見 12/18 目。[2]
- (3) 化合物之治療活性，被進一步分入 A61P 次類內。[7]
- (4) 於此次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，催化劑或聚合物請放入最後適當位置。[2]
- (5) 於此次類中：
 - (a) 有關高分子化合物或其製備之發明，依所製化合物類型之目而分類。屬於一個以上主目之高分子化合物製備之一般製造法分類入 2/00 至 8/00 所用製程之目內。高分子化合物之製造法若屬重要時亦可分類入相對應於所採用的反應之目內； [2]
 - (b) 與均聚物及共聚物兩者均有關之發明分類見 10/00 至 38/00 目內； [2]
 - (c) 限於均聚物之發明僅分類見 110/00 至 138/00 目內； [2]
 - (d) 限於共聚物之發明僅分類見 210/00 至 246/00 目內； [2]
 - (e) 無相反指示時，於 210/00 至 238/00 目內之共聚物依其主要單體組份予以分類。[2]
- (6) 本次類尚包括由單體構成之各種組合物，該等單體形成之高分子化合物皆可分入此次類。[7]

於本次類中：[7]

 - (a) 如果單體很明確，則按照所形成之聚合物分類：[7]
 - 如果沒有預先形成之聚合物存在，則分入 10/00 至 246/00 目。[7]
 - 如果有預先形成之聚合物存在，則考慮要發生之反應是接枝或交

聯反應，分入 251/00 至 291/00 目；[7]

(b) 如果配合材料之存在很重要，則將之分類到 2/44 目；[7]

(c) 如果配合材料本身很重要，則將之分類到 C08K 次類下。[7]

次類索引

聚合製程；催化劑.....	2/00；4/00	均聚物.....	136/00
聚合後處理；化學改性.....	6/00；8/00	共聚物.....	236/00
具有一個或更多不飽和脂族 基團化合物之均聚物與共聚物， 每個不飽和脂族基團僅有一個		具有一個或更多的碳—碳三鍵 化合物之均聚物與共聚物.....	38/00
碳—碳雙鍵.....	10/00 至 30/00	均聚物.....	138/00
均聚物.....	110/00 至 130/00	共聚物.....	238/00
共聚物.....	210/00 至 230/00	烴與礦物油之共聚物.....	240/00
環狀化合物之均聚物與共聚物， 該環狀化合物側鏈上無不飽和脂族基， 而於環內有一個或更多個的		乾性油與其他單體之共聚物.....	242/00
碳—碳雙鍵.....	32/00 至 34/00	苯并呋喃—茚共聚物.....	244/00
均聚物.....	132/00，134/00	其中僅占少數之單體性質為 明確的共聚物.....	246/00
共聚物.....	232/00，234/00	接枝聚合物；以不飽和單體交聯 之聚合物.....	251/00 至 292/00
具有一個或更多的不飽和脂族基 之化合物之均聚物與共聚物， 至少一個脂族基具有兩個或 更多的碳—碳雙鍵.....	36/00	嵌段共聚物.....	293/00 至 297/00
		僅包括碳—碳不飽和鍵反應之 不同聚合物相互反應而得之 高分子化合物.....	299/00
		本次類各目中不包括的技術主題.....	301/00

方法；催化劑

2/00 聚合方法 [2]

- 2/01 • 以聚合反應所用裝置之特色為特徵者 [7]
- 2/02 • 塊狀聚合 [2]
- 2/04 • 溶液聚合（2/32 優先）[2]
- 2/06 • • 有機溶劑 [2]
- 2/08 • • • 使用對聚合物之分散劑者 [2]
- 2/10 • • 水溶劑 [2]
- 2/12 • 於非溶劑內聚合（2/32 優先）
- 2/14 • • 有機介質 [2]
- 2/16 • • 水介質 [2]
- 2/18 • • • 懸浮聚合 [2]
- 2/20 • • • • 使用高分子分散劑者 [2]
- 2/22 • • • 乳化聚合 [2]
- 2/24 • • • • 使用乳化劑 [2]
- 2/26 • • • • • 陰離子型乳化劑 [2]
- 2/28 • • • • • 陽離子型乳化劑 [2]
- 2/30 • • • • • 非離子型乳化劑 [2]
- 2/32 • 於油中水型乳液內之聚合 [2]
- 2/34 • 氣態內聚合 [2]
- 2/36 • 固態內聚合 [2]
- 2/38 • 使用調節劑之聚合，例如鏈終止劑 [2]
- 2/40 • • 使用聚合抑制劑者 [2]
- 2/42 • • 使用速止劑者 [2]
- 2/44 • 於配合成分之存在下聚合，例如增塑劑，染料，填充劑 [2]
- 2/46 • 由波能或粒子輻射引發之聚合作用 [2]
- 2/48 • • 由紫外光或可見光而成者 [2,2006.01]
- 2/50 • • • 使用光敏劑者 [2]
- 2/52 • • 由放電而成者，例如無聲放電處理 [2]
- 2/54 • • 由 X—射線或電子而成者 [2]
- 2/56 • • 由超音波振動而成者 [2]
- 2/58 • 令電流直接作用引發的聚合作用（電解法，例如電泳見 C25）[2]
- 2/60 • 利用二烯合成之聚合 [2]

4/00 聚合催化劑 [2]

4/02

• 所用之載體 [2]

附註

當載體特別需要考慮時，當分類入 4/04 至 4/42 各目內時，也可進而分類入 4/02 目。[2, 8]

4/04

• 偶氮化合物 [2]

4/06

• 除氫化物及金屬有機化合物以外之金屬化合物；鹵化硼或鹵化鋁與含氧有機化合物所形之錯合物 [2]

4/08

• • 鹼金屬者 [2]

4/10

• • 鹼土金屬，鋅，鎘，汞，銅或銀者 [2]

4/12

• • 硼，鋁，鎂，銦，鉈或稀土元素者 [2]

4/14

• • • 鹵化硼或鹵化鋁；該等與含氧有機化合物之錯合物 [2]

4/16

• • 矽，鍺，錫，鉛，鈦，銻或鉛者 [2]

4/18

• • • 氧化物 [2]

4/20

• • 銻，鉍，釷，銻或鉍者 [2]

4/22

• • 鉻，鉬，或鎢者 [2]

4/24

• • • 氧化物 [2]

4/26

• • 錳，鐵族金屬或鉑族金屬者 [2]

4/28

• 氧或釋出游離氧之化合物（氧化還原系統見 4/40）[2]

4/30

• • 無機化合物 [2]

4/32

• • 有機化合物 [2]

4/34

• • • 具有一個過氧基團之過氧化物 [2]

4/36

• • • 具有二個以上過氧基團之過氧化物 [2]

4/38

• • • 過氧化合物之混合物 [2]

4/40

• 氧化還原系統 [2]

4/42

• 金屬，金屬氫化物；金屬有機化合物；當作該等之催化劑母體之使用 [2]

4/44

• • 選自輕金屬，鋅，鎘，汞，銅，銀，金，硼，鎂，銦，鉈，稀土元素或鈷族元素者 [2]

4/46

• • • 選自鹼金屬者 [2]

- 4/48 選自鋰，銦，鉍或鎳者 [2]
- 4/50 選自鹼土金屬，鋅，鎘，汞，銅，或銀者 [2]
- 4/52 選自硼，鋁，鎂，銦，鉍或稀土元素（4/14 優先）[2]
- 4/54 與其他化合物同時使用者[2]
- 4/56 含有鹼金屬為僅有之金屬，例如醇（鹼金屬）烯催化劑 [2]
- 4/58 當矽，鎢，錫，鉛，銻，鉍或該等之化合物同時使用者 [2]
- 4/60 與高熔點金屬，鐵族金屬，鉑族金屬，錳，鎳，銻或該等之化合物同時使用者 [2,5]
- 附註[5]**
- 於 4/602 至 4/62 目內所用的術語之含意如下所示：
- “組成分”包括一種經過或未經前處理之過渡金屬或其化合物而成。[5]
- 4/602 含有有機鋁化合物且包含於 4/60 目內之成分 [5]
- 4/603 含有一種被包含於除有機鋁化合物以外之 4/44 目之金屬或化合物，且包含於 4/60 目內之成分 [5]
- 4/605 含有屬於 4/602 與 4/603 目內之二者而被包含於 4/44 目內之一種金屬或化合物，且包含於 4/60 目內之成分 [5]
- 4/606 由加上被包含於 4/60 目內之成分，呈現金屬形狀或作為該等之化合物，至少二種不同之金屬組成之催化劑 [5]
- 4/607 含有不含金屬之特定化合物者 [5]
- 4/608 無機者 [5]
- 4/609 有機者 [5]
- 4/61 於與被包含於 4/44 目內之金屬或化合物間之最終接觸前，前處理被包含於 4/60 目內之金屬或化合物者 [5]
- 4/611 以不含金屬之化合物前處理者 [5]
- 4/612 以金屬或金屬化合物前處理者 [5]
- 4/613 以包含於 4/60 目內之金屬或該等之化合物 [5]
- 4/614 以鎂或該等之化合物 [5]
- 4/615 以鋁或該等之化合物 [5]
- 4/616 以矽或該等之化合物 [5]
- 4/617 以不分類於 4/613~4/616 目內之金屬或金屬化合物 [5]
- 4/618 屬於 4/613~4/617 之多數的目內之金屬或含金屬化合物 [5]
- 4/619 包含於 4/60 目內且含一個過渡金屬—碳鍵之成分 [8]
- 4/6192 至少含一個稠合或未稠合的環戊二烯環，例如，茚基環或芴基環 [8]
- 4/62 耐熱性金屬或其化合物
- 4/622 含有一個有機鋁化合物，且包含於 4/62 目內之成分 [5]
- 4/623 含有一種被包含於除有機鋁化合物以外之 4/44 目內之金屬或化合物，且包含於 4/62 目內之成分 [5]
- 4/625 含有屬於 4/622 與

- 4/623 目內之二者而被包含於 4/44 目內之一種金屬或化合物，且包含於 4/62 目內之成分 [5]
- 4/626 由加上被包含於 4/62 目內之成分，呈現金屬形狀或作為該等之化合物，至少二種不同之金屬組成之催化劑 [5]
- 4/627 含有不含金屬之特定化合物之催化劑 [5]
- 4/628 無機者 [5]
- 4/629 有機者 [5]
- 4/63 於與被包含於 4/44 目內之金屬或化合物間之最終接觸前，前處理被包含於 4/62 目內之金屬或化合物者 [5]
- 4/631 以不含金屬之化合物前處理者 [5]
- 4/632 以金屬或金屬化合物前處理者 [5]
- 4/633 以包含於 4/62 目內之金屬或該等之化合物 [5]
- 4/634 以鎂或該等之化合物 [5]
- 4/635 以鋁或該等之化合物 [5]
- 4/636 以矽或該等之化合物 [5]
- 4/637 以不分類於 4/633 ~ 4/636 目內之金屬或金屬化合物 [5]
- 4/638 以屬於 4/633 ~ 4/637 之多數的目內之金屬或含金屬化合物 [5]
- 4/639 包含於 4/62 目內且含一個過渡金屬-碳鍵之成分 [8]
- 4/6392 至少含一個稠合或未稠合的環戊二烯環，例如，茚基環或芴基環 [8]
- 4/64 鈦，鋇，鉛或該等之化合物 [2]
- 4/642 含有 1 個有機鋁化合物，且包含於 4/64 目內之成分 [5]
- 4/643 含有一種被包含於除有機鋁化合物以外之 4/44 目內之金屬或化合物，且包含於 4/64 目內之成分 [5]
- 4/645 含有屬於 4/642 與 4/623 目內之二者而被包含於 4/44 目內之一種金屬或化合物，且包含 4/64 目內之成分 [5]
- 4/646 由加上被包含於 4/64 目內之成分，呈現金屬形狀或作為該等之化合物，至少二種不同之金屬組成之催化劑 [5]
- 4/647 含有不含金屬之特定化合物之催化劑 [5]
- 4/648 無機者 [5]
- 4/649 有機者 [5]
- 4/65 於與被包含於 4/44 目內之金屬或化合物間之最終接觸前，前處理被包含於 4/64 目內之金屬或化合物者 [5]
- 4/651 以不含金屬之化合物前處理者 [5]
- 4/652 以金屬或金屬化合物前處理者 [5]
- 4/653 以包含於 4/64 目內之金屬或該等之化合物 [5]

4/654	• • • • • 以鎂或該等之化合物 [5]	6/02	• 聚合塊之中和，例如催化劑之抑制（快速中止見 2/42） [2]
4/655	• • • • • 以鋁或該等之化合物 [5]	6/04	• 分級 [2]
4/656	• • • • • 以矽或該等之化合物 [5]	6/06	• 聚合物溶液之處理 [2]
4/657	• • • • • 以不分類於 4/653 ~4/656 目內之金屬或金屬化合物 [5]	6/08	• • 催化劑殘渣之去除 [2]
4/658	• • • • • 以屬於 4/653 ~4/657 之多數的目內之金屬或金屬化合物 [5]	6/10	• • 揮發性物質，例如單體，溶劑之去除 [2]
4/659	• • • • • 包含於 4/64 目內且含一個過渡金屬—碳鍵之成分 [8]	6/12	• • 由溶液分離出聚合物 [2]
4/6592	• • • • • 至少含一個稠合或未稠合的環戊二烯環，例如，茚基環或芴基環 [8]	6/14	• 聚合物乳液之處理 [2]
4/68	• • • • • 鈮，鈮，鉭或該等之化合物 [2]	6/16	• • 精製 [2]
4/685	• • • • • 同時採用鈮或其化合物與鈦或其化合物 [5]	6/18	• • 分散粒子之粒度的增加 [2]
4/69	• • • • • 鉻，鉭，鎢或該等之化合物 [5]	6/20	• • 濃縮 [2]
4/695	• • • • • 錳，鎳，銻或該等之化合物 [5]	6/22	• • 凝結 [2]
4/70	• • • • • 鐵族金屬，鉭族金屬或此等之化合物 [5]	6/24	• 聚合懸浮液之處理 [2]
4/72	• • 選自不屬於 4/44 目內之金屬（4/54 至 4/70 優先） [2]	6/26	• 由塊狀聚合製備而得之聚合物之處理 [2]
4/74	• • • 選自高熔點金屬者 [2]	6/28	• • 精製 [2]
4/76	• • • • 選自鈦，銻，鉛，鈮，鉭或鉭者 [2]	8/00	用後處理進行化學改性（接枝聚合物、嵌段聚合物、與不飽和單體或與聚合物交聯見 251/00 至 299/00，對於共軛二烯橡膠見 C08C） [2]
4/78	• • • • 選自鉻、鉭或鎢者 [2]	附註	
4/80	• • • 選自鐵族金屬或鉑族金屬 [2]		
4/82	• • • • π -烯丙基錯合物 [2]	於 8/02 至 8/50 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示時，方法請放入最後適當位置。 [2]	
6/00	聚合後之處理（8/00 優先；有關共軛二烯橡膠者見 C08C） [2]		
		8/02	• 烷基化 [2]
		8/04	• 還原，例如氫化 [2]
		8/06	• 氧化 [2]
		8/08	• 環氧化 [2]
		8/10	• 醯化 [2]
		8/12	• 水解 [2]
		8/14	• 酯化 [2]
		8/16	• • 內酯化 [2]
		8/18	• 引入鹵素原子或含鹵素基團 [2]
		8/20	• • 鹵化 [2]
		8/22	• • • 與游離鹵素反應 [2]
		8/24	• • 鹵烷化 [2]
		8/26	• 由分子中去除鹵素原子或含鹵素基團 [2]

- 8/28 • 與醛或酮縮合 [2]
- 8/30 • 引入氮原子或含氮基團 [2]
- 8/32 • • 與胺類反應 [2]
- 8/34 • 引入硫原子或含硫基團 [2]
- 8/36 • • 磺化；硫酸鹽化 [2]
- 8/38 • • 磺鹵化 [2]
- 8/40 • 引入磷原子或含磷基團 [2]
- 8/42 • 引入金屬原子或含金屬基團 [2]
- 8/44 • 金屬鹽或銨鹽之製備 [2]
- 8/46 • 與不飽和二羧酸或其酸酐反應，
例如馬來化反應 [2]
- 8/48 • 異構化；環化 [2]
- 8/50 • 部分解聚作用 [2]

均聚物與共聚物

- 10/00 僅有一個碳—碳雙鍵之不飽和脂族烴之均聚物與共聚物 [2]**
- 10/02 • 乙烯 [2]
- 10/04 • 含有三個或四個碳原子之單體 [2]
- 10/06 • • 丙烯 [2]
- 10/08 • • 丁烯 [2]
- 10/10 • • • 異丁烯 [2]
- 10/14 • 含有五個或更多碳原子之單體 [2]
- 12/00 具有一個或更多的不飽和脂族基團化合物之均聚物與共聚物，每個不飽和脂族基團僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以芳香族碳環為終端者 [2]**
- 12/02 • 僅含有一個不飽和脂族基之單體 [2]
- 12/04 • • 含一個環者 [2]
- 12/06 • • • 烴 [2]
- 12/08 • • • • 苯乙烯 [2]
- 12/12 • • • • 含有一個連接至環上之歧化的不飽和脂族基團或烷基基團者 [2]
- 12/14 • • • 為雜原子或含有雜原子基團所取代者 [2]
- 12/16 • • • • 鹵素 [2]
- 12/18 • • • • • 氯 [2]

- 12/20 • • • • • 氟 [2]
- 12/22 • • • • • 氧 [2]
- 12/24 • • • • • 酚類及醇類 [2]
- 12/26 • • • • • 氮 [2]
- 12/28 • • • • • 胺類 [2]
- 12/30 • • • • • 硫 [2]
- 12/32 • • 含兩個或更多之環者 [2]
- 12/34 • 含兩個或更多之不飽和脂族基單體 [2]
- 12/36 • • 二乙烯苯 [2]

14/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物與共聚物，每個不飽和脂族基僅有一碳—碳雙鍵，且至少有一個係以鹵素為終端者 [2]

- 14/02 • 含氯單體 [2]
- 14/04 • • 具兩個碳原子單體者 [2]
- 14/06 • • • 氯乙烯 [2]
- 14/08 • • • 二氯亞乙烯 [2]
- 14/12 • • • 1,2—二氯乙烯 [2]
- 14/14 • • 具三個或更多碳原子之單體者 [2]
- 14/16 • 含有溴或碘之單體 [2]
- 14/18 • 含氟之單體 [2]
- 14/20 • • 氟乙烯 [2]
- 14/22 • • 二氟亞乙烯 [2]
- 14/24 • • 三氟氯乙烯 [2]
- 14/26 • • 四氟乙烯 [2]
- 14/28 • • 六氟丙烯 [2]

16/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物與共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以醇，醚，醛，酮，醛縮醇，或酮縮醇基為終端者 [2]

- 16/02 • 由醇基而成 [2]
- 16/04 • • 無環化合物 [2]
- 16/06 • • • 聚乙烯醇 [2]
- 16/08 • • • 烯丙醇 [2]
- 16/10 • • 碳環化合物 [2]
- 16/12 • 由醚基而成 [2]

- 16/14 · · 含有一個不飽和脂族基者 [2]
- 16/16 · · · 除醚之氧原子外不含其他雜原子者 [2]
- 16/18 · · · · 無環化合物 [2]
- 16/20 · · · · · 於不飽和脂族基內含有三個或更多碳原子者 [2]
- 16/22 · · · · 碳環化合物 [2]
- 16/24 · · · 含鹵素者 [2]
- 16/26 · · · 除醚之氧原子外尚含有其他氧原子之單體 [2]
- 16/28 · · · 含氮者 [2]
- 16/30 · · · 含硫者 [2]
- 16/32 · · 含有兩個或更多之不飽和脂族基者 [2]
- 16/34 · 由醛基而成 [2]
- 16/36 · 由酮基而成 [2]
- 16/38 · 由醛縮醇或酮縮醇基而成 [2]
- 18/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以飽和羧酸或碳酸或鹵甲酸之醯氧基為終端者 [2]**
- 18/02 · 單羧酸酯 [2]
- 18/04 · · 乙烯基酯 [2]
- 18/06 · · · 甲酸乙烯酯 [2]
- 18/08 · · · 乙酸乙烯酯 [2]
- 18/10 · · · 含有三個或更多碳原子之單羧酸酯 [2]
- 18/12 · · 與含三個或更多碳原子之不飽和醇者 [2]
- 18/14 · 多元羧酸之酯類 [2]
- 18/16 · · 與含三個或更多碳原子之醇者 [2]
- 18/18 · · · 鄰苯二甲酸二丙烯酯 [2]
- 18/20 · 含鹵素之酯類 [2]
- 18/22 · 含氮之酯類 [2]
- 18/24 · 碳酸或鹵甲酸之酯類 [2]
- 20/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—**
- 碳雙鍵，且僅有一個係以羧基或其鹽，酐，酯，醯胺，醯亞胺或腈為終端者 [2]**
- 20/02 · 具有少於十個碳原子之單羧酸；其衍生物 [2]
- 20/04 · · 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 20/06 · · · 丙烯酸；甲基丙烯酸；該等之金屬鹽或銨鹽 [2]
- 20/08 · · 酐 [2]
- 20/10 · · 酯 [2]
- 20/12 · · · 一元醇或酚之酯類 [2]
- 20/14 · · · · 甲酯 [2]
- 20/16 · · · · 酚或含有兩個或更多碳原子之醇之酯類 [2]
- 20/18 · · · · · 與丙烯酸或甲基丙烯酸 [2]
- 20/20 · · · 多元醇或酚之酯 [2]
- 20/22 · · · 含鹵素之酯 [2]
- 20/24 · · · · 含全鹵烷基者 [2]
- 20/26 · · · 除羧基之氧外尚含其他氧之酯 [2]
- 20/28 · · · · 於醇部殘基上無芳香環者 [2]
- 20/30 · · · · 於醇部殘基上有芳香環者 [2]
- 20/32 · · · · 含有環氧基者 [2]
- 20/34 · · · 含氮之酯 [2]
- 20/36 · · · · 除羧基之氧外尚含有其他氧者 [2]
- 20/38 · · · 含硫之酯 [2]
- 20/40 · · · 不飽和醇之酯 [2]
- 20/42 · · 腈 [2]
- 20/44 · · · 丙烯腈 [2]
- 20/50 · · · 含四個或更多的碳原子者 [2]
- 20/52 · · 醯胺或醯亞胺 [2]
- 20/54 · · · 醯胺 [2]
- 20/56 · · · · 丙烯醯胺；甲基丙烯醯胺 [2]
- 20/58 · · · · 除碳醯胺基之氧外尚含有其他氧者 [2]
- 20/60 · · · · 除碳醯胺基之氮外尚含有其他氮者 [2]

- 20/62 • 具有十個或更多碳原子之單羧酸；其衍生物 [2]
- 20/64 • • 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 20/66 • • 酐 [2]
- 20/68 • • 酯 [2]
- 20/70 • • 腈；醯胺；醯亞胺 [2]
- 22/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個以羧基為終端，且於分子中至少含另外一個羧基：其鹽，酐，酯，醯胺，醯亞胺，或腈 [2]**
- 22/02 • 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 22/04 • 酐，例如環酐 [2]
- 22/06 • • 順丁烯二酸酐 [2]
- 22/10 • 酯 [2]
- 22/12 • • 酚或飽和醇之酯 [2]
- 22/14 • • • 無游離羧酸基之酯 [2]
- 22/16 • • • 有游離羧酸基之酯 [2]
- 22/18 • • • 含鹵素之酯 [2]
- 22/20 • • • 除羧基之氧外尚含其他氧之酯 [2]
- 22/22 • • • 含氮之酯 [2]
- 22/24 • • • 含硫之酯 [2]
- 22/26 • • 不飽和醇者 [2]
- 22/28 • • • 順丁烯二酸二丙烯酸酯 [2]
- 22/30 • 腈 [2]
- 22/32 • • α —氰基—丙烯酸；其酯 [2]
- 22/34 • • 二氰亞乙烯 [2]
- 22/36 • 醯胺或醯亞胺 [2]
- 22/38 • • 醯胺 [2]
- 22/40 • • 醯亞胺，例如環醯亞胺 [2]
- 24/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以含氧之雜環為終端（多官能酸之環酯見 18/00；不飽和酸之環酐見 20/00、22/00） [2]**
- 26/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以對於氮之單鍵或雙鍵，或以含氮之雜環為終端 [2]**
- 26/02 • 為由對氮之單鍵或雙鍵予以終結的單體 [2]
- 26/04 • • 二烯丙基胺 [2]
- 26/06 • 以由含氮之雜環所終結之單體 [2]
- 26/08 • • N—乙基—吡咯烷 [2]
- 26/10 • • N—乙基—吡咯烷酮 [2]
- 26/12 • • N—乙基—吡啶 [2]
- 28/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，並且至少有一個係以對硫的鍵或以一個含硫之雜環為終端 [2]**
- 28/02 • 為由對硫之鍵結予以終結的單體 [2]
- 28/04 • • 硫醚 [2]
- 28/06 • 由含硫之雜環所終結之單體 [2]
- 30/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且含有磷、硒、碲或一種金屬 [2,2006.01]**
- 30/02 • 含磷之單體 [2]
- 30/04 • 含金屬之單體 [2]
- 30/06 • • 硼 [2]
- 30/08 • • 矽 [2]
- 30/10 • • 鍺 [2]
- 32/00 環狀化合物之均聚物或共聚物，該環狀化合物側鏈上無不飽和脂族基，而於碳環系內有一個或更多之碳—雙鍵 [2]**
- 32/02 • 不具有稠環之單體 [2]

- 32/04 · · 含有一個碳—碳雙鍵者 [2]
- 32/06 · · 含有兩個或更多之碳—碳雙鍵 [2]
- 32/08 · 具有稠環之單體 [2]
- 34/00 環狀化合物之均聚物或共聚物，該環狀化合物側鏈上無不飽和脂族基，而於雜環上有一個或更多之碳—碳雙鍵（多元酸之環酯見 18/00；環酞或鹽亞胺見 22/00） [2]**
- 34/02 · 環中含氧之單體 [2]
- 34/04 · 環中含硫之單體 [2]
- 36/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物，至少有一個不飽和脂族基具有兩個或更多之碳—碳雙鍵（32/00 優先） [2]**
- 36/02 · 含有兩個碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]
- 36/04 · · 共軛者 [2]
- 36/06 · · · 丁二烯 [2]
- 36/08 · · · 異戊二烯 [2]
- 36/14 · · · 含有碳與氫以外之元素者 [2]
- 36/16 · · · · 鹵素 [2]
- 36/18 · · · · · 氮 [2]
- 36/20 · · 非共軛系
- 36/22 · 含有三個或更多碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]
- 38/00 具有一個或更多之碳—碳三鍵化合物之均聚物或共聚物 [2]**
- 38/02 · 乙炔 [2]
- 38/04 · 乙烯基乙炔 [2]
- 均聚物 [2]**
- 110/00 僅有一個碳—碳雙鍵之不飽和脂族基的均聚物 [2]**
- 110/02 · 乙烯 [2]
- 110/04 · 具有三或四個碳原子之單體 [2]
- 110/06 · · 丙烯 [2]
- 110/08 · · 丁烯 [2]
- 110/10 · · · 異丁烯 [2]
- 110/14 · 具有五個或更多碳原子之單體 [2]
- 112/00 具有一個或更多個不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以芳族碳環為終端 [2]**
- 112/02 · 具有一個不飽和脂族基之單體 [2]
- 112/04 · · 具一個環者 [2]
- 112/06 · · · 烴 [2]
- 112/08 · · · · 苯乙烯 [2]
- 112/12 · · · · 含有一個連至環上之歧化的不飽和脂族基團或烷基基團 [2]
- 112/14 · · · 為雜原子或含雜原子之基團所取代者 [2]
- 112/32 · · 具有兩個或更多之環者 [2]
- 112/34 · 含兩個或更多不飽和脂族基之單體 [2]
- 112/36 · · 二乙烯基苯 [2]
- 114/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以鹵素為終端 [2]**
- 114/02 · 含氮單體 [2]
- 114/04 · · 含兩個碳原子之單體 [2]
- 114/06 · · · 氯乙烯 [2]
- 114/08 · · · 二氯亞乙烯 [2]
- 114/12 · · · 1,2-二氯乙烯 [2]
- 114/14 · · 含三個或更多碳原子之單體 [2]
- 114/16 · 含溴或碘之單體 [2]
- 114/18 · 含氟單體 [2]
- 114/20 · · 氟乙烯 [2]
- 114/22 · · 二氟亞乙烯 [2]
- 114/24 · · 三氟氯乙烯 [2]
- 114/26 · · 四氟乙烯 [2]
- 114/28 · · 六氟丙烯 [2]
- 116/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵**

，且至少有一個係以醇，醚，醛，
酮，醛縮醇，或酮縮醇基為終端
[2]

116/02 · 由醇基而成者 [2]

116/04 · · 無環化合物 [2]

116/06 · · · 聚乙烯醇 [2]

116/08 · · · 烯丙基醇 [2]

116/10 · · 碳環化合物 [2]

116/12 · 由醚基而成者 [2]

116/14 · · 具有一個不飽和脂族基者 [2]

116/16 · · · 除醚之氧外不含雜原子者 [2]

116/18 · · · · 無環化合物 [2]

116/20 · · · · · 於不飽和脂族基中含三
個或更多碳原子之單
體 [2]

116/34 · 由醛基而成者 [2]

116/36 · 由酮基而成者 [2]

116/38 · 由醛縮醇或酮縮醇基而成者 [2]

118/00 具有一個或更多的不飽和脂族
基化合物之均聚物，每個不飽和
脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且
至少有一個係以飽和羧酸，碳
酸，或鹵甲酸之鹽基為終端 [2]

118/02 · 單羧酸之酯 [2]

118/04 · · 乙基酯 [2]

118/06 · · · 甲酸乙酯 [2]

118/08 · · · 乙酸乙酯 [2]

118/10 · · · 含三個或更多碳原子之單羧
酸 [2]

118/12 · · 與含三個或更多碳原子之不飽
和醇間之酯 [2]

118/14 · 多元羧酸酯 [2]

118/16 · · 與含三個或更多碳原子之不飽
和醇間之酯 [2]

118/18 · · · 鄰苯二甲酸二烯丙酯 [2]

120/00 具有一個或更多的不飽和脂族
基化合物之均聚物，每個不飽和
脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且
僅有一個係以羧基或其鹽、酐、
酯、鹽胺、鹽亞胺或腈為終端 [2]

120/02 · 具有少於十個碳原子之單羧酸；
其衍生物 [2]

120/04 · · 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]

120/06 · · · 丙烯酸；甲基丙烯酸；該等
之金屬鹽或銨鹽 [2]

120/08 · · 酐 [2]

120/10 · · 酯 [2]

120/12 · · · 一元醇或酚之酯 [2]

120/14 · · · · 甲酯 [2]

120/16 · · · · 酚或含有兩個或更多碳原
子之醇的酯 [2]

120/18 · · · · · 與丙烯酸或甲基丙烯酸
[2]

120/20 · · · 多元醇或酚之酯 [2]

120/22 · · · 含鹵素之酯 [2]

120/24 · · · · 含全鹵烷基者 [2]

120/26 · · · 除羧基之氧外尚含其他氧之
酯 [2]

120/28 · · · · 於醇部殘基上無芳香環者
[2]

120/30 · · · · 於醇部殘基上有芳香環者
[2]

120/32 · · · · 具有環氧基者 [2]

120/34 · · · 含氮之酯 [2]

120/36 · · · · 除羧基之氧外尚含其他氧之
酯 [2]

120/38 · · · 含硫之酯 [2]

120/40 · · · 不飽和醇之酯 [2]

120/42 · · 腈 [2]

120/44 · · · 丙烯腈 [2]

120/50 · · · 含有四個或更多之碳原子者
[2]

120/52 · · 鹽胺或鹽亞胺 [2]

120/54 · · · 鹽胺 [2]

120/56 · · · · 丙烯鹽胺；甲基丙烯鹽胺
[2]

120/58 · · · · 除碳鹽胺基之氧外尚含其
他氧者 [2]

120/60 · · · · 除碳鹽胺基之氮外尚含其
他氮者 [2]

120/62 · 具有十個或更多碳原子之單羧
酸；其衍生物 [2]

120/64 · · 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]

120/66 · · 酐 [2]

120/68 · · 酯 [2]

120/70 · · 腈；醯胺；醯亞胺 [2]

122/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以羧基為終端，且於分子中至少含有另外一個羧基；其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或腈 [2]

122/02 · 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]

122/04 · 酐，例如環酐 [2]

122/06 · · 順丁烯二酸酐 [2]

122/10 · 酯 [2]

122/12 · · 酚或飽和醇者 [2]

122/14 · · · 不含有游離羧基之酯 [2]

122/16 · · · 含有游離羧基之酯 [2]

122/18 · · · 含鹵素之酯 [2]

122/20 · · · 除羧基之氧外尚含其他氧之酯 [2]

122/22 · · · 含氮之酯 [2]

122/24 · · · 含硫之酯 [2]

122/26 · · 不飽和醇者 [2]

122/28 · · · 順丁烯二酸二烯丙酯 [2]

122/30 · 腈 [2]

122/32 · · α -氰基—丙烯酸；其酯 [2]

122/34 · · 二氰亞乙烯 [2]

122/36 · 醯胺或醯亞胺 [2]

122/38 · · 醯胺 [2]

122/40 · · 醯亞胺，例如環醯亞胺 [2]

124/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以含氧雜環為終端（多元酸之環酯見 118/00；不飽和之環酐見 120/00、122/00）[2]

126/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以對氮之單鍵或

雙鍵，或以含氮雜環為終端 [2]

126/02 · 為由對氮之單鍵或雙鍵予以終結之單體

126/04 · · 二烯丙基胺 [2]

126/06 · 以由氮之雜環所終結之單體

126/08 · · N—乙基—吡咯烷 [2]

126/10 · · N—乙基—吡咯烷酮 [2]

126/12 · · N—乙基—吡啶 [2]

128/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且含有至少有一個係以對硫之鍵或含硫雜環為終端 [2]

128/02 · 為由對硫之鍵結予以終結之單體 [2]

128/04 · · 硫醚 [2]

128/06 · 以由含硫之雜環所終結之單體 [2]

130/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且含有磷、砷、碲或一種金屬 [2,2006.01]

130/02 · 含磷之單體 [2]

130/04 · 含金屬之單體 [2]

130/06 · · 硼 [2]

130/08 · · 矽 [2]

130/10 · · 鍺 [2]

132/00 環狀化合物之均聚物，該環狀化合物側鍵上無不飽和之脂族基，而於碳環系內有一個或更多之碳—碳雙鍵 [2]

132/02 · 不具有稠環之單體 [2]

132/04 · · 含有一個碳—碳雙鍵者 [2]

132/06 · · 含有兩個或更多之碳—碳雙鍵者 [2]

132/08 · 具有稠環者 [2]

134/00 環狀化合物之均聚物，該環狀化合物側鍵上無不飽和脂族基，而於雜環上有一個或更多碳—碳

雙鍵（多元酸之環酯見 118/00；環酞或醯亞胺見 122/00）[2]

134/02 · 環中含氧之單體 [2]

134/04 · 環中含硫之單體 [2]

136/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物，至少有一個不飽和脂族基具有兩個或更多之碳—碳雙鍵（132/00 優先）

136/02 · 含有兩個碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]

136/04 · · 共軛系 [2]

136/06 · · · 丁二烯 [2]

136/08 · · · 異戊二烯 [2]

136/14 · · · 含有碳與氫以外之元素者[2]

136/16 · · · · 鹵素 [2]

136/18 · · · · · 氯 [2]

136/20 · · 非共軛系 [2]

136/22 · 含有三個或更多碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]

138/00 具有一個或更多的碳—碳三鍵化合物之均聚物 [2]

138/02 · 乙炔 [2]

138/04 · 乙烯基乙炔 [2]

共聚物 [2]

附註

(1) 在本分類範圍，當分類入 210/10 至 297/00 目內時，根據 C08F 標題後之附註(4)無法確定的單體成分，而此類單體成分之使用是新穎和非顯而易見的，請依據末位規則放入 210/00 至 238/00 目內最後適當位置。[8]

(2) 根據 C08F 標題後之附註(4)或上述附註(1)無法確定的單體成分，而此類單體成分之使用被認為代表了對檢索重要的資訊，請依據末位規則放入 210/00 至 238/00 目內最後適

當位置。使用分類號組合對於檢索共聚物是重要的情況下，這些非強制分類應該作為“附加資訊”給出。[8]

210/00 僅含一個碳—碳雙鍵之不飽和脂族基的共聚物 [2]

210/02 · 乙烯 [2]

210/04 · 含有三個或四個碳原子之單體 [2]

210/06 · · 丙烯 [2]

210/08 · · 丁烯 [2]

210/10 · · · 異丁烯 [2]

210/12 · · · · 與共軛二烯，如丁基橡膠 [2]

210/14 · 含五個或更多碳原子之單體 [2]

210/16 · 乙烯與 α —烯烴之共聚物，如乙烯丙烯（EP）橡膠 [2]

210/18 · · 與非共軛二烯，如乙烯丙烯三聚物（EPT）橡膠 [2]

212/00 具有一個或更多不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以芳族碳環為終端 [2]

212/02 · 含有一個不飽和脂族基之單體 [2]

212/04 · · 含一個環者 [2]

212/06 · · · 烴 [2]

212/08 · · · · 苯乙烯 [2]

212/10 · · · · · 與腈 [2]

212/12 · · · · 含一個連接至環上之歧化的不飽和脂族基團或烷基基團者 [2]

212/14 · · · 為雜原子或含雜原子之基團所取代者 [2]

212/32 · · 含兩個或更多之環者 [2]

212/34 · 含兩個或更多不飽和脂族基之單體 [2]

212/36 · · 二乙烯基苯 [2]

214/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且

至少有一個係以鹵素為終端 [2]

- 214/02 · 含氯之單體 [2]
- 214/04 · · 含兩個碳原子之單體 [2]
- 214/06 · · · 氯乙烯 [2]
- 214/08 · · · 二氯亞乙烯 [2]
- 214/10 · · · · 與腈 [2]
- 214/12 · · · 1,2-二氯乙烯 [2]
- 214/14 · · 含三個或更多碳原子之單體
- 214/16 · 含溴或碘之單體 [2]
- 214/18 · 含氟之單體 [2]
- 214/20 · · 氟乙烯 [2]
- 214/22 · · 二氟亞乙烯 [2]
- 214/24 · · 三氟氯乙烯 [2]
- 214/26 · · 四氟乙烯 [2]
- 214/28 · · 六氟丙烯 [2]

216/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以醇，醚，醛，酮，醛縮醇，或酮縮醇基為終端 [2]

- 216/02 · 由醇基 [2]
- 216/04 · · 無環化合物 [2]
- 216/06 · · · 聚乙烯醇 [2]
- 216/08 · · · 烯丙基醇 [2]
- 216/10 · · 碳環化合物 [2]
- 216/12 · 由一個醚基而成者 [2]
- 216/14 · · 含有一個不飽和脂族基之單體 [2]
- 216/16 · · · 除醚基之氧外不含雜原子之單體 [2]
- 216/18 · · · · 無環化合物 [2]
- 216/20 · · · · · 於不飽和脂族基中含有三個或更多碳原子之單體 [2]
- 216/34 · 由一個醛基而成者 [2]
- 216/36 · 由一個酮基而成者 [2]
- 216/38 · 由一個醛縮醇或酮縮醇基而成者 [2]

218/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且**至少有一個係以飽和羧酸、碳酸或鹵甲酸之酯氧基為終端 [2]**

- 218/02 · 單羧酸之酯 [2]
- 218/04 · · 乙烯基酯 [2]
- 218/06 · · · 甲酸乙烯酯 [2]
- 218/08 · · · 乙酸乙烯酯 [2]
- 218/10 · · · 含三個或更多碳原子單羧酸之酯 [2]
- 218/12 · · 與含三個或更多碳原子不飽和醇之酯 [2]
- 218/14 · 多元羧酸之酯 [2]
- 218/16 · · 與含三個或更多碳原子之醇 [2]
- 218/18 · · · 鄰苯二甲酸二烯丙酯 [2]

220/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基只有一個碳—碳雙鍵，且僅有一個係僅以羧基或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或腈為終端 [2]

- 220/02 · 具有少於十個碳原子之單羧酸；其衍生物 [2]
- 220/04 · · 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 220/06 · · · 丙烯酸；甲基丙烯酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 220/08 · · 酐 [2]
- 220/10 · · 酯 [2]
- 220/12 · · · 一元醇或酚之酯 [2]
- 220/14 · · · · 甲酯 [2]
- 220/16 · · · · 酚或含兩個或更多碳原子之醇之酯 [2]
- 220/18 · · · · · 與丙烯酸或甲基丙烯酸 [2]
- 220/20 · · · 多元醇或多元酚之酯 [2]
- 220/22 · · · 含鹵素之酯 [2]
- 220/24 · · · · 含全鹵烷基者 [2]
- 220/26 · · · 除羧基之氧外尚含其他氧之酯 [2]
- 220/28 · · · · 在醇部殘基不含芳香環者 [2]
- 220/30 · · · · 於醇部殘基含芳香環者 [2]
- 220/32 · · · · 於醇部殘基含環氧基團者 [2]

- 220/34 . . . 含氮之酯 [2]
- 220/36 . . . 除羧基之氧外尚含其他氧者 [2]
- 220/38 . . . 含硫之酯 [2]
- 220/40 . . . 不飽和醇之酯 [2]
- 220/42 . . 腈 [2]
- 220/44 . . . 丙烯腈 [2]
- 220/46 . . . 與羧酸、磺酸或該等之鹽 [2]
- 220/48 . . . 與含氮單體 [2]
- 220/50 . . . 含四個或更多之碳原子者 [2]
- 220/52 . . 醯胺或醯亞胺 [2]
- 220/54 . . . 醯胺 [2]
- 220/56 . . . 丙烯醯胺；甲基丙烯醯胺 [2]
- 220/58 . . . 除碳醯胺之氧外尚含其他氧者 [2]
- 220/60 . . . 除碳醯胺之氮外尚含其他氮者 [2]
- 220/62 . 具有十個或更多碳原子之單羧酸；其衍生物 [2]
- 220/64 . . 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 220/66 . . 酐 [2]
- 220/68 . . 酯 [2]
- 220/70 . . 腈；醯胺；醯亞胺 [2]

222/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，至少有一個係以羧基為終端，且於分子中至少含有另外一個羧基或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺、或腈 [2]

- 222/02 . 酸；其金屬鹽或銨鹽 [2]
- 222/04 . 酐，如環酐 [2]
- 222/06 . . 順丁烯二酸酐 [2]
- 222/08 . . . 與乙烯基芳香族單體 [2]
- 222/10 . 酯 [2]
- 222/12 . . 酚或飽和醇之酯 [2]
- 222/14 . . . 無游離羧酸基團之酯 [2]
- 222/16 . . . 有游離羧酸基團之酯 [2]
- 222/18 . . . 含鹵素之酯 [2]

- 222/20 . . . 除羧基之氧外尚含其他氧之酯 [2]
- 222/22 . . . 含氮之酯 [2]
- 222/24 . . . 含硫之酯 [2]
- 222/26 . . 不飽和醇之酯 [2]
- 222/28 . . . 順丁烯二酸二烯丙基酯 [2]
- 222/30 . 腈 [2]
- 222/32 . . α -氰基—丙烯酸；其酯 [2]
- 222/34 . . 二氰亞乙烯 [2]
- 222/36 . 醯胺或醯亞胺 [2]
- 222/38 . . 醯胺 [2]
- 222/40 . . 醯亞胺，如環醯亞胺 [2]

224/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係含氧雜環為終端（多元酸之環酯見 218/00；不飽和酸之環酐見 220/00、222/00） [2]

226/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以對氮之單鍵或雙鍵，或以含氮雜環為終端 [2]

- 226/02 . 為由對氮之單鍵或雙鍵予以終結之單體 [2]
- 226/04 . . 二烯丙基胺 [2]
- 226/06 . 以由含氮之雜環所終結之單體
- 226/08 . . N—乙烯基—吡咯烷 [2]
- 226/10 . . N—乙烯基—吡咯烷酮 [2]
- 226/12 . . N—乙烯基—吡啶 [2]

228/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以對硫之鍵或以含硫之雜環為終端 [2]

- 228/02 . 為由對硫之鍵結予以終結之單體 [2]
- 228/04 . . 硫醚 [2]
- 228/06 . 以由含硫之雜環所終結之單體 [2]

230/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，每個脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且含有磷，硒，碲或金屬 [2,2006.01]

230/02 · 含磷之單體 [2]

230/04 · 含金屬之單體 [2]

230/06 · · 硼 [2]

230/08 · · 矽 [2]

230/10 · · 鍺 [2]

232/00 環狀化合物之共聚物，該環狀化合物側鏈上無不飽和脂族基，而於碳環系內具有一個或更多之碳—碳雙鍵 [2]

232/02 · 不具有稠環之單體 [2]

232/04 · · 含有一個碳—碳雙鍵 [2]

232/06 · · 含有兩個或更多之碳—碳雙鍵者 [2]

232/08 · 有稠環者 [2]

234/00 環狀化合物之共聚物，該環狀化合物側鏈無不飽和脂族基，而於雜環內具有一個或更多之碳—碳雙鍵（多元酸之環酯見 218/00，環酞或醯亞胺見 222/00）[2]

234/02 · 環中含氧之單體 [2]

234/04 · 環中含硫之單體 [2]

236/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之共聚物，至少有一個不飽和脂族基具有兩個或更多之碳—碳雙鍵（232/00 優先）[2]

236/02 · 含有兩個碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]

236/04 · · 共軛系 [2]

236/06 · · · 丁二烯 [2]

236/08 · · · 異戊二烯 [2]

236/10 · · · 與乙烯基—芳香族單體 [2]

236/12 · · · 與腈 [2]

236/14 · · · 含有碳及氫以外之元素者[2]

236/16 · · · · 鹵素 [2]

236/18 · · · · · 氯 [2]

236/20 · · 非共軛系 [2]

236/22 · 含有三個或更多碳—碳雙鍵之不飽和脂族基之單體 [2]

238/00 具有一個或更多的碳—碳三鍵化合物之共聚物 [2]

238/02 · 乙炔 [2]

238/04 · 乙烯基乙炔 [2]

240/00 烴與礦物油之共聚物，如石油樹脂 [2]

242/00 乾性油與其他單體之共聚物 [2]

244/00 苯并呋喃—節共聚物 [2]

246/00 僅由少量成分之單體所確定的共聚物 [2]

接枝聚合物；由不飽和單體交聯之聚合物 [2]

251/00 由單體接至多糖或其衍生物上之聚合而得之高分子化合物 [2]

251/02 · 接至纖維素或其衍生物上之聚合 [2]

253/00 由單體接至天然橡膠或其衍生物上聚合而得之高分子化合物 [2]

255/00 由單體接至 10/00 目所規定之烴類聚合物上聚合而得的高分子化合物 [2]

255/02 · 接至具有兩個或三個碳原子之烴聚合物上之聚合而成者 [2]

255/04 · · 接至乙烯—丙烯共聚物上之聚合而成者 [2]

255/06 · · 接至乙烯—丙烯—二烯之三元共聚物上 [2]

255/08 · 接至具有四個或更多碳原子之烴聚合物上之聚合而成者 [2]

255/10 · · 接至丁烯聚合物上之聚合而成者 [2]

257/00 由單體接至 12/00 目所規定的芳香族單體之聚合物上聚合而得的高分子化合物 [2]

257/02 • 接到苯乙烯或烷基取代苯乙烯之聚合物上之聚合而成 [2]

259/00 由單體接至 14/00 目所規定之含鹵素單體之聚合物上的聚合而得的高分子化合物 [2]

259/02 • 接至含氯聚合物上之聚合而成者 [2]

259/04 • • 接至氯乙烯聚合物上之聚合而成者 [2]

259/06 • • 接至二氯亞乙烯聚合物上之聚合而成者 [2]

259/08 • 接至含氟聚合物上之聚合而成者

261/00 由單體接至 16/00 目所規定之含氧單體的聚合物上聚合而得的高分子化合物 [2]

261/02 • 接至不飽和醇之聚合物上之聚合而成者 [2]

261/04 • • 接至乙烯醇之聚合物上之聚合而成者 [2]

261/06 • 接至不飽和醚之聚合物上之聚合而成者 [2]

261/08 • 接至不飽和醛之聚合物上之聚合而成者 [2]

261/10 • 接至不飽和酮之聚合物上之聚合而成者 [2]

261/12 • 接至不飽和醛縮醇或酮縮醇之聚合物上之聚合而成者 [2]

263/00 由單體接至 18/00 目所規定之不飽和的醇與飽和酸之酯的聚合物上聚合而得的高分子化合物 [2]

263/02 • 接至單羧酸乙烯基酯之聚合物上之聚合而成者 [2]

263/04 • • 接至乙酸乙烯酯之聚合物上之聚合而成者 [2]

263/06 • 接至多元羧酸酯之聚合物上之聚合而成者 [2]

263/08 • • 鄰苯二甲酸二烯丙基酯預聚物之聚合 [2]

265/00 由單體接至 20/00 目所規定之不

飽和單羧酸或其衍生物之聚合物上聚合而得的高分子化合物 [2]

265/02 • 接至酸，鹽或酐之聚合物上之聚合而成者 [2]

265/04 • 接至酯之聚合物上之聚合而成者 [2]

265/06 • • 丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯接至此等聚合物上之聚合而成者 [2]

265/08 • 接至腈之聚合物上之聚合而成者

265/10 • 接至醯胺或醯亞胺之聚合物上之聚合成者 [2]

267/00 由單體接至 22/00 目所規定之不飽和多元羧酸或其衍生物之聚合物上之聚合而得的高分子化合物

267/02 • 接至酸或鹽之聚合物上之聚合而成者 [2]

267/04 • 接至酐之聚合物上之聚合而成者 [2]

267/06 • 接至酯之聚合物上之聚合而成者 [2]

267/08 • 接至腈之聚合物上之聚合而成者 [2]

267/10 • 接至醯胺或醯亞胺之聚合物上之聚合而成者 [2]

269/00 由單體接至 24/00 目所規定之含氧雜環單體之聚合物上聚合而得之高分子化合物 [2]

271/00 由單體接至 26/00 目所規定之含氮單體之聚合物上聚合而得之高分子化合物 [2]

271/02 • 接至含氮雜環單體之聚合物上之聚合而成者 [2]

273/00 由單體接至 28/00 目所規定之含硫單體的聚合物上之聚合而得的高分子化合物 [2]

275/00 由單體接至 30/00 目所規定之含磷、硒、碲或金屬的單體之聚合

物上聚合而得之高分子化合物
[2]

277/00 由單體接至 32/00 或 34/00 目所規定之碳環或雜環單體之聚合物上聚合而得之高分子化合物 [2]

279/00 由單體接至 36/00 目所規定之具有兩個或更多的碳—碳雙鍵單體之聚合物上聚合而得高分子化合物 [2]

279/02 • 接至共軛二烯之聚合物上聚合而成者 [2]

279/04 • • 僅含乙烯基芳香族單體及腈之單體 [2]

279/06 • • 僅含乙烯基芳香族單體及甲基丙烯酸酯之單體 [2]

281/00 由單體接至 38/00 目所規定之具有碳—碳三鍵單體的聚合物上聚合而得之高分子化合物 [2]

283/00 由單體接至 C08G 次類所包括的聚合物上聚合而得之高分子化合物 [4]

283/01 • 接至不飽和聚酯上之聚合而成者 [4]

283/02 • 接至聚碳酸酯或飽和聚酯上之聚合而成者 [2]

283/04 • 接至聚碳酸酯、聚碳酸酯胺或聚碳酸酯亞胺上之聚合而成者 [2]

283/06 • 接至聚醚、聚氧化甲烯或聚醛縮醇上之聚合而成者 [2]

283/08 • • 接至聚苯氧上之聚合而成者 [2]

283/10 • 接至每個分子含有多於一個環氧基之聚合物上之聚合而成者 [2]

283/12 • 接至聚矽氧烷上之聚合而成者 [2]

283/14 • 接至碳環化合物開環聚合所得之聚合物上，該碳環化合物於碳環中具有一個或更多的碳—碳雙鍵，即聚亞烷基體 [2]

285/00 由單體接至預先形成的接枝聚

合物上聚合而得之高分子化合物
[2]

287/00 由單體接至嵌段聚合物上聚合而得之高分子化合物 [2]

289/00 由單體接至 251/00 目至 287/00 目未包括的高分子化合物上之聚合而得的高分子化合物 [2]

290/00 單體接至藉由引入脂肪族不飽和末端或側端基團而改性之聚合物所得之高分子化合物 [6]

290/02 • 接至藉由引入不飽和末端基團而改性之聚合物 [6]

290/04 • • C08C 或 F 次類之聚合物 [6]

290/06 • • C08G 次類之聚合物 [6]

290/08 • 接至藉由引入不飽和側端基團而改性之聚合物 [6]

290/10 • • C08B 次類之聚合物 [6]

290/12 • • C08C 或 F 次類之聚合物 [6]

290/14 • • C08G 次類之聚合物 [6]

291/00 由單體接至屬於 251/00 至 289/00 目內一個以上之目的高分子化合物上之聚合而得之高分子化合物 [2]

291/02 • 接至彈性體上之聚合而成者 [2]

291/04 • 接至含鹵素高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/06 • 接至含氧高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/08 • • 接至含羥基之高分子化合物上聚合而成者 [2]

291/10 • • 接至含環氧基之高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/12 • 接至含氮高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/14 • 接至含硫高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/16 • 接至含兩個以上金屬原子之高分子化合物上之聚合而成者 [2]

291/18 • 接至經輻照或氧化之高分子化合物

物上（環氧化者見 291/10） [2]

292/00 使單體聚合至無機物上所得的高分子化合物 [3]

嵌段聚合物 [2]

293/00 於高分子上之聚合反應所得的高分子化合物，該起始高分子僅於一端或兩端具有能導致形成新聚合物鏈之基團（接至引入不飽和末端基團而改性的聚合物上見 290/02） [2]

295/00 逐次利用不同催化劑類型，而不使聚合物中間體活性降低之聚合作用所得的高分子化合物 [2]

297/00 使用離子型或配位型催化劑逐次聚合不同單體體系，而不使聚

合物中間體活性降低之聚合作用所得的高分子化合物 [2]

297/02 · 使用陰離子催化劑者 [2]

297/04 · · 由聚合乙烯基芳香族單體與共軛二烯烴而成者 [2]

297/06 · 使用配位型催化劑 [2]

297/08 · · 由聚合一元烯烴而成者 [2]

299/00 在非高分子單體不存在下，僅用碳—碳不飽和鍵反應使各個聚合物之間相互作用所得的高分子化合物 [2,6]

299/02 · 由不飽和縮聚物而成者 [2]

299/04 · · 由聚酯者 [2]

299/06 · · 由聚胺酯者 [2]

299/08 · · 由聚矽氧烷者 [2]

301/00 10/00 至 299/00 目內不包括的高分子化合物 [8]

C08G 用碳—碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物（藉由發酵或使用酶催化反應以合成所欲之化合物、組合物或從消旋混合物中分離出光學異構物見 C12P）[2]

附註

- (1) 化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]
- (2) 於此次類內，18/00 目優先於其他目。若聚合物係由形成特殊鍵合之反應而得，並對此無適當之目時，則應再進一步分類。[2]
- (3) 於本次類各主目範圍內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明應放入最後適當位置。[2]
- (4) 本次類尚包括由單體構成之各種組合物，該等單體形成之高分子化合物皆可分入此次類。[7]

於本次類中：[7]

- (a) 如果單體很明確，則應根據其所形成之聚合物，分類到 2/00 至 79/00、83/00 等目中； [7]
- (b) 如果單體之確定方式，使得該組合物不能分類到本次類之一個主目中，則將該組合物分入 85/00 目； [7]
- (c) 如果配合材料本身很重要，則將之分類到 C08K 次類下。[7]

次類索引

由醛或酮而得之高分子化合物	2/00 至 16/00	一個含氮鍵合	69/00 至 73/00
聚醛縮醇	2/00，4/00	一個含硫鍵合	75/00
由異氰酸酯或異硫氰酸酯而得之		一個含矽鍵合	77/00
高分子化合物	18/00	一個含碳、氧、氮、硫、矽以外	
環氧樹脂	59/00	原子之鍵合	79/00
於主鏈中形成一個鍵合之反應		無單體之存在下而由聚合物	
所得的高分子化合物	61/00 至 79/00	相互反應而得之高分子化合物	81/00
一個碳—碳鍵合	61/00	其他高分子化合物	83/00
一個含氧鍵合	63/00 至 67/00	一般方法	85/00

2/00 醛或其環狀寡聚物之加成聚合物，或酮之加成聚合物；此等與含有低於百分之五十莫耳之其他物質的加成共聚物 [2]

- 2/02 • 以波能或粒子輻射而引發之聚合作用 [2]
- 2/04 • 使用對分子量有影響之化合物而起(如鏈轉移劑)的聚合作用 [2]
- 2/06 • 催化劑[2]
- 2/08 • 甲醛之聚合作用 [2]
- 2/10 • 甲醛之環狀寡聚物之聚合作用 [2]
- 2/12 • 乙醛或其環狀寡聚物之聚合作用 [2]
- 2/14 • 未包括於 2/08 至 2/12 之單醛的聚合作用 [2]
- 2/16 • 單酮之聚合作用 [2]
- 2/18 • 醛或酮之共聚作用 [2]
- 2/20 • • 其他醛或酮 [2]
- 2/22 • • 與環氧化合物 [2]
- 2/24 • • 與醛縮醇 [2]
- 2/26 • • 與含有碳-碳不飽和鍵化合物 [2]
- 2/28 • 聚合後處理
- 2/30 • 由後處理而起之化學改性 [2]
- 2/32 • • 由酯化作用而成者 [2]
- 2/34 • • 由醚化作用而成者 [2]
- 2/36 • • 由解聚作用而成者 [2]
- 2/38 • 由聚合醛或酮至高分子化合物上而製得之嵌段或接枝聚合物 [2]

4/00 醛或酮與多元醇之縮聚物，於環中至少含一次-O-C-O-基之氧雜環化合物的加成聚合物(關於醛之環狀寡聚物見 2/00) [2]

6/00 僅有醛或酮之縮聚物 [2]

- 6/02 • 醛與酮者 [2]

8/00 醛或酮僅與酚之縮聚物 [2]

- 8/02 • 酮者 [2]
- 8/04 • 醛者 [2]
- 8/06 • • 糠醛者 [2]

- 8/08 • • 甲醛者，例如於反應中就地生成之甲醛 [2]

- 8/10 • • • 與酚 [2]

- 8/12 • • • 與羥基僅於鄰位或對位有一個羥取代基之一元酚，如對-第三丁基酚 [2]

- 8/14 • • • 與鹵代酚 [2]

- 8/16 • • • 與胺基或硝基酚 [2]

- 8/18 • • • 與為羧基或磺酸基所取代之酚 [2]

- 8/20 • • • 與多元酚 [2]

- 8/22 • • • • 間苯二酚 [2]

- 8/24 • • • 與 8/10 至 8/20 目內不只一目所包括之兩種或更多種酚之混合物 [2]

- 8/26 • 由醛與酮之混合物 [2]

- 8/28 • 經化學改性之縮聚物 [2]

- 8/30 • • 由不飽和化合物而成者，如1,3-萜烯 [2]

- 8/32 • • 由有機酸或其衍生物而成者，如脂肪油 [2]

- 8/34 • • 由天然樹脂或樹脂酸而成者，如松香 [2]

- 8/36 • • 由醚化而成者 [2]

- 8/38 • 縮聚醛或酮至高分子化合物上而製得的嵌段或接枝聚合物 [2]

10/00 醛或酮僅與芳烴或鹵代芳烴之縮聚物 [2]

- 10/02 • 醛者 [2]

- 10/04 • • 經化學改性之縮聚物 [2]

- 10/06 • 縮聚醛或酮至高分子化合物上而製得的嵌段或接枝聚合物 [2]

12/00 醛或酮僅與含有氮連接至氮上之化合物之縮聚物(胺基酚類見 8/16) [2]

- 12/02 • 醛者

- 12/04 • • 與無環或碳環化合物 [2]

- 12/06 • • • 胺 [2]

- 12/08 • • • • 芳族 [2]

- 12/10 • • • 與具有 $X=C(-N<)_2$ 構造之無環化合物，其中 X 係 O，

- S 或-N [2]
- 12/12 脲；硫脲 [2]
- 12/14 雙氰胺；脒基脲；胍；雙胍；縮二脲；胺基脲 [2]
- 12/16 雙氰胺 [2]
- 12/18 . . . 與氰胍（與胺基氰）[2]
- 12/20 . . . 與胺基甲酸酯或硫代胺基甲酸酯 [2]
- 12/22 . . . 與羧醯胺 [2]
- 12/24 . . . 與磺醯胺 [2]
- 12/26 . . 與雜環化合物 [2]
- 12/28 . . . 與取代之二吡、二唑或三唑 [2]
- 12/30 . . . 與取代之三吡 [2]
- 12/32 三聚氰胺 [2]
- 12/34 . . . 雜環化合物與無環或碳環化合物 [2]
- 12/36 脲；硫脲 [2]
- 12/38 與三聚氰胺 [2]
- 12/40 . . 經化學改性之縮聚物 [2]
- 12/42 . . . 由醚化而成者 [2]
- 12/44 . . . 由酯化而成者 [2]
- 12/46 . 縮聚醛或酮至高分子化合物上而製得之嵌段或接枝聚合物 [2]
- 14/00 醛或酮與 8/00 至 12/00 內至少兩個目所包括之兩種或更多種其他單體之縮聚物 [2]**
- 14/02 . 醛者 [2]
- 14/04 . . 與酚 [2]
- 14/06 . . . 酚與含有連至氮上之氮的單體 [2]
- 14/067 無環或碳環之單體 [2]
- 14/073 胺類 [5]
- 14/08 脲；硫脲 [2,5]
- 14/09 雜環單體 [5]
- 14/10 三聚氰胺 [2,5]
- 14/12 . . . 經化學改性之縮聚物 [2]
- 14/14 . 縮聚醛或酮至高分子化合物上而製得之嵌段或接枝聚合物 [2]
- 16/00 醛或酮與未包括於 4/00 至 14/00 目內之單體之縮聚物 [2]**

- 16/02 . 醛者 [2]
- 16/04 . . 經化學改性之縮聚物 [2]
- 16/06 . 縮聚醛或酮至高分子化合物上而製得之嵌段或接枝聚合物 [2]

18/00 異氰酸酯類或異硫氰酸酯類之聚合生成物

附註

於此目內，最好加入 101/00 目之索引碼。[5, 8]

- 18/02 . 僅係異氰酸酯或異硫氰酸酯者 [2]
- 18/04 . 與乙烯基化合物 [2]
- 18/06 . 與具有活性氫之化合物 [2]
- 18/08 . . 方法 [2]
- 18/09 . . . 包括異氰酸酯或異硫氰酸酯之低聚合反應，此涉及反應混合物中，有一部分異氰酸酯基或異硫氰酸酯基，相互發生反應 [7]
- 18/10 . . . 涉及第一反應步驟中，異氰酸酯或異硫氰酸酯與含有活性氫之化合物反應的預聚合加工過程 [2]
- 18/12 於第一聚合階段使用兩個或更多個具有活性氫之化合物 [2]
- 18/16 . . . 催化劑 [2]
- 18/18 含有第二胺或第三胺或其鹽 [2]
- 18/20 雜環胺；其鹽 [2]
- 18/22 含金屬化合物者 [2]
- 18/24 錫化合物 [2]
- 18/26 鉛化合物 [2]
- 18/28 . . 以使用含有活性氫之化合物為特徵者 [2]

附註

對於 18/28 至 18/69 目，無需考慮為製備發泡體材料而附加之水。[2]

- 18/30 . . . 低分子量化合物 [2]
- 18/32 多羟基化合物；多元胺；
羟基胺 [2]
- 18/34 羧酸；其與一元羟基化合
物之酯 [2]
- 18/36 高級脂肪酸之羟基化酯[2]
- 18/38 具有氧以外之雜原子者
(18/32 優先) [2]
- 18/40 . . . 高分子量化合物 [2]
- 18/42 主鏈上具有羧基或碳酸酯
基之縮聚物 [2]
- 18/44 聚碳酸酯 [2]
- 18/46 具有氧以外之雜原子者
[2]
- 18/48 聚醚 [2]
- 18/50 具有氧以外之雜原子者
[2]
- 18/52 聚硫醚 [2]
- 18/54 醛之縮聚物 [2]
- 18/56 聚縮醛 [2]
- 18/58 環氧樹脂 [2]
- 18/60 聚醯胺或聚酯醯胺 [2]
- 18/61 聚矽氧烷 [2]
- 18/62 具有碳—碳雙鍵化合物之
聚合物 [2]
- 18/63 由聚合具有碳—碳雙鍵化
合物聚合物上而得之嵌段
或接枝聚合物 [2]
- 18/64 不分類於 18/42 至 18/63
目內之高分子化合物 [2]
- 18/65 . . . 具有活性氫之低分子量化
合物與具有活性氫之高分子
量化合物 [2]
- 18/66 18/42、18/48 或 18/52 目
之化合物 [2]
- 18/67 . . . 具有活性氫之不飽和化合物
[2]
- 18/68 不飽和聚酯 [2]
- 18/69 共軛二烯烴聚合物 [2]
- 18/70 . . 以所用異氰酸酯或異硫氰酸酯
為特徵者 [2]
- 18/71 . . . 單異氰酸酯或單異硫氰酸酯
[2]
- 18/72 . . . 多異氰酸酯或多異硫氰酸酯
[2]
- 18/73 無環者 [2]
- 18/74 有環者 [2]
- 18/75 脂環族 [2]
- 18/76 芳族 [2]
- 18/77 具有除異氰酸酯或異硫氰
酸酯之氮與氧或硫外之雜
原子者 [2]
- 18/78 氮 [2]
- 18/79 以使用具有由異氰酸
酯或異硫氰酸酯之寡
聚化作用而形成的基
之多異氰酸酯為特徵
者 [2]
- 18/80 經掩蔽的多異氰酸酯 [2]
- 18/81 . . . 不飽和異氰酸酯或異硫氰酸
酯 [2]
- 18/82 . . 聚合後處理 [2]
- 18/83 . . 經化學改性的聚合物 [2]
- 18/84 . . . 由醛而成者 [2]
- 18/85 . . . 由偶氮化合物而者 [2]
- 18/86 . . . 由過氧化物而成者 [2]
- 18/87 . . . 由硫而成者 [2]
- 59/00 每個分子含有一個以上環氧基
之縮聚物；環氧縮聚物與單官能
基低分子量化合物反應而得之
高分子；每個分子含有一個以上
環氧基之化合物使用與該環氧
基反應之硬化劑或催化劑聚合
而得的高分子 [2]**
- 59/02 . 每分子含有一個以上環氧基之縮
聚物 [2]
- 59/04 . . 多羟基化合物與表鹵醇或其母
體的 [2]
- 59/06 . . . 多元酚的 [2]
- 59/08 由酚—醛縮合物的 [2]
- 59/10 . . 多元胺與表鹵醇或其母體的[2]
- 59/12 . . 多元羧酸與表鹵醇或其母體的
[2]

- 59/14 · 用化學後處理而改性之縮聚物 [2]
- 59/16 · · 由單羧酸或其酐、鹵化物或低分子量酯而成者 [2]
- 59/17 · · · 由丙烯酸或甲基丙烯酸而成者 [4]
- 59/18 · 使用與環氧基反應之硬化劑或催化劑以聚合物每個分子含有一個以上環氧基之化合物而得的高分子化合物 [2]
- 59/20 · · 以所使用之環氧化合物為特徵者 [2]

附註

環氧縮聚物之製備與硬化，其中環氧縮聚物不限於低分子量化合物，且其硬化方法無特徵者，分類入 59/02 目內 [2, 8]

- 59/22 · · · 含兩環氧基之化合物 [2]
- 59/24 · · · · 碳環 [2]
- 59/26 · · · · 雜環 [2]
- 59/28 · · · · 含有無環氮原子者 [2]
- 59/30 · · · · 含有碳、氫、氧及氮以外原子者 [2]
- 59/32 · · · 含有三個或更多環氧基之環氧化合物者 [2]
- 59/34 · · · · 由不飽和聚合物之環氧化而得到者 [2]
- 59/36 · · · · 與單環氧化合物同時使用者 [2]
- 59/38 · · · · 與二環氧化合物同時使用者 [2]
- 59/40 · · 以所使用之硬化劑有特徵者 [2]
- 59/42 · · · 多元羧酸，其酐、鹵化物或低分子量酯 [2]
- 59/44 · · · 醯胺 [2]
- 59/46 · · · · 與其他硬化劑同時使用者 [2]
- 59/48 · · · · · 與多元羧酸或其酐、鹵化物或低分子量酯同時使用者 [2]
- 59/50 · · · 胺 [2]

- 59/52 · · · · 胺基羧酸 [2]
- 59/54 · · · · 胺基醯胺 [2]
- 59/56 · · · · 與其他硬化劑同時使用者 [2]
- 59/58 · · · · · 與多元羧酸或其酐、鹵化物或低分子量酯同時使用者 [2]
- 59/60 · · · · · 與醯胺同時使用者 [2]
- 59/62 · · · 醇或酚 [2]
- 59/64 · · · · 胺基醇 [2]
- 59/66 · · · 硫醇 [2]
- 59/68 · · 以所使用之催化劑為特徵者 [2]
- 59/70 · · · 螯合物 [2]
- 59/72 · · · 鹵化硼之錯合物 [2]

附註

在 61/00 至 79/00 目內，若無相反指示，由在主鏈上形成兩個不同鍵結反應所得到的高分子化合物僅按存在過量的鍵結分類。 [8]

- 61/00 由高分子主鏈上形成碳—碳鍵合之反應而得的高分子化合物**
(2/00 至 16/00 優先) [2]
- 61/02 · 高分子主鏈上僅含有碳原子之高分子化合物，如聚苯二亞甲基 [2]
- 61/04 · · 僅含脂族碳原子者 [2]
- 61/06 · · · 由碳環化合物之開環而製備者 [2]
- 61/08 · · · · 於環內含有一個或更多碳—碳雙鍵之碳環化合物 [2]
- 61/10 · · 含有芳香族碳原子者，如聚亞苯基 [2]
- 61/12 · 高分子主鏈上含有碳原子以外原子之高分子化合物 [2]
- 63/00 由高分子主鏈上形成羧酸酯鍵之反應而製得的高分子化合物**
(聚酯—醯胺類見 69/44；聚酯—醯亞胺類見 73/16) [2,5]

附註[5]

聚酯的化學構造上有發明特徵時分類入聚酯化合物類型聚酯之製備方法之目內，於聚酯之製備方法上，有發明特徵時分類入 63/78 至 63/87 所用方法之目內，化學構造及製備方法二者上均有發明特徵時分類入此兩方面之每一類目內 [5]

- 63/02 · 由羥基羧酸或由多羧酸與多羥基化合物所衍生之聚酯 [2]
- 63/06 · · 由羥基羧酸衍生而得者 [2]
- 63/08 · · · 內酯或丙交酯 [2]
- 63/12 · · 由多羧酸與多羥基化合物衍生而得者 [2]
- 63/123 · · · 含碳環之酸或羥基化合物[5]
- 63/127 · · · · 含芳環之酸 [5]
- 63/13 · · · · · 含兩個或多個芳香環者 [5]
- 63/133 · · · · · 含芳香環之羥基化合物[5]
- 63/137 · · · · · 含脂肪環之酸或羥基化合物 [5]
- 63/16 · · · 二羧酸與二羥基化合物 [2]
- 63/18 · · · · 含有碳環之酸或羥基化合物 [2]
- 63/181 · · · · · 含芳香環之酸 [5]
- 63/183 · · · · · 對苯二甲酸 [5]
- 63/185 · · · · · 含兩個或多個芳香環者 [5]
- 63/187 · · · · · · 含稠合芳香環者 [5]
- 63/189 · · · · · · 含萘環者 [5]
- 63/19 · · · · · 含芳香環之羥基化合物 [5]
- 63/191 · · · · · · 對苯二酚 [5]
- 63/193 · · · · · · 含兩個或多個芳香環者 [5]
- 63/195 · · · · · · 雙酚 A [5]
- 63/197 · · · · · · 含稠合芳香環者 [5]
- 63/199 · · · · · 含脂肪環之酸或羥基化合物 [5]
- 63/20 · · · · 於具有一個活性基或兩個以上活性基之化合物存在製備而得的聚酯 [2]
- 63/21 · · · · · 於不飽和單羧酸或不飽和單羥基酸或該等之反應性衍生物存在下者 [5]
- 63/40 · · · 除由多元羧酸或多羥基化合物之此等之酯類外的能形成酯之衍生物而得的聚酯 [5]
- 63/42 · · · · 環醚 (59/00 優先)；環碳酸酯；環亞硫酸酯；環原酸酯 [2,7]
- 63/44 · · · · 聚醯胺；聚脲 [2]
- 63/46 · · · 由酯化而得的經化學改性之聚酯 (63/20 優先) [2]
- 63/47 · · · · · 由不飽和單羧酸或不飽和一元醇或由此等之反應性衍生物而成者 [5]
- 63/48 · · · · · 由不飽和高級脂肪油或其酸而成者；由樹脂酸而成者 [2]
- 63/49 · · · · · 醇酸樹脂 [5]
- 63/50 · · · · · 由一元醇而成者 [2]
- 63/52 · · · 多元羧酸或多羥基化合物兩成分中至少其中之一含有脂肪族不飽和羥者 [2]
- 63/54 · · · · · 含碳環之酸或羥基化合物 [2]
- 63/547 · · · · · 含芳香環之羥基化合物 [5]
- 63/553 · · · · · 含脂肪環之酸或羥基化合物，例如狄耳士—阿德爾加成物 [5]
- 63/56 · · · · 除由多元羧酸或多羥基化合物之此等之酯類外的能形成酯之衍生物而得的聚酯 [2]
- 63/58 · · · · · 環醚 (59/00 優先)；環碳酸酯；環亞硫酸酯 [2]
- 63/60 · · 由羥基羧酸，多元羧酸及多羥基化合物之混合物經反應而衍

生得者 [2]

- 63/64 • 同時含有羧酸酯基與碳酸酯基之
聚酯 [2]
- 63/66 • 含有醚基形式氧之聚酯 (63/42、
63/58 優先) [2]
- 63/664 • • 由羥基羧酸而衍生者 [5]
- 63/668 • • 由多元羧酸及多羥基化合物而
衍生得者 [5]
- 63/672 • • • 二元羧酸及二羥基化合物[5]
- 63/676 • • • 兩個成分中至少其中之一成
分含脂肪族不飽和羥者 [5]
- 63/68 • 含有碳、氫及氧以外原子之聚酯
(63/64 優先) [4]
- 63/682 • • 含鹵素者 [5]
- 63/685 • • 含氮者 [5]
- 63/688 • • 含硫者 [5]
- 63/692 • • 含磷者 [5]
- 63/695 • • 含矽者 [5]
- 63/698 • • 含硼者 [5]
- 63/78 • 製備方法 [5]
- 63/79 • • 界面方法，亦即包括於兩種不
相混溶之液體界面上進行反
應之方法 [5]
- 63/80 • • 固相縮聚 [5]
- 63/81 • • 使用溶劑者 (63/79 優先) [5]
- 63/82 • • 以所使用之催化劑為特徵者[5]
- 63/83 • • • 鹼金屬、鹼土金屬、鉍、鎂、
銅、銀、金、鋅、鈣、汞、
錳、或此等之化合物 [5]
- 63/84 • • • 硼、鋁、鎳、銻、銻、稀土
金屬或此等之化合物
[5,2006.01]
- 63/85 • • • 銻、錫、鉛、砷、銻、鉍、
鈦、鎢、鉛、鈆、銻、鉍、鉍、
或此等之化合物 [5]
- 63/86 • • • • 銻、銻或此等之化合物[5]
- 63/87 • • • 非金屬或其相互間形成的化
合物 (硼見 63/84) [5]
- 63/88 • 聚合後之處理 [5]
- 63/89 • • 聚合物之回收 [5]
- 63/90 • • 精製；乾燥 [5]
- 63/91 • 由化學後處理而改性的聚合物

[5]

- 64/00 由於高分子主鏈上形成碳酸酯
鍵之反應製得的高分子化合物**
(聚碳酸酯—醯胺類見 69/44；聚碳
酸酯—醯亞胺類見 73/16) [5]

附註

同時含羧酸酯基及碳酸酯基之
聚合體，即使碳酸酯基過較羧酸
酯基過量存在時，亦當分類入
63/64 目內 [5]

- 64/02 • 脂肪族聚碳酸酯 [5]
- 64/04 • 芳香族聚碳酸酯 [5]
- 64/06 • • 不含脂肪族不飽和鍵者 [5]
- 64/08 • • • 含碳、氫或氧以外原子者 [5]
- 64/10 • • • • 含鹵素者 [5]
- 64/12 • • • • 含氮者 [5]
- 64/14 • • • 含鏈終止劑或交聯劑者 [5]
- 64/16 • 脂肪—芳香或芳脂聚碳酸酯 [5]
- 64/18 • 嵌段或接枝聚合物 [5]
- 64/20 • 一般製備方法 [5]
- 64/22 • • 使用羧基鹵化物 [5]
- 64/24 • • • 與酚類 [5]
- 64/26 • • 使用鹵化碳酸酯類 [5]
- 64/28 • • • 與酚類 [5]
- 64/30 • • 使用碳酸酯類者 [5]
- 64/32 • • 使用二氧化碳者 [5]
- 64/34 • • • 與環醚 [5]
- 64/36 • • 使用一氧化碳者 [5]
- 64/38 • • 使用其他單體者 [5]
- 64/40 • 聚合後處理 [5]
- 64/42 • 化學後處理 [5]

- 65/00 由於高分子主鏈中形成醚鍵之
反應而得的高分子化合物**(環氧
樹脂見 59/00；聚硫醚—醚見
75/12；含有少於 11 個單體單元之
聚醚見 C07C) [2]

- 65/02 • 由環醚以雜環開環之反應 [2]
- 65/04 • • 僅由環醚 [2]
- 65/06 • • • 於環外僅有碳及氫原子之環

- 醚 [2]
- 65/08 飽和的環氧乙烷 [2]
- 65/10 以所使用之催化劑為特徵者 [2]
- 65/12 含有有機金屬化合物或金屬氫化物者 [2]
- 65/14 不飽和環氧乙烷 [2]
- 65/16 具有四個或更多環原子之環醚 [2]
- 65/18 氧雜環丁烷 [2]
- 65/20 四氫呋喃 [2]
- 65/22 . . . 於環外至少有一個除碳及氫外之原子的環醚 [2]
- 65/24 表鹵代醇 [2]
- 65/26 . . 由環醚及其他化合物 [2]
- 65/28 . . . 環醚及羥基化合物 [2]
- 65/30 . . 聚合後之處理，如回收、精製、乾燥 [2]
- 65/32 . . 由化學後處理而改性的聚合物 [2]
- 65/321 . . . 用無機化合物 [7]
- 65/322 含氫者 [7]
- 65/323 含鹵素者 [7]
- 65/324 含氧者 [7]
- 65/325 含氮者 [7]
- 65/326 含硫者 [7]
- 65/327 含磷者 [7]
- 65/328 含其他元素者 [7]
- 65/329 . . . 用有機化合物 [7]
- 65/331 含氧者 [7]
- 65/332 含羧基，或其鹵化物或酯者 [7]
- 65/333 含氮者 [7]
- 65/334 含硫者 [7]
- 65/335 含磷者 [7]
- 65/336 含矽者 [7]
- 65/337 含其他元素者（含有僅以羧基鹵化物存在之鹵素有機化合物，分入 65/332）[7]
- 65/338 . . . 用無機及有機化合物 [7]
- 65/34 . 由羥基化合物或其金屬衍生物（65/28 優先）[2]
- 65/36 . . 糖醇 [2]
- 65/38 . . 由酚衍生而成者 [2]
- 65/40 . . . 由酚及其化合物 [2]
- 65/42 酚與多羥基醚 [2]
- 65/44 . . . 由酚之氧化而成者 [2]
- 65/46 . . 聚合後之處理，如回收、精製、乾燥 [2]
- 65/48 . . 由化學後之處理而改性的聚合物 [2]
- 67/00 不包括於 2/00 至 65/00 目內，由形成含氧或氧與碳鍵合於高分子主鏈上之反應而得的高分子化合物 [2]**
- 67/02 . 一氧化碳與脂族不飽和化合物之共聚物 [2]
- 67/04 . 聚酐 [2]
- 69/00 由於高分子主鏈上形成羧酸醯胺鍵合反應而得的高分子化合物（聚醯肼見 73/08；聚醯胺酸見 73/10；聚醯胺—醯亞胺見 73/14）[2]**
- 69/02 . 由胺基羧酸或由多元胺與多元羧酸衍生而得的聚醯胺 [2]
- 69/04 . . 製備方法 [2]
- 69/06 . . . 固態縮聚 [2]
- 69/08 . . 由胺基羧酸衍生而得者 [2]
- 69/10 . . . α -胺基羧酸 [2]
- 69/12 . . . 胺基與羧基同時與芳香族結合者 [2]
- 69/14 . . . 內醯胺 [2]
- 69/16 製備法 [2]
- 69/18 陰離子聚合 [2]
- 69/20 以所使用之催化劑為特徵者 [2]
- 69/22 β -內醯胺 [2]
- 69/24 吡咯烷酮或哌啶酮 [2]
- 69/26 . . 由多元胺與多元羧酸衍生而得者 [2]
- 69/28 . . . 製備法 [2]
- 69/30 固態縮聚 [2]
- 69/32 . . . 由同時結合胺基與羧基至芳香族上之芳香族二胺與芳香

- 族二酸而者 [2]
- 69/34 . . . 使用已聚合的不飽和脂肪酸者 [2]
- 69/36 . . 由胺基酸、多元胺與多元羧酸衍生而得者 [2]
- 69/38 . 由醛或多腈製備之聚醯胺 [2]
- 69/40 . 含有醚基形式氧之聚醯胺 (69/12、69/32 優先) [2]
- 69/42 . 含有碳、氫、氧、氮以外原子之聚醯胺 (69/12、69/32 優先) [2]
- 69/44 . 聚酯醯胺 [2]
- 69/46 . 聚合後之處理 [2]
- 69/48 . 由化學後處理而改性的聚合物 [2]
- 69/50 . . 由醛而成者 [2]
- 71/00 由於高分子主鏈中形成異氰酸酯基以外之醯脲或胺基甲酸酯鍵合之反應的高分子化合物 [2]**
- 71/02 . 聚脲 [2]
- 71/04 . 聚胺基甲酸酯 [2]
- 73/00 不包括於 12/00 至 71/00 目內，於高分子主鏈中有或無氧或碳鍵合反應而形成含氮之鍵合，所得的高分子化合物 [2]**
- 73/02 . 聚胺 (含少於 11 個單體單元者見 C07C) [2]
- 73/04 . . 由烯化亞胺衍生而得者 [2]
- 73/06 . 於高分子主鏈中有含氮雜環之縮聚物；聚醯肼；聚醯胺酸或類似的聚醯亞胺母體 [2]
- 73/08 . . 聚醯肼；聚三唑；聚胺基三唑；聚 二唑 [2]
- 73/10 . . 聚醯亞胺；聚酯—醯亞胺；聚醯胺—醯亞胺；聚醯胺酸或類似的聚醯亞胺母體 [2]
- 73/12 . . . 不飽和聚醯亞胺母體 [2]
- 73/14 . . . 聚醯胺—醯亞胺 [2]
- 73/16 . . . 聚酯—醯亞胺 [2]
- 73/18 . . 聚苯并咪唑 [2]
- 73/20 . . 吡酮類 [2]
- 73/22 . . 聚苯并噁唑 [2]

73/24 . 氟代亞硝基有機化合物與另一氟有機化合物之共聚物，如亞硝基橡膠 [2]

73/26 . . 三氟亞硝基甲烷與氟一烯烴之共聚合體 [2]

75/00 於高分子主鏈中有或無氮，氧，或碳鍵合反應而形成含硫之鍵合，而得的高分子化合物 [2]

75/02 . 聚硫醚 [2,2016.01]

75/0204 . . 聚亞芳基硫醚 [2016.01]

附註

1. 在本目中，高分子化合物以與以下任何一目次相關之發明觀點而分類：

• C08G75/0209-C08G75/0245 ; [2016.01]

• C08G75/025-C08G75/0268 ; [2016.01]

• C08G75/0277-C08G75/0281 ; [2016.01]

•

C08G75/0286-C08G75/0295[2016.01]

2. 在每目次中的注意事項 (1) 提及的，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明應放入最後適當位置。 [2016.01]

75/0209 . . . 從含有一個芳環單體衍生的
75/0213 包含除了碳，氫或硫以外之元素[2016.01]

75/0222 含氮[2016.01]

75/0227 . . . 從含有兩個或多個芳環之單體衍生的[2016.01]

75/0231 . . . 含鏈終止或鏈枝化劑 [2016.01]

75/0236 . . . 含有除了在亞芳基間連接的碳或硫之原子[2016.01]

75/024 含羰基[2016.01]

- 75/0245 . . . 嵌段或接枝聚合物[2016.01]
 75/025 . . . 製備程序[2016.01]
 75/0254 . . . 採用金屬硫化物[2016.01]
 75/0259 . . . 採用金屬氫硫化物[2016.01]
 75/0263 . . . 採用元素硫[2016.01]
 75/0268 . . . 使用二硫化物[2016.01]
 75/0277 . . . 聚合後處理（化學後處理見 C08G75/0286）[2016.01]
 75/0281 . . . 回收或純化[2016.01]
 75/0286 . . . 化學後處理[2016.01]
 75/029 . . . 以有機化合物修飾 [2016.01]
 75/0295 . . . 以無機化合物修飾[2016.01]
 75/04 . . 由硫醇基化合物或其金屬衍生物（C08G75/0204 優先）
 [2,2016.01]
 75/045 . . . 從巰基化合物和不飽和化合物[2016.01]
 75/06 . . 由環硫醚 [2]
 75/08 . . . 由硫雜丙環 [2]
 75/10 . . 由硫或含硫化合物與醛或酮[2]
 75/12 . 聚硫醚一醚（C08G75/0245 優先）
 [2,2016.01]
 75/14 . 聚硫化合物 [2]
 75/16 . . 由有機化合物與無機多硫化物之縮聚而成者 [2]
 75/18 . 聚亞砷 [2]
 75/20 . 聚砷 [2,2016.01]
 75/205 . . 二氧化硫與不飽和有機化合物的共聚物[2016.01]
 75/22 . . . 二氧化硫與不飽和脂族化合物之共聚物 [2]
 75/23 . . 聚醚砷 [5]
 75/24 . 聚磺酸酯 [2]
 75/26 . 聚硫酯 [2]
 75/28 . 聚硫代碳酸酯 [2]
 75/30 . 聚磺醯胺；聚磺醯亞胺 [2]
 75/32 . 聚噻唑；聚噻二唑 [2]
 77/00 **於高分子主鏈中有或無硫，氮，氧，或碳之鍵合反應而形成含砷之鍵合，而得的高分子化合物 [2]**
 77/02 . 聚砷酸酯 [2]
 77/04 . 聚砷氧烷 [2]
 77/06 . . 製備法 [2]
 77/08 . . . 以所使用之催化劑為特徵者 [2]
 77/10 . . . 平衡法 [2]
 77/12 . . 含有與氮連接之砷 [2]
 77/14 . . 含有與含氧基團連接之砷者 [2]
 77/16 . . . 與羥基 [2]
 77/18 . . . 與烷氧基或芳氧基 [2]
 77/20 . . 含有與不飽和脂族基連接之砷者 [2]
 77/22 . . 含有與含碳、氮及氧以外原子之有機基團連接的砷者 [2]
 77/24 . . . 含鹵素基團 [2]
 77/26 . . . 含氮基團 [2]
 77/28 . . . 含硫基團 [2]
 77/30 . . . 含磷基團 [2]
 77/32 . . 聚合後之處理 [2]
 77/34 . . . 精製 [2]
 77/36 . . . 分級 [2]
 77/38 . . 利用化學後處理而改性的聚砷氧烷 [2]
 77/382 . . . 含碳、氮、氧或砷外之原子者 [5]
 77/385 含鹵素者 [5]
 77/388 含氮者 [5]
 77/392 含硫者 [5]
 77/395 含磷者 [5]
 77/398 含硼或金屬原子者 [5]
 77/42 . 含有聚砷氧烷鏈段之嵌段或接枝聚合物（聚合脂族不飽和單體至聚氧烷上見 C08F 283/12）
 77/44 . . 含有聚砷氧烷鏈段者 [2]
 77/442 . . 含有乙烯基聚合物鏈段者 [5]
 77/445 . . 含聚酯鏈段者 [5]
 77/448 . . 含聚碳酸酯鏈段者 [5]
 77/452 . . 含有含氮之鏈段者 [5]
 77/455 . . . 含有聚醯胺，聚酯醯胺或聚亞醯胺鏈段者 [5]
 77/458 . . . 含聚胺基甲酸乙酯鏈段者 [5]
 77/46 . . 含有聚醚鏈段者 [2]
 77/48 . 其中至少有兩個，而並非所有的

- 矽原子與氧以外之原子經鍵結而成者 (77/42 優先) [2]
- 77/50 • • 由碳鍵合而成者 [2]
- 77/52 • • • 含有芳香族環者 [2]
- 77/54 • • 由含氮鍵合而成者 [2]
- 77/56 • • 由含硼鍵合而成者 [2]
- 77/58 • • 由含金屬鍵合而成者 [2]
- 77/60 • 所有的矽原子與氧以外之原子經鍵合而成者 [2]
- 77/62 • • 氮原子 [2]
- 79/00 於高分子主鍵中，由形成含有除矽、硫、氮、氧及碳以外的原子之鍵合，有或無以上的多種元素之鍵合反應而得的高分子化合物 [2]**
- 79/02 • 含磷鍵合 [2,2016.01]
- 79/025 • • 聚磷腈[2016.01]
- 79/04 • • 與氧相連或與氧及碳相連結合之磷 [2]
- 79/06 • • 僅與碳相結合之磷 [2]
- 79/08 • 含硼之鍵合 [2]
- 79/10 • 含鋁之鍵合 [2]
- 79/12 • 含錫之鍵合 [2]
- 79/14 • 含有除碳，氧，氮，硫及矽之外兩種或更多種元素的鍵合 [2]
- 81/00 於無單體存在時，由聚合物相互作用而得的高分子化合物，例如嵌段聚合物 (僅包括有碳—碳不飽和鍵反應者見 C08F 299/00) [2]**
- 81/02 • 至少有一個聚合物係僅由碳—碳不飽和鍵反應而得者 [2]
- 83/00 未包括於 2/00 至 81/00 目內之高分子化合物 [2]**
- 85/00 包括於本類內之化合物的一般製備法 [2]**
- 涉及發泡體與主目 18/00 聯合使用之索引碼。 [5, 8]**
- 101/00 發泡體之製造 [5]**
-

C08H 天然高分子化合物之衍生物（多糖類見 C08B；天然橡膠見 C08C；天然樹脂及其衍生物見 C09F；瀝青見 C10C 3/00）

附註

化合物之治療活性，得進一步分類到 A61P 次類下。[7]

1/00 由蛋白質衍生之高分子物質（食品蛋白質見 A23，如 A23J；膠或明膠的製備見 C09H） 1/02 • 蛋白質－醛縮合物 1/04 • • 酪蛋白－醛縮合物 1/06 • 由動物角、蹄、毛髮、皮或皮革衍生者 3/00 硫化油，如油膏	7/00 木質素、木質素衍生物及其之高分子量衍生物（木質素之低分子量衍生物見 C07G 1/00）[2011.01] 8/00 由木質纖維素衍生之高分子物質[2010.01] 99/00 本次類其他目未包括的高分子物質[2010.01]

C08J 加工；一般的混合方法；不包含於 C08B、C、F、G 或 H 次類內之後處理（塑膠成型加工見 B29）[2]

附註

- (1) 本次類為聚合物之處理，包含 C08B 至 C08H 內未包含的方法。[4]
- (2) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示時，發明請分入最後適當位置。[2]
- (3) 當分類於本次類時，若所用的材料之資訊有助於檢索，亦可加上 C08L 次類之附加分類。[8]

3/00 高分子物質之處理或混合方法 [2] 3/02 • 由溶液、乳液或懸浮聚合技術以外之方法製造的溶液、分散液或膠乳 [2] 3/03 • • 水性介質中者 [5] 3/05 • • • 來自固體聚合物者 [5] 3/07 • • • 來自聚合物溶液者 [5] 3/075 • • • 高分子凝膠[6] 3/09 • • 有機液體中者 [5] 3/11 • • • 來自固體聚合物者 [5] 3/12 • 粉化或粒化 [2] 3/14 • • 由溶液沈澱而成者 [2]	3/16 • • 由分散液凝結而成者 [2] 3/18 • 高分子化合物之可塑化（可塑劑見 C08K）[2] 3/20 • 聚合物與添加劑之混合，例如著色 [2] 3/205 • • 以液相存在者 [5] 3/21 • • • 聚合物以液相先予混合者[5] 3/215 • • • • 至少一種添加劑以液相先予混合者 [5] 3/22 • • 使用色母技術者 [2] 3/24 • 高分子之交聯，例如硫化 [2]（機械特色見 B29C35/00；交聯劑見 C08K）[2]

- 3/26 • • 乳膠之交聯 [2]
- 3/28 • 利用波能或粒子輻射之處理 [2]
- 5/00 令有高分子物質成形品的製造**
(半透膜之製造見 B01D 67/00 至 71/00) [5]
- 5/02 • 由分散液(如乳膠)直接加工成製品之方法 [2]
- 5/04 • 利用經鬆散的或凝集的纖維狀物質補強高分子化合物 [2]
- 5/06 • • 使用經前處理的纖維狀物質[2]
- 5/08 • • • 玻璃纖維 [2]
- 5/10 • • 以在聚合物的混合物中所使用之添加劑為特徵者 [2]
- 5/12 • 與預先成形的高分子材料黏結以同種或其他的固體材料,例如使用黏合劑與金屬、玻璃、皮革黏合 [2]
- 5/14 • 研磨性或摩擦性物品或物質之製造 [2]
- 5/16 • 磨擦性經減少的物品或材料之製造 [2]
- 5/18 • 薄膜或薄板之製造 [2]
- 5/20 • 離子交換樹脂成形體之製造 [2]
- 5/22 • • 薄膜、膜或隔膜 [2]
- 5/24 • 利用可就地聚合之預聚合物浸漬物質,例如預浸物之製造 [2]
- 7/00 高分子物質成形製品之處理或塗層**(利用金屬材料之塗層見 C23C;金屬之電極沉積見 C25)[2]
- 7/02 • 使用溶劑,如膨潤劑者 [2]
- 7/04 • 塗層 [2,2006.01,2020.01]
- 7/043 • • 改善塗層本身的黏著性,例如:形成底漆(以介於高分子載體與黏合劑之間的底漆層為特徵之薄膜或薄片狀之黏合劑見 C09J 7/50) [2020.01]
- 7/044 • • 形成導電塗層;形成具有抗靜電性能的塗層 [2020.01]
- 7/046 • • 形成耐磨塗層;形成表面硬化塗層 [2020.01]
- 7/048 • • 形成氣體阻障塗層 [2020.01]

- 7/05 • • 形成阻燃塗層或防火塗層 [2020.01]
- 7/052 • • 形成可熱封塗層 [2020.01]
- 7/054 • • 形成防霧塗層或防滴塗層 [2020.01]
- 7/056 • • 形成親水性塗層 [2020.01]
- 7/06 • • 使用不含高分子物質之組合物者 [2]
- 7/12 • 化學改性 [2]
- 7/14 • • 使用酸,其鹽或酐者 [2]
- 7/16 • • 使用聚合性化合物者 [2]
- 7/18 • • • 使用波能或粒子輻射者 [2]
- 9/00 高分子物質經加工成多孔或蜂窩狀製品或材料之處理;其後處理**
(製造多孔或蜂窩狀製品用之塑膠或可塑性狀態物質之成型上有機械性見 B29C) [2]
- 9/02 • 高分子於製備或改性過程中使用由單體或改性劑反應而產生的發泡氣體者 [2]
- 9/04 • 使用由預先加入的發泡劑所產生之發泡氣體者 [2]
- 9/06 • • 由化學發泡劑而成者 [2]
- 9/08 • • • 發生二氧化碳者 [2]
- 9/10 • • • 發生氮氣者 [2]
- 9/12 • • 由物理發泡劑而成者 [2]
- 9/14 • • • 有機性者 [2]

附註

於 9/16 至 9/22 各目內,以下述語之含意為:

— “發泡性”一詞包括發泡中者,預先發泡者或已發泡者 [5, 8]

- 9/16 • 發泡性粒子之製造 [2,5]
- 9/18 • • 發泡劑浸漬令聚合物粒子者[2]
- 9/20 • • 於發泡劑存在下予以懸浮聚合者 [2]
- 9/22 • 發泡性粒子之後處理;泡沫生成物之形成 [2,5]
- 9/224 • • 表面處理 [5]

- 9/228 • • 發泡產品之形成 [5]
- 9/232 • • • 由發泡性粒子之燒結而成者 [5]
- 9/236 • • • 使用黏結劑者 [5]
- 9/24 • 由粒子之表面熔融及結合以形成空隙，如燒結（發泡性粒子之燒結見 9/232） [2,5]
- 9/26 • 由高分子組合物或物品去除固相，如溶解 [2]
- 9/28 • 由高分子組合物或物品去除液相，如凝固物之乾燥 [2]
- 9/30 • 於液體組合物或塑膠溶膠內混入氣體，如吹入空氣以起泡沫 [2]
- 9/32 • 由含微球之組合物者，如合成發泡體 [2]
- 9/33 • 凝結發泡體，例如廢發泡體 [5]
- 9/34 • 製造由發泡體高分子芯體及密度大於芯體之高分子表面層所組成的製品時之化學特徵 [2]
- 9/35 • 複合發泡體，亦即含有不連續多孔粒子或碎片之連續高分子發泡體 [5]
- 9/36 • 後處理（9/22 優先） [2,5]
- 9/38 • • 胞膜之破壞 [2]
- 9/40 • • 浸漬 [2]
- 9/42 • • • 使用高分子化合物者 [2]
- B29B 17/00；包含廢料聚合物或其解聚生成物之精製或再使用之聚合過程見 C08B、C、F、G、H） [4,8]
- 11/02 • 溶劑、可塑劑或未反應單體 [4]
- 11/04 • 聚合物 [2]
- 11/06 • • 無化學反應者 [4]
- 11/08 • • • 使用對聚合物成分有選擇性的溶劑者 [4]
- 11/10 • • 利用化學性方式裂斷聚合物之分子鏈或交鏈，例如脫硫作用（解聚至原來的單體入 C07） [4]
- 11/12 • • • 僅用於熱處理 [4]
- 11/14 • • • 用蒸汽或水處理 [4]
- 11/16 • • • 用無機物料處理（11/14 優先） [4]
- 11/18 • • • 用有機物料處理 [4]
- 11/20 • • • • 用烴或鹵化烴處理 [4]
- 11/22 • • • • 用有機含氧化合物處理 [4]
- 11/24 • • • • • 含羥基 [4]
- 11/26 • • • • • 含羧酸基、此等之酐或酯 [4]
- 11/28 • • • • 用含氮、硫或磷之有機化合物處理 [4]
- 99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [8]

11/00 廢料之回收或加工（機械處理見

C08K 使用無機物或非高分子有機物做為配料（塗料，油墨，清漆，染料，拋光劑，黏合劑見 C09） [2]

附註

- (1) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示時，配料應分類入最後的適當位置 [2]
- (2) 於本次類內：
- 配料混合物應分類入能包括該混合物所有基本配料的最適當的目內，例如：
 - 兩種醇之混合物.....5/05；[4]
 - 兩種多元醇的混合物.....5/053；[6]
 - 醇及醚之混合物.....5/04；[4]
 - 醚及胺之混合物.....5/00；[4]

胺及金屬之混合物 13/02；[4]

— 銨鹽按金屬鹽相同方法分類。[2]

- (3) 於本次類內，如果混合物的任意成份，按照上述附註(2)的分類無法確定，而且該成份的應用是新穎且非顯而易見的，應根據附註(1)分入本次類。該成份可以是單一化合物或組合物。 [8]
- (4) 於本次類內，如果混合物的任意成份，按照上述附註(2)或附註(3)的分類無法確定，而該成份被認為代表了對檢索重要的資訊，也可以根據附註(1)分入本次類。例如，使用分類號組合對於組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為”附加資訊”給出。 [8]
-

3/00 使用無機物質作為配料**[2,2006.01,2018.01]**

- 3/01 • 以其特定功能為特徵 **[2018.01]**
- 3/011 • • 交聯劑或硫化劑，例如促進劑 **[2018.01]**
- 3/012 • • 促進高分子化合物降解的添加劑 **[2018.01]**
- 3/013 • • 填料、顏料或增強劑**[2018.01]**
- 3/014 • • 防止氧化、熱、光或臭氧的穩定劑 **[2018.01]**
- 3/015 • • 殺生劑(高分子化合物作為殺生劑材料載體見 A01N 25/10) **[2018.01]**
- 3/016 • • 防火劑或阻燃劑 **[2018.01]**
- 3/017 • • 抗靜電劑 **[2018.01]**
- 3/02 • 元素 **[2]**
- 3/04 • • 碳 **[2]**
- 3/06 • • 硫 **[2]**
- 3/08 • • 金屬 **[2]**
- 3/10 • 金屬化合物 **[2,2006.01,2018.01]**
- 3/105 • • 含週期表第 1 至 3 族或第 11 至 13 族金屬的化合物 **[2018.01]**
- 3/11 • • 含週期表第 4 至 10 族或第 14 至 16 族金屬的化合物 **[2018.01]**
- 3/12 • • 氮化物 **[2]**
- 3/14 • • 碳化物 **[2]**
- 3/16 • 含鹵素化合物 **[2]**
- 3/18 • 含氧化合物，如羰基金屬 **[2]**
- 3/20 • • 氧化物；氮氧化物 **[2]**
- 3/22 • • • 金屬者 **[2]**
- 3/24 • • 酸；其鹽 **[2]**
- 3/26 • • • 碳酸鹽；碳酸氫鹽 **[2]**
- 3/28 • 含氮化合物 **[2]**
- 3/30 • 含硫，硒或碲化合物 **[2]**
- 3/32 • 含磷化合物 **[2]**
- 3/34 • 含矽化合物 **[2]**
- 3/36 • • 二氧化矽 **[2]**
- 3/38 • 含硼化合物 **[2]**
- 3/40 • 玻璃 **[2]**

5/00 使用有機配料 [2]

- 5/01 • 烴 **[2]**
- 5/02 • 鹵化烴 **[2]**
- 5/03 • • 芳香族者 **[2]**
- 5/04 • 含氧化合物 **[2]**
- 5/05 • • 醇；金屬醇化物 **[2]**
- 5/053 • • • 多元醇 **[6]**
- 5/057 • • • 金屬醇化物 **[6]**
- 5/06 • • 醚；醛縮醇；酮縮醇；原酸酯 **[2]**
- 5/07 • • 醛；酮 **[2]**
- 5/08 • • • 醌 **[2]**
- 5/09 • • 羧酸；其金屬鹽；其酐 **[2]**
- 5/092 • • • 多元羧酸 **[6]**
- 5/095 • • • 含鹵素之羧酸 **[6]**
- 5/098 • • • 羧酸之金屬鹽 **[6]**
- 5/10 • • 酯；醚—酯 **[2]**
- 5/101 • • • 單羧酸者 **[6]**
- 5/103 • • • • 與多元醇者 **[6]**
- 5/105 • • • • 與酚者 **[6]**
- 5/107 • • • • • 與多元酚者 **[6]**
- 5/109 • • • 碳酸者 **[6]**
- 5/11 • • • 無環多羧酸者 **[2]**
- 5/12 • • • 環狀多羧酸者 **[2]**
- 5/13 • • 酚；酚鹽 **[2]**
- 5/132 • • • 含酮基之酚 **[6]**
- 5/134 • • • 含酯基之酚 **[6]**
- 5/136 • • • 含鹵素之酚 **[6]**
- 5/138 • • • 酚鹽 **[6]**
- 5/14 • • 過氧化物 **[2]**
- 5/15 • • 在環中有氧的雜環化合物 **[2]**
- 5/151 • • • 在環中有一個氧原子 **[7]**
- 5/1515 • • • • 三節環 **[7]**
- 5/1525 • • • • 四節環 **[7]**
- 5/1535 • • • • 五節環 **[7]**
- 5/1539 • • • • • 環酐 **[7]**
- 5/1545 • • • • 六節環 **[7]**
- 5/156 • • • 在環中有兩個氧原子 **[7]**
- 5/1565 • • • • 五節環 **[7]**
- 5/1575 • • • • 六節環 **[7]**
- 5/159 • • • 在環中有多於兩個氧原子 **[7]**
- 5/16 • 含氮化合物 **[2]**
- 5/17 • • 胺；季胺化合物 **[2]**
- 5/18 • • • 具芳香族結合的胺基 **[2]**

- 5/19 . . . 季胺化合物 [2]
- 5/20 . . 羧酸醯胺 [2]
- 5/205 . . 包含下式之化合物 $\text{—O—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—N}<$
基，例如胺基甲酸鹽 [6]
- 5/21 . . 脲；其衍生物，如縮二脲 [2]
- 5/22 . . 含有一個氮連接至另一個氮原子之化合物 [2]
- 5/23 . . . 偶氮化合物 [2]
- 5/24 . . . 胼之衍生物 [2]
- 5/25 . . . 羧酸醯胼 [2]
- 5/26 . . . 胺基脲 [2]
- 5/27 . . . 含有一個氮原子連接至另外兩個氮原子之化合物，如重氮胺基化合物 [2]
- 5/28 . . . 疊氮化合物 [2]
- 5/29 . . 含有一個或更多的碳—氮雙鍵之化合物 [2]
- 5/30 . . . 脛；縮胺基脲 [2]
- 5/31 . . . 胍；其衍生物 [2]
- 5/315 . . 含有碳—氮三鍵之化合物 [6]
- 5/32 . . 含有氮連接至氧之化合物 [2]
- 5/33 . . . 脞 [2]
- 5/34 . . 在環中有氮之雜環化合物 [2]
- 5/3412 . . . 環中有一個氮原子 [5]
- 5/3415 五節環 [5]
- 5/3417 與碳環稠合 [5]
- 5/3432 六節環 [5]
- 5/3435 六氫吡啶類 [5]
- 5/3437 與碳環稠合 [5]
- 5/3442 . . . 環中有兩個氮原子 [5]
- 5/3445 五節環 [5]
- 5/3447 與碳環稠合 [5]
- 5/3462 六節環 [5]
- 5/3465 與碳環稠合 [5]
- 5/3467 . . . 環中有兩個以上氮原子 [5]
- 5/3472 五節環 [5]
- 5/3475 與碳環稠合 [5]
- 5/3477 六節環 [5]
- 5/3492 三吡啶類 [5]
- 5/3495 與碳環稠合 [5]
- 5/35 . . . 在環中亦含有氧 [2]
- 5/353 五節環 [5]
- 5/357 六節環 [5]
- 5/36 . 含硫、硒或碲之化合物 [2]
- 5/37 . . 硫醇 [2,7]
- 5/372 . . 硫化物 [6,7]
- 5/375 . . . 含六元芳香族環的 [6,7]
- 5/378 . . . 含雜環的 [6,7]
- 5/38 . . 硫代碳酸；其衍生物；例如黃原酸鹽 [2]
- 5/39 . . 硫代胺基甲酸；其衍生物，例如硫代胺基甲酸鹽 [2]
- 5/40 . . . 秋蘭姆硫化物；秋蘭姆聚硫化物；例如含下列基團之化合物

$$\text{>N—}\overset{\text{S}}{\parallel}\text{C—(S)}_x\text{—}\overset{\text{S}}{\parallel}\text{C—N}< \quad [2]$$
- 5/405 . . 硫脲；其衍生物 [6]
- 5/41 . . 含有硫連接至氧之化合物 [2]
- 5/42 . . . 磺酸；其衍生物 [2]
- 5/43 . . 含有硫連接至氮之化合物 [2]
- 5/435 . . . 磺醯胺 [6]
- 5/44 . . . 亞磺醯胺 [2]
- 5/45 . . 環中有硫之雜環化合物 [2]
- 5/46 . . . 在環中有氧或氮 [2]
- 5/47 噻唑 [2]
- 5/48 . . 含硒或碲之化合物 [2]
- 5/49 . 含磷化合物 [2]
- 5/50 . . 磷僅連接至碳 [2,5]
- 5/51 . . 磷連接至氧 [2]
- 5/52 . . . 僅連接至氧 [2]
- 5/521 磷酸之酯類，例如 H_3PO_4 者 [5]
- 5/523 與羥芳基化合物 [5]
- 5/524 亞磷酸之酯類，例如 H_3PO_3 者 [5]
- 5/526 與羥芳基化合物 [5]
- 5/527 環酯類 [5]
- 5/529 含有非磷酸或亞磷酸酯類之雜環酯類 [5]
- 5/53 . . . 僅連接至氧及碳 [2,5]
- 5/5313 次磷酸之化合物，例如 $\text{R}_2=\text{P}(\text{:O})\text{OR}'$ [5]

- 5/5317 膦酸之化合物；例如

$$\text{R-P}(\text{:O})(\text{OR}')_2$$
 [5]
 5/5333 膦酸之酯類 [5]
 5/5337 亦含鹵素 [5]
 5/5353 亦含氮 [5]
 5/5357 環狀者 [5]
 5/5373 含有非膦酸之酯類的
 雜環 [5]
 5/5377 三價膦酸化合物，例如

$$\text{R}_2=\text{P-OR}'$$
 [5]
 5/5435 在環中含氧者 [7]
 5/544 . . . 含氮者 [7]
 5/5445 . . . 含至少一個 Si—N 鍵 [7]
 5/5455 . . . 含至少一個 $\text{>N}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$ 基團 [7]
 5/5465 . . . 含至少一個 C=N 鍵 [7]
 5/5475 . . . 含至少一個 C≡N 鍵 [7]
 5/548 . . . 含硫者 [7]
 5/549 . . . 在環中含矽 [7]
 5/55 . . . 含硼化合物 [2]
 5/56 . . . 金屬有機化合物，即含有金屬與
 碳連接鍵之有機化合物 [2]
 5/57 . . . 有機錫化合物 [2]
 5/58 . . . 含有硫 [2]
 5/59 . . . 含砷或銻之化合物 [2]
7/00 使用的配料以形狀區分 [2]
 7/02 . . . 纖維或針狀單晶 [2]
 7/04 . . . 無機者 [2]
 7/06 元素 [2]
 7/08 含氧化合物 [2]
 7/10 含矽化合物 [2]
 7/12 石棉 [2]
 7/14 玻璃 [2]
 7/16 . . . 固體圓球 [2]
 7/18 . . . 無機者 [2]
 7/20 玻璃 [2]

- 5/5393 亞膦酸化合物，例如

$$\text{R-P}(\text{OR}')_2$$
 [5]
 5/5397 氧化磷 [5]
 5/5398 . . . 磷連接至硫 [5]
 5/5399 . . . 磷連接至氮 [5]
 5/54 . . . 含矽化合物 [2]
 5/541 . . . 含氧 [7]
 5/5415 . . . 含至少一個 Si—O 鍵 [7]
 5/5419 . . . 含至少一個 Si—C 鍵 [7]
 5/5425 . . . 含至少一個 C=C 鍵 [7]
 7/22 . . . 膨脹的、多孔或空心的粒子 [2]
 7/24 . . . 無機者 [2]
 7/26 . . . 含矽化合物 [2]
 7/28 . . . 玻璃 [2]
9/00 使用預處理的配料（使用預處理的
 纖維狀材料以製造含高分子物質之
 製品或成形材料見 C08J5/06）[2]
 9/02 . . . 用無機物質處理的配料 [2]
 9/04 . . . 用有機物質處理的配料 [2]
 9/06 . . . 用含矽化合物 [2]
 9/08 . . . 用黏結劑處理而凝結之配料 [2]
 9/10 . . . 包膠的配料 [2]
 9/12 . . . 吸附的配料 [2]
**11/00 使用未知成分之配料，如不明確
 的反應產物** [2]
**13/00 使用不包括於上述單獨一個主
 目內的配料混合物，其中每種化
 合物均為基本配料** [4]
 13/02 . . . 有機及無機配料 [4]
 13/04 . . . 以其形狀區分之配料及有機或無
 機的配料 [4]
 13/06 . . . 預處理配料 3/00 至 7/00 主目所
 包括的配料 [4]
 13/08 . . . 未知成分之配料及 3/00 至 9/00
 主目所包括的配料 [4]

C08L 高分子化合物之組合物（基於可聚合單體的組成成分見 C08F、C08G；人
 造絲或纖維見 D01F；織物處理之配方見 D06）[2]

附註

- (1) 於本次類內，以下術語的含意為：
- “橡膠” 包含：
 - (a) 天然橡膠或共軛二烯橡膠；
 - (b) 一般橡膠（對於一種特殊橡膠，除天然橡膠或共軛二烯橡膠外，見包括此高分子化合物組合物之目）。[2]
- (2) 於本次類內：
- (a) 組合物請依據主成分規則分類； [2]
 - (b) 組合物請依據主成分規則分類；如此等組成分以相同比例存在，則按此等組成分之每一種分類。[2]
- (3) 如果組合物的任意高分子組成分，按照上述附註(2)的分類無法確定，而且該組成分的使用是新穎和非顯而易見的，還應分入本次類。例如，含 80% 聚乙烯和 20% 聚氯乙烯的組合物，如果確定聚氯乙烯的使用是新穎和非顯而易見的，則該組合物同時分類入 23/06 和 27/06 目。 [8]
- (4) 如果組合物的任意高分子組成分，按照上述附註(2)或附註(3)的分類無法確定，而該成分被認為代表了對檢索重要的資訊，也可以分入本次類。例如，使用分類號組合對於組合物進行檢索是重要的情況下，這些非強制分類應當作為“附加資訊”給出。 [8]

次類索引

多糖類或其衍生物之組合物....	1/00 至 5/00	由碳—碳不飽和鍵以外反應而得到的高分子化合物之組合物；此類聚合物之衍生物的組合物.....	59/00 至 87/00
橡膠或其衍生物之組合物.....	7/00 至 21/00	天然高分子化合物或其衍生物之組合物.....	89/00 至 99/00
僅有碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物之組合物；此類聚合物的之衍生物的組合物	23/00 至 57/00	未指定的高分子化合物之組合物.....	101/00

多糖類或其衍生物之組合物 [2]

1/00 纖維素、改性纖維素或纖維素衍生物之組合物 [2]

- 1/02 • 纖維素；改性纖維素 [2]
- 1/04 • • 氧化纖維素；水解纖維素 [2]
- 1/06 • • 纖維素水合物 [2]
- 1/08 • 纖維素衍生物 [2]
- 1/10 • • 有機酸之酯 [2]
- 1/12 • • • 乙酸纖維素 [2]
- 1/14 • • • 混合酯；如乙酸丁酸纖維素 [2]
- 1/16 • • 無機酸之酯 [2]
- 1/18 • • • 硝酸纖維素 [2]

- 1/20 • • 有機酸與無機酸兩者的酯 [2]

- 1/22 • • 黃原酸纖維素 [2]

- 1/24 • • • 黏液絲 [2]

- 1/26 • • 纖維素醚 [2]

- 1/28 • • • 烷基醚 [2]

- 1/30 • • • 芳基醚；芳烷基醚 [2]

- 1/32 • • 纖維素醚酯 [2]

3/00 澱粉、直鏈澱粉或支鏈澱粉或此等之衍生物或降解物的組合物 [2]

- 3/02 • 澱粉；其降解產物，如糊精 [2]
- 3/04 • 澱粉衍生物 [2]
- 3/06 • • 酯 [2]

- 3/08 • • 醚 [2]
- 3/10 • • 氧化的澱粉 [2]
- 3/12 • 直鏈澱粉；支鏈澱粉，此等之降解產物 [2]
- 3/14 • 直鏈澱粉衍生物；支鏈澱粉衍生物 [2]
- 3/16 • • 酯 [2]
- 3/18 • • 醚 [2]
- 3/20 • • 氧化的直鏈澱粉；氧化的支鏈澱粉 [2]

5/00 不包括於 1/00 或 3/00 目內的多糖類或其衍生物之組合物 [2]

- 5/02 • 葡聚糖；及其衍生物 [2]
- 5/04 • 藻酸；及其衍生物 [2]
- 5/06 • 果膠；及其衍生物 [2]
- 5/08 • 幾丁質；軟骨素硫酸鹽、玻尿酸；及其衍生物 [2]
- 5/10 • 肝素；及其衍生物 [2]
- 5/12 • 瓊脂；及其衍生物 [2]
- 5/14 • 半纖維素；及其衍生物 [2]
- 5/16 • 環糊精；及其衍生物 [2]

橡膠或其衍生物組合物 [2]

- 7/00 天然橡膠之組合物 [2]**
- 7/02 • 膠乳 [2]
- 9/00 共軛二烯烴均聚物或共聚物之組合物 [2]**
- 9/02 • 與丙烯腈之共聚物 [2]
- 9/04 • • 膠乳 [2]
- 9/06 • 與苯乙烯之共聚物 [2]
- 9/08 • • 膠乳 [2]
- 9/10 • 膠乳（9/04，9/08 優先）[2]
- 11/00 氯丁二烯均聚物或共聚物之組合物 [2]**
- 11/02 • 膠乳 [2]
- 13/00 含有羧基橡膠之組合物 [2]**
- 13/02 • 膠乳 [2]
- 15/00 橡膠衍生物之組合物（11/00，13/00 優先）[4]**

- 15/02 • 含鹵素之橡膠衍生物 [2]

17/00 再生膠之組合物 [2]

19/00 不包括於 7/00 至 17/00 目內之橡膠組合物 [2]

- 19/02 • 膠乳 [2]

21/00 未指定的橡膠之組合物 [2]

- 21/02 • 膠乳 [2]

僅用碳-碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物之組合物 [2]

附註

(1) 在 23/00 至 49/00 目中，“脂族基團”係指以下列各鍵結而予終結之無環或非芳香碳環骨架：

- (a) 碳以外之元素； [8]
- (b) 與碳以外之一個對原子具有雙鍵結合之碳原子； [8]
- (c) 與芳香族碳環或雜環。 [8]

(2) 在 23/00 至 49/00 目中，若無相反指示，共聚物按其主要單體組成分來分類。 [8]

23/00 僅有一個碳-碳雙鍵之不飽和脂族烴的均聚物或共聚物之組合物；此種聚合物衍生物之組合物 [2]

- 23/02 • 未用化學後處理改性者 [2,2006.01,2025.01]
- 23/025 • • 未指定烯烴與非烯烴單體的共聚物[2025.01]
- 23/04 • • 乙烯的均聚物或共聚物（23/16 優先）[2]
- 23/06 • • • 聚乙烯 [2]
- 23/08 • • • 乙烯共聚物（23/16 優先）[2,2006.01,2025.01]
- 23/0807 • • • • 與僅含有四個或更多碳原子之不飽和烴[2025.01]

- 23/0846 與含有碳或氫以外原子之不飽和烴[2025.01]
- 23/0853 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 [2025.01]
- 23/0861 皂化共聚物，如乙烯- 乙 烯 醇 共 聚 物 [2025.01]
- 23/0869 與不飽和酸，如(甲基)丙烯酸；含有不飽和酯，如(甲基)丙烯酸酯 [2025.01]
- 23/0876 其鹽，如離子聚合物 [2025.01]
- 23/0884 含環氧基之酯[2025.01]
- 23/0892 含有碳、氫或氧以外原子之單體[2025.01]
- 23/10 . . 丙烯之均聚物或共聚物 [2]
- 23/12 . . . 聚丙烯 [2]
- 23/14 . . . 丙烯之共聚物 (23/16 優先) [2]
- 23/16 . . 乙烯- 丙烯或乙烯- 丙烯- 二 烯 共 聚 物 [2,2006.01]
- 23/18 . . 具有四個或更多碳原子之烴的均聚物或共聚物 [2,2006.01,2025.01]
- 23/20 . . . 具有四至九個碳原子 [2,2006.01,2025.01]
- 23/22 異丁烯之共聚物；丁基橡膠；其他異烯烴之均聚物或共聚物 [2,2006.01,2025.01]
- 23/24 . . . 具有十個或更多碳原子 [2]
- 23/26 . 用化學後處理改性者 (皂化共聚物見 23/0861；不飽和酸之鹽見 23/0876) [2,2006.01,2025.01]
- 23/28 . . 與鹵素或含鹵素化合物反應 (23/32 優 先) [2,2006.01,2025.01]
- 23/283 . . . 鹵化異烯烴之均聚物或共聚物[2025.01]
- 23/286 . . . 氯化聚乙烯[2025.01]
- 23/30 . . 氧化 [2]
- 23/32 . . 與含磷或含硫化合物反應 [2,2006.01]
- 23/34 . . . 氯磺醯化作用 [2]
- 23/36 . . 與含氮化合物反應，如硝化作用 [2]
- 25/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以芳族碳環為終端；此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 25/02 . 烴之均聚物或共聚物 [2]
- 25/04 . . 苯乙烯之均聚物或共聚物 [2]
- 25/06 . . . 聚苯乙烯 [2]
- 25/08 . . . 苯乙烯之共聚物 (29/08、35/06、55/02 優先) [2]
- 25/10 與共軛二烯 [2]
- 25/12 與不飽和腈 [2]
- 25/14 與不飽和酯 [2]
- 25/16 . . 烷基取代苯乙烯之均聚物或共聚物 [2]
- 25/18 . 含有碳、氫以外元素的芳族單體之均聚物或共聚物 [2]
- 27/00 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以鹵素為終端；此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 27/02 . 未用化學後處理改性者 [2]
- 27/04 . . 含氯原子 [2]
- 27/06 . . . 氯乙烯之均聚物或共聚物[2]
- 27/08 . . . 二氯亞乙烯基之均聚物或共聚物 [2]
- 27/10 . . 含溴或含碘原子 [2]
- 27/12 . . 含氟原子 [2]
- 27/14 . . . 氟乙烯之均聚物或共聚物[2]
- 27/16 . . . 二氟亞乙烯基之均聚物或共聚物 [2]
- 27/18 . . . 四氟乙烯之均聚物或共聚物 [2]
- 27/20 . . . 六氟丙烯之均聚物或共聚物

- [2]
- 27/22 • 用化學後處理改性者 [2]
- 27/24 • • 鹵化者 [2]
- 29/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係是以醇，醚，醛，酮，醛縮醇或酮縮醇基為終端；不飽和醇與飽和羧酸之酯水解的聚合物之組合物；此種聚合物之衍生物的組合物 [2]
- 29/02 • 不飽和醇之均聚物或共聚物（29/14 優先）[2]
- 29/04 • • 聚乙烯醇；部分水解的不飽和醇與飽和羧酸之酯的均聚物或共聚物 [2]
- 29/06 • • 烯丙醇之共聚物 [2]
- 29/08 • • • 與乙烯基芳族單體 [2]
- 29/10 • 不飽和醚之均聚物或共聚物（35/08 優先）[2]
- 29/12 • 不飽和酮之均聚物或共聚物 [2]
- 29/14 • 由不飽和醛縮醇或酮縮醇聚合，或由不飽和醇聚合物經後處理而得的醛縮醇或酮縮醇之均聚物或共聚物 [2]
- 31/00** 具有一個或更多不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以飽和羧酸之鹽基、碳酸或鹵甲酸之鹽基作為終端（水解的聚合物見 29/00）；此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 31/02 • 單羧酸酯之均聚物或共聚物 [2]
- 31/04 • • 乙酸乙烯酯之均聚物或共聚物 [2]
- 31/06 • 多元羧酸酯的均聚物或共聚物 [2]
- 31/08 • • 苯二甲酸者 [2]
- 33/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且只有一個僅以一個羧基或其鹽，酐，酯，鹽胺，鹽亞胺或脛作為終端；此種聚合物之衍生物之組合物 [2]
- 33/02 • 酸之均聚物或共聚物；此等之金屬鹽或銨鹽 [2]
- 33/04 • 酯之均聚物或共聚物 [2]
- 33/06 • • 僅含有碳、氫及氧之酯，而氧原子僅作為羧基部分存在 [2]
- 33/08 • • • 丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [2]
- 33/10 • • • 甲基丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [2]
- 33/12 • • • 甲基丙烯酸甲酯之均聚物或共聚物 [2]
- 33/14 • • 含有鹵素，氮，硫之酯，或除羧基氧之外尚含其他氧原子的酯 [2]
- 33/16 • • • 含鹵素原子之酯的均聚物或共聚物 [2]
- 33/18 • 脛之均聚物或共聚物 [2]
- 33/20 • • 丙烯脛之均聚物或共聚物（55/02 優先）[2]
- 33/22 • • 含有四個或更多碳原子的脛之均聚物或共聚物 [2]
- 33/24 • 鹽胺或鹽亞胺之均聚物或共聚物 [2]
- 33/26 • • 丙烯鹽胺或甲基丙烯鹽胺之均聚物或共聚物 [2]
- 35/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳—碳雙鍵，且至少有一個係以羧基為終端，且於分子中至少含有另一個羧基，或其鹽、酐、酯、鹽胺、鹽亞胺或脛；此種聚合物之衍生物的組合物 [2]
- 35/02 • 酯之均聚物或共聚物（35/06、

- 35/08 優先) [2]
- 35/04 • 腈之均聚物或共聚物 (35/06、35/08 優先) [2]
- 35/06 • 乙烯基芳族單體之共聚物 [2]
- 35/08 • 乙烯基醚之共聚物 [2]
- 37/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以含氧的雜環為終端 (多官能酸見之環酯見 31/00; 不飽和酸之環酐見 35/00); 此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 39/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以對氮之單鍵或雙鍵或以含氮雜環作為終端; 此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 39/02 • 乙烯胺之均聚物或共聚物 [2]
- 39/04 • 含有以氮為環原子之雜環單體之均聚物或共聚物 [2]
- 39/06 • • N-乙基吡咯烷酮之均聚物或共聚物 [2]
- 39/08 • • 乙基吡啶之均聚物或共聚物 [2]
- 41/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，且至少有一個係以連接至硫之鍵或以含硫雜環作為終端; 此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 43/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物，每個脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且含有硼、矽、磷、硒、碲、或一種金屬; 此種聚合
- 物衍生物之組合物 [2]**
- 43/02 • 含磷單體之均聚物或共聚物 [2]
- 43/04 • 含矽單體之均聚物或共聚物 [2]
- 45/00** 於側鏈上無不飽和脂族基，而於碳環或雜環系統內有一個或更多的碳-碳雙鍵化合物之均聚物或共聚物之組合物; 此種聚合物之衍生物之組合物 (關於多官能酸之環酯見 31/00; 環酐或環醯亞胺見 35/00) [2]
- 45/02 • 苯并呋喃-茛聚物 [2]
- 47/00** 具有一個或更多的不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的組合物; 該不飽和脂族基至少有一個具有兩個或更多之碳-碳雙鍵; 此種聚合物衍生物之組合物 (45/00 優先; 共軛二烯烴橡膠見 9/00 至 21/00) [2]
- 49/00** 具有一個或更多的碳-碳三鍵化合物之均聚物或共聚物的組合物; 此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 51/00** 接枝聚合物之組合物，其中接枝之組成分係僅由碳-碳不飽和鍵反應而得者 (對於 ABS 聚合物見 55/02); 此種聚合物衍生物之組合物 [2]
- 51/02 • 接枝至多糖上 [2]
- 51/04 • 接枝至橡膠上 [2]
- 51/06 • 接枝至僅含有一個碳-碳雙鍵脂族烴之均聚物或共聚物上 [2]
- 51/08 • 接枝至除僅由不飽和碳-碳鍵反應之外而得的高分子化合物上 [2]
- 51/10 • 接枝至無機物上 [2]
- 53/00** 嵌段共聚物之組合物，該共聚物至少有一個聚合物鏈區係僅由碳-碳不飽和鍵反應而得者; 此種聚合物衍生物之組合物 [2]

53/02 · 乙烯基芳族單體與共軛二烯者 [2]

55/00 不包括在 23/00 至 53/00 目內僅由碳-碳不飽和鍵聚合反應而得的均聚物或共聚物之組合物 [2]

55/02 · ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) 聚合物 [2]

55/04 · 由二烯合成而得的加聚物 [2]

57/00 僅由碳-碳不飽和鍵反應而得之未指明的聚合物之組合物 [2]

57/02 · 礦物油烴之共聚物 [2]

57/04 · 僅由少量成分之單體所確定的共聚物 [2]

57/06 · 含有碳及氫以外元素之均聚物或共聚物 [2]

57/08 · · 含鹵素原子 [2]

57/10 · · 含氧原子 [2]

57/12 · · 含氮原子 [2]

由碳-碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物之組合物 [2]

59/00 聚縮醛之組合物；聚縮醛衍生物之組合物(聚乙烯縮醛見 29/14) [2]

59/02 · 僅含聚甲醛鏈段之聚縮醛 [2]

59/04 · 甲醛共聚物 [3]

61/00 醛或酮之縮聚物之組合物 (與多元醇者見 59/00；與多元腈者見 77/00)；此種聚合物之衍生物的組合物 [2]

61/02 · 僅係醛或酮之縮聚物 [2]

61/04 · 醛或酮僅與酚之縮聚物 [2]

61/06 · · 醛與酚者 [2]

61/08 · · · 與一元酚 [2]

61/10 · · · · 苯酚-甲醛縮聚物 [2]

61/12 · · · 與多元酚 [2]

61/14 · · · 改性酚-醛縮聚物 [2]

61/16 · · 酮與酚者 [2]

61/18 · 醛或酮僅與芳烴或此等之鹵素衍生物之縮聚物 [2]

61/20 · 醛或酮僅與含有氮連接至氮之化合物之縮聚物 (與胺基酚類者見 61/04) [2]

61/22 · · 醛與無環或碳環化合物者 [2]

61/24 · · · 與脲或硫脲 [2]

61/26 · · 醛與雜環化合物者 [2]

61/28 · · · 與三聚氰胺 [2]

61/30 · · 醛與雜環及無環或碳環化合物者 [2]

61/32 · · 改性之胺-醛縮聚物 [2]

61/34 · 醛或酮與包括在 61/04、61/18 及 61/20 目中至少兩類單體之縮聚物 [2]

63/00 環氧樹脂之組合物；環氧樹脂衍生物之組合物 [2]

63/02 · 雙酚之聚縮水甘油醚類 [2]

63/04 · 線型酚醛環氧樹脂 [2]

63/06 · 三縮水甘油基異三聚氰酸酯 [2]

63/08 · 環氧化聚合多烯烴 [2]

63/10 · 用不飽和化合物改性之環氧樹脂 [2]

附註

無相反指示時，在 65/00 至 85/00 目中，由主鏈中形成兩種不同鍵合及反應而得的高分子化合物之組合物，僅依過量之鍵合而分類。[2]

65/00 由主鏈中形成碳-碳鍵反應而得的高分子化合物之組合物 (7/00 至 57/00、61/00 優先)；此種聚合物衍生物之組合物 [2]

65/02 · 聚亞苯基 [2]

65/04 · 聚對苯二亞甲基 [2]

67/00 由主鏈中形成一個羧酸酯鍵合反應而得的聚酯之組合物 (有關聚酯-醯胺見 77/12；有關聚酯-醯亞胺之見 79/08)；此種聚合物衍生物之組合物 [2]

67/02 · 由二羧基酸與二羟基化合物而得

- 的聚酯 (67/06 優先) [2]
- 67/03 • • 具有羥基與羧基直接連至芳香環上之二羧酸與二羥基化合物 [5]
- 67/04 • 由羥基酸得到的聚酯，如內酯 (67/06 優先) [2]
- 67/06 • 不飽和聚酯 [2]
- 67/07 • • 具有碳-碳不飽和端基者 [5]
- 67/08 • 用高級脂肪油或其酸，或以天然樹脂或樹脂酸改性之聚酯 [2]
- 69/00 聚碳酸酯之組合物；聚碳酸酯衍生物之組合物 [2]**
- 71/00 由主鏈中形成醚鍵合之反應而得的聚醚之組合物 (有關聚醛縮醇見 59/00；有關環氧樹脂者見 63/00；有關聚硫醚-醚者見 81/02；有關聚醚砜者見 81/06)；此種聚合物衍生物之組合物 [2]**
- 71/02 • 聚烯化氧 [2]
- 71/03 • • 聚表鹵代醇類 [5]
- 71/08 • 由羥基化合物或由其金屬衍生物而得的聚醚 (71/02 優先) [5]
- 71/10 • • 由酚 [5]
- 71/12 • • • 聚苯氧 [5]
- 71/14 • • 糖醇聚合物 [5]
- 73/00 不包括在 59/00 至 71/00 目內者，由在主鏈中形成含有氧鍵合或氧與碳鍵合反應而得的高分子化合物之組合物；此種聚合物衍生物之組合物 [2]**
- 73/02 • 聚酞 [2]
- 75/00 聚脲或聚胺酯之組合物；此種聚合物之衍生物之組合物 [2]**
- 75/02 • 聚脲 [2]
- 75/04 • 聚胺酯 [2]
- 75/06 • • 由聚酯 [2]
- 75/08 • • 由聚醚 [2]
- 75/10 • • 由聚醛縮醇 [2]
- 75/12 • • 由含有氮與活性氫之化合物，而氮原子並非異氰酸酯基之一部分 [2]
- 75/14 • • 具有碳-碳不飽和鍵之聚胺酯 [2]
- 75/16 • • • 末端具有碳-碳不飽和鍵者 [5]
- 77/00 由在主鏈中形成羧酸鹽胺鍵合反應得的聚鹽胺之組合物 (有關聚鹽胍之組合物見 79/06；聚鹽胺-鹽亞胺或聚鹽胺之組合物見 79/08)；此等聚合物之衍生物之組合物 [2]**
- 77/02 • 由 ω -胺基羧酸或其內鹽胺得到的聚鹽胺 (77/10 優先) [2]
- 77/04 • 由 α -胺基羧酸而得的聚鹽胺 (77/10 優先) [2]
- 77/06 • 由多元胺與多元羧酸而得的聚鹽胺 (77/10 優先) [2]
- 77/08 • • 由多元胺與已聚合之不飽和脂肪酸 [2]
- 77/10 • 由胺基羧酸或多元胺與多元羧酸與芳基連接之胺基及羧基之反應而得的聚鹽胺 [2]
- 77/12 • 聚酯-鹽胺 [2]
- 79/00 不包括於 61/00 至 77/00 目內者，由只在主鏈中形成含氮者，與或不與氧、碳鍵合反應而得至的高分子化合物之組合物 [2]**
- 79/02 • 聚胺 [2]
- 79/04 • 在主鏈中具有含氮雜環之縮聚物；聚鹽胍；聚鹽胺酸或類似之聚鹽亞胺母體 [2]
- 79/06 • • 聚鹽胍；聚三唑；聚胺基三唑，聚噁二唑 [2]
- 79/08 • • 聚鹽亞胺；聚酯-鹽亞胺；聚鹽胺-鹽亞胺；聚鹽胺酸或類似之聚鹽亞胺母體 [2]
- 81/00 由僅在主鏈中形成含硫者，與或不與氮、氧或碳鍵合反應而得的高分子化合物之組合；聚砜組合物；此種聚合物之衍生物之組合**

物 [2]

- 81/02 • 聚硫醚；聚硫醚-醚 [2]
- 81/04 • 聚硫化合物 [2]
- 81/06 • 聚砜；聚醚砜 [2]
- 81/08 • 聚磺酸酯 [2]
- 81/10 • 聚砜鹽胺；聚砜鹽亞胺 [2]
- 83/00 由僅在主鏈中形成含矽者，與或不與硫、氮、氧或碳鍵合反應而得的高分子化合物之組合物；此種高分子化合物之組合物 [2]**
- 83/02 • 聚矽酸酯 [2]
- 83/04 • 聚矽氧烷 [2]
- 83/05 • • 含連接至氮之矽 [4]
- 83/06 • • 含有連接至含氧基團之矽（83/12 優先） [2]
- 83/07 • • 含連接至不飽和脂族基團之矽 [4]
- 83/08 • • 含連接至含碳、氮及氧以外原子的有機基團之矽 [2]
- 83/10 • 含有聚矽氧烷鏈區之嵌段或接枝共聚物（由具有一個碳-碳雙鍵之化合物聚合至聚矽氧烷而得者見 51/08、53/00） [2]
- 83/12 • • 含有聚醚鏈段 [2]
- 83/14 • 其中至少兩個，但並非所有的矽原子與氧以外原子連接（83/10 優先） [2]
- 83/16 • 其中所有的矽原子係與氧以外之原子連接 [2]
- 85/00 由在主鏈中形成除矽、硫、氮、氧及碳以外原子鍵合反應而得的高分子化合物之組合物；此種聚合物之衍生物之組合物 [2]**
- 85/02 • 含磷 [2]
- 85/04 • 含硼 [2]
- 87/00 由碳-碳不飽和鍵之聚合以外之反應而得的未指明之高分子化合物之組合物 [2]**

天然高分子化合物或其衍生物之組合物 [2]**89/00 蛋白質之組合物；其衍生物之組合物 [2]**

- 89/02 • 酪蛋白-醛縮聚物 [2]
- 89/04 • 由廢物而得的產物，如角、蹄或毛髮 [2]
- 89/06 • • 由皮革或皮而得者 [2]

91/00 油、脂肪或蠟之組合物；此等衍生物之組合物 [2]

- 91/02 • 硫化油，如油膏 [2]
- 91/04 • 氧化亞麻油 [2]
- 91/06 • 蠟 [2]
- 91/08 • • 地蠟 [2]

93/00 天然樹脂之組合物；其衍生物之組合物（有關多糖類者見 1/00 至 5/00；有關天然橡膠者見 7/00） [2]

- 93/02 • 蟲膠 [2]
- 93/04 • 松香 [2]

95/00 瀝青材料之組合物，如石油瀝青、焦油或天然瀝青 [2]**97/00 含木質素材料之組合物（有關多糖類者見 1/00 至 5/00） [2]**

- 97/02 • 木質-纖維素材料，如木材，稻草或蔗渣 [2]

99/00 未包括在 1/00 至 7/00 或 89/00 至 97/00 目內的天然高分子化合物或其衍生物之組合物 [2]**101/00 未指明高分子化合物之組合物 [2]**

- 101/02 • 按所存在指明之基團區分 [2]
- 101/04 • • 含鹵素原子 [2]
- 101/06 • • 含氧原子 [2]
- 101/08 • • • 羧基 [2]
- 101/10 • • 含可水解的矽烷基團 [2]
- 101/12 • 以物理性質為特徵者，例如各向異性、黏度或電導度 [6]
- 101/14 • • 高分子為水溶性或水膨脹性者，例如水溶膠凝體 [6]
- 101/16 • 高分子化合物可被生物分解 [7]

C09 染料；塗料；拋光劑；天然樹脂；黏合劑；其他類目不包括的組合物；其他類目不包括的各種材料之應用

C09B 有機染料或用於製造染料之有關化合物；媒染劑；色澱（發酵或用酶的方法合成要求之化學化合物見 C12P）

附註

於此次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示時，化合物請放入最後適當位置。

次類索引

蒽染料.....1/00，3/00，5/00，6/00，9/02	吡啶，吡啶，嘔啶，
偶氮染料	噻吩染料..... 15/00 至 21/00
由重氮化及偶合製備者	喹啉及多甲川基染料..... 23/00，25/00
單偶氮染料..... 29/00	脘；三氮烯染料.....26/00
雙偶氮及多偶氮染料.31/00，33/00，35/00	卟啉，紫菜卟啉，硫化染料..... 47/00，49/00
重氮化之胺類與其本身偶合	噻吡啶酮.....48/00
之偶氮染料..... 37/00	甲脞染料；硝基及亞硝基染料；
其他偶氮染料..... 39/00	醌亞胺；偶氮甲鹼
進行偶合反應之特殊方法..... 41/00	染料..... 50/00；51/00；53/00；55/00
由其他偶氮化合物製備偶氮染料..... 43/00	其他合成染料..... 57/00，59/00
除由重氮化與偶合之外的製備..... 27/00	天然來源之染料.....61/00
含有鎘類基團之化合物..... 44/00	活性染料.....62/00
偶氮金屬錯合物..... 45/00	色澱，媒染劑，
含有其他發色體系之化合物..... 56/00	染劑之製備.....63/00，65/00，67/00
其他偶氮染料..... 46/00	其他染料.....69/00
靛類染料；二芳基與三芳基甲烷染料；	
羰基染料..... 7/00，9/04；11/00；13/00	
♣	1/14 . . . 含醌基之染料

蒽染料

1/00 具有一個未與任何其他環稠合的蒽環之染料

1/02	• 羧基蒽醌類；其醚及其酯類
1/04	• • 由環之合成製備
1/06	• • 由已含有蒽環之原料製備
1/08	• • • 僅含有羥基之染料
1/10	• • • 含鹵素之染料
1/12	• • • 含磺酸基之染料

1/16	• 氨基蒽醌類
1/18	• • 由環之合成製備
1/20	• • 由已含有蒽環之原料製備
1/22	• • • 具有未取代的胺基之染料
1/24	• • • • 磺化者
1/26	• • • 具有為羥基所取代的氨基之染料
1/28	• • • • 以烷基，芳烷基或環烷基取代者

- 1/30 磺化者
- 1/32 以芳基取代者（蔥亞胺見 1/48）
- 1/34 磺化者
- 1/36 具有醯化胺基之染料
- 1/38 脲或硫脲衍生物
- 1/40 係一個脂肪族或芳香脂肪族羧酸之醯基
- 1/42 係一個芳香族羧酸之醯基
- 1/43 二羧酸 [3]
- 1/44 係一個雜環羧酸之醯基
- 1/46 係三聚氰酸或類似雜環化合物之醯基
- 1/467 連接兩個或更多個蔥醌環[3]
- 1/473 係一個磺酸之醯基 [3]
- 1/48 蔥亞胺類
- 1/50 胺基-羥基蔥醌類；其醚或酯類
- 1/503 未取代之胺基-羥基蔥醌 [2]
- 1/51 N-取代之胺基-羥基蔥醌 [2]
- 1/514 N-芳基衍生物（N-芳烷基衍生物見 1/515） [2]
- 1/515 N-烷基，N-芳烷基，或 N-環烷基衍生物 [2]
- 1/516 N-醯化衍生物 [3]
- 1/52 磺化者
- 1/54 醚化者
- 1/56 巰基-蔥醌類
- 1/58 與脂肪族，脂環族，芳脂族之基或芳基取代之巰基 [3]
- 1/60 由脂肪族，脂環族或芳脂族之基取代 [3]
- 1/62 與一個雜環取代之巰基 [3]
- 3/00 蔥環與一個或多個碳環稠合之染料**
- 3/02 苯并蔥醌類
- 3/04 由環之合成製備
- 3/06 由已含有苯并蔥醌環之原料製備
- 3/08 用鹵化作用
- 3/10 胺基衍生物
- 3/12 二苯并蔥醌基
- 3/14 茈衍生物
- 3/16 由環之合成製備
- 3/18 由已含有茈環之原料製備
- 3/20 用鹵化作用
- 3/22 二苯并蔥醌類；異二苯并蔥醌類
- 3/24 由環之合成製備
- 3/26 由二苯并蔥醌基
- 3/28 由茈衍生物
- 3/30 由已含有二苯并蔥醌或異二苯并蔥醌環之原料製備
- 3/32 用鹵化作用
- 3/34 用氧化作用
- 3/36 用羥基化合物之醚化作用
- 3/38 用在胺基中引入烴基或醯基
- 3/40 皮蔥醌類
- 3/42 由環之合成製備
- 3/44 由已含有皮蔥醌環原料製備
- 3/46 用鹵化作用
- 3/48 胺基衍生物
- 3/50 二苯并茈醌類
- 3/52 由環之合成製備
- 3/54 由已含有二苯并茈醌環之原料製備
- 3/56 胺基衍生物
- 3/58 苯并蔥醌類
- 3/60 蔥朶蔥醌類
- 3/62 由環之合成製備
- 3/64 由已含有蔥朶蔥醌類環之原料製備
- 3/66 用鹵化作用
- 3/68 胺基衍生物
- 3/70 苯并-，萘并-，蔥-，二蔥醌類
- 3/72 用環之合成製備
- 3/74 由已含有苯并-，萘并-，或蔥并-二蔥醌環之原料製備
- 3/76 由鹵化作用
- 3/78 其他染料，其中蔥環與一個或多個碳環稠合
- 3/80 用環之合成製備
- 3/82 由已含稠合蔥環之原料製備
- 5/00 具有一個蔥環與一個或多個雜**

	環稠合，與或未與碳環稠合的染料	5/60	• • • 噻吡；嘮吡
5/02	• 在迫位上稠合之雜環	5/62	• 蒽，苯并蒽，或芘系之迫位二羧酸之環亞胺及脒
5/04	• • 吡啶蒽酮類	6/00	以上未包括的蒽染料 [2]
5/06	• • • 苯并蒽酮-吡啶蒽酮縮合產物	7/00	靛類染料
5/08	• • • 二吡啶蒽酮類	7/02	• 雙吡啶靛藍類
5/10	• • 異噻啉蒽酮類；異嘮啉蒽酮類；異噻啉蒽酮類	7/04	• • 其鹵化作用
5/12	• • 噻吩蒽酮類	7/06	• 二氫茛酮-硫茛靛藍類
5/14	• • 苯并-氮雜苯并蒽酮類（蒽吡啶酮類）	7/08	• 其他吡啶-靛藍類
5/16	• • 苯并-二氮雜苯并蒽酮，如蒽啉啶酮	7/10	• 雙硫茛靛藍類
5/18	• • 萘并咕噸；萘并噻噸；萘并吡啶滿；及其衍生物	7/12	• 其他硫茛靛藍類
5/20	• • 黃烷土酮類	9/00	還原性染料之無色體之酯及酯-鹽類
5/22	• • • 由已含有黃烷土酮環之原料製備	9/02	• 蒽染料者
5/24	• 在 1,2 位或 2,3 位與一個蒽醌環稠合的雜環	9/04	• 靛類染料者
5/26	• • 蒽系之吡啶類	11/00	二芳基或三芳基甲烷染料
5/28	• • • 蒽醌亞胺吡啶	11/02	• 由二芳基甲烷而得者
5/30	• • 蒽系之 1,2 唑	11/04	• 由三芳基甲烷而得者
5/32	• • 蒽系之 1,3 唑	11/06	• • 三芳基甲烷之羥基衍生物，其中至少有一個羥基連接至芳族環上
5/34	• • 蒽醌吡啶酮類或硫雜蒽醌酮類	11/08	• • • 酞類
5/36	• • • 胺基吡啶酮	11/10	• • 三芳基甲烷之胺基衍生物
5/38	• • • 含有吡啶酮及吡啶環之化合物	11/12	• • • 無羥基與芳族環連接
5/40	• • • 苯并蒽酮-胺基蒽醌之縮合產物	11/14	• • • • 由芳族醛、芳族羧酸或其衍生物，及芳族胺製備
5/42	• • 吡啶并蒽醌類	11/16	• • • • 由二芳基酮或二芳基甲醇製備
5/44	• • 蒽系之吡啶類	11/18	• • • • 用氧化作用製備
5/46	• • • 對二吡	11/20	• • • • 由其他三芳基甲烷衍生物製備
5/48	• • • • 雙蒽醌二吡（陰丹酮）	11/22	• • • 含有連接至一個芳族環上之羥基
5/50	• • • • • 由 2-胺基蒽醌之鹼熔融製備	11/24	• • • 含有胺基之酞
5/52	• • • • • 由 1,2-鹵代胺基蒽醌之縮合製備	11/26	• • 三芳基甲烷染料，其中至少有一個芳族環係雜環
5/54	• • • • • 由 2-胺基蒽醌製備	11/28	• 二苯氧雜芑胺類
5/56	• • • • • 由已含有陰丹士林環之原料製備	13/00	羥基酮染料
5/58	• • • • • 用鹵化作用	13/02	• 萘系者，如萘茜
		13/04	• 芘系者
		13/06	• 苯乙酮系者

吡啶，吡啶，嘧啶及噻啶染料**15/00 吡啶染料****17/00 吡啶染料**

17/02 • 苯系者

17/04 • 萘系者

17/06 • 螢吡啶及其衍生物

19/00 嘧啶染料

19/02 • 由胺基醌製備之雙嘧啶染料

21/00 噻啶染料**噻啶及多次甲基染料****23/00 次甲基或多次甲基染料，例如菁染料**

23/01 • 以次甲基鏈為特徵者 [3]

23/02 • • 含有奇數之 CH 基 [3]

23/04 • • • 一個 CH 基，如菁、異菁、假菁 [3]

23/06 • • • 三個 CH 基，如羧花菁 [3]

23/08 • • • 多於三個 CH 基，如多羧花菁 [3]

23/10 • • 含有偶數之 CH 基 [3]

23/12 • 多次甲基鏈係分支者

23/14 • 苯乙烯基染料

23/16 • 多次甲基鏈含有雜原子

25/00 噻啶并醌酮類**26/00 脲染料；三氮烯染料 [3]**

26/02 • 脲染料（脲-偶氮染料見 56/18） [3]

26/04 • • 陽離子者 [3]

26/06 • 三氮烯染料（三氮烯-偶氮染料見 56/20） [3]

偶氮染料**附註**

於 27/00 至 46/00 目內的各種不同類型之偶氮染料之化學式中，箭頭表示用重氮化及偶合方法所製備的偶氮染料，一部分係

由重氮組成分產生者，一部分係由偶合組成分產生者。箭頭指向的部分係由偶合組成分產生者。 [4]

27/00 除用重氮化及偶合以外之任何方法生成偶氮基之偶氮染料

27/06 • 酒石黃 [3]

29/00 由重氮化及偶合製備之單偶氮染料

29/01 • 以重氮組成分為特徵者 [3]

29/02 • • 由重氮化之鄰-胺基-羥基化合物 [3]

29/03 • • 由重氮化之鄰-胺基羧酸或鄰-胺基-磺酸 [3]

29/033 • • 由含有一個雜環之重氮化的胺 [3]

29/036 • • • 僅含有氮作為雜原子之雜環 [3]

29/039 • • • 含有氮及硫作為雜原子之雜環 [3]

29/042 • • • • 雜環係噻唑環 [3]

29/045 • • • • 苯并噻唑 [3]

29/048 • • • • 雜環係硫雜重氮環 [3]

29/06 • 由含有胺基作為僅有的定向基之偶合組成分

29/08 • • 苯胺類

29/085 • • • 與重氮化之苯胺偶合 [3]

29/09 • • • 與含有雜環之重氮化之胺偶合 [3]

29/095 • • 胺基萘類 [3]

29/10 • 由含有羥基作為僅有的定向基之偶合組成分

29/12 • • 苯系者

29/14 • • • 羥基羧酸

29/15 • • 萘系者 [3]

29/16 • • • 萘酚-磺酸 [3]

29/18 • • 鄰-羥基碳醯胺

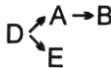
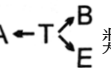
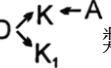
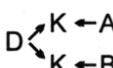
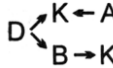
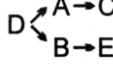
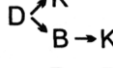
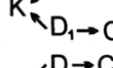
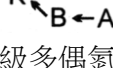
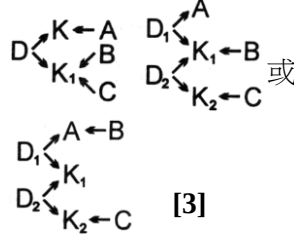
29/20 • • • 萘系者

29/22 • • • 雜環化合物者

29/24 • 由含有羥基及胺基兩個定向基之偶合組成分

- 29/26 · · 胺基苯酚類
- 29/28 · · 胺基萘酚類
- 29/30 · · · 胺基萘酚磺酸
- 29/32 · 由含有一個活性亞甲基之偶合組成分
- 29/33 · · 乙醯-或苯甲醯-乙醯芳基化物 [3]
- 29/34 · 由其他偶合組成分
- 29/36 · · 由雜環化合物
- 29/40 · · · 含有一個具有一個氮原子作為僅有的環雜原子之五元環 [3]
- 29/42 · · · 含有一個具有一個氮原子作為僅有的環雜原子之六元環 [3]
- 29/44 · · · · 喹啉或氫化喹啉 [3]
- 29/46 · · · 1,2-二唑或氫化 1,2-二唑 [3]
- 29/48 · · · · 胺基-1,2-二唑 [3]
- 29/50 · · · · 1,2-二唑酮 [3]
- 29/52 · · · 二吡 [3]
- 31/00 由重氮化及偶合製備的 $A \rightarrow B \rightarrow C$, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$, 等類型之雙偶氮及多偶氮染料**
- 31/02 · 雙偶氮染料
- 31/04 · · 由含有一個定向胺基之偶合組成分 “C”
- 31/043 · · · 苯胺類 [3]
- 31/047 · · · · 含有酸基, 例如 $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{OSO}_3\text{H}$, $-\text{OPO}_2\text{H}_2$ 或其鹽 [3]
- 31/053 · · · 胺基萘胺類 [3]
- 31/057 · · · · 含有酸基, 例如例如 $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{OSO}_3\text{H}$, $-\text{OPO}_2\text{H}_2$ 或其鹽 [3]
- 31/06 · · 由含有一個定向羥基之偶合組成分 “C”
- 31/062 · · · 酚類 [3]
- 31/065 · · · · 含有酸基, 例如 $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{OSO}_3\text{H}$, $-\text{OPO}_2\text{H}_2$ 或其鹽 [3]
- 31/068 · · · 萘酚類 [3]
- 31/072 · · · · 含有酸基, 例如 $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{OSO}_3\text{H}$, $-\text{OPO}_2\text{H}_2$ 或其鹽 [3]
- 31/075 · · · 鄰-羥基羧酸醯胺 [3]
- 31/078 · · · · 含有酸基, 例如 $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{OSO}_3\text{H}$, $-\text{OPO}_2\text{H}_2$ 或其鹽 [3]
- 31/08 · · 由含有定向羥基及胺基之偶合組成分 “C”
- 31/10 · · 由含有活性亞甲基之偶合組成分 “C”
- 31/11 · · · 乙醯-或苯甲醯-乙醯基芳基化物 [3]
- 31/12 · · 由其他偶合組成分 “C”
- 31/14 · · · 雜環化合物
- 31/143 · · · · 1,2-二唑 [3]
- 31/147 · · · · · 吡唑 [3]
- 31/15 · · · · 吡啶 [3]
- 31/153 · · · · 含有一個具有一個氮原子作為僅有之環雜原子之六元環 [3]
- 31/157 · · · · · 喹啉及氫化喹啉 [3]
- 31/16 · 三偶氮染料
- 31/18 · · 由含有一個定向胺基之偶合組成分 “D”
- 31/20 · · 由含有一個定向羥基之偶合組成分 “D”
- 31/22 · · 由含有一個定向羥基及胺基之偶合組成分 “D”
- 31/24 · · 由含有活性亞甲基之偶合組成分 “D”
- 31/26 · · 由其他偶合組成分 “D”
- 31/28 · · · 雜環化合物
- 31/30 · 其他多偶氮染料
- 33/00 由重氮化及偶合製備的 $A \rightarrow K \leftarrow B$, $A \rightarrow B \rightarrow K \leftarrow C$, 等類型之雙偶氮及多偶氮染料**
- 33/02 · 雙偶氮染料

- 33/04 . . . 其中偶合組成分係二羥基或多羥基化合物
- 33/044 . . . 偶合組成分係雙酚 [3]
- 33/048 . . . 偶合組成分係雙萘酚 [3]
- 33/052 . . . 偶合組成分係雙-(萘酚-胺) [3]
- 33/056 . . . 偶合組成分係雙-(萘酚-脲) [3]
- 33/06 . . . 其中偶合組成分係二元胺及多元胺
- 33/08 . . . 其中偶合組成分係羥基-胺基化合物
- 33/10 . . . 其中偶合組成分係胺基萘酚
- 33/12 . . . 其中偶合組成分係雜環化合物
- 33/13 . . . 偶合組成分係雙唑酮 [3]
- 33/147 . . . 其中偶合組成分係雙-(鄰-羥基羧酸醯胺) [3]
- 33/153 . . . 其中偶合組成分係雙-(乙醯-乙醯胺)或雙-(苯甲醯-乙醯胺) [3]
- 33/16 . . . 由其他偶合組成分
- 33/18 . . . 三偶氮或高級多偶氮染料
- 33/22 . . . $A \rightarrow B \rightarrow K \leftarrow C$ 類型之三偶氮染料 [3]
- 33/24 . . . $A \rightarrow K \begin{matrix} \nwarrow B \\ \swarrow C \end{matrix}$ 類型之三偶氮染料 [3]
- 33/26 . . . $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow K \leftarrow D$ 類型之四偶氮染料 [3]
- 33/28 . . . $A \rightarrow B \rightarrow K \leftarrow C \leftarrow D$ 類型之四偶氮染料 [3]
- 33/30 . . . $A \rightarrow K \begin{matrix} \nwarrow B \\ \swarrow C \end{matrix} \leftarrow D$ 類型之四偶氮染料 [3]
- 33/32 . . . $A \rightarrow K \begin{matrix} \nwarrow B \\ \swarrow C \end{matrix} \rightarrow D$ 類型之四偶氮染料 [3]
- 35/00 由重氮化及偶合製備的 $A \leftarrow D \rightarrow B$ 類型之雙偶氮或多偶氮染料**
- 35/02 . . . 雙偶氮染料
- 35/021 . . . 以兩種相同類型之偶合組成分為特徵者 [3]
- 35/023 . . . 其中偶合組成分係羥基或多羥基化合物 [3]
- 35/025 . . . 其中偶合組成分係胺基或多胺 [3]
- 35/027 . . . 其中偶合組成分係羥基-胺基化合物 [3]
- 35/029 . . . 胺基萘酚 [3]
- 35/03 . . . 其中偶合組成分係雜環化合物[3]
- 35/031 . . . 含有一個帶有一個氮原子作為僅有的環雜原子之六元環 [3]
- 35/033 . . . 其中偶合組成分係鄰-羥基-羧酸或 β -酮基-羧酸之芳香醯胺 [3]
- 35/035 . . . 其中偶合組含有活性亞甲基 [3]
- 35/037 . . . 以兩種不同類型之偶合組合為特徵者 [3]
- 35/039 . . . 以雙偶氮組成分為特徵者 [3]
- 35/04 . . . 雙偶氮組成分係苯衍生物 [3]
- 35/06 . . . 雙偶氮組成分係萘衍生物 [3]
- 35/08 . . . 雙偶氮組成分係聯苯衍生物 [3]
- 35/10 . . . 由兩種相同類型之偶合組成分 [3]
- 35/12 由胺 [3]
- 35/14 由羥基化合物 [3]
- 35/16 由羥基胺 [3]
- 35/18 由雜化合物 [3]
- 35/20 由兩種不同類型之偶合組成分 [3]
- 35/205 . . . 雙偶氮組成分係二芳基-或三芳基-鏈烷烴或-鏈烯烴之衍生物 [3]
- 35/21 二芳基甲烷或三芳基甲烷者 [3]
- 35/215 二芳基乙烷或二芳基乙烯者[3]
- 35/22 . . . 雙偶氮組成分係二芳基醚之衍生物 [3]
- 35/227 . . . 雙偶氮組成分係二芳基硫化物或二芳基多硫化物之衍生物 [3]
- 35/233 . . . 雙偶氮組成分係二芳基酮或

- 聯苯醌之衍生物 [3]
- 35/24 . . . 雙偶氮組成分係二芳基胺之衍生物 [3]
- 35/26 . . . 雙偶氮組成分係二芳基脲之衍生物 [3]
- 35/28 . . . 雙偶氮組成分含有兩個芳環，兩芳環由—CON<，—SO₂N<，—SO₂—，或—SO₂O—基中至少一個連接 [3]
- 35/30 由兩個相同的偶合組成分 [3]
- 35/32 由兩個不同的偶合組成分 [3]
- 35/34 . . . 雙偶氮組成分係雜環 [3]
- 35/35 . 三偶氮染料，其中雙偶氮組成分係二胺基-偶氮-芳基化合物 [3]
- 35/36 .  類型之三偶氮染料
- 35/362 . . D 係苯 [3]
- 35/364 . . D 係萘 [3]
- 35/366 . . D 係聯苯 [3]
- 35/368 . . D 係二芳基醚，二芳基硫化物或二芳基多硫化物 [3]
- 35/37 . . D 係二芳基胺 [3]
- 35/372 . . D 係二芳基脲 [3]
- 35/374 . . D 含有兩個芳環，此兩個芳環由—CON<，SO₂N<，—SO₂—，或 SO₂O—其中至少一個連接 [3]
- 35/376 . . D 係雜環化合物 [3]
- 35/378 .  類型之三偶氮染料 [3]
- 35/38 .  類型之三偶氮染料
- 35/40 . . 組成分 K 係二羥基或多羥基化合物
- 35/42 . . 組成分 K 係二元胺或多元胺
- 35/44 . . 組成分 K 係羥基胺
- 35/46 . . . 組成分係胺基萘酚
- 35/48 . . 組成分 K 係雜環
- 35/50 . 四偶氮染料
- 35/52 . .  類型者[3]
- 35/54 . .  類型者[3]
- 35/56 . .  類型者[3]
- 35/58 . .  類型者[3]
- 35/60 . .  類型者[3]
- 35/62 . .  類型者[3]
- 35/64 . 高級多偶氮染料，例如
-  [3]
- 37/00 重氮化的胺與其本身偶合製備之偶氮染料
- 39/00 由重氮化及偶合製備的其他偶氮染料
- 41/00 進行偶合反應之特殊方法
- 43/00 由其他偶氮化合物製備的偶氮染料
- 43/02 . 用磺化作用
- 43/04 . 用硝化作用
- 43/06 . 用氧化作用
- 43/08 . 用還原作用(脫胺基作用見 43/44)
- 43/10 . . 形成一個新之偶氮或一個氧化偶氮橋
- 43/11 . 於伯胺或仲胺基上，引進羥基或取代羥基(用還原形成胺基，例如硝基之還原見 43/08) [3]
- 43/12 . 用胺基之醯化作用
- 43/124 . . 用一元羧酸，胺基甲酸酯或鹵化物，單異氰酸鹽，或鹵化甲酸酯 [3]
- 43/128 . . . 脂肪族，脂環族或芳香脂肪族之酸 [3]
- 43/132 . . . 具有羧基直接連接到一個芳

- 族碳環上 [3]
- 43/136 • • 用多官能醯化劑 [3]
- 43/14 • • • 用光氣或硫光氣 [3]
- 43/145 • • • 用多元羧酸 [3]
- 43/15 • • • • 帶有鄰位-或迫位-二元羧酸之環狀亞胺之生成 [3]
- 43/155 • • • 用二-或多-異氰酸鹽 [3]
- 43/16 • • • 用三聚氰酸或三聚氰酸殘基將胺基偶氮化合物與其他胺基化合物鍵合 [3]
- 43/18 • 用羥基之醯化作用
- 43/20 • • 用一元羧酸，胺基甲酸酯或鹵化物，單異氰酸鹽或鹵代甲酸酯 [3]
- 43/22 • • • 具有羧基直接連接至一個芳族碳環上 [3]
- 43/24 • • 用 $-O-SO_2-R$ 或 $-O-SO_3H$ 基之生成 [3]
- 43/26 • • 用多官能之醯化劑 [3]
- 43/28 • 用羥基之醚化作用 [3]
- 43/30 • 用 $-COOH$ 或 $-SO_3H$ 基之酯化作用 [3]
- 43/32 • 用羥基或磺基或其衍生物，與胺反應，用酮基與胺反應 [3]
- 43/34 • • 由鄰-或迫-二羧基染料反應 [3]
- 43/36 • • 用胺基蒽或胺基蒽醌染料 [3]
- 43/38 • • 由兩個或更多個鄰羥基萘甲酸染料與多元胺反應 [3]
- 43/40 • 由含有其他雜原子基團取代雜原子
- 43/42 • • 由含有雜原子基團取代-CN 基 [3]
- 43/44 • 用胺基取代羥基或羥基取代胺基；醯-胺基脫醯作用；脫胺基作用 [3]
- 44/00 含有鎘基之偶氮染料 [3]**
- 44/02 • 含有不直接連接至偶氮基上之鎘基 [3]
- 44/04 • • 由含有羥基作為僅有的定向基之偶合組成分 [3]
- 44/06 • • 由含有羥基作為僅有的定向基之偶合組成分 [3]
- 44/08 • • 由含有雜環之偶合組成分 [3]
- 44/10 • 含有由環系之一個碳原子連接至一個偶氮基上的環鎘基 [3]
- 44/12 • • 具有一個氮原子作為僅有的環雜原子 [3]
- 44/14 • • 1,2-二唑或氫化 1,2-二唑 [3]
- 44/16 • • 1,3-二唑或氫化 1,3-二唑 [3]
- 44/18 • • 具有三個氮原子作為僅有之環雜原子 [3]
- 44/20 • • 噻唑或氫化噻唑 [3]
- 45/00 偶氮染料之錯合金屬化合物**
- 45/01 • 以金屬化之方法為特徵者 [3]
- 45/02 • 由在鄰位含有羥基與在次鄰位含有羥基，烷氧基，羧基，胺基或酮基之染料製備 [2]
- 45/04 • • 一般偶氮化合物
- 45/06 • • • 鉻化合物
- 45/08 • • • 銅化合物
- 45/10 • • • 鈷化合物
- 45/12 • • • 其他金屬化合物
- 45/14 • • 單偶氮化合物
- 45/16 • • • 含鉻
- 45/18 • • • 含銅
- 45/20 • • • 含鈷
- 45/22 • • • 含其他金屬
- 45/24 • • 雙偶氮或多偶氮化合物
- 45/26 • • • 含鉻
- 45/28 • • • 含銅
- 45/30 • • • 含鈷
- 45/32 • • • 含其他金屬
- 45/34 • 由在次鄰位上有一個原子或除羥基，烷氧基，羧基，胺基或酮基以外之官能團之鄰-單羥基偶氮化合物製備
- 45/36 • • 用於次鄰位上氫之氧化
- 45/38 • 由在相同環內或在迫位具有相鄰的 $-OH$ 及 $-COOH$ 之化合物製備
- 45/40 • • 鉻化合物
- 45/42 • • 銅化合物
- 45/44 • • 鈷化合物
- 45/46 • • 其他金屬化合物
- 45/48 • 由偶氮染料之其他錯合金屬化合物

物製備

46/00 未包括於 27/00 至 45/00 目內之偶氮染料 [2]**47/00 吡吩，吡吩吩**

- 47/04 • 酞菁類 [3]
- 47/06 • • 由羧酸或其衍生物製備 [3]
- 47/067 • • • 由酞二腈製備 [3]
- 47/073 • • 由異吡啶製備 [3]
- 47/08 • • 由其他酞菁化合物製備
- 47/10 • • • 獲得具有鹵原子直接連接至酞菁骨架上之化合物 [3]
- 47/12 • • • 獲得具有烷基，或由雜原子取代的烷基，連接至酞菁骨架上之化合物 [3]
- 47/14 • • • • 有由鹵原子取代之烷基[3]
- 47/16 • • • • 有由氮原子取代之烷基[3]
- 47/18 • • • 獲得具有氧原子直接連接至酞菁骨架上之化合物 [3]
- 47/20 • • • 獲得具有硫原子直接連接至酞菁骨架上之化合物 [3]
- 47/22 • • • 獲得具有氮原子直接連接至酞菁骨架上之化合物 [3]
- 47/24 • • • 獲得具有—COOH 或—SO₃H 基，或其衍生物，直接連接至酞菁基上之化合物 [3]
- 47/26 • • • • 醯胺基 [3]
- 47/28 • • 含有—S—SO₃H 基之酞菁染料 [3]
- 47/30 • • 不含金屬之酞菁 [3]
- 47/32 • • 陽離子之酞菁染料 [3]

48/00 噻吩吡啶酮**49/00 硫化染料**

- 49/02 • 由苯、萘或蒽系之硝基化合物
- 49/04 • 由苯、萘或蒽系之胺基化合物
- 49/06 • 由吡啶，嘧啶，噻吩或噻唑
- 49/08 • 由脲衍生物
- 49/10 • 由二苯胺，吡啶胺或噻吩
- 49/12 • 由其他化合物

50/00 甲腈染料；四唑染料 [3]

- 50/02 • 四唑染料

- 50/04 • 不含金屬之甲腈染料 [3]

- 50/06 • 雙甲腈染料 [3]

- 50/08 • 中-醯基甲腈染料 [3]

- 50/10 • 陽離子之甲腈染料 [3]

51/00 硝基及亞硝基染料**53/00 醯亞胺類**

- 53/02 • 吡啶胺類；醯胺類

55/00 偶氮甲鹼染料**56/00 含有其他發色體系之偶氮染料 [3]**

- 56/02 • 偶氮甲鹼-偶氮染料 [3]
- 56/04 • 對稱二苯代乙烯-偶氮染料 [3]
- 56/06 • • 雙-或多-對稱二苯代乙烯-偶氮染料[3]
- 56/08 • 苯乙炔基-偶氮染料 [3]
- 56/10 • 甲腈-偶氮染料 [3]
- 56/12 • 蒽醌-偶氮染料 [3]
- 56/14 • 酞菁-偶氮染料 [3]
- 56/16 • 次甲基或多次甲基-偶氮染料 [3]
- 56/18 • 脲-偶氮染料 [3]
- 56/20 • 三氮烯—偶氮染料 [3]

57/00 其他已知結構之合成染料

- 57/02 • 香豆素染料 [3]
- 57/04 • 異吡啶滿染料 [3]
- 57/06 • 萘并內醯胺染料 [3]
- 57/08 • 萘二甲醯胺染料；醯醯亞胺染料 [3]
- 57/10 • 於非錯合體中非為染料之有機化合物之金屬錯合物 [3]
- 57/12 • 迫位酮，即萘醯基烯-芳基-咪唑 [3]
- 57/14 • 苯并咕嗪染料；苯并噻嗪染料 [3]

59/00 未知結構之人造染料**61/00 由天然原料製備的天然來源之染料****62/00 活性染料，即與基質形成共價鍵或自身聚合之染料 [3]**

- 62/002 • 與交替給予的活性基團之連接[3]
- 62/004 • • 蒽染料 [3]

- 62/006 . . . 偶氮染料 [3]
 62/008 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/01 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/012 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/014 . . . 硝基染料 [3]
 62/016 . . . 吡吩；吡吩 [3]
 62/018 . . . 甲腈染料 [3]
 62/02 . . . 帶有直接連接至雜環上之活性基團
 62/022 . . . 交替地給予的雜環 [3]
 62/024 . . . 蔥染料 [3]
 62/026 . . . 偶氮染料 [3]
 62/028 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/03 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/032 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/034 . . . 硝基染料 [3]
 62/036 . . . 吡吩；吡吩
 62/038 . . . 甲腈染料 [3]
 62/04 . . . 連接至一個三吡環上
 62/06 . . . 蔥染料
 62/08 . . . 偶氮染料
 62/085 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/09 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/095 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/10 . . . 吡吩；吡吩
 62/12 . . . 連接至一個噻吡環上
 62/14 . . . 蔥染料
 62/16 . . . 偶氮染料
 62/165 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/17 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/175 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/18 . . . 吡吩；吡吩
 62/20 . . . 連接至一個噻吡環上
 62/22 . . . 蔥染料
 62/24 . . . 偶氮染料
 62/245 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/25 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/255 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/26 . . . 吡吩；吡吩
 62/28 . . . 連接至一個吡吡環上
 62/30 . . . 蔥染料
 62/32 . . . 偶氮染料
 62/325 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/33 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/335 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/34 . . . 吡吩；吡吩
 62/343 . . . 連接至一個五元環上 [3]
 62/345 . . . 蔥染料 [3]
 62/347 . . . 偶氮染料 [3]
 62/35 . . . 單偶氮染料
 62/353 . . . 雙偶氮或多偶氮染料
 62/355 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/357 . . . 吡吩；吡吩 [3]
 62/36 . . . 連接至其他某個雜環上
 62/38 . . . 蔥染料
 62/40 . . . 偶氮染料
 62/405 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/41 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/415 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/42 . . . 吡吩；吡吩
 62/44 . . . 帶有不直接連接至雜環上活性基團
 62/443 . . . 交替地給予的活性基團 [3]
 62/445 . . . 蔥染料 [3]
 62/447 . . . 偶氮染料 [3]
 62/45 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/453 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/455 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/457 . . . 吡吩；吡吩 [3]
 62/463 . . . 甲腈染料 [3]
 62/465 . . . 活性基團係一個丙烯醯基，一個季銨化之或非季銨化之胺基烷基羰基或一個 $(-N)_n-CO-A-O-X$ 或 $(-N)_n-CO-A-Hal$ 基團，其中 A 為烷撐或烷叉基，X 為氫或有機或無機酸之醯基，Hal 為鹵原子，n 為 0 或 1 [3]
 62/467 . . . 蔥染料 [3]
 62/47 . . . 偶氮染料 [3]
 62/473 . . . 單偶氮染料 [3]
 62/475 . . . 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
 62/477 . . . 金屬錯合偶氮染料 [3]
 62/483 . . . 吡吩；吡吩 [3]

- 62/485 · · · 活性基團係一個鹵素-環丁基-羰基、鹵素-環丁基-乙烯基-羰基或鹵素-環丁基-羰基 [3]
- 62/487 · · · 蔥染料 [3]
- 62/489 · · · 偶氮染料 [3]
- 62/491 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/493 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/495 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/497 · · · 吡吩；吡吩 [3]
- 62/503 · · 活性基團係一個酯化或未酯化之羧基磺基或巯基烷基磺基，一個季銨化或非季銨化之胺基烷基磺基，一個雜巯基烷基磺基，一個乙烯基磺基或取代之乙烯基磺基，或一個噻吩-二氧化物基團 [3]
- 62/505 · · · 蔥染料 [3]
- 62/507 · · · 偶氮染料 [3]
- 62/51 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/513 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/515 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/517 · · · 吡吩；吡吩 [3]
- 62/523 · · 活性基團係一個酯化或未酯化之羧基磺基或巯基烷基磺基，一個季銨化或非季銨化之胺基烷基磺基，或一個取代之烷基胺基磺基，或一個鹵代烷基磺基，或一個鹵代烷基胺基磺基，或一個乙烯基磺基或取代之乙烯基磺基 [3]
- 62/525 · · · 蔥染料 [3]
- 62/527 · · · 偶氮染料 [3]
- 62/53 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/533 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/535 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/537 · · · 吡吩；吡吩 [3]
- 62/54 · · 活性基團係環氧基或鹵代醇基 [3]
- 62/56 · · · 蔥染料
- 62/58 · · · 偶氮染料
- 62/585 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/59 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/595 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/60 · · · 吡吩；吡吩
- 62/62 · · 活性基團係一個乙撐亞胺或N-醯化之乙撐亞胺或一個—CO—NH—CH₂—CH₂—X基，其中X係鹵原子，季銨基或O-醯基與由有機酸或無機酸衍生的醯基，或β取代的乙胺基
- 62/64 · · · 蔥染料
- 62/66 · · · 偶氮染料
- 62/665 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/67 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/675 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/68 · · · 吡吩；吡吩
- 62/763 · · 活性基團係N-羥甲基或其O-衍生物 [3]
- 62/765 · · · 蔥染料 [3]
- 62/767 · · · 偶氮染料 [3]
- 62/77 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/773 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/775 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/777 · · · 吡吩；吡吩
- 62/78 · · 帶有其他活性基團
- 62/80 · · · 蔥染料
- 62/82 · · · 偶氮染料
- 62/825 · · · 單偶氮染料 [3]
- 62/83 · · · 雙偶氮或多偶氮染料 [3]
- 62/835 · · · 金屬錯合偶氮染料 [3]
- 62/84 · · · 吡吩；吡吩
- 色澱；媒染料；染料製備**
- 63/00 色澱**
- 65/00 含媒染劑之組合物**
- 67/00 無化學反應，例如用溶劑處理，對染料之物理性能（例如染或印）之影響；染料製備過程中之工藝特點，特殊物理形態之染料製備，例如片狀、膜狀**
- 67/02 · 以特殊物理形狀為特徵之染料製備，例如片狀、膜狀 [3]

67/04 • 研磨或碾磨 (67/14 優先) [3] 67/06
• 乾燥 [3]

67/08 • 塗層之細顆粒顏料或染料 [3]

67/10 • 用液體，例如溶劑處理對物理性質之影響 (67/14、67/18、67/20 優先) [3]

67/12 • • 酞菁染料者 [3]

67/14 • 用酸處理對物理性能之影響 [3]

67/16 • • 酞菁染料者 [3]

67/18 • 用胺處理對物理性能之影響 [3]

67/20 • 有機顏料之製備 [3]

67/22 • 不同顏料或染料之混合或顏料或染料之固體溶液 [3]

67/24 • 酸性染料或活性染料之製備 [3]

67/26 • • 以液體產品 [3]

67/28 • 還原或硫化染料之製備 [3]

67/30 • • 以液體產品 [3]

67/32 • 陽離子或鹼性染料之製備 [3]

67/34 • • 以液體產品 [3]

67/36 • 偶氮染料之製備 [3]

67/38 • 分散染料之製備 [3]

67/40 • • 以液體產品 [3]

67/42 • 於 67/24 至 67/40 單一目內不包括的染料製備 [3]

67/44 • • 溶解液 [3]

67/46 • • 分散液 [3]

67/48 • 顏料或染料結晶之調整 (62/42 優先) [3]

67/50 • • 酞菁染料者 [3]

67/52 • • 喹吖啶酮者 [3]

67/54 • 分離；純化 (67/06、67/10 優先) [3]

69/00 此次類之單一目不包括的染料 [2]

69/02 • 染料之鹽，例如酸性染料與鹼性染料之鹽 [3,2006.01]

69/04 • • 帶有含氮化合物之陰離子染料者 [3]

69/06 • • 帶有有機酸之陽離子染料者 [3]

69/08 • 含有一種易分裂的水溶性基之染料 [3]

69/10 • 高分子之染料；染料與單體或高分子化合物之反應產物 [3]

C09C 纖維狀填料以外的無機材料之處理以增強其著色或填充性能（專門適用於增強其於砂漿，混凝土，人造石或類似物質內填充性能之材料處理見 C04B 14/00、18/00、20/00）；**碳黑之製備** [4]

附註

此次類，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示，化合物請放入最後適當位置。

1/00 纖維狀填料以外的特殊無機材料之處理（變色螢光材料見 C09K 9/00；發光材料見 C09K 11/00）；**碳黑之製備**[1,2006.01]

1/02 · 鹼土金屬或鎂之化合物

1/04 · 鋅之化合物

1/06 · · 鋅鋇白

1/08 · · 鉻酸鋅

1/10 · 鎘之化合物

1/12 · · 碲化鎘

1/14 · 鉛之化合物

1/16 · · 鉛白

1/18 · · 鉛丹

1/20 · · 鉻酸鉛

1/22 · 鐵之化合物

1/24 · · 鐵之氧化物

1/26 · · 鐵藍

1/28 · 矽之化合物

1/30 · · 矽酸

1/32 · · 群青

1/34 · 鉻之化合物

1/36 · 鈦之化合物

1/38 · 汞之化合物

1/40 · 鋁之化合物

1/42 · · 黏土（黏土器皿預處理見 C04B 33/04）[1,2006.01]

1/44 · 碳

1/46 · · ~~石墨（石墨之製備見 C01B 32/205）~~ [1,2006.01]

1/48 · · 碳黑

1/50 · · · 爐法碳黑

1/52 · · · 槽法碳黑

1/54 · · · 乙炔黑；熱法碳黑

1/56 · · · 碳黑之處理

1/58 · · · · 用濕法成團，造粒等等

1/60 · · · · 用乾法成團，造粒等等

1/62 · 金屬顏料或填料（~~為獲得金屬粉末；見所用方法之相關類，如 B22F 9/00、C21B 15/02、C22B 5/20、C25C 5/00）~~ [1,2006.01]

1/64 · · 鋁

1/66 · · 銅合金，如青銅

1/68 · 鬆散的磨料粒子

3/00 除纖維狀填料以外之無機材料之一般處理以增強其著色或填充性能（~~其他高分子粒子之染色見 C08J 3/20；高分子纖維之染色見 D06P）~~ [1,2006.01]

3/04 · 物理處理，如研磨，用超音波振動處理 [2]

3/06 · 用無機化合物處理 [2]

3/08 · 用低分子有機化合物處理 [2]

3/10 · 用高分子有機化合物處理 [2]

3/12 · 用有機矽化合物處理 [2]

C09D 塗料組合物；例如色漆、清漆或天然漆；補土；化學塗料或油墨之去除劑；油墨；修正液；木材著色劑；用於著色或印刷之漿料或固體；

該等材料之使用（化妝品見 A61K；一般將液體或其它流動物料塗至表面上之方法見 B05D；木材著色見 B27K 5/02；釉或玻璃搪瓷見 C03C；天然樹脂、蟲膠清漆、乾性油、催乾劑、松節油本身見 C09F；除蟲膠清漆以外之拋光組合物，滑雪履蠟見 C09G；動物膠或明膠之製備見 C09H；黏合劑或用作黏合劑之物質見 C09J；用於接頭或蓋之密封或包裝之材料見 C09K 3/10；用於防止洩漏之材料見 C09K 3/12；電解或電泳生成鍍層之方法見 C25D）[5]

附註

- (1) 於本次類內，下列名詞或術語意指：
 - “塗料組合物之物質的使用”意指已知或新的聚合物或產物之使用；
 - “橡膠”包含：
 - (a) 天然橡膠或共軛二烯橡膠；
 - (b) 一般橡膠（對於一種特橡膠，除天然橡膠或共軛二烯橡膠外，見包含基於此高分子化合物之塗料組合物之目）；
 - “基於”係利用以下附註(3)所限定者；
 - “補土”係指塗覆以前為使基材者面平滑而用以填洞或坑之材料。[5]
- (2) 於本次類內，含有指明的有機高分子的物質之塗料組合物僅根據該高分子物質分類，非高分子物質則不予考慮。
 例如：一種含聚乙烯及胺基—丙基三甲氧基矽烷之塗料組合物分入 123/06 目內，但是，含至少帶有一個可聚合的碳—碳不飽和鍵之有機非高分子化合物與除 159/00 至 187/00 目之不飽和聚合物以外的預聚物或聚合物組合之塗料組合物，則依據該不飽和的非高分子成分分入 4/00 目內。
 例如：一種含有聚乙烯及苯乙烯單體之塗料組合物分入 4/00 目。若清楚並明確地指出係涉及 5/00 目內所限定的塗料組合物之物理性質或其產生的效果方面，亦分入本次類內。除高分子成分被限定者外，以其它性能例如添加劑為特徵之塗料組合物分入 7/00 目內。[5]
- (3) 於本次類內，含兩個或更多高分子成分之塗料組合物請依據主成分規則分類。如該組合物係以相同比例存在之兩種或多種成分為基礎，則以此等組成分之每一種分類。
 例如：一種含有 80 份聚乙烯及 20 份聚氯乙烯之塗料組合物分入 123/06 目內。
 一種含有 40 份聚乙烯及 40 份聚氯乙烯之塗料組合物分入 123/06 及 127/06 目內。[5]

次類索引

塗料組合物，例如色漆、清漆、天然漆
 基於無機物者 1/00
 基於有機高分子物質者 101/00 至 201/00
 基於至少帶有一個可聚合的碳—碳
 不飽和鍵之有機非高分子化合物者 4/00
 物理性質或所產生之效果，
 包括用作補土 5/00
 其他特徵 7/00
 油墨 11/00

木材著色劑 15/00
 化學塗料或油墨之去除劑 9/00
 修正液 10/00
 用於著色或印刷之漿料或固體
 鉛筆蕊、顏色鉛筆組合物、粉筆
 組合物 13/00
 顏料漿 17/00

1/00 基於無機物質之塗料組合物，例如色漆、清漆或天然漆 [1,2006.01]	裝飾效果者 5/29 • 用於多色效果者 [2] 5/30 • 偽裝塗料
1/02 • 鹼金屬矽酸鹽	5/32 • 吸收輻射之塗料
1/04 • • 帶有機添加劑	5/33 • 反射輻射之塗料（5/30 優先）[4]
1/06 • 水泥	5/34 • 補土（用於接頭或蓋之密封或包裝之材料見 C09K 3/10，用於阻止洩漏之材料見 C09K 3/12）
1/08 • • 帶有機添加劑	5/36 • 珠光粉，例如，含珍珠色澤片狀色素之塗料
1/10 • 石灰	5/38 • 未包括於 5/00 至 5/36 目內的游離金屬之塗料 [2]
1/12 • • 帶有機添加劑	5/44 • 用於電泳者（5/46 優先；電泳鍍層方法見 C25D 13/00）[4]
4/00 基於至少具有一個可聚合的碳—碳不飽和鍵之非高分子有機化合物之塗料組合物，例如色漆、清漆或天然漆 [5]	5/46 • 用於火焰噴塗者；用於靜電或旋轉燒結塗層者 [4]
4/02 • 丙烯醯基單體 [5]	7/00 特徵未包括於 5/00 目內之塗料組合物（催乾劑見 C09F 9/00）；將配料混合入塗料組合物之方法[1,2006.01,2018.01]
4/04 • • 腈基丙烯酸酯單體 [5]	7/02 (轉見 7/45)
4/06 • 與除 159/00 至 187/00 目的不飽和聚合物以外之高分子化合物組合 [5]	7/04 (轉見 7/46)
5/00 以其物理物質或所產生的效果為特徵之塗料組合物，例如色漆、清漆或天然漆；補土 [5]	7/06 (轉見 7/47)
5/02 • 乳膠漆	7/12 (轉見 7/40 - 7/44，7/48 - 7/65)
5/03 • 粉末塗料（5/46 優先）[4]	7/14 (轉見 7/80)
5/04 • 觸變塗料	7/20 • 稀釋劑或溶劑 [2018.01]
5/06 • 美術用塗料	7/40 • 添加劑 [2018.01]
5/08 • 抗腐蝕塗料	7/41 • • 有機顏料；有機染料[2018.01]
5/10 • • 含金屬粉末者	7/42 • • 消光劑 [2018.01]
5/12 • • 洗滌底漆	7/43 • • 增稠劑 [2018.01]
5/14 • 含殺菌劑之塗料，例如，殺真菌劑、殺昆蟲劑或殺蟲劑（5/16 優先）[6]	7/44 • • • 兩種或多種增稠劑的組合 [2018.01]
5/16 • 防污塗料；水下塗料 [6]	7/45 • • 抗沉降劑 [2018.01]
5/18 • 防火塗料	7/46 • • 抗結皮劑 [2018.01]
5/20 • 可剝離性塗料，例如，可暫時性剝離之塗料	7/47 • • 均染劑 [2018.01]
5/22 • 發光塗料	7/48 • • 防止透過氧、光或熱降解的穩定劑 [2018.01]
5/23 • 可磁化或磁性的塗料或清漆 [2]	7/60 • • 非高分子的（7/41 – 7/48 優先）[2018.01]
5/24 • 導電塗料	7/61 • • • 無機物 [2018.01]
5/25 • 電絕緣塗料或清漆 [2]	7/62 • • • • 用其他化合物處理改性 [2018.01]
5/26 • 熱敏塗料	
5/28 • 用於起皺、裂紋狀、桔皮或類似	

- 7/63 . . . 有機物 [2018.01]
- 7/65 . . 高分子的 (7/41 – 7/48 優先) [2018.01]
- 7/80 . 混合配料之方法 [2018.01]
- 9/00 化學塗膜或油墨之去除劑** (經由塗覆以改正印刷錯誤之液體介質見 10/00) [4]
- 9/02 . 帶有磨料者
- 9/04 . 帶有界面活性劑者
- 10/00 修正液，例如經由塗覆以改正印刷錯誤之液體介質** [5]
- 11/00 油墨** [1, 2014.01]
- 11/02 . 印刷油墨 (11/30 優先) [2014.01]
- 11/023 . . 乳劑油墨 [2014.01]
- 11/0235 . . . 複製油墨，例如，模板印刷用 [2014.01]
- 11/03 . . 以黏合劑化學本性以外的特性為特徵 [2014.01]
- 11/033 . . . 以溶劑為特徵 [2014.01]
- 11/037 . . . 以顏料為特徵 [2014.01]
- 11/04 . . 以蛋白質為主者
- 11/06 . . 以油脂為主者
- 11/08 . . 以天然樹脂為主者
- 11/10 . . 以人造樹脂為主者 [1, 2014.01]
- 11/101 . . . 特別適用於印刷過程涉及波能或粒子輻射硬化的油墨，例如，在印刷後以紫外線硬化 [2014.01]
- 11/102 . . . 包含除僅涉及碳—碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物 [2014.01]
- 11/103 醛的，例如，酚—甲醛樹脂 [2014.01]
- 11/104 聚酯 [2014.01]
- 11/105 醇酸樹脂 [2014.01]
- 11/106 . . . 包含僅涉及碳—碳不飽和鍵之反應而得的高分子化合物 [2014.01]
- 11/107 由不飽和酸或其衍生物 [2014.01]
- 11/108 烴類樹脂 [2014.01]
- 11/12 . . 以蠟或瀝青為主者
- 11/14 . . 以碳水化合物為主者
- 11/16 . 書寫油墨水 [1, 2014.01]
- 11/17 . . 以著色劑為特徵 [2014.01]
- 11/18 . . 用於原子筆者
- 11/20 . . 無法消除的油墨
- 11/30 . 噴墨印刷油墨 [2014.01]
- 11/32 . . 以著色劑為特徵 [2014.01]
- 11/322 . . . 顏料油墨 [2014.01]
- 11/324 含碳黑 [2014.01]
- 11/326 以顏料分散劑為特徵 [2014.01]
- 11/328 . . . 以染料為特徵 [2014.01]
- 11/34 . . 熱熔墨 [2014.01]
- 11/36 . . 以非水溶劑為主者 [2014.01]
- 11/38 . . 以溶劑以外的非高分子添加物為特徵，例如，顏料或染料 [2014.01]
- 11/40 . . 特別適用於多色噴墨印刷的油墨組 [2014.01]
- 11/50 . 隱形、變色或類似油墨 [2014.01]
- 11/52 . 導電油墨 [2014.01]
- 11/54 . 以兩種液體為主的油墨，一種液體是油墨，另一種液體是油墨的反應液、定影液或處理液 [2014.01]
- 13/00 鉛筆芯；蠟筆成份；粉筆成份**
- 15/00 木材著色劑** [2]
- 17/00 顏料漿料，如用於混入塗料之內者** [2]
- 基於多糖類或其衍生物之塗料組合物** [5]
- 附註**
- (1) 於 101/00 至 201/00 目內，塗料組合物的任何高分子組成分，按照 C09D 次類類名後的附註 (3) 的分類不能被確定，而其使用是新穎的和非顯而易見的，也可以分類至 101/00 至 201/00

中的一個目中。[8]

- (2) 塗料組合物的任何高分子組成分，按照 C09D 次類類名後的附註(3)或上述的附註(1)的分類不能被確定時，而該成分被認為代表了對檢索重要的資訊，也可以分類至 101/00 至 201/00 目中。例如，使用分類號組合對於檢索塗料組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為“附加資訊”給出。[8]

101/00 基於纖維素、改性纖維素或纖維素衍生物之塗料組合物 [5]

- 101/02 · 纖維素；改性纖維素 [5]
- 101/04 · · 氧化纖維素；水解纖維素 [5]
- 101/06 · · 水合纖維素 [5]
- 101/08 · 纖維素衍生物 [5]
- 101/10 · · 有機酸酯(具有有機酸和無機酸兩者見 101/20) [5]
- 101/12 · · · 乙酸纖維素 [5]
- 101/14 · · · 混合酯，例如乙酸-丁酸纖維素 [5]
- 101/16 · · 無機酸酯(具有有機酸和無機酸兩者見 101/20) [5]
- 101/18 · · · 硝酸纖維素 [5]
- 101/20 · · 有機酸及無機酸兩者之酯 [5]
- 101/22 · · 黃原酸纖維素 [5]
- 101/24 · · · 黏膠 [5]
- 101/26 · · 纖維素醚 [5]
- 101/28 · · · 烷基醚 [5]
- 101/30 · · · 芳基醚；芳烷基醚 [5]
- 101/32 · · 纖維素醚-酯 [5]

103/00 基於澱粉、直鏈澱粉、支鏈澱粉、其衍生物或降解產物之塗料組合物 [5]

- 103/02 · 澱粉；其降解產物，例如糊精 [5]
- 103/04 · 澱粉衍生物 [5]
- 103/06 · · 酯類 [5]
- 103/08 · · 醚類 [5]
- 103/10 · · 氧化澱粉 [5]

103/12 · 直鏈澱粉；支鏈澱粉；其降解產物 [5]

103/14 · 直鏈澱粉衍生物；支鏈澱粉衍生物 [5]

103/16 · · 酯類 [5]

103/18 · · 醚類 [5]

103/20 · · 氧化直鏈澱粉，氧化支鏈澱粉 [5]

105/00 基於 101/00 或 103/00 目不包括的多糖類或其衍生物之塗料組合物 [5]

- 105/02 · 葡聚糖；其衍生物 [5]
- 105/04 · 藻酸；其衍生物 [5]
- 105/06 · 果膠；其衍生物 [5]
- 105/08 · 幾丁質；硫酸軟骨素；玻尿酸；其衍生物 [5]
- 105/10 · 肝素；其衍生物 [5]
- 105/12 · 瓊脂；其衍生物 [5]
- 105/14 · 半纖維素；其衍生物 [5]
- 105/16 · 環糊精；其衍生物 [5]

基於橡膠或其衍生物之塗料組合物 [5]

107/00 基於天然橡膠之塗料組合物 [5]

- 107/02 · 膠乳 [5]

109/00 基於共軛二烯烴之均聚物或共聚物的塗料組合物 [5]

- 109/02 · 與丙烯腈之共聚物 [5]
- 109/04 · · 膠乳 [5]
- 109/06 · 與苯乙烯之共聚物 [5]
- 109/08 · · 膠乳 [5]
- 109/10 · 膠乳 (109/04、108/08 優先) [5]

111/00 基於氯丁二烯之均聚物或共聚物之塗料組合物 [5]

- 111/02 · 膠乳 [5]

113/00 基於含羧基橡膠之塗料組合物 [5]

- 113/02 · 膠乳 [5]

115/00 基於橡膠衍生物的塗料組合物 (111/00、113/00 優先) [5]

115/02 · 含鹵素之橡膠衍生物 [5]

117/00 基於再生橡膠之塗料組合物 [5]

119/00 基於 107/00 至 117/00 目不包括的橡膠之塗料組合物 [5]

119/02 · 膠乳 [5]

121/00 基於未指明的橡膠之塗料組合物 [5]

121/02 · 膠乳 [5]

僅基於由碳-碳不飽和鍵反應而得的有機高分子化合物之塗料組合物 [5]

附註

(1) 在 123/00 至 149/00 目中，“脂族基”指無環或非芳香族環骨架，它以下列一種連接為終端：[8]

(a)與碳以外的一個元素連接；[8]

(b)與一個碳以外的原子相連的有雙鍵的碳原子連接；[8]

(c)與一個芳香族碳環或一個雜環鍵接。[8]

(2) 在 123/00 至 149/00 目中，若無相反指示，共聚物按其重要單體組成成分來分類。[8]

123/00 基於僅有一個碳-碳雙鍵之不飽和脂族烴的均聚物或共聚物之塗料組合物；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

123/02 · 未經化學後處理改性的 [5]

123/04 · · 乙烯之均聚物或共聚物 [5]

123/06 · · · 聚乙烯 [5]

123/08 · · · 乙烯之共聚物（123/16 優先）[5]

123/10 · · 丙烯之均聚物或共聚物 [5]

123/12 · · · 聚丙烯 [5]

123/14 · · · 丙烯之共聚物（123/16 優先）[5]

123/16 · · 乙烯-丙烯或乙烯-丙烯-二烯之共聚物 [5,2006.01]

123/18 · · 有四個或更多個碳原子之烴的均聚物或共聚物 [5]

123/20 · · · 有四至九個碳原子者 [5]

123/22 · · · 異丁烯之共聚物；丁基橡膠 [5]

123/24 · · · 有十個或更多個碳原子者[5]

123/26 · 經化學後處理改性者 [5]

123/28 · · 由與鹵素或含鹵素化合物反應（123/32 優先）[5]

123/30 · · 由氧化 [5]

123/32 · · 由與含磷或含硫化合物反應[5]

123/34 · · · 由氯磺化作用 [5]

123/36 · · 由與含氮化合物反應，例如由硝化作用 [5]

125/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少一個係以芳族碳環為終端；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

125/02 · 烴之均聚物或共聚物 [5]

125/04 · · 苯乙烯之均聚物或共聚物 [5]

125/06 · · · 聚苯乙烯 [5]

125/08 · · · 苯乙烯之共聚物（129/08、135/06、155/02 優先）

125/10 · · · · 與共軛二烯 [5]

125/12 · · · · 與不飽和腈 [5]

125/14 · · · · 與不飽和酯 [5]

125/16 · · 烷基取代苯乙烯之均聚物或共聚物 [5]

125/18 · 含有除碳及氫之外元素之芳族單體的均聚物或共聚物 [5]

127/00 基於有一個或多個不飽和脂族基之化合物的均聚物或共聚物之塗料組合物，其中每個不飽和脂族基只有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以鹵素為終

端；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 127/02 · 未由化學後處理改性者 [5]
- 127/04 · · 含氯原子者 [5]
- 127/06 · · · 氯乙烯之均聚物或共聚物[5]
- 127/08 · · · 1,1-氯乙烯之均共聚物或共聚物 [5]
- 127/10 · · 含溴或碘原子者 [5]
- 127/12 · · 含氟原子者 [5]
- 127/14 · · · 氟乙烯之均聚物或共聚物[5]
- 127/16 · · · 1,1-二氟乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/18 · · · 四氟乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/20 · · · 六氟丙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/22 · 由化學後處理改性者 [5]
- 127/24 · · 鹵化者 [5]

129/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以醇、醚、醛、酮、醛縮醇或酮縮醇基為終端；基於不飽和醇與飽和羧酸之酯的水解聚合物之塗料組合物；基於此種聚合物衍生物的塗料組合物 [5]

- 129/02 · 不飽和醇之均聚物或共聚物（129/14 優先） [5]
- 129/04 · · 聚乙烯醇；不飽和醇與飽和羧酸之酯的部分水解之均聚物或共聚物 [5]
- 129/06 · · 烯丙醇之共聚物 [5]
- 129/08 · · · 與乙烯基芳族單體 [5]
- 129/10 · 不飽和醚之均聚物或共聚物（135/08 優先） [5]
- 129/12 · 不飽和酮之均聚物或共聚物 [5]
- 129/14 · 由不飽和醛縮醇或酮縮醇聚合、或由不飽和醇聚合物經後處理而得的醛縮醇或酮縮醇之均聚物或

共聚物 [5]

131/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以飽和羧酸，碳酸或鹵甲酸之酸基為終端；基於此種聚合物的衍生物的塗料組合物 [5]

- 131/02 · 一元羧酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/04 · · 乙酸乙烯酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/06 · 多元羧酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/08 · · 苯二甲酸者 [5]

133/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係僅以一個羧基或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或脛為終端；基於此種聚合物之衍生物之塗料組合物 [5]

- 133/02 · 酸之均聚物或共聚物；其金屬鹽或銨鹽 [5]
- 133/04 · 酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/06 · · 僅含有碳、氫及氧之酯，而氧原子僅作為羧基部分存在 [5]
- 133/08 · · · 丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/10 · · · 甲基丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/12 · · · · 甲基丙烯酸甲酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/14 · · 含有鹵、氮、硫或除羧基氧之外氧原子的酯 [5]
- 133/16 · · · 含鹵原子之酯的均聚物或共聚物 [5]
- 133/18 · 脛之均聚物或共聚物 [5]
- 133/20 · · 丙烯脛之均聚物或共聚物

- (155/02 優先) [5]
- 133/22 · · 含有四個或更多個碳原子之腈的均聚物或共聚物 [5]
- 133/24 · 醯胺或醯亞胺之均聚物或共聚物 [5]
- 133/26 · · 丙烯醯胺或甲基丙烯醯胺之均聚物或共聚物 [5]
- 135/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以羧基為終端，且於分子內至少含有另一個羧基，或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或腈；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]
- 135/02 · 酯之均聚物或共聚物 (135/06、135/08 優先) [5]
- 135/04 · 腈之均聚物或共聚物 (135/06、135/08 優先) [5]
- 135/06 · 與乙烯基芳族單體之共聚物 [5]
- 135/08 · 與乙烯基醚之共聚物 [5]
- 137/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以含氧之雜環為終端（基於多官能酸之環酯的聚合物見 131/00；基於不飽和酸的環酐的聚合物見 135/00）；基於此種聚合物之衍生物的塗料組合物 [5]
- 139/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物之塗料組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以連接氮之單鍵或雙鍵、或以含氮雜環作為終端；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]
- 139/02 · 乙烯胺之均聚物或共聚物 [5]
- 139/04 · 含有以氮為環原子之雜環單體之均聚物或共聚物 [5]
- 139/06 · · N-乙烯基吡咯烷酮之均聚物或共聚物 [5]
- 139/08 · · 乙烯基吡啶之均聚物或共聚物 [5]
- 141/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以連接硫之鍵或以含硫雜環作為終端；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]
- 143/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物的塗料組合物，每個脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且含有硼、矽、磷、硒、碲或金屬；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]
- 143/02 · 含磷單體的均聚物或共聚物 [5]
- 143/04 · 含矽單體的均聚物或共聚物 [5]
- 145/00** 基於在側鏈上無不飽和脂族基，而於碳環或雜環系內有一個或多個碳-碳雙鍵之聚合物的均聚物或共聚物之塗料組合物；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物（基於多官能酸之環酯的聚合物見 131/00；基於環酐或環醯亞胺之聚合物見 135/00） [5]
- 145/02 · 苯并呋喃-茚聚合物 [5]
- 147/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之塗料組合物，至少有一個不飽和脂族基有兩個或多個碳-碳雙鍵；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 (145/00 優先；基於共軛二烯烴橡膠見 109/00 至 121/00) [5]

149/00 基於有一個或多個碳-碳三鍵化合物之均聚物或共聚物之塗料組合物；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

151/00 基於接枝聚合物之塗料組合物，其中接枝成分是只由包括碳-碳不飽和鍵反應而得者（基於ABS 聚合物者見 155/02）；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

151/02 · 接枝至多糖類上 [5]

151/04 · 接枝至橡膠上 [5]

151/06 · 接枝至僅含有一個碳-碳雙鍵之酯族烴的均聚物或共聚物上 [5]

151/08 · 接枝至由僅包括碳-碳不飽和鍵的反應之外而得的高分子化合物上 [5]

151/10 · 接枝至無機物上 [5]

153/00 基於嵌段共聚物之塗料組合物，該共聚物至少有一個聚合物鏈區係僅由包括碳-碳不飽和鍵之反應而得者；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

153/02 · 乙烯基芳族單體與共軛二烯烴 [5]

155/00 基於與由包括碳-碳不飽和鍵之聚合反應得者，而於 123/00 至 153/00 目內不包括的均聚物或共聚物之塗料組合物 [5]

155/02 · ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) 聚合物 [5]

155/04 · 由二烯烴合成而得至的加聚物 [5]

157/00 基於僅由涉及碳-碳不飽和鍵反應而得的未指明聚合物之塗料組合物 [5]

157/02 · 礦物油烴類之共聚物 [5]

157/04 · 僅確定其中少數單體之共聚物 [5]

157/06 · 含有除碳及氫以外元素之均聚物或共聚物 [5]

157/08 · · 含鹵原子者 [5]

157/10 · · 含氧原子者 [5]

157/12 · · 含氮原子者 [5]

基於由碳-碳不飽和鍵以外之反應而得的有機高分子化合物之塗料組合物 [5]

159/00 基於聚縮醛類之塗料組合物；基於聚縮醛類衍生物之塗料組合物 [5]

159/02 · 僅含聚甲醛鏈區之聚縮醛類 [5]

159/04 · 共聚甲醛類 [5]

161/00 基於醛或酮之縮聚物的塗料組合物（與多元醇類者見 159/00；與多元腈類者見 177/00）；基於此種聚合物之衍生物之塗料組合物 [5]

161/02 · 僅係醛或酮之縮聚物 [5]

161/04 · 僅係醛或酮與酚之縮聚物 [5]

161/06 · · 醛與酚者 [5]

161/08 · · · 與一元酚 [5]

161/10 · · · · 苯酚-甲醛縮合物 [5]

161/12 · · · 與多元酚 [5]

161/14 · · · 改性的酚-醛縮合物 [5]

161/16 · · 酮與酚者 [5]

161/18 · 僅係醛或酮與芳烴或其鹵素衍生物之縮聚物 [5]

161/20 · 醛或酮僅與含有氮連有氫化合物之縮聚物（與胺基酚類者見 161/04） [5]

161/22 · · 醛與無環或碳環化合物者 [5]

161/24 · · · 與脲或硫脲 [5]

161/26 · · 醛與雜環化合物者 [5]

161/28 · · · 與三聚氰胺 [5]

161/30 · · 醛與雜環及無環或碳環化合物者 [5]

161/32 · · 改性的胺-醛縮合物 [5]

161/34 · 醛或酮與至少包括於 161/04、161/18 及 161/20 兩個目內的單體

的縮聚物 [5]

163/00 基於環氧樹脂之塗料組合物；基於環氧樹脂衍生物的塗料組合物 [5]

- 163/02 · 雙酚之聚縮水甘油醚類 [5]
- 163/04 · 線型酚醛環氧樹脂 [5]
- 163/06 · 三縮水甘油基異三聚氰酸酯 [5]
- 163/08 · 環氧化聚合多烯 [5]
- 163/10 · 由不飽和化合物改性的環氧樹脂 [5]

附註

於 165/00-185/00 目內，若無相反指示時，基於由主鏈中形成兩種不同鍵合的反應而得之高分子化合物的塗料組合物，僅按照量多的鍵分類。

165/00 基於由主鏈中形成碳-碳鍵之反應得至的高分子化合物之塗料組合物（107/00-157/00、161/00 優先）；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 165/02 · 聚亞苯基 [5]
- 165/04 · 聚亞二甲苯基 [5]

167/00 基於由主鏈中形成一個羧酸酯鍵之反應而得之聚酯之塗料組合物（基於聚酯-醯胺者見 177/12；基於聚酯-醯亞胺者見 179/08）；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 167/02 · 由二羧基與二羥基化合物衍生的聚酯（167/06 優先）[5]
- 167/03 · · 由羥基及羧基直接連接至芳環上而成的二羧基與二羥基化合物 [5]
- 167/04 · 由羥基羧酸衍生的聚酯，如內酯（167/06 優先）[5]
- 167/06 · 具有碳-碳不飽和部分之不飽和聚酯 [5]
- 167/07 · · 具有碳-碳不飽和鍵終端者 [5]

167/08 · 用高級脂肪油或其酸、或用天然樹脂或樹脂酸改性的聚酯

169/00 基於聚碳酸酯之塗料組合物；基於聚碳酸酯衍生物之塗料組合物 [5]

171/00 基於由主鏈中形成醚鍵反應而得的聚醚之塗料組合物（基於聚縮醛者見 159/00；基於環氧樹脂者見 163/00；共於聚硫醚-醚者見 181/02；基於聚醚砜者見 181/06）；基於此聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 171/02 · 聚烯化氧 [5]
- 171/03 · · 聚表鹵代醇 [5]
- 171/08 · 由羥化合物或其金屬衍生物衍生的聚醚 [5]
- 171/10 · · 由酚 [5]
- 171/12 · · · 聚亞苯基氧化物 [5]
- 171/14 · · 糖醇聚合物 [5]

173/00 基於在 159/00 至 171/00 目內不包括者；由在主鏈中形成含氧與碳之鍵反應而得的高分子化合物之塗料組合物；此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 173/02 · 聚酞 [5]

175/00 基於聚脲或聚胺酯之塗料組合物；基於此聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

- 175/02 · 聚脲 [5]
- 175/04 · 聚胺酯 [5]
- 175/06 · · 由聚酯 [5]
- 175/08 · · 由聚醚 [5]
- 175/10 · · 由聚縮醛 [5]
- 175/12 · · 由含有氮及活性氫之化合物，其中氮原子非為異氰酸酯基之一部分 [5]
- 175/14 · · 含有碳-碳不飽和鍵之聚胺酯 [5]
- 175/16 · · · 含有末端碳-碳不飽和鍵 [5]

177/00 基於由在主鏈中形成羧酸醯胺鍵反應而得的聚醯胺之塗料組合物（基於聚醯胺者見 179/06；基於聚醯胺-醯亞胺者見 179/08）；基於此聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

177/02 · 由 ω -胺基羧酸或其內醯胺衍生的聚醯胺（177/10 優先）[5]

177/04 · 由 α -胺基羧酸衍生的聚醯胺（177/10 優先）[5]

177/06 · 由多元胺和多元羧酸衍生的聚醯胺（177/10 優先）[5]

177/08 · · 由多元胺及聚合的不飽脂肪酸 [5]

177/10 · 由胺基羧酸或多元胺與多元羧酸之與芳基連接之胺基及羧基衍生的聚醯胺 [5]

177/12 · 聚酯-醯胺 [5]

179/00 基於在 161/00 至 177/00 目內不包括者，由僅於主鏈中成含氮者、有或無氧、碳鍵之反應而得的高分子化合物之塗料組合 [5]

179/02 · 聚胺 [5]

179/04 · 於主鏈中具有含氮雜環之縮聚物；聚醯胺；聚醯胺酸或類似之聚醯亞胺母體 [5]

179/06 · · 聚醯胺；聚三唑；聚胺基三唑；聚噁二唑 [5]

179/08 · · 聚醯亞胺；聚酯-醯亞胺；聚醯胺-醯亞胺；聚醯胺酸或類似之聚醯亞胺母體 [5]

181/00 基於由僅在主鏈中形成含硫者、有或無氮、氧或碳鍵反應而得的高分子化合物之塗料組合物；基於聚硫之塗料組合物；基於此等聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

181/02 · 聚硫醚，聚硫醚-醚 [5]

181/04 · 聚硫化物 [5]

181/06 · 聚硫；聚硫醚 [5]

181/08 · 聚磺酸酯 [5]

181/10 · 聚硫醯胺；聚硫醯亞胺 [5]

183/00 基於由僅主鏈中形成含矽者、有或無硫、氮、氧或碳鍵反應而得的高分子化合物之塗料組合物；基於此種聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

183/02 · 聚矽酸酯 [5]

183/04 · 聚矽氧烷 [5]

183/05 · · 含與氫連接之矽者 [5]

183/06 · · 含與含氧基團連接之矽者（183/12 優先）[5]

183/07 · · 含與不飽和脂族基連接之矽者 [5]

183/08 · · 含有與除碳、氮和氧外之原子之有機基團連接之矽者 [5]

183/10 · 含有聚矽氧烷鏈區之嵌段或接枝共聚物（由具有一個碳-碳雙鍵之化合物聚合至聚矽氧烷上而得者見 151/08、153/00）[5]

183/12 · · 含聚醚鏈區者 [5]

183/14 · 其中至少兩個、但並非所有的矽原子與氧以外之原子連接（183/10 優先）[5]

183/16 · 其中所有的矽原子與氧以外之原子連接 [5]

185/00 基於由在主鏈中形成含有除矽、硫、氮、氧及碳以外原子鍵反應而得的高分子化合物之塗料組合物；基於此等聚合物衍生物之塗料組合物 [5]

185/02 · 含磷者 [5]

185/04 · 含硼者 [5]

187/00 基於僅由碳-碳不飽和鍵聚合物以外之反應而得的未指明的高分子化合物之塗料組合物 [5]

基於天然高分子化合物或其衍生物之塗料組合物 [5]

189/00 基於蛋白質之塗料組合物；基於

其衍生物之塗料組合物 [5]

- 189/02 · 酪蛋白-醛縮合物 [5]
- 189/04 · 由廢料而得的產物，如由角、蹄或毛髮 [5]
- 189/06 · · 由皮革或皮而得者 [5]

191/00 基於油、脂肪或蠟之塗料組合物；基於其衍生物之塗料組合物
 （拋光組合物、滑雪履蠟見 C09G）
 [5]

- 191/02 · 硫化油，如油膏 [5]
- 191/04 · 氧化亞麻油 [5]
- 191/06 · 蠟 [5]
- 191/08 · · 地蠟 [5]

193/00 基於天然樹脂之塗料組合物；基於其衍生物之塗料組合物（基於多糖類者見 101/00 至 105/00；基於天然橡膠者見 107/00；拋光組合物見 C09G）[5]

- 193/02 · 蟲膠 [5]
- 193/04 · 松香 [5]

195/00 基於瀝青材料之塗料組合物，如石油瀝青、焦油或天然瀝青

197/00 基於含木質素材料之塗材組合物（基於多糖類者見 101/00 至 105/00；基於天然橡膠者見 107/00）[5]

- 197/02 · 木纖維素材料，如木材、稻草或蔗渣 [5]

199/00 基於在 101/00 至 107/00 或 189/00 至 197/00 目內不包括的天然高分子化合物或其衍生物之塗料組合物 [5]

201/00 基於未指明的高分子化合物之塗料組合物 [5]

- 201/02 · 以存在的指定基團為特徵者 [5]
- 201/04 · · 含鹵原子者 [5]
- 201/06 · · 含氧原子 [5]
- 201/08 · · · 羧基 [5]
- 201/10 · · 含可水解的矽烷基團 [5]

C09F 天然樹脂；蟲膠清漆；乾性油；油乾燥劑，即催乾劑；松節油

-
1/00 天然樹脂之取得，精製或化學改性，如含油樹脂 1/02 • 精製 1/04 • 化學改性，例如酯化 3/00 獲得松節油 3/02 • 作為紙漿工藝過程中之一種副產物 5/00 獲得乾性油 5/02 • 由天然資源 5/04 • • 由腰果 5/06 • 用烴基化之脂肪酸或油之脫水 5/08 • 用脂肪酸之酯化	5/10 • 精製 5/12 • • 用蒸餾法 7/00 乾性油之化學改性（油膏見 C08H） 7/02 • 用氧化 7/04 • 用無聲放電處理 7/06 • 用聚合 7/08 • 用異構化 7/10 • 用再酯化 7/12 • 所用設備 9/00 用作乾燥劑，即催乾劑之化合物 [1,2006.01] 11/00 蟲膠清漆之製備
-

C09G 拋光組合物(蟲膠清漆見 C09F 11/00)；滑雪履蠟

-
1/00 拋光組合物（蟲膠清漆見 C09F 11/00；清潔劑見 C11D） 1/02 • 含有磨料或研磨劑 1/04 • 水性分散劑（1/02 優先） 1/06 • 其他拋光組合物 1/08 • • 基於蠟為主者 1/10 • • • 基於蠟及天然或合成樹脂混合物者	1/12 • • • • 蠟與含矽縮聚物之混合物 1/14 • • 基於非蠟物質者 1/16 • • • 基於天然或合成樹脂者 1/18 • • • 基於其他物質者 3/00 滑雪履蠟
-

C09H 動物膠或明膠之製備

-
1/00 為製膠用的含膠原料之預處理 1/02 • 骨類者（骨之脫脂見 C11B） 1/04 • 生皮、蹄、或碎皮革片者 3/00 由原料中分離膠或明膠，例如用萃取，加熱（食品用明膠見 A23J 1/10） 3/02 • 明膠溶液之精製 5/00 膠或明膠溶液之穩定	7/00 水不溶的明膠之製備 9/00 膠或明膠之乾燥 9/02 • 成薄片狀 9/04 • 成顆粒狀，如珠粒狀者

C09J 黏合劑；一般非機械方面黏合方法；其它類目不包括的黏合方法；用作黏合劑之材料（動物膠或明膠之製備見 C09H） [5]

附註[5]

- (1) 於本次類內，下列名詞或術語意指：
- “用作黏合劑之物質” 係指已知的或新的聚合物或產物之使用；
 - “橡膠” 包含：
 - (a) 天然橡膠或共軛二烯橡膠；
 - (b) 一般橡膠（對於一種特定橡膠，除天然橡膠或共軛二烯橡膠外，見包括基於此等高分子化合物之黏合劑之目）；
 - “基於” 係如下列附註(3)所定義者。
- (2) 於本次類內，含有特定的有機高分子物質之黏合劑僅按該高分子物質分類，非高分子物質則不予考慮。
- 例如：一種含有聚乙烯及胺基-丙基三甲氧基矽烷之黏合劑分入 123/06 目內。
 - 然而，包含至少帶有一個可聚合的碳-碳不飽和鍵之有機非高分子化合物與除 159/00 至 187/00 目之不飽和聚合物以外的預聚物或聚合物組合之黏合劑，則按照不飽和非高分子成分分類入 4/06 目內。
 - 例如：一種含有聚乙烯及苯乙烯單體之黏合劑分類入 4/06 目內。
 - 若清楚並明確地指出涉及 9/00 目內所限定的黏合劑之物理性質或其產生的效果方面，亦分入本次類內。
 - 除高分子成分被特定者，以其它特性，例如添加劑為特徵之黏合劑分入 11/00 目內。
- (3) 於本次類內，含有兩個或多個高分子成分之黏合劑請依據主成分規則分類。若該黏合劑係以相同比例存在的的兩種或多種成分為基礎，則按照該等組成分之每一種分類。
- 例如：一種包含 80 份聚乙烯及 20 份聚氯乙烯之黏合劑分入 123/06 目內。
 - 一種包含 40 份聚乙烯及 40 份聚氯乙烯之黏合劑分入 123/06 及 127/06 目內。

次類索引

黏合劑	物理性質或所產生之效果	9/00
基於無機成分者	其他特徵，如添加劑	11/00
基於有機高分子成分者	一般黏合方法；其他類目不包括的	
基於至少帶有一個可聚合的碳-碳不飽和鍵之	黏合方法	5/00
非高分子有機化合物者	薄膜或薄片狀之黏合劑	7/00

1/00 基於無機成分之黏合劑

1/02 · 有水溶性鹼金屬矽酸鹽

4/00 基於至少具有一個可聚合的碳-碳不飽和鍵之非高分子有機化

合物的黏合劑 [5]

4/02 · 丙烯鹽基單體 [5]

4/04 · · 腈基丙烯酸酯單體 [5]

4/06 · 與除 159/00-187/00 目之不飽和聚

合物外的高分子化合物組合 [5]

5/00 一般黏合方法；其他類目不包括的黏合方法，例如，有關底膠

- 5/02 • 涉及需接合的表面之預處理
- 5/04 • 向需接合的不同表面各自使用黏合組成分
- 5/06 • 包括所用黏合劑之加熱
- 5/08 • 使用發泡黏合劑
- 5/10 • 以嵌入塑膠用焊接重疊邊緣的方法予以接合材料

7/00 薄膜或薄片狀之黏合劑 [1,2006.01,2018.01]

- 7/02 (轉見 7/20 – 7/50)
- 7/04 (轉見 7/21 – 7/50)
- 7/10 • 無載體 [2018.01]
- 7/20 • 以載體為特徵 [2018.01]
- 7/21 • • 紙；織物 [2018.01]
- 7/22 • • 塑膠；金屬化塑膠 [2018.01]
- 7/24 • • • 基於僅由碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [2018.01]
- 7/25 • • • 基於由碳—碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物 [2018.01]
- 7/26 • • • 多孔或蜂窩狀塑膠[2018.01]
- 7/28 • • 金屬板(金屬化塑膠見 7/22) [2018.01]
- 7/29 • • 層壓材料(金屬化塑膠見 7/22) [2018.01]
- 7/30 • 以黏合劑組成為特徵 [2018.01]
- 7/32 • • 水活化型，例如膠紙[2018.01]
- 7/35 • • 熱活化型 [2018.01]
- 7/38 • • 壓敏型黏合劑[PSA] [2018.01]
- 7/40 • 以剝離襯墊為特徵 [2018.01]
- 7/50 • 以介於載體與黏合劑之間的底漆層為特徵 [2018.01]

9/00 以其特理性質或所產生的效果為特徵之黏合劑，例如，固體膠（7/00 優先） [5]

- 9/02 • 導電之黏合劑（專門適用於治療或體內測試用的導電黏合劑見

A61K 50/00） [5, 8]

11/00 特徵未包括於 9/00 目內之黏合劑，例如添加劑 [5]

- 11/02 • 非高分子添加劑 [5]
- 11/04 • • 無機者
- 11/06 • • 有機者 [5]
- 11/08 • 高分子添加劑 [5]

基於多糖類或其衍生物之黏合劑 [5]

附註

(1) 於 101/00 至 201/00 目內，黏合組合物的任何高分子成分，按照 C09J 次類標題後之附註(3)的分類不能被確定，而其使用是新穎的和非顯而易見的，也可以分類至 101/00 至 201/00 中的各目。
[8]

(2) 黏合組合物的任何高分子成分，按照 C09J 次類標題後之附註(3)或上述附註(1)的分類不能被確定時，而該成分被認為代表了對檢索重要的資訊，也可以分類至 101/00 至 201/00 目中。例如，使用分類號組合對於檢索黏合組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為“附加資訊”給出。[8]

101/00 基於纖維素、改性纖維素或纖維素衍生物之黏合劑 [5]

- 101/02 • 纖維素；改性纖維素 [5]
- 101/04 • • 氧化纖維素，水解纖維素 [5]
- 101/06 • • 水合纖維素 [5]
- 101/08 • 纖維素衍生物 [5]
- 101/10 • • 有機酸酯(具有機酸和無機酸兩者見 101/20) [5]
- 101/12 • • • 乙酸纖維素 [5]
- 101/14 • • • 混合酯，例如乙酸-丁酸纖維素 [5]
- 101/16 • • 無機酸酯(具有機酸和無機酸兩

者見 101/20) [5]

- 101/18 ··· 硝酸纖維素 [5]
- 101/20 ··· 有機酸與無機酸兩者之酯 [5]
- 101/22 ··· 黃原酸纖維素 [5]
- 101/24 ··· 黏膠 [5]
- 101/26 ··· 纖維素醚 [5]
- 101/28 ··· 烷基醚 [5]
- 101/30 ··· 芳基醚；芳烷基醚 [5]
- 101/32 ··· 纖維素醚-酯 [5]

103/00 基於澱粉、直鏈澱粉、支鏈澱粉、其衍生物或降解產物之黏合劑 [5]

- 103/02 · 澱粉；其降解產物，例如糊精 [5]
- 103/04 · 澱粉衍生物 [5]
- 103/06 ··· 酯 [5]
- 103/08 ··· 醚 [5]
- 103/10 ··· 氧化的澱粉 [5]
- 103/12 · 直鏈澱粉；支鏈澱粉；此等之降解產物 [5]
- 103/14 · 直鏈澱粉衍生物；支鏈澱粉衍生物 [5]
- 103/16 ··· 酯 [5]
- 103/18 ··· 醚 [5]
- 103/20 ··· 氧化的直鏈澱粉；氧化的支鏈澱粉 [5]

105/00 基於 101/00 或 103/00 目內未包括的多糖類或其衍生物之黏合劑 [5]

- 105/02 · 葡聚糖；其衍生物 [5]
- 105/04 · 藻酸；其衍生物 [5]
- 105/06 · 果膠；其衍生物 [5]
- 105/08 · 幾丁質；硫酸軟骨素；玻尿酸；其衍生物 [5]
- 105/10 · 肝素；其衍生物 [5]
- 105/12 · 瓊脂；其衍生物 [5]
- 105/14 · 半纖維素；其衍生物 [5]
- 105/16 · 環糊精；其衍生物 [5]

基於橡膠或其衍生物之黏合劑 [5]

107/00 基於天然橡膠之黏合劑 [5]

- 107/02 · 膠乳 [5]

109/00 基於共軛二烯烴之均聚物或共聚物之黏合劑 [5]

- 109/02 · 與丙烯腈之共聚物 [5]
- 109/04 ··· 膠乳 [5]
- 109/06 · 與苯乙烯之共聚物 [5]
- 109/08 ··· 膠乳 [5]
- 109/10 · 膠乳（109/04、109/08 優先） [5]

111/00 基於氯丁二烯之均聚物或共聚物之黏合劑 [5]

- 111/02 · 膠乳 [5]

113/00 基於含羧基橡膠之黏合劑 [5]

- 113/02 · 膠乳 [5]

115/00 基於橡膠衍生物之黏合劑 （111/00、113/00 優先） [5]

- 115/02 · 含鹵素之橡膠衍生物 [5]

117/00 基於再生橡膠之黏合劑 [5]

119/00 基於 107/00 至 117/00 目內未包括之橡膠的黏合劑 [5]

- 119/02 · 膠乳

121/00 基於未指明的橡膠之黏合劑 [5]

- 121/02 · 膠乳 [5]

基於僅由碳—碳不飽和鍵反應而得的有機高分子化合物之黏合劑 [5]

附註

- (1) 在 123/00 至 149/00 目中，“脂族基”指無環或非芳香族環骨架，它以下列一種連接為終端：[8]
 - (a) 與碳以外的一個元素連接；[8]
 - (b) 與一個碳以外的原子相連的有雙鍵的碳原子連接；[8]
 - (c) 與一個芳香族碳環或一個雜環鍵接。[8]
- (2) 在 123/00 至 149/00 目中，若無相反指示，共聚物按其主要單體組成分來分類。[8]

123/00 基於僅有一個碳-碳雙鍵之不飽和脂族烴之均聚物或共聚物之黏合劑；基於此種聚合物的衍生物之黏合劑 [5]

- 123/02 · 未經化學後處理改性者 [5]
- 123/04 · · 乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 123/06 · · · 聚乙烯 [5]
- 123/08 · · · 乙烯之共聚物 (123/16 優先) [5]
- 123/10 · · 丙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 123/12 · · · 聚丙烯 [5]
- 123/14 · · · 丙烯之共聚物 (123/16 優先) [5]
- 123/16 · · 乙烯-丙烯或乙烯-丙烯-二烯之共聚物 [5]
- 123/18 · · 有四個或更多個碳原子之烴之均聚物或共聚物 [5]
- 123/20 · · · 有四至九個碳原子者 [5]
- 123/22 · · · · 異丁烯之共聚物；丁基橡膠 [5]
- 123/24 · · · 有十個或更多個碳原子者 [5]
- 123/26 · 經化學後處理改性者 [5]
- 123/28 · · 由與鹵素或含鹵素之化合物反應 (123/32 優先) [5]
- 123/30 · · 由氧化反應 [5]
- 123/32 · · 由與含磷或含硫化合物反應 [5]
- 123/34 · · · 由氯磺化作用 [5]
- 123/36 · · 由與含氮化合物反應，例如由硝化作用 [5]

125/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少一個係以芳族碳環為終端；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 125/02 · 烴之均聚物或共聚物 [5]
- 125/04 · · 苯乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 125/06 · · · 聚苯乙烯 [5]
- 125/08 · · · 苯乙烯之共聚物 (129/08、135/06、155/02 優先) [5]
- 125/10 · · · · 與共軛二烯 [5]

- 125/12 · · · · 與不飽和腈 [5]
- 125/14 · · · · 與不飽和酯 [5]
- 125/16 · · 烷基取代苯乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 125/18 · 含有除碳及氫之外元素的芳族單體的均聚物或共聚物 [5]

127/00 基於有一個或多個不飽和脂族基之化合物的均聚物或共聚物之黏合劑；其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以鹵素為終端；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 127/02 · 未由化學後處理改性者 [5]
- 127/04 · · 含氯原子者 [5]
- 127/06 · · · 氯乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/08 · · · 1,1-二氯乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/10 · · 含溴或碘原子者 [5]
- 127/12 · · 含氟原子者 [5]
- 127/14 · · · 氟乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/16 · · · 1,1-二氟乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/18 · · · 四氟乙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/20 · · · 六氟丙烯之均聚物或共聚物 [5]
- 127/22 · 由化學後處理改性者 [5]
- 127/24 · · 鹵化者

129/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以醇、醚、醛、酮、醛縮醇或酮縮醇基為終端；基於不飽和醇與飽和羧酸之酯的水解聚合物之黏合劑，基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 129/02 · 不飽和醇之均聚物或共聚物 (129/14 優先) [5]
- 129/04 · · 聚乙烯醇；不飽和醇與飽和羧

- 酸之酯的部分水解之均聚物或共聚物 [5]
- 129/06 · · 烯丙醇之共聚物 [5]
- 129/08 · · · 與乙烯基芳族單體 [5]
- 129/10 · 不飽和醚之均聚物或共聚物 (135/08 優先) [5]
- 129/12 · 不飽和酮之均聚物或共聚物 [5]
- 129/14 · 由不飽和醛縮醇或酮縮醇聚合、或由不飽和醇聚合物經後處理而得的醛縮醇或酮縮醇之均聚物或共聚物 [5]
- 131/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以飽和羧酸、碳酸或鹵甲酸之醯氧基為終端（基於水解之聚合物者見 129/00）；基於此種聚合物之衍生物之黏合劑 [5]**
- 131/02 · 一元羧酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/04 · · 乙酸乙烯酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/06 · 多元羧酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 131/08 · · 苯二甲酸者 [5]
- 133/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，其中每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係僅以一個羧基或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或腈為終端；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]**
- 133/02 · 酸之均聚物或共聚物；其金屬鹽或銨鹽 [5]
- 133/04 · 酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/06 · · 僅含有碳、氫和氧之酯，而氧原子僅作為羧基部分存在 [5]
- 133/08 · · · 丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/10 · · · 甲基丙烯酸酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/12 · · · · 甲基丙烯酸甲酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/14 · · 含有鹵、氮、硫或除羧基氧之外氧原子之酯者 [5]
- 133/16 · · · 含鹵原子之酯之均聚物或共聚物 [5]
- 133/18 · 腈之均聚物或共聚物 [5]
- 133/20 · · 丙烯腈的均聚物或共聚物 (155/02 優先) [5]
- 133/22 · · 含有四個或更多個碳原子的腈的均聚物或共聚物 [5]
- 133/24 · 醯胺或醯亞胺之均聚物或共聚物 [5]
- 133/26 · · 丙烯醯胺或甲基丙烯醯胺之均聚物或共聚物 [5]
- 135/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之黏合劑；每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個是以羧基為終端，並在分子中至少含有另一個羧基或其鹽、酐、酯、醯胺、醯亞胺或腈；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]**
- 135/02 · 酯之均聚物或共聚物 (135/06、135/08 優先) [5]
- 135/04 · 腈之均聚物或共聚物 (135/06、135/08 優先) [5]
- 135/06 · 與乙烯基芳族單體之共聚物 [5]
- 135/08 · 與乙烯基醚之共聚物 [5]
- 137/00 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，每個不飽和脂族基僅一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以含氧之雜環為終端（基於多官能酸之環酯之聚合物見 131/00；基於不飽和酸之環酐之聚合物見 135/00）；基於此種聚合物之衍生物之黏合劑 [5]**

- 139/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，每個不飽和脂族基只有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以連接氮之單鍵或雙鍵、或以含氮雜環作為終端；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 139/02 · 乙烯胺之均聚物或共聚物 [5]
- 139/04 · 含有以氮為環原子之雜環單體之均聚物或共聚物 [5]
- 139/06 · · N-乙烯基吡咯烷酮之均聚物或共聚物 [5]
- 139/08 · · 乙烯基吡啶之均聚物或共聚物 [5]
- 141/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，每個不飽和脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且至少有一個係以連接硫之鍵或以含硫雜環作為終端；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 143/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，每個脂族基僅有一個碳-碳雙鍵，並且含有硼、矽、磷、硒、碲或金屬，基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 143/02 · 含磷單體之均聚物或共聚物 [5]
- 143/04 · 含矽單體之均聚物或共聚物 [5]
- 145/00** 基於在側鏈上無不飽和脂族基，而於碳環或雜環系統內有一個或多個碳-碳雙鍵之化合物之均聚物或共聚物之黏合劑；基於此種聚合物衍生物之黏合劑（基於多官能酸之環酯之聚合物見 131/00；基於環酐或環醯亞胺之聚合物見 135/00）[5]
- 145/02 · 苯并呋喃-茚聚合物 [5]
- 147/00** 基於有一個或多個不飽和脂族基化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，至少有一個不飽和脂族基有兩個或多個碳-碳雙鍵；基於此種聚合物衍生物之黏合劑（145/00 優先；基於共軛二烯烴橡膠見 109/00 至 121/00）[5]
- 149/00** 基於有一個或多個碳-碳三鍵化合物之均聚物或共聚物之黏合劑，基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 151/00** 基於接枝聚合物之黏合劑，其中接枝成分係僅由包括碳-碳不飽和鍵反應而得者（基於 ABS 聚合物者見 155/02）；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 151/02 · 接枝至多糖類上 [5]
- 151/04 · 接枝至橡膠上 [5]
- 151/06 · 接枝至僅含有一個碳-碳雙鍵之脂族烴之均聚物或共聚物上 [5]
- 151/08 · 接枝至由僅包括碳-碳不飽和鍵之反應之外而得的高分子化合物上 [5]
- 151/10 · 接枝至無機物上 [5]
- 153/00** 基於嵌段共聚物之黏合劑，該共聚物至少有一個聚合物鏈區僅由包括碳-碳不飽和鍵之反應係者；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]
- 153/02 · 乙烯基芳族單體與共軛二烯烴 [5]
- 155/00** 基於僅由包括碳-碳不飽和鍵之聚合反應而得者，而且於 123/00 至 153/00 目內不包括的均聚物或共聚物之黏合劑 [5]
- 155/02 · ABS (丙烯腈-苯乙烯-丁二烯) 聚合物 [5]
- 155/04 · 由二烯烴合成得到之加聚物 [5]

157/00 基於僅由涉及碳-碳不飽和鍵之反應而得的未指明的聚合物之黏合劑 [5]

- 157/02 · 礦物油烴類之共聚物 [5]
- 157/04 · 僅確定其中少數單體之共聚物 [5]
- 157/06 · 含有碳及氫以外元素之均聚物或共聚物 [5]
- 157/08 · · 含鹵原子者 [5]
- 157/10 · · 含氧原子者 [5]
- 157/12 · · 含氮原子者 [5]

基於由碳-碳不飽和鍵以外之反應而得的有機高分子化合物之黏合劑 [5]

159/00 基於聚縮醛類之黏合劑；基於聚縮醛類衍生物之黏合劑 [5]

- 159/02 · 僅含聚甲醛鏈區之聚縮醛類 [5]
- 159/04 · 共聚甲醛類 [5]

161/00 基於醛或酮之縮聚物之黏合劑 (與多元醇類者見 159/00；與多元腈類者見 177/00)；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 161/02 · 僅係醛或酮之縮聚物 [5]
- 161/04 · 僅係醛或酮與酚之縮聚物 [5]
- 161/06 · · 醛與酚者 [5]
- 161/08 · · · 與一元酚 [5]
- 161/10 · · · · 苯酚-甲醛縮合物 [5]
- 161/12 · · · · 與多元酚 [5]
- 161/14 · · · · 改性的酚醛縮合物
- 161/16 · · 酮與酚者
- 161/18 · 僅係醛或酮與芳烴或其鹵素衍生物之縮聚物
- 161/20 · 醛或酮僅與含有氮上連有氫之化合物之縮聚物 (與胺基酚類者見 161/04) [5]
- 161/22 · · 醛與無環或碳環化合物 [5]
- 161/24 · · · 與脲或硫脲 [5]
- 161/26 · · 醛與雜環化合物 [5]
- 161/28 · · · 與三聚氰胺 [5]
- 161/30 · · 醛與雜環和無環或碳環化合物者 [5]

- 161/32 · · 改性的胺-醛縮合物 [5]
- 161/34 · 醛或酮與至少包括於 161/04、161/18 及 161/20 兩個目內的單體之縮聚物 [5]

163/00 基於環氧樹脂之黏合劑；基於環氧樹脂衍生物之黏合劑 [5]

- 163/02 · 雙酚之聚縮水甘油醚類 [5]
- 163/04 · 線型酚醛環氧樹脂 [5]
- 163/06 · 三縮水甘油基異三聚氰酸酯 [5]
- 163/08 · 環氧化聚合多烯烴 [5]
- 163/10 · 由不飽和化合物改性環氧樹脂 [5]

附註

於 165/00 至 185/00 目內，若無相反指示時，基於由主鏈中形成兩不同鍵的反應而得之高分子化合物之黏合劑，僅按照量多之鍵而分類。[5]

165/00 基於由主鏈中形成碳-碳鍵之反應而得的高分子化合物之黏合劑 (107/00 至 157/00、161/00 優先)；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 165/02 · 聚亞苯基 [5]
- 165/04 · 聚亞二甲苯基 [5]

167/00 基於由主鏈中形成一個羧酸酯鍵之反應而得的聚酯之黏合劑 (基於聚酯-醯胺者見 177/12；基於聚酯醯亞胺者見 179/08)；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 167/02 · 由二羧基與二羟基化合物衍生的聚酯 (167/06 優先) [5]
- 167/03 · · 由羟基及羧基直接連接於芳環上之二羧基與二羟基化合物 [5]
- 167/04 · 由羟基羧酸衍生之聚酯；如內酯 (167/06 優先) [5]
- 167/06 · 具有碳-碳不飽和部分之不飽和聚酯 [5]

- 167/07 · · 具有碳-碳不飽和鍵終端者 [5]
 167/08 · 用高級脂油或其酸、或用天然樹脂或樹脂酸改性之聚酯 [5]

169/00 基於聚碳酸酯之黏合劑；基於聚碳酸酯衍生物之黏合劑 [5]

171/00 基於由主鏈中形成醚鍵之反應而得的聚醚黏合劑（基於聚縮醛者見 159/00；基於環氧樹脂者見 163/00；基於聚硫醚-醚者見 181/02；基於聚醚砜者見 181/06）；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 171/02 · 聚烯化氧 [5]
 171/03 · · 聚表鹵化醇 [5]
 171/08 · 由經基化合物或其金屬衍生物衍生的聚醚（171/02 優先）[5]
 171/10 · · 由酚 [5]
 171/12 · · · 聚亞苯基氧化物 [5]
 171/14 · · 糖醇聚合物 [5]

173/00 基於在 159/00 至 171/00 目內不包括者，由在主鏈中形成含氧或氧與碳之鍵反應而得的高分子化合物之黏合劑；此聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 173/02 · 聚酞 [5]

175/00 基於聚脲或胺酯之黏合劑；基於此聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 175/02 · 聚脲 [5]
 175/04 · 聚胺酯 [5]
 175/06 · · 由聚酯 [5]
 175/08 · · 由聚醚 [5]
 175/10 · · 由聚縮醛 [5]
 175/12 · · 由含有氮及活性氫之化合物，其中氮原子非為異氰酸酯基之一部分 [5]
 175/14 · · 含有碳-碳不飽和鍵之聚胺基甲酸酯 [5]
 175/16 · · · 含有碳-碳不飽和鍵終端者 [5]

177/00 基於由在主鏈中形成羧酸醯胺鍵之反應而得的聚醯胺之黏合劑（基於聚醯肼者見 179/06；基於聚醯胺-醯亞胺者見 179/08）；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 177/02 · 由 ω -胺基羧酸或其內醯胺衍生的聚醯胺（177/10 優先）[5]
 177/04 · 由 α -胺基羧酸衍生之聚醯胺（177/10 優先）[5]
 177/06 · 由多元胺與多元羧酸衍生的聚醯胺（177/10 優先）[5]
 177/08 · · 由多元胺與聚合的不飽和脂肪酸 [5]
 177/10 · 由胺基羧酸或多元胺與多元羧酸之與芳基連接之胺基與羧基衍生的聚醯胺 [5]
 177/12 · 聚酯-醯胺 [5]

179/00 基於在 161/00 至 177/00 目內不包括者，由僅在主鏈中形成含氮者、有或無氧、碳鍵之反應而得的高分子化合物之黏合劑 [5]

- 179/02 · 聚胺 [5]
 179/04 · 在主鏈中具有含氮雜環之縮聚物；聚醯肼；聚醯胺酸或類似的聚醯亞胺母體 [5]
 179/06 · · 聚醯肼；聚三唑；聚胺基三唑；聚噁二唑 [5]
 179/08 · · 聚醯亞胺；聚酯-醯亞胺；聚醯胺-醯亞胺；聚醯胺酸或類似的聚醯亞胺母體 [5]

181/00 基於僅在主鏈中形成含硫者、有或無氮、氧或碳之鍵之反應而得的高分子化合物之黏合劑；基於聚砜之黏合劑；基於此等聚合物衍生物之黏合劑 [5]

- 181/02 · 聚硫醚；聚硫醚-醚 [5]
 181/04 · 聚硫化合物 [5]
 181/06 · 聚砜；聚醚砜 [5]
 181/08 · 聚磺酸酯 [5]
 181/10 · 聚砜醯胺；聚砜醯亞胺 [5]

183/00 基於僅由主鏈中形成含矽者、有或無硫、氮、氧或碳鍵之反應而得的高分子化合物之黏合劑；基於此種聚合物衍生物之黏合劑 [5]

183/02 · 聚矽酸酯 [5]

183/04 · 聚矽氧烷 [5]

183/05 · · 含與氫連接的矽者 [5]

183/06 · · 含與含氧基團連接的矽者 (183/12 優先) [5]

183/07 · · 含與不飽和脂族基連接之矽者 [5]

183/08 · · 含有與除碳、氮及氧外之原子之有機基團連接的矽 [5]

183/10 · 含有聚矽氧烷鏈區之嵌段或接枝共聚物(由具有一個碳-碳雙鍵之化合物聚合至聚矽氧烷上而得至者見 151/08、153/00) [5]

183/12 · · 含聚醚鏈區 [5]

183/14 · 其中至少兩個、但並非所有的矽原子與氧以外之原子連接 (183/10 優先) [5]

183/16 · 其中所有的矽原子與氧以外之原子連接 [5]

185/00 基於由在主鏈中形成含除矽、硫、氮、氧及碳以外原子鍵之反應而得的高分子化合物之黏合劑；基於此聚合物之衍生物之黏合劑 [5]

185/02 · 含磷者 [5]

185/04 · 含硼者 [5]

187/00 基於僅由碳-碳不飽和鍵之聚合反應以外的反應而得的未指明之高分子化合物之黏合劑 [5]

基於天然高分子化合物或其衍生物之黏合劑 [5]

189/00 基於蛋白質之黏合劑；基於其衍生物之黏合劑[5]

189/02 · 酪蛋白-醛縮合物 [5]

189/04 · 由廢料而得的產物，如角、蹄或毛髮 [5]

189/06 · · 由皮革或皮而得者 [5]

191/00 基於油、脂肪及或蠟之黏合劑；基於其衍生物之黏合劑[5]

191/02 · 硫化油，如油膏 [5]

191/04 · 氧化亞麻油 [5]

191/06 · 蠟 [5]

191/08 · · 地蠟 [5]

193/00 基於天然樹脂之黏合劑；基於其衍生物之黏合劑 (基於多糖類者見 101/00 至 105/00；基於天然橡膠者見 107/00) [5]

193/02 · 蟲膠 [5]

193/04 · 松香 [5]

195/00 基於瀝清材料之黏合劑，如石油瀝青、焦油或天然瀝青 [5]

197/00 基於木質素材料之黏合劑 (基於多糖類者見 101/00 至 105/00)[5]

197/02 · 木質纖維素材料，如木材、稻草或蔗渣 [5]

199/00 基於在 101/00 至 107/00 或 189/00 至 197/00 目內未包括的天然高分子化合物或其衍生物之黏合劑 [5]

201/00 基於未指明的高分子化合物之黏合劑 [5]

201/02 · 以存在的指定基團為特徵者 [5]

201/04 · · 含鹵原子者 [5]

201/06 · · 含氧原子者 [5]

201/08 · · · 羧基 [5]

201/10 · · 含可水解的矽烷基團 [5]

C09K 其他類目不包括的各種應用材料；其他類目不包括的材料之各種應用

附註

- (1) 此次類亦包括特殊材料之一般應用或此等於其他類目所不包括方面之應用。
- (2) 於此次類內，下列術語之意思指：“材料”包括組合物 [4]

3/00 其他類目不包括之各種各樣材料 [2]

- 3/10 • 用於接頭或蓋之密封或包裝
- 3/12 • 用於防止洩漏，例如在散熱器內或在料槽內
- 3/14 • 防滑材料；研磨材料 [4]
- 3/16 • 抗靜電材料 [4]
- 3/18 • 用於表面以減少對冰、霧或水之黏附；用於表面上之融化或防凍材料 [4]
- 3/20 • 用作甘油於非化學方面之使用中的取代物，例如用作洗護霜或藥膏中之底子[1,2006.01]
- 3/22 • 用於防塵或吸塵 [4]
- 3/24 • 用於模仿冰或雪 [4]
- 3/30 • 用於空氣溶膠 [4]
- 3/32 • 用於處理液體污染體，如油、汽油或脂肪（藉由產生化學變化使有害的化學物質無害或減少害處的方法見 A62D 3/00） [1, 8]

5/00 傳遞熱、熱交換或儲熱之材料，如製冷劑；用於除燃燒外的化學反應方式製熱或製冷的材料 [2]

- 5/02 • 在使用時發生物理狀態變化的材料（5/16，5/20 優先） [2]
- 5/04 • • 相態變化係由液體至蒸汽或相反 [2]
- 5/06 • • 相態變化是由液體到固體或相反 [2]
- 5/08 • 使用時不發生物理狀態變化之材料（5/16，5/20 優先） [7]
- 5/10 • • 液體材料 [7]
- 5/12 • • • 熔融材料，即室溫下為固體之材料，例如金屬或鹽 [7]

- 5/14 • • 固體材料，例如粉末或顆粒 [7]
- 5/16 • 使用時發生化學反應之材料 [7]
- 5/18 • • 不可逆之化學反應 [7]
- 5/20 • 所屬之防凍劑，例如用於散熱器液體 [7]

8/00 用於鑽孔或鑽井的組合物；用來處理孔或井的組合物，例如，用於完成或修復操作 [8]

- 8/02 • 鑽井組合物 [8]

附註

在 8/03 至 8/38 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反的指示時，請放入最後適當的位置。[8]

- 8/03 • • 在鑽井組合物中一般使用的特殊添加劑 [8]
- 8/035 • • • 有機添加劑 [8]
- 8/04 • • 水性鑽井組合物 [8]
- 8/05 • • • 僅含無機化合物的，例如黏土和鹽的混合物 [8]
- 8/06 • • • 無黏土組合物（僅含無機化合物的見 8/05） [8]
- 8/08 • • • • 含天然有機化合物，例如多糖，或其衍生物 [8]
- 8/10 • • • • • 纖維素或其衍生物 [8]
- 8/12 • • • • 含合成有機高分子化合物或其前驅物 [8]
- 8/14 • • • 含黏土的組合物（僅含無機化合物的見 8/05） [8]
- 8/16 • • • • 以黏土以外的無機化合物為特徵 [8]
- 8/18 • • • • 以有機化合物為特徵 [8]

- 8/20 • • • • • 天然有機化合物或其衍生物，例如多糖或木質素衍生物 [8]
- 8/22 • • • • • 合成有機化合物 [8]
- 8/24 • • • • • 聚合物 [8]
- 8/26 • • • 水包油乳劑 [8]
- 8/28 • • • • 含有機添加劑 [8]
- 8/32 • • 非水的鑽井組合物，例如油基組合物 [8]
- 8/34 • • • 有機液體 [8]
- 8/36 • • • 油包水乳劑 [8]
- 8/38 • • 氣態或泡沫狀鑽井組合物 [8]
- 8/40 • 隔離組合物，例如用於分離黏合物質與鑽井的組合物 [8]
- 8/42 • 黏合組成物，例如將孔套黏接到孔眼上；堵漏組合物，例如填井（塗抹孔眼壁組合物見 8/50） [8]
- 8/44 • • 僅含有機黏合劑 [8]
- 8/46 • • 含無機黏合劑，例如波特蘭水泥 [8]
- 8/467 • • • 含特殊用途的添加劑 [8]
- 8/473 • • • • 用於降低密度的添加劑，例如用於獲得泡沫水泥的組合物 [8]
- 8/48 • • • • 用於提高密度或增重的添加劑 [8]
- 8/487 • • • • 控制流體損失的添加劑；用於降低或防止循環損失的添加劑 [8]
- 8/493 • • • • 用於降低或阻止氣體遷移的添加劑 [8]
- 8/50 • 塗抹孔眼壁用的組合物，即用於暫時固結孔眼壁的組合物 [8]
- 8/502 • • 油基組合物 [8]
- 8/504 • • 水基或極性溶劑的組合物（8/502 優先） [8]
- 8/506 • • • 含有機化合物 [8]
- 8/508 • • • • 高分子化合物 [8]
- 8/512 • • • • • 含交聯劑 [8]
- 8/514 • • • • • 來自天然原料，例如多糖、纖維素（8/512 優先） [8]
- 8/516 • • 以它們的形狀或其組成分的形狀為特徵，例如膠囊狀物質 [8]
- 8/518 • • • 泡沫狀 [8]
- 8/52 • 用於防止、限制或消除沈積的組合物，例如為了清洗 [8]
- 8/524 • • 有機沈積物，例如石蠟或瀝青烯 [8]
- 8/528 • • 無機沈積物，例如硫酸鹽或碳酸鹽 [8]
- 8/532 • • • 硫磺 [8]
- 8/536 • • 以它們的形狀或其組成分的形狀為特徵，例如膠囊狀物質 [8]
- 8/54 • 孔眼或井中就地抑制腐蝕的組合物 [8]
- 8/56 • 用於固定井四周的散沙或類似物但不會過度降低其滲透性的組合物 [8]
- 8/565 • • 油基組合物 [8]
- 8/57 • • 水基或極性溶劑組合物（8/565 優先） [8]
- 8/575 • • • 含有機化合物 [8]
- 8/58 • 提高獲得碳氫化合物的回收方法的組合物，即用於改善油的遷移率，例如取代液 [8]
- 8/582 • • 以使用細菌為特徵 [8]
- 8/584 • • 以使用特殊的表面活性劑為特徵 [8]
- 8/588 • • 以使用特殊的聚合物為特徵 [8]
- 8/592 • • 與產生的熱量（例如以蒸汽注射）結合使用的組合物 [8]
- 8/594 • • 與注射的氣體結合使用的組合物（8/592 優先） [8]
- 8/60 • 以作用於地下結構物來增加產量的組合物 [8]
- 8/62 • • 形成裂縫或破裂的組合物 [8]
- 8/64 • • • 油基組合物 [8]
- 8/66 • • • 水基或極性溶劑組合物（8/64 優先） [8]
- 8/68 • • • • 含有機化合物 [8]

- 8/70 . . . 以它們的形狀或其組成分的形狀為特徵，例如泡沫狀 [8]
- 8/72 . . . 腐蝕性化學藥品，例如酸 [8]
- 8/74 與特殊用途的添加劑結合 [8]
- 8/76 用於阻止或降低流體損失 [8]
- 8/78 用於防止封閉層形成 [8]
- 8/80 . . 用於加強破裂的組合物，例如用於保持破裂開啟的支撐劑的組合物 [8]
- 8/82 . . 油基組合物（8/64 優先）[8]
- 8/84 . . 水基或極性溶劑組合物（8/66、8/82 優先）[8]
- 8/86 . . . 含有機化合物 [8]
- 8/88 高分子化合物 [8]
- 8/90 來自天然原料，例如多糖、纖維素 [8]
- 8/92 . . 以它們的形狀或其組成分的形狀為特徵，例如膠囊狀物質（8/70 優先）[8]
- 8/94 . . . 泡沫狀 [8]
- 9/00 變色材料，即受某種形式能量之激發而引起能量吸收波長範圍變化的材料 [2,2006.01]**
- 9/02 . 有機變色材料 [2]
- 11/00 發光材料，例如電致發光材料、化學發光材料 [2]**
- 11/01 . 發光材料之回收 [3]
- 11/02 . 以特殊材料作為黏合劑，用於粒子塗層或作懸浮介質 [2]
- 11/04 . 含有天然或人造放射性元素或未經指明的放射性元素 [2]
- 11/06 . 含有機發光材料 [2]
- 11/07 . . 具有化學相互作用之組成分，如反應性化學發光組合物 [3]
- 11/08 . 含無機發光材料 [2]
- 附註**
- 於 11/54 至 11/89 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反的指示時，材料請放入最後適當的位置；而發光材料之活性組成分並非於分類時予以注意。[4]
- 11/54 . . 含鋅或鎘 [4]
- 11/55 . . 含鈹、鎂、鹼金屬或鹼土金屬 [4]
- 11/56 . . 含硫 [4]
- 11/57 . . 含錳或銻 [4]
- 11/58 . . 含銅、銀或金 [4]
- 11/59 . . 含矽 [4]
- 11/60 . . 含鐵、鈷或鎳 [4]
- 11/61 . . 含氟、氯、溴、碘或未指明的鹵素元素 [4]
- 11/62 . . 含鋅、銦或鉍 [4]
- 11/63 . . 含硼 [4]
- 11/64 . . 含鋁 [4]
- 11/65 . . 含碳 [4]
- 11/66 . . 含鋅、錫或鉛 [4]
- 11/67 . . 含難熔金屬 [4]
- 11/68 . . . 含鉻，鉬或鎢 [4]
- 11/69 . . . 含鈾 [4]
- 11/70 . . 含磷 [4]
- 11/71 . . . 尚含鹼土金屬 [4]
- 11/72 . . . 尚含鹵素，如鹵化磷酸鹽[4]
- 11/73 尚含鹼土金屬 [4]
- 11/74 . . 含砷、銻或鉍 [4]
- 11/75 . . . 含銻 [4]
- 11/76 尚含磷及鹵素，如鹵磷酸鹽 [4]
- 11/77 . . 含稀土金屬 [4]
- 11/78 . . . 含氧 [4]
- 11/79 . . . 含矽 [4]
- 11/80 . . . 含鋁或鎂 [4]
- 11/81 . . . 含磷 [4]
- 11/82 . . . 含鈾 [4]
- 11/83 . . . 含鈾及磷 [4]
- 11/84 . . . 含硫、如硫氧化物 [4]
- 11/85 . . . 含鹵素 [4]
- 11/86 . . . 含氧及鹵素，如鹵氧化物 [4]
- 11/87 . . 含鉑族金屬 [4]
- 11/88 . . 含硒、碲或未指明的硫屬元素 [4]

11/89 · · 含汞 [4]

13/00 蝕刻，表面光亮或浸漬組合物[2]

附註

在 13/02 至 13/12 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，組合物請放入最後適當位置。[2]

13/02 · 含一種鹼金屬之氫氧之物 [2]

13/04 · 含一種無機酸 [2]

13/06 · · 帶有機材料者 [2]

13/08 · · 含一種氟化物 [2]

13/10 · · 含一種硼化物 [2]

13/12 · 含至少為非溶劑組成分 50%量的重金屬鹽 [2]

15/00 抗氧劑組合物；抑制化學變化之組合物 [4]

附註

(1) 在 15/02 至 15/34 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，組合物請放入之最後適當位置。[2]

(2) 於 15/02 至 15/34 目內，有機化合物之金屬鹽按該化合物分類。[2]

15/02 · 含無機化合物 [2]

15/04 · 含有機化合物 [2]

15/06 · · 含氧者 [2]

15/08 · · · 含一個酚或一部分醌者 [2]

15/10 · · 含硫者 [2]

15/12 · · 含硫及氧者 [2]

15/14 · · · 含一個酚或一部分醌者 [2]

15/16 · · 含氮者 [2]

15/18 · · · 含一個胺或一部分亞胺者[2]

15/20 · · 含氮及氧者 [2]

15/22 · · · 含一個醯胺或一部分醯亞胺者 [2]

15/24 · · · 含一個酚或一部分醌者 [2]

15/26 · · 含氮及硫者 [2]

15/28 · · 含氮、氧及硫者 [2]

15/30 · · 含至少有一個氮原子作為環節之雜環者 [2]

15/32 · · 含硼、矽、磷、硒、碲或一種金屬者 [2]

15/34 · 含未知成分的動物或植物材料 [2]

17/00 土壤調節材料或土壤穩定材料 [3]

附註

(1) 本目涵蓋土壤調節或土壤穩定材料與以土壤調節或土壤穩定活性為特徵之肥料的混合物。[6]

(2) 本目不涵蓋以肥料活性為特徵的土壤調節或土壤穩定材料與肥料的混合物，它包括在 C05G 次類中。[6]

(3) 為了本目中分類之目的，組合物中之肥料不列入考量。[6]

(4) 在 17/02 至 17/50 目中，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，材料請放入最後適當位置。[6]

(5) 在本目中，最好加入 101/00 至 109/00 目之索引碼。 [6]

17/02 · 僅包含無機化合物 [6]

17/04 · · 以溶液或泥漿以外之物理形態應用，例如，細粒或氣體 [6]

17/06 · · 鈣化合物，例如灰石 [6]

17/08 · · 鋁化合物，例如氫氧化鋁 [6]

17/10 · · 水泥，例如卜特蘭水泥 [6]

17/12 · · 水溶性矽酸鹽，例如水玻璃[6]

17/14 · 僅包含有機化合物 [6]

17/16 · · 以溶液或泥漿以外之物理形態應用，例如片晶或細粒 [6]

17/18 · · 預聚合物；高分子化合物 [6]

17/20 · · · 乙烯聚合物 [6]

17/22 · · · 聚丙烯酸酯；聚甲基丙烯

酸酯 [6]

- 17/24 . . . 醛或酮之縮合聚合物 [6]
- 17/26 . . . 酚-醛縮合聚合物 [6]
- 17/28 . . . 脲-醛縮合聚合物 [6]
- 17/30 . . . 聚異氰酸酯；聚脲酯 [6]
- 17/32 . . . 天然來源者，例如，纖維材料 [6]
- 17/34 . . . 瀝青材料 [6]
- 17/36 . . 含有一個或多個碳-矽鍵之化合物 [6]
- 17/38 . . . 矽氧烷 [6]
- 17/40 . 包含有機與無機化合物之混合物 [6]
- 17/42 . . 無機化合物與有機活性成分混合者，例如加速劑 [6]
- 17/44 . . . 該無機化合物為水泥者 [6]
- 17/46 . . . 該無機化合物為水溶性矽酸鹽者 [6]
- 17/48 . . 有機化合物與無機活性成分混合者，例如聚合觸媒 [6]
- 17/50 . . . 該有機化合物為天然來源者，例如，纖維衍生物 [6]
- 17/52 . 林地覆蓋物 [6]

19/00 液晶材料 [4]

附註

於 19/02 至 19/60 目內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示，材料請放入最後適當位置。[4]

- 19/02 . 一般以組份之光、電或物理性質為特徵者 [4]
- 19/04 . 以液晶組份之化學結構為特徵者 [4]
- 19/06 . . 非固醇族液晶化合物 [4]
- 19/08 . . . 至少含兩個非稠環者 [4]
- 19/10 至少含兩個苯環者 [4]
- 19/12 至少兩個苯環係直接連接之，如聯苯 [4]
- 19/14 用碳鏈連接的 [4]
- 19/16 含碳-碳雙鍵之鏈，如

均二苯代乙烯 [4]

- 19/18 含碳-碳三鍵之鏈，如二苯乙炔 [4]
- 19/20 用含碳及氧原子鏈為鏈鏈連接的，如酯 [4]
- 19/22 用含碳及氮原子鏈為鏈鏈連接的，如席夫鹼 [4]
- 19/24 用含氮-氮鍵之鏈連接的 [4]
- 19/26 氧化偶氮化合物 [4]
- 19/28 用含碳及硫原子鏈為鏈鏈連接的，如硫酯 [4]
- 19/30 含飽和的或不飽和的非芳環，如環己烷之環 [4]
- 19/32 . . . 含稠環系，例如稠合、橋連或螺環系 [4]
- 19/34 . . . 至少含一個雜環 [4]
- 19/36 . . 固醇族之液晶化合物 [4]
- 19/38 . . 聚合物，如聚醯胺 [4]
- 19/40 . . 含除碳、氫、鹵素、氧、氮或硫以外的元素，如矽、金屬 [4]
- 19/42 . . 包括於以上 19/06 至 9/40 目內的兩個目或兩個目以上的液晶化合物之混合物 [4]

附註

- (1) 本目中不包含混合物—含有包含在 19/04 至 19/40 各目中同一目內的兩種或多種液晶化合物的混合物，分類只分入該目內。[4]
- (2) 如果分入本目中的混合物的液晶組成分是重要的組成分，則它們也應按在 19/04 至 19/40 目內的化合物分類。[4]

- 19/44 . . . 含與苯環直接鍵合的化合物 [4]
- 19/46 . . . 含酯者 [4]
- 19/48 . . . 含席夫鹼者（Schiff 鹼）[4]
- 19/50 . . . 含固醇族液晶化合物者 [4]
- 19/52 . 以非液晶之成分為特徵者，如添加劑 [4]

- 19/54 • • 無特定中間相之添加劑 [4]
- 19/56 • • • 調節劑 [4]
- 19/58 • • 摻雜劑或電荷傳遞劑 [4]
- 19/60 • • 多色染料 [4]

21/00 耐火材料 [4]

附註

於 21/02 至 21/14 目內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示，材料請放入最後適當位置。[4]

- 21/02 • 無機材料 [4]
- 21/04 • • 含磷 [4]
- 21/06 • 有機材料 [4]
- 21/08 • • 含鹵素 [4]
- 21/10 • • 含氮 [4]
- 21/12 • • 含磷 [4]
- 21/14 • 高分子材料 [4]
- 23/00 作為乳化劑、濕潤劑、分散劑、或發泡劑使用之物質 [2022.01]**
- 23/02 • 衍生自一元醇之烷基磺酸鹽或硫酸酯鹽 [2022.01]
- 23/04 • 衍生自多元醇或胺基醇之磺酸鹽或硫酸酯鹽或其衍生物(硫酸化或磺化脂肪油見 23/08) [2022.01]
- 23/06 • 高級脂肪酸與羥烷基化磺酸或其鹽之酯 [2022.01] 23/08 • 脂肪、油、蠟或高級脂肪酸或其酯與一元醇之硫酸化或磺化產物 [2022.01]
- 23/10 • 低分子量磺基羧酸或磺基多羧酸之衍生物 [2022.01]
- 23/12 • 芳族或烷基化芳族化合物之磺酸鹽 [2022.01]
- 23/14 • 磷酸衍生物 [2022.01]
- 23/16 • 胺或多胺 [2022.01]
- 23/18 • 四級銨化合物 [2022.01]
- 23/20 • 磷及銻化合物 [2022.01]
- 23/22 • 醯胺或醯肼 [2022.01]
- 23/24 • • 高級脂肪酸與胺基烷基化磺酸

- 之醯胺 [2022.01]
- 23/26 • 磺醯胺 [2022.01]
- 23/28 • 胺基羧酸(蛋白質及蛋白質水解物見 23/30) [2022.01]
- 23/30 • 蛋白質；蛋白質水解物 [2022.01]
- 23/32 • 雜環化合物 [2022.01]
- 23/34 • 高分子量羧酸酯(高級脂肪酸與羥烷基化磺酸或其鹽之酯見 23/06) [2022.01]
- 23/36 • • 多元羧酸酯 [2022.01]
- 23/38 • 醇，例如石蠟之氧化產物 [2022.01]
- 23/40 • 酚 [2022.01]
- 23/42 • 醚，例如醇或酚之聚二醇醚 [2022.01]
- 23/44 • • 羧酸醚 [2022.01]
- 23/46 • • 胺基醇之醚 [2022.01]
- 23/48 • • 纖維素醚 [2022.01]
- 23/50 • 木質素衍生物 [2022.01]
- 23/52 • 天然或合成樹脂或其鹽 [2022.01]
- 23/54 • 矽化合物 [2022.01]
- 23/56 • 糖苷；黏液；皂苷 [2022.01]

涉及土壤調節或土壤穩定材料之用途或所欲之效果與主目 17/00 聯合使用之索引碼。 [6]

101/00 農業用途 [6]

103/00 土木工程用途 [6]

105/00 防腐蝕 [6]

107/00 不滲透化 [6]

109/00 pH 調節 [6]

C10 石油、煤氣及煉焦工業；含一氧化碳之工業氣體；燃料；潤滑劑；泥煤

C10B 含碳物料之乾餾生產煤氣、焦炭、焦油或類似物（油的裂化見 C10G；礦石之地下汽化見 E21B 43/295） [5]

次類索引

炭化爐，煉焦爐	去除積垢.....41/00；43/00
炭化爐.....1/00	其他部件.....45/00
煉焦爐.....3/00 至 15/00	碳化或焦化工藝過程
煉焦爐之結構特點	用乾餾.....47/00 至 53/00
門，封閉物；	礦物油或類似物之焦化.....55/00
其他特性.....25/00，27/00，29/00	其他工藝過程.....57/00
加熱.....17/00 至 23/00	一般乾餾工藝
加料裝置.....13/00，31/00 至 35/00	過程之特點
安全裝置；防止或	7/00，13/00，37/00，39/00，57/00

炭化爐及煉焦爐

1/00 炭化爐

- 1/02 · 固定式炭化爐
- 1/04 · · 立式炭化爐
- 1/06 · · 臥式炭化爐
- 1/08 · · 傾斜式炭化爐
- 1/10 · 轉動式炭化爐

3/00 附立式炭化室之煉焦爐

- 3/02 · 帶熱交換裝置

5/00 附臥式炭化室之煉焦爐

- 5/02 · 附立式加熱煙道
- 5/04 · · 附交叉內連件者
- 5/06 · 附臥式加熱煙道
- 5/08 · 附臥式並立式之加熱煙道
- 5/10 · 附熱交換裝置
- 5/12 · · 附蓄熱室
- 5/14 · · · 位於炭化室之縱向
- 5/16 · · · · 附分隔開的煙道
- 5/18 · · · 位於爐組之縱向
- 5/20 · · 附同流式換熱器

7/00 於爐內有傳送原料之機械裝置

的煉焦爐

- 7/02 · 附旋轉扒刮裝置
- 7/04 · 附搖震或振動裝置
- 7/06 · 附環帶之運送裝置
- 7/08 · · 豎直方向運送
- 7/10 · 附螺旋運送機
- 7/12 · 附翻轉或搖動裝置
- 7/14 · 附運轉車、容器或料盤

9/00 蜂巢式焦爐

11/00 附傾斜碳化室之煉焦爐

13/00 附有於機械壓力下供給並保持爐料裝置之煉焦爐

15/00 其他煉焦爐

- 15/02 · 附底部加熱

煉焦爐之加熱

17/00 煉焦爐之預熱

19/00 以電加熱煉焦爐

21/00 以可燃氣體加熱煉焦爐

- 21/02 · 用貧煤氣

- 21/04 • 用富煤氣
- 21/06 • 於適用貧煤氣或煤氣之煉焦爐內
- 21/08 • 應用特殊的加熱氣體
- 21/10 • 調節並控制燃燒 [1,2006.01]
- 21/12 • • 燃燒器
- 21/14 • • 排煙轉向裝置
- 21/16 • • 用控制或改變加熱煙道及蓄熱室煙道之間的開口
- 21/18 • • 煙道氣之再循環
- 21/20 • 箱式煉焦爐之加熱方法
- 21/22 • • 在不同水平引入可燃氣體與空氣
- 21/24 • • • 於立式加熱煙道之頂部及底部
- 21/26 • • 僅於立式煙道之頂部引入加熱氣體與空氣

23/00 其他加熱煉焦爐之方法

25/00 煉焦爐之門或封閉物

- 25/02 • 門；門框
- 25/04 • • 用於立式炭化室煉焦爐者
- 25/06 • • 用於臥室炭化室煉焦爐者
- 25/08 • • 門之開閉
- 25/10 • • • 對立式炭化室煉焦爐者
- 25/12 • • • 對臥式炭化室之煉焦爐者
- 25/14 • • • 爐門提升裝置
- 25/16 • • 密封；密封用品
- 25/18 • • 冷卻
- 25/20 • 裝料孔之蓋及封閉物
- 25/22 • • 用於立式炭化室煉焦爐
- 25/24 • • 用於臥式炭化室煉焦爐

27/00 乾餾氣之回收裝置

- 27/02 • 設於炭化室不同水平處之排出口
- 27/04 • 煉焦爐裝料操作期間
- 27/06 • 導管零件，如閥門

29/00 煉焦爐之其他部件

- 29/02 • 砌磚作業，如砌磚、襯裏、牆壁
- 29/04 • 膨脹與收縮之控制及防止
- 29/06 • 防止及修復砌磚之漏洩
- 29/08 • 爐之支柱與地基

煉焦爐之裝料及卸料裝置：煤料之機械處理

31/00 煉焦爐裝料裝置

- 31/02 • 用於垂直裝料者
- 31/04 • • 臥式炭化室煉焦爐
- 31/06 • 用於水平裝料者
- 31/08 • • 臥式炭化室煉焦爐
- 31/10 • • • 帶一壓實裝料者
- 31/12 • 用於液體材料者

33/00 煉焦爐卸料裝置；焦炭導向裝置

- 33/02 • 用內裝的裝置提出焦炭，如齒輪、螺旋
- 33/04 • 拉出裝置
- 33/06 • • 用於臥式炭化室者
- 33/08 • 推出器，如推焦機
- 33/10 • • 用於臥式炭化室者
- 33/12 • 卸料閥
- 33/14 • 焦炭導向裝置

35/00 煉焦爐裝料、卸料聯合裝置

37/00 裝入爐內之煤的機械處理

- 37/02 • 平料，如用鐵條
- 37/04 • 壓緊料（在焦化期間見 47/12）
- 37/06 • 於在物料內形成孔

39/00 焦炭之冷卻或驟熄

- 39/02 • 爐外乾式冷卻
- 39/04 • 濕式驟熄
- 39/06 • • 在爐中
- 39/08 • • 焦炭驟熄塔
- 39/10 • 與攪拌裝置相結合，如旋轉台或轉筒
- 39/12 • 與傳送裝置相結合
- 39/14 • 車輛
- 39/16 • 與分選相結合
- 39/18 • 焦炭斜台

41/00 安全裝置，如用於焦炭卸料中之信號及控制裝置

- 41/02 • 用於焦炭卸料者
- 41/04 • • 用電動方法

- 41/06 · · 用氣動或液壓方法
- 41/08 · 用於排出乾餾氣體者

43/00 防止或去除積垢

- 43/02 · 去除積垢
- 43/04 · · 用機械方法
- 43/06 · · · 自導管、閥及類似部件上
- 43/08 · · 用液體
- 43/10 · · 用燒除的方法
- 43/12 · · · 燃燒器
- 43/14 · 防止積垢

45/00 其他部件

- 45/02 · 於爐外製備密實一致之煤料之裝置

碳化或焦化工藝過程

47/00 間接加熱使固體含碳物料乾餾，如用外部燃燒

- 47/02 · 對固定的物料
- 47/04 · · 於豎爐內
- 47/06 · · 於炭化爐內
- 47/08 · · 於蜂房式爐內
- 47/10 · · 於箱式煉焦爐內
- 47/12 · · 於焦化時物料受機械壓力
- 47/14 · · 借助熱液體，如熔融鹽
- 47/16 · · 於炭化爐內外均有間接加熱裝置
- 47/18 · 對移動的物料
- 47/20 · · 按“移動床”技術者（47/26 優先）
- 47/22 · · 以分散的形式（47/26 優先）
- 47/24 · · · 按“流動床”技術者
- 47/26 · · 借助熱液體，如熔融鹽
- 47/28 · 其他工藝過程
- 47/30 · · 於旋轉爐或炭化爐內
- 47/32 · · 於有機機械傳送裝置之爐內
- 47/34 · · · 帶旋轉刮動裝置
- 47/36 · · · · 於多段爐內
- 47/38 · · · 帶搖動或振動裝置
- 47/40 · · · 帶循環傳送裝置
- 47/42 · · · · 於垂直方向
- 47/44 · · · 帶螺旋傳送器

- 47/46 · · · 帶有料車、容器或料盤
- 47/48 · · · 帶傾斜或搖動裝置

49/00 以熱載體，包括待加工的固態物料之部分燃燒，直接加熱固態含碳物料之乾餾

- 49/02 · 以熱氣體或蒸汽，如用物料之部分燃燒所得的熱氣體
- 49/04 · · 於移動待處理之固態物料的情況下
- 49/06 · · · 按“移動床”技術者
- 49/08 · · · 按分散的形式
- 49/10 · · · · 按“流動床”技術者
- 49/12 · · · · 用切線方向混合者，如在旋渦燃燒室內者
- 49/14 · 以熱液體，如熔融金屬
- 49/16 · 以分開的形式移動固體熱載體
- 49/18 · · 按“移動床”技術者
- 49/20 · · 以分散的形式
- 49/22 · · · 按“流動床”技術者

51/00 以直接與間接加熱相結合的固態含碳物料之乾餾

53/00 專用於特定的固態原材料或特殊形式之固態原材料的乾餾（泥煤之濕式碳化見 C10F）

- 53/02 · 對含纖維素物料者（焦木酸之生產見 C10C 5/00）
- 53/04 · 粉煤者
- 53/06 · 油頁岩或瀝青岩者
- 53/07 · 合成聚合物材料的，例如輪胎（用乾熱處理法回收或加工的廢料，其基材是有機高分子化合物或組合物，以製得部分解聚材料者見 C08J 11/10；由橡膠或橡膠廢料製備液態碳氫混合物見 C10G 1/10）
- [8]
- 53/08 · 以壓塊、團塊或類似形式

55/00 礦物油、瀝青、焦油及類似物或其與固態含碳物料之混合物的焦化（油之裂化見 C10G）

- 55/02 · 與固態物料

C10B,C,F

55/04	• • 與移動的固態物料	57/06	• • 含有添加劑者
55/06	• • • 按”移動床”技術者	57/08	• 物料之非機械預處理
55/08	• • • 以分散形式	57/10	• • 乾燥
55/10	• • • • 按”流化床”技術者	57/12	• 焦化期間使用添加劑
57/00	其他碳化或焦化工藝過程；一般的乾餾工藝之特性	57/14	• 低溫碳化工藝過程之特徵
57/02	• 多步碳化或焦化工藝過程	57/16	• 高溫碳化工藝過程之特徵
57/04	• 使用特殊成分之物料	57/18	• 爐中乾餾氣性能之改良
-

C10C 焦油，焦油瀝青，石油瀝青，天然瀝青之加工；焦木酸

1/00	焦油之加工（製取烴油見 C10G）	之加工	
	[4]		
1/02	• 水之去除（用蒸餾見 1/06）	3/02	• 用化學方法
1/04	• 用蒸餾方法	3/04	• • 用吹氣或氧化
1/06	• • 水的去除	3/06	• 用蒸餾
1/08	• • 取得芳族餾分	3/08	• 用選擇萃取
1/10	• • • 苯餾分	3/10	• 熔化
1/12	• • • 萘餾分	3/12	• • 所用設備
1/14	• • 由煤焦油取得煤餾油	3/14	• 固化；破碎，如粒化
1/16	• • 取得石油瀝青	3/16	• • 與液體直接接觸
1/18	• 用選擇性溶劑萃取	3/18	• 自反應器、容器及類似設備內以固體形狀移出，如用切割，用壓製方法
1/19	• 用蒸餾以外之熱處理法 [4]		
1/20	• 用化學法提煉	5/00	焦木酸的製造（木材之碳化見 C10B）
3/00	焦油瀝青，石油瀝青、天然瀝青		
-

C10F 泥煤之乾燥或加工

5/00	泥煤之乾燥或脫水	7/00	泥煤之加工（由泥煤中抽提蠟見 C10G）
5/02	• 於現場；所用的輔助設備	7/02	• 泥煤之分解（由泥煤中取得纖維見 D01B1/50）
5/04	• 使用壓榨機，帶式壓榨機，軋輥，或離心機（模製見 7/04）	7/04	• 用模製
5/06	• 與碳化步驟相結合以製造泥碳	7/06	• • 壓製成塊
		7/08	• 與切割相結合的擠壓
-

C10G 煙油裂解；液態煙混合物之製備，例如，利用破壞性氫化反應，低聚反應，聚合反應（裂解成氫或合成氣見 C01B；煙氣體裂解或熱解成各別煙類或其特定組成之混合物見 C07C；裂解成焦炭見 C10B）；由油頁岩、油砂或油氣中回收煙油；含煙類為主之混合物的精製；石腦油之重組；礦物蠟 [6]

附註

- (1) 於本次類內：
 - 9/00 至 49/00 各目僅限有關一步工藝過程的發明； [3]
 - 聯合的或多步工藝過程之發明包括於 51/00 至 69/00 各目內； [3]
 - 礦物蠟之精製或回收包括於 73/00 目內。[3]
- (2) 於本次類內，使用下列術語，其含意表示：
 - “存在氫之情況下“或”不存在氫之情況下“意指於工藝過程中分別地加入或不加入游離氫、加入或不加入可產生氫之化合物。[3]
 - “加氫處理”用於 45/00 或 47/00 目內所指的轉化工藝過程。[3]
 - “煙油”包括煤焦油或礦物油之煙類混合物。[3]
- (3) 於本次類內，適用末位規則，即各階層中，如無相反指示時，發明請放入最後適當位置。[3]

次類索引

液態煙混合物之製造 1/00 至 5/00，50/00	其他工藝過程..... 31/00，32/00，33/00
煙油之蒸餾..... 7/00	重組 35/00，59/00 至 63/00
裂化..... 9/00 至 15/00，47/00	多步工藝過程..... 51/00 至 69/00
煙油之精製	其他工藝處理..... 70/00，71/00
用酸、用鹼處理..... 17/00，19/00	礦物蠟之處理..... 73/00
用溶劑或吸附性固體萃取..... 21/00，25/00	抑制腐蝕..... 75/00
用與氫反應，用氧化作用或其他	本次類各目中不包括的技術主
化學反應..... 27/00，29/00，45/00，49/00，	題..... 99/00

1/00 由油頁岩、油砂或非熔的固態含碳物料或類似物類，如木材、煤，製造液態煙混合物（由油頁岩、油砂及類似物用機械方法取得油見 B03B）

- 1/02 • 用蒸餾方法
- 1/04 • 用萃取法
- 1/06 • 用破壞性加氫
- 1/08 • • 用移動催化劑

1/10 • 從橡膠或橡膠廢料

2/00 由碳之氧化物製備組成不確定的液態煙混合物 [5]

3/00 由含氧的有機物製備液態煙混合物，如由脂肪油，脂肪酸（由不熔的含氧之含碳固態物料製備見 1/00）

5/00 由氣體，如自天然氣中回收液態

煙混合物

- 5/02 • 用固體吸附劑
- 5/04 • 用液體吸收劑
- 5/06 • 用冷卻或壓縮法

7/00 煙油之蒸餾

- 7/02 • 用分餾去除氣體以穩定汽油
- 7/04 • 脫水
- 7/06 • 真空蒸餾 [3]
- 7/08 • 共沸蒸餾或萃取蒸餾（於不存在氫之情況下，採用選擇性溶劑萃取精製煙油見 21/00）[3]
- 7/10 • 蒸餾時防止腐蝕（一般的防腐見 C23F）[3]
- 7/12 • 控制或調節 [3]

不存在氫之情況下的裂化**9/00 於不存在氫之情況下，煙油之非催化熱裂化**

- 9/02 • 於乾餾釜內
- 9/04 • • 乾餾釜
- 9/06 • 用加壓蒸餾
- 9/08 • • 所用設備
- 9/12 • • • 去除積垢
- 9/14 • 於帶有或不帶有輔件之管內或盤管中，例如蒸煮器，裂化反應塔，膨脹器
- 9/16 • • 防止或去除積垢
- 9/18 • • 設備
- 9/20 • • • 管式爐
- 9/24 • 用電加熱法
- 9/26 • 用不連續預熱的不移動的固態物料，如噴氣及運行
- 9/28 • 用預熱的移動的固體物料
- 9/30 • • 按照“移動床”技術者
- 9/32 • • 按照“流動床”技術者
- 9/34 • 用與惰性的經預熱的流體直接接觸，如用熔融金屬或熔融鹽
- 9/36 • • 用熱之氣體或蒸氣
- 9/38 • • • 由待裂化物料之部分燃燒或另一種煙之燃燒產生 [2]
- 9/40 • 與除熱燃燒氣體外之經預熱的流

體之間接接觸

- 9/42 • 將待裂化的物料以細流或噴霧狀通至連續加熱之表面或表面附近

11/00 於不存在氫之情況下、煙油之催化裂化（與熔融金屬或熔融鹽直接接觸的裂化見 9/34）

- 11/02 • 以所用的催化劑為特徵者
- 11/04 • • 氧化物
- 11/05 • • • 晶狀矽鋁酸鹽，如分子篩 [3]
- 11/06 • • 硫化物
- 11/08 • • 鹵化物
- 11/10 • 用固定催化劑床
- 11/12 • 用不連續預熱的不移動的固態催化劑，如送風與運行
- 11/14 • 用經預熱的移動的固態催化劑
- 11/16 • • 按“移動床”技術者
- 11/18 • • 按“流動床”技術者
- 11/20 • 與惰性加熱氣體或蒸汽直接接觸
- 11/22 • • 由待裂化的物料之部分燃燒產生

15/00 用電方法、電磁或機械振動、用粒子輻射或用於電弧內過熱的氣體進行煙油之裂化

- 15/08 • 用電或電磁或機械振動之方法 [3]
- 15/10 • 用粒子輻射 [3]
- 15/12 • 用於電弧內過熱的氣體，如電漿 [3]

於不存在氫之情況下精製**17/00 於不存在氫之情況下，用酸、酸式化合物或含酸液體，如酸渣，精製煙油**

- 17/02 • 用酸或含酸液體，如酸渣
- 17/04 • • 形成不相混的兩相之液一液處理
- 17/06 • • • 使用硫之衍生酸或其酸渣
- 17/07 • • • 使用氫鹵酸或鹵之含氧酸（生成鹵素之酸見 27/02）[3]
- 17/08 • 用成酸氧化物（用 CO₂ 或 SO₂

作為選擇性溶劑之精製見 21/06)

- 17/085 • • 用發煙硫酸 [3]
- 17/09 • 用酸式鹽 [3]
- 17/095 • 用“固體酸”，如沉積於載體上之磷酸 [3]
- 17/10 • 回收用過的精製劑

19/00 於不存在氫之情況下，用鹼處理精製烴油

- 19/02 • 用鹼性水溶液
- 19/04 • • 含增溶劑，如溶解加速劑
- 19/06 • • 用鉛酸鹽或高鉛酸鹽
- 19/067 • 用熔化的鹼性物料 [3]
- 19/073 • 用固態鹼性物料 [3]
- 19/08 • 回收用過的精製劑

21/00 於不存在氫之情況下，用選擇性之溶劑萃取精製烴油（17/00、19/00 優先）

- 21/02 • 用兩種或兩種以上溶劑分別地加入或排出者
- 21/04 • • 以彼此逆流之方式同時加入至少兩種不相溶混的溶劑
- 21/06 • 以所用的溶劑為特徵者
- 21/08 • • 僅用無機化合物
- 21/10 • • • 二氧化硫
- 21/12 • • 僅用有機化合物
- 21/14 • • • 烴類
- 21/16 • • • 含氧化合物
- 21/18 • • • 含鹵化合物
- 21/20 • • • 含氮化合物
- 21/22 • • • 含硫、硒或碲之化合物
- 21/24 • • • 含磷化合物
- 21/26 • • • 含矽化合物
- 21/27 • • • 於 21/14 至 21/26 內之單一
目內中所不包括的有機化
合物 [3]
- 21/28 • 回收用過的溶劑 [3]
- 21/30 • 控制或調節 [5]

25/00 於不存在氫之情況下，用固體吸附劑精製烴油

當分類至本次目時，就與色層分析相關的一般意義的技術主題而言，還應該分類至 B01D 15/08。[8]

- 25/02 • 用離子交換材料
- 25/03 • • 用晶狀矽鋁酸鹽，如分子篩[3]
- 25/05 • • • 去除非烴類化合物，如硫化物 [3]
- 25/06 • 用移動的吸附劑或分散於油中之
吸附劑
- 25/08 • • 按“移動床”技術者
- 25/09 • • 按“流動床”技術者 [3]
- 25/11 • • 於有移動的吸附劑之情況下的
蒸餾 [3]
- 25/12 • 回收用過的吸附劑

27/00 於不存在氫之情況下，用氧化法精製烴油

- 27/02 • 用鹵素或產生鹵素之化合物；次
氯酸或其鹽
- 27/04 • 用氧或產生氧之化合物
- 27/06 • • 於鹼溶液之存在下
- 27/08 • • 於氯化銅之存在下
- 27/10 • • 於存在金屬有機配合物情況
下，如螯合物、或陽離子交換
樹脂 [3]
- 27/12 • • 用產生氧之化合物，如過化
物、鉻酸鹽（鉛酸鹽或高鉛酸
鹽見 19/06）[3]
- 27/14 • • 用含臭氧之氣體 [3]

29/00 於不存在氫之情況下，用其他化學品精製烴油

- 29/02 • 非金屬
- 29/04 • 金屬或沉積於載體上之金屬
- 29/06 • 金屬鹽或沈積於載體上之金屬鹽
- 29/08 • • 含低價金屬者
- 29/10 • • 硫化物
- 29/12 • • 鹵化物 [3]
- 29/16 • 金屬氧化物
- 29/20 • 不含金屬原子之有機化合物
- 29/22 • • 含有氧作為僅有的雜原子者
- 29/24 • • • 醛或酮
- 29/26 • • 鹵化烴

附註

- 29/28 • • 含有硫作為僅有的雜原子者，
如硫醇，或硫及氧作為僅有的
雜原子

**31/00 於不存在氫之情況下，用其他未
提及的方法精製煙油（用蒸餾見
7/00） [2]**

- 31/06 • 用加熱、冷卻或加壓處理
31/08 • 用水處理 [3]
31/09 • 用過濾法 [3]
31/10 • 借助離心力
31/11 • 用滲析法 [3]

**32/00 用電法或磁法，用輻射光，或用
微生物方法精製煙油 [3]**

- 32/02 • 用電或磁之方法
32/04 • 用粒子輻射法 [3]

**33/00 煙油之脫水或破乳化（蒸餾法見
7/04）**

- 33/02 • 用電或磁之方法
33/04 • 用化學方法
33/06 • 用機械方法，如過濾
33/08 • 控制或調節[3]

35/00 石腦油之重整

附註

本主目內所用的術語之含意係
指：“重整”係為改進石腦油之
辛烷值或其芳烴含量而對石腦
油之加工處理 [3]

- 35/02 • 熱重整
35/04 • 催化重整
35/06 • • 以所用催化劑為特徵者
35/085 • • • 含有鉑族金屬或此等之化合
物 [3]
35/09 • • • • 至少有一金屬為鉑族之雙
金屬催化劑 [3]
35/095 • • • 含晶狀矽鋁酸鹽，如分子篩
[3]
35/10 • • 用移動的催化劑
35/12 • • • 按“移動床”技術者
35/14 • • • 按“流動床”技術者

- 35/16 • 用電、電磁或機械振動；用粒子
輻射

- 35/22 • 重整操作之開車 [3]

- 35/24 • 重整操作之控制或調節[3]

加氫處理之工藝過程

**45/00 用氫或生成氫之化合物精製煙
油 [3]**

附註

於 45/02，45/32，45/44 或 45/58
目之單一目中未包括的產生氫
之化合物存在的情況下處理煙
油，包括於 49/00 目內 [3]

- 45/02 • 去除雜原子，而無需改變有關煙
之骨架及裂解成低沸點的煙；加
氫精製 [3]
45/04 • • 以所用的催化劑為特徵者
45/06 • • • 含鎳或鈷金屬，或其化合物
者 [3]
45/08 • • • • 與鉻、鉬或鎢金屬或此等
之化合物相結合 [3]
45/10 • • • 含鉑族金屬或其化合物者[3]
45/12 • • • 含晶狀矽鋁酸鹽，如分子篩
[3]
45/14 • • 用移動的固體粒子 [3]
45/16 • • • 懸浮於油中者，如漿液 [3]
45/18 • • • 按“移動床”技術者 [3]
45/20 • • • 按“流動床”技術者 [3]
45/22 • • 用溶解或懸浮於油之氫 [3]
45/24 • • 用生成氫之化合物 [3]
45/26 • • • 水蒸氣或水 [3]
45/28 • • • 有機化合物：由氫精製 [3]
45/30 • • • • 以所用的催化劑為特徵者
[3]
45/32 • 二烯或炔烴化合物之選擇性加氫
[3]
45/34 • • 以所用的催化劑為特徵者 [3]
45/36 • • • 含鎳或鈷金屬，或其化合物
者 [3]
45/38 • • • • 與鉻、鉬或鎢金屬或與此
等之化合物相結合 [3]

- 45/40 . . . 含鉑族金屬或其化合物 [3]
- 45/42 . . 用移動的固體粒子 [3]
- 45/44 . 芳烴之加氫 [3]
- 45/46 . . 以所用的催化劑為特徵者 [4]
- 45/48 . . . 含鎳或鈷金屬或此等之化合物 [3]
- 45/50 與鉻、鉬或鎢金屬結合或與此等之化合物結合 [3]
- 45/52 . . . 含鉬族金屬或此等之化合物者 [3]
- 45/54 . . . 含晶狀之矽鋁酸鹽者，如分子篩 [3]
- 45/56 . . 用移動固體粒子 [3]
- 45/58 . 改變某些所含烴之結構骨架，而不使另一部分所存的烴裂解，如降低傾點；正構烷烴之選擇性加氫裂化（32/00 優先；改進或增加石腦油之辛烷值或芳烴含量見 35/00） [3]
- 45/60 . . 以所用的催化劑為特徵者 [3]
- 45/62 . . . 含鉑族金屬或此等之化合物 [3]
- 45/64 . . . 含結晶之矽鋁酸者，如分子篩 [3]
- 45/66 . . 用移動固體粒子 [3]
- 45/68 . . 烴油餾分之芳構化 [3]
- 45/70 . . . 用含鉑族金屬或此等之化合物之催化劑。[3]
- 45/72 . 控制或調節 [3]
- 47/00 於存在氫或存在生成氫之化合物的情況下，為獲得低沸點之餾份的烴油裂解（15/00 優先；非熔的含碳固態物質之類似物的破壞性氫化見 1/06） [3]**
- 47/02 . 以所用的催化劑為特徵 [3]
- 47/04 . . 氧化物 [3]
- 47/06 . . 硫化物 [3]
- 47/08 . . 鹵化物 [3]
- 47/10 . . 用沉積於載體上之催化劑 [3]
- 47/12 . . . 無機載體 [3]
- 47/14 含鉑族金屬或其化合物之催化劑 [3]
- 47/16 結晶矽鋁酸鹽載體 [3]
- 47/18 含鉑族金屬或其等之化合物之催化劑 [3]
- 47/20 含其他金屬或此等之化合物之催化劑 [3]
- 47/22 . 於存在氫之情況下非催化裂解 [3]
- 47/24 . 用移動固體粒子 [3]
- 47/26 . . 懸浮於油中者，如漿液 [3]
- 47/28 . . 按“移動床”技術者 [3]
- 47/30 . . 按“流化床”技術者 [3]
- 47/32 . 於存在產生氫之化合物的情況下 [3]
- 47/34 . . 有機化合物，如經氫化的烴類 [3]
- 47/36 . 控制或調節[3]
- 49/00 於存在氫或產生氫之化合物的情況下，於 45/02，45/32，45/44，45/58 或 47/00 單一內未包括的烴油之處理 [3]**
- 49/02 . 以所用的催化劑為特徵者 [3]
- 49/04 . . 含鎳、鈷、鉻、鉬或鎢金屬或此等化合物者 [3]
- 49/06 . . 含鉑族金屬或此等化合物 [3]
- 49/08 . . 含結晶矽鋁酸鹽者，如分子篩 [3]
- 49/10 . 用移動固體粒子 [3]
- 49/12 . . 懸浮於油中者，如漿液 [3]
- 49/14 . . 按“移動床”技術者 [3]
- 49/16 . . 按“流化床”技術者 [3]
- 49/18 . 於產生氫之化合物的存在下，如氫、水、硫化氫 [3]
- 49/20 . . 有機化合物 [3]
- 49/22 . 流出物之分離 [3]
- 49/24 . 加氫處理之操作的開車 [3]
- 49/26 . 控制與調節[3]
- 50/00 由低碳數烴製備液態烴混合物，例如，利用低聚反應[6]**
- 50/02 . 製備潤滑目的之烴油 [6]

多步驟方法

附註

- 51/00 至 69/00 目僅涵蓋指出各步驟反應過程之間的關係之結合處理操作。 [3]
- 51/00 於不存在氫之情況下，僅用兩步或多步裂解工藝過程處理煙油 [3]**
- 51/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 51/04 • • 僅包括熱裂解及催化裂化步驟者 [3]
- 51/06 • 僅多級並聯者 [3]
- 53/00 於不存在氫之情況下，用兩步或多步精製工藝過程處理煙油 [3]**
- 53/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 53/04 • • 至少包括一個萃取工藝步驟者 [3]
- 53/06 • • • 僅包括萃取步驟，如芳烴萃取後接溶劑脫瀝青之處理 [3]
- 53/08 • • 至少包括一個吸附步驟者 [3]
- 53/10 • • 至少包括一個酸處理步驟者 [3]
- 53/12 • • 至少包括一個鹼處理步驟者 [3]
- 53/14 • • 至少包括一個氧化步驟者 [3]
- 53/16 • 僅多級並聯工藝過程者 [3]
- 55/00 於不存在氫之情況下，用至少一個精製過程及至少一個裂解過程處理煙油 [3]**
- 55/02 • 僅多級串聯工藝過程者 [3]
- 55/04 • • 至少包括一個熱裂解步驟者 [3]
- 55/06 • • 至少包括一個催化裂化步驟者 [3]
- 55/08 • 僅多級並聯工藝過程者 [3]
- 57/00 於不存在氫之情況下，用至少一個裂解工藝過程或精製工藝過程及至少一個其他轉化過程處理煙油 [3]**
- 57/02 • 用聚合反應 [3]
- 59/00 僅用兩個或多個重整工藝過程或用至少一個重整工藝過程及**
- 一個實施上不改變石腦油沸程之工藝過程處理石腦油 [3]**
- 59/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 59/04 • • 至少包括一個催化重整與至少一個非催化重整步驟者 [3]
- 59/06 • 僅多級並聯者 [3]
- 61/00 於不存在氫之情況下，用至少一個重整工藝過程及至少一個精製工藝過程處理石腦油 [3]**
- 61/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 61/04 • • 精製步驟為萃取 [3]
- 61/06 • • 精製步驟為吸附 [3]
- 61/08 • 僅多級並聯者 [3]
- 61/10 • 尚包括其他轉化步驟之的工藝過程 [3]
- 63/00 用至少一個重整工藝過程及至少一個其他轉化步驟之工藝過程處理石腦油 (59/00、61/00 優先) [3]**
- 63/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 63/04 • • 至少包括一個裂解步驟 [3]
- 63/06 • 僅多級並聯者 [3]
- 63/08 • • 至少包括一個裂解步驟 [3]
- 65/00 僅用二個或多個加氫處理工藝過程處理煙油 [3]**
- 65/02 • 僅多步串聯者 [3]
- 65/04 • • 僅包括精製步驟者 [3]
- 65/06 • • • 至少有一個步驟係二烯烴選擇性加氫 [3]
- 65/08 • • • 至少有一個步驟係芳烴加氫 [3]
- 65/10 • • 僅包括裂解步驟者 [3]
- 65/12 • • 包括裂解步驟及其他加氫處理步驟者 [3]
- 65/14 • 僅多級並聯者 [3]
- 65/16 • • 僅包括精製步驟 [3]
- 65/18 • • 僅包括裂解步驟 [3]
- 67/00 用至少一個加氫處理工藝過程及至少一個僅於不存在氫之情況下的精製過程處理煙油 [3]**

- 67/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 67/04 • • 於不存在氫之情況下，包括有一溶劑萃取作為精製步驟者 [3]
- 67/06 • • 於不存在氫之情況下，包括一個吸附工藝過程作為精製步驟者 [3]
- 67/08 • • 於不存在氫之情況下，包括一酸處理工藝過程作為精製步驟者 [3]
- 67/10 • • 於不存在氫之情況下，包括一鹼處理工藝過程作為精製步驟者 [3]
- 67/12 • • 於不存在氫之情況下，包括一氧化反應作為精製步驟者 [3]
- 67/14 • • 於不存在氫之情況下，包括至少有兩個不同的精製步驟者 [3]
- 67/16 • 僅多級並聯者 [3]
- 69/00 用至少一個加氫處理工藝過程及至少一個其他的轉化步驟處理烴油（67/00 優先）[3]**
- 69/02 • 僅多級串聯者 [3]
- 69/04 • • 不存在氫之情況下，至少包括一個催化裂化步驟者 [3]
- 69/06 • • 不存在氫之情況下，至少包括一個熱裂解步驟者 [3]
- 69/08 • • 至少包括一個石腦油重整步驟者 [3]
- 69/10 • • • 高沸點餾分加氫裂解成石腦油及所得的石腦油重整 [3]
- 69/12 • • 至少包括一個聚合反應或烷基化步驟者 [3]
- 69/14 • 僅多級並聯者 [3]

- 70/00 由 9/00、11/00、15/00、47/00、51/00 目內包括的方法製得的不確定的正常氣體混合物之加工 [5]**
- 70/02 • 用氫化 [5]
- 70/04 • 用物理方法 [5]
- 70/06 • • 通過氣液接觸 [5]

- 71/00 用其它未提及的方法處理潤滑用之烴油或脂肪油[3]**
- 71/02 • 用無聲放電處理法增稠（用無聲放電化學改性乾油見 C09F 7/04）[3]
- 73/00 礦物蠟之回收或精製，如地蠟（以蠟為主之組合物見 C08L 91/00）[3]**
- 73/02 • 烴油內之石油蠟的回收；烴油之脫蠟 [3]
- 73/04 • • 用助濾劑 [3]
- 73/06 • • 用溶劑 [3]
- 73/08 • • • 有機化合物 [3]
- 73/10 • • • • 烴 [3]
- 73/12 • • • • 含氧化合物 [3]
- 73/14 • • • • 含鹵素化合物 [3]
- 73/16 • • • • 含氮化合物 [3]
- 73/18 • • • • 含硫、硒、碲者 [3]
- 73/20 • • • • 含磷者 [3]
- 73/22 • • • • 有機化合物之混合物 [3]
- 73/23 • • • 已使用過溶劑之回收 [6]
- 73/24 • • 用形成加合物之方法 [3]
- 73/26 • • 用浮選法 [3]
- 73/28 • • 用離心力 [3]
- 73/30 • • 用電之方法 [3]
- 73/32 • • 脫蠟時之冷卻方法 [3]
- 73/34 • • 控制或調節 [3]
- 73/36 • 由其它含少量油之組合物、由濃縮物或由殘油內回收石油蠟；脫油；發油 [3]
- 73/38 • 石油蠟之化學改性 [3]
- 73/40 • 蠟或改性蠟之物理處理，如粒化、分散、乳化、光輻射 [3]
- 73/42 • 石油蠟之精製 [3]
- 73/44 • • 於氫或產生氫之化合物之存在下 [3]
- 75/00 烴類處理或轉化裝置之腐蝕或污染之一般抑制（7/10、9/16 優先）[6]**
- 75/02 • 利用防蝕劑之添加 [6]
- 75/04 • 利用抗污劑之添加 [6]
- 99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [8]**

C10H 乙炔之濕法生產[5]

次類索引

發生器	(Doberiner)型	7/00 , 9/00
非自動給水	其他型式	11/00 至 19/00
自動給水	零部件	21/00
基普(Kipp)或多伯林納		
1/00 具滴下式、重力式、非自動式給水器的乙炔發生器	細管給水)	
1/02 • 閥門	9/04 • 由儲氣罐操縱的氣體旋塞	
1/04 • • 螺旋閥	9/06 • 以儲氣罐調節氣體出口管之高度	
1/06 • • 旋塞	[1,2006.01]	
1/08 • 其他控制給水之設施	9/08 • 帶可移動的儲氣罐	
1/10 • 通過一個中心管或側管由上部給水	9/10 • 僅於底部濕潤碳化鈣者	
1/12 • 通過多孔材料由上部給水	11/00 碳化鈣浸沒於水中之乙炔發生器	
3/00 用不屬儲氣罐之部件自動調節給水的乙炔發生器 [1,2006.01]	11/02 • 於儲氣罐內部	
3/02 • 帶隔膜者	11/04 • 密封水與反應水彼此分開者	
3/04 • 帶浮筒者	13/00 浸液式與逐滴加入式相結合的乙炔發生器	
3/06 • 帶活塞者	15/00 帶或不帶氣壓調節碳化鈣供料之乙炔發生器 [1,2006.01]	
5/00 用儲氣罐自動調節給水之乙炔發生器 [1,2006.01]	15/02 • 非自動供給碳化鈣	
5/02 • 帶溢水流道者	15/04 • • 裝料斗上之關閉裝置	
5/04 • 與儲氣罐相連接的逐滴加水之閥	15/06 • 以閥門自動供給碳化鈣	
5/06 • • 用與儲氣罐相連接的逐滴加水之旋塞	15/08 • • 用閘閥或滑閥	
5/08 • 帶有與儲氣罐相連接的浸沒式閥門或旋塞	15/10 • • 用浮閥	
	15/12 • • 用計量閥，包括袋輪	
	15/14 • 帶進料螺桿或進料輸送器	
	15/16 • 帶進料鼓輪	
	15/18 • 帶可移動的進料盤及固定的碳化鈣容器	
	15/20 • 以筒或其他包裝形式供給碳化鈣	
7/00 以基普氏原理給水的乙炔發生器	15/22 • 由貯罐或通過儲氣罐供給粉狀碳化鈣	
7/02 • 自下部給水	15/24 • 用活塞供給碳化鈣	
7/04 • 自上部給水	17/00 高壓乙炔發生器	
9/00 按多伯林納氏原理、裝有碳化鈣裝料鐘之乙炔發生器	19/00 其他乙炔發生器	
9/02 • 通過多孔物質自下部給水（用毛	19/02 • 轉動的碳化鈣貯罐	

21/00	乙炔發生器之零部件；濕法生產乙炔之附屬設備或特徵	21/08	• 乙炔發生器之安全裝置
21/02	• 用於發生器內之電石的包裝，如料筒	21/10	• 碳化鈣組合物
21/04	• • 將包裝物放入發生器	21/12	• 氣體密封裝置，如發生器之液封
21/06	• • • 開啟發生器內包裝物之裝置	21/14	• 通風裝置；冷卻裝置
		21/16	• 由發生器去除殘渣

C10J 由固態含碳物料與氧氣或蒸汽行部份氧化反應以製造含一氧化碳及氫氣之氣體（礦物地下氣化見 E21B 43/295）；混合碳化物之空氣或其他氣體 [5]

1/00	用空氣或其他氣體混合碳化物以製造燃料氣（用於內燃機者見 F02M）		行部份氧化反應以製造含一氧化碳及氫氣之氣體，例：合成氣或煤氣（乾餾工藝過程見 C10B）
1/02	• 空氣增熱化	3/02	• 塊狀燃料之固定床氣化
1/04	• • 供給空氣之控制	3/04	• • 循環工藝過程，例如交替送風與運行
1/06	• • 用常溫下呈液態之物料	3/06	• • 連續工藝過程
1/08	• • • 將空氣通過液體或通向液體表面	3/08	• • • 液態除灰
1/10	• • • • 用吸收於載體上之液體	3/10	• • • 使用外部加熱
1/12	• • • 用液體之霧化	3/12	• • • 使用固體熱載體
1/14	• • • 根據空氣之供給以控制液體的供給	3/14	• • • 使用氣體之熱載體
1/16	• • 用固態烴類(1/207、1/213 優先)	3/16	• • • 同時用氧及水與含碳物料反應
1/18	• • 於旋轉的增熱化器內	3/18	• • • 使用電
1/20	• 除空氣外的氣體增熱化	3/20	• • 設備；裝置
1/207	• 在燃料堆中，藉由固態含碳物料行裂解反應以進行碳化物混合(3/66 優先) [2012.01]	3/22	• • • 閥與煙道之安排與布置
1/213	• 在汽化器中，藉由固態含碳物料行裂解反應以進行碳化物混合 [2012.01]	3/24	• • • • 允許氣體或蒸汽除向上流經通過燃料層
1/22	• 以防止蒸汽沉積的添加料	3/26	• • • • • 向下
1/24	• 控制經增熱化的空氣或氣體之濕度	3/28	• • • • 全自動者
1/26	• 採用增高的溫度或壓力(1/207、1/213 優先)	3/30	• • • 燃料加料裝置
1/28	• 加味風煤氣	3/32	• • • 攪動燃料床層使燃料均勻地分布在燃料床層上之裝置
3/00	由固態含碳物料與氧氣或蒸汽	3/34	• • • 爐柵；機械除灰裝置
		3/36	• • • • 固定爐柵
		3/38	• • • • • 附攪動桿者
		3/40	• • • • 可移動的爐柵
		3/42	• • • • • 旋轉爐柵
		3/44	• • • 適用於車輛上者

C10J

- 3/46 • 在懸浮狀態下粒狀或粉狀燃料之
氣化
- 3/48 • • 設備；裝置
- 3/50 • • • 燃料加料裝置
- 3/52 • • • 除灰裝置
- 3/54 • • 用文克勒（Winkler）技術，即
用流態化，氣化粒狀或粉狀燃
料
- 3/56 • • • 設備；裝置
- 3/57 • 用融鹽或熔融金屬氣化（3/02、
3/46 優先）[4]
- 3/58 • 與燃料之預乾餾相結合
- 3/60 • • 工藝過程
- 3/62 • • • 分離排出的乾餾產物
- 3/64 • • • 乾餾產物之分解
- 3/66 • • • • 用將產物引入氣化區之方
法
- 3/72 • 其他特徵
- 3/74 • • 殼體或夾套之結構
- 3/76 • • • 水夾套；蒸汽鍋爐夾套
- 3/78 • • 高壓設備
- 3/80 • • 附預熱鼓風或水蒸發裝置
- 3/82 • • 燃料氣引出裝置
- 3/84 • • • 附自燃料氣中除塵或焦油之
裝置
- 3/86 • • 與廢熱鍋爐相結合

C10K 含一氧化碳可燃氣體化學組合物之淨化及改良

1/00	含一氧化碳可燃氣體之純化 （由含氫與一氧化碳混合物中分離出氫見 C01B 3/50）	1/26	• • 淨化物料之再生
		1/28	• • 控制流經淨化器之氣體流量
		1/30	• • 用移動的淨化物質
1/02	• 除塵	1/32	• 選擇有吸收力之固體；如活性碳
1/04	• 冷卻冷凝非氣體物料	1/34	• 雜質之催化轉化，使成更易除去的物質
1/06	• • 與用水噴霧相結合		
1/08	• 用液體洗滌；用過洗液之再生	3/00	含一氧化碳可燃氣體之化學組合物的改良，以產生改良燃料，如一種不同熱值、可不含一氧化碳之燃料
1/10	• • 用含水液體		
1/12	• • • 鹼性反應		
1/14	• • • • 有機者		
1/16	• • 用無水之液體	3/02	• 用催化處理
1/18	• • • 烴油類	3/04	• • 降低一氧化碳含量
1/20	• 用固體處理；用過的淨化物之再生	3/06	• 與其他氣體混合
1/22	• • 設備，如乾式箱式淨化器		
1/24	• • • 淨化物料之支撐方法		

C10L 其他類目不包括之燃料；天然氣；用 C10G 或 C10K 次類不包括的方法而得的合成天然氣；液化石油氣；在燃料或火焰中使用添加劑；引火物 [5]

1/00	液體含碳燃料		分類。[8]
1/02	• 基於僅由碳、氫、及氧組成的成份為主者		(3)化合物之金屬鹽或胺鹽按化合物分類，如磺酸銨係按磺酸鹽進行分類，入 1/24 目，而不入 1/30 目。
1/04	• 基於烴類混合物為主者		
1/06	• • 用於火花點火		
1/08	• • 用於壓縮點火		
1/10	• 含添劑者	1/12	• • 無機化合物
附註		1/14	• • 有機化合物
	(1)於 1/12 至 1/14 目內，適用末位規則，即在各階層中，如無相反指示時，化合物請放入最後適當位置。	1/16	• • • 烴類者
	(2)如果添加劑是多種化合物的混合物，則每種重要的化合物都應	1/18	• • • 含氧者
		1/182	• • • • 含羥基；其鹽 [8]
		1/183	• • • • • 至少一個與芳香碳原子連接的羥基 [8]
		1/185	• • • • 醚；縮醛；縮酮；醛；酮 [8]
		1/188	• • • • 羧酸；其鹽 [8]

- 1/189 至少一個與芳香碳原子連接的羧基 [8]
- 1/19 酯 [8]
- 1/192 高分子化合物 [8]
- 1/195 由僅涉及碳—碳不飽和鍵的反應製得者 [8]
- 1/196 由含有碳—碳不飽和鍵和羧基或其鹽、酞或酯的單體衍生者 [8]
- 1/197 由含有碳—碳不飽和鍵和飽和羧酸或碳酸的鹽氧基的單體衍生者 [8]
- 1/198 由僅涉及碳—碳不飽和鍵以外的反應製得者 [8]
- 1/20 含鹵素者
- 1/22 含氮者
- 1/222 至少含一個碳—氮單鍵 [8]
- 1/223 至少有一個與芳香碳原子連接的胺基 [8]
- 1/224 醯胺；醯亞胺 [8]
- 1/226 至少含一個氮—氮鍵，例如偶氮化合物、疊氮、肼 [8]
- 1/228 至少含一個碳—氮鍵，例如胍、脲、縮胺基脲、醯亞胺；至少含碳—氮三鍵，例如脒 [8]
- 1/23 至少含一個氮—氧鍵，例如硝基化合物、硝酸鹽、亞硝酸鹽 [8]
- 1/232 在雜環上含氮 [8]
- 1/233 環上含氮和氧，例如噁唑 [8]
- 1/234 高分子化合物 [8]
- 1/236 由僅涉及碳—碳不飽和鍵的反應製得者 [8]
- 1/238 由僅涉及碳—碳不飽和鍵以外的反應製得者 [8]
- 1/2383 聚胺或聚亞胺，或其衍生物 [8]
- 1/2387 聚氧化烯胺 [8]
- 1/24 含硫、硒或碲者
- 1/26 含磷者
- 1/28 含砷者
- 1/30 含 1/16 至 1/28 各目未指出的元素者
- 1/32 由煤—油懸浮液或水乳液所組成者
- 3/00 氣體燃料，天然氣，用不包括於次類 C10G、C10K 之方法而得的合成天然氣；液化石油氣 [5]**
- 3/02 含乙炔之組合物
- 3/04 吸收的組合物，如溶劑
- 3/06 天然氣；用不包括於 C10G、C10K 3/02 或 3/04 之方法而得的合成天然氣 [5]
- 3/08 合成天然氣之生產
- 3/10 加工天然氣或合成天然氣 [5]
- 3/12 液化石油氣 [5]
- 5/00 固體燃料（由流體燃料固化製成者見 7/00；泥煤磚見 7/06）**
- 5/02 以含碳之礦物質為主所組成的煤磚（泥煤磚見 C10F）
- 5/04 所用的原料；其預處理
- 5/06 製塊工藝過程
- 5/08 不借助於外加的黏合劑 5/10 借助於黏合劑，如以預處理的黏合劑
- 5/12 用無機黏合劑
- 5/14 用有機黏合劑
- 5/16 用瀝青類之黏合劑，如焦油，焦油瀝青
- 5/18 用萘
- 5/20 用亞硫酸鹽鹼液
- 5/22 將黏合劑用於其他配料之方法；及其設備
- 5/24 製塊時之防塵；防爆安全裝置
- 5/26 煤磚之後處理
- 5/28 煤磚之加熱；黏合劑之燒結

5/30 . . . 煤磚之冷卻

5/32 . . . 塗層

5/34	• • 煤磚之其他方面	9/12	• • 氧化劑，如產生氧之化合物
5/36	• • • 形狀	10/00	為特殊目的在燃料和火焰中使用添加劑 （借助黏合劑製備磚狀固體燃料見 C10L 5/10，使用添加劑改進固體燃料燃燒見 C10L 9/10）[1, 8]
5/38	• • • • 由不同的層組成煤磚	10/02	• 為減少煙灰之產生
5/40	• 基於非礦物來源為主的物質	10/04	• 為減少腐蝕或積垢者
5/42	• • 基於動物之物質或由其而得的產物	10/06	• 為易於除去煙灰者
5/44	• • 基於植物之物質	10/08	• 為提高潤滑性；為降低磨損 [8]
5/46	• • 基於污物，家庭或城市之垃圾	10/10	• 為提高辛烷值 [8]
5/48	• • 基於工業殘渣及廢料（5/42，5/44 優先）[4]	10/12	• 為提高十六烷值 [8]
7/00	流體燃料固化製成的燃料	10/14	• 為提高低溫性能 [8]
7/02	• 液體燃料	10/16	• • 傾點抑制劑 [8]
7/04	• • 醇	10/18	• 為了不包括在 C10L 10/02 至 C10L 10/16 各次目的目的而使用清潔劑或分散劑 [8]
8/00	本次類其他各目不包含的燃料 [8]	11/00	引火物
9/00	為改進燃燒對固體燃料進行的處理	11/02	• 基於耐火多孔體者
9/02	• 用化學方法	11/04	• 由可燃料組成者（火柴見 C06F）
9/04	• • 用氫化	11/06	• 特殊形狀者
9/06	• • 用氧化	11/08	• 製造此物之設備
9/08	• 用熱處理，如煅燒		
9/10	• 用添加劑		

C10M 潤滑組合物（鑽井用組合物見 C09K 8/02）；**於潤滑組合物內化學物質之單獨使用或用作潤滑組成分**（脫模，即金屬脫模劑見 B22C 3/00，一般塑膠或塑態物質之脫模劑見 B29C 33/56，玻璃脫模劑見 C03B 40/02；紡織品潤滑劑見 D06M 11/00、13/00、15/00；顯微鏡用之鏡油見 G02B 21/33）[4]

附註

(1) 於本次類內，下列名詞或表示意指：

— “潤滑劑”或“潤滑組合物”包括切削油、液壓液、金屬抽拉用組合物、洗滌油、防銹油，或其它同類物；

— “脂肪族”包括“環脂肪族”。[4]

(2) 於本次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明請放入最後適當位置。因此，含有芳環之化合物不考慮有關的取代基係於環上或於分子中之脂鏈上，均按芳族予以分類。[4]

(3) 於本次類內：

a. 化合物之金屬鹽或銨鹽按該化合物進行分類；

- b. 二個或更多有機化合物之間形成的鹽或加合物若屬重要，則按形成該鹽或加合物的所有化合物予以分類；
- c. 由高分子烴基取代的特定化合物，如酚類、酸類，按該化合物予以分類；
- d. 由不包括任何特定主目之混合物組成的基料或增稠劑或添加劑分入包括該混合物所有基本組成分之最合適的目，例如：
- 酮與醯胺為基料之混合物見 105/00 目；
 - 酮與醚為基料之混合物見 105/08 目；
 - 長鏈酯與短鏈酯之添加劑混合物見 129/00 目；
 - 短鏈脂族與芳族羧酸組成的添加劑混合物見 129/26 目；
- e. 除含水量超過 10% 之含水潤滑組合物係單獨分類以外，係根據組分的類型或各種類型特徵組成分（基料、增稠劑或添加劑）之混合物予以分類。須注意者，僅以其組成分之一而非為以整個混合物為特徵之主要成分之混合物，不按混合物進行分類，例如，一潤滑組合物包含：
- 一種已知基料與一種新的添加劑，僅按分類表之“添加劑”部分分類；
 - 一種已知基料同時以增稠劑及另一添加劑做為主要成分，不論其是否個別地已知，按增稠劑與添加劑之混合物予以分類；
 - 一種已知基料與添加劑組合做為主要成分，不論其是否個別地已知，均分入添加劑混合物之適當位置。[4]
- (4) 組合物的任何成分，通過按照上述附註(2)或附註(3)的分類不能被確定，而且其本身是新穎的和非顯而易見的，請依據末位規則放入最後適當位置。組成分可以是組合物中的單一成分或組合物。[8]
- (5) 組合物的任何成分，通過按照上述附註(2)或附註(4)的分類不能被確定，該組成分被認為代表對檢索重要的資訊，請依據末位規則放入最後適當位置。例如，使用分類號組合對於檢索組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為”附加資訊”給出。[8]
- (6) 於本次類內，最好加入次類 C10N 之索引碼。[4]

次類索引

基料	非高分子有機化合物..... 115/00，117/00
礦物油或脂肪油..... 101/00	高分子化合物..... 119/00
無機材料..... 103/00	結構未知或不完全確定的化合物..... 121/00
非高分子有機化合物..... 105/00	混合物..... 123/00，169/00
高分子化合物..... 107/00	添加劑
結構未知或不完全確定的化合物..... 109/00	無機材料..... 125/00
混合物..... 111/00，169/00	非高分子有機化合物..... 127/00 至 139/00
增稠劑	高分子化合物..... 143/00 至 155/00
無機材料..... 113/00	結構未知或不完全確定的化合物..... 159/00

混合物.....141/00，157/00，161/00 至 169/00
以物理性能為特徵之組合物..... 171/00
含水之組合物..... 173/00

加工..... 175/00
製備或後處理..... 177/00

基料 [4]

101/00 以礦物油或脂肪油基料為特徵之潤滑組合物（含水高於 10%者見 173/00）[4]

101/02 · 石油餾份 [4]

101/04 · 脂肪油餾份 [4]

103/00 以無機材料基料為特徵之潤滑組合物（含水高於 10%者見 173/00）[4]

103/02 · 碳；石墨 [4]

103/04 · 金屬；合金 [4]

103/06 · 金屬化合物 [4]

105/00 以非高分子有機化合物基料為特徵之潤滑組合物 [4]

105/02 · 明確限定的烴類（石油餾分見 101/02）[4]

105/04 · · 脂族者 [4]

105/06 · · 芳族者 [4]

105/08 · 含氧者 [4]

105/10 · · 有羥基連至無環或脂族碳原子上 [4]

105/12 · · · 單羥基 [4]

105/14 · · · 多羥基 [4]

105/16 · · 有羥基連至六節芳環之碳原子上 [4]

105/18 · · 醚，例如環氧化物 [4]

105/20 · · 醛；酮 [4]

105/22 · · 羧酸或其鹽 [4]

105/24 · · · 僅有一個羧基連至無環碳原子、脂環族碳原子或氫上 [4]

105/26 · · · 有多個羧基連至一個無環碳原子或脂環族碳原子上 [4]

105/28 · · · 僅有一個羧基連至六節芳環之一個碳原子上 [4]

105/30 · · · 有多個羧基連至六節芳環之碳原子上 [4]

105/32 · · 酯 [4]

105/34 · · · 單羧酸者 [4]

105/36 · · · 多羧酸者 [4]

105/38 · · · 多羥基化合物者 [4]

105/40 · · · 含有游離羥基或羧基者 [4]

105/42 · · · 混合酯即至少含有三個酯化羧基之化合物並由下列五類化合物中至少三種不同類化合物之化合所衍生者；單羥基化合物，多羥基化合物，單羧酸，多羧酸及羥基羧酸 [4]

105/44 · · · · 僅由單羧酸，二羧酸及二羥基化合物化合衍生，且無游離羥基或羧基者 [4]

105/46 · · · · 僅由單羥基化合物、二羥基化合物及二羧基化合物化合衍生，且無游離羥基或羧基者 [4]

105/48 · · · 碳酸者 [4]

105/50 · 含鹵素者 [4]

105/52 · · 僅含碳、氫及鹵素者 [4]

105/54 · · 含碳、氫、鹵素及氧者 [4]

105/56 · 含氮者 [4]

105/58 · · 胺，例如多亞烷基多胺、季胺（具有十一個或更多單體單元之多亞烴多胺見 107/44）[4]

105/60 · · · 有胺基連至無環或脂環族碳原子上 [4]

105/62 · · · · 含有羥基者 [4]

105/64 · · · 有胺基連至六節芳環之碳原子上者 [4]

105/66 · · · · 含有羥基者 [4]

105/68 · · 醯胺；醯亞胺 [4]

105/70 · · 作為雜環原子 [4]

105/72 · 含硫、硒或碲者 [4]

105/74 · 含磷者 [4]

105/76 · 含矽者 [4]

105/78 · 含硼者 [4]

105/80 · 含有 105/02 至 105/78 目不包括的元素原子者 [4]

107/00 以高分子化合物基料為特徵之潤滑組合物 [4]

- 107/02 • 烴類聚合物；用氧化作用改性的烴類聚合物 [4]
- 107/04 • • 聚乙烯 [4]
- 107/06 • • 含丙烯者 [4]
- 107/08 • • 含丁烯者 [4]
- 107/10 • • 含四個碳原子上之脂族單體者 [4]
- 107/12 • • 含有芳族單體者，例如苯乙烯 [4]
- 107/14 • • 含有共軛二烯者 [4]
- 107/16 • • 含有非共軛二烯者 [4]
- 107/18 • • 用氧化作用改性的烴類聚合物 [4]
- 107/20 • 含氧者（107/18 優先）[4]
- 107/22 • • 僅由碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
- 107/24 • • • 含有一個不飽和基連至一個醇、醛、酮、醚、酮縮醇或醛縮醇基上之單體者 [4]
- 107/26 • • • 含有一個不飽和基連至一個飽和羧酸或碳酸之鹼氧基上之單體者 [4]
- 107/28 • • • 含有不飽和基連至一羧基上之單體者，如丙烯酸酯 [4]
- 107/30 • • 除僅由碳—碳不飽和鍵反應以外而得的高分子化合物 [4]
- 107/32 • • • 醛或酮之縮聚物；聚酯；聚醚 [4]
- 107/34 • • • • 聚氧化烯 [4]
- 107/36 • • 多糖類，例如纖維素 [4]
- 107/38 • 含鹵素者 [4]
- 107/40 • 含氮者 [4]
- 107/42 • • 僅由碳—碳不飽和鍵之反應而得的高分子化合物 [4]
- 107/44 • • 除僅由碳—碳不飽和鍵反應以外而得的高分子化合物 [4]
- 107/46 • 含硫者 [4]
- 107/48 • 含磷者 [4]
- 107/50 • 含砷者 [4]
- 107/52 • 含硼者 [4]
- 107/54 • 含有 107/02 至 107/52 各目未包括的元素原子者 [4]

109/00 以未知或不完整確定結構之化合物作基料為特徵的潤滑組合物（101/00 優先）[4]

109/02 • 反應產物 [4]

附註

當分類至本目時，反應產物的任何反應物，被認為代表了對檢索是重要的資訊，請依據末位規則放入次類最後適當位置。例如，使用分類號組合對於檢索組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為“附加資訊”給出。
[8]

111/00 以 101/00 至 109/00 一個以上之主目包括的兩種或兩種以上化合物之混合物，其中每種化合物均為不可或缺，作基料為特徵之潤滑組合物 [4]

111/02 • 至少其中之一為非高分子有機化合物 [4]

111/04 • 至少其中之一為高分子有機化合物 [4]

111/06 • 至少其中一為 109/00 目所列類型之化合物 [4]

增稠劑 [4]

附註[4]

113/00 至 123/00 目內，所用下列術語的含意表示：

— “增稠劑”係一種使其他液體組成分固化成潤滑脂之試劑。由固體成分組成的固態潤滑劑分類至 103/00 至 111/00 目中。

113/00 以無機材料作增稠劑為特徵之潤滑組合物 [4]

113/02 • 碳，石墨 [4]

113/04 • 硫 [4]

- 113/06 · 金屬；合金 [4]
- 113/08 · 金屬化合物 [4]
- 113/10 · 黏土；雲母 [4]
- 113/12 · 矽 [4]
- 113/14 · 玻璃 [4]
- 113/16 · 用有機化合物處理過的無機材料，例如經塗覆者 [4]

115/00 以除羧酸或其鹽以外的非高分子有機化合物作增稠劑為特徵之潤滑組合物 [4]

- 115/02 · 烴類（石油餾份見 121/02） [4]
- 115/04 · 含氧者 [4]
- 115/06 · 含鹵素者 [4]
- 115/08 · 含氮者 [4]
- 115/10 · 含硫者 [4]
- 115/12 · 含磷者 [4]

117/00 以非高分子羧酸或其鹽作增稠劑為特徵之潤滑組合物 [4]

- 117/02 · 僅有一個羧基連至無環碳原子、脂環族碳原子或氮上者 [4]
- 117/04 · 含有烴基者 [4]
- 117/06 · 有一個以上之羧基連在一個無環碳原子或脂環族碳原子上者 [4]
- 117/08 · 僅有一個羧基連至六節芳環之碳原子上者 [4]
- 117/10 · 有一個以上之羧基連至六節芳環之碳原子上者 [4]

119/00 以高分子化合物作增稠劑為特徵之潤滑組合物 [4]

- 119/02 · 烴類聚合物；經氧化改性的烴類聚合物 [4]
- 119/04 · 含氧者（經氧化改性的烴類聚合物見 119/02） [4]
- 119/06 · 僅由碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
- 119/08 · 含有一個不飽和基連至一個醇基、醛基、酮基、醚基、酮縮醇基或醛縮醇基上之單體者 [4]
- 119/10 · 含有不飽和基連至飽和羧酸

或碳酸的鹽氧基上之單體者 [4]

- 119/12 · 含有一個不飽和基連至一羧基上之單體者，如丙烯酸酯 [4]
- 119/14 · 不由碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
- 119/16 · 醛或酮之縮聚物；聚酯；聚醚 [4]
- 119/18 · 聚氧化烯 [4]
- 119/20 · 多糖類，例如纖維素 [4]
- 119/22 · 含鹵素者 [4]
- 119/24 · 含氮者 [4]
- 119/26 · 含硫者 [4]
- 119/28 · 含磷者 [4]
- 119/30 · 含有 119/02 至 119/28 目內未包括的元素原子者 [4]

121/00 以結構未知或不完全確定的化合物作增稠劑為特徵之潤滑組合物 [3]

- 121/02 · 石油餾分，例如焦油 [4]
- 121/04 · 反應產物 [4]

附註

當分類至本目時，反應產物的任何反應物，被認為代表了對檢索是重要的資訊，請依據末位規則放入次類最後適當位置。例如，使用分類號組合對於檢索組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為“附加資訊”給出。
[8]

123/00 以 113/00 至 121/00 一個主目以上之目所包括的兩種或兩種以上的化合物作增稠劑為特徵之潤滑組合物，其中每種化合物均為不可或缺者（塗以有機化合物之無機材料見 113/16） [4]

- 123/02 · 至少其中之一為非高分子化合物 [4]

123/04 · 至少其中之一為高分子化合物 [4]

123/06 · 至少其中之一為 121/00 目所包括的添加劑 [4]

添加劑 [4]

125/00 以添加劑係無機材料為特徵之潤滑組合物 [4]

125/02 · 碳；石墨 [4]

125/04 · 金屬；合金 [4]

125/06 · 硫 [4]

125/08 · 金屬之碳化物或氮化物 [4]

125/10 · 金屬氧化物，氮氧化物，碳酸鹽或碳酸氫鹽 [4]

125/12 · 金屬羰基化合物 [4]

125/14 · 水（含水 10%以上之含水潤滑組合物見 173/00） [4]

125/16 · 過氧化氫，充氧水 [4]

125/18 · 含鹵素之化合物 [4]

125/20 · 含氮之化合物 [4]

125/22 · 含硫，硒或碲之化合物 [4]

125/24 · 含磷，砷或銻之化合物 [4]

125/26 · 含有矽或硼之化合物，例如矽土，砂 [4]

125/28 · · 玻璃 [4]

125/30 · · 黏土 [4]

127/00 以添加劑係非高分子烴為特徵之潤滑組合物（石油餾分見 159/04） [4]

127/02 · 組成確定的脂族 [4]

127/04 · 組成確定的芳族 [4]

127/06 · 烷基化之芳烴 [4]

129/00 以添加劑係含氧非高分子有機化合物為特徵之潤滑組合物 [4]

129/02 · 有少於 30 個原子之碳鏈者 [4]

129/04 · · 烴基化合物 [4]

129/06 · · · 有烴基連至無環或脂環族之碳原子上者 [4]

129/08 · · · · 至少含兩個烴基者 [4]

129/10 · · · · 有烴基連至六節芳環之碳原

子上者 [4]

129/12 · · · · 附稠合環者 [4]

129/14 · · · · 至少含兩個烴基者 [4]

129/16 · · 醚 [4]

129/18 · · · 環氧化合物 [4]

129/20 · · · 有四個或四個以上環原子之環醚，例如，呋喃，二氧戊環 [4]

129/22 · · 過氧化物；臭氧化物 [4]

129/24 · · 醛，酮 [4]

129/26 · · 羧酸；及其鹽 [4]

129/28 · · · 有羧基連至無環或脂環族之碳原子上者 [4]

129/30 · · · · 有七個或少於七個碳原子者 [4]

129/32 · · · · · 單羧酸者 [4]

129/34 · · · · · 多羧酸者 [4]

129/36 · · · · · 含烴基者 [4]

129/38 · · · · 有八個或更多的碳原子 [4]

129/40 · · · · · 單羧酸者 [4]

129/42 · · · · · 多羧酸者 [4]

129/44 · · · · · 含烴基者 [4]

129/46 · · · · 脂環族者 [4]

129/48 · · · 有羧基連至六節芳環之碳原子上者 [4]

129/50 · · · · 單羧酸者 [4]

129/52 · · · · 多羧基者 [4]

129/54 · · · · 含烴基者 [4]

129/56 · · · 結構未知的或不完全確定的酸 [4]

129/58 · · · · 環烷酸 [4]

129/60 · · · · 妥爾油酸 [4]

129/62 · · · · 松香酸 [4]

129/64 · · · 由不飽和酸聚合而得的酸 [4]

129/66 · · 環氧化的酸或酯 [4]

129/68 · · 酯（環氧化者見 129/66） [4]

129/70 · · · 單羧酸者 [4]

129/72 · · · 多羧酸者

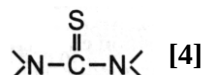
129/74 · · · 多烴基化合物者 [4]

129/76 · · · 含游離烴基或羧基者 [4]

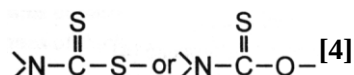
129/78 · · · 混酯，即至少含三個酯化的羧基及由下列五種類型之

- 化合物中至少三種不同類型之化合而衍生者；一羥基化合物，多羥基化合物，單羧酸，多羧酸，羥基羧酸 [4]
- 129/80 由一元羧酸、二羧酸僅與二羥基化合物化合而衍生，且無游離羥基或羧基者 [4]
- 129/82 由一羥基化合物、二羥基化合物僅與二羧酸化合而衍生，且無游離羥基或羧基者 [4]
- 129/84 . . . 碳酸者 [4]
- 129/86 . 有 30 個或更多原子之碳鏈者 [4]
- 129/88 . . 羥基化合物 [4]
- 129/90 . . . 有羥基連至無環或脂環族之碳原子上者 [4]
- 129/91 . . . 有羥基連至六節芳環之碳原子上者 [4]
- 129/92 . . 羧酸 [4]
- 129/93 . . . 有羧基連在無環或脂環族之碳原子上者 [4]
- 129/94 . . . 有羧基連至六節芳環之碳原子上者 [4]
- 129/95 . . 酯 [4]
- 131/00 以含鹵素之非高分子有機化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]**
- 131/02 . 僅含碳、氫及鹵素者 [4]
- 131/04 . . 脂族者 [4]
- 131/06 . . 芳族者 [4]
- 131/08 . 含碳、氫、鹵素及氧者 [4]
- 131/10 . . 醇；醚；醛；酮 [4]
- 131/12 . . 酸；其鹽或酯 [4]
- 131/14 . 鹵化的石蠟 [4]
- 133/00 以含氮的非高分子有機化合物作添加劑為特徵之潤滑組合物 [4]**
- 133/02 . 有一個少於三十個原子之碳鏈者 [4]
- 133/04 . . 胺，例如多亞烷基多胺；季胺（有十一個或更多單體單元之多亞烷基多胺見 149/22）[4]
- 133/06 . . . 有胺基連至無環或脂環族之碳原子上者 [4]
- 133/08 含有羥基者 [4]
- 133/10 脂環族者 [4]
- 133/12 . . . 有胺基連至六節芳環之碳原子上者 [4]
- 133/14 含有羥基者 [4]
- 133/16 . . 醯胺；醯亞胺 [4]
- 133/18 . . . 碳酸或三鹵代甲酸者 [4]
- 133/20 尿素；胺基脲；脲基甲酸鹽 [4]
- 133/22 . . 含一個碳-氮雙鍵者，例如胍、脲、縮胺基脲 [4]
- 133/24 . . 腈 [4]
- 133/26 . . 含一個氮-氮雙鍵者 [4]
- 133/28 . . . 偶氮化合物 [4]
- 133/30 . . 含一個氮-氧鍵者 [4]
- 133/32 . . . 含硝基者 [4]
- 133/34 . . . 含亞硝基者 [4]
- 133/36 . . . 羥基胺 [4]
- 133/38 . . 雜環氮化合物 [4]
- 133/40 . . . 僅含氮及碳之六節環 [4]
- 133/42 三吡 [4]
- 133/44 . . . 僅含氮及碳之五節環 [4]
- 133/46 咪唑 [4]
- 133/48 . . . 含氮及氧之環 [4]
- 133/50 嗎啉 [4]
- 133/52 . 有一個 30 個或更多原子之碳鏈者 [4]
- 133/54 . . 胺 [4]
- 133/56 . . 醯胺；醯亞胺 [4]
- 133/58 . . 雜環化合物 [4]
- 135/00 以含硫、硒或碲之非高分子有機化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]**
- 135/02 . 硫化物 [4]
- 135/04 . . 烴 [4]
- 135/06 . . 酯，例如脂肪 [4]
- 135/08 . 含硫-氧鍵者 [4]

- 135/10 • • 磺酸或其衍生物 [4]
 135/12 • 硫代酸；硫代氰酸鹽；及其衍生物 [4]
 135/14 • • 有碳—硫雙鍵者 [4]
 135/16 • • • 硫脲型，即含基團者



- 135/18 • • • 硫代胺基甲酸，例如含有基團的



- 135/20 • 硫醇；硫醚；多硫化物 [4]
 135/22 • • 含硫原子連至無環或脂環族之碳原子上者 [4]
 135/24 • • • 含有羥基者；及其衍生物 [4]
 135/26 • • • 含羧基者；及其衍生物 [4]
 135/28 • • 含硫原子連至六節芳環之碳原子上者 [4]
 135/30 • • • 含羥基者；及其衍生物 [4]
 135/32 • 雜環之硫，硒或碲化合物 [4]
 135/34 • • 僅含硫及碳之環 [4]
 135/36 • • 含硫及碳之環帶有氮及氧 [4]

137/00 以含磷之非高分子有機化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]

- 137/02 • 無磷—碳鍵者 [4]
 137/04 • • 磷酸酯 [4]
 137/06 • • • 金屬鹽 [4]
 137/08 • • • 銨或胺鹽 [4]
 137/10 • • • 硫代衍生物 [4]
 137/12 • 有磷—碳鍵者 [4]
 137/14 • • 含硫者 [4]
 137/16 • 有磷—氮鍵者 [4]

139/00 以含 127/00 至 137/00 目內不包括的元素之非高分子有機化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]

- 139/02 • 矽酸酯 [4]
 139/04 • 有矽—碳鍵者，如矽烷類 [4]
 139/06 • 有金屬—碳鍵者（未知結構之金屬配合物見 159/18） [4]

141/00 以 125/00 至 139/00 一個以上主目內包括的兩種或多種化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成份 [4]

- 141/02 • 至少其中之一係含氧的有機化合物 [4]
 141/04 • 至少其中之一係含鹵素的有機化合物 [4]
 141/06 • 至少其中之一係含氮的有機化合物 [4]
 141/08 • 至少其中之一係含硫、硒或碲的有機化合物 [4]
 141/10 • 至少其中之一係含磷的有機化合物 [4]
 141/12 • 至少其中之一係含不包括於 141/02 至 141/10 目內的元素原子之有機化合物 [4]

143/00 以高分子烴或由氧化改性的高分子烴作添加劑為特徵之潤滑組合物 [4]

- 143/02 • 聚乙烯 [4]
 143/04 • 含丙烯者 [4]
 143/06 • 含丁烯者 [4]
 143/08 • 含四個碳原子以上之脂族單體者 [4]
 143/10 • 含芳族單體者，如苯乙烯 [4]
 143/12 • 含共軛二烯者 [4]
 143/14 • 含非共軛二烯者 [4]
 143/16 • 含脂環族單體者 [4]
 143/18 • 氧化的烴，即在生成高分子後而氧化者 [4]

145/00 以含氧的高分子化合物作添加劑為特徵之潤滑組合物（氧化的烴見 143/18） [4]

- 145/02 • 僅由碳—碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
 145/04 • • 含有與醇、醛、酮、醚、酮縮醇或醛縮醇基鍵合的不飽和基單體者 [4]
 145/06 • • 含有與飽和羧酸或碳酸之羧基

- 鍵合的不飽和基單體者 [4]
- 145/08 . . . 飽和羧酸或碳酸之乙烯基酯 [4]
- 145/10 . . 含有與羧基鍵合的不飽和基單體者，如丙烯酸酯 [4]
- 145/12 . . . 單羧酸者 [4]
- 145/14 丙烯酸酯；甲基丙烯酸酯 [4]
- 145/16 . . . 多元羧酸者 [4]
- 145/18 . 除僅用碳一碳不飽和鍵以外的反應而得的高分子化合物 [4]
- 145/20 . . 醛或酮之縮聚物 [4]
- 145/22 . . 聚酯 [4]
- 145/24 . . 聚醚 [4]
- 145/26 . . . 聚氧化烯 [4]
- 145/28 僅含兩個碳原子之烯化氧者 [4]
- 145/30 僅含三個碳原子之烯化氧者 [4]
- 145/32 含四個或更多碳原子之烯化氧者 [4]
- 145/34 兩種或多種不同類型者 [4]
- 145/36 醚化者 [4]
- 145/38 酯化者 [4]
- 145/40 . 多糖類，如纖維素 [4]
- 147/00 以含鹵素的高分子化合物作添加劑為特徵之潤滑組合物 [4]**
- 147/02 . 僅含碳、氫及鹵素之單體 [4]
- 147/04 . 含碳、氫、鹵素及氧之單體 [4]
- 149/00 以含氮的高分子化合物作添加劑為特徵之潤滑組合物 [4]**
- 149/02 . 僅由碳一碳不飽和反應而得的高分子化合物 [4]
- 149/04 . . 含有一個與胺基鍵合的不飽和基之單體者 [4]
- 149/06 . . 含有一個與醯胺基或亞胺基鍵合的不飽和基之單體者 [4]
- 149/08 . . 含有一個與腈基鍵合的不飽和基之單體者 [4]
- 149/10 . . 含有一個與含氮的雜環鍵合之不飽和基的單體者 [4]
- 149/12 . 除僅由碳一碳不飽和鍵以外的反應而得的高分子化合物 [4]
- 149/14 . . 包括縮合反應 [4]
- 149/16 . . . 含氮單體與醛或酮之間 [4]
- 149/18 . . . 聚醯胺 [4]
- 149/20 . . . 聚脲 [4]
- 149/22 . . . 聚胺 [4]
- 151/00 以含硫、硒或碲之高分子化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]**
- 151/02 . 僅由碳一碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
- 151/04 . 除僅由碳一碳不飽和鍵之外的反應而得的高分子化合物 [4]
- 153/00 以含磷的高分子化合物作添加劑為特徵之潤滑組合物 [4]**
- 153/02 . 僅由碳一碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物 [4]
- 153/04 . 除僅由碳一碳不飽和鍵之外的反應而得的高分子化合物 [4]
- 155/00 以含 143/00 至 153/00 目內不包括的元素之高分子化合物作添加劑為特徵的潤滑組合物 [4]**
- 155/02 . 含碲的單體 [4]
- 155/04 . 含硼的單體 [4]
- 157/00 以包括於 143/00 至 153/00 一個以上主目內兩種或多種高分子化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]**
- 157/02 . 至少其中之一係含鹵素的化合物 [4]
- 157/04 . 至少其中之一係含氮的化合物 [4]
- 157/06 . 至少其中之一係含硫、硒或碲的化合物 [4]
- 157/08 . 至少其中一係含磷的化合物 [4]
- 157/10 . 至少其中之一係含不包括於 157/02 至 157/08 內的元素原子之化合物 [4]

159/00 以結構未知或不完全確定的添加劑為特徵之潤滑組合物（鏈中碳原子少於 30、結構未知或不完全確定的羧酸見 129/56） [4]

159/02 • 天然產物 [4]

159/04 • • 石油餾分，如焦油，溶劑 [4]

159/06 • • 蠟，如天然地蠟、地蠟、礦脂蠟或疏鬆石蠟 [4]

159/08 • • 脂肪油 [4]

159/10 • • 橡膠 [4]

159/12 • 反應產生 [4]

附註

當分類至本目時，反應產物的任何反應物，被認為代表了對檢索是重要的資訊，請依據末位規則放入次類最後適當位置。例如，使用分類號組合對於檢索組合物是重要的情況下，這種非強制分類應當作為“附加資訊”給出。[8]

159/14 • • 用夫里得-夸夫特縮合反應而得者 [4]

159/16 • • 用曼尼期反應而得者 [4]

159/18 • • 金屬配合物 [4]

159/20 • • 有過量中和鹼之反應混合物，如高鹼或強鹼產物 [4]

159/22 • • • 含酚基者 [4]

159/24 • • • 含磺基者 [4]

161/00 以高分子及非高分子化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]

163/00 以一種結構未知的或不完全確定的化合物與一種非高分子化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]

165/00 以一種高分子化合物與一種結

構未知的或不完全確定的化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]

167/00 以一種高分子化合物、一種非高分子化合物及一種結構未知的或不完全確定的化合物之混合物作添加劑為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]

基料、增稠劑與添加劑之混合物 [4]

169/00 以由包括於前述各目內的基料，增稠劑或添加劑中至少選擇兩類成分之混合物作組成分為特徵的潤滑組合物，此等化合物之每一種均為主要成分 [4]

169/02 • 基料及增稠劑之混合物 [4]

169/04 • 基料及添加劑之混合物 [4]

169/06 • 增稠劑及添加劑之混合物 [4]

以物理性能為特徵之組合物 [4]

171/00 純粹以物理性能指標為特徵之潤滑組合物，即所含的用作基料、增稠劑或添加劑之組成分完全係以其某些特定的物理性能之數值為特徵，即所含的組成分在物理上明確，但對其化學本質未作明確說明或僅作含糊的說明（化學上明確的組成分見 101/00 至 169/00；石油餾分見 101/02、121/02、159/04） [4]

171/02 • 特定黏度值或特定黏度指數 [4]

171/04 • 特定分子量或分子量分布 [4]

171/06 • 特殊的粒型及粒度 [4]

含水的潤滑組合物 [4]	175/02 · 基於礦物油者 [4]
	175/04 · 基於水乳液者 [4]
173/00 含水量大於 10%之潤滑組合物 [4]	175/06 · 用超濾法或滲透法 [4]
173/02 · 不含礦物油或脂肪油者 [4]	製備或後處理 [4]
加工 [4]	177/00 製備潤滑組合物之專用方法；用對組成分的或整個潤滑組合物之後處理進行其他類內所不包括的化學改性 [4]
175/00 加工用過的潤滑劑，以回收有用的產品 [4]	

C10N 與次類 C10M 聯合使用之索引碼 [4]

附註[4]

- (1) 本次類構成與次類 C10M 聯合使用之索引碼。涉及：
 - 金屬本身及金屬之化合物於 10/00 目中；
 - 潤滑組合物之性能或其組份的性能於 20/00，30/00 目中；
 - 潤滑劑之使用或應用於 40/00 目中；
 - 潤滑劑之使用形態於 50/00 目中；
 - 用潤滑組合物之後處理進行化學改性於 60/00 目中；
 - 特殊的製備方法於 70/00 目中；
 - 經潤滑的材料之特殊預處理於 80/00 目中；
- (2) 於本次類內，下列術語之含意表示：
 - “潤滑劑”或“潤滑組合物”包括切削油、液壓液、金屬拉擠用組合物、洗滌油、抗蝕油，或類似物；
 - “脂族者”包括“脂環族者”。[4]

10/00 金屬本身或以化合物形式存在的金屬 [4,2010.01]	10/10 · 第 5 或 15 族 [4]
	10/12 · 第 6 或 16 族 [4]
	10/14 · 第 7 族 [4]
	10/16 · 第 8、9 或 10 族 [4]
附註	20/00 潤滑組合物之特定的物理性能 [4]
於本目內，金屬應按其於周期表中之族別予以標引	20/02 · 黏度：黏度指數 [4]
	20/04 · 分子量；分子量分布 [4]
10/02 · 第 1 或 11 族 [4]	20/06 · 特殊形狀或尺寸之顆粒 [4]
10/04 · 第 2 或 12 族 [4]	30/00 用表徵潤滑組合物之添加劑改進特定的物理性能或化學性
10/06 · 第 3 或 13 族 [4]	
10/08 · 第 4 或 14 族 [4]	

能，如多功能的添加劑 [4]

- 30/02 • 傾點；黏度指數 [4]
- 30/04 • 清潔或分散性能 [4]
- 30/06 • 潤滑性；膜強度；抗磨性；耐極壓性 [4]
- 30/08 • 耐溫極限 [4]
- 30/10 • 氧化之抑制；如抗氧劑 [4]
- 30/12 • 耐腐蝕性，如防鏽劑，防腐劑 [4]
- 30/14 • 金屬鈍化 [4]
- 30/16 • 抗菌性；殺生物性 [4]
- 30/18 • 抗發泡性 [4]
- 30/20 • 顏色，如染料 [4]

40/00 潤滑組合物之特定用途或應用 [4]

- 40/02 • 軸承 [4]
- 40/04 • 油浴；齒輪箱；自動變速裝置；牽引聯動裝置 [4]
- 40/06 • 儀器或其他精密設備，如阻尼液 [4]
- 40/08 • 液壓液，如剎車液 [4]
- 40/10 • 磨合用潤滑油 [4]
- 40/12 • 燃氣輪機 [4]
- 40/13 • • 飛機渦輪 [5]
- 40/14 • 電或磁方面 [4]
- 40/16 • • 電介質：絕緣油 [4]
- 40/18 • • 與磁帶或唱片上之錄音有關 [4]
- 40/20 • 金屬加工 [4]
- 40/22 • • 主要用以切削材料 [4]
- 40/24 • • 主要用於切削材料以外；衝壓金屬 [4]
- 40/25 • 內燃機 [5]
- 40/26 • • 雙衝程 [5]
- 40/28 • • 旋轉者 [5]
- 40/30 • 冷凍機潤滑劑 [5]
- 40/32 • 鋼絲，繩，纜索潤滑劑 [5]
- 40/34 • 潤滑之封膠 [5]
- 40/36 • 脫模劑 [5]

50/00 經潤滑的材料上所用潤滑劑之形態 [4]

- 50/02 • 溶解或懸浮於載體內，然後載

體蒸發後留下潤滑塗層 [4]

- 50/04 • 空氣溶膠 [4]
- 50/06 • 氣相，至少在工作條件時 [4]
- 50/08 • 固相 [4]
- 50/10 • 半固相；油脂狀 [4]

60/00 潤滑組合物成份之化學後處理 [4]

- 60/02 • 還原，如加氫 [4]
- 60/04 • 氧化，如臭氧化 [4]
- 60/06 • 用環氧化物
- 60/08 • 鹵化 [4]
- 60/10 • 用硫化含硫化合物 [4]
- 60/12 • 用磷或含磷化合物，如 P_xS_y [4]
- 60/14 • 用硼或含硼化合物 [4]

70/00 特殊的製備方法 [4]**80/00 經潤滑的材料之特殊預處理，如金屬之磷化或滲鉻 [4]**

C11 動物或植物油、脂、脂肪物質或蠟；由此製取的脂肪酸；清潔劑；蠟燭（食用油或脂肪組合物見 A23）

C11B 生產，例如由原料中壓榨或由廢料內萃取、精製或保存脂肪、脂肪物質，例如羊毛脂、油脂或蠟；香精油；香料（乾性油見 C09F）

次類索引

生產	精製，保存，
脂或油脂者.....1/00，13/00	固化.....3/00，5/00，7/00，15/00
其他脂肪物質者.....11/00	香精油，香料.....9/00

1/00 由原料生產脂或脂油

- 1/02 · 預處理
- 1/04 · · 植物性原料者
- 1/06 · 壓榨法
- 1/08 · · 用熱壓法
- 1/10 · 萃取法
- 1/12 · 熔出法
- 1/14 · · 用熱水或水溶液
- 1/16 · · 用蒸汽

3/00 脂或油脂之精製

- 3/02 · 化學反應法
- 3/04 · · 用酸
- 3/06 · · 用鹼
- 3/08 · · 用氧化劑
- 3/10 · 吸附法

9/00 香精油；香料 [1,2006.01]

- 9/02 · 由原料回收或精製香精油

11/00 其他脂肪物質，如羊毛脂或蠟之回收或精製 [1,2006.01]

13/00 由廢料內回收脂、油脂或脂肪酸 [1,2006.01]

- 13/02 · 由皂腳內
- 13/04 · 由廢吸附材料內

15/00 用物理方法固化油脂、脂或蠟

附註

當分類至本目時，就與色層分析相關的一般意義的技術主題而言，還應該分類至 B01D 15/08 目中。[8]

- 3/12 · 蒸餾法
- 3/14 · · 用惰性氣體或蒸汽，如水蒸汽
- 3/16 · 機械法

5/00 用添加劑，如用抗氧劑進行保存

7/00 脂或油脂混合物分離成其組成分，如飽和油與不飽和油分離

C11C 由脂、油或蠟內獲得的脂肪酸；蠟燭；脂、油或脂肪酸經化學修飾而獲得的脂、油或脂肪酸

1/00 由脂、油脂或蠟製備脂肪酸，該類脂肪酸之精製（由廢材料內回收脂肪酸見 C11B 13/00）

1/02 • 由脂或油內

1/04 • • 水解法

1/06 • • • 使用固體催化劑

1/08 • 精製

1/10 • • 蒸餾法

3/04 • 脂或脂油之酯化法

3/06 • • 與甘油

3/08 • • 與脂肪酸

3/10 • • 酯交換

3/12 • 加氫法

3/14 • 異構化法

5/00 蠟燭

5/02 • 製備蠟燭用之設備

3/00 脂、油或脂肪酸經化學修飾而獲得的脂、油或脂肪酸，例如，經臭氧分解（磺化的脂或油見 C07C 309/62；環氧化油脂見 C07D 303/42；硫化油，例如硫化油膏，見 C08H 3/00）

3/02 • 脂肪酸與甘油之酯化法

C11D 清潔劑組合物；用單一物質作為清潔劑；皂或製皂；樹脂皂；甘油之回收

附註

- (1) 於本次類的混合目內，組合物的任何單一成分，通過本分類不能被確定，若具有新穎性和非顯而易見性的，也應當分類至 1/00 至 10/00。單一成分既可以是某單一物質也可以是組合物。[8]
- (2) 任何一種組合物成分，通過附註(1)之分類仍不能被確定，而該成分被認為對檢索是重要的資訊，則可以分類至 1/00 至 9/00。例如使用分類號組合對檢索很重要時，即可使用這種分類法。這種非強制分類應當作“附加資訊給出。[8]

次類索引

表面活性清潔劑

非皂類..... 1/00，3/00

以皂為基料者.....9/00

非表面活性清潔劑..... 7/00

清潔劑混合物..... 10/00，11/00

製皂；甘油.....13/00，15/00，19/00

成型.....17/00

表面活性非皂類清潔劑

1/00 主要以表面活性化合物為基料之清潔組合物；使用此等化合物作為清潔劑

附註

於 1/02 至 1/88 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示時，化合物請放入最後適當位置。

- 1/02 • 陰離子化合物
- 1/04 • • 酸或其鹽類（皂見 9/00）
- 1/06 • • • 醚羧酸或硫醚羧酸
- 1/08 • • • 不含氮或硫的多羧酸
- 1/10 • • • 胺基羧酸；亞胺基羧酸；其脂肪酸縮合物
- 1/12 • • 磺酸或硫酸脂；其鹽類（3/065 優先）
- 1/14 • • • 由脂族烴或一元醇衍生者
- 1/16 • • • 由二元或多元醇衍生者
- 1/18 • • • 由胺基醇衍生者
- 1/20 • • • • 脂肪酸縮合物
- 1/22 • • • 由芳族化合物衍生者
- 1/24 • • • • 含直接於環上之酯基或醚基者
- 1/26 • • • 由雜環化合物衍生者
- 1/28 • • • 由脂肪酸或其衍生物，如酯，醯胺衍生的磺化產物
- 1/29 • • • 聚氧烯基醚之硫酸鹽 [2]
- 1/30 • • • 由木質素衍生的磺化產物
- 1/32 • • 蛋白質水解產物；其脂肪酸縮合物
- 1/34 • • 含磷之酸類衍生物
- 1/36 • • 未知結構者
- 1/37 • • 全係陰離子型化合物之混合物
- 1/38 • 陽離子型化合物
- 1/40 • • 單胺或多胺；其鹽類
- 1/42 • • 胺基醇或胺基醚
- 1/44 • • • 含有胺基醇之聚氧化烯烴醚；環氧鏈烷與胺之縮合產

物

- 1/46 • • 含有胺基醇之羧酯脂；含有醇之胺基羧酸酯
- 1/48 • • 含氮的縮聚產物
- 1/50 • • 尿毒、硫脲、胺基腈、胍或胺基甲酸乙酯的衍生物
- 1/52 • • 羧酸醯胺、醇醯胺或亞胺（3/07 優先）
- 1/54 • • 酸之醯肼
- 1/56 • • 含硝基或亞硝基者
- 1/58 • • 雜環化合物
- 1/60 • • 硫或磷化合物
- 1/62 • • 季銨化合物
- 1/64 • • 未知結構者
- 1/645 • • 全係陽離子型化合物之混合物
- 1/65 • • 陰離子型化合物與陽離子型化合物之混合物
- 1/655 • • • 含羧酸醇醯胺之磺化產物者（3/066 優先）
- 1/66 • 非離子型化合物
- 1/68 • • 醇；除酸以外的石蠟氧化產物
- 1/70 • • 酚
- 1/72 • • 聚亞氧烷基乙二醇之醚（3/075 優先）
- 1/722 • • 含混合氧化烯基之氧化烯基醚 [2]
- 1/74 • • 聚亞氧烷基乙二醇之羧酸酯或磺酸酯
- 1/75 • • 胺氧化物 [2]
- 1/755 • • 亞砷 [2]
- 1/76 • • 不含氮的合成樹脂
- 1/78 • • 含磷酸類之中性酯
- 1/79 • • 磷之氧化物 [2]
- 1/80 • • 不含磺基或硫酸酯基之木質素衍生物
- 1/82 • • 含矽之化合物
- 1/825 • • 全係非陰離子型化合物之混合物
- 1/83 • • 非離子型化合物與陰離子型化合物之混合物
- 1/831 • • • 含聚氧烯基醚，不含磷酸鹽之磺酸鹽者

- 1/835 • • 非離子型化合物與陽離子型化合物之混合物
- 1/86 • 陰離子型化合物、陽離子型化合物及非離子型化合物之混合物
- 1/88 • 兩性電解質；電中性化合物 [2]
- 1/90 • • 三甲銨內酯 [2]
- 1/92 • • 磺基三甲銨乙內酯 [2]
- 1/94 • • 有陰離子型化合物、陽離子型化合物或非離子型化合物之混合物 [2]

3/00 包括於 1/00 目內之清潔劑組合物的其他配料成分

附註

於 3/02 至 3/39 目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，化合物請放入最後適當位置。[2]

- 3/02 • 無機化合物
- 3/04 • • 水溶性化合物
- 3/06 • • • 磷酸鹽，包括多磷酸鹽
- 3/065 • • • • 於與磺化產物之摻和物內
- 3/066 • • • • • 及含羧酸醇醯胺
- 3/07 • • • • 於與碳環酸之醇醯胺的一種混合物內
- 3/075 • • • • 於與聚氧化亞烷醚之摻和物
- 3/08 • • • 矽酸鹽
- 3/10 • • • 碳酸鹽
- 3/12 • • 水不溶性化合物
- 3/14 • • • 顏料；填料；磨料
- 3/16 • 有機化合物
- 3/18 • • 烴
- 3/20 • • 含氧者
- 3/22 • • • 碳水化合物或其衍生物
- 3/24 • • 含鹵素者
- 3/26 • • 含氮者
- 3/28 • • • 環上含氮的雜環化合物
- 3/30 • • • 胺；取代胺
- 3/32 • • • 醯胺；取代醯胺

- 3/33 • • • 胺基羧酸 [2]
- 3/34 • • 含硫者
- 3/36 • • 含磷者
- 3/37 • • 聚合物 [2]
- 3/38 • • 含未確定組成分之產物
- 3/382 • • • 植物產品，如大豆粉、木粉、鋸末 [2]
- 3/384 • • • 動物產品 [2]
- 3/386 • • • 含酶的製品 [2]
- 3/39 • 有機或無機過化合物 [2]
- 3/395 • 漂白劑 [2]
- 3/40 • 染料 [2]
- 3/42 • • 增白劑 [2]
- 3/43 • 溶劑 [2]
- 3/44 • • 混合溶劑
- 3/46 • 富脂劑 [2]
- 3/48 • 藥用劑或消毒劑 [2]
- 3/50 • 香料 [2]
- 3/60 • 配料成分之混合物 [2]

7/00 主要以非表面活性化合物為基料之清潔組合物

附註

於 7/02 至 7/22 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，化合物請放入最後適當位置。

- 7/02 • 無機化合物
- 7/04 • • 水溶性化合物
- 7/06 • • • 氫氧化物
- 7/08 • • • 酸
- 7/10 • • • 鹽
- 7/12 • • • • 碳酸鹽
- 7/14 • • • • 矽酸鹽
- 7/16 • • • • 包括多磷酸鹽的磷酸鹽
- 7/18 • • 過氧化物；過酸鹽
- 7/20 • • 水不溶性氧化物
- 7/22 • 有機化合物
- 7/24 • • 烴
- 7/26 • • 含氧者
- 7/28 • • 含鹵素者

- 7/30 • • • 鹵代烴
- 7/32 • • 含氮者
- 7/34 • • 含硫者
- 7/36 • • 含磷者
- 7/38 • • 過化合物
- 7/40 • • 組成未確定的產品
- 7/42 • • • 含酶之製備物
- 7/44 • • • 植物產品 (7/42 優先)
- 7/46 • • • 動物產品 (7/42 優先)
- 7/50 • 溶劑 [2]
- 7/52 • • 與促進劑結合者 [2]
- 7/54 • 漂白劑 [2]
- 7/56 • • 與磷酸鹽結合者 [2]
- 7/60 • 非表面活性化合物之混合物 [2]

皂清潔劑

9/00 主要以皂為基料之清潔劑組合物 (含樹脂皂之組合物見 15/04)

- 9/02 • 以鹼皂或銨皂為基料者
- 9/04 • 含非皂配料成分者

附註

於 9/06 至 9/42 各次目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，化合物請放入最後適當位置。

- 9/06 • • 無機化合物
- 9/08 • • • 水溶性化合物
- 9/10 • • • • 鹽
- 9/12 • • • • • 碳酸鹽
- 9/14 • • • • • 磷酸鹽；多磷酸鹽
- 9/16 • • • • • 硼酸鹽
- 9/18 • • • 水不溶性化合物
- 9/20 • • • • 顏料；填料；磨料
- 9/22 • • 有機化合物
- 9/24 • • • 烴
- 9/26 • • • 含氧者
- 9/28 • • • 含鹵素者
- 9/30 • • • 含氮者
- 9/32 • • • 含硫者

- 9/34 • • • 含磷者
- 9/36 • • • 含矽者
- 9/38 • • • 組成未確定的產品
- 9/40 • • • 蛋白質
- 9/42 • • 過化合物
- 9/44 • • 香料；著色材料；增白劑
- 9/48 • • 富脂劑
- 9/50 • • 藥用劑或消毒劑
- 9/60 • • 配料成分之混合物 [2]

10/00 不屬於上述某目包括的清潔劑組合物 [2]

- 10/02 • 以非皂表面活性化合物及非表面活性化合物之混合物基料者 [2]
- 10/04 • 以非皂表面活性化合物及皂之混合物為基料者 [2]
- 10/06 • 以非表面活性化合物及皂之混合物為基料者 [2]

11/00 製備含清潔劑混合物之組合物的特殊方法

- 11/02 • 用噴霧乾燥法製造粉末品
- 11/04 • 用化學方法，如於其他配料成分存在下磺化，然後中和

皂或製皂；樹脂皂

13/00 一般皂或皂液之製造；所用的設備 (樹脂皂見 15/00)

- 13/02 • 蒸煮皂；精製
- 13/04 • • 所用的連續方法
- 13/06 • • 皂或皂液之漂白
- 13/08 • 著色或加香
- 13/10 • 混合；捏合
- 13/12 • 冷卻 (13/14 優先)
- 13/14 • 成型
- 13/16 • • 模型法
- 13/18 • • 擠壓或壓榨法
- 13/20 • • 小顆粒形狀品；如粉或片
- 13/22 • 切削
- 13/24 • • 於冷卻鼓上切皂
- 13/26 • 乾燥
- 13/28 • 壓花；磨光

13/30 • 皂之回收；如由廢液內回收

15/00 樹脂皂或環烷酸衍生皂之製造；組合物

15/02 • 所用的裝置

15/04 • 含樹脂皂或環烷酸衍生皂之組合物

17/00 由其形狀或物理性能表示特性之清潔劑材料（皂成型見 13/14）

17/02 • 清潔劑之漂浮體

17/04 • 結合有或含有其他物體者

17/06 • 粉，薄片；自由流動的混合物；片材

17/08 • 液體皂；膠囊包裹者

19/00 由皂化液回收甘油

C12 生物化學；啤酒；烈性酒；葡萄酒；醋；微生物學；酶學；突變或遺傳工程

附註

- (1) 於 C12M 至 C12Q 次類及該等次類中之各自範圍內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，請放入最後適當位置。例如，發酵或使用酶之方法包含條件反應控制見 C12Q 次類。[3]
- (2) 於本次類內，病毒、未分化的人類、動物或植物之細胞、原生動物、組織及單細胞藻類被視作微生物。[3,5]
- (3) 於本類內，除特殊規定外，未分化的人類、動物或植物細胞、原生動物、組織及單細胞藻類均分入微生物之位置處。除非另有特別規定，亞細胞部份亦與整個細胞一併分類。[5]
- (4) 次類 C12R 之編碼僅做為與次類 C12C 至 C12Q 連用之索引碼，以提供該等次類分類時有關微生物的資訊。[3]

C12C 啤酒；用發酵製備啤酒（經由貯藏之陳釀或催熟見 C12H 1/22；降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00；增加發酵後酒精含量的方法見 C12H 6/00；酒桶，琵琶桶或其類似物之通氣設備見 C12L 9/00）；**用於製造啤酒之麥芽之製備；用於製造啤酒之啤酒花之製備**

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

次類索引

製造啤酒之原料.....	1/00，3/00，5/00	特殊啤酒.....	12/00
麥芽汁之製備及處理；啤酒之		釀造設備.....	13/00
發酵方法	7/00，11/00		

1/00 麥芽之製備

- 1/02 • 穀粒之預處理，如清洗、浸泡
- 1/027 • 發芽 [6]
- 1/033 • • 在箱子或圓筒中 [6]
- 1/047 • • 以化學或物理方法影響發芽 [6]
- 1/053 • • • 利用輻射或電處理 [6]
- 1/067 • 乾燥 [6]
- 1/073 • • 特別用於節省或回收能源之方

法或裝置 [6]

- 1/10 • • 於固於支架上乾燥
- 1/12 • • 於移動支架上乾燥
- 1/125 • 浸溼、發芽或乾燥之連續或半連續方法 [6]
- 1/13 • • 穀粒係垂直輸送者 [6]
- 1/135 • • 穀粒係水平輸送者 [6]
- 1/15 • 穀粒或麥芽之轉動、送料或出料

- 裝置 [6]
- 1/16 • 麥芽之後處理，例如麥芽之淨化、胚芽之分離
- 1/18 • 麥芽萃取物或特殊種類之麥芽，例如焦糖、黑麥芽之製備（用做食品之麥芽產品見 A23L）
- 3/00 酒花之處理**
- 3/02 • 乾燥
- 3/04 • 保存；貯藏；包裝
- 3/06 • • 來自酒花之粉末或圓粒 [6]
- 3/08 • • 來自酒花之溶劑萃取 [6]
- 3/10 • • • 利用二氧化碳 [6]
- 3/12 • • 來自酒花之異構化產物 [6]
- 5/00 製備啤酒之其它原料**
- 5/02 • 啤酒之添加劑
- 5/04 • • 色素添加劑
- 7/00 麥芽汁之製備（麥芽萃取物見 1/18）**
- 7/01 • 麥芽之製備，例如麥芽磨粉 [6]
- 7/04 • 麥芽漿之製備或處理
- 7/047 • • 部份麥芽漿為非麥芽之穀漿 [6]
- 7/053 • • 部份麥芽漿為非穀類物 [6]
- 7/06 • • 搗碎裝置
- 7/14 • 過濾，即澄清麥芽汁 [1,2006.01]
- 7/16 • • 利用粗濾
- 7/165 • • • 在麥芽漿濾器中 [6]
- 7/17 • • • 在濾桶中 [6]
- 7/175 • • 利用離心 [6]
- 7/20 • • 煮沸啤酒汁（釀造鍋見 13/02）[6]
- 7/22 • • • 特別用於節省或回收能源之方法或設備 [6]
- 7/24 • 在沸與冷卻間澄清啤酒汁 [6]
- 7/26 • 冷卻啤酒汁；在冷卻中及冷卻後澄清啤酒汁 [6]
- 7/28 • 後處理 [6]
- 11/00 啤酒之發酵方法**
- 11/02 • 接種酵母
- 11/06 • 酸化麥芽汁
- 11/07 • 連續發酵 [6]
- 11/09 • 以固定酵母發酵 [6]
- 11/11 • 後發酵處理，例如碳酸化或濃縮（降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00；提高發酵後酒精含量的方法見 C12H 6/00）[6,2006.01,2019.01]
- 12/00 特別用於製備特殊種類啤酒之方法 [6]**
- 12/02 • 低熱量啤酒（12/04 優先）[6]
- 12/04 • 低酒精含量啤酒（降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00）[6,2006.01]
- 13/00 釀造裝置，非涵蓋於 1/00 至 12/04 之單一目中 [3,6]**
- 13/02 • 釀造鍋 [3]
- 13/06 • • 用火加熱 [3]
- 13/08 • • 利用內部加熱元件 [6]
- 13/10 • 家庭釀造設備 [6]

C12F 發酵溶液副產品之回收；（從葡萄酒或起泡葡萄酒去除酵母見 C12G 1/08）；變性酒精；其製備 [6]

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

3/00 副產品之回收

3/02 • 二氧化碳之回收

3/04	• • 由二氧化碳回收揮發的發酵產品	3/08	• • 由壓榨濾渣或其他廢物中回收酒精（由二氧化碳中見 3/04）
3/06	• 由啤酒及葡萄酒中（3/02 優先，葡萄酒中酵母之去除見 C12G 1/08）	3/10	• 由蒸餾廢液中
		5/00	變性酒精之製備

C12G 葡萄酒；其製備；含酒精飲料（啤酒見 C12C）；C12C 或 C12H 次類不包括的含酒精飲料之製備

附註

於本次類中，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

**1/00 葡萄酒或起泡葡萄酒之製備
[1,2006.01,2019.01]**

- 1/02 • 由葡萄製備葡萄汁；葡萄汁之處理或發酵 [6]
- 1/022 • • 發酵；微生物或酵素處理 [6]
- 1/024 • • • 在水平裝置之圓柱容器中（1/026 優先）[6]
- 1/026 • • • 在具有混合內容物之可移動裝置的容器中 [6]
- 1/028 • • • 葡萄或葡萄汁之熱處理 [6]
- 1/032 • • • 葡萄汁之循環，以進行萃取 [6]
- 1/036 • • • 利用家庭製酒容器 [6]
- 1/04 • • 亞硫酸化葡萄汁；脫亞硫酸
- 1/06 • 起泡葡萄酒之製備；以二氧化碳浸漬葡萄酒（降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00；提高發酵後酒精含量的方法見 C12H 6/00）[1,2006.01,2019.01]
- 1/067 • • 連續方法 [6]
- 1/073 • • 以固定酵母發酵 [6]
- 1/08 • 酵母之去除〔“排去陳酒泥”〕[1,2006.01]
- 1/09 • • 瓶子之攪拌、離心或振動 [6]

- 1/10 • 葡萄酒之去酸作用 [6,2006.01]
- 1/12 • 防止葡萄子沈澱之方法 [6]
- 1/14 • 製備低酒精含量的葡萄酒或起泡葡萄酒（降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00）[2019.01]

**3/00 其它含酒精飲料之製備
[1,2006.01,2019.01]**

- 3/005 • 形成固體或糊狀酒精飲料的組合物[2019.01]
- 3/02 • 用發酵法[1,2006.01,2019.01]
- 3/021 • • 禾本科植物，例如：小麥、小米、高粱、大麥、黑麥或玉米 [2019.01]
- 3/022 • • • 稻屬植物，例如：稻米 [2019.01]
- 3/023 • • 茄科植物，例如：馬鈴薯 [2019.01]
- 3/024 • • 除了葡萄屬植物以外的水果 [2019.01]
- 3/025 • • 低酒精飲料（降低發酵後酒精含量的方法見 C12H 3/00）[2019.01]
- 3/026 • • 在發酵前或發酵過程中添加促進健康的成分，例如：類黃酮類、黃酮類、多酚類或多糖類；在發酵前或發酵過程中添加香料[2019.01]
- 3/04 • 用混合法，例如：利口酒的製備

	[1,2006.01,2019.01]		發酵溶液或酒精類飲料組成之方法（降低發酵溶液或酒精飲料的酒精含量之方法見 C12H 3/00；提高發酵溶液或酒精飲料的酒精含量之方法見 C12H 6/00）
3/05	• • 添加促進健康的成分，例如：類黃酮類、黃酮類、多酚類或多醣類 [2019.01]		
3/055	• • • 從植物中萃取 [2019.01]		
3/06	• • 添加香料		[1.2006.01]
3/07	• • • 以木材萃取物增香，例如：與木材接觸產生的；木材的預處理 [6.2006.01]	3/10	(轉見 C12H 6/00)
		3/12	(轉見 C12H 6/02)
		3/14	(轉見 C12H 6/04)
3/08	• 用未分類於 3/02-3/07 目中，改變		

C12H 酒精飲料之低溫殺菌、除菌、保存、純化、澄清或陳釀；改變發酵溶液或酒精類飲料的酒精含量之方法(葡萄酒去酸見 C12G 1/10；防止葡萄子沈澱見 C12G 1/12；利用芳香化之模擬陳釀見 C12G 3/06) **[6]**

附註

當分類入本次類時，就與色層分析相關的一般意義的技術主題而言，還應該分入 B01D 15/08。[8]

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

1/00 酒精飲料之低溫殺菌、滅菌、保存、純化、澄清或陳釀	1/12	• 無沈澱
1/02 • 結合除去沈澱物或添加材料，例如吸附材料	1/14	• • 用非沈澱化合物，例如，亞硫酸化；分離作用，例如，以螯合成化合物
1/04 • • 借助於離子交換材料或惰性澄清材料，如吸附材料	1/15	• • • 利用酵母 [6]
1/044 • • • 借助無機材料 [6]	1/16	• • 利用物理方法，例如照射
1/048 • • • • 借助含矽材料 [6]	1/18	• • • 利用加熱
1/052 • • • • 借助有機材料 [6]	1/20	• • • • 於允許內容物膨脹的容器內
1/056 • • • • 借助高分子 [6]	1/22	• 經由貯藏之陳釀或催熟，如啤酒之後發酵
1/06 • • 以物理方法沈澱，例如，利用照射，振動	3/00	降低發酵溶液或酒精飲料中酒精含量以獲得低酒精或非酒精飲料的方法[6,2006.01,2019.01]
1/065 • • • 利用離心分離 [6]	3/02	• 利用蒸發 [6,2006.01,2019.01]
1/07 • • • 利用過濾分離 [6]	3/04	• 利用半透膜 [6,2006.01,2019.01]
1/075 • • • • 利用叉流過濾 [6]	6/00	增加發酵溶液或酒精飲料中酒
1/08 • • • 利用加熱		
1/10 • • 以化學方法沈澱		

精含量的方法[2019.01] 6/04 • 利用冷凍[2019.01]
 6/02 • 利用蒸餾[2019.01]

C12J 醋；其製備或純化

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

1/00	醋；其製備或純化 [1,2006.01]	1/08	• 添加香料
1/02	• 由葡萄酒而成者	1/10	• 裝置
1/04	• 由酒精而成者		
1/06	• 由牛奶而成者		

C12L 塗瀝青或脫瀝青機器；酒窖用具

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

3/00	塗瀝青或脫瀝青機器	11/00	酒窖用具
9/00	酒桶，琵琶桶或其類似物之通氣設備		

C12M 酶學或微生物學裝置（糞肥之發酵裝置見 A01C 3/02；人或動物之活器官的保存見 A01N1/10；釀造裝置見 C12C；葡萄酒之發酵裝置見 C12G；製醋裝置見 C12J 1/10）[3]

附註

注意 C12 類標題後之附註(1)至(3)。[4]

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

1/00	酶學或微生物學裝置 [3]	1/00 目包括：
附註		— 產生或分離微生物或酶之裝置； [3]

— 研究微生物或酶之特性，如需要何種生長因素之裝置； [3]	1/24	• 管或瓶型 [3]
— 專門適用於利用微生物或酶作為“反應物”或生物催化劑之裝置； [3]	1/26	• 接種器或採樣器 [3]
— 實驗室及工業規模之裝置； [3]	1/28	• • 容器之部分 [3]
	1/30	• • • 擦棉棒採樣器 [3]
	1/32	• • 多層型或連續型 [3]
	1/33	• 解裂器 [5]
	1/34	• 用條件測量或信號傳感方法測量或檢驗，如菌落計數器 [3,2006.01]
1/02 • 用攪拌方法；用熱交換方法 [3]	1/36	• 包括條件或時間反應控制，如自動控制的發酵器 [3]
1/04 • 用氣體導入方法 [3]	1/38	• • 溫度反應性控制 [3]
1/06 • • 用攪拌器，如葉輪 [3]	1/40	• 為使用游離的，固定的或與載體結合的酶特殊設計的裝置，如含有固定化酶的流動化床裝置 [3]
1/08 • • 用通風管 [3]	1/42	• 用電或波能，如磁力、聲波處理微生物或酶之裝置 [5]
1/09 • • 浮集機 [3]		
1/10 • 固定於旋轉部件上 [3]		
1/107 • 用收集發酵氣體，如甲烷之方法（對於發淤漿進行厭氧處理生產甲烷見 C02F 11/04） [5]	3/00	組織，人類，動物或植物細胞，或病毒培養裝置 [5]
1/113 • • 借助發酵期間輸送底物 [5]	3/02	• 採用懸浮之方法 [3]
1/12 • 用消毒，過濾或透析方法 [3]	3/04	• 採用薄層之方法 [3]
1/14 • 用提供薄層方法或用多級平面盤 [3]	3/06	• 用過濾、超濾、反向滲透或透析方法 [5]
1/16 • 包含或適於包含固體介質 [3]	3/08	• 組織解集聚裝置 [5]
1/18 • • 多層式或間隔式 [3]	3/10	• 於雞蛋內培養 [5]
1/20 • • • 水平面式 [3]		
1/21 • 發泡抑制物 [3]		
1/22 • 培養皿 [3,2006.01]		

C12N 微生物或酶；其組合物；繁殖、保存或維持微生物；變異或遺傳工程；培養基（微生物學之試驗介質見 C12Q 1/00） [3]

附註

- (1) 注意 C12 類標題後之附註(1)至(3)。[3, 4]
- (2) 殺生、害蟲驅避、害蟲引誘、植物生長調節活性劑或製劑還進一步分類見 A01P。[8]
- (3) 單細胞蛋白質或酶之治療活性被進一步分類到 A61P 次類中。[7]
- (4) 當分類至本次類時，就與色層分析相關的一般意義的技術主題而言，還應該分類至 B01D 15/08。[8]

附註

於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

次類索引

微生物；孢子；未分化的細胞；
病毒.....1/00；3/00；5/00；7/10；11/00
酶.....9/00，11/00

用電或波能處理 13/00
突變或基因工程 15/00

1/00 微生物本身，如原生動物；及其組合物（含有由原生動物、細菌或病毒得到的材料之藥物的製備見 A61K 35/66；由藻類材料製備藥物見 A61K 36/02；由真菌中材料製備藥物見 A61K 36/06；藥用細菌之抗原或抗體組合物的製備，如細菌疫苗見 A61K 39/00）；**繁殖，維持或保存微生物或其組合物之方法；製備或分離含有一種微生物之組合物的方法；及其培養基 [3]**

1/02 • 由其培養基內分離微生物 [3]
1/04 • 保存或維持活的微生物（固定化微生物見 11/00）[3]
1/06 • 微生物之溶解 [3]
1/08 • 降低核酸含量 [3]
1/10 • 原生動物；其培養基 [3]
1/11 • • 引入外來遺傳材料而予修飾者 [5]
1/12 • 單細胞藻類；及其培養基（多細胞植物之培養見 A01G；作為新植物本身見 A01H 13/00）[3]
1/13 • • 引入外來遺傳材料而予修飾者 [5]
1/14 • 真菌（蘑菇之培養見 A01G 18/00；作為新植物本身見 A01H 15/00）；其培養基 [3,2006.01]
1/15 • • 引入外來遺傳材料而予修飾者 [5]
1/16 • • 酵母；其培養基 [3]
1/18 • • • 麵包酵母，啤酒酵母 [3]
1/19 • • • 引入外來遺傳材料而予修飾

者 [5]

1/20 • 細菌，其培養基 [3]
1/21 • • 引入外來遺傳材料而予修飾者 [5]
1/22 • 使用纖維素或其水解產物之方法，或含有此等之培養基 [3]
1/24 • 使用廢亞硫酸液之方法，或含有此等之培養基 [3]
1/26 • 使用烴類之方法，或含有其培養基（使用微生物精製烴油見 C10G 32/00）[3]
1/28 • • 脂肪族者 [3]
1/30 • • • 有五個或少於五個碳原子[3]
1/32 • 使用低級鏈烷醇，即 C₁ 至 C₆ 鏈烷醇之培養基 [3]
1/34 • 使用泡沫培養物之方法 [3]
1/36 • 細胞之適應或退化 [3]
1/38 • 用添加作為非必需生長因素之化合物以刺激生長或活性；經由除去化合物刺激生長（1/34 優先）[3]

3/00 孢子形成或分離之方法 [3]

5/00 未分化的人類、動物或植物細胞，如細胞系；組織；其培養或維持；其培養基（用組織培養技術再生植物見 A01H 4/00）[3,5]

5/02 • 單細胞或懸浮細胞之增殖；其維持；其培養基 [3]
5/04 • 植物細胞或組織 [5]
5/07 • 動物細胞或組織 [2010.01]

附註

末位規則並不適用於本群組

- [2010.01]**
- 5/071 • • 脊椎動物細胞或組織，如人類細胞或組織 **[2010.01]**
- 5/073 • • • 胚胎細胞或組織；胎兒細胞或組織 **[2010.01]**
- 5/0735 • • • • 胚胎幹細胞；胚種細胞 **[2010.01]**
- 5/074 • • • 成人幹細胞 **[2010.01]**
- 5/075 • • • 卵母細胞；卵原細胞**[2010.01]**
- 5/076 • • • 精子細胞；精原細胞**[2010.01]**
- 5/077 • • • 間質細胞，如成骨細胞、軟骨細胞、骨髓基質幹細胞、脂肪細胞或肌肉細胞 **[2010.01]**
- 5/0775 • • • • 間質幹細胞；脂肪組織衍生的幹細胞**[2010.01]**
- 5/078 • • • 由血液或免疫系統而衍生的細胞**[2010.01]**
- 5/0781 • • • • B 細胞；及其前驅細胞 **[2010.01]**
- 5/0783 • • • • T 細胞；NK 細胞；及其前驅細胞**[2010.01]**
- 5/0784 • • • • 樹突細胞；及其前驅細胞 **[2010.01]**
- 5/0786 • • • • 單核細胞；巨噬細胞**[2010.01]**
- 5/0787 • • • • 顆粒細胞，如嗜鹼性、嗜酸性、嗜中性或肥大細胞 **[2010.01]**
- 5/0789 • • • • 幹細胞；及其前驅細胞 **[2010.01]**
- 5/079 • • • 神經細胞**[2010.01]**
- 5/0793 • • • • 神經原細胞**[2010.01]**
- 5/0797 • • • • 幹細胞；及其前驅細胞 **[2010.01]**
- 5/09 • 腫瘤細胞**[2010.01]**
- 5/095 • • 幹細胞；及其前驅細胞**[2010.01]**
- 5/10 • 經引入外來遺傳材料而修飾的細胞，如病毒轉化的細胞 [5]
- 5/12 • • 融合細胞，如雜交瘤 [5]
- 5/14 • • • 植物細胞 [5]
- 5/16 • • • 動物細胞 [5]
- 5/18 • • • • 鼠細胞，如小鼠細胞 [5]

- 5/20 • • • • 融合對象之一條 B 淋巴細胞 [5]
- 5/22 • • • 人類細胞 [5]
- 5/24 • • • • 融合對象之一條 B 淋巴細胞 [5]
- 5/26 • • • 種間融合而得的細胞 [5]
- 5/28 • • • • 融合對象之一條人類細胞 [5]
- 7/00 病毒，如噬菌體；其組合物；其製備或純化**(含有病毒藥物之製備見 A61K 35/76；藥用病毒抗原或抗體組合物之製備，如病毒疫苗見 A61K 39/00) **[3]**
- 7/01 • 病毒，如噬菌體，以引入外來基因材料而予修飾者（載體見 15/00）[5]
- 7/02 • 回收或純化 [3]
- 7/04 • 失活或減毒；生產病毒亞單位 [3]
- 7/06 • • 用化學處理 [3]
- 7/08 • • 用病毒連續傳代之方法 [3]
- 9/00 酶，如連接酶 (6.)；酶原；其組合物**(用於清潔牙齒之含酶製劑見 A61K 8/66、A61Q 11/00；含酶或酶原的醫藥製劑見 A61K 38/43；含酶去污劑組合物見 C11D)；**製備、活化、抑制、分離或純化酶之方法**(麥芽之製備見 C12C 1/00) **[3]**

附註

於本目內：

- 酶原分類入與相應的酶內 [5]
 - 在本目中，按照國際酶學委員會之“酶之命名及分類法”進行酶的一般分類。在適當場合，此一指示出現在各目後的圓括號中。[3]
- 9/02 • 氧化還原酶 (1.)，如螢蟲素酶 [3]
- 9/04 • • 作為供體作用於 CHOH 基團，如葡萄糖氧化酶，乳酸脫

- 9/06 氫酶 (1.1) [3]
 • 作為供體作用於含氮化合物 [1.4、1.5、1.7] [3]
- 9/08 • 作為受體作用於過氧化氫 (1.11) [3]
- 9/10 • 轉移酶 (2.) (核糖核酸酶見 9/22) [3]
- 9/12 • 轉移含磷基團，如激酶 (2.7) [3]
- 9/14 • 水解酶 (3.) [3]
- 9/16 • 作用於酯鍵上 (3.1) [3]
- 9/18 • • 羧酸酯水解酶 [3]
- 9/20 • • • 三羧酸甘油酯裂解，如用脂肪酶 [3]
- 9/22 • • • 核糖核酸酶 [3]
- 9/24 • • 作用於糖基化合物上 (3.2) [3]
- 9/26 • • • 作用於 α -1,4-糖苷鍵上，如透明質酸酶，轉化酶，澱粉酶 [3]
- 9/28 • • • • 來自微生物源之 α -澱粉酶，如細菌澱粉酶 [3]
- 9/30 • • • • • 真菌源 [3]
- 9/32 • • • • 來自植物源之 α -澱粉酶 [3]
- 9/34 • • • • 葡糖澱粉酶 [3]
- 9/36 • • • 作用在 N-乙醯胞壁酸及 2-乙醯胺基 2-脫氧-D-葡萄糖之間的 β -1,4 鍵上，如溶菌酶 [3]
- 9/38 • • • 作用於 β -半乳糖苷鍵上，如 β -半乳糖苷酶 [3]
- 9/40 • • • 作用在 α -半乳糖苷鍵上，如 α -半乳糖苷酶 [3]
- 9/42 • • • 作用於 β -1,4-糖苷鍵上，如纖維素酶 [3]
- 9/44 • • • 作用於 α -1,6-糖苷鍵上，如異澱粉酶，支鏈澱粉酶 [3]
- 9/46 • • • • 葡聚糖酶 [3]
- 9/48 • • 作用於肽鍵上，如促凝血酶，亮胺酸胺基肽酶 (3.4) [3]
- 9/50 • • • 蛋白酶 [3]
- 9/52 • • • • 由細菌得到 [3]
- 9/54 • • • • 屬於芽孢桿菌屬之細菌 [3]
- 9/56 • • • • • 枯草芽孢桿菌或地衣型芽孢桿菌 [3]
- 9/58 • • • • 由真菌得到 [3,2006.01]
- 9/60 • • • • • 由酵母 [3]
- 9/62 • • • • • 由曲黴屬 [3]
- 9/64 • • • • 由動物組織得到，如凝乳酶 [3]
- 9/66 • • • 彈性硬蛋白酶 [3]
- 9/68 • • • 血纖維蛋白溶酶 [3]
- 9/70 • • • 鏈激酶 [3]
- 9/72 • • • 尿激酶 [3]
- 9/74 • • • 凝血酶 [3]
- 9/76 • • • 胰蛋白酶；胰凝乳蛋白酶 [3]
- 9/78 • • 作用於除肽鍵外之碳-氮鍵上 (3.5) [3]
- 9/80 • • • 作用於有線型醯胺中之醯胺鍵上 [3]
- 9/82 • • • • 天冬醯胺酶 [3]
- 9/84 • • • • 青黴素醯胺酶 [3]
- 9/86 • • • 作用在環醯胺內之醯胺鍵上，如青黴素酶 [3]
- 9/88 • 裂解酶 (4.) [3]
- 9/90 • 異構酶 (5.) [3]
- 9/92 • • 葡萄糖異構酶 [3]
- 9/94 • 胰酶 (製劑) [3]
- 9/96 • 用形成一種加合物或組合物之方法予以穩定酶；形成酶結合物 [3]
- 9/98 • 粒狀或自由流動酶組合物之製備 (9/96 優先) [3]
- 9/99 • 用化學處理使酶失活 [3]
- 11/00 與載體結合的或固相化的酶；與載體結合的或固相化的微生物細胞；其製備 [3]**
- 11/02 • 固定於有機載體上或於其中之酶或微生物細胞 [3,2006.01]
- 11/04 • • 截留於載體，如凝膠或空心纖維內 [3,2006.01]
- 11/06 • • 利用橋接劑附於載體上 [3]
- 11/08 • • 載體為合成聚合物 [3,2006.01,2020.01]

- 11/082 . . . 僅涉及碳-碳不飽和鍵之反應獲得 [2020.01]
- 11/084 . . . 含有乙烯醇單元的聚合物 [2020.01]
- 11/087 . . . 丙烯酸聚合物 [2020.01]
- 11/089 . . . 除僅涉及碳-碳不飽和鍵以外之反應獲得 [2020.01]
- 11/091 . . . 酚醛樹脂；胺基樹脂 [2020.01]
- 11/093 . . . 聚胺酯 [2020.01]
- 11/096 . . . 聚酯；聚醯胺 [2020.01]
- 11/098 . . . 在酶或微生物細胞存在下形成的 [2020.01]
- 11/10 . . 載體為碳水化合物 [3]
- 11/12 . . . 纖維素或其衍生物 [3]
- 11/14 . 固定於無機載體上或其中之酶或微生物細胞 [3,2006.01]
- 11/16 . 固定於生物細胞上或其中之酶或微生物細胞 [3,2006.01]
- 11/18 . 多酶體系 [3]
- 13/00 用電或波能，如磁，聲波處理微生物或酶 [3]**
- 15/00 突變或基因工程；涉及基因工程之 DNA 或 RNA、載體，例如質體，或其分離、製備或純化；其宿主之應用（突變體或基因工程化之微生物見 1/00、5/00、7/00；新植物見 A01H；利用組織培養技術複製植物見 A01H 4/00；新動物見 A01K 67/00；含插入活體細胞以治療遺傳病之基因材料的藥劑之應用，基因治療法見 A61K 48/00；一般肽類見 C07K） [3,5,6]**

附註

本目包括對無人為干預情況下自然界中通常不出現的遺傳材料進行修飾之方法；此一方法使基因結構發生可連續傳代之改變。 [3]

- 15/01 . 其中未引入外來遺傳材料之突變體的製備 [5]
- 15/02 . 由二個或二個以上細胞融合，如原生質體融合製備雜交細胞 [5]
- 15/03 . . 細菌 [5]
- 15/04 . . 真菌 [5,2006.01]
- 15/05 . . 植物細胞 [5]
- 15/06 . . 動物細胞 [5]
- 15/07 . . 人類細胞 [5]
- 15/08 . . 種間融合而得的細胞 [5]
- 15/09 . DNA 重組技術 [5]
- 15/10 . . 分離、製備或純化 DNA 或 RNA 之方法（DNA 或 RNA 之化學製備見 C07H 21/00；自微生物內或用酶製備非結構多核苷酸見 C12P 19/34） [5]
- 15/11 . . DNA 或 RNA 片段，其修飾形成（不用於重組技術之 DNA 或 RNA 見 C07H 21/00） [5]
- 15/113 . . . 非編碼核酸調節基因的表達，如反義寡核苷酸 [2010.01]
- 15/115 . . . 適體，如核酸與目標分子結合及高度親合但非與雜交有關 [2010.01]
- 15/117 . . . 核酸具有免疫調節特性，如 CpG-motifs [2010.01]
- 15/12 . . . 編碼動物蛋白質之基因 [5]
- 15/13 . . . 免疫球蛋白 [5]
- 15/14 . . . 人血清蛋白 [5]
- 15/15 . . . 蛋白酶抑制物、如抗凝血酶、抗胰蛋白酶、水蛭素 [5]
- 15/16 . . . 激素 [5]
- 15/17 . . . 胰島素 [5]
- 15/18 . . . 生長激素 [5]
- 15/19 . . . 干擾素；淋巴激活素；細胞激活素 [5]
- 15/20 . . . 干擾素 [5]
- 15/21 . . . α -干擾素 [5]
- 15/22 . . . β -干擾素 [5]
- 15/23 . . . γ -干擾素 [5]
- 15/24 . . . 白細胞介素 [5]

- 15/25 白細胞介素-1 [5]
- 15/26 白細胞介素-2 [5]
- 15/27 集落刺激因子 [5]
- 15/28 腫瘤壞死因子 [5]
- 15/29 . . . 編碼植物蛋白質，如奇甜蛋白（thaumatin）之基因 [5]
- 15/30 . . . 編碼原生動物蛋白質，如瘧原蟲、錐體蟲或艾美蟲屬蛋白質之基因 [5]
- 15/31 . . . 編碼微生物蛋白質，如內毒素之基因 [5]
- 15/32 芽孢桿菌結晶蛋白質 [5]
- 15/33 編碼病毒蛋白質之基因[5]
- 15/34 來自 DNA 病毒之蛋白質 [5]
- 15/35 微小 DNA 病毒科，如貓瘟病毒、人微小 DNA 病毒 [5]
- 15/36 Hepadnaviridae 病毒科 [5]
- 15/37 乳多空病毒科，如乳頭狀瘤病毒、多型瘤病毒、猿猴腎病毒 40（SV40） [5]
- 15/38 疱疹病毒科，如單純疱疹病毒、水痘一帶狀疱疹病毒、非洲淋巴瘤病毒（Epstein-Barr，E-B 病毒）、細胞巨化病毒、假狂犬病病毒 [5]
- 15/39 痘病毒科，如牛痘病毒或天花病毒 [5]
- 15/40 來自 RNA 病毒，如黃色病毒之蛋白質 [5]
- 15/41 微小 RNA 病毒科，如鼻病毒，柯薩奇病毒、埃可病毒、腸道病毒 [5]
- 15/42 口蹄疫病毒 [5]
- 15/43 脊髓灰質炎病毒[5]
- 15/44 正黏病毒科，如流感病毒 [5]
- 15/45 副黏病毒科，如麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、雞瘟病毒、犬溫熱病毒、牛瘟病毒、呼吸道合胞體病毒 [5]
- 15/46 呼腸病毒科、如輪狀病毒、蘭舌病毒、科洛拉多蜱熱病毒 [5]
- 15/47 彈性病毒科，如狂犬病毒、水疱性口炎病毒 [5]
- 15/48 逆向轉錄病毒科，如牛白血病病毒、貓白血病毒 [5]
- 15/49 慢病毒亞科，如免疫缺陷病毒、綿羊髓鞘脫落症病毒、馬感染性貧血病毒 [5]
- 15/50 冠狀病毒科，如傳染性支氣管炎病毒、可傳播性胃腸炎病毒 [5]
- 15/51 肝炎病毒 [5]
- 15/52 . . . 編碼酶或酶原之基因 [5]

附註

本目內

- 編號酶原之基因係分類入編碼相應之基因內；
- 按照國際酶學委員會之“酶之命名及分類法”對酶進行一般分類。於適當場合，此一命名出現於各目之括號內。[5]

15/53 氧化還原酶（1） [5]

15/54 轉移酶（2） [5]

15/55 水解酶（3） [5]

15/56 作用於糖基化合物上（3.2），如澱粉酶、半乳糖苷酶、溶菌酶 [5]

- 15/57 作用於肽鍵上 (3.4) [5]
 15/58 血纖維蛋白溶酶原活化劑，如尿激酶、組織型血纖維蛋白溶酶原活化因子 (TPA) [5]
 15/59 凝乳糖 [5]
 15/60 裂解酶 (4) [5]
 15/61 異構酶 (5) [5]
 15/62 . . . 編碼融合蛋白質之 DNA 順序 [3]

附註

於本目內，所用下列術語具有指定之意義；
 — “融合” 意指兩種不同蛋白質之融合。[5]

- 15/63 . . 使用載體引入外來遺傳材料；載體；其宿主；表達之調節 [5,2006.01]
 15/64 . . . 製備載體、將其引入細胞或選擇含載體宿主之一般方法 [5]
 15/65 . . . 使用標記 (用酶作標記物見 15/52) [5]
 15/66 . . . 經裂解及連接將基因插入載體內以形成重組載體；非功
 15/72 使用得自 lac 操縱子之調節順序之表達系統 [5]
 15/73 使用入噬菌體調節順序之表達系統 [5]
 15/74 . . . 專門適用於大腸桿菌以外之原核細胞宿主，如乳桿菌、小單孢菌之載體或表達系統 [5]

附註

本目包括使用原核生物作為宿主 [5]

- 15/75 用於芽孢桿菌屬 [5]

能性銜接子或連接物，如含限制性核酸內切酶裂解順序的銜接子之使用。[5]

附註

於本目內，所用下列辭句具有指定之意義：

— “非功能性銜接子” 係指用於連接 DNA 順序且無結構基因之已知功能或調節功能的 DNA 順序。[5]

- 15/67 . . . 提高表達之一般方法 [5]
 15/68 載體之穩定化 [5]
 15/69 增加載體之複印數 [5]
 15/70 . . . 專門適用於大腸桿菌之載體或表達系統 [5]

附註

- (1) 本目包括用大腸桿菌作為宿主。
 (2) 亦於大腸桿菌內複製的穿梭載體按照其他宿主分類 [5]

- 15/71 使用得自 trp 操縱子之調節順序之表達系統 [5]
 15/76 用於放線菌；鏈黴菌屬 [5]
 15/77 用於棒狀桿菌屬；短桿菌屬 [5]
 15/78 用於假單胞菌屬 [5]
 15/79 . . . 專門適用於真核細胞宿主之載體或表達系統 [5]

附註

本目包括使用真核生物作為宿主。[5]

- 15/80 用於真菌 [5,2006.01]
 15/81 用於酵母 [5]
 15/82 用於植物細胞 [5]

- 15/83 病毒載體，如花椰菜花
葉病毒 [5]
- 15/84 Ti 質粒 [5]
- 15/85 用於動物細胞 [5]
- 15/86 病毒載體 [5]
- 15/861 腺病毒載體 [7]
- 15/863 痘病毒載體，例如痘
苗病毒 [7]
- 15/864 細小病毒載體 [7]
- 15/866 桿狀病毒載體 [7]
- 15/867 逆轉錄病毒載體 [7]
- 15/869 疱疹病毒載體 [7]
- 15/87 使用其他次目不包括之方法（如
共轉化）引入外來遺傳材料 [5]
- 15/873 生產胚胎的技術，如核移植，
調控胚胎細胞或生產嵌合胚細
胞[2010.01]
- 15/877 生產新哺乳類無性繁殖胚
胎的技術[2010.01]
- 15/88 使用微膠囊，如使用脂質體
[5]
- 15/89 使用微量注射法 [5]
- 15/90 將外來 DNA 穩定地引入染
色體內 [5]

C12P 藉由發酵或使用酶催化反應以合成所欲之化合物、組合物或從外消旋 混合物中分離出光學異構物 [3]

附註 [3,4,6]

- (1) 本次類涵蓋較大或較小之化學修飾。
- (2) 1/00 目涵蓋生產不能充分確定分入 3/00 至 37/00 目內之有機化合物的方
法。僅按其實驗式確定的化合物不能被視為充分確定者。
- (3) 注意 C12 類標題後之附註(1)至(3)。
- (4) 如一個特殊反應視作合適者，其亦可被分入相關的化合物類中例如
C07，C08。
- (5) 於本次類內：
 - 一種化合物之金屬或銨鹽按該化合物分類；
 - 組合物分入相關之化合物類中。
- (6) 於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。

次類索引

化學物質之生物合成	雜環有機化合物	17/00
無機化合物.....	含糖基	19/00
無環或碳環有機化合物.....	核黃素	25/00
肽或蛋白質類.....	赤黴素	27/00
葫蘿蔔素	頭孢菌素；青黴素	35/00，37/00
四環素	旋光異構體之分離	41/00
前列腺素	生物合成製備之其他方法	1/00，39/00
類固醇		

1/00 使用微生物或酶，製備 3/00 至 39/00 目內未提供的化合物或組合物；使用微生物或酶製備化合物或組合物之一般方法 [3]

1/02 • 使用真菌 [3,2006.01]

1/04 • 使用細菌 [3]

1/06 • 使用放線菌目 [5]

3/00 除二氧化碳外元素或無機化合物之製備 [3]

5/00 烴之製備 [3]

5/02 • 無環者 [3]

7/00 含氧有機化合物之製備 [3]

7/02 • 含有羥基 [3]

7/04 • • 無環者 [3]

7/06 • • • 乙醇，即非飲料 [3]

7/08 • • • • 作為副產品或由廢物或纖維素材料基質中製得 [3]

7/10 • • • • • 含纖維素材料之基質[3]

7/12 • • • • • 含亞硫酸鹽廢液或柑桔廢液基質 [3]

7/14 • • • • 多級發酵；多種類型微生物或微生物之重複使用 [3]

7/16 • • • 丁醇 [3]

7/18 • • • 多羥基者 [3]

7/20 • • • • 甘油

7/22 • • 芳香族 [3]

7/24 • 含有羰基 [3]

7/26 • • 酮類 [3]

7/28 • • • 含丙酮之產品 [3]

7/30 • • • • 由含有水以外無機化合物之基質中製得 [3]

7/32 • • • • 由含無機氧源基質中製得 [3]

7/34 • • • • 由含蛋白質作為氮源之基質中製得 [3]

7/36 • • • • 由含有穀物或穀類植物之材料基質中製得 [3]

7/38 • • • 含環戊酮或環戊二烯產品[3]

7/40 • 含有一個羧基 [3]

7/42 • • 羥基羧酸 [3]

7/44 • • 多羧酸 [3]

7/46 • • • 有四個或少於四個碳原子之二羧酸，如富馬酸、馬來酸 [3]

7/48 • • • 三羧酸，如檸檬酸 [3]

7/50 • • • 含酮基，如 2-氧化酮戊二酸 [3]

7/52 • • 丙酸；丁酸 [3]

7/54 • • 醋酸 [3]

7/56 • • 乳酸 [3]

7/58 • • 醛糖酸，酮基一醛糖酸或糖酸（糖醛酸見 19/00）[3]

7/60 • • • 2-酮古洛糖酸 [3]

7/62 • 羧酸酯 [3,2006.01,2022.01]

7/625 • • 羥基羧酸酯之聚酯 [2022.01]

7/64 • 脂肪；脂油；酯型蠟；高級脂肪酸，即在一連接羧基之完整的鏈上至少有七個碳原子；氧化油或脂 [3,2006.01,2022.01]

7/6409 • • 脂肪酸 [2022.01]

7/6418 • • • 通過脂肪酸酯之水解 [2022.01]

7/6427 • • • 聚不飽和脂肪酸 [PUFA]，即在其主鏈中具有二或多個雙鍵 [2022.01]

7/6431 • • • • 亞麻油酸 [18:2[n-6]] [2022.01]

7/6432 • • • • 二十碳五烯酸 [EPA] [2022.01]

7/6434 • • • • 二十二碳六烯酸 [DHA] [2022.01]

7/6436 • • 脂肪酸酯 [2022.01]

7/6445 • • • 甘油酯 [2022.01]

7/6454 • • • • 通過酯化作用 [2022.01]

7/6458 • • • • 通過轉酯化作用，例如交酯化、酯交換、醇解或酸解作用 [2022.01]

7/6463 • • • • 由產生甘油酯之微生物獲得，例如單細胞油脂 [2022.01]

7/6472 • • • • 含有不飽和脂肪酸[PUFA]之殘基，即在其主鏈中具有二或多個雙鍵 [2022.01]

7/6481 • • • • 磷酸甘油酯(具有少於七個

- 碳原子之羧酸之磷酸甘油
酯見 7/62) [2022.01]
- 7/649 • • • 生質柴油，即脂肪酸烷基酯
[2022.01]
- 7/66 • 含有醌型結構 [3]
- 9/00 含有一種金屬或除 H, N, C, O, S
或鹵素以外之原子的有機化合
物之製備 [3]**
- 11/00 含硫有機化合物之製備 [3]**
- 13/00 含氮有機化合物之製備 [3]**
- 13/02 • 醯胺，如氯黴素 [3]
- 13/04 • α -或 β -胺基酸 [3]
- 13/06 • • 丙胺酸；亮胺酸；異亮胺酸；
絲胺酸；高絲胺酸 [3]
- 13/08 • • 賴胺酸；二胺基庚二酸；蘇胺
酸；纈胺酸 [3]
- 13/10 • • 瓜胺酸；精胺酸；鳥胺酸 [3]
- 13/12 • • 蛋胺酸；半胱胺酸；胱胺酸 [3]
- 13/14 • • 穀胺酸；穀醯胺 [3]
- 13/16 • • • 使用表面活性劑，脂肪酸或
脂肪酸酯，即在一與羧基或
羧酯基連接的完整鏈上至
少有七個碳原子 [3]
- 13/18 • • • 使用生物素或其衍生物 [3]
- 13/20 • • 天冬胺酸；天冬醯胺 [3]
- 13/22 • • 色胺酸；酪胺酸；苯丙胺酸；
3,4-二羥苯丙胺酸 [3]
- 13/24 • • 脯胺酸；羥基脯胺酸；組胺酸
[3]
- 15/00 至少含三個稠合碳環之化合物的
製備 [3]**
- 17/00 僅有 O, N, S, Se 或 Te 作為環雜
原子之雜環碳化合物的製備
(13/04 至 13/24 優先) [3]**
- 17/02 • 氧作為僅有之環上雜原子 [3]
- 17/04 • • 含有五個節之雜環，如灰黃黴
素 [3]
- 17/06 • • 含有六個節之雜環，如螢光素
[3]
- 17/08 • • 含有至少七個節之雜環，如玉
米赤黴烯酮，大環內酯糖苷配
基 [3]
- 17/10 • 氮作為僅有之環雜原子 [3]
- 17/12 • • 含有六個節之雜環 [3]
- 17/14 • 氮或氧作為雜原子且在相同的環
上至少有另一個不同的雜環原子
[3]
- 17/16 • 含有兩個或更多的雜環 [3]
- 17/18 • 至少含有兩個在其本身之間稠合
或與一共同的碳環體系稠合的雜
環，如利福黴素 [3]
- 19/00 含有糖殘基之化合物之製備（酮
醛糖酸見 7/58）[3]**
- 附註**
- 注意於 C07H 次類標題後之附註
(3)，限定“糖類殘基”一詞之定
義 [3]
- 19/02 • 單糖 [3]
- 19/04 • 多糖，即含五個以上由糖苷鍵彼
此連接的糖類殘基之化合物 [3]
- 19/06 • • 黃原，即黃單胞菌屬型雜多糖
[3]
- 19/08 • • 葡聚糖 [3]
- 19/10 • • 支鏈澱粉 [3]
- 19/12 • 二糖 [3]
- 19/14 • 由碳水化合物酶作用產生者，如
由 α -澱粉酶 [3]
- 19/16 • 由 α -1,6 糖苷酶作用產生者，如
直鏈澱粉，去分枝支鏈澱粉 [3]
- 19/18 • 由糖基轉移酶作用產生者，如 α -
、 β -或 γ -環狀糊精 [3]
- 19/20 • 由外切-1,4 α -糖苷酶作用產生
者，如葡萄糖 [3]
- 19/22 • 由 β -澱粉酶作用產生者，如麥芽
糖 [3]
- 19/24 • 由異構酶作用產生者，如果糖 [3]
- 19/26 • 含氮碳水化合物之製備 [3]
- 19/28 • • N-葡萄糖苷 [3]
- 19/30 • • • 核苷酸 [3]
- 19/32 • • • • 於同一環節中有兩個氮原
子之含六節環之稠合環體
系，如嘌呤二核苷酸，菸

- 醯胺一腺嘌呤二核苷酸 [3]
- 19/34 多核苷酸，如核酸、寡核糖核苷酸 [3]
- 19/36 二核苷酸，如磷酸菸醯胺一腺嘌呤二核苷酸 [3]
- 19/38 核苷 [3]
- 19/40 於同一環中有兩個氮原子之六節環之稠合環體系，如嘌呤核苷 [3]
- 19/42 鈷胺素，即維生素 B12，LLD 因子 [3]
- 19/44 O-糖苷，如糖苷之製備 [3]
- 19/46 有一個與環己基連接的糖殘基氧原子，如春日黴素 [3]
- 19/48 為兩個或更多的氮原子取代之環己基，如越黴素，新黴胺 [3]
- 19/50 有兩個利用僅有的氧與相鄰環的己基碳原子相連接的糖基，如胺丁醯苷菌素，核苷糖黴素 [3]
- 19/52 含有三個或更多的糖類殘基，如新菌素，青紫黴素 [3]
- 19/54 環己基直接連接至兩個或更多 $\begin{array}{c} \text{N}-\text{C}-\text{N} \\ \parallel \\ \text{N} \end{array}$ 殘基之氮原子上。如鏈黴素 [3]
- 19/56 有一個直接與有三個更多個碳環之稠合環體系連接的糖類殘基之氧原子，如道諾黴素，亞德里亞黴素 [3]
- 19/58 有一利用僅有的無環碳原子直接與非糖化物雜環連接的糖類殘基之氧原子，如博萊黴素，腐草黴素 [3]
- 19/60 有一個直接與非糖化物雜環或含有一非糖化物雜環之稠合環體系相連接的糖類殘基氧，如香豆黴素，新生黴素 [3]
- 19/62 有八個或更多環節與僅有氧作為環上雜原子之雜環，如

紅黴素，螺旋黴素，制黴菌素 [3]

- 19/64 S-糖苷，如林絲黴素之製備 [3]
- 21/00 肽或蛋白質之製備（單細胞蛋白見 C12N 1/00） [3]
- 21/02 有兩個或更多個胺基酸之已知序列，如穀胱甘肽 [3]
- 21/04 環或橋接肽或多肽，如桿菌肽 [3,2006.01]

附註[2020.01]

僅利用—S—S—鍵成環之環或橋接肽或多肽僅分類入 21/02。

- 21/06 由肽鍵水解產生，如水解產物 [3]
- 21/08 單株抗體 [3]
- 23/00 含有共軛雙鍵連接的至少含十個碳原子之不飽和側鏈之環己烯環的化合物之製備（含雜環者見 17/00） [3]
- 25/00 含咯吡或異咯吡核化合物，如核黃素之製備 [3]
- 27/00 含赤黴素烷環體系之化合物，如赤黴素之製備 [3]
- 29/00 含有并四苯環體系之化合物，如四環素之製備（19/00 優先） [3]
- 31/00 含有一五節環化合物之製備，該環於相互鄰位上有二個側鏈，且至少有一以與其中一個側鏈之相鄰位置直接與環連接的氧原子，不直接與環連接一個側鏈含一個有三個與雜原子連接的鍵之碳原子，其中至多一個鍵與鹵素連接，而另一側鏈至少有一個於 γ 位與環連接的氧原子，如前列腺素 [3]
- 33/00 類固醇之製備 [3]

附註

注意於 C07J 次類標題後附註
內“類固醇”之含義。[3]

附註

於目 33/02 至 33/20 內，所用
下列術語具有指定之含意：
“作用”“形成”、“羥基
化”、“脫羥基”或“脫
氫”係指其他化學作用以外
之微生物或酶之作用。[3]

- 33/02 · 脫氫，脫羥基 [3]
- 33/04 · · 由 A 環形成芳香環 [3]
- 33/06 · 羥基化 [3]
- 33/08 · · 於 11 位 [3]
- 33/10 · · · 於 11 α -位 [3]
- 33/12 · 作用於 D 環上 [3]
- 33/14 · · 於 16 位上羥基化 [3] 33/16
· · 作用在 17 位上 [3]
- 33/18 · · · 於 17 位上羥基化 [3]
- 33/20 · 含雜環 [3]
- 35/00 有 5-硫雜-1-氮雜雙環 [4.2.0] 辛

烷環體系之化合物，如頭孢黴菌
素之製備 [3]

- 35/02 · 由在 7 位上取代基之去鹽化作用
[3]
- 35/04 · 由在 7 位上取代基之鹽化作用[3]
- 35/06 · 頭孢菌素 C；及其衍生物 [3]
- 35/08 · 於 7 位雙取代者 [3]
- 37/00 含 4-硫雜-1-氮雜二環 [3.2.0]庚
烷環體系之化合物，如青黴素之
製備 [3]
- 37/02 · 存在苯乙酸或苯乙醯胺或此等之
衍生物 [3]
- 37/04 · 由在 6 位上取代基之鹽化作用[3]
- 37/06 · 由在 6 位上取代基之去鹽化作用
[3]
- 39/00 於同一過程中同時包含不同屬
之微生物的方法 [3]
- 41/00 使用酶或微生物之由外消旋混
合物內分離旋光異構體之方法
[4]

C12Q 包含酶、核酸或微生物之測定或檢驗方法（免疫檢測見 G01N 33/53）；其
所用之組合物或試紙；此種組合物之製備方法；於微生物學方法或酶
學方法內之條件反應控制 [3]

附註[3,4,6]

- (1) 本次類不涵蓋 G01N 3/00 至 29/00 目內之任何方法之進展或結果的檢
測，其係涵蓋於 G01N 次類內。[3]
- (2) 於本次類內，下列名詞意指：
— “包含”，當用於相關物質時，包括檢測該物質以及於檢驗不同物質
時做為決定性因素或反應物。[3]
- (3) 注意 C12 類標題後之附註(1)至(3)。[4]
- (4) 於本次類內，試驗培養基被分類入有關試驗方法之適當之目內。[3]
- (5) 於本次類內，最好加入次類 C12R 之索引碼。[6]

**1/00 包括酶、核酸或微生物之測定或
檢測方法**（帶有條件測量或傳感器

之測定或試驗裝置，如菌落計數器
見 C12M 1/34）；其組合物；此種

- 組合物之製備方法 [3,2006.01]**
- 1/02 • 包含能生存的微生物 [3]
 - 1/04 • • 微生物之存在或種類之測定；
用於試驗抗菌素或殺菌劑之
選擇性培養基之使用；其含化
學 指 示 劑 之 組 合 物
[3,2006.01]
 - 1/06 • • • 定量檢測 [3]
 - 1/08 • • • • 使用多區域培養基 [3]
 - 1/10 • • • 腸細菌 [3]
 - 1/12 • • • 還原硝酸鹽為亞硝酸鹽之細
菌 [3]
 - 1/14 • • • 鏈球菌屬；葡萄球菌屬 [3]
 - 1/16 • • • 使用放射性材料 [3]
 - 1/18 • • 材料之抗微生物活性的試驗
[3,2006.01]
 - 1/20 • • • 使用多區域培養基 [3]
 - 1/22 • • 無菌條件之試驗 [3,2006.01]
 - 1/24 • • 採樣，或接種或擴散樣品之方
法；物理分離完整微生物之方
法 [3]
 - 1/25 • 包括不分入 1/26～1/70 目內的
酶。[5]
 - 1/26 • 包括氧化還原酶 [3]
 - 1/28 • • 包括過氧化物酶 [3]
 - 1/30 • • 包括過氧化氫酶 [3]
 - 1/32 • • 包括脫氫酶 [3]
 - 1/34 • 包括水解酶 [3]
 - 1/37 • • 包括肽酶或蛋白酶 [5]
 - 1/40 • • 包括澱粉酶 [3]
 - 1/42 • • 包括磷酸酶 [3]
 - 1/44 • • 包括酯酶 [3]
 - 1/46 • • • 包括膽鹼酯酶 [3]
 - 1/48 • 包括轉移酶 [3]
 - 1/50 • • 包括磷酸肌酸激酶 [3]
 - 1/52 • • 包括轉胺酶 [3]
 - 1/527 • 包括溶解酶 [5]
 - 1/533 • 包括異構酶 [5]
 - 1/54 • 包括葡萄糖或半乳糖 [3]
 - 1/56 • 包括血凝因子，如包含凝血酶，
組織促凝血酶原激酶，血纖維蛋
白原 [3]
 - 1/58 • 包括尿素或尿素酶 [3]
 - 1/60 • 包括膽固醇 [3]
- 附註 [2018.01]**
- 於本目中，根據最相關的特徵進行分類，而不考慮末位優先規則
- 1/61 • 包括甘油三酯 [5]
 - 1/62 • 包含尿酸 [5]
 - 1/64 • 地質微生物試驗，如用於石油
[3,2006.01]
 - 1/66 • 包括發光酶螢光素 [3]
 - 1/68 • 包括核酸 [3,2006.01,2018.01]
 - 1/6804 • • 使用免疫原分析核酸(免疫測定
法見 G01N 33/53) [2018.01]
 - 1/6806 • • 製備用於分析的核酸，例如用
於聚合酶連鎖反應[PCR]測定
(1/6804 優先) [2018.01]
 - 1/6809 • • 包括差異檢測的核酸測定或鑑
定方法 [2018.01]
 - 1/6811 • • 用於生產或設計標靶特異性寡
核苷酸或結合分子的選擇方法
[2018.01]
 - 1/6813 • • 雜交測定 [2018.01]
 - 1/6816 • • • 以檢測方式為特徵 (1/6804
優先) [2018.01]
 - 1/6818 • • • • 包括兩個或多個標記的相
互作用，例如共振能量轉
移 [2018.01]
 - 1/682 • • • • 信號擴增 [2018.01]
 - 1/6823 • • • • 結合標記的釋放[2018.01]
 - 1/6825 • • • • 包括感測器的核酸檢
[2018.01]
 - 1/6827 • • • 用於檢測突變或多型
[2018.01]
 - 1/683 • • • • 包括限制酶，例如限制片
段多型性[RELP]
[2018.01]
 - 1/6832 • • • 增強雜交反應 [2018.01]
 - 1/6834 • • • 酶或生化偶合核酸至固相
[2018.01]
 - 1/6837 • • • • 利用探針陣列或探針晶片
(1/6874 優先) [2018.01]
 - 1/6839 • • • 雜交測定中的三重螺旋形成
或其他更高階構形
[2018.01]
 - 1/6841 • • • 原位雜交 [2018.01]
 - 1/6844 • • 核酸擴增反應[2018.01]

- 1/6848 . . . 以用於防止污染或增加擴增反應的特異性或敏感性的方法為特徵 [2018.01]
- 1/6851 . . . 定量擴增 [2018.01]
- 1/6853 . . . 使用經修飾的引子或模板 [2018.01]
- 1/6855 . . . 連接轉接器 [2018.01]
- 1/6858 . . . 等位基因特異性擴增 [2018.01]
- 1/686 . . . 聚合酶連鎖反應[PCR] [2018.01]
- 1/6862 . . . 連接酶連鎖反應[LCR] [2018.01]
- 1/6865 . . . 基於啟動子的擴增，例如基於核酸序列的擴增[NASBA]、自我持續序列複製[3SR]或基於轉錄的擴增系統[TAS] [2018.01]
- 1/6867 . . . 基於複製酶的擴增，例如利用 Q-β 複製酶 [2018.01]
- 1/6869 . . . 定序之方法 [2018.01]
- 1/6872 . . . 包括質譜法 [2018.01]
- 1/6874 . . . 包括核酸陣列，例如經由雜交定序[SBH] [2018.01]
- 1/6876 . . . 用於分析核酸的核酸產物，例如引子或探針 [2018.01]
- 1/6879 . . . 用於性別之判定 [2018.01]
- 1/6881 . . . 用於組織或細胞之分型，例如人類白血球抗原[HLA]探針 [2018.01]
- 1/6883 . . . 用於因遺傳物質改變引起的疾病 [2018.01]
- 1/6886 . . . 用於癌症(用免疫測定法測定癌症見 G01N 33/574) [2018.01]
- 1/6888 . . . 用於檢測或鑑定生物 [2018.01]
- 1/689 . . . 細菌 [2018.01]
- 1/6893 . . . 原生動物 [2018.01]
- 1/6895 . . . 植物、真菌或藻類 [2018.01]
- 1/6897 . . . 包括報導基因可操作地連接至啟動子 [2018.01]
- 1/70 . . . 包括病毒或噬菌體 [3]
- 3/00 條件反應控制方法**（其裝置見 C12M 1/36）[3]

C12R 涉及微生物與次類 C12C 至 C12Q 聯合使用之索引碼 [3]

附註

- (1) 本次類構成與分類至次類 C12C 至 C12Q 之方法內所使用的微生物聯合使用之索引碼。[3]
- (2) 細菌術語之根據係依“檢測細菌學之 Berger 手冊”，1975 年第八版 [3]

1/00 微生物 [3]

- 1/01 . . . 細菌或放線菌目 [3]
- 1/02 . . . 醋酸桿菌屬 [3]
- 1/025 . . . 無色桿菌屬 [3]
- 1/03 . . . 馬杜拉放線菌屬 [3]
- 1/04 . . . 放線菌屬 [3]
- 1/045 . . . 游動放線菌屬 [3]
- 1/05 . . . 產鹼桿菌屬 [3]

- 1/06 . . . 節桿菌屬 [3]
- 1/065 . . . 固氮菌屬 [3]
- 1/07 . . . 芽孢桿菌屬 [3]
- 1/08 . . . 短芽孢桿菌 [3]
- 1/085 . . . 蠟狀芽孢桿菌 [3]
- 1/09 . . . 環狀芽孢桿菌 [3]
- 1/10 . . . 地衣芽孢桿菌 [3]
- 1/11 . . . 巨大芽孢桿菌 [3]

- 1/12 • • • 多黏芽孢桿菌 [3]
1/125 • • • 枯草芽孢桿菌 [3]
1/13 • • 短桿菌屬 [3]
1/14 • • 欽氏菌屬 [3]
1/145 • • 梭狀芽孢桿菌屬 [3]
1/15 • • 棒桿菌屬 [3]
1/16 • • • 白喉棒桿菌 [3]
1/165 • • • 猩猩木棒桿菌 [3]
1/17 • • • 化膿棒桿菌 [3]
1/18 • • 歐氏植病桿菌屬 [3]
1/185 • • 埃希氏桿菌屬 [3]
1/19 • • • 大腸桿菌 [3]
1/20 • • 黃桿菌屬 [3]
1/21 • • 嗜血桿菌屬 [3]
1/22 • • 克雷伯氏桿菌屬 [3]
1/225 • • 乳桿菌屬 [3]
1/23 • • • 嗜酸乳桿菌 [3]
1/24 • • • 短乳桿菌 [3]
1/245 • • • 乾酪乳桿菌 [3]
1/25 • • • 胚芽乳桿菌 [3]
1/26 • • 甲基單胞菌屬 [3]
1/265 • • 微生物屬 [3]
1/27 • • • 黃色微球菌 [3]
1/28 • • • 殼胺酸微球菌 [3]
1/285 • • • 溶壁微球菌 [3]
1/29 • • 小單孢菌屬 [3]
1/30 • • • 青銅色小單孢菌 [3]
1/31 • • • 紫紅小單孢菌 [3]
1/32 • • 分枝桿菌 [3]
1/325 • • • 鳥分枝桿菌 [3]
1/33 • • • 偶發分枝桿菌 [3]
1/34 • • • 恥垢分枝桿菌 [3]
1/35 • • 枝原體屬 [3]
1/36 • • 奈瑟氏球菌屬 [3]
1/365 • • 諾卡氏菌屬 [3]
1/37 • • 變形桿菌屬 [3]
1/38 • • 假單胞菌屬 [3]
1/385 • • • 銅綠色假單胞菌 [3]
1/39 • • • 螢光假單胞菌 [3]
1/40 • • • 惡臭假單胞菌 [3]
1/41 • • 根瘤菌屬 [3]
1/42 • • 沙門氏菌屬 [3]
1/425 • • 沙雷氏菌屬 [3]
1/43 • • • 黏質沙雷氏菌 [3]
1/44 • • 葡萄球菌屬 [3]
1/445 • • • 金黃色葡萄球菌 [3]
1/45 • • • 表皮葡萄球菌 [3]
1/46 • • 鏈球菌屬 [3]
1/465 • • 鏈黴菌屬 [3]
1/47 • • • 白色鏈黴菌 [3]
1/48 • • • 抗生素鏈黴菌 [3]
1/485 • • • 金黴素鏈黴菌 [3]
1/49 • • • 金色鏈黴菌 [3]
1/50 • • • 比基尼鏈黴菌 [3]
1/51 • • • 純白鏈黴菌 [3]
1/52 • • • 教酒鏈黴菌 [3]
1/525 • • • 澱粉酶產色鏈黴菌 [3]
1/53 • • • 菲律賓鏈黴菌 [3]
1/54 • • • 弗氏鏈黴菌 [3]
1/545 • • • 灰色鏈黴菌 [3]
1/55 • • • 吸水鏈黴菌 [3]
1/56 • • • 薰衣草鏈黴菌 [3]
1/565 • • • 林絲鏈黴菌 [3]
1/57 • • • 諾爾斯氏鏈黴菌 [3]
1/58 • • • 橄欖色鏈黴菌 [3]
1/585 • • • 普拉待鏈黴菌 [3]
1/59 • • • 龜裂鏈黴菌 [3]
1/60 • • • 產烯鏈黴菌 [3]
1/61 • • • 委內瑞拉鏈黴菌 [3]
1/62 • • 孢囊鏈黴菌屬 [3]
1/625 • • 輪枝鏈黴菌屬 [3]
1/63 • • 弧菌屬 [3]
1/64 • • 黃色單胞菌屬 [3]
1/645 • 真菌 [3,2006.01]
1/65 • • 犁頭黴屬 [3]
1/66 • • 曲黴屬 [3]
1/665 • • • 泡盛酒曲黴 [3]
1/67 • • • 黃曲黴 [3]
1/68 • • • 煙曲黴 [3]
1/685 • • • 黑曲黴 [3]
1/69 • • • 米曲黴 [3]
1/70 • • • 焦曲黴 [3]
1/71 • • • 文氏曲黴 [3]
1/72 • • 假絲酵母屬 [3]

- 1/725 . . . 白假絲酵母 [3]
- 1/73 . . . 解酯假絲酵母 [3]
- 1/74 . . . 熱帶假絲酵母 [3]
- 1/745 . . 頭孢黴屬 [3]
- 1/75 . . . 頂頭孢黴 [3]
- 1/76 . . . 淺天蘭頭孢黴 [3]
- 1/765 . . . 產扁蟲菌素頭孢黴 [3]
- 1/77 . . 鐮刀黴屬 [3]
- 1/78 . . 漢生遜酵母屬 [3]
- 1/785 . . 毛黴屬 [3]
- 1/79 . . 擬青黴屬 [3]
- 1/80 . . 青黴屬 [3]
- 1/81 . . . 短青黴 [3]
- 1/82 . . . 產黃青黴 [3]
- 1/825 . . . 特異青黴 [3]
- 1/83 . . . 展青黴 [3]
- 1/84 . . 準赤酵母屬 [3]
- 1/845 . . 根黴屬 [3]
- 1/85 . . 酵母屬 [3]
- 1/86 . . . 卡爾酵母 [3]
- 1/865 . . . 釀酒酵母 [3]
- 1/87 . . . 乳酸酵母 [3]
- 1/88 . . 圓酵母屬 [3]
- 1/885 . . 木黴屬 [3]
- 1/89 . 藻 [3]
- 1/90 . 原生動物 [3]
- 1/91 . 細胞系 [3,7]
- 1/92 . 病毒 [5,7]
- 1/93 . . 動物病毒 [7]
- 1/94 . . 植物病毒 [7]

C13 糖工業 [4]

附註

在本主類中，下列名詞如其所指之義：

“糖”為一類可食用的水溶性結晶碳水化合物，具有獨特的甜味，包含單、雙及寡糖，例如蔗糖、乳糖及果糖。在次類 C13B 之附註對“糖”有更特定的定義。[2011.01]

C13B 蔗糖之生產；及其專門適用的設備（化學合成之糖或糖衍生物見 C07H；利用發酵或使用酶處理以製備含糖基之化合物見 C12P 19/00）[2011.01]

附註

在本次類中，下列名詞如其所指之義：

- “糖”被用於其非科學之定義，意指蔗糖，亦被稱為“食用糖”，是一白色結晶雙糖；[2011.01]
- “糖汁”是糖溶液，本質上含有如甜菜、甘蔗或楓樹等各種植物來源之蔗糖；[2011.01]
- “糖漿”是高度濃縮之糖汁。[2011.01]

5/00 減少萃取糖之原料體積（澱粉之萃取見 C08B 30/02）[2011.01]

5/02 • 切蔗 [2011.01]

5/04 • • 將甘蔗切成條狀 [2011.01]

5/06 • 甜菜切絲 [2011.01]

5/08 • 刀；調節或維修 [2011.01]

10/00 糖汁之生產（樹汁之割採見 A01G 23/10；割採用流槽、汁液容器見 A01G 23/14）[2011.01]

10/02 • 由甘蔗或類似之原料，如甜高粱內榨取汁 [2011.01]

10/04 • • 與吸液結合 [2011.01]

10/06 • • 壓蔗機 [2011.01]

10/08 • 用水由甜菜內萃取糖 [2011.01]

10/10 • • 連續法 [2011.01]

10/12 • • 萃取裝置之詳細結構，如管子或閥門之配置 [2011.01]

10/14 • 使用水以外之萃取劑，如酒精或

鹽溶液 [2011.01]

15/00 從已被萃取糖之材料榨取水分（從已萃取澱粉之材料見 C08B 30/10）[2011.01]

15/02 • 於多孔移動帶間 [2011.01]

20/00 糖汁之純化 [2011.01]

附註

分類至本目時，如其技術主題與層析法有關，亦需分至 B01D 15/08。[2011.01]

20/02 • 使用鹼土金屬化合物 [2011.01]

20/04 • • 接著用飽和法 [2011.01]

20/06 • • • 用二氧化碳或二氧化硫 [2011.01]

20/08 • 用氧化或還原法 [2011.01]

20/10 • • 用二氧化硫或亞硫酸鹽 [2011.01]

- 20/12 · 用吸附劑，如活性碳 [2011.01]
- 20/14 · 用離子交換材料 [2011.01]
- 20/16 · 用物理方法，如滲透或過濾 [2011.01]
- 20/18 · 用電之方法 [2011.01]
- 25/00 專門適用於糖汁之蒸發裝置或煮糖罐；糖汁之蒸發或煮沸 [2011.01]**
- 25/02 · 細部結構，如防止起泡或接取糖汁用者 [2011.01]
- 25/04 · · 加熱設備 [2011.01]
- 25/06 · 結合測量儀器以控制生產過程 [2011.01]
- 30/00 結晶；結晶設備；從母液分離結晶 [2011.01]**
- 30/02 · 結晶；結晶設備 [2011.01]
- 30/04 · 從母液分離結晶 [2011.01]
- 30/06 · · 藉由離心力 [2011.01]
- 30/08 · · 由結晶上洗去殘留母液 [2011.01]
- 30/10 · · · 在離心機 [2011.01]
- 30/12 · · 回收母液或洗液再利用 [2011.01]
- 30/14 · · 溶解或精製粗糖 [2011.01]
- 35/00 從糖蜜中萃取蔗糖 [2011.01]**
- 35/02 · 用化學方法 [2011.01]
- 35/04 · · 以鹼土金屬蔗糖鹽之形式沈澱 [2011.01]
- 35/06 · · 用離子交換法 [2011.01]
- 35/08 · 用物理方法，如滲透 [2011.01]
- 40/00 糖之乾燥 [2011.01]**
- 45/00 專門適用於糖之切割機械 [2011.01]**
- 45/02 · 與分選及包裝機械結合 [2011.01]
- 50/00 糖產品，如粉狀、塊狀或液體狀之糖；糖之加工製造 (40/00、45/00 優先；糖果見 A23G 3/00) [2011.01]**
- 50/02 · 模壓糖成型 [2011.01]
- 99/00 本類各目中不包括的技術主題 [2011.01]**

C13K 從天然來源或由天然存在的雙糖、寡糖或多糖水解而得之糖類（蔗糖之生產見 C13B；化學合成之糖或糖衍生物見 C07H；多糖類，如澱粉及其衍生物見 C08B；麥芽見 C12C；利用發酵或使用酶處理以製備含糖基之化合物見 C12P 19/00）

- 1/00 葡萄糖（由轉化糖分離見 3/00）；含葡萄糖之糖漿 [2]**
- 1/02 · 藉由纖維素材料之糖化而得（飼料之生產見 A23K 1/1210/32）
- 1/04 · · 純化
- 1/06 · 藉由澱粉或含澱粉原料之糖化而得
- 1/08 · · 純化
- 1/10 · 結晶
- 3/00 轉化糖；由轉化糖分離葡萄糖或果糖**
- 5/00 乳糖**
- 7/00 麥芽糖**
- 11/00 果糖（由轉化糖分離見 3/00） [2]**
- 13/00 本類內不包括的糖 [2]**

C14 小原皮；大原皮：毛皮或皮革

C14B 小原皮；大原皮及皮革之一般機械處理或加工；毛皮剪切機械；剖割腸之機械（製造皮革代用品見 B29、D06N；製造皮革製品見 B68F；原皮或類似物之機械清理見 D06G；人造革見 D06N）

次類索引

皮革

製造 1/00，7/00
處理
磨革，切割 3/00，5/00
整飾 11/00，13/00
皮帶製造 9/00
設備，工具 17/00，19/00

毛皮

處理 15/00
設備，工具 17/00，19/00
腸
剖開，切割 21/00
本次類各目中不包括的技術主題 99/00

1/00 皮革製造；所用之機器或裝置

- 1/02 • 小原皮，大原皮或皮革之去肉，脫毛，均溫，伸展，壓水，削勻，片皮或剖革
- 1/04 • • 使用固定於支架之刮，磨或盪平滾筒或刀具；如裝在基本上與工作面成直角之平面上的滾筒
- 1/06 • • • 於僅用輥使工作與加工工具接觸之機械內
- 1/08 • • • 於用彈性帶作為底部支承部件或支力部件之機械內
- 1/10 • • • 於用圓筒型，圓錐型或類似外表之轉筒以支承整個工作加工之機械內
- 1/12 • • • 於用平板支承托板之機械內
- 1/14 • • 使用於一平面上切削原皮之刀具，該平面基本上與原皮表面平行
- 1/16 • • • 用固定或往復或擺動式刀具
- 1/18 • • • 用帶型刀具
- 1/20 • • • 用圓盤型刀具或圓錐型刀具
- 1/22 • • • 用圓筒型刀具
- 1/24 • • 削或剪毛而不傷其皮（毛皮製造過程中剪毛與拉毛見 15/02）

- 1/26 • 皮革繃皮或拉伸架；拉伸機；定型板；貼板（貼板工藝見 1/60；固定裝置見 17/08）
- 1/28 • 結合測量及印花裝置之整理皮革的設備
- 1/30 • 皮革壓平或滾平
- 1/32 • • 壓平部件之縱向運動
- 1/34 • • 壓平或滾平部件之旋轉運動
- 1/36 • • • 橋式皮革滾平機
- 1/38 • 捶革
- 1/40 • 使原皮或皮革軟化，如利用刮軟機，搓軟機或揉皮機，或利用乾磨等
- 1/42 • • 利用帶徑向葉片之轉鼓
- 1/44 • 皮革表面之機械處理
- 1/46 • • 起毛，軟磨及砂磨
- 1/48 • • 粗糙化（利用砂磨見 1/46）
- 1/50 • • 打光
- 1/52 • • 毛刷或絨毛輪刷革
- 1/54 • • 熨平（壓平或滾平見 1/30）
- 1/56 • • 整飾，產生圖案，壓花（一般壓平或滾平見 1/30；毛皮產生花案見 15/12）
- 1/58 • 乾燥
- 1/60 • • 貼板乾燥工藝（貼板見 1/26；

- 化學方面見 C14C 7/00)
- 1/62 • 原皮及皮革之包捲與堆積
- 3/00 皮革之滾花**
- 5/00 皮革之銜，打孔或裁切**（用於鞋之部分，如鞋底見 A43D；不為皮革專用之設備見 B26D）
- 5/02 • 用於皮革製品之壓印模或模具
- 5/04 • 用於製造皮帶或皮條
- 5/06 • • 用於圓盤革切螺旋皮條之機械
- 7/00 特種皮革及其製造**
- 7/02 • 複合多層皮革（與一層或多層塑膠複合見 B32B 9/02）
- 7/04 • • 用黏合或者加壓之方法將皮件，皮條或皮薄片複合成一塊；用加入增強層之方法提高皮革之強度及硬度
- 7/06 • 皮條或皮件交編成之皮織品，如經由編織
- 9/00 生產傳動皮帶或其他皮帶或皮條**
- 11/00 皮件邊緣之修整，如折邊或燒邊**（磨邊見 3/00）
- 13/00 撕裂原皮或皮革**（一般撕裂見 B02C）
- 15/00 毛皮之機械處理**
- 15/02 • 剪毛，用剪毛或拉毛之方法除去死毛、粗毛或脆毛
- 15/04 • 毛皮整修
- 15/06 • • 毛皮拉伸裝置
- 15/08 • 對毛皮內層敷貼增強或硬化層
- 15/10 • 毛皮切割；生產毛皮片或條
- 15/12 • 整飾，如繡飾；使毛皮產生花紋或圖案
- 17/00 製造或處理小原皮，大原皮，皮革或毛皮之設備或機械之結構細節**
- 17/02 • 帶葉片之輥筒或其他加工輥筒，如刮削輥筒
- 17/04 • 工作支承物或其他支力部件；底輥或支力輥
- 17/06 • 給料或夾緊裝置
- 17/08 • • 固定裝置，如皮革拉伸用之夾具等
- 17/10 • 皮革加工機械傳動部件之布置
- 17/12 • 皮革加工機械專用安全裝置
- 17/14 • 皮革加工機械之輔助裝置，如葉片輥之碾磨裝置或結合皮革加工機械之除塵裝置
- 19/00 皮革及毛皮製造過程中，處理大小原皮或皮革之專用手工工具**（鞍具製造用設備及工具見 B68C）
- 21/00 腸之剖裂；腸之縱向切割**（肉食品加工中腸之切割與清理見 A22C 17/00）
- 99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [8]**

C14C 以化學物、酶或微生物對大原皮，小原皮或皮革進行處理，如鞣製、浸漬或整飾；所用的設備；鞣製組合物（皮革或毛皮之漂白見 D06L；皮革或毛皮之染色及見 D06P）

次類索引

預處理	1/00	整飾；特種皮革	11/00；13/00
鞣製，貼板，浸漬	3/00，7/00，9/00	設備	15/00
脫脂	5/00	本次類各目中不包括的技術主題....	99/00

1/00 鞣製前以化學物、酶或微生物對大原皮，小原皮或皮革進行處理

- 1/02 • 原皮熟化
- 1/04 • 浸水
- 1/06 • 加速脫毛，如用塗灰漿法，用浸灰法
- 1/08 • 脫灰；軟化；浸酸；脫酯

3/00 鞣製；鞣製組合物

- 3/02 • 化學鞣製
- 3/04 • • 無機鞣製
- 3/06 • • • 應用鉻化合物
- 3/08 • • 使用有機藥劑
- 3/10 • • • 植物鞣製
- 3/12 • • • • 使用純化或改性之植物鞣劑
- 3/14 • • • 油脂鞣；油鞣
- 3/16 • • • 使用脂族醛
- 3/18 • • • 使用縮聚產品或縮聚產品的母體
- 3/20 • • • • 磺化者
- 3/22 • • • 使用聚合產品
- 3/24 • • • 使用木質素衍生物，如硫酸鹽溶液
- 3/26 • • • 使用其他含鹵素之有機物
- 3/28 • • 多級工序
- 3/30 • • 使用物理與化學相結合的方法
- 3/32 • 由皮革中回收鞣劑

5/00 皮革之脫脂**7/00 雙層黏合處理的化學方式****9/00 用浸漬的方法生產可長期保存、防水、耐熱或其他類似作用之皮革**

- 9/02 • 使用油脂或油性物質，如脂肪溶液
- 9/04 • 使鞣劑固定在皮革內

11/00 皮革之表面整飾**13/00 特種皮革之製造，如：羊皮紙等（油鞣見 3/14）**

- 13/02 • 工業用革之製造

15/00 大原皮，小原皮或皮革之化學處理或洗滌的設備**99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [8]**

次 部：冶 金

C21 鐵之冶金

C21B 鐵或鋼之冶金（鐵礦石或廢鋼之預處理見 C22B 1/00）

附註

本次類包括：

- 用原材料生產鐵或鋼，例如生鐵之生產；
- 專用設備，例如高爐或熱風爐。

次類索引

煉生鐵	一般特點..... 3/00
於高爐內 5/00，7/00，9/00	煉鐵 13/00，15/00
其他方法 11/00	直接還原法煉液體鋼..... 13/00

3/00 生鐵冶煉之一般特點（生鐵混鐵爐見 C21C 1/06）

- 3/02 • 使用添加物，如熔劑
- 3/04 • 副產品，如爐渣之回收
- 3/06 • • 融渣之處理
- 3/08 • • • 爐渣之冷卻
- 3/10 • • • 渣罐；渣車

5/00 高爐煉生鐵

- 5/02 • 煉特殊生鐵，例如使用其他金屬氧化物等之添加物
- 5/04 • 特殊成分渣之煉製
- 5/06 • 高爐生產中爐頂煤氣之使用

7/00 高爐

- 7/02 • 內部形狀
- 7/04 • 使用特殊耐火材料者
- 7/06 • • 爐襯
- 7/08 • 爐喉保護板
- 7/10 • 冷卻；所用設備
- 7/12 • 開或堵出鐵口、出渣口
- 7/14 • 排放裝置，如用於排渣者

- 7/16 • 風口
- 7/18 • 料鐘及料斗之布置
- 7/20 • • 帶有布料裝置者
- 7/22 • 除塵裝置
- 7/24 • 探料尺或其他檢測裝置

9/00 高爐用熱風爐

- 9/02 • 磚砌熱風爐
- 9/04 • • 帶有燃燒爐身者
- 9/06 • • 爐襯
- 9/08 • 鐵製熱風爐
- 9/10 • 其他元件，如總風管
- 9/12 • • 高爐熱風閥或滑閥
- 9/14 • 助燃空氣之預熱
- 9/16 • 熱風之冷卻或乾燥

11/00 不用高爐之生鐵冶煉

- 11/02 • 於矮豎爐內
- 11/06 • 於回轉窯內
- 11/08 • 於床式爐內
- 11/10 • 於電爐內

13/00 直接還原法煉海綿鐵或液體鋼

13/02	• 於豎爐內	15/00	用鐵之化合物煉鐵的其他方法 (電解法見 C25C 1/06)
13/04	• 於反應罐內	15/02	• 金屬熱還原法，如鋁熱還原法
13/06	• 於多層爐內	15/04	• 用羰基鐵
13/08	• 於回轉爐內		
13/10	• 於床式爐內		
13/12	• 於電爐內		
13/14	• 多步法		

C21C 生鐵之加工處理，例如精煉，熟鐵及鋼之冶煉；熔融態下鐵類合金之處理

1/00	生鐵之精煉；鑄鐵	5/52	• 電爐煉鋼
1/02	• 脫磷或脫硫	5/54	• • 生產特殊成分爐渣之方法
1/04	• 除碳、磷及硫以外的雜質之去除	5/56	• 其他煉鋼法（直接還原法煉液體鋼見 C21B 13/00）
1/06	• 混鐵爐構件		
1/08	• 鑄鐵之冶煉	7/00	熔融鐵類合金之處理，例如不包括於 1/00 至 5/00 目內之鋼（鑄造成型過程中熔融金屬之處理見 B22D 1/00、27/00）
1/10	• 球墨鑄鐵之冶煉	7/04	• 添加處理劑去除雜質 [2]
3/00	熟鐵或鍛鋼之冶煉	7/06	• • 脫氧，例如鎮靜 [2]
5/00	碳鋼之冶煉，例如普通低碳鋼，中碳鋼，或鑄鋼	7/064	• • 脫磷；脫硫 [3]
5/02	• 鉗鍋爐法	7/068	• • 脫碳 [3]
5/04	• 平爐鋼，例如西門子一馬丁爐鋼之冶煉	7/072	• • 用氣體處理（7/06、7/064、7/068 優先）[3]
5/06	• • 生產特殊成分爐渣之方法	7/076	• • 用爐渣或熔劑作為處理劑（7/06、7/064、7/068 優先）[3]
5/28	• 轉爐煉鋼	7/10	• 真空處理
5/30	• • 吹風之調節或控制		
5/32	• • • 頂吹（5/35 優先）[5]		
5/34	• • • 通過熔池吹（5/35 優先）[5]		
5/35	• • • 頂吹及通過熔池吹 [5]		
5/36	• • 生產特殊成分爐渣之方法		
5/38	• • 廢氣或煙塵之去除		
5/40	• • • 轉爐廢氣或煙塵之排出或分離裝置		
5/42	• • 轉爐構件		
5/44	• • • 耐火爐襯		
5/46	• • • 零件或輔助設備		
5/48	• • • • 轉爐之爐底或風嘴		
5/50	• • • • 轉爐之傾動機械		

C21D 改變含鐵金屬之物理結構；含鐵或非鐵金屬或合金之熱處理用之一般設備；使金屬具有韌性，例如：利用脫碳或回火（擴散法滲入處理見 C23C；與 C23 主類及本次類內之至少一種方法有關的金屬材料之表面處理見 C23F 17/00；共晶材料之定向凝固或共析材料之定向分層見 C30B）

附註

- (1) 藉擴散製程之離子還原法被分類至 C23C [2012.01]
- (2) 以 C23C 所包含之至少一種方法及本次類所包含之至少一種方法以進行的冶金材料表面處理，被分類至 C23F 17/00 [2012.01]

次類索引

熱處理	機械處理.....7/00
一般方法或設備.....1/00，11/00	形變熱處理.....8/00
鑄鐵者，鐵合金者.....5/00，6/00	其他處理.....10/00
適用於特殊目的者.....9/00	去除非金屬之擴散法.....3/00

1/00 熱處理之一般方法或設備，例如退火、硬化、淬火或回火	1/28	• • 正火
1/02 • 除需成型之工件外不需要再加熱之鍛造或軋製成型硬化工件或材料	1/30	• • 消除應力
1/04 • 同時使用超音波、磁場或電場	1/32	• • 軟化退火，例如球化處理
1/06 • 表面硬化	1/34	• 加熱方法（1/06 優先）
1/08 • • 使用火焰	1/38	• • 通過陰極放電加熱
1/09 • • 直接使用電能或波能；使用粒子輻射 [3]	1/40	• • 直接電阻加熱
1/10 • • • 使用電感應 [3]	1/42	• • 感應加熱
1/18 • 硬化（1/02 優先）；隨後回火或不回火的淬火（淬火設備見 1/62）[3]	1/44	• • 於熱處理浴槽內
1/19 • • 階段冷卻淬火 [3]	1/46	• • • 鹽浴
1/20 • • • 等溫淬火，例如貝氏體淬火 [3]	1/48	• • • 金屬浴
1/22 • • • 馬氏體等溫淬火 [3]	1/50	• • • 油浴
1/25 • • 硬化，與於 300°C ~ 600°C 之間之退火相結合，即熱精煉（調質處理）[3]	1/52	• • 用火焰
1/26 • 退火方法	1/53	• • 用流動床加熱 [3]
	1/54	• 通過測定電或磁之特性以確定達到硬化溫度之時間
	1/55	• 淬透性試驗，例如：頂端淬火試驗 [3,2006.01]
	1/56	• 使用冷卻劑之特性
	1/58	• • 油
	1/60	• • 水劑
	1/607	• • 熔鹽 [3]
	1/613	• • 氣體；液化或固化之普通汽體

材料 [3]	附註
1/62 • 淬火設備 [3] 1/63 • • 槽浴淬水用者 [3] 1/64 • • • 用循環液體 [3] 1/667 • • 用於噴液淬水者 [3] 1/673 • • 用於壓床淬火者 [3] 1/68 • 於熱處理前或其過程中臨時應用之塗覆或包覆材料 1/70 • • 加熱或淬火時 1/72 • • 於表面化學變化時 1/74 • 於惰性氣體、控制氣氛、真空或粉狀材料內之處理方法 1/76 • • 調節氣氛之成份 1/767 • • 用強制氣體循環；及其再加熱 [3] 1/773 • • 於低壓或真空下 [3] 1/78 • 不包括在上述規定內之複合熱處理 1/82 • 用熱應力去除氧化皮（機械法見 B21、B23；化學法見 C23；電解法見 C25F 1/00） 1/84 • 受控緩慢冷卻（金屬軋製用之冷卻床見 B21B 43/00） [3]	(1) 當分類至 6/00 目時，被認為代表對檢索重要的資訊的鐵合金的熱處理方法的任何方面也可以分類至 1/02 至 1/84 目中。例如對鐵合金的熱處理的檢索很重要時，即可使用這種分類法。這種非強制分類應當作“附加資訊”給出。 [8] (2) 當分類至 6/00 目時，被認為代表對檢索重要的資訊的任何合金成分也可以分類至 C22C 38/02 至 38/60 目中。例如對特殊合金的熱處理的檢索很重要時，即可使用這種分類法。這種非強制分類應當作“附加資訊”給出。 [8] 6/02 • 沈澱硬化 [2] 6/04 • 於 0°C 以下之冷卻硬化 [2] 7/00 通過變形改變鐵或鋼之物理性能 （金屬機械加工設備見 B21、B23、B24） 7/02 • 通過冷卻加工 7/04 • • 表面者 7/06 • • • 用噴丸硬化或其他類似之方法 7/08 • • • 用拋光或其他類似之方法 7/10 • • 整個橫斷面者，例如混凝土鋼筋者 7/12 • • • 通過擴張管體之方法 7/13 • 通過熱加工法 8/00 經由伴隨有變形之熱處理或變形後再進行熱處理以改變物理性能 （除需成型之工件外不需要再加熱的鍛造或軋製成型之硬化工件或材料見 1/02） [3] 8/02 • 於生產鋼板或帶鋼時（8/12 優先） [3] 8/04 • • 生產深衝鋼板或帶鋼 [3] 8/06 • 於生產棒材料或線材時 [3] 8/08 • • 用於混凝土鋼筋 [3] 8/10 • 於生產管狀體時 [3]
3/00 去除非金屬之擴散法；所用爐子 （局部保護塗層見 1/72） 3/02 • 非金屬之去除 3/04 • • 脫碳 3/06 • • 脫氫 3/08 • • 脫氮 3/10 • 所用之爐子 5/00 鑄鐵之熱處理 5/02 • 改善灰口鑄鐵之延展性 5/04 • 白口鑄鐵者 5/06 • • 延展性 5/08 • • • 用碳之氧化 5/10 • • • • 於氣體介質內 5/12 • • • • 於固體介質內 5/14 • • • 石墨化 5/16 • • • • 填料劑	
6/00 鐵基合金之熱處理 [2]	

8/12 • 於生產具有特殊電磁性能之產品時 [3]

9/00 熱處理，例如適合於特殊產品之退火、硬化、淬火或回火；所用的爐子

- 9/02 • 用於彈簧
- 9/04 • 用於鋼軌
- 9/06 • • 減少產生波紋之傾向
- 9/08 • 用於管狀體或管子
- 9/10 • • 槍管
- 9/12 • • 炮管
- 9/14 • • 耐磨或耐壓管
- 9/16 • 用於爆炸彈殼
- 9/18 • 用於小刀、長柄鐮刀、剪刀或類似手工切割工具
- 9/20 • 用於冰鞋之刀刃
- 9/22 • 用於鑽頭；銑刀；機械切削工具
- 9/24 • 用於鋸片
- 9/26 • 用於針；梳理機之齒
- 9/28 • 用於普通軸
- 9/30 • 用於曲軸；凸輪軸
- 9/32 • 用於齒輪；蝸輪或其他類似物
- 9/34 • 用於輪箍；輪緣
- 9/36 • 用於滾珠；滾柱
- 9/38 • 用於輥體
- 9/40 • 用於環；軸承座圈
- 9/42 • 用於裝甲板
- 9/44 • 用於襯砌山豎井設備，例如扇形體、環形體或支柱
- 9/46 • 用於金屬薄板
- 9/48 • • 深衝薄板
- 9/50 • 用於焊接接頭
- 9/52 • 用於線材；帶材
- 9/54 • • 處理帶材或線材之爐子
- 9/56 • • • 帶材或線材連續處理爐
- 9/567 • • • • 用流動床加熱 [3]
- 9/573 • • • • 帶冷卻 [3]
- 9/58 • • • • 用槽浴加熱
- 9/60 • • • • 用感應加熱
- 9/62 • • • • 用直接電阻加熱
- 9/63 • • • • 用氣體緩衝器支承帶材 [3]

9/64 • • • 鉛淬火爐

9/66 • • • 塔式爐

9/663 • • • 鐘罩式爐 [3]

9/665 • • • • 仰拱或側襯式 [3]

9/667 • • • • 多工位爐 [3]

9/67 • • • • • 為於真空或特殊氣氛下處理爐料所採用者

9/673 • • • • 鐘罩式爐所使用的零件、輔助設備或專用設備 [3]

9/675 • • • • 裝料或出料裝置之配置[3]

9/677 • • • • 加熱設備之配置 [3]

9/68 • • • 爐子纏捲裝置；熱纏捲裝置（冷纏捲裝置見 B21C 47/00）

9/70 • 加熱鋼錠用之爐子，即均熱爐

10/00 用熱處理或變形以外之方法以改變物理性能 [3]

11/00 熱處理過程之控制或調整 [2]

C22 冶金；鐵或非鐵合金；鐵或非鐵合金之處理

附註

- (1) 將固態或熔融態鐵礦或羰化鐵轉化為鐵的專用方法或設備，被分類至 C21B [2012.01]
- (2) — 生鐵或鑄鐵之處理；[2012.01]
 - 熟鐵、熟鋼或碳鋼之製造；[2012.01]
 - 熔融態鐵基合金之處理；[2012.01]
 - 之專用方法或設備被分類至 C21C
- (3) 下述之方法或設備被分類至 C21D：
 - 鐵基合金或鋼的專用熱處理製程；[2012.01]
 - 金屬或合金的熱處理用設備 [2012.01]

C22B 金屬之生產或精煉（金屬粉末或其懸浮物之製取見 B22F 9/00；藉電解法或電泳法生產金屬見 C25）；原材料之預處理

附註

於本次類內，有關提取各種金屬之目包括用非冶金方法提煉金屬及用冶金方法製取金屬化合物。因此，例如 11/00 目包括用氧化銀氨溶液還原法生產銀，17/00 目包括用冶金方法生產氧化鎘。此外，雖然砷及銻之化合物分入 C01G 中，但此等元素本身之生產以及用冶金方法生產此等化合物卻包括於 C22B 內。

次類索引

原材料之預處理.....1/00，4/00，7/00	金屬之精煉或重熔.....9/00
提取金屬之工藝過程..... 3/00，4/00，5/00	特定金屬之提煉..... 11/00 至 61/00

1/00 礦石或廢料之初步處理

- 1/02 • 焙燒工藝過程 (1/16 優先)
- 1/04 • • 鼓風焙燒
- 1/06 • • 硫酸化焙燒
- 1/08 • • 氯化焙燒
- 1/10 • • 流態化焙燒
- 1/11 • 非焙燒法除硫、磷或砷 [2]
- 1/14 • 結塊；製團；黏合；製粒
- 1/16 • • 燒結；結塊
- 1/18 • • • 於燒結鍋內
- 1/20 • • • 於活動爐柵燒結機內
- 1/212 • • • 於隧道爐內 [2]
- 1/214 • • • 於豎爐內 [3]
- 1/216 • • • 於回轉爐內 [3]
- 1/22 • • • 於其他燒結設備內
- 1/24 • • 黏合；製團
- 1/242 • • • 用黏結劑 [2]
- 1/243 • • • • 無機者 [2]
- 1/244 • • • • 有機者 [2]
- 1/245 • • • • • 含生產焦結塊用碳質材料者 [2]
- 1/248 • • • 金屬廢料或合金者 [2]
- 1/26 • 焙燒、燒結或結塊礦石之冷卻

3/00 利用濕式法由礦石或精礦內提取金屬化合物 [5]**附註**

當分類至本目時，任何金屬的本質被認為對檢索是重要的資訊時，也應分類至 11/00 至 25/00 之各主目中（僅為主目），19/34 目或 26/00 至 61/00 之各目中。例如對提取特殊金屬或其化合物的檢索很重要時，即可使用這種分類法。這種非強制分類應當作“附加資訊”給出。[8]

- 3/02 • 所用之設備
- 3/04 • 通過浸取 (3/18 優先) [5]
- 3/06 • • 於無機酸溶液內 [5]
- 3/08 • • • 硫酸 [5]
- 3/10 • • • 鹽酸 [5]

- 3/12 • • 於無機鹼溶液內 [5]
- 3/14 • • • 含有氨或銨鹽者 [5]
- 3/16 • • 於有機溶液內 [5]
- 3/18 • 借助微生物或酶，例如細菌或藻類 [5]
- 3/20 • 溶液，例如通過浸取製得的處理或淨化 (3/18 優先) [5]
- 3/22 • • 通過物理方法，例如通過過濾，通過磁性方法 (3/26 優先) [5]
- 3/24 • • • 通過固體物質上之吸附，例如用固體樹脂提取 [5]
- 3/26 • • 通過使用有機化合物之液－液萃取 [5]

附註

於目 3/28 至 3/40 內：

- (a) 適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，化合物請放入最後適當位置；
- (b) 當依次使用兩種或兩種以上化合物時，每種化合物請依據末位規則放入最後適當位置；
- (c) 含有分別由 3/28 至 3/38 各目內同一目所包括的兩種或兩種化合物之混合物僅分入該目。[5]

- 3/28 • • • 胺類 [5]
- 3/30 • • • 肟類 [5]
- 3/32 • • • 羧酸類 [5]
- 3/34 • • • 含硫者 [5]
- 3/36 • • • 雜環化合物 (3/34 優先) [5]
- 3/38 • • • 含磷者 [5]
- 3/40 • • • 混合物 [5]
- 3/42 • • 通過離子交換提取 [5]
- 3/44 • • 通過化學方法 (3/26、3/42 優先) [5]
- 3/46 • • • 通過置換，例如通過沉澱置換 [5]

4/00 用電熱法處理礦石或冶金產品

以提煉金屬或合金（金屬精煉或重熔之一般方法見 9/00；鐵或鋼之冶煉見 C21B、C21C）

4/02 • 輕金屬 [2]

4/04 • 重金屬 [2]

4/06 • 合金 [2]

4/08 • 設備 [2]

5/00 還原成金屬之一般方法

5/02 • 乾法

5/04 • • 用鋁、其他金屬或矽

5/06 • • 用碳化物或類似化合物

5/08 • • 用硫化物；焙燒反應法

5/10 • • 用固體碳質還原劑

5/12 • • 用氣體

5/14 • • • 流態化材料

5/16 • • 利用被生產金屬之揮發或冷凝

5/18 • • 分步還原

5/20 • • 由金屬羰基化合物

7/00 處理非礦石原材料，如廢料，以生產非鐵金屬或其他化合物

7/02 • 煙塵之處理

7/04 • 爐渣之處理

9/00 金屬精煉或重熔之一般方法；金屬電渣或電弧重熔之設備 [5]

9/02 • 用熔析、過濾、離心分離、蒸餾或超音波作用精煉

9/04 • 真空精煉 [3]

9/05 • 氣體處理（如氣體沖洗）法精煉 [3]

9/10 • 用精煉劑或助熔劑；為此採用之材料（9/18 優先）[3]

9/14 • 以固態精煉

9/16 • 金屬之重熔（熔析見 9/02）[3]

9/18 • • 電渣重熔 [3]

9/187 • • • 所用之設備，如爐子 [5]

9/193 • • • • 結晶器，底板或起動器板 [5]

9/20 • • 電弧重熔 [3]

9/21 • • • 所用之設備 [5]

9/22 • • 用波能或粒子輻射加熱 [3]

11/00 貴金屬之提煉

11/02 • 用乾法

11/06 • 氯化法

11/08 • 氰化法

11/10 • 混汞法

11/12 • • 所用的設備

13/00 鉛之提煉

13/02 • 用乾法

13/06 • 精煉

13/08 • • 用沈澱法，如帕克（Parkes）法，由鉛中分離金屬

13/10 • • 用結晶法，如派梯森（Pattison）法，由鉛中分離金屬

15/00 銅之提煉

15/02 • 於鼓風爐內

15/04 • 於反射爐內

15/06 • 於轉爐內

15/14 • 精煉

17/00 鎢之提煉

17/02 • 用乾法

17/06 • 精煉

19/00 鋅或氧化鋅之提取

19/02 • 礦石之初步處理，氧化鋅之初步純化

19/04 • 蒸餾法提取鋅

19/06 • • 於馬弗爐內 [1,2006.01]

19/08 • • 於鼓風爐內

19/10 • • 於反射爐內

19/12 • • 於坩堝爐內

19/14 • • 於豎式蒸餾罐內

19/16 • • 蒸餾器

19/18 • • • 冷凝器；接受器

19/20 • 用非蒸餾法提取鋅

19/28 • 由馬弗爐殘渣中 [1,2006.01]

19/30 • 由金屬渣或廢料中

19/32 • 鋅之精煉

19/34 • 氧化鋅之製取（氧化鋅之純化見 C01G 9/02）

19/36 • • 於鼓風爐或反射爐內

19/38 • • 於迴轉窯內

21/00 鋁之提煉

- 21/02 • 還原法
- 21/04 • 用鹼金屬
- 21/06 • 精煉

23/00 鎳或鈷之提煉

- 23/02 • 用乾法
- 23/06 • 精煉

25/00 錫之提煉

- 25/02 • 用乾法
- 25/06 • 由廢料中，尤指由錫廢料中（電解法見 C25C 1/14）
- 25/08 • 精煉

26/00 鹼金屬、鹼土金屬或鎂之提取 [2]

- 26/10 • 鹼金屬之提取 [2]
- 26/12 • • 鋰之提取 [2]
- 26/20 • 鹼土金屬或鎂之提取 [2]
- 26/22 • • 鎂之提取 [2]

30/00 銻、砷或鉍之提取

- 30/02 • 銻之提取 [2]
- 30/04 • 砷之提取 [2]
- 30/06 • 鉍之提取 [2]
- 34/00 • 難熔金屬之提取 [2]
- 34/10 • 鈦、鈳或鉛之提取 [2]

- 34/12 • • 鈦之提取 [2]
- 34/14 • • 鈳或鉛之提取 [2]
- 34/20 • 鈳、鉍或鈳之提取 [2]
- 34/22 • • 鈳之提取 [2]
- 34/24 • • 鈳或鉍之提取 [2]
- 34/30 • 鉍、鉍或鉍之提取 [2]
- 34/32 • • 鉍之提取 [2]
- 34/34 • • 鉍之提取 [2]
- 34/36 • • 鉍之提取 [2]

35/00 鈹之提取**41/00 鍺之提取****43/00 汞之提取****47/00 錳之提取****58/00 鎳或鈷之提取 [2]****59/00 稀土金屬之提取****60/00 原子序數為 87 或高於 87 之金屬，即放射性金屬之提取 [2]**

- 60/02 • 鈾、鈾或其他鈾系元素之提取 [2]
- 60/04 • • 鈾之提取 [2]

61/00 不包括本次類的其他金屬之提取（鐵見 C21）[2]**C22C 合金（合金之處理見 C21D、C22F）****附註**

(1) 於本次類內，下列名詞或術語意指：

— “合金”亦包含：

- (a) 含有主要比例之纖維或其它較大粒子之金屬複合材料；[4]
- (b) 含有除做為巨觀增強劑外者，接至碳化物、金剛石、氧化物、硼化物、氮化物或矽化物（例如金屬陶瓷）或其它金屬化合物（例如氮氧化物或硫化物）上之游離金屬的陶瓷組合物。[4]

— “基於”須為佔特定一個或一組成分之至少 50% 重量。[2]

次類索引

非鐵合金	
製造.....	1/00，3/00
以特定金屬為基或含有	
特定金屬.....	5/00 至 32/00
含鐵合金	
製造.....	33/00
母（中間）合金.....	35/00

鑄鐵合金.....	37/00
鐵基金屬.....	38/00
放射性合金.....	43/00
非晶態合金.....	45/00
含纖維或細絲之合金.....	47/00，49/00

附註

43/00 至 49/00 各目優先於 1/00 至 38/00 各目。[2009.01]非鐵合金，即基本上以除鐵之外的金屬為基的合金 [2,5]

- 1/00 非鐵合金之製造**（用電熱法見 C22B 4/00；用電解法見 C25C 1/24，C25C 3/36）
[1,2006.01,2023.01]
- 1/02 • 用熔煉法
- 1/03 • • 使用母（中間）合金 **[2,2006.01]**
- 1/04 • 用粉末冶金法（C22C 1/08 優先）
[1,2,2006.01,2023.01]
- 1/047 • • 包含金屬間化合物 [2023.01]
- 1/05 • • 金屬粉末與非金屬粉末之混合物（C22C 1/08 優先）
[1,2,2006.01,2023.01]
- 1/051 • • • 製造基於硼化物、碳化物、氮化物、氧化物或矽化物的硬質金屬；用作其起始原料的粉末混合物的製備[2023.01]
- 1/053 • • • • 原位形成硬質化合物 [2023.01]
- 1/055 • • • • 用碳 [2023.01]
- 1/056 • • • • 用燃氣 [2023.01]
- 1/057 • • • • 通過固相反應燒結原位形成硬質化合物以外的相，例如還原反應形成的金屬相 [2023.01]
- 1/059 • • • 製造包含按重量計小於 5% 的分散增強相的合金[2023.01]
- 1/06 • 使用精煉或脫氧的專用添加劑

[1,2006.01]

- 1/08 • 有開或閉孔隙之合金
- 1/10 • 含非金屬之合金（C22C 1/05，C22C 1/08 優先）

[1,2,2006.01,2023.01]

- 1/11 • 製造非晶態合金 [2023.01]
- 1/12 • 通過半固態加工，例如將合金保持在固－液相[2023.01]

3/00 由非鐵合金中去除物質以生產不同成分之合金

5/00 貴金屬基金屬

- 5/02 • 金基金屬 [2]
- 5/04 • 鉑系金屬基金屬 [2]
- 5/06 • 銀基金屬 [2]
- 5/08 • • 銅作次主要成分者 [2]
- 5/10 • • 鎳作次主要成分者 [2]

7/00 汞基金屬 [2]**9/00 銅基金屬 [2]**

- 9/01 • 鋁作次主要成分者 [2]
- 9/02 • 錫作次主要成分者 [2]
- 9/04 • 鋅作次主要成分者 [2]
- 9/05 • 鎳作次主要成分者 [2]
- 9/06 • 鎳或鈷作次主要成分者 [2]
- 9/08 • 鉛作次主要成分者 [2]
- 9/10 • 矽作次主要成分者

11/00 鉛基金屬 [2]

- 11/02 • 鹼金屬或鹼土金屬作次主要成分者 [2]
- 11/04 • 銅作次主要成分者 [2]
- 11/06 • 錫作次主要成分者 [2]

- 11/08 · 銻或鉍作次主要成分者 [2]
- 11/10 · · 含錫者 [2]
- 12/00 銻或鉍基合金 [2]**
- 13/00 錫基合金**
- 13/02 · 銻或鉍作次主要成分者 [2]
- 14/00 鈦基合金 [2]**
- 16/00 鉛基合金 [2]**
- 18/00 鋅基合金 [2]**
- 18/02 · 銅作次主要成分者 [2]
- 18/04 · 鋁作次主要成分者 [2]
- 19/00 鎳或鈷基合金**
- 19/03 · 鎳基合金 [2]
- 19/05 · · 含鉻者 [2]
- 19/07 · 鈷基合金 [2]
- 20/00 鎘基合金 [2]**
- 21/00 鋁基合金**
- 21/02 · 矽作次主要成分者 [2]
- 21/04 · · 變質鋁矽合金
- 21/06 · 鎂作次主要成分者 [2]
- 21/08 · · 含矽者 [2]
- 21/10 · 鋅作次主要成分者 [2]
- 21/12 · 銅作次主要成分者 [2]

附註

在 21/14 至 21/18 各目中，適用末位規則，即在各階層中，無相反指示時，合金請放入最後適當位置。[4]

- 21/14 · · 含矽者 [2]
- 21/16 · · 含鎂者 [2]
- 21/18 · · 含鋅者 [2]

22/00 錳基合金 [2]

23/00 鎂基合金

- 23/02 · 鋁作次主要成分者 [2]
- 23/04 · 鋅或鎘作次主要成分者 [2]
- 23/06 · 稀土金屬作次主要成分者 [2]

24/00 鹼金屬或鹼土金屬基合金 [2]

25/00 鈹基合金

26/00 含金鋼石合金 [4]

27/00 銻或 14/00 或 16/00 目內未提及的難熔金屬基合金 [2]

- 27/02 · 鈮、鈮或鈮基合金 [2]
- 27/04 · 鎢或鉬基合金 [2]
- 27/06 · 鉻基合金 [2]

28/00 不包括 5/00 至 27/00 目之金屬基合金 [2]

29/00 以碳化物、氧化物、硼化物、氮化物或矽化物（例如金屬陶瓷）或其他金屬化合物（例如氮氧化物、硫化物）為基之合金 [4]

- 29/02 · 以碳化物或碳氮化物為基者 [4]
- 29/04 · · 以碳氮化物為基者 [4]
- 29/06 · · 以碳化物為基，但不含其他金屬化合物者 [4]
- 29/08 · · · 以碳化鎢為基者 [4]
- 29/10 · · · 以碳化鈦為基者 [4]
- 29/12 · 以氧化物為基者 [4]
- 29/14 · 以硼化物為基者 [4]
- 29/16 · 以氮化物為基者 [4]
- 29/18 · 以矽化物為基者 [4]

30/00 每一種成分之重量均小於 50% 的合金 [2]

附註

於 30/02 至 30/06 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示時，合金請放入最後適當位置。[4]

- 30/02 · 含銅者 [2]
- 30/04 · 含錫或含鉛者 [2]
- 30/06 · 含鋅者 [2]

32/00 按重量至少含 5% 但小於 50% 者，無論係本身加入的或原位形

成的硼化物、碳化物、氮化物、
氧化物、矽化物或其他金屬化合
物（例如氮氧化合物、硫化物）之
非鐵合金 [2]

含鐵合金 [2,5]

33/00 含鐵合金之製造（其熱處理見 C21D5/00、6/00）

- 33/02 · 用粉末冶金法
- 33/04 · 用熔煉法 [2]
- 33/06 · · 使用母（中間）合金 [2]
- 33/08 · 鑄鐵合金之製造 [2]
- 33/10 · · 包括添加鎂之方法 [2]
- 33/12 · · · 用流體噴入法 [2]

35/00 鐵或鋼之母（中間）合金

附註

於 37/00 或 38/00 目內，適用末
位規則，即在各階層中，若無相
反指示時，合金各成分請放入最
後適當位置。[2]

37/00 鑄鐵合金 [2]

- 37/04 · 含球墨者
- 37/06 · 含鉻者 [2]
- 37/08 · · 含鎳者
- 37/10 · 含鋁或矽者

38/00 鐵基合金，例如合金鋼（鑄鐵合 金見 37/00）[2]

- 38/02 · 含矽者 [2]
- 38/04 · 含錳者 [2]
- 38/06 · 含鋁者 [2]
- 38/08 · 含鎳者 [2]
- 38/10 · 含鈷者 [2]
- 38/12 · 含鎢、鉍、鉬、釩或鉬者 [2]
- 38/14 · 含鈦或鉍者 [2]
- 38/16 · 含銅者 [2]
- 38/18 · 含鉻者 [2]
- 38/20 · · 含銅者 [2]
- 38/22 · · 含鉬或鎢者 [2]

- 38/24 · · 含釩者 [2]
- 38/26 · · 含鉍或鉍者 [2]
- 38/28 · · 含鈦或鉍者 [2]
- 38/30 · · 含鈷者 [2]
- 38/32 · · 含硼者 [2]
- 38/34 · · 含大於 1.5%（重量）之矽 [2]
- 38/36 · · 含大於 1.7%（重量）之碳 [2]
- 38/38 · · 含大於 1.5%（重量）之錳 [2]
- 38/40 · · 含鎳者 [2]
- 38/42 · · · 含銅者
- 38/44 · · · 含鉬或鎢者 [2]
- 38/46 · · · 含釩者 [2]
- 38/48 · · · 含鉍或鉍者 [2]
- 38/50 · · · 含鈦或鉍者 [2]
- 38/52 · · · 含鈷者 [2]
- 38/54 · · · 含硼者 [2]
- 38/56 · · · 含大於 1.7%（重量）之碳[2]
- 38/58 · · · 含大於 1.5%（重量）之錳[2]
- 38/60 · 含鉛、硒、碲或銻或含大於 0.04%
（重量）之硫 [2]

43/00 含放射物質之合金 [2]

45/00 非晶態合金（製作非晶態有色合 金見 C22C 1/11）

[5,2006.01,2023.01]

- 45/02 · 鐵作主要成分者 [5]
- 45/04 · 鎳或鈷作主要成分者 [5]
- 45/06 · 鉍作主要成分者 [5]
- 45/08 · 鋁作主要成分者 [5]
- 45/10 · 鉬、鎢、鉍、鉍、鈦或鉍作主要
成分者 [5]

含纖維或細絲之合金 [7]

附註

於 47/00 及 49/00 諸目內，最好
加入 101/00、111/00 及 121/00
目之索引碼。[7]

47/00 製造含有金屬或非金屬纖維或 細絲之合金 [7]

- 47/02 · 纖維或細絲之預先處理 [7]
- 47/04 · · 經由塗佈方式，例如帶有一層

- 保護或活性覆蓋 [7]
- 47/06 • • 經由將纖維或細絲形成預成型結構，例如利用暫時黏合方式形成一種底板狀元件 [7]
- 47/08 • 經由將纖維或細絲與熔融金屬接觸，例如把纖維或細絲置放在鑄模中浸滲 [7]
- 47/10 • • 在有反應活性狀況中浸滲；反應中浸滲 [7]
- 47/12 • • 在機械壓力下浸滲或鑄造 [7]
- 47/14 • 經由粉末冶金，亦即經由金屬粉末與纖維或細絲混合物之加工 [7]
- 47/16 • 經由金屬之熱噴射，例如電漿噴射 [7]
- 47/18 • • 使用纖維或細絲之預成形結構 [7]
- 47/20 • 經由對至少一層或一片金屬與一層纖維或細絲構成之組件加壓和加熱 [7]

49/00 含金屬或非金屬纖維或細絲之合金 [7]

- 49/02 • 以基質材料為特徵者 [7]
- 49/04 • • 輕金屬 [7]
- 49/06 • • • 鋁 [7]
- 49/08 • • 鐵系金屬 [7]
- 49/10 • • 難熔金屬 [7]
- 49/11 • • • 鈦 [7]
- 49/12 • • 金屬間化合物基質材料 [7]
- 49/14 • 以纖維或細絲為特徵者 [7]

涉及包含在金屬—纖維組合物中，纖維材料性質與主目 47/00 及 49/00 聯合使用之索引碼。 [7]

101/00 非金屬纖維或細絲 [7]

- 101/02 • 以氧化物為主者，例如氧化物陶瓷纖維 [7]
- 101/04 • • 氧化鋁 [7]
- 101/06 • • 氧化物混合物，例如鋁矽酸鹽或玻璃 [7]
- 101/08 • 以非氧化物為主者，例如非氧化物陶瓷纖維 [7]

- 101/10 • • 碳 [7]
- 101/12 • • 碳化物 [7]
- 101/14 • • • 碳化矽 [7]
- 101/16 • • 氮化物 [7]
- 101/18 • • • 氮化矽 [7]
- 101/20 • • 硼 [7]
- 101/22 • • 硼化物 [7]

111/00 金屬纖維或細絲 [7]

- 111/02 • 難熔金屬纖維或細絲，例如鎢纖維 [7]

121/00 預先處理之纖維或細絲 [7]

- 121/02 • 塗佈過之纖維或細絲，例如帶有保護作用塗層之陶瓷纖維 [7]

C22F 改變非鐵金屬或非鐵合金之物理結構(鐵基合金或鋼的專用熱處理方法及金屬或合金之熱處理設備見 C21D)

附註 [2012.01]

以 C23C 所包含之至少一種方法及本類所包含之至少一種方法以進行的冶金材料表面處理，被分類至 C23F 17/00

1/00 用熱處理法或用熱加工或冷加工法改變非鐵金屬或合金之物理結構

- 1/02 • 於惰性氣體或控制氣氛或真空內
- 1/04 • 鋁或鋁基合金
- 1/043 • • 以矽作次主要成分之合金者[4]
- 1/047 • • 以鎂作次主要成分之合金者[4]
- 1/05 • • 矽及鎂於比例上近似相等之 Al-Si-Mg 系合金者 [4]
- 1/053 • • 以鋅作次主要成分之合金者[4]
- 1/057 • • 以銅作次主要成分之合金者[4]
- 1/06 • 鎂或鎂基合金
- 1/08 • 銅或銅基合金
- 1/10 • 鎳或鈷或此等基之合金
- 1/11 • 鉻或鉻基合金
- 1/12 • 鉛或鉛基合金
- 1/14 • 貴金屬或以此等為基之合金
- 1/16 • 其他金屬或以此等為基之合金
- 1/18 • • 高熔點或難熔金屬或以此等為基之合金

3/00 用特殊的物理方法（例如中子處理）改變非鐵金屬或合金的物理結構

- 3/02 • 用超音波或電場或磁場控制之熔體凝固法

C23 對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆；表面化學處理；金屬材料之擴散處理；真空蒸發法、濺射法、離子注入法或化學氣相沈積法之一般鍍覆；金屬材料腐蝕或積垢之一般抑制[2]

附註[4]

(1) 於本類中，下列術語的含義為：

— “金屬材料” 包含：

(a) 金屬； [4]

(b) 合金。

(2) 注意 C22C 次類標題後面之附註。

C23C 對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆；表面擴散法，化學轉化或置換法之金屬材料表面處理；真空蒸發法、濺射法、離子注入法或化學氣相沈積法之一般鍍覆（擠壓法製造包覆金屬之產品見 B21C 23/22；通過將預先存在的薄層連接至製品上之方法用金屬進行鍍覆處理者見各有關位置。例如 B21D39/00，B23K；玻璃之金屬化見 C03C；砂漿，混凝土，人造石，陶瓷或天然石之金屬化見 C04B 41/00；金屬之搪瓷或向金屬上鍍覆玻璃體層見 C23D；藉電解法或電泳法進行之金屬表面處理或塗層見 C25D；單晶膜生長見 C30B；藉用金屬化織物見 D06M 11/83；通過局部金屬化裝飾織物見 D06Q 1/04） [4]

附註

本次類內，當某種工序專門適用於但又截然不同於所涉及的被覆工藝並構成一種單獨之工序，則視作預處理或後處理。若某種工序之結果形成永久的底層或面層，則不視作預處理或後處理，而作多步被覆工藝予以分類。[4]

次類索引

用熔融覆層材料之鍍覆	2/00 至 6/00	接觸鍍.....	18/00
固態擴散鍍覆.....	8/00 至 12/00	表面化學處理	22/00
用真空蒸發、濺射或		使用無機粉末之鍍覆.....	24/00
離子注入法鍍覆.....	14/00	其他鍍覆，多層鍍覆.....	26/00， 28/00
化學鍍覆	16/00 至 20/00	金屬覆層材料之組成.....	30/00

狀之熱浸或浸漬工藝；其所用的

用熔融態覆層材料之鍍覆 [4]

設備 [4]

2/02 • 待鍍材料之預處理，例如為於選定的表面區域上鍍覆(2/30 優先)

2/00 用熔融態覆層材料且不影響形

- [4]
- 2/04 • 以覆層材料為特徵者 [4]
- 2/06 • • 鋅或鎳或以其為基之合金 [4]
- 2/08 • • 錫或錫合金
- 2/10 • • 鉛或鉛合金 [4]
- 2/12 • • 鋁或鋁合金 [4]
- 2/14 • 過量熔融覆層之除去；覆層厚度之控制或調節 [4,2006.01]
- 2/16 • • 使用壓力流體，例如氣刀者 [4]
- 2/18 • • • 長形材料上過量熔融層之除去 [4]
- 2/20 • • • • 帶材；板材 [4]
- 2/22 • • 利用鏟刮，例如用刀 [4]
- 2/24 • • 使用磁場或電場者 [4]
- 2/26 • 後處理（2/14 優先）[4]
- 2/28 • • 加熱後處理，例如在油槽中處理 [4]
- 2/30 • 熔劑或融態槽液上之覆蓋物（2/22 優先）[4]
- 2/32 • 用施加於槽液或基體之振動能者（2/14 優先）[4]
- 2/34 • 以待處理材料之形狀為特徵者（2/14 優先）[4]
- 2/36 • • 長形材料 [4]
- 2/38 • • • 線材；管材 [4]
- 2/40 • • • 板材；帶材 [4]
- 4/00 熔融態覆層材料噴鍍法，例如火焰噴鍍法，電漿噴鍍法或放電噴鍍法之鍍覆（堆焊見 B23K，例如 B23K 5/18、B23K9/04；噴槍見 B05B；通過金屬的熱噴鍍製備含纖維或絲的合金見 C22C 47/16；電漿槍見 H05H）[4,2016.01]**
- 4/01 • 選擇性塗層，例如圖案塗佈，無待塗佈材料的預處理 [2016.01]
- 4/02 • 待鍍材料之預處理，例如為了於選定的表面區域鍍覆 [4]
- 4/04 • 以鍍覆材料為特徵者 [4]
- 4/06 • • 金屬材料 [4,2016.01]
- 4/067 • • • 含非金屬元素的自由粒子，例如碳，矽，硼，磷或砷 [2016.01]
- 4/073 • • • 含 MCrAl 或 MCrAlY 的合金，其中 M 是有或沒有非金屬元素之鎳，鈷或鐵，[2016.01]
- 4/08 • • • 僅含金屬元素者（C23C4/073 優先）[4,2016.01]
- 4/10 • • 氧化物，硼化物，碳化物，氮化物，矽化物或其混合物或矽化物；為此之混合物 [4,2016.01]
- 4/11 • • • 氧化物[2016.01]
- 4/12 • 以噴鍍方法為特徵者 [4,2016.01]
- 4/123 • • 噴塗熔融金屬[2016.01]
- 4/126 • • 爆炸噴塗[2016.01]
- 4/129 • • 火焰噴塗[2016.01]
- 4/131 • • 線電弧噴塗[2016.01]
- 4/134 • • 電漿噴塗[2016.01]
- 4/137 • • 在真空中或在惰性氣體中噴塗 [2016.01]
- 4/14 • • 用於長形材料之鍍覆塗佈 [4,2016.01]
- 4/16 • • • 線材；管材 [4,2016.01]
- 4/18 • 後處理 [4]
- 6/00 基體上澆鑄熔融材料之鍍覆 [4]**
- 金屬材料表面之固滲 [4]**
- 8/00 金屬材料表面中僅滲入非金屬元素之固滲（滲矽見 10/00）；金屬材料表面與反應氣體反應、覆層中留存表面材料反應產物法之表面化學處理，例如轉化層，金屬之鈍化（14/00 優先）[4]**
- 8/02 • 待被覆材料之預處理（8/04 優先）[4]
- 8/04 • 局部表面之處理，例如使用光罩者 [4]
- 8/06 • 使用氣體者 [4]
- 8/08 • • 僅用一種元素者 [4]
- 8/10 • • • 氧化 [4]
- 8/12 • • • • 使用元素氧或臭氧者 [4]

- 8/14 含鐵金屬表面之氧 [4]
- 8/16 使用含氧化合物，例如
H₂O、CO₂ 者 [4]
- 8/18 含鐵金屬表面之氧化 [4]
- 8/20 滲碳 [4]
- 8/22 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/24 滲氮 [4]
- 8/26 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/28 . . . 一步法滲多種元素 [4]
- 8/30 碳氮共滲 [4]
- 8/32 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/34 . . . 多步法滲多種元素 [4]
- 8/36 . . . 使用電離氣體者，例如離子氮
化 [4,2006.01]
- 8/38 含鐵金屬表面之處理 [4]
- 8/40 . . . 使用液體，例如鹽浴、懸浮液者
[4]
- 8/42 . . . 僅滲一種元素 [4]
- 8/44 滲碳 [4]
- 8/46 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/48 滲氮 [4]
- 8/50 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/52 . . . 一步法滲多種元素 [4]
- 8/54 碳氮共滲 [4]
- 8/56 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/58 . . . 多步法滲多種元素 [4]
- 8/60 . . . 使用固體，例如粉末、膏劑者
（使用含固體之懸浮液者見
8/40）[4]
- 8/62 . . . 僅滲一種元素 [4]
- 8/64 滲碳 [4]
- 8/66 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/68 滲硼 [4]
- 8/70 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/72 . . . 一步法滲多種元素 [4]
- 8/74 碳氮共滲 [4]
- 8/76 含鐵金屬表面者 [4]
- 8/78 . . . 多步法滲多種元素 [4]
- 8/80 . . . 後處理 [4]
- 10/00 金屬材料表面內僅滲入金屬元
素或矽之固滲 [4]**
- 10/02 . . . 待被覆材料之預處理，（10/04 優
先）[4]
- 10/04 . . . 局部表面上之擴散處理，例如使
用光罩 [4]
- 10/06 . . . 使用氣體者 [4]
- 10/08 . . . 僅滲一種元素 [4]
- 10/10 滲鉻 [4]
- 10/12 含鐵金屬表面者 [4]
- 10/14 . . . 一步法滲多種元素 [4]
- 10/16 . . . 多步法滲多種元素 [4]
- 10/18 . . . 使用液體，例如鹽浴、懸浮液者
[4]
- 10/20 . . . 僅滲一種元素 [4]
- 10/22 於含有欲滲元素之金屬熔體
內 [4]
- 10/24 於含欲滲元素之鹽浴內[4]
- 10/26 . . . 滲多種元素 [4]
- 10/28 . . . 使用固體，例如粉末、膏劑者[4]
- 10/30 . . . 於表面上使用粉末層或膏劑層
者（使用含固體之懸浮液者見
10/18）[4]
- 10/32 滲鉻 [4]
- 10/34 . . . 埋置於粉末混合物內者，例如
包埋滲 [4]
- 10/36 . . . 僅滲一種元素 [4]
- 10/38 滲鉻 [4]
- 10/40 含鐵金屬表面者 [4]
- 10/42 有揮發性催滲添加
劑，例如鹵代物存在
[4]
- 10/44 滲矽 [4]
- 10/46 含鐵金屬表面上滲矽者
[4]
- 10/48 滲鋁 [4]
- 10/50 含鐵金屬表面上滲鋁者
[4]
- 10/52 一步法滲入多種元素 [4]
- 10/54 至少有鉻 [4]
- 10/56 且至少有鋁 [4]
- 10/58 . . . 多步法滲多種元素 [4]
- 10/60 . . . 後處理 [4]
- 12/00 金屬材料表面內至少滲入一種**

矽以外的非金屬元素及至少一種金屬元素或矽之固滲 [4]

12/02 · 一步法滲入 [4]

真空蒸發法、濺射法或離子注入法之鍍覆 [4]

14/00 經由覆層形成材料之真空蒸發、濺射或離子注入進行鍍覆 [4,2006.01]

14/02 · 待鍍材料之預處理 (14/04 優先) [4]

14/04 · 局部表面上之鍍覆，例如使用光罩 [4]

14/06 · 以鍍層材料為特徵者 (14/04 優先) [4]

14/08 · · 氧化物 (14/10 優先) [4]

14/10 · · 玻璃或二氧化矽 [4]

14/12 · · 有機材料 [4]

14/14 · · 金屬材料、硼或矽 [4]

14/16 · · · 於金屬基體或於硼或矽基體上 [4]

14/18 · · · 於其他無機基體上 [2]

14/20 · · · 於有機物基體上 [4]

14/22 · 以鍍覆工藝為特徵者 [4]

14/24 · · 真空蒸發 [4]

14/26 · · · 電阻加熱蒸發源法或感應加熱蒸發源法 [4]

14/28 · · · 波能法或粒子輻射法 (14/32 至 14/48 優先) [4]

14/30 · · · · 電子轟擊法 [4]

14/32 · · · 爆炸法；蒸發及隨後的氯化物電離法 (14/34 至 14/48 優先) [4]

14/34 · · 濺射 [4]

14/35 · · · 利用磁場者，例如磁控濺射 [5]

14/36 · · · 二極濺射 (14/35 優先) [4,5]

14/38 · · · · 用直流熾熱放電 [4]

14/40 · · · · 用交流放電者，例如高頻放電 [4]

14/42 · · · 三極濺射 (14/35 優先) [4,5]

14/44 · · · · 施加高頻及附加直流電壓法 [4]

14/46 · · · 用外部離子源產生之離子束法 (14/40 優先) [4]

14/48 · · 離子注入 [4]

14/50 · · 基座 [4]

14/52 · · 觀察鍍覆工藝之裝置 [4]

14/54 · · 鍍覆工藝之控制或調節 [4,2006.01]

14/56 · · 連續鍍覆之專用設備；維持真空之裝置，例如真空鎖定器 [4]

14/58 · 後處理 [4]

化學沈積或分解法鍍覆；接觸鍍 [4]

16/00 經由氣態化合物分解且表面反應產物不留存於鍍層內之化學鍍覆，例如化學氣相沈積 [CVD] 工藝 (反應濺射或真空蒸發見 14/00) [4,2006.01]

16/01 · 在臨時受質上，例如在隨後以蝕刻去除之受質上 [7]

16/02 · 待鍍材料之預處理 (16/04 優先) [4]

16/04 · 局部表面上之鍍覆，例如使用光罩者 [4]

16/06 · 以金屬材料之沈積為特徵者 [4]

16/08 · · 自金屬鹵化物 [4]

16/10 · · · 僅沉積鉻 [4]

16/12 · · · 僅沉積鋁 [4]

16/14 · · · 僅沉積一種其他之金屬元素 [4]

16/16 · · 自金屬羰基化合物 [4]

16/18 · · 自有機金屬化合物 [4]

16/20 · · · 僅沉積鋁 [4]

16/22 · 以沈積金屬材料以外之無機材料為特徵者 [4]

16/24 · · 僅沉積矽 [4]

16/26 · · 僅沉積碳 [4]

16/27 · · · 僅只金剛石 [7]

- 16/28 · · 僅沉積一種其他之非金屬元素 [4]
- 16/30 · · 沉積化合物、混合物或固溶體，例如硼化物、碳化物、氮化物 [4]
- 16/32 · · · 碳化物 [4]
- 16/34 · · · 氮化物 [4]
- 16/36 · · · 碳氮化物 [4]
- 16/38 · · · 硼化物 [4]
- 16/40 · · · 氧化物 [4]
- 16/42 · · · 矽化物 [4]
- 16/44 · 以鍍覆方法為特徵者(16/04 優先) [4]
- 16/442 · · 採用流化床加工法 [7]
- 16/448 · · 以產生反應氣流方法為特徵者，例如經由先質之蒸發或昇華 [7]
- 16/452 · · · 在輸入反應室之前先活化反應氣流法，例如經由電離或添加活性物種 [7]
- 16/453 · · 經由燃燒器或噴火炬輸入反應氣體，例如大氣壓力下之 CVD 法 (16/513 優先；在熔融狀態下以火焰或電漿噴灑之塗佈材料見 4/00) [7]
- 16/455 · · 以將氣體輸入反應室或改變反應室內氣流方法為特徵者 [7]
- 16/458 · · 以支援反應室內受質方法為特徵者 [7]
- 16/46 · · 用加熱基體之方法 (16/48、16/50 優先) [4]
- 16/48 · · 輻射法，例如光分解、輻射分解、粒子輻射 [4]
- 16/50 · · 借助放電者 [4]
- 16/503 · · · 採用直流或交流放電 [7]
- 16/505 · · · 採用無線電頻率放電 [7]
- 16/507 · · · · 採用外在電極，例如在隧道式反應器中 [7]
- 16/509 · · · · 採用內在電極 [7]
- 16/511 · · · · 採用微波放電 [7]
- 16/513 · · · · 採用電漿噴射 [7]
- 16/515 · · · · 採用脈動放電 [7]

- 16/517 · · · 採用 16/503 至 16/515 諸目中至少兩項合併放電 [7]
- 16/52 · · 鍍覆工藝之控制或調整 [4,2006.01]
- 16/54 · · 連續鍍覆之專用設備 [4]
- 16/56 · 後處理 [4]
- 18/00 經由液態化合物分解抑或覆層形成化合物溶液分解、且覆層內不留存表面材料反應產物之化學鍍覆；接觸鍍 [4,2006.01]

附註

本主目亦包括含有反應液體與不反應固體顆粒之懸浮液 [4]

- 18/02 · 熱分解法 [4]
- 18/04 · · 待鍍材料之預處理 (18/06 優先) [4]
- 18/06 · · 局部表面上之鍍覆，例如使用光罩者 [4]
- 18/08 · · 以金屬材料之沉積為特徵者 [4]
- 18/10 · · · 僅沉積鋁 [4]
- 18/12 · · 以沉積金屬材料以外之無機材料為特徵者 [4]
- 18/14 · 輻射分解法，例如光分解、粒子輻射 [4]
- 18/16 · 還原法或置換法，例如無電流鍍 (18/54 優先) [4]
- 18/18 · · 待鍍材料之預處理 [4]
- 18/20 · · · 有機物表面，例如樹脂者 [4]
- 18/22 · · · · 粗糙化，例如用蝕刻 [4]
- 18/24 · · · · · 使用酸性水溶液者 [4]
- 18/26 · · · · · 使用有機液體者 [4]
- 18/28 · · · · 敏化或活化 [4]
- 18/30 · · · · · 活化 [4]
- 18/31 · · 用金屬鍍覆 [5]
- 18/32 · · · 用鐵、鈷或鎳之一種鍍覆；用此等金屬之一種與磷或硼所成的混合物鍍覆 [4,5]
- 18/34 · · · · 使用還原劑者 [4,5]
- 18/36 · · · · · 使用次磷酸鹽者 [5]

18/38	• • • 鍍銅 [4,5]		
18/40	• • • • 使用還原劑者 [4,5]		指示，發明請放入最後適當位置。[4]
18/42	• • • 鍍貴金屬 [4,5]		
18/44	• • • • 使用還原劑者 [4,5]	22/02	• 使用非水溶液者 [4]
18/48	• • 用合金鍍覆 [4,5]	22/03	• • 含有磷化合物者 [4]
18/50	• • • 用鐵基、鈷基或鎳基合金 (18/32 優先) [4,5]	22/04	• • 含有六價鉻化合物者 [4]
18/52	• • 使用還原劑鍍不包括 18/32 至 18/50 各目之單一目內之金屬 材料 [4]	22/05	• 使用水溶液者 [5]
18/54	• 接觸鍍，即無電流化學鍍 [4]	22/06	• • 使用 pH<6 之酸性水溶液者 [4,5]
20/00	經由固態覆層化合物抑或覆層 形成化合物懸浮液分解且覆層 內不留存表面材料反應產物之 化學鍍覆 [4,2006.01]	22/07	• • • 含有磷酸鹽者 [4,5]
附註		22/08	• • • • 偏磷酸鹽 [4,5]
	本主目亦包括含有不反應液體 與反應固體顆粒之懸浮液。[4]	22/10	• • • • • 含有氧化劑者 [4,5]
20/02	• 鍍金屬材料 [4]	22/12	• • • • • 含有鋅陽離子者 [4,5]
20/04	• • 鍍金屬 [4]	22/13	• • • • • 尚包有硝酸根或或亞 硝酸根者 [4,5]
20/06	• 鍍金屬材料以外之無機材料 [4]	22/14	• • • • • 尚含有氯酸根者[4,5]
20/08	• • 鍍化合物、混合物或固溶體， 例如硼化物、碳化物、氮化物 [4]	22/16	• • • • • 尚含有過氧化物者 [4,5]
22/00	表面與反應液反應、覆層內留存 表面材料反應產物之金屬材料 表面化學處理，例如轉化層、金 屬之鈍化 [4,2006.01]	22/17	• • • • • 尚含有有機酸者[4,5]
附註		22/18	• • • • • 含有錳陽離子者 [4,5]
	(1) 本主目亦包括含有反應液體 與不反應固體顆粒之懸浮 液。[4]	22/20	• • • • • 含有鋁陽離子者 [4,5]
	(2) 槽液之再生分入與該特定槽 液組成相應之位置。[4]	22/22	• • • • • 含有鹼土金屬陽離子者 [4,5]
附註		22/23	• • • • 縮合磷酸鹽 [4,5]
	22/02 至 22/86 各目內，適用末位 規則，即在各階層中，若無相反	22/24	• • • 含有六價鉻化合物者 [4,5]
		22/26	• • • • 尚含有有機化合物 [4,5]
		22/27	• • • • • 酸類 [4,5]
		22/28	• • • • • 高分子化合物 [4,5]
		22/30	• • • • 尚含有三價鉻 [4,5]
		22/32	• • • • 尚含有金屬粉末 [4,5]
		22/33	• • • • 尚含有磷酸鹽 [4,5]
		22/34	• • • 含有氟化物或錯合氟化物者 [4,5]
		22/36	• • • • 尚含有磷酸鹽 [4,5]
		22/37	• • • • 尚含有六價鉻化合物[4,5]
		22/38	• • • • • 尚含有磷酸鹽 [4,5]
		22/40	• • • 含有鉬酸鹽、鎢酸鹽或釩酸 鹽者 [4,5]
		22/42	• • • • 尚含有磷酸鹽 [4,5]
		22/43	• • • • 尚含有六價鉻化合物者 [4,5]
		22/44	• • • • 尚含有氟化物或絡合氟化 物 [4,5]

- 22/46 . . . 含有草酸鹽者 [4,5]
- 22/47 尚含有磷酸鹽 [4,5]
- 22/48 . . . 不含磷酸鹽、六價鉻化合物、氟化物或絡合氟化物、鉬酸鹽、鎢酸鹽、釩酸鹽或草酸鹽者 [4,5]
- 22/50 鐵或鐵基合金之處理 [4,5]
- 22/52 銅或銅基合金之處理 [4,5]
- 22/53 鋅或鋅基合金之處理 [4,5]
- 22/54 難熔金屬或以其為基之合金的處理 [4,5]
- 22/56 鋁或鋁基合金之處理 [4,5]
- 22/57 鎂或鎂基合金之處理 [4,5]
- 22/58 其他金屬材料之處理 [4,5]
- 22/60 . . 使用 pH>8 之鹼性水溶液者 [4,5]
- 22/62 . . . 鐵或鐵合金之處理 [4,5]
- 22/63 . . . 銅或銅合金之處理 [4,5]
- 22/64 . . . 難熔金屬或以其為基之合金的處理 [4,5]
- 22/66 . . . 鋁或鋁合金之處理 [4,5]
- 22/67 用六價鉻化之溶液 [4,5]
- 22/68 . . 使用 pH 為 6~8 之間之水溶液者 [4,5]
- 22/70 . 使用熔體 [4]
- 22/72 . . 鐵或鐵合金之處理 [4]
- 22/73 . 以工藝為特徵者 [4]
- 22/74 . . 用於獲得燒上轉化層者 [4]
- 22/76 . . 利用噴霧法鍍覆液體 [4]
- 22/77 . . 鍍覆工藝之控制或調節 [4,2006.01]
- 22/78 . 待鍍覆材料之預處理 [4]
- 22/80 . . 用含鈦或鉛化合物之溶液者 [4]
- 22/82 . 後處理 [4]
- 22/83 . . 化學後處理 [4]
- 22/84 . . 著色 [4]
- 22/86 . 鍍覆槽液之再生 [4]
- 24/00 自無機粉末起始的鍍覆（熔融態覆層材料之噴鍍見 4/00；固滲見 8/00 至 12/00）[4,2006.01]
- 24/02 . 僅使用壓力者 [4]
- 24/04 . . 顆粒之衝擊或動力沉積 [4]
- 24/06 . . 粉末狀覆層材料之壓製，例如軋製 [4]
- 24/08 . 加熱法或加壓加熱法者（24/04 優先）[4]
- 24/10 . . 覆層中臨時形成液相者 [4]
- 26/00 不包括 2/00 至 24/00 各目內之鍍覆 [4]
- 26/02 . 基體上鍍覆熔融材料者 [4,2006.01]
- 28/00 用不包括 2/00 至 26/00 各主目內單一目之方法抑或用列入 C23C 與 C25D 各次類中方法之組合以獲得至少二層疊合層之鍍覆 [4]
- 28/02 . 僅為金屬材料覆層 [4]
- 28/04 . 僅為無機非金屬材料覆層 [4]
- 30/00 僅以金屬材料組成為特徵之金屬材料鍍覆，即不以鍍覆工藝為特徵（26/00、28/00 優先）[4]

C23D 金屬之搪瓷或塗玻璃層~~(瓷釉之化學成分見 C03G)~~**次類索引**

搪瓷前之處理..... 1/00，3/00 後處理..... 13/00，15/00，17/00
 搪瓷.....5/00 至 11/00

1/00 瓷釉之熔化或熱熔；所用的設備或爐子	燒瓷
1/02 • 熔融物之粒化；粒之乾燥	9/00 燒瓷釉專用爐
塗瓷料	9/02 • 非電加熱之馬弗爐 [1,2006.01]
3/00 塗瓷料前金屬表面之化學處理 ~~(金屬工件之清洗與脫脂見 C23G)~~ [1,2006.01]	9/04 • 非電加熱之隧道式窯
5/00 搪瓷或搪玻璃層 [4]	9/06 • 電爐
5/02 • 用濕法	9/08 • 燃燒桿之支撐裝置
5/04 • 用乾法	9/10 • 裝料或卸料裝置
5/06 • 印圖或文字	11/00 燒瓷釉之連續處理；所需設備
5/08 • 表面不均勻地塗敷瓷料	後處理
7/00 塗層處理，例如燒製前之乾燥	13/00 搪瓷件之後處理
	13/02 • 用瓷釉局部再熔化法去除缺陷， 整形
	15/00 用一次搪瓷法將若干搪瓷件與其他搪瓷件同時聯結
	17/00 去除瓷釉

C23F 非機械方法去除表面上之金屬材料（電浸蝕法加工金屬見 B23H；火焰法清除表層金屬材料見 B23K 7/00；用雷射束加工金屬見 B23K 26/00）；**金屬材料之緩蝕；一般防積垢**（藉電解法或電泳法進行金屬表面處理或塗層見 C25D、C25F）；至少一種於 C23 主類內所列的方法及至少一種於 C21D 或 C22F 次類或者 C25 主類內所列的方法之多步法金屬材料表面處理 [4]

附註

- (1) 根據下列附註(2)，本次類包括金屬或非金屬表面或於表面上一般的緩蝕或防止積垢。
- (2) 本次類不包括：
- 保護層或覆層成分或其被覆方法；其分入相應的位置，例如 B05、

B44、C09D、C10M、C23C；

- 特定的緩積垢製品之機械裝置或結構特徵；其分入相應的位置，例如管道或管接頭內者見 F16L 58/00；
- 以選擇所用材料之抗腐蝕性能或抗積垢性能為特徵的製品；其分入相應的位置，例如渦輪葉片見 F01D 5/28。

次類索引

蝕刻，拋光，所用之組合物.....	1/00，3/00	防腐蝕或防垢	11/00 至 15/00
金屬材料之其他去除方法.....	4/00	多步表面處理	17/00

1/00 金屬材料之化學法蝕刻 [2]

- 1/02 · 局部蝕刻
- 1/04 · · 化學銑削
- 1/06 · 使銼刀銳利
- 1/08 · 裝置，如照相印刷製板裝置
- 1/10 · 蝕刻用組合物（1/44 優先）[4]
- 1/12 · · 氣態組合物 [4]
- 1/14 · · 含水組合物 [4]
- 1/16 · · · 酸性組合物（1/42 優先）[4]
- 1/18 · · · · 蝕刻銅或銅合金用者 [4]
- 1/20 · · · · 蝕刻鋁或鋁合金用者 [4]
- 1/22 · · · · 蝕刻鎂或鎂合金用者 [4]
- 1/24 · · · · 蝕刻矽或鍍用者 [4]
- 1/26 · · · · 蝕刻難熔金屬用者 [4]
- 1/28 · · · · 蝕刻鐵族金屬用者 [4]
- 1/30 · · · · 蝕刻其他金屬材料用者[4]
- 1/32 · · · · 鹼性組合（1/42 優先）[4]
- 1/34 · · · · 蝕刻銅或銅合金用者 [4]
- 1/36 · · · · 蝕刻鋁或鋁合金用者 [4]
- 1/38 · · · · 蝕刻難熔金屬用者 [4]
- 1/40 · · · · 蝕刻其他金屬材料用者 [4]
- 1/42 · · · 含有一種與水不互溶的分散相液體者 [4]
- 1/44 · 由一種不同成分之金屬材料基體上蝕刻金屬材料之組合物 [4]
- 1/46 · 蝕刻組合物之再生 [4]

3/00 金屬之化學法光亮處理

- 3/02 · 輕金屬
- 3/03 · · 用酸性溶液者 [4]

3/04 · 重金屬

3/06 · · 用酸性溶液者 [4]

4/00 不包括 1/00 或 3/00 目內之表面除去金屬材料之工藝 [4]

- 4/02 · 蒸發法 [4]
- 4/04 · 物理溶蝕法 [4]

11/00 於有腐蝕危險之表面上施加緩蝕劑或於腐蝕劑內加入緩蝕劑來抑制金屬材料腐蝕

- 11/02 · 於空氣或氣體內添加氣相緩蝕劑
- 11/04 · 於明顯酸性之液體內
- 11/06 · 於明顯鹼性之液體內
- 11/08 · 於其他液體內
- 11/10 · · 用有機的緩蝕劑

附註

11/12 至 11/173 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示時，化合物請放入最後適當位置。

- 11/12 · · · 含氧之化合物
- 11/14 · · · 含氮之化合物
- 11/16 · · · 含硫之化合物
- 11/167 · · · 含磷之化合物 [4]
- 11/173 · · · 高分子化合物 [4]
- 11/18 · · 用無機緩蝕劑

13/00 用陽極或陰極保護法之金屬防

腐蝕

- 13/02 • 陰極；陰極保護之條件，參數或工藝，如電條件之選擇 [5]
- 13/04 • • 所需參數之控制或調節 [5]
- 13/06 • • 陰極保護裝置之結構部件或組件 [5]
- 13/08 • • • 陰極保護之專用緩蝕電極，其製造；電流之導入 [5]
- 13/10 • • • • 以結構為特徵之電極（13/16 優先）[5]
- 13/12 • • • • 以材料為特徵之電極（13/16 優先）[5]
- 13/14 • • • • • 犧牲陽極用之材料 [5]
- 13/16 • • • • 以結構及材料之組合為特徵之電極 [5]
- 13/18 • • • • 電極之支承物 [5]
- 13/20 • • • • 向電極導入電流 [5]
- 13/22 • • • • 所用之檢測裝置 [5]

14/00 於物理或化學用之液體加熱裝置內之防垢（於水中添加預防或去除水垢劑見 C02F 5/00）[2]

14/02 • 用化學法

15/00 防腐蝕或防垢之其他方法

17/00 包括至少一種 C23 主類中所列入的工藝及至少一種 C21D 或 C22F 次類或 C25 主類內所列入的工藝之多步法金屬材料表面處理工藝（用不包括 C23C 2/00 至 C23C 26/00 各主目內單一目之方法抑或用列入 C23C 與 C25D 各次類中方法之組合以獲得至少二層疊合層之鍍覆見 C23C 28/00）
[1,4,2006.01]

C23G 電解法除外的化學法金屬材料清洗或除油

1/00 用溶液或熔融鹽清洗或酸洗金屬材料（用有機溶劑見 5/02）

- 1/02 • 用酸溶液
- 1/04 • • 用緩蝕劑
- 1/06 • • • 有機緩蝕劑
- 1/08 • • 鐵或鋼
- 1/10 • • 其他重金屬
- 1/12 • • 輕金屬
- 1/14 • 用鹼溶液
- 1/16 • • 用緩蝕劑
- 1/18 • • • 有機緩蝕劑
- 1/19 • • 鐵或鋼 [4]
- 1/20 • • 其他重金屬 [4]
- 1/22 • • 輕金屬
- 1/24 • 用中性溶液
- 1/26 • • 用緩蝕劑
- 1/28 • 用熔融鹽
- 1/30 • • 用緩蝕劑
- 1/32 • • 重金屬

1/34 • • 輕金屬

1/36 • 廢酸洗液之再生

3/00 金屬材料清洗或酸洗用之設備（用有機溶劑者見 5/04）

3/02 • 連續清洗線材，帶材，絲材用者

3/04 • 清洗管材

5/00 金屬材料用其他方法清洗或除油；金屬材料用有機溶劑清洗或除油之設備

附註

於 5/02 至 5/06 各目內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明分入最後相應位置。[4]

5/02 • 有用機溶劑

5/024 • • 含有碳氫化合物者 [4]

C23G

- 5/028 • • 含有鹵代烴者 [4]
- 5/032 • • 含有含氧化合物者 [4]
- 5/036 • • • 尚有氮者 [4]
- 5/04 • • 設備
- 5/06 • 使用乳化液者 [4]

C25 電解或電泳工藝；其所用的設備 [4]

附註

- (1) 涉及電解或電泳工藝或設備或操作特性之發明分入
 - (i) 所生產之化合物或製品之各目，及
 - (ii) 包括設備或操作特性之各目。[2]
- (2) 材料之電解法或電泳法純化，按液體之性質分入相應的位置，例如 A01K 63/00、C02F 1/46、C25B 15/08、C25D 21/16、C25F 7/02。[2]
- (3) 包含至少一種於 C23 主類內所列的方法及至少一種於主類內所列的方法之多步法金屬材料表面處理，被分類至 C23F 17/00。[2012.01]

主類索引

電解生產

無機化合物，非金屬 C25B 1/00
 有機化合物 C25B 3/00
 非金屬覆層 C25D 9/00
 金屬 C25C 1/00，C25C 3/00，C25C 5/00
 金屬覆層 C25D 3/00，C25D 5/00，C25D 7/00

同時產生電的化合物

或非金屬之電解生產 C25B 5/00

電泳生產

化合物，非金屬 C25B 7/00
 覆層 C25D 13/00

電鑄 C25D 1/00

陽極氧化，磷化，



鉻酸鹽化處理 C25D 11/00

帶嵌入材料的覆層 C25D 15/00

電解清理、腐蝕或

褪除金屬覆層 C25F 1/00，C25F 5/00

電解浸蝕或拋光 C25F 3/00

電解槽，電極，隔膜

化合物或非金屬之生產 C25B 9/00，C25B 11/00，C25B 13/00，C25B 15/00

金屬之生產 C25C 7/00

覆層之製備

..... C25D 17/00，C25D 19/00，C25D 21/00

清理，腐蝕，表面處理 C25F 7/00

C25B 生產化合物或非金屬之電解工藝或電泳工藝；其所用的設備（陽極或陰極防護見 C23F 13/00；單晶生長見 C30B）[2]

附註[2]

特別重要的化合物尚需分入相關的主類，例如 C01、C07。

1/00 無機化合物或非金屬之電解生產 [2,2006.01,2021.01]

1/01 • 產物 [2021.01]

1/02 • • 氫或氧 [2,2006.01]

1/04 • • • 電解水法 [2,2006.01,2021.01]

1/042 • • • • 通過水蒸氣之電解 [2021.01]

1/044 • • • • 生產混合氫氣與氧氣，例

如：布朗氣體 [HHO]
[2021.01]

1/06 (轉見 1/04、9/70 至 11/02)

1/08 (轉見 1/04、9/70 至 11/02)

1/10 (轉見 1/04、9/70 至 9/77)

1/12 (轉見 1/04、9/05、9/70 至 9/77)

1/13 • • 臭氧 [7,2006.01]

- 1/135 • • 碳 [2021.01]
- 1/14 • • 鹼金屬化合物 [2,2006.01]
- 1/16 • • • 氫氧化物 (鹼金屬氫氧化物與氯、氯之含氧酸或鹽之同時生產見 1/34) [2,2006.01]
- 1/18 • • 鹼土金屬化合物或鎂化合物 [2,2006.01]
- 1/20 • • 氫氧化物 [2]
- 1/21 • • 氧化錳 [7,2006.01]
- 1/22 • • 無機酸 [2,2006.01]
- 1/23 • • 一氧化碳或合成氣 [2021.01]
- 1/24 • • 鹵素或其化合物 [2,2006.01,2021.01]
- 1/245 • • • 氟；其化合物[2021.01]
- 1/26 • • • 氯；其化合物(鹼金屬氫氧化物與氯、氯之含氧酸或鹽之同時生產見 1/34) [2,2006.01]
- 1/27 • • 氨 [2021.01]
- 1/28 • • 過化合物 [2,2006.01,2021.01]
- 1/29 • • • 過硫酸鹽 [2021.01]
- 1/30 • • 過氧化物 [2]
- 1/32 • • 過硼酸鹽 [2]
- 1/33 • • 矽 [2021.01]
- 1/34 • • 鹼金屬氫氧化物與氯、氯之含氧酸或鹽之同時生產，例如：用氯鹼電解法 [2,2006.01]
- 1/36 • • • 汞陰極電解槽中 [2,2006.01,2021.01]
- 1/38 (轉見 1/36)
- 1/40 (轉見 1/36)
- 1/42 • • • 汞齊之分解 [2]
- 1/44 • • • • 借助催化劑者 [2]
- 1/46 • • 於隔膜電解槽內 [2]
- 1/50 • 製程 [2021.01]
- 1/55 • • 光電解法 [2021.01]
- 3/00 有機化合物之電解生產 [2,2006.01,2021.01]**
- 3/01 • 產物 [2021.01]
- 3/02 (轉見 3/23)
- 3/03 • • 無環或碳環烴 [2021.01]
- 3/04 (轉見 3/25)
- 3/05 • • 雜環化合物 [2021.01]
- 3/06 (轉見 3/27 至 3/28)
- 3/07 • • 含氧化合物 [2021.01]
- 3/08 (轉見 3/28)
- 3/09 • • 含氮化合物 [2021.01]
- 3/10 (轉見 3/29)
- 3/11 • • 含鹵素化合物[2021.01]
- 3/12 (轉見 3/13)
- 3/13 • • 有機金屬化合物 [2021.01]
- 3/20 • 製程 [2021.01]
- 3/21 • • 光電解法 [2021.01]
- 3/23 • • 氧化法(鹵化法見 3/27) [2021.01]
- 3/25 • • 還原法 [2021.01]
- 3/26 • • • 二氧化碳的 [2021.01]
- 3/27 • • 鹵化法 [2021.01]
- 3/28 • • • 氟化 [2021.01]
- 3/29 • • 耦合反應 [2021.01]
- 5/00 電發生工藝，即同時發生電流之化合物生產工藝 [2,2006.01]**
- 7/00 化合物或非金屬之電泳法生產 (電泳法分離或精製蛋白質見 C07K 3/14) [2]**
- 9/00 電解槽或電解槽組合；電解槽構造零件；構造零件組合，例如電極—滲透膜組合；與製程相關之電解槽特徵 [2,7,2006.01,2021.01]**
- 9/01 • 以形狀或類型為特徵之電解槽 [2021.01]
- 9/015 • • 圓柱型電解槽 [2021.01]
- 9/02 (轉見 9/60 至 9/63)
- 9/04 (轉見 9/60、9/65)
- 9/05 • 壓力型電解槽 [2021.01]
- 9/06 (轉見 9/17)
- 9/07 • 普通導管型電解槽 [2021.01]
- 9/08 (轉見 9/19)
- 9/09 • 熔融浴電解槽 [2021.01]
- 9/10 (轉見 9/23)
- 9/12 (轉見 9/30、11/02、11/034)
- 9/13 • 具有循環電解液之單一電解槽 [2021.01]
- 9/14 (轉見 11/00 至 11/02、11/033)
- 9/15 • • 流通型電解槽 [2021.01]

- 9/16 (轉見 9/40、11/02、11/037) [2021.01]
- 9/17 • 包含尺寸穩定且不可移動電極之電解槽；其構造零件組合 [2021.01]
- 9/18 (轉見 9/70 至 9/77)
- 9/19 • • 具有隔膜者 [2021.01]
- 9/20 (轉見 9/73 至 9/77)
- 9/21 • • • 二或更多隔膜 [2021.01]
- 9/23 • • • 包括嵌入電極材料之離子交換薄膜 [2021.01]
- 9/30 • 包含可移動電極之電解槽，例如：旋轉電極；其構造零件組合 [2021.01]
- 9/40 • 包含由粒子製成的電極之電解槽或電解槽組合 [2021.01]
- 9/50 • 包含光電極之電解槽或電解槽組合 [2021.01]
- 9/60 • 電解槽構造零件 [2021.01]
- 9/63 • • 電極支座；電極之定位 [2021.01]
- 9/65 • • 供電裝置；電極連接件；槽間電氣連接件 [2021.01]
- 9/67 • • 加熱或冷卻裝置 [2021.01]
- 9/70 • 包含二或多個電解槽組合 [2021.01]
- 9/73 • • 屬過濾擠壓型者 [2021.01]
- 9/75 • • • 具有雙極電極者 [2021.01]
- 9/77 • • • 具有隔膜者 [2021.01]
- 11/00 電極；不包括其他位置之電極製造 [2,2006.01,2021.01]**
- 11/02 • 以形狀或類型為特徵者 [2,2006.01,2021.01]
- 11/03 • • 多孔或有小孔者 [2,2006.01,2021.01]
- 11/031 • • • 多孔電極者 [2021.01]
- 11/032 • • • • 氣體擴散電極 [2021.01]
- 11/033 • • 液體電極 [2021.01]
- 11/034 • • 旋轉電極 [2021.01]
- 11/036 • • 雙極電極 [2021.01]
- 11/037 • • 由粒子製成之電極 [2021.01]
- 11/04 • 以材料為特徵者 [2,2006.01,2021.01]
- 11/042 • • 由單一材料形成之電極 [2021.01]
- 11/043 • • • 碳，例如：金剛石或石墨烯 [2021.01]
- 11/044 • • • • 碳之浸漬 [2021.01]
- 11/045 • • • 汞或汞合金 [2021.01]
- 11/046 • • • 合金 [2021.01]
- 11/047 • • • 陶瓷 [2021.01]
- 11/048 • • • 有機化合物 [2021.01]
- 11/049 • • • 光觸媒 [2021.01]
- 11/051 • • 在基材或載體上由電催化劑形成之電極 [2021.01]
- 11/052 • • • 在基材上包含一或多個電催化塗層之電極 [2021.01]
- 11/053 • • • • 以多層電催化塗層為特徵者 [2021.01]
- 11/054 • • • 包含支撐在載體上的電催化劑之電極 [2021.01]
- 11/055 • • • 以基材或載體材料為特徵者 [2021.01]
- 11/056 • • • • 由織物或非織物組成 [2021.01]
- 11/057 • • • • 由單一元素或化合物組成 [2021.01]
- 11/059 • • • • • 矽 [2021.01]
- 11/06 (轉見 11/04 至 11/059、11/061 至 11/079、11/081 至 11/097)
- 11/061 • • • • • 金屬或合金 [2021.01]
- 11/063 • • • • • 閥金屬，例如：鈦 [2021.01]
- 11/065 • • • • • 碳 [2021.01]
- 11/067 • • • • • 無機化合物，例如：氧化錫銦(ITO)、二氧化矽或二氧化鈦 [2021.01]
- 11/069 • • • • 由至少一個單一元素及至少一個化合物組成；由二或多個化合物組成 [2021.01]
- 11/071 • • • • • 包含金屬或合金粉末及非金屬黏合劑 [2021.01]
- 11/073 • • • 以電催化劑材料為特徵 [2021.01]
- 11/075 • • • • 由單一催化元素或催化化合物組成 [2021.01]

- 11/077 該化合物是非貴金屬氧化物 [2021.01]
- 11/079 二氧化錳；二氧化鉛 [2021.01]
- 11/08 (轉見 11/051、11/073 至 11/075、11/081)
- 11/081 該元素是一貴金屬 [2021.01]
- 11/083 金剛石 [2021.01]
- 11/085 有機化合物 [2021.01]
- 11/087 光催化化合物 [2021.01]
- 11/089 合金 [2021.01]
- 11/091 由至少一催化元素及至少一催化化合物組成；由二或多個催化元素或催化化合物組成 [2021.01]
- 11/093 至少一貴金屬或貴金屬氧化物及至少一非貴金屬氧化物 [2021.01]
- 11/095 至少一化合物為有機的 [2021.01]
- 11/097 包含二或多個貴金屬或貴金屬合金 [2021.01]
- 11/10 (轉見 11/04、11/051、11/055、11/057、11/061 至 11/063)
- 11/12 (轉見 11/04、11/051、11/055、11/057、11/065)
- 11/14 (轉見 11/04、11/043 至 11/044)
- 11/16 (轉見 11/04、11/051、11/073 至 11/079)

11/18 (轉見 11/04、11/045)

13/00 隔膜；間隔元件 [4]

- 13/02 . . . 以形狀或類型為特徵者 [2,2006.01]
- 13/04 . . . 以材料為特徵者 [2,2006.01,2021.01]
- 13/05 . . . 以無機化合物為基料者 [2021.01]
- 13/06 . . . 以石棉為基料者 [2006.01]
- 13/07 . . . 以陶瓷為基料者 [2021.01]
- 13/08 . . . 以有機材料為基料者 [2006.01]

15/00 電解槽操作或維護 [2,2006.01]

- 15/02 . . . 工藝控制或調節 [2,2006.01,2021.01]
- 15/021 . . . 加熱或冷卻 [2021.01]
- 15/023 . . . 在電解生產過程中的測量、分析或測試 [2021.01]
- 15/025 . . . 電解液參數 [2021.01]
- 15/027 . . . 溫度 [2021.01]
- 15/029 . . . 濃度 [2021.01]
- 15/031 . . . pH 值 [2021.01]
- 15/033 . . . 電導率 [2021.01]
- 15/04 . . . 電極間距離之調節 [2]
- 15/06 . . . 電解槽內短路之監測或防止 [2,2006.01]
- 15/08 . . . 反應物或電解液之供給或移除；電解液之再生 [2]

C25C 電解法生產、回收或精煉金屬之工藝；其所用的設備（陽極或陰極防護見 C23F 13/00；單晶生長見 C30B）[2]

- 1/00 由溶液電解法電解生產、回收或精煉金屬（5/00 優先）[2]
- 1/02 . . . 輕金屬者 [2]
- 1/04 . . . 汞陰極電解槽內 [2]
- 1/06 . . . 鐵族金屬、難熔金屬或錳者 [2]
- 1/08 . . . 鎳或鈷者 [2]
- 1/10 . . . 鉻或錳者 [2]
- 1/12 . . . 銅者 [2]
- 1/14 . . . 錫者 [2]
- 1/16 . . . 鋅、鎘或汞者 [2]

- 1/18 . . . 鉛者 [2]
- 1/20 . . . 貴金屬者 [2]
- 1/22 . . . 不包括 1/02 至 1/20 各目之金屬者 [2]
- 1/24 . . . 陰極還原其全部離子所製得的合金 [2]
- 3/00 由熔融液電解法電解生產、回收或精煉金屬（5/00 優先）[2]
- 3/02 . . . 鹼金屬或鹼土金屬者 [2]
- 3/04 . . . 鎂者 [2]

- 3/06 • 鋁者 [2]
- 3/08 • • 電解槽之結構，例如底、壁、
陰極 [2]
- 3/10 • • • 外部支架或結構 [2]
- 3/12 • • • 陽極 [2]
- 3/14 • • 供料裝置或殼破碎裝置 [2]
- 3/16 • • 電流供給裝置，例如匯流排[2]
- 3/18 • • 電解流 [2]
- 3/20 • • 電解槽之自動控制或調節（控
制或調節本身見 G05）[2]
- 3/22 • • 析出氣體之收集 [2]
- 3/24 • • 精煉 [2]
- 3/26 • 鈦、鋯、鉛、鉍、或釩者 [2]
- 3/28 • • 鈦者 [2]
- 3/30 • 錳者 [2]
- 3/32 • 鉻者 [2]
- 3/34 • 不包括 3/02 至 3/32 各目之金屬
者 [2]
- 3/36 • 陰極還原其全部離子所製得的合
金 [2]
- 5/00 金屬粉末或多孔金屬體之電解
生產、回收或精煉 [2]**
- 5/02 • 自溶液 [2]
- 5/04 • 自熔融液 [2]
- 7/00 電解槽之結構部件，或其組合
件；電解槽之維護或操作（生產
鋁者見 3/06 至 3/22）[2]**
- 7/02 • 電極（金屬精煉用之自耗陽極見
1/00 至 5/00）；電極之連接件 [2]
- 7/04 • 隔膜；間隔元件 [2]
- 7/06 • 操作或維護 [2]
- 7/08 • • 沉積金屬於陰極上分離 [2]

C25D 覆層之電解或電泳生產之工藝方法；電鑄（以金屬沈積法製造印刷電路見 H05K 3/18）；**以電解法聯接工件；其所用裝置**（陽極或陰極防護見 C23F 13/00；單晶生長見 C30B） [2,6]

附註

用本次類內及 C23C 次類內所包含方法之組合獲得至少二層疊合層之鍍覆，被分類至 C23C 28/00

1/00 電鑄 [2]	特徵者 [2]
1/02 • 管；環；中空體 [2]	3/34 • • 鉛者 [2]
1/04 • 絲；帶；箔 [2]	3/36 • • • 以所用鍍液的有機組成分為
1/06 • 全金屬鏡 [2]	特徵者 [2]
1/08 • 多孔製品或小孔製品，例如篩網	3/38 • • 銅者 [2]
（1/10 優先） [2]	3/40 • • • 自氰化物鍍液 [2]
1/10 • 模具；掩蔽物；主型腔 [2]	3/42 • • 輕金屬者 [2]
1/12 • 利用電泳法 [2]	3/44 • • • 鋁 [2]
1/14 • • 無機材料者 [2]	3/46 • • 銀者 [2]
1/16 • • • 金屬 [2]	3/48 • • 金者 [2]
1/18 • • 有機材料者 [2]	3/50 • • 鉑族金屬者 [2]
1/20 • 鑄件與電極之分離 [2]	3/52 • • • 以所用鍍液的有機組成分為
1/22 • • 分離用之化合物 [2]	特徵者 [2]
2/00 利用電解法聯接工件 [6]	3/54 • • 不包括 3/04 至 3/50 各目之金屬者 [2]
3/00 電鍍；其所用的鍍液 [2]	3/56 • • 合金者 [2]
3/02 • 自溶液（5/24 至 5/32 優先） [2]	3/58 • • • 含銅重量超過 50%者 [2]
3/04 • • 鉻者 [2]	3/60 • • • 含錫重量超過 50%者 [2]
3/06 • • • 自三價鉻溶液 [2]	3/62 • • • 含金重量超過 50%者 [2]
3/08 • • • 黑鉻之沈積 [2]	3/64 • • • 含銀重量超過 50%者 [2]
3/10 • • • 以所用鍍液的有機組成分為	3/66 • 自熔融液 [2]
特徵者 [2]	5/00 以工藝方法為特徵之電鍍；工件
3/12 • • 鎳或鈷者 [2]	之預處理或後處理 [2]
3/14 • • • 自含有炔屬化合物或雜環化	5/02 • 局部表面上之電鍍 [2]
合物之鍍液 [2]	5/04 • 用移動電極電鍍 [2]
3/16 • • • • 炔屬化合物 [2]	5/06 • • 刷鍍或補鍍 [2]
3/18 • • • • 雜環化合物 [2]	5/08 • 用流動電解液之電鍍，例如噴射
3/20 • • 鐵者 [2]	電鍍 [2]
3/22 • • 鋅者 [2]	5/10 • 一層以上相同金屬或不同金屬之
3/24 • • • 自氰化物鍍液 [2]	電鍍（用於軸承者見 7/10） [2]
3/26 • • 鎳者 [2]	5/12 • • 至少有一層為鎳或鉻 [2]
3/28 • • • 自氰化物鍍液 [2]	5/14 • • • 二層或二層以上為鎳或鉻，
3/30 • • 錫者 [2]	例如二層或三層 [2]
3/32 • • • 以所用鍍液的有機組成分為	5/16 • 不同鍍層厚度之電鍍 [2]

- 5/18 • 使用調製電流、脈衝電流或換向電流之電鍍 [2]
- 5/20 • 使用超音波之電鍍 [2]
- 5/22 • 沈積過程結合機械處理之電鍍 [2]
- 5/24 • 難以施鍍之金屬表面上的電鍍 (5/34 優先) [2]
- 5/26 • • 鐵或鋼表面者 [2]
- 5/28 • • 難熔金屬表面者 [2]
- 5/30 • • 輕金屬表面者 [2]
- 5/32 • • 鋼系金屬表面者 [2]
- 5/34 • 施鍍金屬表面的預處理 [2]
- 5/36 • • 鐵或鋼者 [2]
- 5/38 • • 難熔金屬或鎳者 [2]
- 5/40 • • • 鎳；鉻 [2]
- 5/42 • • 輕金屬者 [2]
- 5/44 • • • 鋁 [2]
- 5/46 • • 鋼系金屬者 [2]
- 5/48 • 電鍍表面之後處理 [2]
- 5/50 • • 熱處理 [2]
- 5/52 • • 出光或拋光 [2]
- 5/54 • 非金屬表面之電鍍(7/12 優先) [2]
- 5/56 • • 塑膠者 [2]
- 7/00 以施鍍製品為特徵之電鍍 [2]**
- 7/02 • 拉鏈 [2]
- 7/04 • 管；環；中空體 [2]
- 7/06 • 絲；帶；箔 [2]
- 7/08 • 鏡子；反射鏡 [2]
- 7/10 • 軸承 [2]
- 7/12 • 半導體 [2]
- 9/00 非金屬電鍍層 (11/00、15/00 優先；電泳覆層見 13/00) [2]**
- 9/02 • 有機材料者 [2]
- 9/04 • 無機材料者 [2]
- 9/06 • • 用陽極工藝方法 [2]
- 9/08 • • 用陰極工藝方法 [2]
- 9/10 • • • 鐵或鋼上 [2]
- 9/12 • • • 輕金屬上 [2]
- 11/00 表面反應，即形成轉化層之電解覆層 [2]**
- 11/02 • 陽極氧化 [2]
- 11/04 • • 鋁或以其為基之合金者 [2]
- 11/06 • • • 以所用電解液為特徵者 [2]
- 11/08 • • • • 含無機酸者 [2]
- 11/10 • • • • 含有機酸者 [2]
- 11/12 • • • 一次以上之陽極氧化，例如於不同之槽液內 [2]
- 11/14 • • • 整體著色層之生產 [2]
- 11/16 • • • 預處理 [2]
- 11/18 • • • 後處理，例如封孔處理 [2]
- 11/20 • • • • 電解法後處理 [2]
- 11/22 • • • • • 製作著色層者 [2]
- 11/24 • • • • 化學法後處理 [2]
- 11/26 • • 難熔金屬或以其為基之合金者 [2]
- 11/28 • • 鋼系金屬或以其為基之合金者 [2]
- 11/30 • • 鎂或以其為基之合金者 [2]
- 11/32 • • 半導體材料者 [2]
- 11/34 • • 不包括 11/04 至 11/32 各目之金屬或合金者 [2]
- 11/36 • 磷化 [2]
- 11/38 • 鉻酸鹽處理 [2]
- 13/00 以製程為特徵的電泳鍍覆 (15/00 優先；電泳鍍覆用之組合物見 C09D 5/44) [2]**
- 13/02 • 無機材料者 [2]
- 13/04 • 有機材料者 [2]
- 13/06 • • 聚合物 [2]
- 13/08 • • • 單體材料當場聚合 [2]
- 13/10 • 以所用添加劑為特徵者 [2]
- 13/12 • 以施鍍製品為特徵者 [2]
- 13/14 • • 管；環；中空體 [2]
- 13/16 • • 絲；帶；箔 [2]
- 13/18 • 使用調製電流、脈衝電流或換向電流者 [2]
- 13/20 • 預處理 [2]
- 13/22 • 維護或操作 [2]
- 13/24 • • 處理液之再生 [2]
- 15/00 含嵌入材料，例如顆粒、鬚、絲之覆層的電解或電泳生產 [2]**
- 15/02 • 電解與電泳相結合之工藝方法

[2]		19/00 電解鍍覆之成套設備 [2]	
17/00	電解鍍覆用電解槽之結構件、或其組合件 [2]	21/00	電解鍍覆用電解槽之維護或操作方法 [2]
17/02	• 鍍槽；鍍槽之安裝 [2]	21/02	• 加熱或冷卻 [2]
17/04	• • 外部支架或結構 [2]	21/04	• 氣體或氯化物之驅除 [2]
17/06	• 施鍍製品之懸掛或支承裝置 [2]	21/06	• 過濾 [2]
17/08	• • 掛具 [2]	21/08	• 漂洗 [2]
17/10	• 電極 [2]	21/10	• 電解液之攪拌；掛具之移動 [2]
17/12	• • 形狀或類型（17/14 優先）[2]	21/11	• 電解槽表面保護層之使用 [2]
17/14	• • 補鍍用者 [2]	21/12	• 工藝控制或調節 [2]
17/16	• 零散小件電鍍用之裝置 [2]	21/14	• • 電解液組成分之控制添加 [2]
17/18	• • 有閉合容器者 [2]	21/16	• 處理液之再生 [2]
17/20	• • • 水平滾桶 [2]	21/18	• • 電解液者（21/22 優先）[2]
17/22	• • 有開口容器者 [2]	21/20	• • 漂洗液者（21/22 優先）[2]
17/24	• • • 斜式滾桶 [2]	21/22	• • 離子交換法 [2]
17/26	• • • 振動籃 [2]		
17/28	• • 帶有將工作於處理過程中單個地送入設備之裝置者 [2]		

C25F 電解法除去物體上材料之方法；其所用的設備（水、廢水或污水之電化學處理見 C02F 1/46；陽極或陰極防護見 C23F 13/00）[2]

附註

本次類內，適用末位規則，即在各階層中，若無相反指示，發明請放入最後適當位置。[2]

1/00	電解法清理、除油、強浸蝕或除氧化皮 [2]	3/10	• • 銅系金屬者 [2]
1/02	• 強浸蝕；除氧化皮 [2]	3/12	• • 半導體材料者 [2]
1/04	• • 於溶液內 [2]	3/14	• • 局部者 [2]
1/06	• • • 鐵或銅者 [2]	3/16	• 拋光者 [2]
1/08	• • • 難熔金屬者 [2]	3/18	• • 輕金屬者 [2]
1/10	• • • 銅系金屬者 [2]	3/20	• • • 鋁者 [2]
1/12	• • 於熔融液內 [2]	3/22	• • 重金屬者 [2]
1/14	• • • 鐵或銅者 [2]	3/24	• • • 鐵或銅者 [2]
1/16	• • • 難熔金屬者 [2]	3/26	• • • 難熔金屬者 [2]
1/18	• • • 銅系金屬者 [2]	3/28	• • • 銅系金屬者 [2]
3/00	電解浸蝕或拋光	3/30	• • 半導體材料者 [2]
3/02	• 浸蝕 [2]	5/00	金屬層或金屬覆層之電解褪除 [2]
3/04	• • 輕金屬者 [2]	7/00	由物體上電解去除材料用電解槽之構件，或其組合件（用於電鍍及
3/06	• • 鐵或銅者 [2]		
3/08	• • 難熔金屬者 [2]		

褪鍍者見 C25D 17/00)；**維護或操作[2]**

7/02 • 處理液之再生 **[2]**

C30 晶體生長 [3]

C30B 晶體生長（用超高壓者，例如用於金剛石形成者見 B01J 3/06）；**共晶材料之定向凝固或共析材料之定向分層**；**材料之區熔精煉**（金屬或合金之區熔精煉見 C22B）；**具有一定結構的均勻多晶材料之製備**（金屬鑄造，其他物質按同樣工藝或裝置之鑄造見 B22D；塑膠之加工見 B29；改變金屬或合金之物理結構見 C21D、C22F）；**單晶或具有一定結構之均勻多晶材料**；**單晶或具有一定結構之均勻多晶材料之後處理**（用於半導體裝置或元件生產者見 H01L，H10）；**其所用的裝置** [3]

附註[3,5,2012.01]

(1) 本次類中，下列詞匯按指定的含意使用：

- “單晶”亦包括孿晶及單晶占支配地位之產品； [3]
- “均勻多晶材料”係指具有晶體顆粒之材料，所有顆粒具有同樣的化學組成分； [5]
- “一定的結構”係指含有晶粒材料之結構，其中晶粒按最佳方式定向排列，或晶粒尺寸大於常規方法獲得的晶粒尺寸。[5]

(2) 本次類中

- 發明涉及製備特定材料或特定形狀之單晶或具有一定結構之均勻多晶材料，分入該工藝方法目及 29/00 目；
- 特定工藝方法專用之裝置，分入該工藝方法之相應目。用一種以上工藝方法之裝置，分入 35/00 目。

次類索引

單晶生長	多晶材料之製備	28/00，30/00
自固體或凝膠.....1/00，3/00，5/00	單晶或具有一定結構之均勻	
自液體.....7/00 至 21/00，27/00	多晶材料.....	29/00
自氣化物.....23/00，25/00	後處理.....	31/00，33/00
具有一定結構之均勻	裝置	35/00

自固體或凝膠之單晶生長 [3]

1/00 直接自固體之單晶生長（共析材料之定向分層者見 3/00；於保護流體下者見 27/00）[3]

1/02 • 熱處理法，例如應變退火（1/12 優先）[3]

1/04 • • 等溫度重結晶 [3]

1/06 • • 溫度梯度下之重結晶 [3]

1/08 • • • 區熔重結晶 [3]

1/10 • 固相反應法或多相擴散法 [3]

1/12 • 生長期間之壓力處理法 [3]

3/00 共析材料之定向分層 [3]

5/00 自凝膠之單相生長（在保護流體下者見 27/00）[3]

5/02 • 添加摻雜材料者 [3]

自液體的單晶生長；共晶材料的定向凝固 [3]

7/00 自常溫液態溶劑之溶液，例如水溶液之單晶生長（自熔融溶劑者見 9/00；用正常凝固法或溫度梯度凝固法者見 11/00；於保護流體下者見 27/00）[3]

- 7/02 • 溶劑蒸發法 [3]
- 7/04 • • 用水溶劑者 [3]
- 7/06 • • 用非水溶劑者 [3]
- 7/08 • 溶液冷卻法 [3]
- 7/10 • 加壓法，例如水熱法 [3]
- 7/12 • 電解法 [3]
- 7/14 • 由溶液中之化學反應生成的結晶化材料

9/00 自使用熔融態溶劑之熔體的單晶生長（用正常凝固法或溫度梯度凝固法者見 11/00；用區域熔融法者見 13/00；晶體提拉法見 15/00；於浸入的晶種上者見 17/00；液相外延生長法見 19/00；於保護流體下者見 27/00）[3]

- 9/02 • 熔融態溶劑之蒸發法 [3]
- 9/04 • 熔融溶液冷卻法 [3]
- 9/06 • • 使用晶體組成之一種組成分作溶劑者 [3]
- 9/08 • • 使用其他溶劑者 [3]
- 9/10 • • • 金屬溶劑 [3]
- 9/12 • • • 鹽溶劑，例如助熔劑生長
- 9/14 • 電解法

11/00 正常凝固法或溫度梯度凝固法之單晶生長，例如

Bridgman-Stockbarger 法

（13/00、15/00、17/00、19/00 優先；於保護流體下者見 27/00）[3]

- 11/02 • 不使用溶劑者（11/06 優先）[3]
- 11/04 • 熔體中添加結晶化材料或添加於反應過程中就地生長結晶化材料之反應物者 [3]

11/06 • • 至少有一種但非全部晶體成分之組成分係添加者 [3]

11/08 • • 晶體成分之所有組成分均係在結晶化過程添加者 [3]

11/10 • • • 固態組成分或液態組成分，例如焰熔法 [3]

11/12 • • • 氣化態組成分，例如氣化相-液相-固相生長 [3]

11/14 • 以種晶，例如其結晶取向為特徵者 [3]

13/00 區域熔融法單晶生長；區域熔融法精煉（17/00 優先；改變所處理固體之橫截面者見 15/00；在保護流體下者見 27/00；具有一定結構之均勻多晶材料的生長見 28/00）

[3,5,2006.01]

13/02 • 用溶劑之區域熔化，例如移動溶劑法 [3]

13/04 • 區熔勻化法之均質化 [3]

13/06 • 不遍及整個橫截面之熔融區 [3]

13/08 • 熔融區中添加結晶化材料或添加在反應過程中就地形成結晶化材料之反應物者 [3]

13/10 • • 同時添加摻雜材料者 [3]

13/12 • • • 以氣態或氣化態者 [3]

13/14 • 坩堝或舟皿 [3]

13/16 • 熔融區之加熱 [3]

13/18 • • 接觸或浸入熔融區域之加熱元件 [3]

13/20 • • 感應法，例如熱線式法（13/18 優先）[3]

13/22 • • 輻照法或放電法 [3]

13/24 • • • 使用電磁波者 [3]

13/26 • 熔融區之攪拌 [3]

13/28 • 控制或調節 [3]

13/30 • • 熔融區之穩定化或形狀控制，例如用濃縮器者，用電磁場者；控制晶體截面者 [3]

13/32 • 移動裝料或加熱器用之機構 [3]

13/34 • 以種晶，例如以其結晶取向為特徵者 [3]

15/00 熔融液提拉法之單晶生長，例如 Czochralski 法（於保護流體下者見 27/00） [3]

- 15/02 • 熔融液中添加結晶化材料或添加反應過程中就地形成結晶材料之反應物者 [3]
- 15/04 • • 添加摻雜材料，例如用於 n-p 結者 [3]
- 15/06 • 非垂直提拉 [3]
- 15/08 • 下拉 [3]
- 15/10 • 承載熔融液之坩堝或容器 [3]
- 15/12 • • 雙坩堝法 [3]
- 15/14 • 熔融液或已結晶化材料之加熱 [3]
- 15/16 • • 輻照法及放電法 [3]
- 15/18 • • 除其他加熱方法以外用直接電阻加熱法，例如使用 Peltier 加熱者 [3]
- 15/20 • 控制或調節（一般之控制或調節見 G05） [3]
- 15/22 • • 被拉晶體附近熔融區之穩定化或形狀控制；晶體截面之控制 [3]
- 15/24 • • • 使用機械裝置，例如成形導模者（邊緣限制熔膜供料之晶體生長用之成形模見 15/34） [3]
- 15/26 • • • 使用電視攝像機者；使用光檢測器或 X 射線檢測器者 [3]
- 15/28 • • • 利用晶體或熔體重量變化者；例如浮稱法 [3]
- 15/30 • 轉動或移動熔體或晶體之機構（浮稱法見 15/28） [3]
- 15/32 • 種晶夾持器，例如種晶夾頭 [3]
- 15/34 • 使用成形膜或縫隙之邊緣限制熔膜供料之晶體生長 [3]
- 15/36 • 以種晶，例如其結晶取向為特徵者 [3]

17/00 生長期間種晶保留於熔融液內之單晶生長，例如

Necken-Kyropoulos 法（15/00 優先）

19/00 液相外延層生長 [3]

- 19/02 • 使用熔融態溶劑，如助熔劑者 [3]
- 19/04 • • 晶體組成分之一係溶劑者 [3]
- 19/06 • 反應室；承載熔融液之舟皿；襯底夾持器 [3]
- 19/08 • 反應室或襯底之加熱 [3]
- 19/10 • 控制或調節（一般之控制或調節見 G05） [3]
- 19/12 • 以襯底為特徵者 [3]

21/00 共晶材料之定向凝固 [3]

- 21/02 • 正常澆鑄法或溫度梯度凝固法者 [3]
- 21/04 • 區域熔融法者 [3]
- 21/06 • 自熔融液之提拉法 [3]

自氣化物之單晶生長 [3]

23/00 冷凝氣化物或材料揮發法之單晶生長 [3]

- 23/02 • 外延層生長 [3]
- 23/04 • • 圖案沉積，如使用光罩者 [3]
- 23/06 • • 沉積室、襯底或欲蒸發材料之加熱 [3]
- 23/08 • • 電離氣化物之冷凝法（用反應濺射法者見 25/06） [3]

25/00 反應氣體化學反應法之單晶生長，例如化學氣相沉積生長 [3]

- 25/02 • 外延層生長 [3]
- 25/04 • • 圖案沉積，例如使用光罩者 [3]
- 25/06 • • 反應濺射法者 [3]
- 25/08 • • 反應室；其所用材料之選擇 [3]
- 25/10 • • 反應室或襯底之加熱 [3]
- 25/12 • • 襯底夾持器或基座 [3]
- 25/14 • • 氣體供給或排出用之裝置；反應氣流之變換 [3]
- 25/16 • • 控制或調節（一般的控制或調節見 G05） [3]
- 25/18 • • 以襯底為特徵者 [3]
- 25/20 • • • 與外延層材料相同之襯底 [3]

25/22 · · 夾層之工藝方法 [3]

27/00 保護流體下之單晶生長 [3]

27/02 · 自熔融液之提拉法 [3]

28/00 製備具有一定結構之均勻多晶材料 [5]

28/02 · 由固態直接製備 [5]

28/04 · 由液態製備 [5]

28/06 · · 正常凝固法或溫度梯度凝固法 [5]

28/08 · · 區熔法 [5]

28/10 · · 自熔體之提拉法 [5]

28/12 · 由氣態直接製備 [5]

28/14 · · 用反應氣體進行化學反應法[5]

29/00 以材料或形狀為特徵的單晶或具有一定結構之均勻多晶材料 [3,5]

附註 [3,2010.01]

(1) 29/02 至 29/54 各目內，適用末位規則，即在各階層內，若無相反指示，材料請分類放入最後適當位置。

(2) 注意 C 類標題下之附註(3)，該附註用來說明國際分類表所使用之化學元素週期表版次。在本目中，採用的週期系是週期表下羅馬數字所指的 8 族系。

29/02 · 元素 [3]

29/04 · · 金剛石 [3]

29/06 · · 矽 [3]

29/08 · · 鍺 [3]

29/10 · 無機化合物或組合物 [3]

29/12 · · 鹵化物 [3]

29/14 · · 磷酸鹽 [3]

29/16 · · 氧化物 [3]

29/18 · · · 石英 [3]

29/20 · · · 氧化鋁 [3]

29/22 · · · 複合氧化物 [3]

29/24 · · · · 分子式為 $A\text{MeO}_3$ 者，其中

A 為稀土金屬，Me 為 Fe、Ga、Sc、Cr、Co、或 Al，例如正鐵氧體 [3]

29/26 · · · · 分子式為 $B\text{Me}_2\text{O}_4$ 者，其中 B 為 Mg、Ni、Co、Al、Zn 或 Cd，Me 為 Fe、Ga、Sc、Cr、Co 或 Al [3]

29/28 · · · · 分子式為 $A_3\text{Me}_5\text{O}_{12}$ 者，其中 A 為稀土金屬、Me 為 Fe、Ga、Sc、Cr、Co 或 Al，例如石榴石 [3]

29/30 · · · · 鉬酸鹽；釩酸鹽；鉭酸鹽 [3]

29/32 · · · · 鈦酸鹽；鎢酸鹽；鉍酸鹽；鎢酸鹽 [3]

29/34 · · 矽酸鹽 [3]

29/36 · · 碳化物 [3]

29/38 · · 氮化物 [3]

29/40 · · $A_{III}B_V$ 化合物 [3]

29/42 · · · 砷化鎵 [3]

29/44 · · · 磷化鎵 [3]

29/46 · · 含硫、硒或碲之化合物 [3]

29/48 · · · $A_{II}B_{VI}$ 化合物 [3]

29/50 · · · · 硫化鎢 [3]

29/52 · · 合金 [3]

29/54 · 有機化合物 [3]

29/56 · · 酒石酸鹽 [3]

29/58 · · 高分子化合物 [3]

29/60 · 以形狀為特徵者 [3]

29/62 · · 晶鬚或針狀結晶 [3]

29/64 · · 平面晶體，例如板狀，窄條狀或圓盤狀晶體 [5]

29/66 · · 幾何形狀複雜之晶體，例如管狀，圓筒狀之晶體 [5]

29/68 · · 具有疊層結構之晶體，例如“超晶格晶體” [5]

30/00 利用電場，磁場，波能或其他特定物理條件之作用為特徵以製備單晶或具有一定結構的均勻多晶材料 [5]

附註

分入 30/00 目內之發明亦可分入
依工藝方法製備的相應目 1/00
至 28/00) [5]

的專用裝置 [3,5]

- 30/02 • 用電場者，例如電解法 [5]
- 30/04 • 用磁場者 [5]
- 30/06 • 用機械振盪者 [5]
- 30/08 • 在微重力或零重力條件下者 [5]

**單晶或具有一定結構之均勻多晶材
料的後處理 [3,5]**

**31/00 單晶或具有一定結構之均勻多
晶材料之擴散或摻雜工藝；其所
用裝置 [3,5]**

- 31/02 • 用固態擴散材料接觸者 [3]
- 31/04 • 同液態擴散材料接觸者 [3]
- 31/06 • 同氣態擴散材料接觸者
[3,2006.01]
- 31/08 • • 擴散材料為被擴散元素之化合
物者 [3]
- 31/10 • • 反應室；其所用材料之選擇 [3]
- 31/12 • • 反應室之加熱 [3]
- 31/14 • • 襯底夾持器或基座 [3]
- 31/16 • • 氣體供給或排出之裝置；氣流
之變換 [3]
- 31/18 • • 控制或調節 [3]
- 31/20 • 電磁波輻照或粒子輻射法之摻雜
[3]
- 31/22 • • 離子注入法者 [3]

**33/00 單晶或具有一定結構的均勻多
晶材料之後處理（31/00 優先）
[3,5]**

- 33/02 • 熱處理（33/04，33/06 優先）[5]
- 33/04 • 用電場或磁場粒子輻射者 [5]
- 33/06 • 晶體之接合 [5]
- 33/08 • 蝕刻[5]
- 33/10 • • 於溶液或熔體內者 [5]
- 33/12 • • 於氣體氣氛或電漿下者 [5]

**35/00 單晶或具有一定結構的均勻多
晶材料之生長、製備、或後處理**

次 部：組合技術

C40 組合技術 [8]

C40B 組合化學；化合物庫，如化學庫(核酸、蛋白質或肽於電腦模擬的組合庫見 G16B 35/00；電腦模擬組合化學見 G16C 20/60) [2006.01]

附註[2006.01]

- (1) 本次類中，採用“首位規則”，即在每一個階層結構中，若無相反指示，應分類至第一個適當位置。
- (2) 當分類至本次類時，化學庫中的化合物根據“馬庫西”型分子式的分類規則（見指南第 100 至 101 段）也分類至國際專利分類表中其他適當位置上（例如 C 部）。

10/00 高分子的定向分子展開，例如 RNA、DNA 或蛋白質 [8]**20/00 專門適用於識別庫成員的方法 [8]**

20/02 • 利用其在載體或培養基上固定的物理位置來識別庫中成員 [8]

20/04 • 利用與庫中成員相關聯的標籤、標記或其他可讀或可檢測的實體（如解碼方法）來識別庫中成員 [8]

20/06 • 使用重複解碼技術 [8]

20/08 • 使用物理方法直接分析庫中成員本身，如光譜法 [8]

30/00 篩選化合物庫的方法 [8]

30/02 (轉見 G16B 35/00、G16B 35/20、G16C 20/60、G16C 20/64)

30/04 • 利用測定對靶分子特殊結合能力，例如抗體－抗原結合、受體－配體結合能力 [8]

30/06 • 利用測量對活體、組織或細胞的作用 [8]

30/08 • 利用測定催化活性 [8]

30/10 • 利用測定物理性質，例如質量 [8]

40/00 庫本身，例如陣列、混合物 [8]

40/02 • 包含在微生物中或由微生物表現的化合物庫，例如細菌或動物細胞；包含在載體中或由載體表現的化合物庫，例如質體；僅含微生物或載體的化合物庫 [8]

40/04 • 僅含有機化合物的化合物庫 [8]

附註

含有機化合物的鹽的化合物庫
分類至含母體化合物的庫的各目中

40/06 • • 含核苷酸或多核苷酸，或其衍生物的化合物庫 [8]

40/08 • • • 含有編碼蛋白的 RNA 或 DNA 的化合物庫，例如基因庫 [8]

40/10 • • 含肽或多肽，或其衍生物的化合物庫 [8]

40/12 • • 含糖或多糖，或其衍生物的化合物庫 [8]

40/14 • • 含高分子化合物且 40/06 至 40/12 各目中不包含的化合物庫 [8]

40/16 • • 含金屬有機化合物的化合物庫 [8]

40/18 • 僅含無機化合物或無機材料的化合物庫 [8]

50/00 建立化合物庫的方法，例如組合合成 [8]

50/02 (轉見 G16B 35/00 - G16B 35/10, G16C 20/60 - G16C 20/62)

50/04 • 使用動態組合化學技術 [8]

50/06 • 生物化學方法，例如使用酶或全活微生物 [8]

50/08 • 液相合成法，即在建庫期間所有化合物庫建構區塊都在液相或呈溶液狀態；從液相載體中分裂的特定方法 [8]

50/10 • • 涉及編碼步驟的 [8]

50/12 • • 使用附屬於液相載體的特定方法 [8]

50/14 • 固相合成法，即在建庫期間一個或多個化合物庫建構區塊與固相載體結合；從固相載體中分裂的特定方法 [8]

50/16 • • 涉及編碼步驟的 [8]

50/18 • • 使用附屬於固相載體的特定方法 [8]

60/00 專門適用於組合化學或化合物庫的裝置 [8]

60/02 • 專門適用於建立化合物庫、篩選化合物庫和鑑別庫成員的整合裝置 [8]

60/04 • 專門適用於篩選化合物庫和鑑別庫成員二者的整合裝置 [8]

60/06 • 專門適用於建立化合物庫和鑑別庫成員二者的整合裝置 [8]

60/08 • 專門適用於建立化合物庫和篩選化合物庫二者的整合裝置 [8]

60/10 • 用於鑑別庫成員 [8]

C40B

60/12 • 用於篩選化合物庫 [8]

60/14 • 用於建立化合物庫 [8]

70/00 專門適用於組合化學或化合物庫的標籤或標記，例如螢光標記或條碼 [8]

80/00 專門適用於組合化學或化合物庫的連接體或間隔物，例如無痕連接體或保險連接體 [8]

99/00 本次類各目中不包括的技術主題 [8]

C99 本部其他類目中不包括的技術主題 [8]**C99Z 本部其他類目中不包括的技術主題 [8]****附註**

本次類包括的技術主題是：[8]

(a) 本部中的各個次類所不包括的技術主題，但與其最密切相關的，和 [8]

(b) 明確不被其他部的任何次類所包含的技術主題。[8]

99/00 本部其他類目中不包括的技術主題 [8]